

Automation PC 810 mit GM45 CPU Board

Anwenderhandbuch

Version: **1.26 (Dezember 2012)**

Best. Nr.: **MAAPC800A-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines.....	13
1 Handbuchhistorie.....	13
2 Sicherheitshinweise.....	15
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	15
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	15
2.2.1 Verpackung.....	15
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung.....	15
2.3 Vorschriften und Maßnahmen.....	15
2.4 Transport und Lagerung.....	16
2.5 Montage.....	16
2.6 Betrieb.....	16
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile.....	16
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase.....	16
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme.....	17
2.7 Umweltgerechte Entsorgung.....	17
2.7.1 Werkstofftrennung.....	17
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen.....	18
4 Richtlinien.....	18
5 Übersicht.....	19
Kapitel 2 Technische Daten.....	22
1 Einleitung.....	22
1.1 Features.....	23
1.2 Aufbau / Konfiguration.....	23
1.3 Konfiguration - Grundsystem.....	24
1.4 Konfiguration - optionale Komponenten.....	25
2 Gesamtgerät.....	26
2.1 Temperaturangaben.....	26
2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit.....	27
2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur.....	28
2.1.3 Temperaturüberwachung.....	28
2.1.4 Temperatursensorpositionen.....	28
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben.....	29
2.3 Leistungshaushalt.....	30
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung.....	30
2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0.....	31
2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0.....	32
2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0.....	33
2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0.....	34
2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00.....	35
2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00.....	36
2.4 Seriennummernaufkleber.....	37
2.5 Blockschaltbilder.....	39
2.5.1 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-00.....	39
2.5.2 Systemeinheit 5PC810.SX01-00 + Buseinheit 5PC810.BX01-01.....	40
2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00.....	41
2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01.....	42
2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00.....	43
2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00.....	44
2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01.....	45
2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02.....	46
2.6 Geräteschnittstellen.....	47
2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC.....	47
2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1.....	48
2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2.....	48
2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI).....	49
2.6.5 Ethernet 1 (ETH1).....	51

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2).....	52
2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5).....	53
2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT.....	54
2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz.....	54
2.6.10 Add-on USV Steckplatz.....	55
2.6.11 AP Link Steckplatz.....	55
2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe).....	56
2.6.13 Status LEDs.....	58
2.6.14 CMOS Profile Schalter.....	58
2.6.15 Power Taster.....	59
2.6.16 Reset Taster.....	59
2.6.17 Batterie.....	60
2.6.18 Hardware Security Key (Dongle).....	61
2.6.19 CompactFlash Slot 1.....	62
2.6.20 CompactFlash Slot 2.....	62
2.6.21 Slide-in Slot 1.....	63
2.6.22 Slide-in Slot 2.....	63
2.6.23 Slide-in compact Slot.....	64
3 Einzelkomponenten.....	65
3.1 Systemeinheiten.....	65
3.1.1 5PC810.SX01-00.....	65
3.1.2 5PC810.SX02-00.....	73
3.1.3 5PC810.SX03-00.....	81
3.1.4 5PC810.SX05-00.....	89
3.2 Buseinheiten.....	96
3.2.1 Allgemeines.....	96
3.2.2 Bestelldaten.....	97
3.2.3 Technische Daten.....	97
3.3 CPU Boards GM45.....	99
3.3.1 Allgemeines.....	99
3.3.2 Bestelldaten.....	99
3.3.3 Technische Daten.....	99
3.4 Kühlkörper.....	101
3.4.1 5AC801.HS00-01.....	101
3.5 Hauptspeicher.....	102
3.5.1 5MMDDR.xxxx-02.....	102
3.6 Laufwerke.....	103
3.6.1 5AC801.HDDI-00.....	103
3.6.2 5AC801.HDDI-02.....	105
3.6.3 5AC801.HDDI-03.....	107
3.6.4 5AC801.SSDI-00.....	109
3.6.5 5AC801.SSDI-01.....	112
3.6.6 5AC801.SSDI-02.....	114
3.6.7 5AC801.ADAS-00.....	116
3.6.8 5AC801.HDDS-00.....	117
3.6.9 5AC801.DVDS-00.....	119
3.6.10 5AC801.DVRS-00.....	121
3.6.11 5ACPCI.RAIC-03.....	124
3.6.12 5ACPCI.RAIC-04.....	127
3.6.13 5ACPCI.RAIC-05.....	129
3.6.14 5MMHDD.0250-00.....	132
3.7 Lüfter Kit.....	134
3.7.1 5PC810.FA01-00.....	134
3.7.2 5PC810.FA02-01.....	135
3.7.3 5PC810.FA03-00.....	136
3.7.4 5PC810.FA05-00.....	137
3.8 AP Link Steckkarten.....	138

3.8.1 5AC801.SDL0-00.....	138
3.8.2 5AC801.RDYR-00.....	140
3.9 Ready Relais.....	141
3.9.1 5AC801.RDYR-01.....	141
3.9.2 Allgemeines.....	141
3.9.3 Bestelldaten.....	141
3.9.4 Pinbelegung.....	141
3.9.5 Lieferumfang.....	142
3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option).....	143
3.10.1 Allgemeines.....	143
3.10.2 5AC600.CANI-00.....	143
3.10.3 5AC600.485I-00.....	146
Kapitel 3 Inbetriebnahme.....	149
1 Montage.....	149
1.1 Vorgehensweise.....	149
1.2 Wichtige Informationen zur Montage.....	149
1.3 Einbaulagen.....	150
1.3.1 Einbaulage - senkrecht.....	150
1.3.2 Einbaulage - waagrecht.....	150
1.4 Luftzirkulationsabstände.....	151
2 Anschluss von Kabeln.....	152
3 Erdungskonzept.....	153
4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests.....	154
4.1 Vorgehensweise.....	154
4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen.....	154
4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center.....	154
4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark.....	155
4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen.....	157
4.4 Auswertung der Messergebnisse.....	157
5 Anschlussbeispiele.....	158
5.1 Auswahl der Displayeinheiten.....	158
5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard.....	159
5.2.1 Voraussetzung Grundsystem.....	159
5.2.2 Linkbaugruppe.....	159
5.2.3 Kabel.....	159
5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen.....	160
5.2.5 BIOS Einstellungen.....	160
5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard.....	161
5.3.1 Voraussetzung Grundsystem.....	161
5.3.2 Linkbaugruppe.....	161
5.3.3 Kabel.....	161
5.3.4 BIOS Einstellungen.....	162
5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard.....	163
5.4.1 Voraussetzung Grundsystem.....	163
5.4.2 Kabel.....	163
5.4.3 BIOS Einstellungen.....	164
5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard.....	165
5.5.1 Voraussetzung Grundsystem.....	165
5.5.2 Linkbaugruppe.....	165
5.5.3 Kabel.....	165
5.5.4 BIOS Einstellungen.....	165
5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard.....	167
5.6.1 Voraussetzung Grundsystem.....	167
5.6.2 Linkbaugruppen.....	167
5.6.3 Kabel.....	167
5.6.4 BIOS Einstellungen.....	168

5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link.....	169
5.7.1 Voraussetzung Grundsystem.....	169
5.7.2 Linkbaugruppe.....	169
5.7.3 Kabel.....	169
5.7.4 BIOS Einstellungen.....	170
5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link.....	171
5.8.1 Voraussetzung Grundsystem.....	171
5.8.2 Linkbaugruppe.....	171
5.8.3 Kabel.....	171
5.8.4 BIOS Einstellungen.....	172
5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link.....	173
5.9.1 Voraussetzung Grundsystem.....	173
5.9.2 Linkbaugruppe.....	173
5.9.3 Kabel.....	173
5.9.4 BIOS Einstellungen.....	174
5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link.....	175
5.10.1 Voraussetzung Grundsystem.....	175
5.10.2 Linkbaugruppe.....	176
5.10.3 Kabel.....	176
5.10.4 BIOS Einstellungen.....	177
5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link.....	178
5.11.1 Voraussetzung Grundsystem.....	178
5.11.2 Linkbaugruppe.....	179
5.11.3 Kabel.....	179
5.11.4 BIOS Einstellungen.....	179
6 Anschluss von USB Peripheriegeräten.....	181
6.1 Lokal am APC810.....	181
6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI.....	182
6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL.....	182
7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes.....	183
7.1 Create RAID Set.....	184
7.2 Create RAID Set - Striped.....	184
7.3 Create RAID Set - Mirrored.....	185
7.4 Delete RAID Set.....	185
7.5 Rebuild Mirrored Set.....	186
7.6 Resolve Conflicts.....	186
7.7 Low Level Format.....	187
8 Bekannte Probleme / Eigenheiten.....	188
8.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses.....	188
8.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose.....	188

Kapitel 4 Software..... 189

1 BIOS Optionen.....	189
1.1 Allgemeines.....	189
1.2 BIOS Setup und Startvorgang.....	189
1.2.1 BIOS Setup Tasten.....	191
1.3 Main.....	192
1.4 Advanced.....	193
1.4.1 ACPI Configuration.....	194
1.4.2 PCI Configuration.....	195
1.4.3 PCI Express Configuration.....	198
1.4.4 Graphics Configuration.....	200
1.4.5 CPU Configuration.....	202
1.4.6 Chipset Configuration.....	204
1.4.7 I/O Interface Configuration.....	205
1.4.8 Clock Configuration.....	206
1.4.9 IDE Configuration.....	206

1.4.10 USB Configuration.....	212
1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration.....	213
1.4.12 CPU Board Monitor.....	214
1.4.13 Baseboard/Panel Features.....	215
1.5 Boot.....	219
1.6 Security.....	221
1.6.1 Hard Disk Security User Password.....	222
1.6.2 Hard Disk Security Master Password.....	222
1.7 Power.....	223
1.8 Exit.....	224
1.9 BIOS Defaulteinstellungen.....	225
1.9.1 Main.....	225
1.9.2 Advanced.....	225
1.9.3 Boot.....	229
1.9.4 Security.....	229
1.9.5 Power.....	229
1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes).....	231
1.11 Ressourcenaufteilung.....	232
1.11.1 RAM-Adressbelegung.....	232
1.11.2 I/O-Adressbelegung.....	232
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode.....	233
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode.....	234
2 Upgradeinformationen.....	237
2.1 BIOS Upgrade.....	237
2.1.1 Was muss ich wissen?.....	237
2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS.....	238
2.1.3 Vorgangsweise mit dem Control Center.....	239
2.2 Firmwareupgrade.....	240
2.2.1 Vorgangsweise.....	240
2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00).....	242
2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP.....	243
2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files.....	245
2.4.1 Was wird benötigt.....	245
2.4.2 Vorgangsweise.....	245
2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?.....	245
2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files.....	246
2.5.1 Was wird benötigt?.....	246
2.5.2 Vorgangsweise.....	246
2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?.....	246
2.6 Upgradeprobleme.....	246
3 Microsoft DOS.....	247
3.1 Bestelldaten.....	247
3.2 Bekannte Probleme.....	247
3.3 Auflösungen und Farbtiefe.....	247
4 Windows XP Professional.....	248
4.1 Bestelldaten.....	248
4.2 Übersicht.....	248
4.3 Installation.....	248
4.3.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05.....	249
4.3.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante.....	249
4.4 Treiber.....	249
5 Windows 7.....	250
5.1 Allgemeines.....	250
5.2 Bestelldaten.....	250
5.3 Übersicht.....	250
5.4 Installation.....	251
5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05.....	251

5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante.....	251
5.5 Eigenheiten, Einschränkungen.....	252
5.6 Treiber.....	252
6 Windows Embedded Standard 2009.....	253
6.1 Allgemeines.....	253
6.2 Bestelldaten.....	253
6.3 Übersicht.....	253
6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009).....	253
6.5 Installation.....	254
6.6 Treiber.....	254
6.6.1 Touch Screen Treiber.....	254
7 Windows Embedded Standard 7.....	255
7.1 Allgemeines.....	255
7.2 Bestelldaten.....	255
7.3 Übersicht.....	256
7.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7).....	256
7.5 Installation.....	256
7.6 Treiber.....	256
7.6.1 Touch Screen Treiber.....	256
8 Automation Runtime.....	258
8.1 Allgemeines.....	258
8.2 Bestelldaten.....	258
8.3 Automation Runtime Windows (ARwin).....	258
8.4 Automation Runtime Embedded (ARemb).....	258
9 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center.....	259
9.1 Funktionen.....	259
9.2 Installation.....	260
9.3 SDL Equalizer Einstellung.....	261
9.4 USV Parametrierung.....	262
9.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV.....	262
9.4.2 Statuswerte der USV anzeigen.....	263
9.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten.....	263
9.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren.....	264
9.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern.....	265
9.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren.....	265
9.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern.....	266
9.4.8 Ablauf bei einem Powerfail.....	268
10 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit.....	269
11 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK.....	271
12 B&R Key Editor.....	273

Kapitel 5 Normen und Zulassungen.....275

1 Gültige europäische Richtlinien.....	275
2 Normenübersicht.....	275
3 Störaussendungsanforderungen (Emission).....	276
3.1 Netzgebundene Emission.....	276
3.2 Störaussendung, Elektromagnetische Strahlung.....	277
4 Störfestigkeitsanforderung (Immunität).....	278
4.1 Elektrostatische Entladung (ESD).....	278
4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld).....	278
4.3 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst).....	279
4.4 Stoßspannungen (Surge).....	279
4.5 Leitungsgeführte Störgrößen.....	279
4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen.....	279
4.7 Spannungsschwankungen.....	279
4.8 Spannungsunterbrechungen.....	280
4.9 Änderung Versorgungsspannung.....	280

4.10 Allmähliches Abschalten / Zuschalten.....	280
4.11 Gedämpft schwingende Wellen.....	280
5 Mechanische Bedingungen.....	281
5.1 Vibration Betrieb.....	281
5.2 Vibration Transport (verpackt).....	281
5.3 Schock Betrieb.....	281
5.4 Schock Transport (verpackt).....	281
5.5 Kippfallen.....	282
5.6 Freier Fall (verpackt).....	282
6 Klimabedingungen.....	283
6.1 Worst Case Betrieb.....	283
6.2 Trockene Wärme.....	283
6.3 Trockene Kälte.....	283
6.4 Große Temperaturschwankungen.....	283
6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb.....	283
6.6 Feuchte Wärme zyklisch.....	284
6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager).....	284
7 Sicherheit.....	285
7.1 Erdungswiderstand.....	285
7.2 Isolationswiderstand.....	285
7.3 Hochspannung.....	285
7.4 Restspannung.....	285
7.5 Ableitstrom.....	286
7.6 Überlast.....	286
7.7 Bauteildefekt.....	286
8 Sonstige Prüfungen.....	287
8.1 Schutzart.....	287
9 Internationale Zulassungen.....	288

Kapitel 6 Zubehör.....289

1 Ersatz CMOS Batterien.....	289
1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000.....	289
1.1.1 Allgemeines.....	289
1.1.2 Bestelldaten.....	289
1.1.3 Technische Daten.....	289
2 Spannungsversorgungsstecker.....	291
2.1 0TB103.9x.....	291
2.1.1 Allgemeines.....	291
2.1.2 Bestelldaten.....	291
2.1.3 Technische Daten.....	291
3 Ersatz Lüfterfilter.....	292
3.1 Allgemeines.....	292
3.2 Bestelldaten.....	292
4 DVI - Monitor Adapter.....	293
4.1 5AC900.1000-00.....	293
4.2 Allgemeines.....	293
4.3 Bestelldaten.....	293
5 CompactFlash Karten.....	294
5.1 Allgemeines.....	294
5.2 Grundlagen.....	294
5.2.1 Flashtechnologie.....	294
5.2.2 Wear Leveling.....	294
5.2.3 Fehlerkorrektur ECC.....	294
5.2.4 S.M.A.R.T. -Support.....	295
5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit.....	295
5.3 5CFCRD.xxxx-06.....	296
5.3.1 Allgemeines.....	296

5.3.2	Bestelldaten.....	296
5.3.3	Technische Daten.....	296
5.3.4	Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	298
5.3.5	Abmessungen.....	298
5.3.6	Benchmark.....	299
5.4	5CFCRD.xxxx-04.....	300
5.4.1	Allgemeines.....	300
5.4.2	Bestelldaten.....	300
5.4.3	Technische Daten.....	300
5.4.4	Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	302
5.4.5	Abmessungen.....	302
5.4.6	Benchmark.....	303
5.5	5CFCRD.xxxx-03.....	304
5.5.1	Allgemeines.....	304
5.5.2	Bestelldaten.....	304
5.5.3	Technische Daten.....	304
5.5.4	Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	306
5.5.5	Abmessungen.....	306
5.6	Bekannte Probleme / Eigenheiten.....	307
6	USB Media Drive.....	308
6.1	5MD900.USB2-01.....	308
6.1.1	Allgemeines.....	308
6.1.2	Bestelldaten.....	308
6.1.3	Schnittstellen.....	308
6.1.4	Technische Daten.....	309
6.1.5	Abmessungen.....	310
6.1.6	Abmessungen mit Frontklappe.....	311
6.1.7	Einbau in Wanddurchbrüche.....	311
6.1.8	Lieferumfang.....	311
6.1.9	Montage.....	311
6.2	5MD900.USB2-02.....	313
6.2.1	Allgemeines.....	313
6.2.2	Bestelldaten.....	313
6.2.3	Schnittstellen.....	313
6.2.4	Technische Daten.....	313
6.2.5	Abmessungen.....	315
6.2.6	Abmessungen mit Frontklappe.....	315
6.2.7	Einbau in Wanddurchbrüche.....	316
6.2.8	Lieferumfang.....	316
6.2.9	Montage.....	316
6.3	5A5003.03.....	317
6.3.1	Allgemeines.....	317
6.3.2	Bestelldaten.....	317
6.3.3	Technische Daten.....	317
6.3.4	Abmessungen.....	317
6.3.5	Lieferumfang.....	317
6.3.6	Montage.....	317
7	USB Memory Sticks.....	319
7.1	5MMUSB.2048-00.....	319
7.1.1	Allgemeines.....	319
7.1.2	Bestelldaten.....	319
7.1.3	Technische Daten.....	319
7.1.4	Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	320
7.2	5MMUSB.2048-01.....	321
7.2.1	Allgemeines.....	321
7.2.2	Bestelldaten.....	321
7.2.3	Technische Daten.....	321

7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	322
8 HMI Drivers & Utilities DVD.....	323
8.1 5SWHMI.0000-00.....	323
8.1.1 Allgemeines.....	323
8.1.2 Bestelldaten.....	323
8.1.3 Inhalt (V2.10).....	323
9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung.....	326
9.1 Features.....	326
9.2 Was wird benötigt.....	326
9.3 5AC600.UPSI-00.....	327
9.3.1 Allgemeines.....	327
9.3.2 Bestelldaten.....	327
9.3.3 Technische Daten.....	327
9.3.4 Montage.....	327
9.4 5AC600.UPSB-00.....	328
9.4.1 Allgemeines.....	328
9.4.2 Bestelldaten.....	328
9.4.3 Technische Daten.....	328
9.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekapazität.....	329
9.4.5 Tiefentladezyklen.....	329
9.4.6 Abmessungen.....	330
9.4.7 Bohrschablone.....	330
9.4.8 Montagevorschriften.....	330
9.5 5CAUPS.00xx-00.....	331
9.5.1 Allgemeines.....	331
9.5.2 Bestelldaten.....	331
9.5.3 Technische Daten.....	331
10 PCI Einsteckkarten.....	332
10.1 5ACPCI.ETH1-01.....	332
10.1.1 Allgemeines.....	332
10.1.2 Bestelldaten.....	332
10.1.3 Technische Daten.....	332
10.1.4 Treibersupport.....	333
10.1.5 Abmessungen.....	334
10.2 5ACPCI.ETH3-01.....	335
10.2.1 Allgemeines.....	335
10.2.2 Bestelldaten.....	335
10.2.3 Technische Daten.....	335
10.2.4 Treibersupport.....	336
10.2.5 Abmessungen.....	337
11 Kabel.....	338
11.1 DVI Kabel.....	338
11.1.1 5CADVI.0xxx-00.....	338
11.2 SDL Kabel.....	341
11.2.1 5CASDL.0xxx-00.....	341
11.3 SDL Kabel mit 45° Stecker.....	344
11.3.1 5CASDL.0xxx-01.....	344
11.4 SDL Kabel flex.....	347
11.4.1 5CASDL.0xxx-03.....	347
11.5 SDL Kabel flex mit Extender.....	350
11.5.1 5CASDL.0xx0-13.....	350
11.6 USB Kabel.....	354
11.6.1 5CAUSB.00xx-00.....	354
11.7 RS232 Kabel.....	355
11.7.1 9A0014.xx.....	355
11.8 Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00.....	357
11.8.1 Allgemeines.....	357

11.8.2 Bestelldaten.....	357
11.8.3 Technische Daten.....	357
12 HDD Ersatzdiskablage.....	358
12.1 5AC801.FRAM-00.....	358
12.1.1 Allgemeines.....	358
12.1.2 Bestelldaten.....	358
12.1.3 Technische Daten.....	358
12.1.4 Abmessungen.....	359
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung.....	360
1 Batteriewechsel.....	360
1.1 Batteriestatusermittlung.....	360
1.2 Vorgangsweise.....	360
2 CompactFlash Tausch.....	362
3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	363
3.1 Vorgangsweise.....	363
4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	364
4.1 Vorgangsweise.....	364
5 Slide-in compact Adapter Montage.....	365
5.1 Vorgangsweise.....	365
6 Lüfter Kit Einbau / Tausch.....	367
6.1 Vorgangsweise.....	367
7 Montage des USV Moduls.....	369
7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul.....	369
7.1.1 APC810 1 Card Slot.....	369
7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot.....	371
7.1.3 APC810 5 Card Slot.....	373
7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul.....	375
7.2.1 APC810 1 Card Slot.....	375
7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot.....	377
7.2.3 APC810 5 Card Slot.....	379
8 Seitendeckeldemontage.....	381
8.1 APC810 mit 1 Card Slot.....	381
8.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot.....	381
8.3 APC810 mit 5 Card Slot.....	382
9 AP Link Montage.....	383
9.1 Vorgangsweise.....	383
10 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1.....	384
10.1 Vorgangsweise.....	384
11 Montage der HDD Ersatzdiskablage.....	386
11.1 Vorgangsweise.....	386
12 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz.....	387
12.1 Vorgangsweise.....	387
Anhang A	389
1 Maintenance Controller Extended (MTCX).....	389
1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung.....	389
2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard.....	391
3 Glossar.....	392

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.00	18.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Version
1.05	24.03.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation von „Automation PC 810 mit BM45 CPU Board“ auf „Automation PC 810 mit GM45 CPU Board“ umbenannt. • Tabelle "Tab. 17: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL" auf Seite 49 korrigiert. • Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 25 korrigiert. • Abschnitt „Automation PC 810 mit Windows XP Embedded“ in „Automation PC 810 mit Windows Embedded Standard 2009“ umbenannt, siehe Seite 253.
1.10	26.07.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 5 "Normen und Zulassungen" auf Seite 275 überarbeitet. • Bezeichnung des CPU Boards von BM45 auf GM45 geändert. • Die Systemeinheit 5PC810.SX03-00, die Buseinheit 5PC810.BX03-00, den Lüfter Kit 5PC810.FA03-00 und den Ersatzlüfter 5AC801.FA03-00 ergänzt. • CPU Board 5PC800.BM45-01 ergänzt. • Hauptspeicher 5MMDDR.4096-02 ergänzt. • B&R ID Codes der Systemeinheiten ergänzt. • Technisches Datum „Remanente Variablen für AR (Automation Runtime) im Power Fail Mode“ bei den APC810 Systemeinheiten ergänzt. • Abschnitt 9 "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 259 aktualisiert. • B&R CompactFlash 16 GByte (5CFCRD.016G-04) ergänzt. • Abschnitt 11 "Kabel" auf Seite 338 im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt. • B&R USB Memory Stick im Kapitel 6 "Zubehör" auf Seite 289 ergänzt. • Abschnitt 5 "Windows 7" auf Seite 250 im "Software" ergänzt.
1.11	04.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ready Relais 5AC801.RDYR-01 im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt. • Abschnitt 12 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 387 im Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" ergänzt. • "5AC801.HDDI-03" auf Seite 107 ergänzt. • "5ACPCI.RAIC-05" auf Seite 129 ergänzt. • "5MMHDD.0250-00" auf Seite 132 ergänzt. • Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 25 überarbeitet. • 5AC801.HDDI-03, 5ACPCI.RAIC-05 und 5MMHDD.0250-00 in Abschnitt 2.1.1 "Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit" auf Seite 27 und in Abschnitt 2.2 "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 29 ergänzt.
1.12	18.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Das BIOS wurde auf die Version 1.13 aktualisiert. • Der Abschnitt 5 "CompactFlash Karten" auf Seite 294 wurde aktualisiert. • Abschnitt 7 "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255 wurde ergänzt.
1.13	24.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitte "Automation Runtime" auf Seite 258, "B&R Automation Runtime Dongle", auf Seite 378, und "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 271 ergänzt. • Abschnitte "B&R Key Editor" auf Seite 273, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 269, "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 259 und "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 323 überarbeitet. • Buseinheit 5PC810.BX05-02 ergänzt • Abbildung "Abb. 2: Konfiguration - optionale Komponenten" auf Seite 25 überarbeitet. • 5SWWI7.0900-MUL und 5SWWI7.1000-MUL in Abschnitt "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255 ergänzt.
1.14	06.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> • USB 5 in Überschrift ergänzt ("USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)" auf Seite 53). • Abschnitt "Add-on USV Steckplatz" auf Seite 55 überarbeitet. • 5CFCRD.016G-04 in Tabelle "Tab. 35: CompactFlash Slot (CF1)" auf Seite 62 ergänzt. • 5AC801.HDDI-03 in Tabelle "Tab. 39: Slide-in compact Slot" auf Seite 64 ergänzt und Kurzbeschreibung zu 5AC801.HDDI-02 korrigiert. • Tabelleneintrag "Ladedauer bei Low Battery" "Tab. 290: 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten" auf Seite 328 ergänzt. • Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 259, "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 269 und "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 271 überarbeitet. • Information zu „Besonderheiten 5PCI Slot Variante bei "Windows XP Professional" auf Seite 248 und "Windows 7" auf Seite 250 ergänzt. • Information zu „Windows XP Mode“ in Abschnitt "Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)" auf Seite 256 korrigiert. • Verweis auf die externe USV 24 VDC in Abschnitt "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" auf Seite 326 überarbeitet.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
1.20	23.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt "CompactFlash Karten" auf Seite 294 wurde überarbeitet. • Abschnitt "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" in Kapitel Software verschoben. • Abschnitt "Temperatursensorpositionen" in Kapitel Technische Daten verschoben. • Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im Kapitel 6 "Zubehör" ergänzt - die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekündigt. • Abschnitt "B&R Automation Runtime Dongle" entfernt, die Bestelldaten wurden im Abschnitt "Automation Runtime" auf Seite 258 ergänzt. • BIOS Version aktualisiert (1.13 -> 1.15). • Die Informationen zum Automation Device Interface und Key Editor wurden aktualisiert. • Gesamtes Handbuch gemäß den aktuellen Formatierungsvorgaben überarbeitet.
1.21	25.06.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Im Abschnitt "Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)" auf Seite 56 wurden Informationen zur Verwendung mit 64-Bit PCI Karten ergänzt. • BIOS Version aktualisiert (1.15 -> 1.17). • Der Abschnitt "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" auf Seite 49 wurde ergänzt. • Informationen zu der "PCI to PCI Bridge" wurden in den "Technische Daten" auf Seite 97 der Buseinheiten ergänzt. • Informationen zu der "PCIe to SATA Bridge" wurde im Abschnitt 2.6.22 "Slide-in Slot 2" auf Seite 63 ergänzt. • Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 wurde auf Seite 5AC801.RDYR-01 verschoben.
1.22	04.07.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Die CPU Board Bestellnummern in der "Tab. 5: Umgebungstemperatur mit Lüfter" auf Seite 27 wurden korrigiert.
1.25	01.10.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 18 wurde geändert - der Beschreibungstext für "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht. • SSD Laufwerke "5AC801.SSDI-01" auf Seite 112 und "5AC801.SSDI-02" auf Seite 114 wurden ergänzt. • Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 154 wurde ergänzt. • Windows 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows 7" auf Seite 250). • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 255). • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 259 wurde aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 269 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. • Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 271 wurde auf Version 1.80 aktualisiert. • Der "B&R Key Editor" auf Seite 273 wurde auf Version 3.30 aktualisiert. • Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards GM45" auf Seite 99.
1.26	21.11.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Die B&R CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergänzt, siehe "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 296. • Die Technischen Daten der USV Kabel wurden überarbeitet, siehe "5CAUPS.00xx-00" auf Seite 331.

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- **Elektrische Baugruppen mit Gehäuse**
... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- **Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse**
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubbiederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

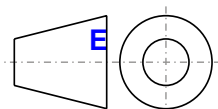
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 3: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	$\pm 0,1$ mm
über 6 bis 30 mm	$\pm 0,2$ mm
über 30 bis 120 mm	$\pm 0,3$ mm
über 120 bis 400 mm	$\pm 0,5$ mm
über 400 bis 1000 mm	$\pm 0,8$ mm

Tabelle 4: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
Automation PC / Panel PC		
1A4601.06	B&R Automation Runtime AREmb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	258
Automation Panel Link Steckkarten		
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	140
5AC801.SDLO-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	138
Batterien		
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	289
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	289
Buseinheiten		
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	97
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	97
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	97
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	97
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	97
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	97
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	97
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	97
CPU Boards		
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	99
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	99
CompactFlash		
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	300
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	300
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	300
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	300
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	300
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	296
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	304
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	300
DVI Kabel		
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	338
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	338
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	338
Feldklemmen		
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	291
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	291
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards		
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	102
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	102
Kühlkörper		
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	101
Laufwerke		
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	116
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	119
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	121
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	103
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	107
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	117
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	109
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	112
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	114
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	129
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	132

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
Lüfter Kit		
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	134
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	135
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	136
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	137
MS-DOS		
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	247
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	247
RS232 Kabel		
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	355
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	355
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	355
SDL Kabel		
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	341
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	341
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	341
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	341
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	341
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	341
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	341
SDL Kabel 45° Anschluss		
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	344
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	344
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	344
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	344
SDL Kabel flex		
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	347
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	347
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	347
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	347
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	347
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	347
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	347
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	350
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	350
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	350
Serialadapter		
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	146
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	143
Sonstiges		
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	293
5SWHMI.0000-00	HMI Drivers & Utilities DVD	323
Systemeinheiten		
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	65
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	73
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	81
5PC810.SX05-00	APC810 Systemeinheit 5 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 2 Slide-in Steckplätze; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzug- klemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	89
USB Kabel		
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	354
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	354
USB Zubehör		
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	317
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	308
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	313
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte	319
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R	321
Undefined		
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	258
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	258
1A4600.10-4	B&R Automation Runtime ARwin+ARNC0+PVIControls	258
1A4601.06-2	B&R Automation Runtime AREmb, ARNC0	258

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	105
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	124
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	127
5CAMSC.0001-00	APC620 Versorgungskabel intern - kundenspezifische Variante -	357
Unterbrechungsfreie Stromversorgung		
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	328
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*, 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	327
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	331
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	331
Windows 7		
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.0200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.0200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.0400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	250
Windows Based Runtime		
1A4600.10	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	258
Windows Embedded Standard 2009		
5SWWXP.0733-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	253
Windows Embedded Standard 7		
5SWWI7.0533-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	255
5SWWI7.0633-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.0733-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	255
5SWWI7.0833-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1533-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1633-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1733-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1 Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
5SWWI7.1833-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	255
Windows XP Professional		
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	248
Zubehör		
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	292
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	292
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	292
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	292
5AC801.FRAM-00	APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage	358
5AC801.RDYR-01	Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	141
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	332
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	335

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Core™ 2 Duo Technologie bietet der APC810 höchste Performance für alle Anwendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommt.

Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschützt hinter einer Klappe Einschübe für Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots (mit GM45 CPU Board ist nur ein CF-Slot nutzbar). Durch die modulare Einschubtechnik können die Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlüsse und Schnittstellen sind auf der Gehäuseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergrößert. Der APC810 bietet mit den unterschiedlichen Baugrößen mit einem, zwei oder fünf Card Slots (für PCI bzw. PCI Express Steckkarten) die optimale Bauform für jede Einbausituation - passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu verschwenden.



1.1 Features

- Neueste Prozessortechnologien - Core 2 Duo
- Bis zu 8 GB Hauptspeicher (Dual Channel Memory Support)
- 1 CompactFlash Steckplatz (Typ I)
- 1, 2, 3 oder 5 Card Slot Steckplätze (für PCI / PCI Express (PCIe) Karten)
- SATA Laufwerke (Slide-in bzw. Slide-in compact Steckplätze)
- 5x USB 2.0
- 2x Ethernet 10/100/1000 MBit Schnittstellen
- 2x RS232 Schnittstelle, modemfähig
- 24 VDC Versorgungsspannung
- BIOS (AMI)
- Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)
- SRAM 512 kByte (batteriegepuffert)
- Anschluss verschiedenster Anzeigegeräte am „Monitor/Panel“ Videoausgang (Unterstützung von RGB, DVI und SDL - Smart Display Link - Signalen)
- 2'ter Grafikstrang mit Einbau der optionalen AP Link Steckkarte
- Einfacher Slide-in Laufwerkstausch (SATA Hot Plug fähig)
- Optionaler Einbau des Add-on USV Modules
- Optionale CAN Schnittstelle
- Optionale RS232/422/485 Schnittstelle
- Optionaler RAID Controller (benötigt einen freien PCI Slot)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das APC810 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Systemeinheit
- Buseinheit
- CPU Board
- Kühlkörper
- Hauptspeicher
- Lüfter Kit
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte oder Hard Disk) für das Betriebssystem
- Software

1.3 Konfiguration - Grundsysteem





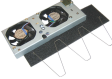
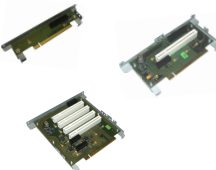

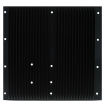

Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehör				
Systemeinheit	1 auswählen			
Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard. <u>Varianten:</u> Card Slots (1,2,3 oder 5) Slide-in Slots (0,1 oder 2) AP Link Steckplatz (0 oder 1) <u>Beispiel:</u> (2 / 1 / 1) = 2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot				
	5PC810.SX01-00 (1 / 0 / 0)	5PC810.SX02-00 (2 / 1 / 1)	5PC810.SX03-00 (3 / 1 / 1)	5PC810.SX05-00 (5 / 2 / 1)
Lüfter Kit	1 ausw.			
	5PC810.FA01-00	5PC810.FA02-01	5PC810.FA03-00	5PC810.FA05-00
Buseinheit	1 auswählen			
	5PC810.BX01-00 (1 PCI)	5PC810.BX02-00 (2 PCI)	5PC810.BX03-00 (2 PCI / 1 PCIe)	5PC810.BX05-00 (4 PCI / 1 PCIe)
	5PC810.BX01-01 (1 PCIe)	5PC810.BX02-01 (1 PCI / 1 PCIe)		5PC810.BX05-01 (2 PCI / 3 PCIe)
				5PC810.BX05-02 (5 PCI)
CPU Board - Kühlkörper - Hauptspeicher				
CPU Board	1 auswählen			
	5PC800.BM45-00 5PC800.BM45-01			
Kühlkörper	1 auswählen			
	5AC801.HS00-01			
Hauptspeicher	1 oder 2 auswählen			
	5MMDDR.2048-02 - 2 GB 5MMDDR.4096-02 - 4 GB			

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsysteem

1.4 Konfiguration - optionale Komponenten
























Konfiguration - Laufwerke, Software, Zubehör				
Systemeinheit	1 auswählen			
<div>Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard.</div> <div>Varianten:</div> <div>Card Slots (1,2,3 oder 5)</div> <div>Slide-in Slots (0,1 oder 2)</div> <div>AP Link Steckplatz (0 oder 1)</div> <div>Beispiel: (2 / 1 / 1)</div> <div>= 2 Card Slots, 1 Slide-in Slot, 1 AP Link Slot</div>				
	5PC810.SX01-00 (1 / 0 / 0)	5PC810.SX02-00 (2 / 1 / 1)	5PC810.SX03-00 (3 / 1 / 1)	5PC810.SX05-00 (5 / 2 / 1)
Slide-in compact Laufwerk	1 auswählen			
	<div>5AC801.HDDI-00 (40 GByte)</div> <div>5AC801.HDDI-03 (250 GByte)</div> <div>5AC801.SSDI-00 (32 GByte)</div> <div>5AC801.SSDI-01 (60 GByte)</div> <div>5AC801.SSDI-02 (180 GByte)</div>			
CompactFlash	1 auswählen			
 	<div>5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06,</div> <div>5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06,</div> <div>5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06</div> <div>5CFCRD.032G-06</div>	<div>5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03,</div> <div>5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03,</div> <div>5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03,</div> <div>5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03</div>		
Slide-in Laufwerk	nicht möglich	1 möglich	2 möglich	
 		<div>5AC801.HDDS-00 (40 GByte)</div> <div>5AC801.DVDS-00 (DVD Laufwerk)</div> <div>5AC801.ADAS-00 (Adapter)</div> <div>5AC801.DVRS-00 (DVD Brenner)</div>		
AP Link Steckkarte		1 auswählen		
 		<div>5AC801.SDL0-00 (für 2'ten Grafikstrang)</div> <div>5AC801.RDYR-00 (Ready Relais)</div>		
RAID System	1 auswählen			
	<div>5ACPCI.RAIC-05 (2x 250 GByte, belegt 1 PCI Slot)</div> <div>5MMHDD.0250-00 (Ersatz SATA-HDD 250 GByte)</div>			
Schnittstellenoption	1 auswählen			
	<div>5AC600.CANI-00 (CAN)</div> <div>5AC600.485I-00 (kombinierte RS232/RS422/RS485)</div>			
USV Modul + Batterie	1 auswählen			
 	<div>5AC600.UPSI-00 (Add-on USV Modul) + 5AC600.UPSB-00 (USV Batterieeinheit)</div> <div>Verbindungskabel: 5CAUPS.0005-00 (0,5 Meter) oder 5CAUPS.0030-00 (3 Meter)</div>			
Feldklemmen	1 auswählen			
 	<div>0TB103.9 (Schraubklemme)</div> <div>0TB103.91 (Federzugklemme)</div>			
Software	1 auswählen			
<div> Windows XP</div> <div> Windows 7</div> <div> Windows Embedded Standard 2009</div> <div> Windows Embedded Standard 7</div> <div> Automation Runtime</div>	<div>Windows XP</div> <div>5SWWXP.0500-ENG</div> <div>5SWWXP.0500-GER</div> <div>5SWWXP.0500-MUL</div> <div>5SWWXP.0600-ENG</div> <div>5SWWXP.0600-GER</div> <div>5SWWXP.0600-MUL</div> <div>Windows 7</div> <div>5SWWI7.1200-ENG</div> <div>5SWWI7.1200-GER</div> <div>5SWWI7.1400-MUL</div>	<div>Windows Embedded Standard 2009</div> <div>5SWWXP.0733-ENG</div> <div>Windows Embedded Standard 7</div> <div>5SWWI7.1533-ENG</div> <div>5SWWI7.1633-ENG</div> <div>5SWWI7.1733-MUL</div> <div>5SWWI7.1833-MUL</div> <div>5SWWI7.1100-ENG</div> <div>5SWWI7.1100-GER</div> <div>5SWWI7.1300-MUL</div>	<div>Automation Runtime</div> <div>1A4601.06</div> <div>1A4601.06-2</div> <div>1A4600.10</div> <div>1A4600.10-2</div> <div>1A4600.10-3</div> <div>1A4600.10-4</div> <div>Microsoft DOS</div> <div>9S0000.01-010</div> <div>9S0000.01-020</div>	

Abbildung 2: Konfiguration - optionale Komponenten

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

Aufgrund der Möglichkeit, CPU Boards mit verschiedensten Komponenten wie Laufwerke, Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. in Abhängigkeit von Systemeinheit und Lüfter Kit zu kombinieren, bieten die nachfolgenden Tabellen bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden, maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb mit und ohne Lüfter Kit ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V3.8.1) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, Add-on und Slide-in Laufwerke, USB Schnittstellen, Audioausgänge)
- Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

Was muss bei der Ermittlung der maximalen Umgebungstemperatur beachtet werden?

- Betrieb der Ethernetschnittstellen (ETH1/ETH2) im 10/100 MBit oder 1 GBit Modus
- Revision des verwendeten Kühlkörpers

2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur mit Lüfter Kit

Information:

- Senkrechte wie auch waagrechte (minus 5°C) Einbaulage erlaubt (1.3 "Einbaulagen" auf Seite 150).
- Die Angaben in der folgenden Tabelle gelten nur für Systemeinheiten mit dem Kühlkörper 5AC801.HS00-01 ≥ Rev. D0.

Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Temperaturgrenzen	Sensor(en) im Bereich
Maximale Umgebungstemperatur ¹⁾		50	55		
Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?					
Slide-in compact Laufwerke	On-Board CompactFlash ²⁾	✓	✓	80	I/O
	5AC801.HDDI-00	✓	✓	80	
	5AC801.HDDI-02	✓	✓	80	
	5AC801.HDDI-03	✓	50	60	
	5AC801.SSDI-00	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-01	✓	✓	70	
	5AC801.SSDI-02	✓	✓	70	
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	✓	✓	80	Slide-in Laufwerk
	5AC801.DVDS-00	✓	✓	50	
	5AC801.DVRS-00	✓	✓	50	
Hauptspeicher	5MMDDR.2048-02	✓	✓	-	-
	5MMDDR.4096-02	✓	✓	-	
Systemeinheiten	5PC810.SX01-00	✓	✓	80	Netzteil
	5PC810.SX02-00	✓	✓	80	
	5PC810.SX03-00	✓	✓	80	
	5PC810.SX05-00	✓	✓	80	
Zusatzsteckkarten Schnittstellen / AP Link	5AC600.CANI-00	✓	✓	-	-
	5AC600.485I-00	✓	✓	-	
	5AC801.SDL0-00	✓	✓	-	
	5AC801.RDYR-00	✓	✓	-	
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/ Standard)	✓	✓	-	
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/ Standard)	✓	50	-	

1) Bei waagrechter Einbaulage ist die maximale Umgebungstemperatur um 5°C zu reduzieren!

2) Nur in Verbindung mit einer bei B&R erhältlichen und mit dem Gerät kompatiblen CompactFlash Karte möglich.

Tabelle 5: Umgebungstemperatur mit Lüfter

Wie bestimmt man die maximale Umgebungstemperatur?

1. Auswahl des CPU Boards (Verwendung mit oder ohne Lüfter Kit).
2. Die Zeile „Maximale Umgebungstemperatur“ zeigt die maximale Umgebungstemperatur des Gesamtsystems in Verbindung mit dem jeweiligen CPU Board an.

Information:

Die maximalen Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.

3. Sind im APC810 System zusätzlich Laufwerke (Add-on, Slide-in), Hauptspeicher, Zusatzsteckkarten, usw. eingebaut, kann es vorkommen, dass bedingt durch diese Komponente(n) eine Temperatureinschränkung besteht.

Ist bei der verbauten Komponente ein „✓“ (Häkchen), so kann diese bei der maximalen Umgebungstemperatur des Gesamtsystems problemlos betrieben werden.

Ist bei der verbauten Komponente eine Temperaturangabe z.B. „35“, so darf die Umgebungstemperatur des gesamten APC810 Systems diese nicht überschreiten.

2.1.2 Minimale Umgebungstemperatur

Die minimale Umgebungstemperatur liegt in Verbindung mit einer der folgenden Komponenten bei +5°C: 5AC801.DVDS-00, 5AC801.DVRS-00. Wird keine der genannten Komponenten verwendet so liegt die minimale Umgebungstemperatur bei 0°C.

2.1.3 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board, Board I/O, Board ETH2, Board Netzteil, ETH2 Controller, Netzteil und Slide-in Laufwerke 1/2) im APC810. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Abb. 3: Temperatursensorpositionen" auf Seite 28 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle¹⁾ dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

Desweiteren sind die bei B&R erhältlichen Hard Disks für APC810 Systeme mit der S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) Technologie ausgestattet. D.h., es können verschiedene Parameter, wie z. B. Temperatur mittels Software (z.B. HDD Thermometer - Freeware) unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen (außer Windows CE) ausgelesen werden.

2.1.4 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Board I/O, Slide-in Laufwerk, usw.) im APC810 an. Die Temperaturen²⁾ können im BIOS (Menüpunkt Advanced - CPU Monitor) oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center³⁾ ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielpprogramme verfügbar.

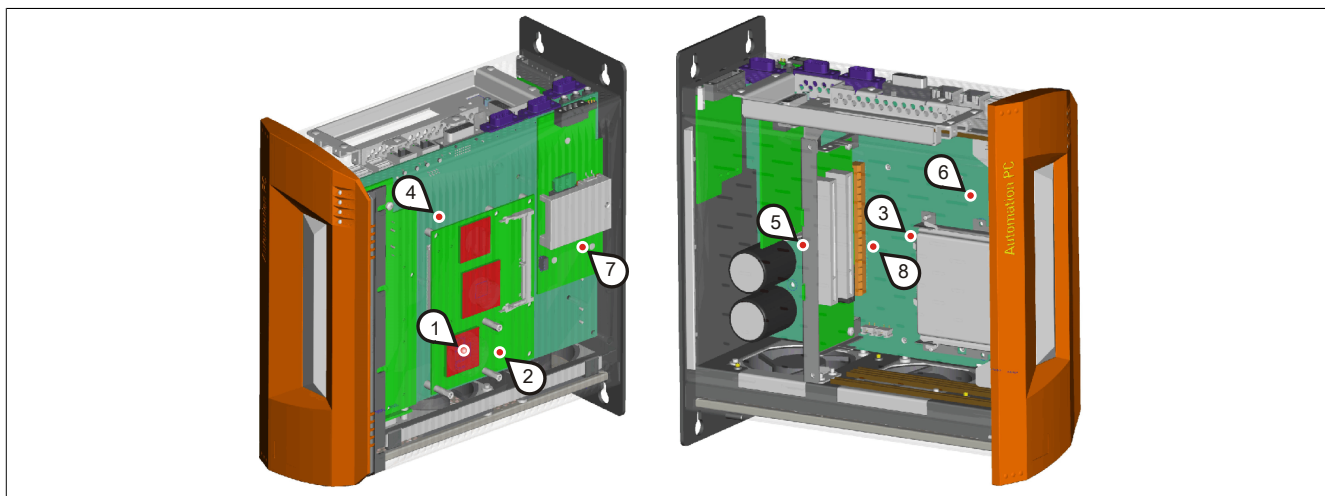


Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
1	CPU	Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor).	100°C
2	Board	Temperatur des CPU Boards (Sensor integriert im CPU Board).	85°C
3	Board I/O	Temperatur des Board I/O Bereiches (Sensor auf dem Baseboard).	85°C
4	Board ETH2	Temperatur des Baseboards im Bereich des ETH2 Controllers (Sensor am Baseboard).	80°C
5	Board Netzteil	Temperatur des Board Netzteils (Sensor am Baseboard).	80°C
6	ETH2 Controller	Temperatur des ETH2 Controllers (Sensor im ETH2 Controller).	125°C
7	Netzteil	Temperatur des Netzteils (Sensor am Netzteil).	80°C
8	Slide-in Laufwerk 1	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 1 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig
8	Slide-in Laufwerk 2	Temperatur eines Slide-in Laufwerks 2 (Sensor ist auf dem Slide-in Einschub integriert).	laufwerkabhängig

Tabelle 6: Temperatursensorpositionen

- 1) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.
- 2) Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.
- 3) Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb	Lagerung / Transport
CPU Boards GM45 COM Express		10 bis 90%	5 bis 95%
Systemeinheiten (alle Varianten)		5 bis 90%	5 bis 95%
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%
Slide-in compact Laufwerke	5AC801.HDDI-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-02	8 bis 80%	5 bis 95%
	5AC801.HDDI-03	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-01	5 bis 95%	5 bis 95%
	5AC801.SSDI-02	5 bis 95%	5 bis 95%
Slide-in Laufwerke	5AC801.HDDS-00	5 bis 90%	5 bis 90%
	5AC801.DVDS-00	8 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.DVRS-00	8 bis 90%	5 bis 95%
Zusatzsteckkarten Schnittstellen AP Link	5AC600.CANI-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC600.485I-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.SDL0-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5AC801.RDYR-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-03 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-04 (24 Stunden/Standard)	8 bis 90%	5 bis 95%
	5ACPCI.RAIC-05 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0250-00 (24 Stunden/Standard)	5 bis 95%	5 bis 95%
Zubehör	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%
	Memory Stick 5MMUSB.2048-xx	10 bis 90%	5 bis 90%
	USB Media Drive 5MD900.USB2-01	20 bis 80%	5 bis 90%

Tabelle 7: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der APC810 Spannungsversorgung für die Systemeinheiten dar.

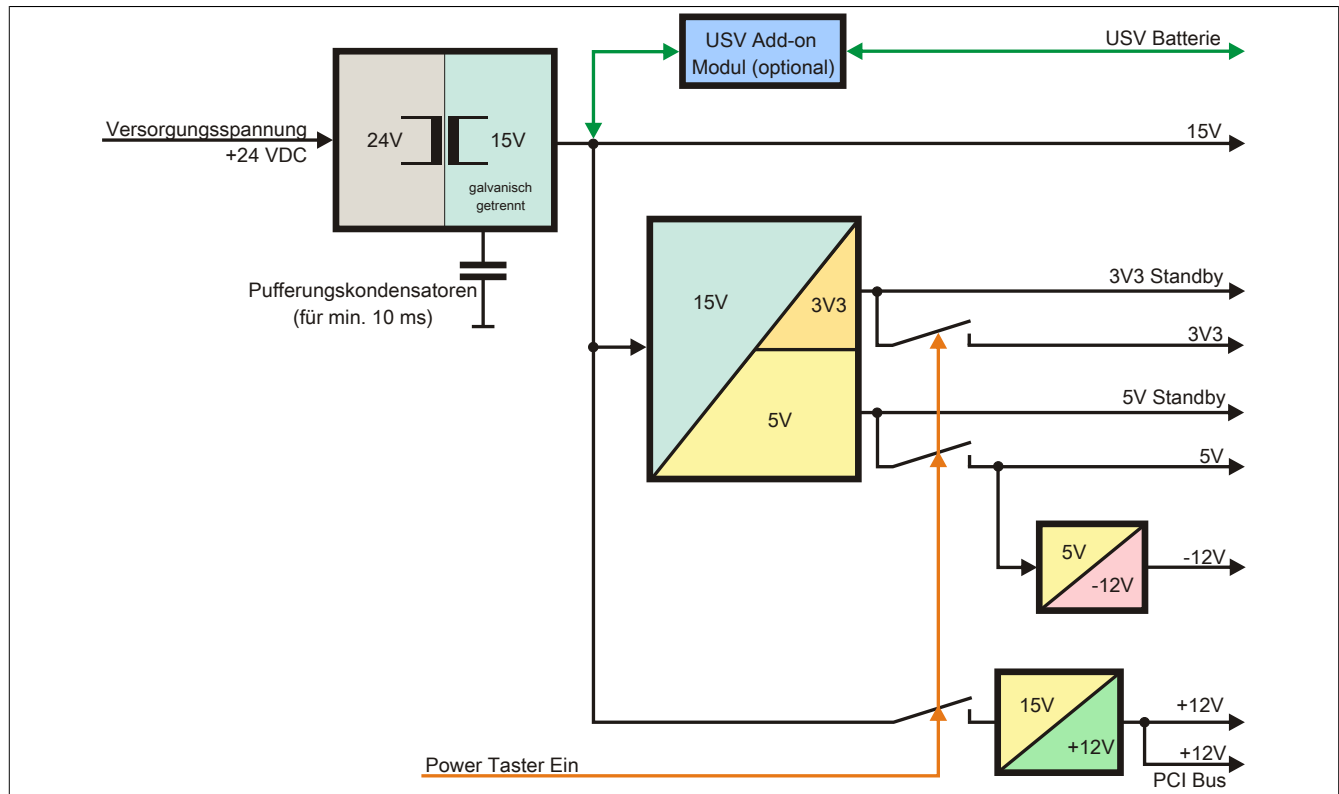


Abbildung 4: Spannungsversorgung für Systemeinheiten

Erläuterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V auf den Bus gelegt. Beim 5 V Ausgang generiert ein weiterer DC/DC Wandler -12 V und legt diese auf den Bus. Ein zusätzlicher DC/DC Wandler generiert +12 V.

Die optional anschließbare Add-on USV inklusive Batterieeinheit wird über 15 V versorgt und gewährleistet bei Verlust der Versorgungsspannung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des 15 V Bus.

2.3.2 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision >= D0

Information:		CPU Board		Vorliegendes System
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen
Leistung Gesamtnetzteil (maximal)				130
Gesamtnetzteil	+12 V	Add-on USV Modul, optional		
		7.5	7.5	
		maximal möglich bei +12 V		75
		CPU Board, Fixverbraucher		
		43	36	
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W		
		Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W		
		Lüfter Kit		
		1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		
		10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
		Verbraucher +12 V Σ		
		maximal möglich bei +12 V		65
	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher		
		4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)		
		4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)		
		4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W		
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W		
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		
		0.5	0.5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		
		5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
		maximal möglich bei -12 V		1.2
	-12 V	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾		
		Verbraucher -12 V Σ		
		Verbraucher +5 V Σ		
		maximal möglich bei 3V3		40
	3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher		
		4	4	
		CompactFlash		
		1	1	
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		
		0.25	0.25	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾		
		Verbraucher 3V3 Σ		
		Verbraucher Σ		

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 8: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.3 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX01-00 Revision < D0

Information:		CPU Board		Vorliegendes System	
		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen	
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.					
		Leistung Gesamtnetzteil (maximal)		85	
Gesamtnetzteil	Add-on USV Modul, optional		7.5	7.5	
	maximal möglich bei +12 V		75		
	+12 V	CPU Board, Fixverbraucher	43	36	
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W			
		Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W			
		Lüfter Kit	1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾			
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾			
	Verbraucher +12 V ∑				
	maximal möglich bei +5 V		65		
	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)	4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W			
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W			
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾			
		maximal möglich bei -12 V		1.2	
-12 V		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾			
	Verbraucher -12 V ∑				
Verbraucher +5 V ∑					
maximal möglich bei 3V3		40			
3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4		
	CompactFlash	1	1		
	Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25		
	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾				
	Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾				
Verbraucher 3V3 ∑					
Verbraucher ∑					

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 9: Leistungskalkulation APC 1 Slot

2.3.4 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision >= D0

Information:		CPU Board		Vorliegendes System
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen
Leistung Gesamtnetzteil (maximal)				130
Gesamtnetzteil	+12 V	Add-on USV Modul, optional		
		7.5	7.5	
		maximal möglich bei +12 V		75
		CPU Board, Fixverbraucher		
		43	36	
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W		
		Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W		
		Lüfter Kit		
		1.8	1.8	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		
		10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
		Verbraucher +12 V ∑		
		maximal möglich bei +5 V		65
	+5 V	Systemeinheit, Fixverbraucher		
		4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)		
		4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)		
		4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W		
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W		
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		
		0.5	0.5	
	-12 V	Grafikadapter (AP Link), optional		
		5	5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		
		5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
		maximal möglich bei -12 V		1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾		
		Verbraucher -12 V ∑		
		Verbraucher +5 V ∑		
		maximal möglich bei 3V3		40
	3V3	Systemeinheit, Fixverbraucher		
		4	4	
		CompactFlash		
		1	1	
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		
		0.25	0.25	
		Grafikadapter (AP Link), optional		
		1.5	1.5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾		
		Verbraucher 3V3 ∑		
		Verbraucher ∑		

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 10: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.5 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX02-00 Revision < D0

Information:		CPU Board		Vorliegendes System
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen
Gesamtnetzteil	Leistung Gesamtnetzteil (maximal)			85
	Add-on USV Modul, optional	7.5	7.5	
	maximal möglich bei +12 V			75
	CPU Board, Fixverbraucher	43	36	
	Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W			
	Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W			
	Lüfter Kit	1.8	1.8	
	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10	
	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾			
	Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾			
	Verbraucher +12 V ∑			
	maximal möglich bei +5 V			65
	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	
	Hard Disk (Slide-in compact)	4	4	
	Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)	4	4	
	USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W			
	USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W			
	Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5	
	Grafikadapter (AP Link), optional	5	5	
	Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5	
	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾			
	maximal möglich bei -12 V			1.2
	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾			
	Verbraucher -12 V ∑			
	Verbraucher +5 V ∑			
	maximal möglich bei 3V3			40
	Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4	
	CompactFlash	1	1	
	Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25	
	Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5	
	Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾			
	Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾			
	Verbraucher 3V3 ∑			
	Verbraucher ∑			

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 11: Leistungskalkulation APC 2 Slot

2.3.6 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX03-00

Information:				CPU Board		Vorliegendes System
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.				5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen
				Leistung Gesamtnetzteil (maximal)		130
Gesamtnetzteil	+12 V	Add-on USV Modul, optional		7.5	7.5	
		maximal möglich bei +12 V				75
		CPU Board, Fixverbraucher		43	36	
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W				
		Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W				
		Lüfter Kit		3.7	3.7	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		10	10	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾				
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾				
		Verbraucher +12 V ∑				
	+5 V	maximal möglich bei +5 V				65
		Systemeinheit, Fixverbraucher		4	4	
		Hard Disk (Slide-in compact)		4	4	
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)		4	4	
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W				
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W				
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		0.5	0.5	
		Grafikadapter (AP Link), optional		5	5	
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)		5	5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾				
	-12 V	maximal möglich bei -12 V				1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾				
		Verbraucher -12 V ∑				
	3V3	Verbraucher +5 V ∑				
		maximal möglich bei 3V3				40
		Systemeinheit, Fixverbraucher		4	4	
		CompactFlash		1	1	
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional		0.25	0.25	
		Grafikadapter (AP Link), optional		1.5	1.5	
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾				
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾				
		Verbraucher 3V3 ∑				
		Verbraucher ∑				

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 12: Leistungskalkulation APC 3 Slot

2.3.7 Leistungskalkulation mit 5PC810.SX05-00

Information:		CPU Board		Vorliegendes System
Alle Angaben in Watt Bei den Angaben der Erzeuger handelt sich um Maximalwerte. Bei den Angaben der Verbraucher handelt es sich um gemittelte maximale Werte, jedoch keine Peak-Werte.		5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01	Werte in dieser Spalte Eintragen
Leistung Gesamtnetzteil (maximal)				130
Gesamtnetzteil	Add-on USV Modul, optional			
	+12 V	maximal möglich bei +12 V		75
		CPU Board, Fixverbraucher	43	36
		Arbeitsspeicher 2048 MB max. 2 Stück je 3 W		
		Arbeitsspeicher 4096 MB max. 2 Stück je 4 W		
		Lüfter Kit	2.8	2.8
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	10	10
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 6 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
		Verbraucher +12 V Σ		
	+5 V	maximal möglich bei +5 V		65
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4
		Hard Disk (Slide-in compact)	4	4
		Slide-in Laufwerk (Hard Disk, DVD-ROM,...)	4	4
		USB Peripherie USB2 und USB4 je 2,5 W		
		USB Peripherie USB1, USB3 und USB5 je 5 W		
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.5	0.5
		Grafikadapter (AP Link), optional	5	5
		Externer Verbraucher, optional (über Baseboard)	5	5
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 20 W ¹⁾		
	-12 V	maximal möglich bei -12 V		1.2
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 1,2 W ¹⁾		
		Verbraucher -12 V Σ		
		Verbraucher +5 V Σ		
	3V3	maximal möglich bei 3V3		40
		Systemeinheit, Fixverbraucher	4	4
		CompactFlash	1	1
		Schnittstellenoption (Add-on Interface), optional	0.25	0.25
		Grafikadapter (AP Link), optional	1.5	1.5
		Leistungsangabe PCI Karte, optional, max. 15 W ¹⁾		
		Leistungsangabe PCIe x4 Karte, optional, max. 10 W ¹⁾		
		Verbraucher 3V3 Σ		
		Verbraucher Σ		

1) Die Gesamtleistung einer PCI / PCIe Karte pro PCI Steckplatz (= Summe der Leistungsaufnahmen pro Spannungsbereich) darf die max. Leistungsangabe mit Lüfter Kit nicht überschreiten.

Tabelle 13: Leistungskalkulation APC 5 Slot

2.4 Serialnummernaufkleber

Jedes B&R Gerät wird mit einem einzigartigen Serialnummernaufkleber mit Barcode (Type 128) versehen, um eine eindeutige Identifizierung des Gerätes zu ermöglichen. Hinter dieser Seriennummer sind alle in dem System verbauten Komponenten (Bestellnummer, Bezeichnung, Revision, Seriennummer, Lieferdatum und Garantieende) abgebildet.



Abbildung 5: Serialnummernaufkleber Vorderseite

Ein Aufkleber mit detaillierten Informationen der verbauten Komponenten ist auch auf der Rückseite der Montageplatte zu finden.

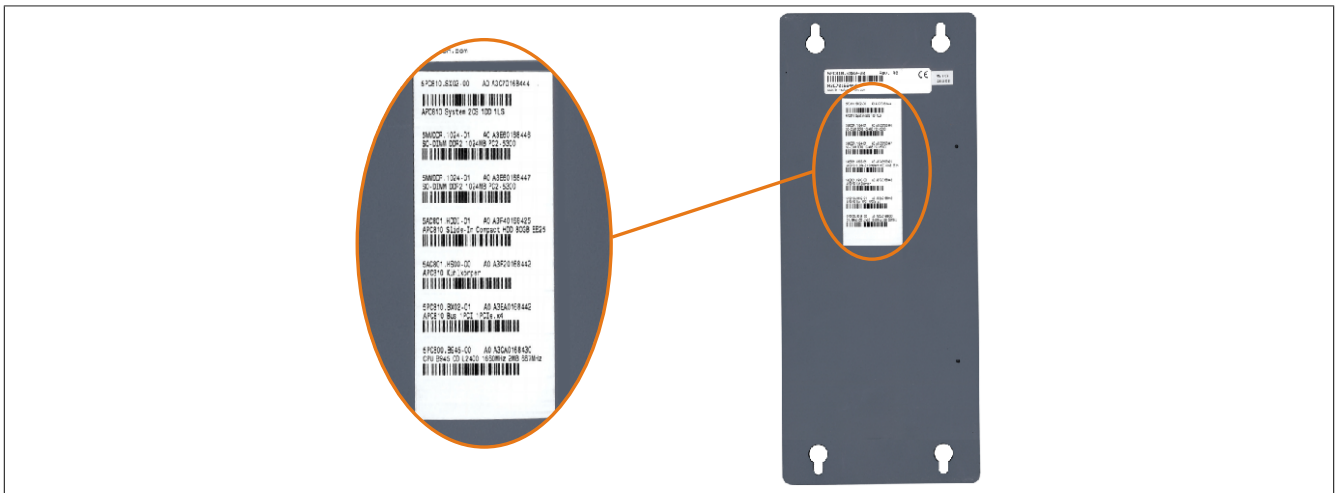


Abbildung 6: Serialnummernaufkleber Rückseite

Diese Information kann auch über die B&R Homepage abgerufen werden. Hierzu ist auf der Startseite www.br-automation.com die Seriennummer des Gesamtgerätes bei der Seriennummernsuche einzugeben. Nach der Suche erhält man eine detaillierte Auflistung der verbauten Komponenten.

Unternehmen

Produkte

Service

Termine

News

myPortal

Industrie PCs

Provit 5000

Provit 5600

Automation PC 620

Automation PC 800

Automation Panel 800

Automation Panel 900

Panel PC 300

Panel PC 700

Mobile Panel 10/50

Mobile Panel 100

Power Panel

Visualisieren und Bedienen

Steuerungssysteme

I/O Systeme

Antriebstechnik

Netzwerke und Feldbus Module

Software

Prozessleittechnik

Stromversorgungen

Zubehör

automationLETTER

Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte unterstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.

Ihre e-Mail Adresse:

Home | Kontakt | Sprache | Login

Perfection in Automation

www.br-automation.com

Industrie PCs > Automation PC 800 > Systemeinheiten > SPC810.SX02-00

Basissinformation

Serialnummer

Materialnummer: SPC810.SX02-00

Materialnummer:

Suche

Materialnummer:

Suche

Suche

Materialnummer:

Suche

Downloads

Automation PC 800

Anwenderhandbuch

Materialnummer: SPC810.SX02-00

Beschreibung:
APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Express, PCI, abhängig vom Dual), 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slice-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/Video/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x E*H 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme OTB103.9 oder Federzugklemme OTB103.9; gesondert bestellen).

Serviceauftrag auflösen

Serialnummer	Materialnummer	Rev	Auslieferungsdatum	Gewährleistungsende
A3C70168444	SPC810.SX02-00	AC	0000-00-00	0000-00-00

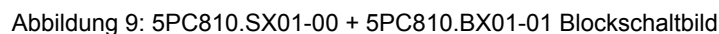
Dieses Material ist Bestandteil eines konfigurierten Materials und wurde in folgender Konfiguration zugeordnet.

Serialnummer	Materialnummer	Rev	Auslieferungsdatum	Gewährleistungsende
A3C70168444	SPC810.SX02-00	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3E60168446	SMHDDR.1C24-01	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3C60168447	SMHDDR.1C24-01	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3F40168445	SAC801.HDD1-01	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3F20168442	SAC801.HSDC-00	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3EA0168442	SPC810.BX02-C1	AC	0000-00-00	0000-00-00
A3CAU16844U	SPC800.B945-00	AC	0000-00-00	0000-00-00

Serialnummerneingabe
z.B. A3C70168444

Auflistung der verbauten
Komponenten nach der
Serialnummernsuche

Abbildung 7: Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444



2.5.3 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-00

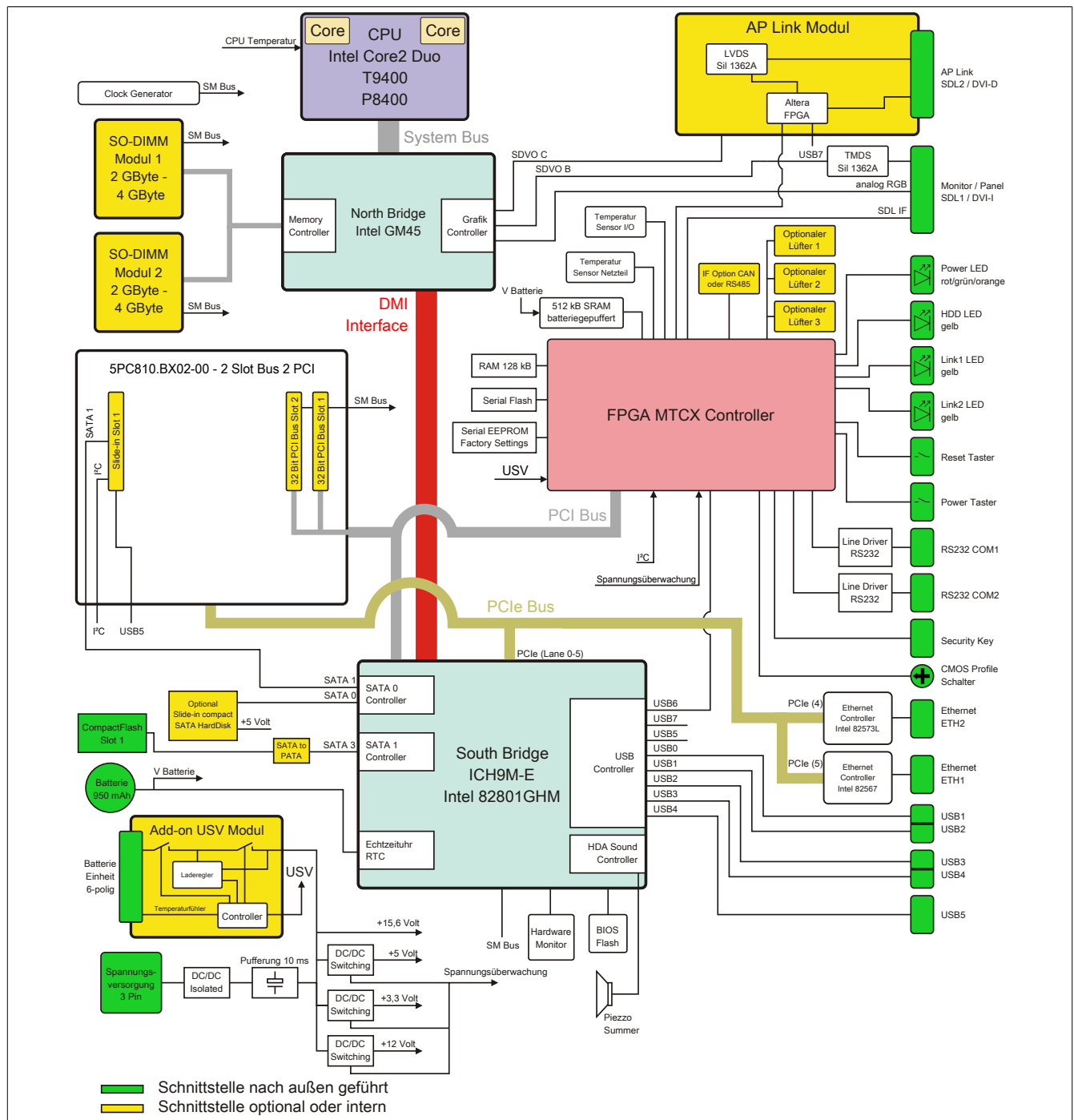


Abbildung 10: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild

2.5.4 Systemeinheit 5PC810.SX02-00 + Buseinheit 5PC810.BX02-01

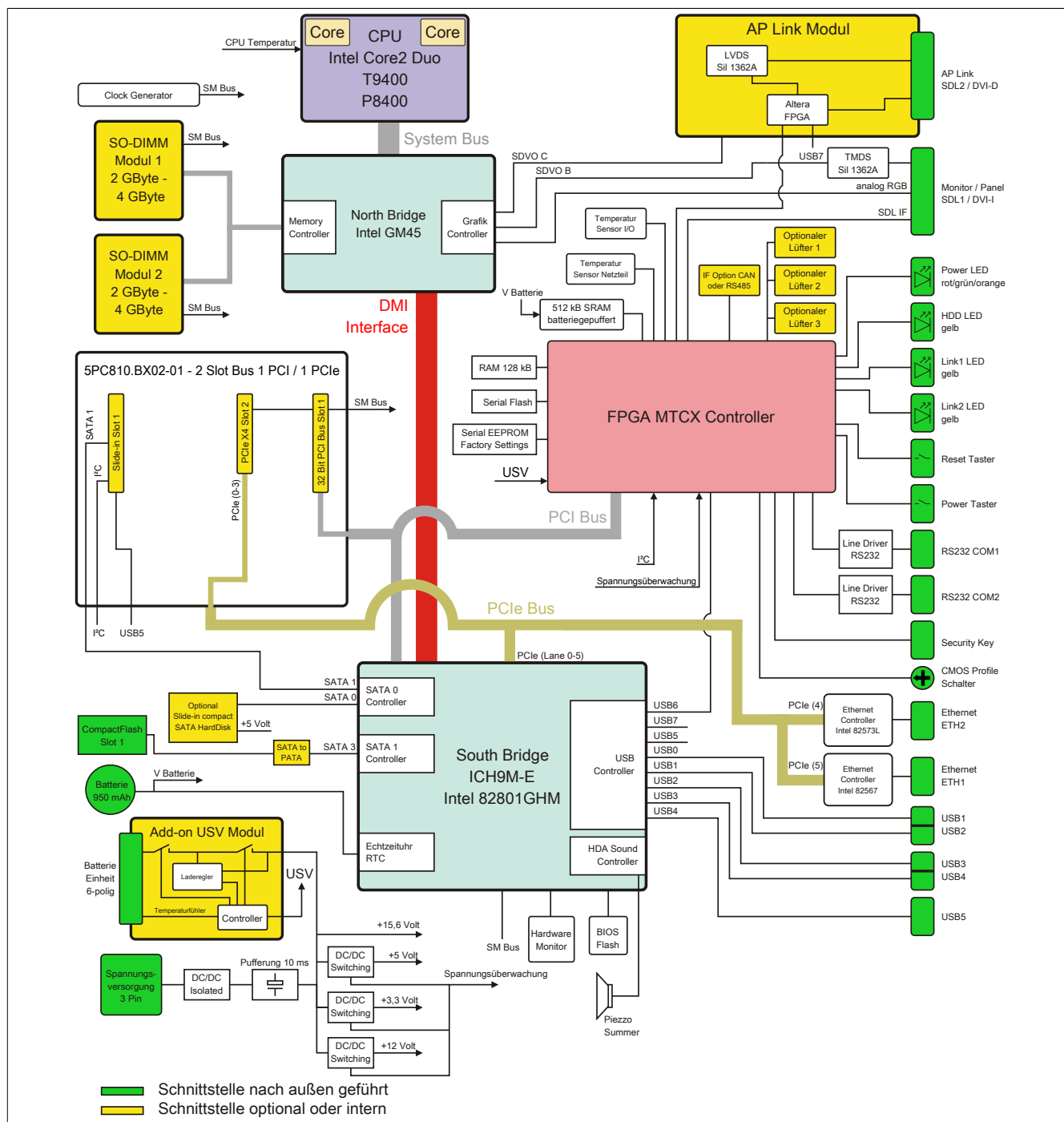


Abbildung 11: 5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild

2.5.5 Systemeinheit 5PC810.SX03-00 + Buseinheit 5PC810.BX03-00

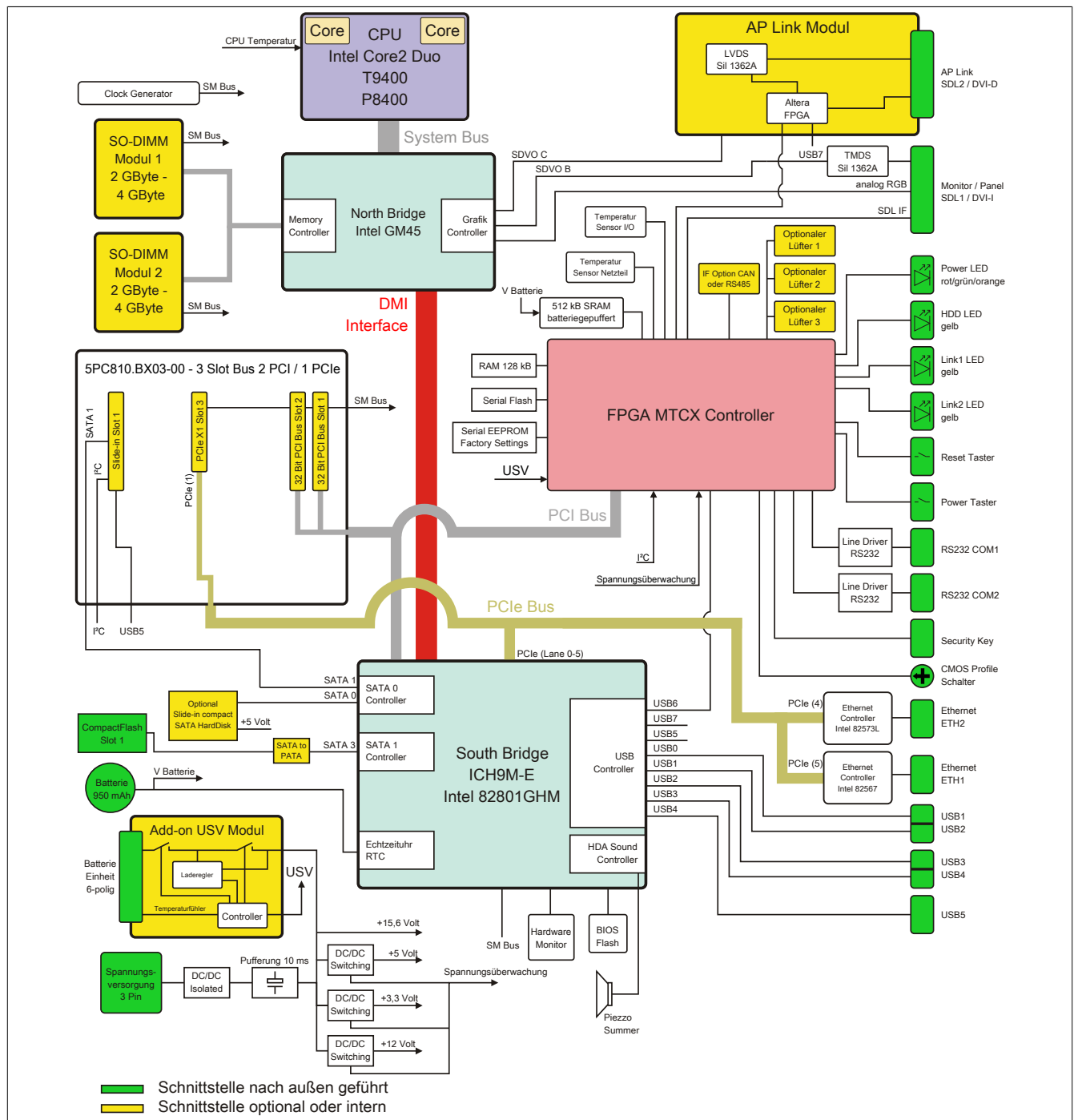


Abbildung 12: 5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild

2.5.6 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-00

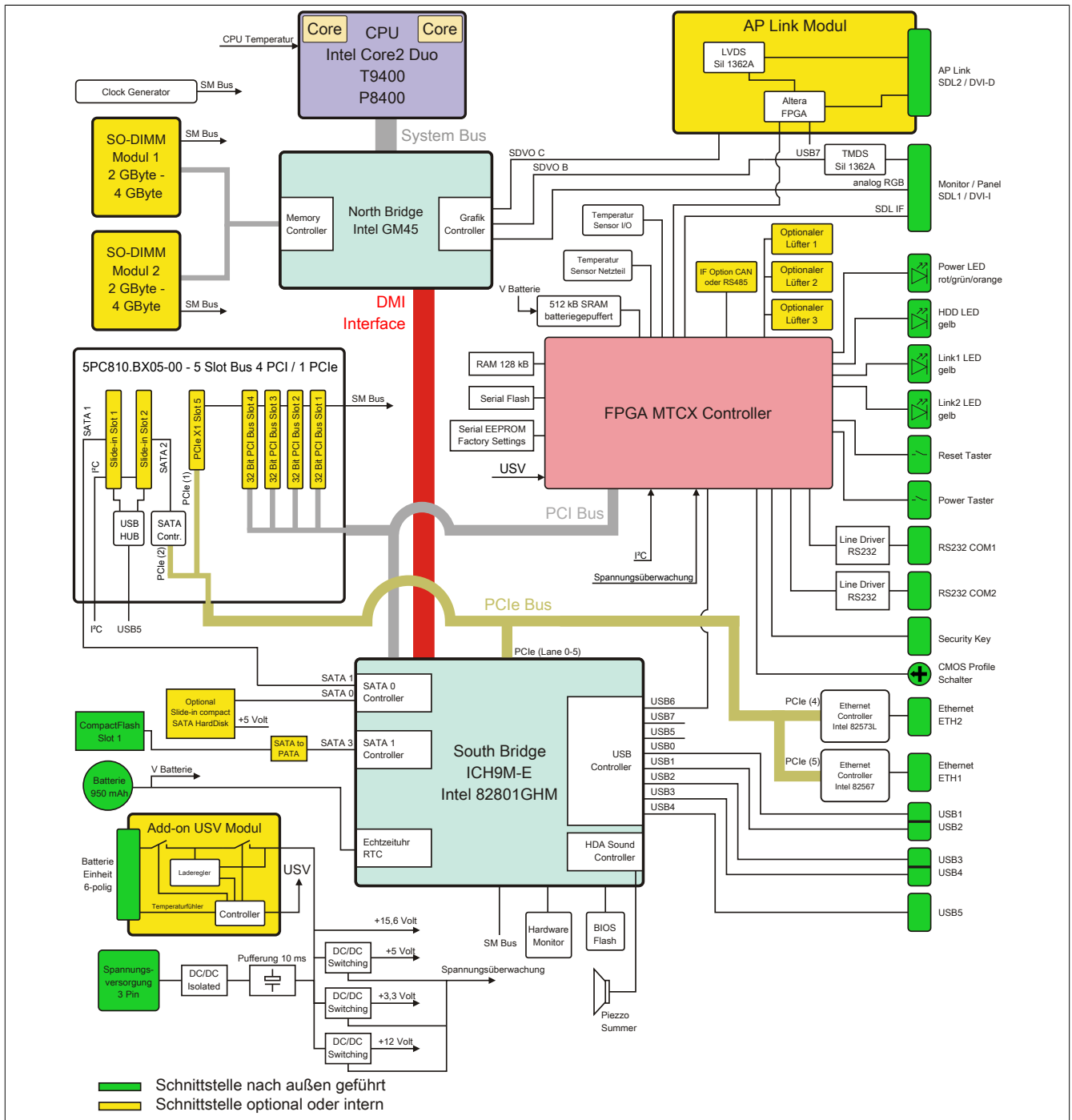


Abbildung 13: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild

2.5.7 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-01

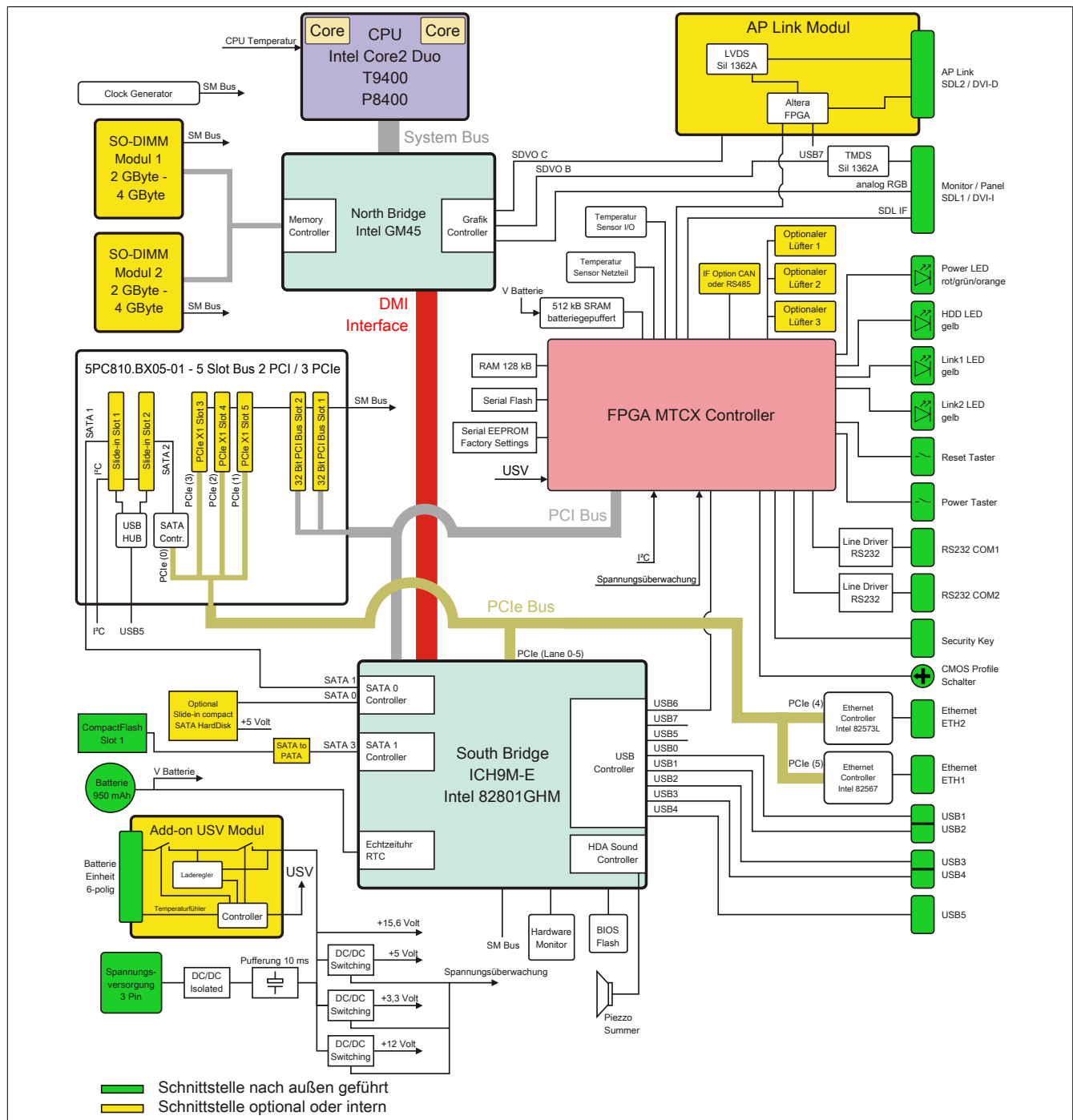


Abbildung 14: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild

2.5.8 Systemeinheit 5PC810.SX05-00 + Buseinheit 5PC810.BX05-02

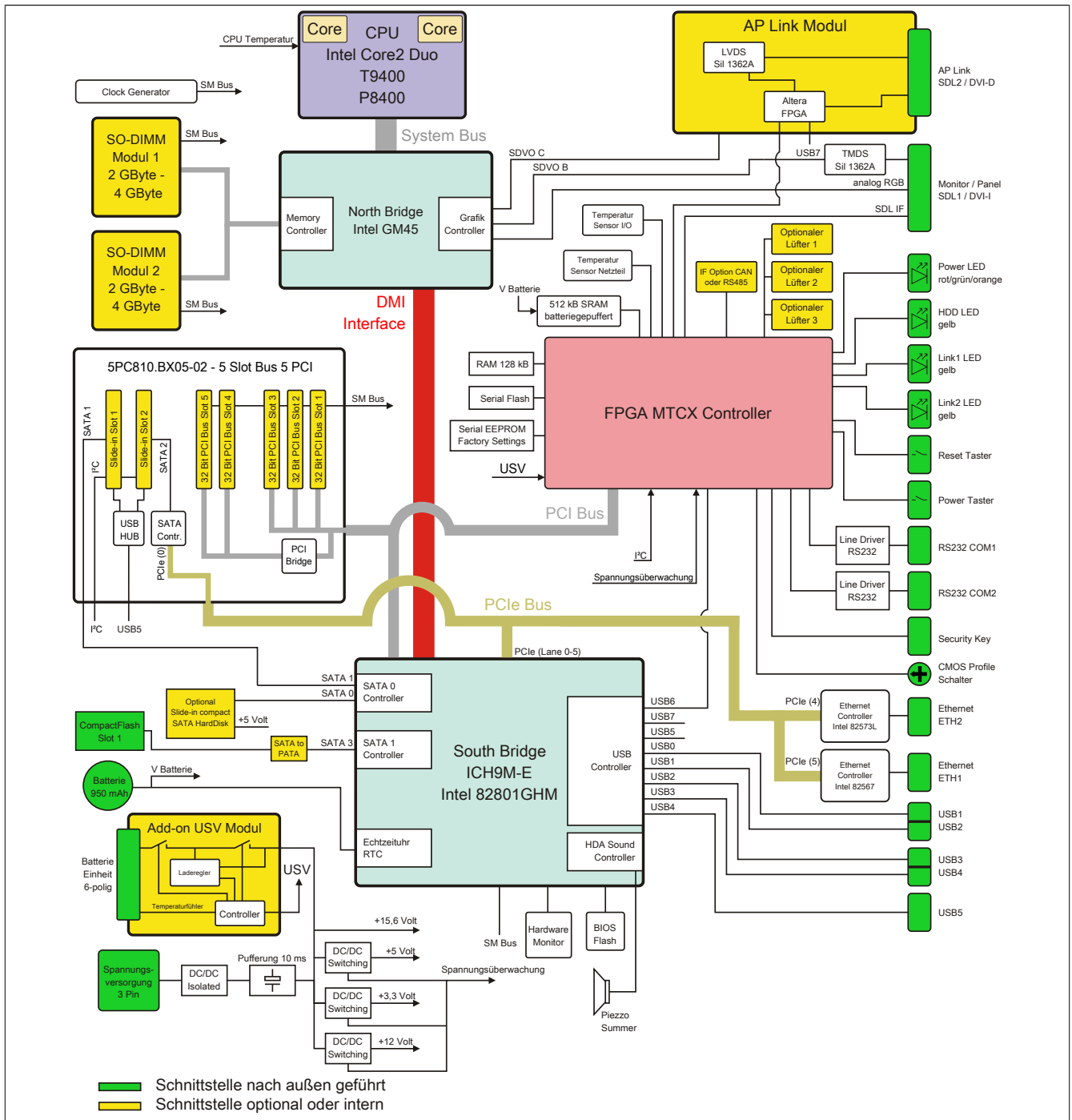


Abbildung 15: 5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild

2.6 Geräteschnittstellen

2.6.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC810 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung	
verpolungssicher	
Pin	Beschreibung
1	-
2	Funktionserde
3	+
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Feldklemmen
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme

3-polig, male

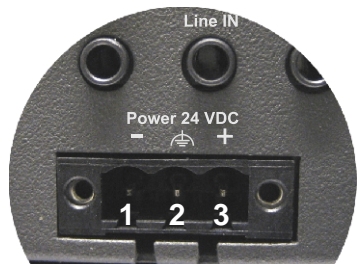


Tabelle 14: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die APC810 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.



Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschranks oder der Anlage in der der APC810 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.6.2 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1 ¹⁾	
	RS232
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s
Buslänge	max. 15 m
Pin	Belegung
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

9-poliger DSUB Stecker

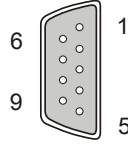


Tabelle 15: Pinbelegung COM1

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.3 Serielle Schnittstelle COM2

Serielle Schnittstelle COM2 ¹⁾	
	RS232
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s
Buslänge	max. 15 m
Pin	Belegung
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

9-poliger DSUB Stecker

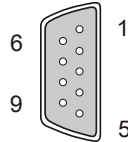


Tabelle 16: Pinbelegung COM2

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.6.4 Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link / DVI)

Monitor / Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI		
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosignale beim Monitor/Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.		
CPU Board	Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten	
5PC800.BM45-00	RGB, DVI, SDL	
5PC800.BM45-01	RGB, DVI, SDL	



Tabelle 17: Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL

Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchronization
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

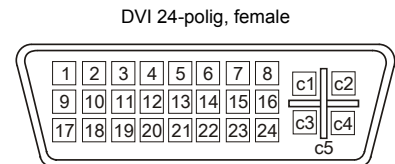


Tabelle 18: Pinbelegung DVI Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -	- - 5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-03	- -	- 5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-03	- -	- -	- -
30	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-00 5CASDL.0300-03	- 5CASDL.0300-13	- 5CASDL.0300-13	- -	- 5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 19: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI Kabels:

DVI Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 20: Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

2.6.5 Ethernet 1 (ETH1)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 1 Anschluss (ETH1 ¹⁾)		
Controller	Intel 82567	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ²⁾	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾
Orange	1000 MBit/s	-
Link LED	Ein	Aus
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)

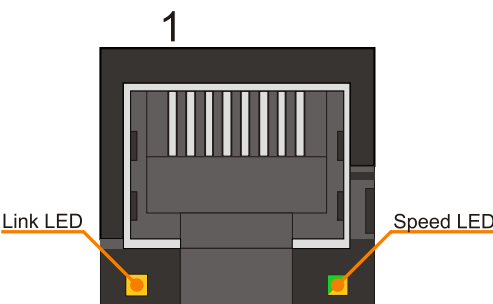


Tabelle 21: Ethernet Anschluss (ETH1)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Realtek Ethernet-Controllers 82567 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.6 Ethernet 2 (ETH2)

Dieser Ethernet Controller ist im Basisboard integriert und wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 2 Anschluss (ETH2 ¹⁾)		
Controller	Intel 82573L	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ²⁾	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾
Orange	1000 MBit/s	-
Link LED	Ein	Aus
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)

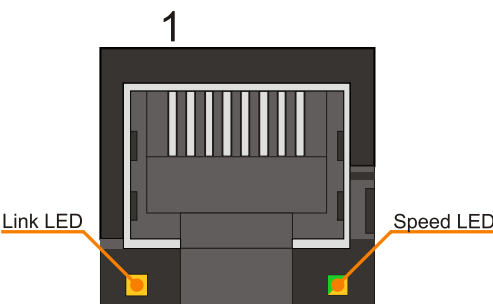


Tabelle 22: Ethernet Anschluss (ETH2)

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Umschaltung erfolgt automatisch.
- 3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82573L ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.7 USB Schnittstellen (USB1, 2, 3, 4, 5)

Die APC810 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 5 nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Information:

Weitere Informationen siehe Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt "Anschluss von USB Peripheriegeräten" auf Seite 181.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1,2,3,4

Universal Serial Bus (USB1, USB2, USB3, USB4 ¹⁾)		4 x USB Typ A, female
Typ	USB 2.0	
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit ²⁾ USB1, USB3 USB2, USB4	max. 1 A max. 500 mA	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

Tabelle 23: USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

USB5

Universal Serial Bus (USB5 ¹⁾)		1 x USB Typ A, female
Typ	USB 2.0	
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Stromversorgung ²⁾ USB5	max. 1 A	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

Tabelle 24: USB5 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 1 A) abgesichert.

2.6.8 MIC, Line IN, Line OUT

Da das bei 5PC800.BM45-0x verwendete Intel GM45 Chipset keinen AC97 Sound mehr unterstützt, werden die MIC, Line In und Line OUT nicht unterstützt.



Tabelle 25: MIC, Line IN, Line OUT

2.6.9 Add-on Schnittstellensteckplatz

Hier kann eine optionale Add-on Schnittstelle (z.B. CAN, RS485) gesteckt werden. Siehe auch "Schnittstellenoptionen (IF Option)" auf Seite 143.

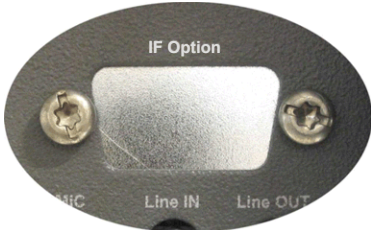
Add-on Schnittstellensteckplatz		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Serialadapter	
5AC600.CANI-00	Add-on CAN Interface	
5AC600.458I-00	Add-on RS232/422/458 Interface	

Tabelle 26: Add-on Schnittstellensteckplatz

2.6.10 Add-on USV Steckplatz

An diesem Steckplatz kann ein optionales Automation PC Add-on USV Modul oder das APC810 Ready Relais /2 montiert werden.

Add-on USV Steckplatz	
Pinbelegung bei montiertem Add-on USV Modul	
1	+
2	+
3	-
4	-
5	NTC (für Batterietemperaturmessung)
6	NTC (für Batterietemperaturmessung)
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	Add-on USV Modul
5AC600.UPSB-00	Battereeinheit 5 Ah
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m
APC810 Ready Relais	
5AC801.RDYR-01	APC810 Ready Relais /2

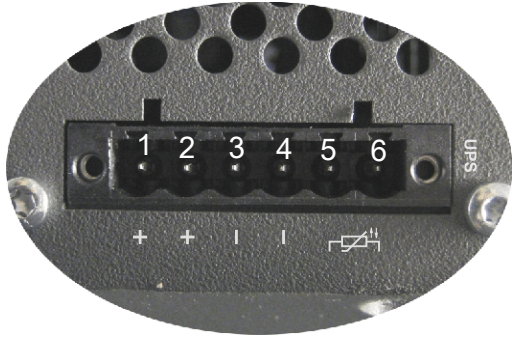
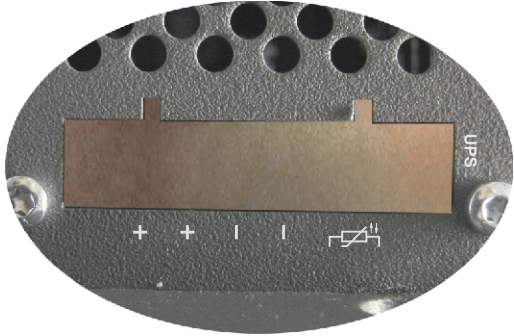


Tabelle 27: Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV)

Informationen zum USV Modul siehe Kapitel 6 "Zubehör", Abschnitt 326.

2.6.11 AP Link Steckplatz

In Verbindung mit der AP Link Steckkarte 5AC801.SDL0-00 besteht die Möglichkeit, einen zweiten Grafikstrang mit DVI und SDL aber ohne RGB Signalen zu realisieren. Weiters kann das APC810 Ready Relais 5AC801.RDYR-00 montiert werden.

Information:

Die Montage von AP Link Steckkarten ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

2.6.12 Card Slot Steckplatz (PCI / PCIe)

Je nach Variante der Buseinheit können Standard PCI 2.2 half-size Karten bzw. PCI Express (PCIe) half-size Karten gesteckt werden. Diese dürfen die nachfolgenden Abmessungen nicht überschreiten.

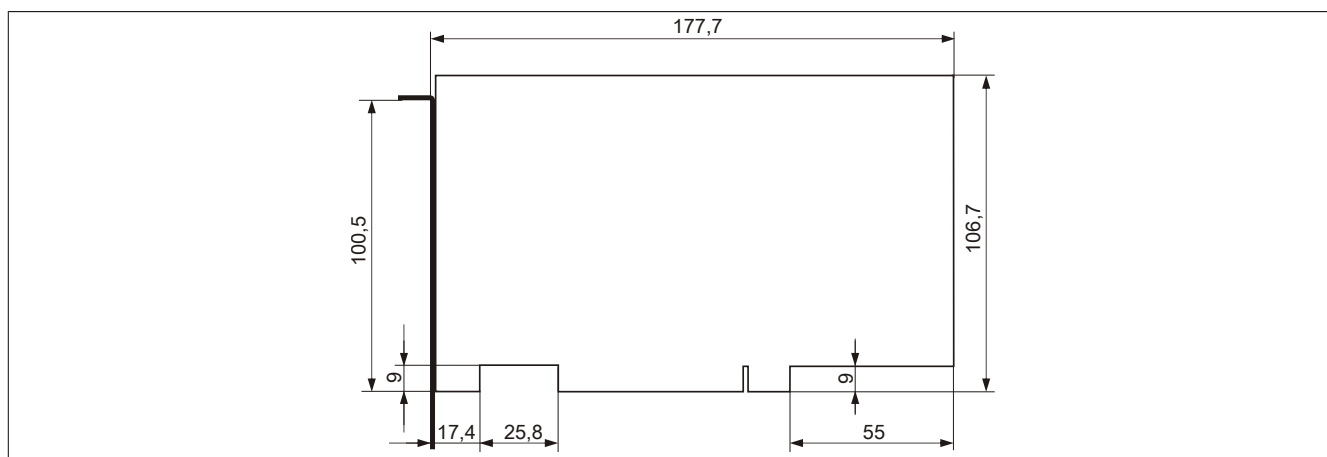


Abbildung 16: Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte

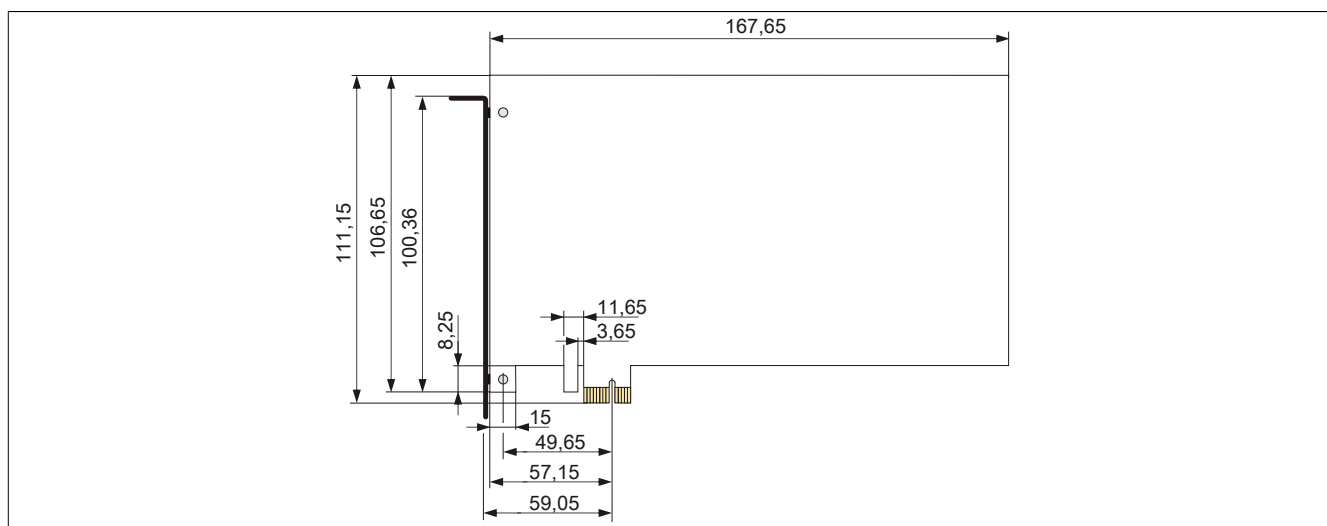
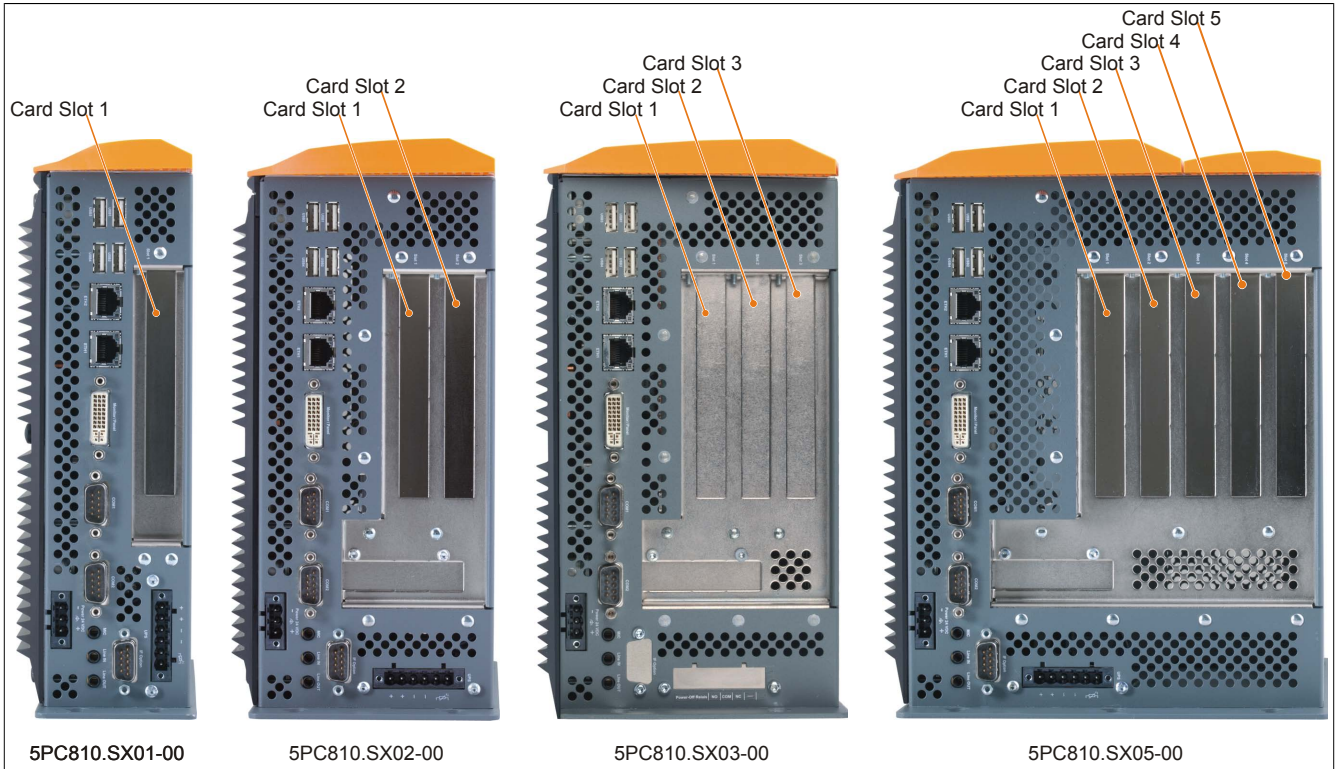


Abbildung 17: Abmessungen Standard half-size PCIe Karte

Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

Systemeinheit	Buseinheit	Card Slot 1	Card Slot 2	Card Slot 3	Card Slot 4	Card Slot 5
5PC810.SX01-00	5PC810.BX01-00	32-Bit PCI				
	5PC810.BX01-01	PCIe				
5PC810.SX02-00	5PC810.BX02-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI			
	5PC810.BX02-01	32 und 64-Bit PCI	PCIe			
5PC810.SX03-00	5PC810.BX03-00	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCIe		
5PC810.SX05-00	5PC810.BX05-00	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32-Bit PCI	PCIe
	5PC810.BX05-01	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	PCIe	PCIe	PCIe
	5PC810.BX05-02	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI	32 und 64-Bit PCI



2.6.13 Status LEDs

Die Status LEDs sind in der Systemeinheit integriert und befinden sich hinter der orangenen Frontabdeckung.

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- Stand- by Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernat e Modus -Suspend-to-Disk)
	Orange ¹⁾	Ein	Spannungsversorgung nicht OK; das System läuft im Batteriebetrieb.
HDD	Gelb	Ein	Signalisiert einen IDE Laufwerkszugriff (CF, HDD, CD, usw.)
Link1	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Monitor / Panel Stecker an.
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.
Link2	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am AP Link an.
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung am AP Link wurde durch einen Spannungsverlust der Displayeinheit unterbrochen.

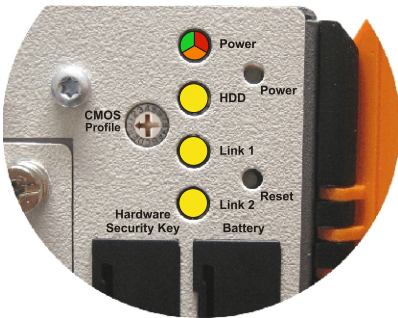


Tabelle 28: Daten Status LEDs

1) Leuchtet nur bei installierter Add-on USV.

Das Licht der Status LEDs wird über Lichtleiter an die Vorderseite der Frontabdeckung geführt.



Abbildung 18: Status LEDs Vorderseite

2.6.14 CMOS Profile Schalter

CMOS Profile Schalter	
Mit dem 16 stelligen CMOS Profile Schalter können verschiedene BIOS Defaultwerte- profile eingestellt werden.	
Schalterstellung	Beschreibung
0	Profil 0: Defaultprofil reserviert.
1	Profil 1: Optimiert für die Systemeinhei- ten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00
2	Profil 2: Optimiert für die Systemeinheit 5PC810.SX05-00
3	Profil 3: Optimiert für die Systemeinheit 5PC820.SX01-00 und 5PC820.SX01-00
4	Profil 4: Reserviert
5	Profil 5: Optimiert für die Systemeinheiten 5PC820.1505-00 und 5PC820.1906-00

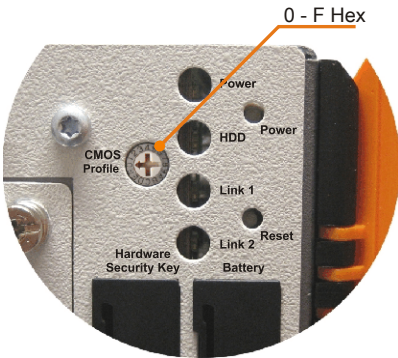


Tabelle 29: CMOS Profile Schalter

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die Position des CMOS Profile Schalters wird unter anderem in den BIOS Setupseiten und im B&R ADI Control Center angezeigt.

2.6.15 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.


Power Taster	
<p>Der Power Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-spitze) betätigt werden.</p> <p>Der Power Taster verhält sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit ATX Netzteil:</p> <p>kurzes Drücken ... APC810 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und APC810 ausschalten.</p> <p>langes Drücken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC810 aus (Da-tenverlust möglich!).</p> <p>Beim Drücken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.</p>	

Tabelle 30: Power Taster

2.6.16 Reset Taster

Information:

Ab der MTCX PX32 Firmware \geq V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware $<$ V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wieder loslassen des Reset Tasters nicht mehr.


Reset Taster	
<p>Der Reset-Taster kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-spitze) betätigt werden.</p> <p>Wenn der Reset Taster betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst. Der APC810 startet neu (Kaltstart).</p> <p>Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.</p>	

Tabelle 31: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.6.17 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) individuell gespeicherten BIOS Einstellungen sowie Daten im SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 2½ Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

Batterie	
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer	Renata 950 mAh Ja, von außen zugänglich 2½ Jahre ¹⁾
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V, 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle




Tabelle 32: Batterie

1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 33: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.6.18 Hardware Security Key (Dongle)

Als Hardware Security Key (Dongle) für den Kopierschutz der Software empfiehlt B&R einen Dongle basierend auf dem DS1425 von MAXIM (früher Dallas Semiconductors).


Hardware Security Key	
Hinter der schwarzen Abdeckung kann ein Hardware Security Key (Dongle) gesteckt werden.	

Tabelle 34: Hardware Security Key

Warnung!

Ein- und Ausbau des Hardware Security Keys darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.19 CompactFlash Slot 1

Dieser CompactFlash Slot ist fixer Bestandteil eines APC810 Systems und ist intern über eine SATA to PATA Bridge mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot (CF1)	
Anschluss	PATA Master
CompactFlash Typ	Typ I
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
CompactFlash	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte WD
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte WD
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte WD
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte WD
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1024 MByte WD
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2048 MByte WD
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4096 MByte WD
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8192 MByte WD




Tabelle 35: CompactFlash Slot (CF1)

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.20 CompactFlash Slot 2

Da das bei 5PC800.BM45-0x verwendete Intel GM45 Chipset keinen IDE (PATA) Kanal mehr unterstützt, wird der CF2 Steckplatz nicht unterstützt.


CompactFlash Slot (CF2)


Tabelle 36: CompactFlash Slot (CF2)

2.6.21 Slide-in Slot 1

Der Slide-in Slot 1 ist intern über SATA I und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 1	
Anschluss	SATA I und USB
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).

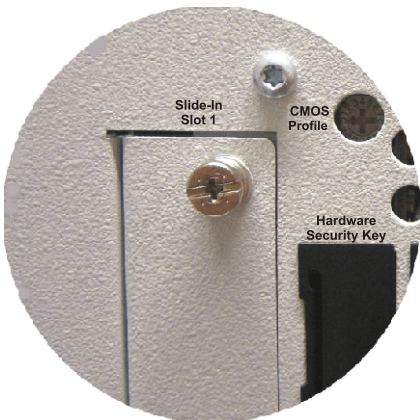


Tabelle 37: Slide-in Slot 1

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

2.6.22 Slide-in Slot 2

Der Slide-in Slot 2 ist intern über eine PCIe to SATA Bridge (SiL 3531) und USB mit dem Chipset verbunden.

Slide-in Slot 2	
Anschluss	PCIe to SATA Bridge (SiL 3531) und USB
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Laufwerke
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).




Tabelle 38: Slide-in Slot 2

Information:

Der APC810 Slide-in compact Adapter 5AC801.ADAS-00 kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Information:

Benötigte Treiber sind je nach verwendetem Betriebssystem von der B&R Homepage herunterzuladen.

2.6.23 Slide-in compact Slot

Der Slide-in compact Slot ist intern über SATA I mit dem Chipset verbunden.


Slide-in compact Slot		
Anschluss	SATA I	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	

Tabelle 39: Slide-in compact Slot

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

Einbau bzw. Tausch eines Slide-in compact Laufwerks siehe "Vorgangsweise" auf Seite 363.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

Die Systemeinheit vereint alle Einzelkomponenten in sich zu einem kompakten Gerät. Es besteht aus dem Gehäuse mit integriertem Basisboard. Die Schnittstellen sind vorderseitig hinter der orangenen Fronttüre bzw. oberseitig leicht zugänglich. Die Systemeinheiten gibt es in den Größen mit 1, 2, 3 oder 5 Card Slots.

3.1.1 5PC810.SX01-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 1 PCI oder 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX01-00	APC810 Systemeinheit 1 Slot (PCI Express, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slide-in compact Steckplatz; Smart Display Link/DVI/ Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Hauptspeicher für GM45 CPU Boards	
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	
	Kühlkörper	

Tabelle 40: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 40: 5PC810.SX01-00 - Bestelldaten

Schnittstellen

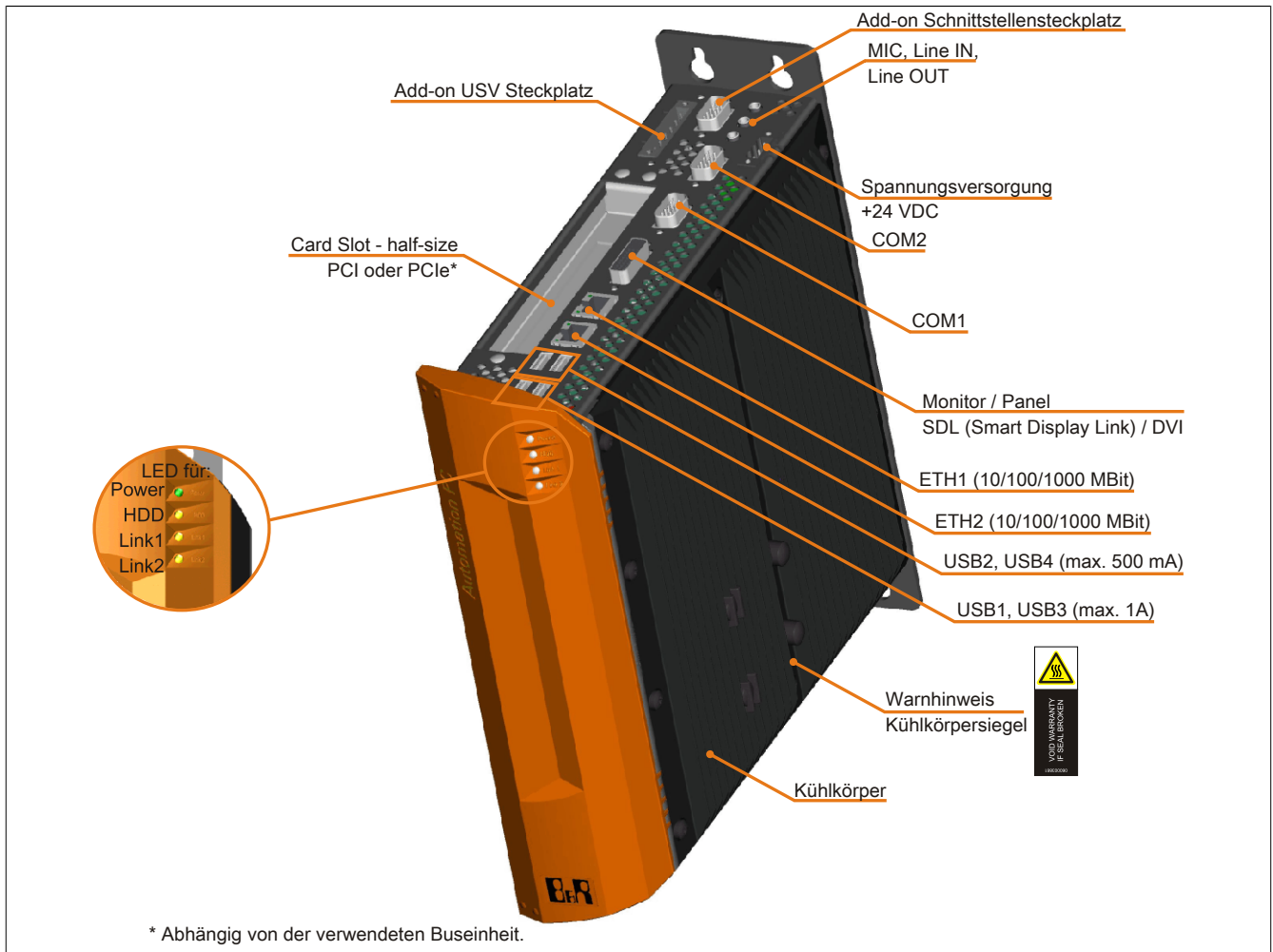


Abbildung 19: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite

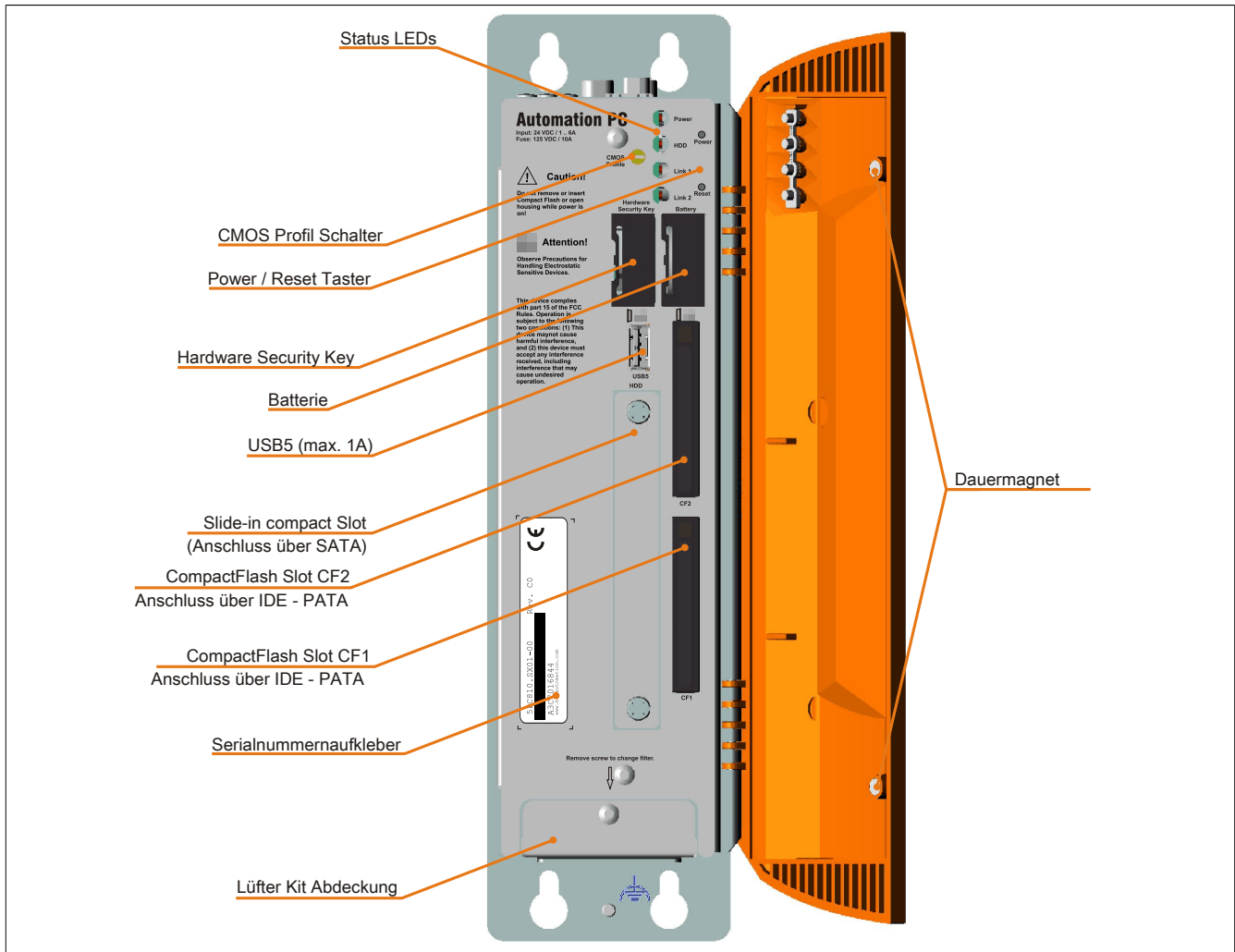


Abbildung 20: 5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$A3ED
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ¹⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttür zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ²⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)

Tabelle 41: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5PC810.SX01-00
Speicher		
Typ		abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe		abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen		
COM1		
Typ		RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung		9-poliger DSUB Stecker
UART		16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate		115 kBit/s
COM2		
Typ		RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung		9-poliger DSUB Stecker
UART		16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate		115 kBit/s
CompactFlash Slot 1		
Anzahl		1
Typ		Typ I
CompactFlash Slot 2		
Typ		Typ I
Anzahl		1
USB		
Anzahl		5
Typ		USB 2.0
Ausführung		Typ A
Übertragungsrate		Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit		je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet		
Anzahl		2
Ausführung		geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate		10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate		1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle		
Ausführung		DVI-I Buchse
Typ		SDL/DVI/Monitor
CAN		
Anmerkung		optional
Audio		
Typ		AC97 Sound
Eingänge		Mikrofon, Line In
Ausgänge		Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz		
Anzahl		1
Einschübe		
PCI / PCIe Slots		
Anzahl		1 PCI Slot oder 1 PCIe Slot ³⁾
Slide-in Laufwerke		Nein
Slide-in compact Laufwerke		1
Automation Panel Link Slot		Nein
Add-on USV Steckplatz		Ja
Einschub für Lüfter Kit		Ja
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung		24 VDC ±25%
Nennstrom		6 A
Einschaltstrom		typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Galvanische Trennung		Ja
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529		IP20
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb		komponentenabhängig
Lagerung		-20 bis 60°C
Transport		-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb		komponentenabhängig
Lagerung		komponentenabhängig
Transport		komponentenabhängig
Vibration ⁴⁾		
Betrieb (dauerhaft)		2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)		2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung		2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport		2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ⁴⁾		
Betrieb		15 g, 11 ms
Lagerung		30 g, 15 ms
Transport		30 g, 15 ms

Tabelle 41: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX01-00
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁵⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse ⁶⁾ Material Frontabdeckung Lackierung	verzinktes Blech, Kunststoff eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV) hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	81,3 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 96,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01 270 mm 252,7 mm
Gewicht	ca. 2200 g (komponentenabhängig)

Tabelle 41: 5PC810.SX01-00 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 2) Maintenance Controller Extended
- 3) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX01-00 und 5PC810.BX01-01.
- 4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 6) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Information:

Das Maß "A" ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28
5AC801.HS00-02	12,8

Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch V 1.26

Bohrschablone

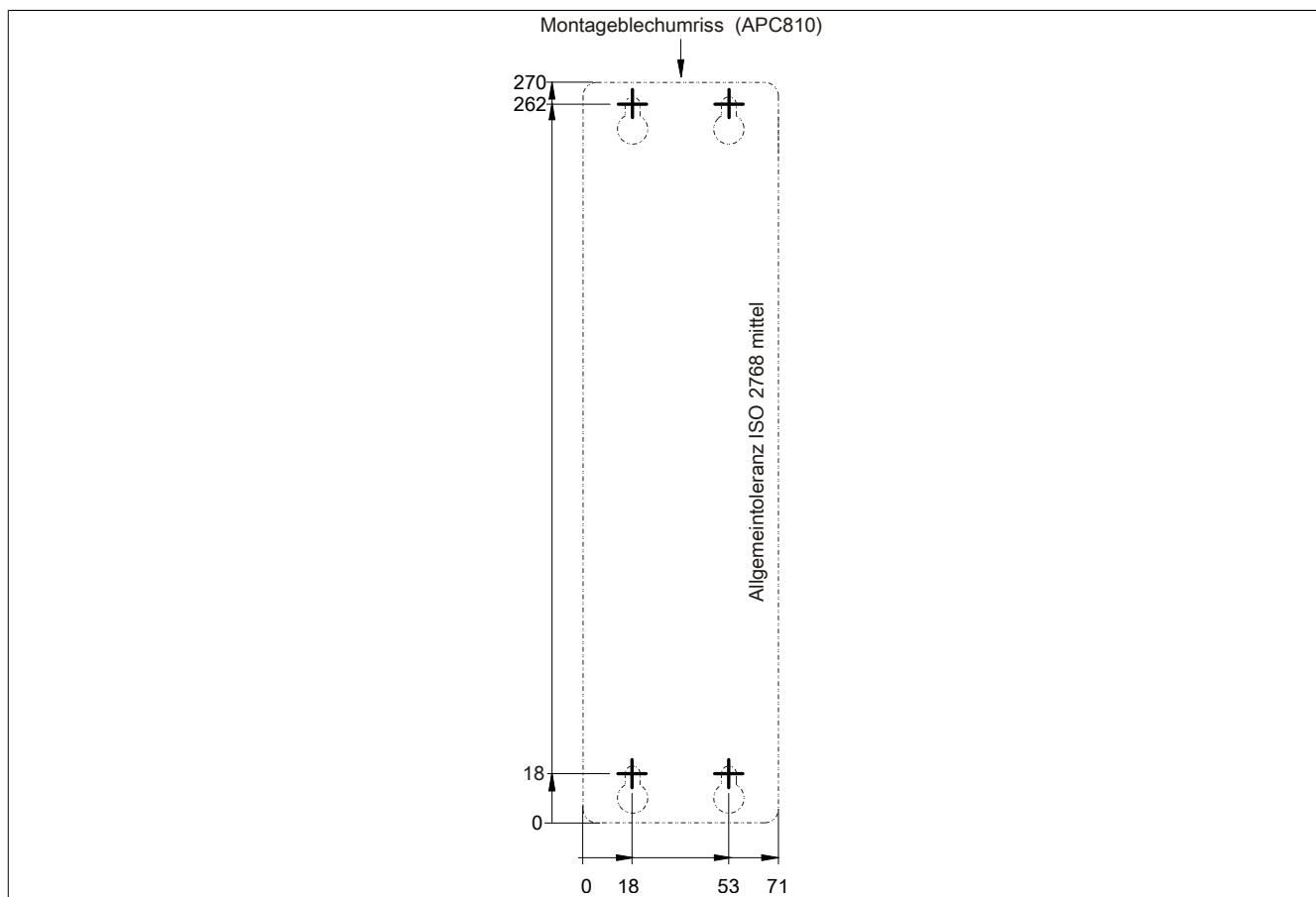


Abbildung 22: 5PC810.SX01-00 - Bohrschablone

3.1.2 5PC810.SX02-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI Slots oder 1 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX02-00	APC810 Systemeinheit 2 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/ DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Feder- zugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Hauptspeicher für GM45 CPU Boards	
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	

Tabelle 42: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 42: 5PC810.SX02-00 - Bestelldaten

Schnittstellen

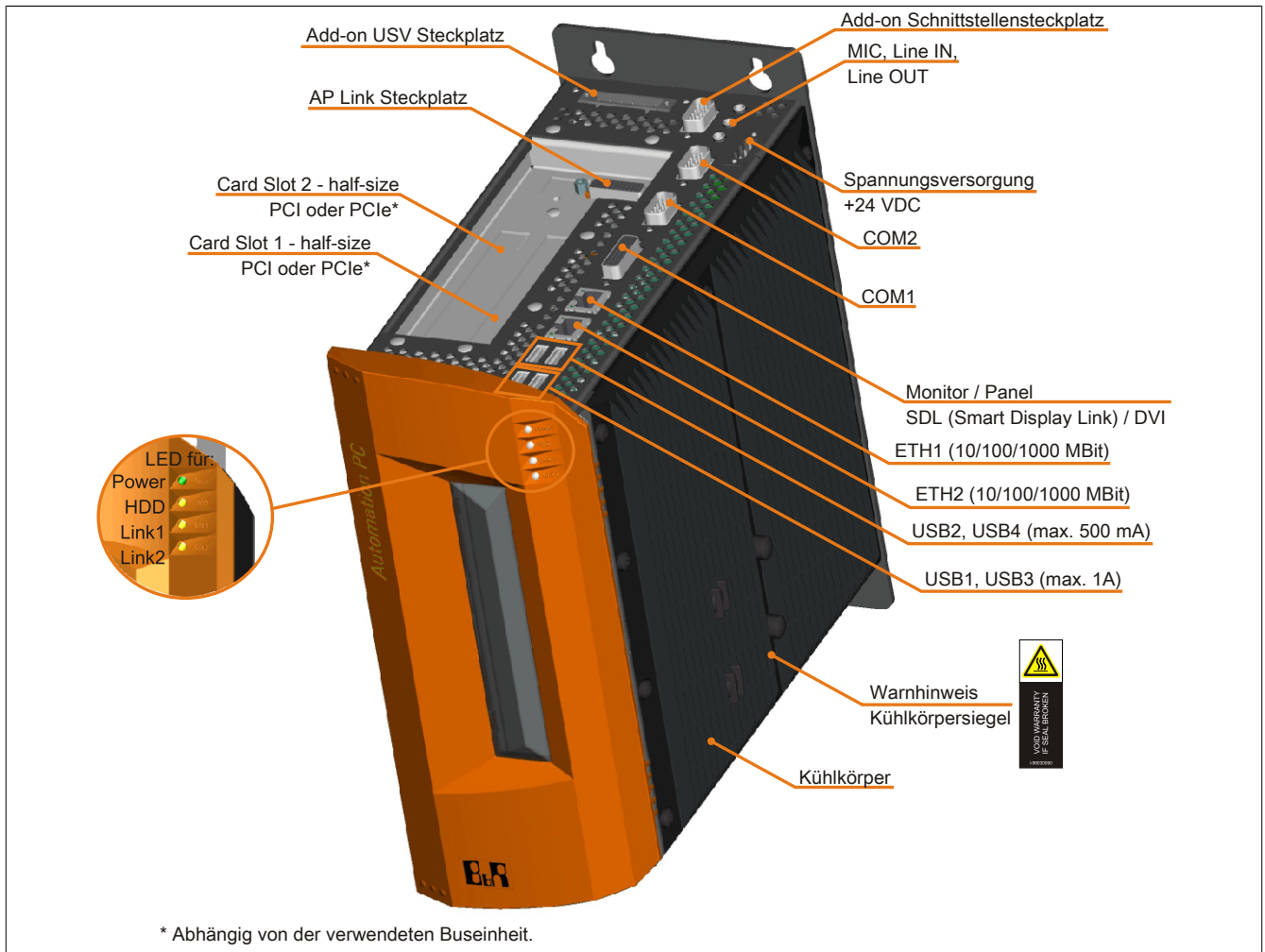


Abbildung 23: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite

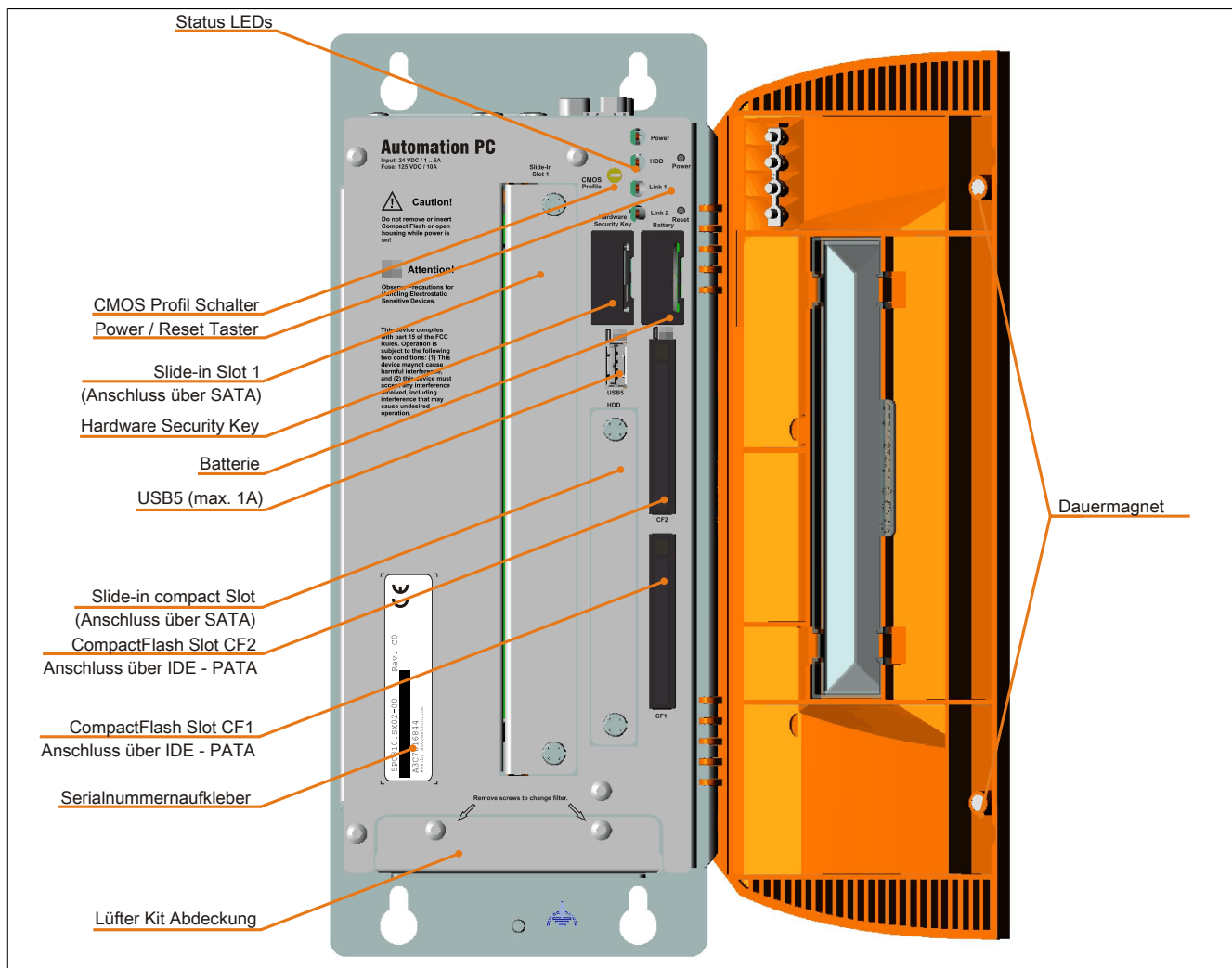


Abbildung 24: 5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$A3C7
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ¹⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttür zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ²⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja

Tabelle 43: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	
5PC810.SX02-00	
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
COM2	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
CompactFlash Slot 2	
Typ	Typ I
Anzahl	1
USB	
Anzahl	5
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet	
Anzahl	2
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate	1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI/Monitor
CAN	
Anmerkung	optional
Audio	
Typ	AC97 Sound
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz	
Anzahl	1
Einschübe	
PCI / PCIe Slots	
Anzahl	2 PCI Slots oder 1 PCI und 1PCIe Slot ³⁾
Slide-in Laufwerke	1
Slide-in compact Laufwerke	1
Automation Panel Link Slot	Ja
Add-on USV Steckplatz	Ja
Einschub für Lüfter Kit	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	6 A
Einschaltstrom	typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	komponentenabhängig
Lagerung	komponentenabhängig
Transport	komponentenabhängig
Vibration ⁴⁾	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ⁴⁾	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms

Tabelle 43: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX02-00
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁵⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse ⁶⁾	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	120,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 136 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,6 mm
Gewicht	ca. 2800 g (komponentenabhängig)

Tabelle 43: 5PC810.SX02-00 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 2) Maintenance Controller Extended
- 3) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX02-00 und 5PC810.BX02-01.
- 4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 6) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

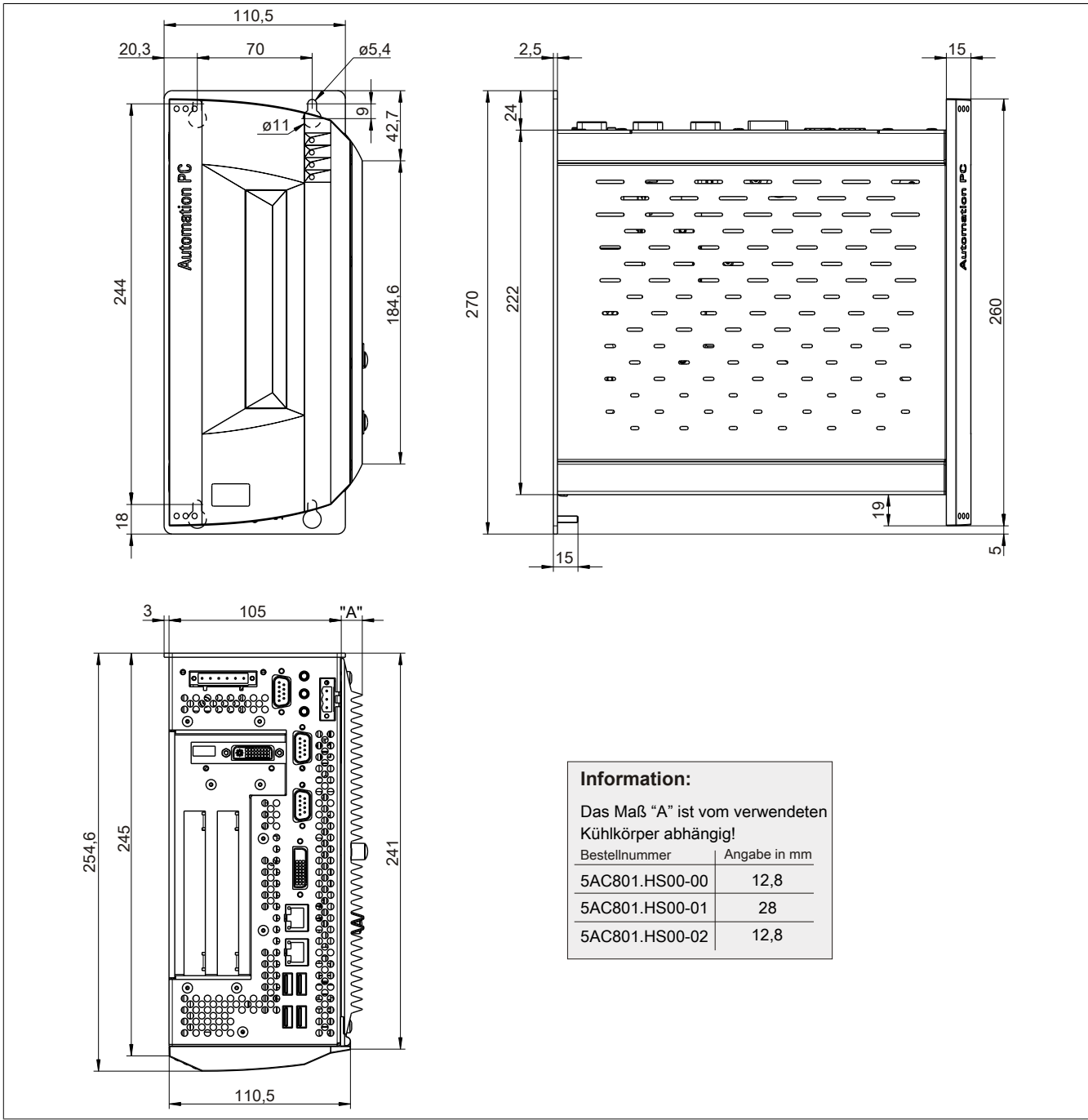


Abbildung 25: 5PC810.SX02-00 - Abmessungen

Bohrschablone

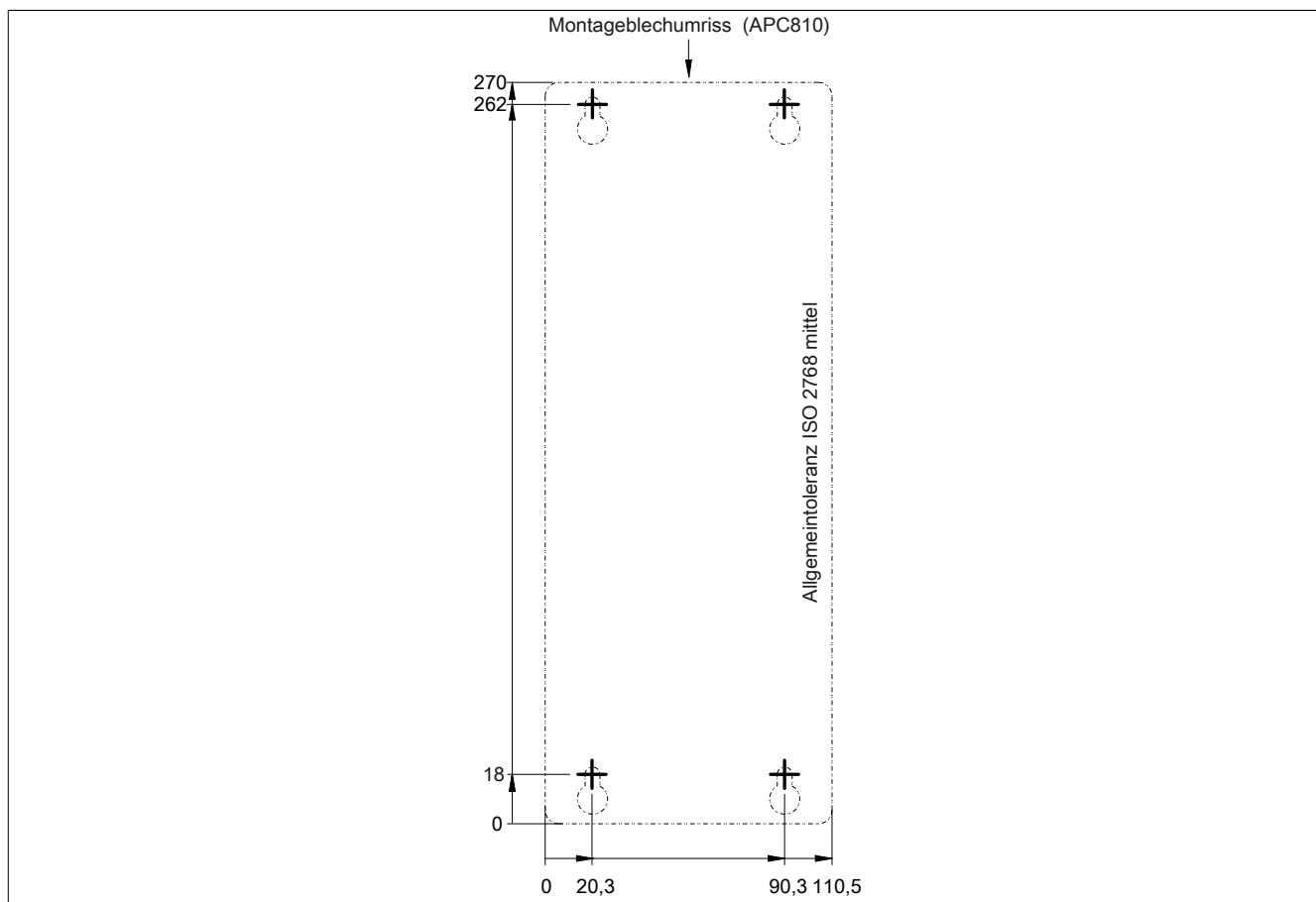


Abbildung 26: 5PC810.SX02-00 - Bohrschablone

3.1.3 5PC810.SX03-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI und 1 PCIe Slot
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC810.SX03-00	APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Buseinheiten	
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	
	CPU Boards	
5PC800.B945-05	Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-10	Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-11	Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-12	Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-13	Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Hauptspeicher für GM45 CPU Boards	
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-00	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
5AC801.HS00-02	APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.	
	Optionales Zubehör	
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	

Tabelle 44: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 44: 5PC810.SX03-00 - Bestelldaten

Schnittstellen

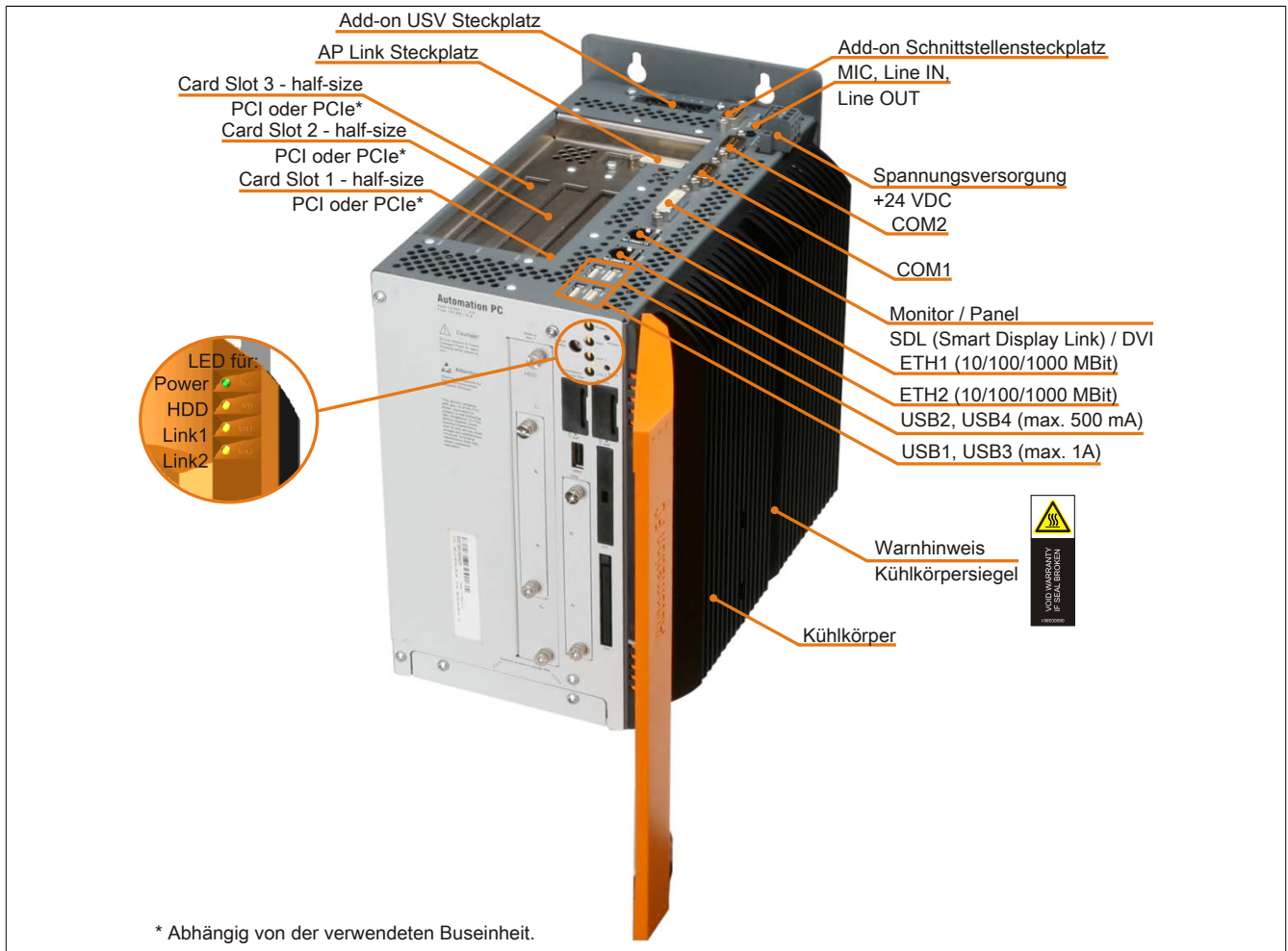


Abbildung 27: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite

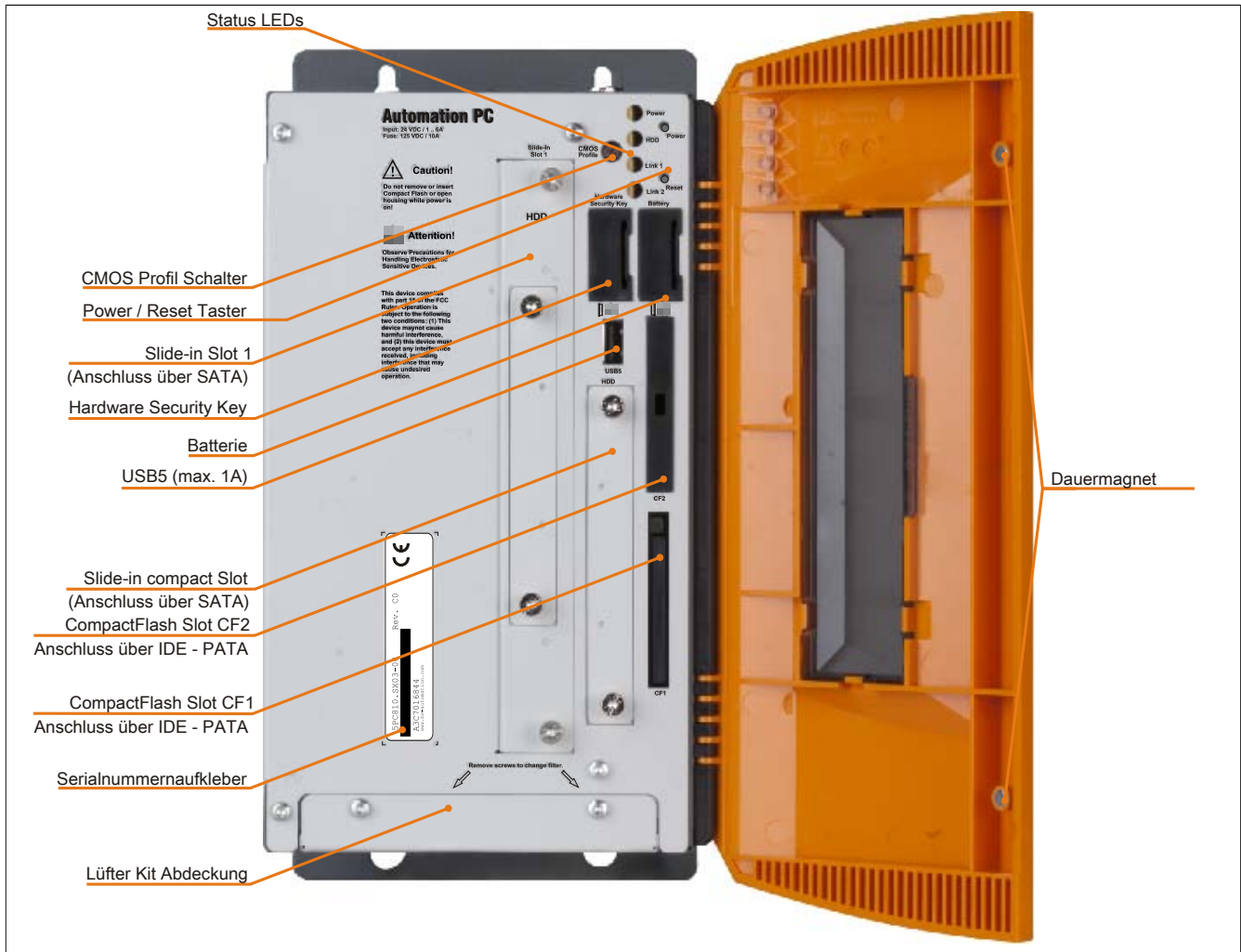


Abbildung 28: 5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$B2C3
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ¹⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttür zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ²⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)

Tabelle 45: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5PC810.SX03-00
Speicher		
Typ		abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe		abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen		
COM1		
Typ		RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung		9-poliger DSUB Stecker
UART		16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate		115 kBit/s
COM2		
Typ		RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung		9-poliger DSUB Stecker
UART		16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate		115 kBit/s
CompactFlash Slot 1		
Anzahl		1
Typ		Typ I
CompactFlash Slot 2		
Typ		Typ I
Anzahl		1
USB		
Anzahl		5
Typ		USB 2.0
Ausführung		Typ A
Übertragungsrate		Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit		je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet		
Anzahl		2
Ausführung		geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate		10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate		1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle		
Ausführung		DVI-I Buchse
Typ		SDL/DVI/Monitor
CAN		
Anmerkung		optional
Audio		
Typ		AC97 Sound
Eingänge		Mikrofon, Line In
Ausgänge		Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz		
Anzahl		1
Einschübe		
PCI / PCIe Slots		
Anzahl		2 PCI und 1 PCIe Slot ³⁾
Slide-in Laufwerke		1
Slide-in compact Laufwerke		1
Automation Panel Link Slot		Ja
Add-on USV Steckplatz		Ja
Einschub für Lüfter Kit		Ja
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung		24 VDC ±25%
Nennstrom		6 A
Einschaltstrom		typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Galvanische Trennung		Ja
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529		IP20
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb		komponentenabhängig
Lagerung		-20 bis 60°C
Transport		-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb		komponentenabhängig
Lagerung		komponentenabhängig
Transport		komponentenabhängig
Vibration ⁴⁾		
Betrieb (dauerhaft)		2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)		2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung		2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport		2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ⁴⁾		
Betrieb		15 g, 11 ms
Lagerung		30 g, 15 ms
Transport		30 g, 15 ms

Tabelle 45: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX03-00
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁵⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse ⁶⁾ Material Frontabdeckung Lackierung	verzinktes Blech, Kunststoff eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV) hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	140,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 156,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01 270 mm 254,6 mm
Gewicht	ca. 3200 g (komponentenabhängig)

Tabelle 45: 5PC810.SX03-00 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 2) Maintenance Controller Extended
- 3) Es kann die Buseinheit 5PC810.BX03-00 mit 2 PCI und 1 PCIe Slot verwendet werden.
- 4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 6) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

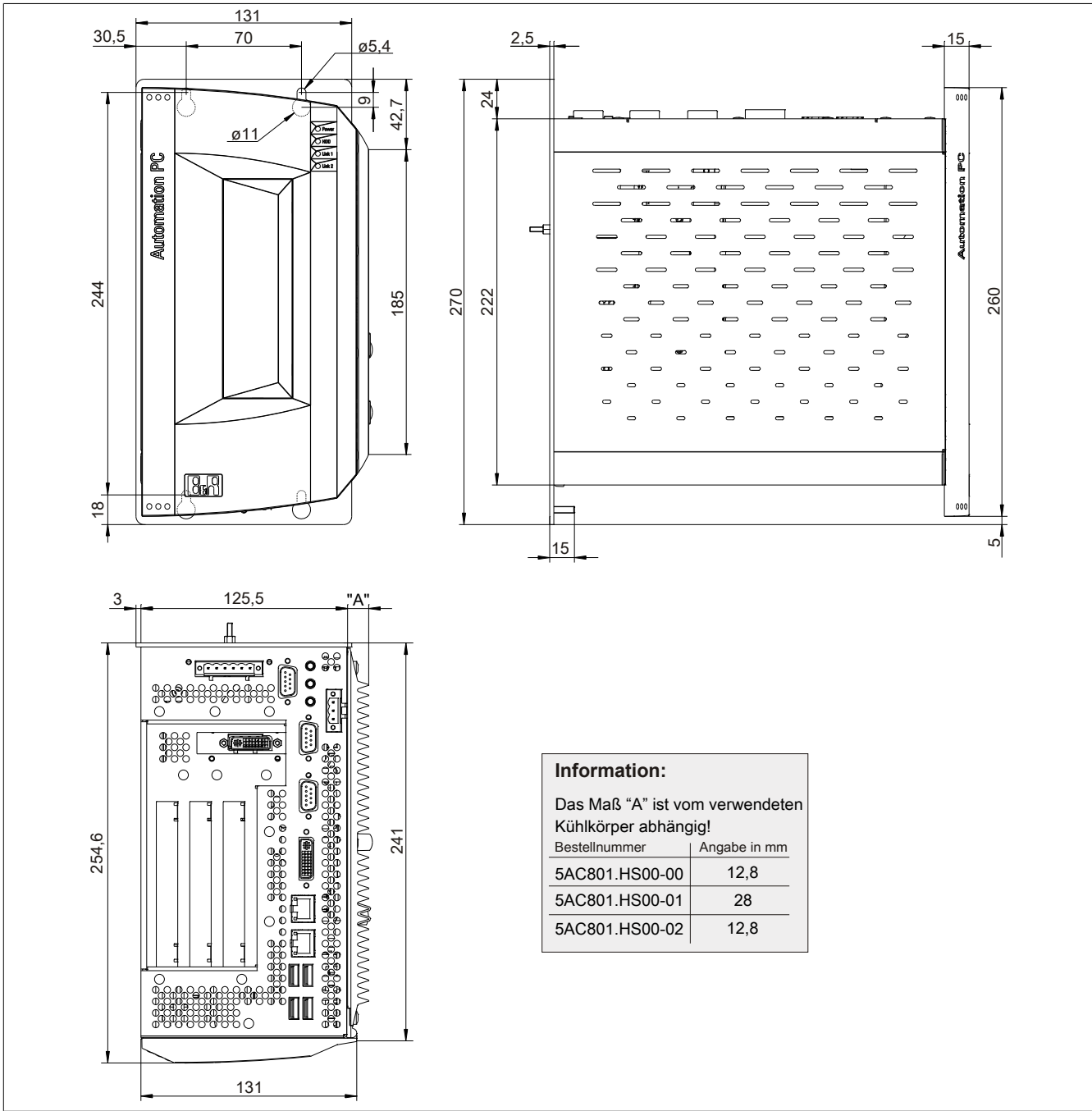


Abbildung 29: 5PC810.SX03-00 - Abmessungen

Bohrschablone

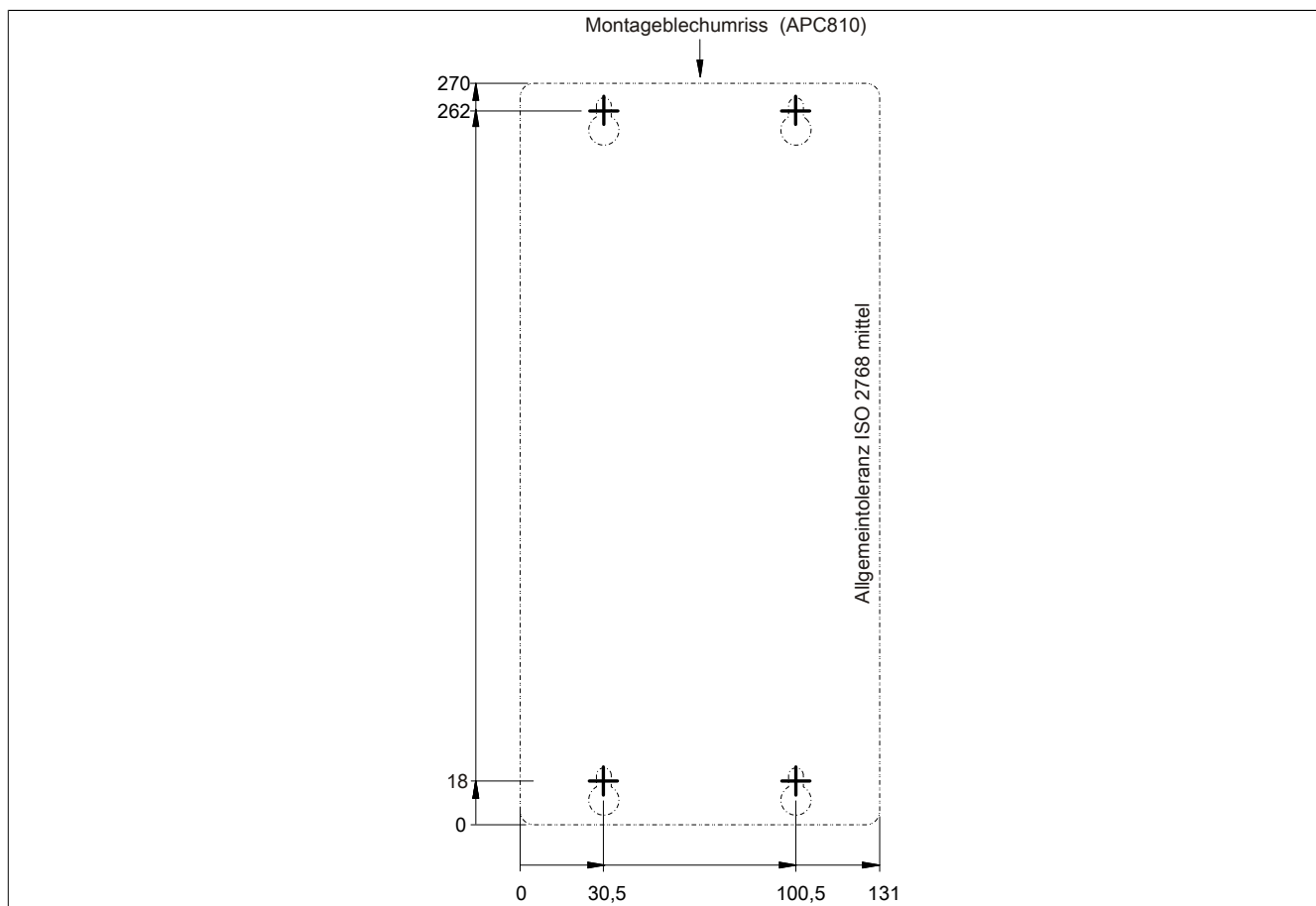


Abbildung 30: 5PC810.SX03-00 - Bohrschablone

3.1.4 5PC810.SX05-00

Allgemeines

- Steckplatz für eine Buseinheit mit 4 PCI und 1 PCIe Slot oder 2 PCI und 3 PCIe Slots
- SRAM 512 kByte onboard
- Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 2 Slide-in Laufwerke
- Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
Systemeinheiten		
5PC810.SX05-00		
Erforderliches Zubehör		
Buseinheiten		
5PC810.BX05-00		
5PC810.BX05-01		
5PC810.BX05-02		
CPU Boards		
5PC800.B945-05		
5PC800.B945-10		
5PC800.B945-11		
5PC800.B945-12		
5PC800.B945-13		
5PC800.B945-14		
5PC800.BM45-00		
5PC800.BM45-01		
Feldklemmen		
0TB103.9		
0TB103.91		
Hauptspeicher		
5MMDDR.0512-01		
5MMDDR.1024-01		
5MMDDR.2048-01		
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards		
5MMDDR.2048-02		
5MMDDR.4096-02		
Kühlkörper		
5AC801.HS00-00		
5AC801.HS00-01		
5AC801.HS00-02		
Optionales Zubehör		
Automation Panel Link Steckkarten		

Tabelle 46: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.RDYR-00	Ready Relais für APC810	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	
5AC801.DVDS-00	DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	
5ACPCI.RAIC-05	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Lüfter Kit	
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	
	Serialadapter	
5AC600.485I-00	RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 46: 5PC810.SX05-00 - Bestelldaten

Schnittstellen

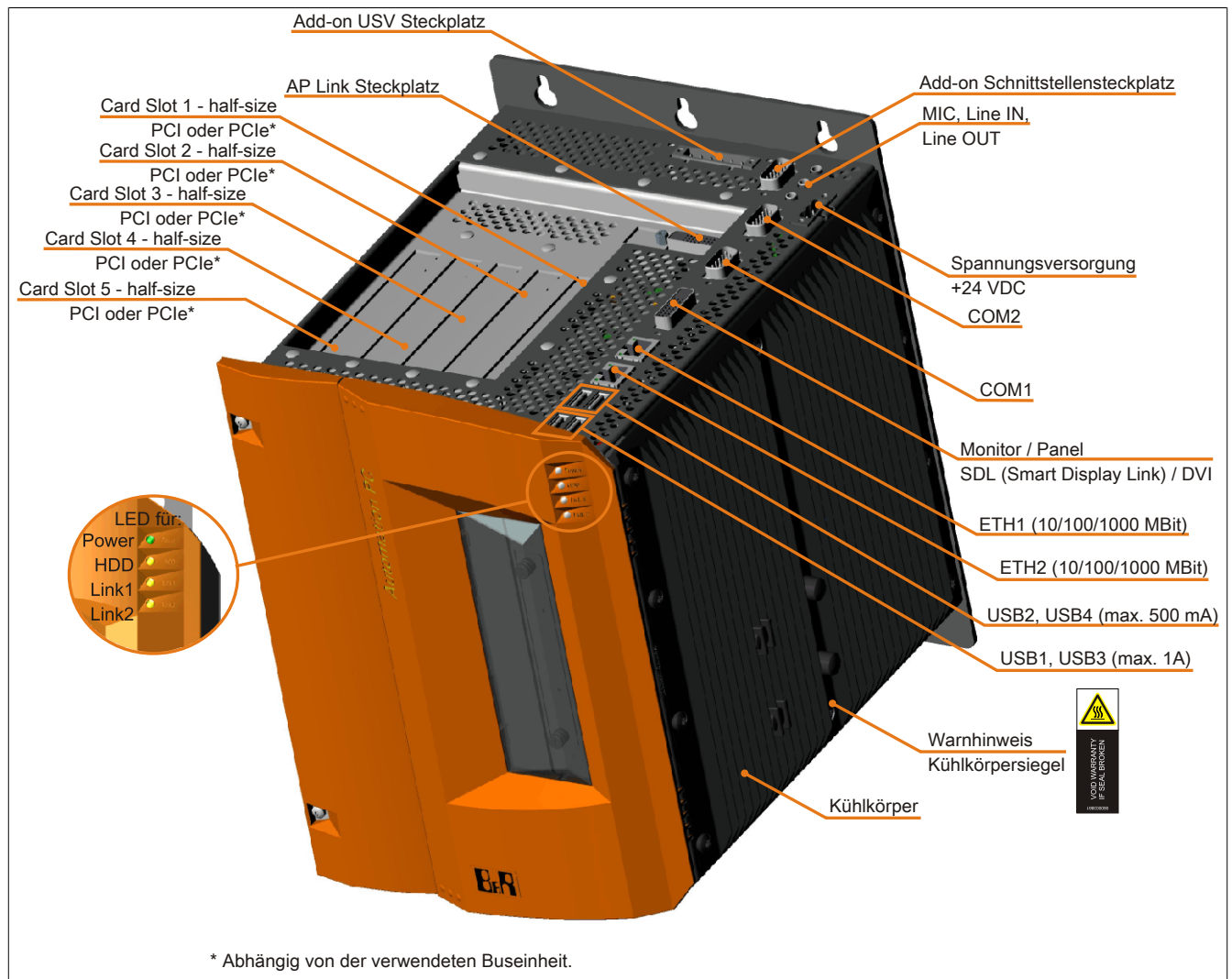


Abbildung 31: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite

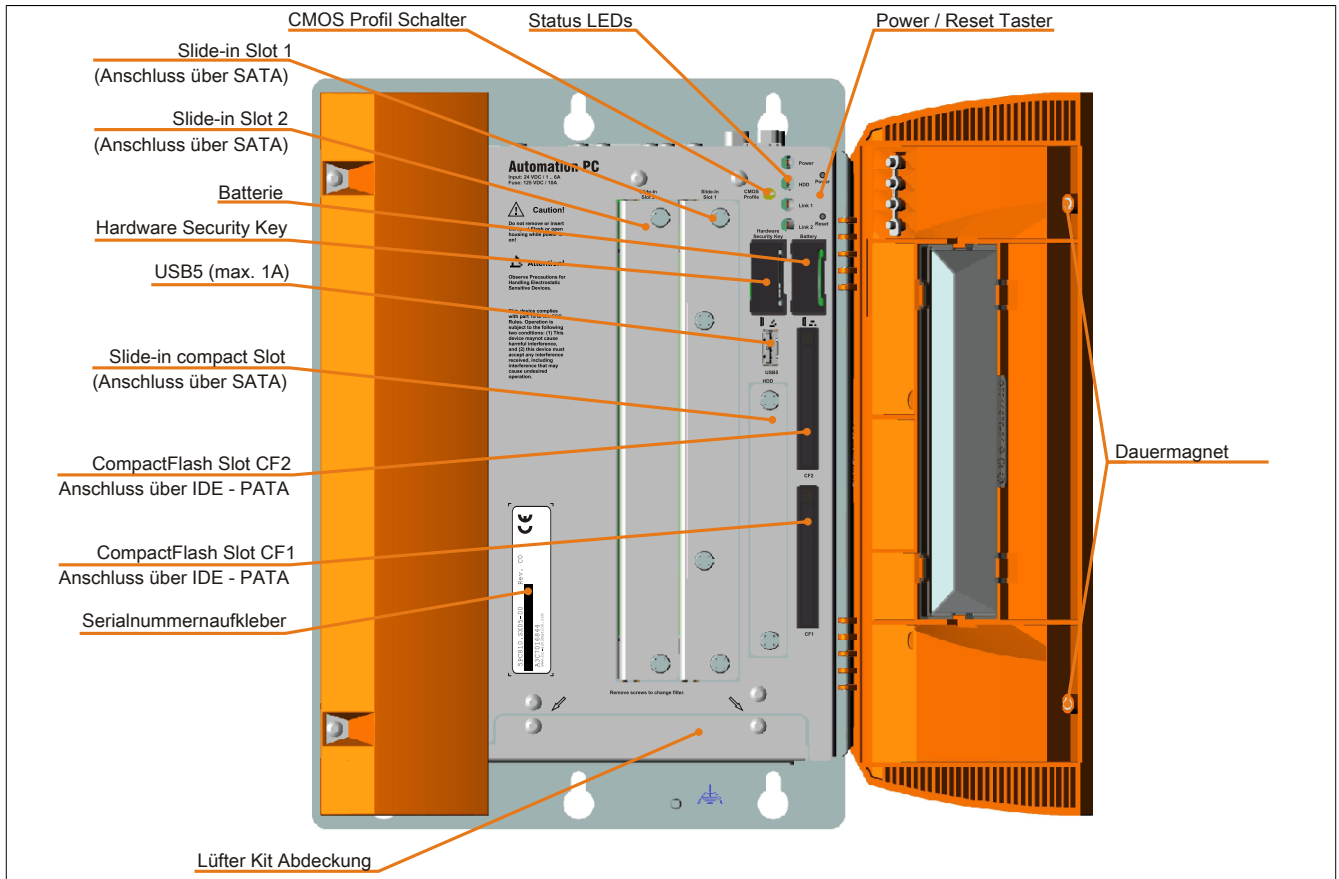


Abbildung 32: 5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00
Allgemeines	
Donglehalter	Ja
Kühlung	Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
LEDs	Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code	\$A3EE
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	2½ Jahre ¹⁾
tauschbar	Ja, hinter der orangen Fronttür zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power Taster	Ja
Reset Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Echtzeituhr	
batteriegepuffert	Ja
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ²⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Speicher	
Typ	abhängig vom verwendeten CPU Board
Größe	abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt

Tabelle 47: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5PC810.SX05-00
Ausführung UART max. Baudrate		9-poliger DSUB Stecker 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO 115 kBit/s
COM2 Typ Ausführung UART max. Baudrate		RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt 9-poliger DSUB Stecker 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1 Anzahl Typ		1 Typ I
CompactFlash Slot 2 Typ Anzahl		Typ I 1
USB Anzahl Typ Ausführung Übertragungsrate Strombelastbarkeit		5 USB 2.0 Typ A Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet Anzahl Ausführung Übertragungsrate max. Baudrate		2 geschirmter RJ45 Port 10/100/1000 MBit/s 1 GBit/s
Panel/ Monitor Schnittstelle Ausführung Typ		DVI-I Buchse SDL/DVI/Monitor
CAN Anmerkung		optional
Audio Typ Eingänge Ausgänge		AC97 Sound Mikrofon, Line In Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz Anzahl		1
Einschübe		
PCI / PCIe Slots Anzahl		4 PCI und 1 PCIe Slots oder 2 PCI und 3 PCIe Slots oder 5 PCI Slots ³⁾
Slide-in Laufwerke		2
Slide-in compact Laufwerke		1
Automation Panel Link Slot		Ja
Add-on USV Steckplatz		Ja
Einschub für Lüfter Kit		Ja
Elektrische Eigenschaften		
Nennspannung		24 VDC ±25%
Nennstrom		6 A
Einschaltstrom		typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Galvanische Trennung		Ja
Einsatzbedingungen		
Schutzart nach EN 60529		IP20
Umgebungsbedingungen		
Temperatur Betrieb Lagerung Transport		komponentenabhängig -20 bis 60°C -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport		komponentenabhängig komponentenabhängig komponentenabhängig
Vibration ⁴⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport		2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock ⁴⁾ Betrieb Lagerung Transport		15 g, 11 ms 30 g, 15 ms 30 g, 15 ms
Meereshöhe Betrieb		max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁵⁾
Mechanische Eigenschaften		
Gehäuse ⁶⁾		

Tabelle 47: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.SX05-00
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	201,7 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02 216,9 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe	270 mm
Tiefe	254,5 mm
Gewicht	ca. 3900 g (komponentenabhängig)

Tabelle 47: 5PC810.SX05-00 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 2) Maintenance Controller Extended
- 3) Die PCI Slots und PCIe Slots sind abhängig von der verwendeten Buseinheit 5PC810.BX05-00 und 5PC810.BX05-01.
- 4) Maximalwerte, sofern eine Einzelkomponente keinen anderen angibt.
- 5) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- 6) Prozess- bzw. chargenbedingt sind optische Abweichungen in der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit möglich.

Abmessungen

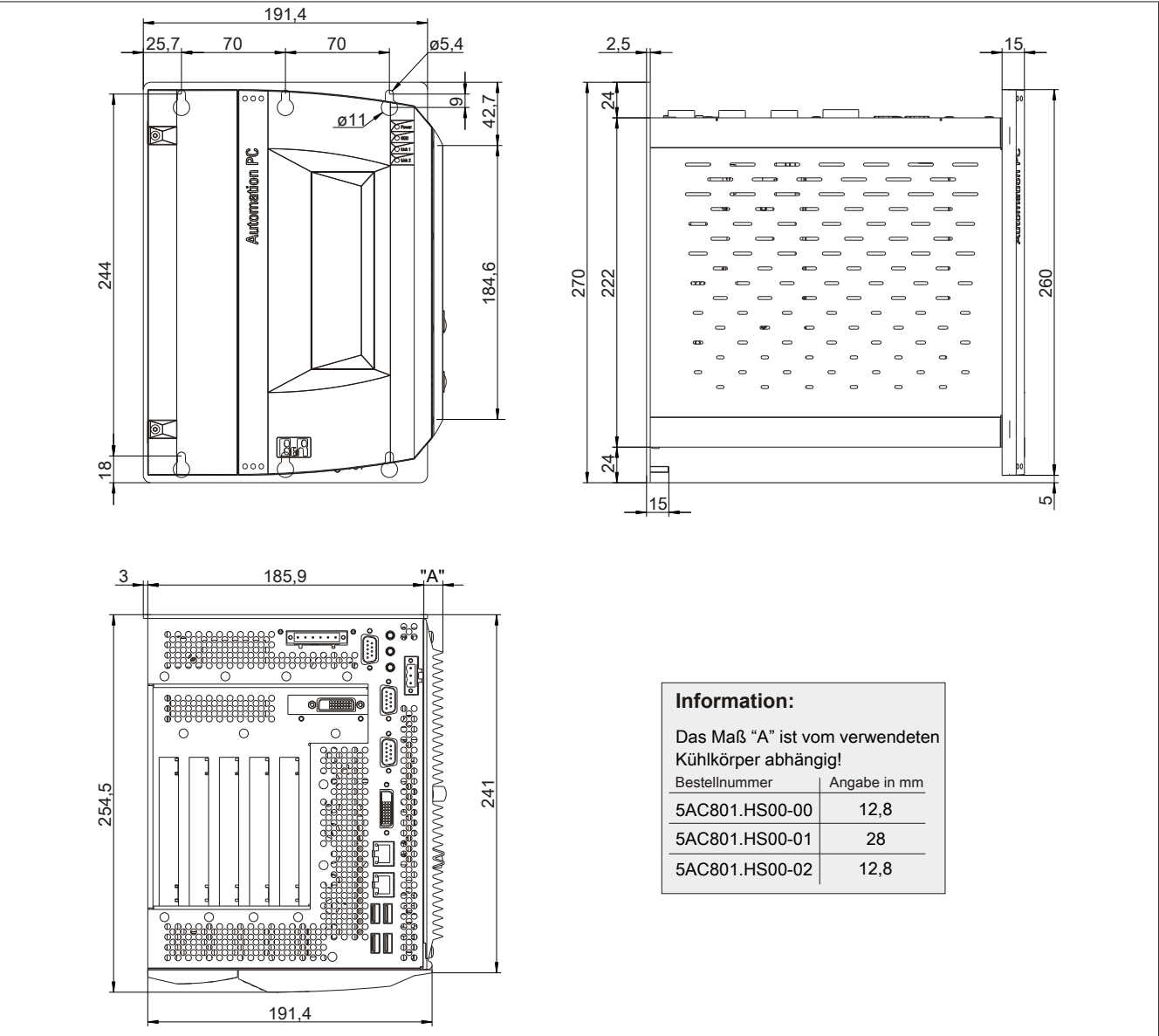


Abbildung 33: 5PC810.SX05-00 - Abmessungen

Bohrschablone

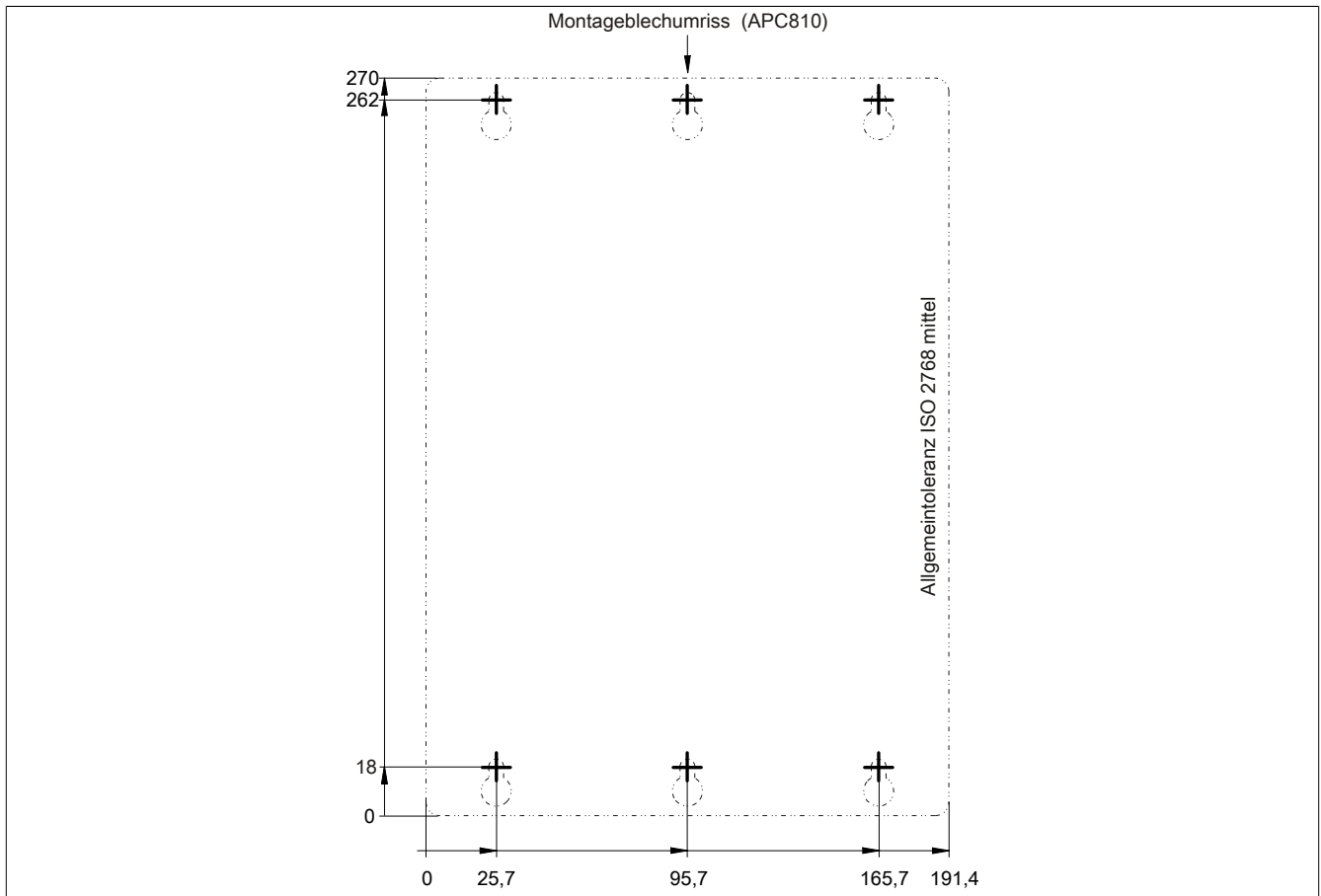


Abbildung 34: 5PC810.SX05-00 - Bohrschablone

3.2 Buseinheiten

3.2.1 Allgemeines

Die Buseinheiten sind passend zu den Systemeinheiten in 1, 2, 3 bzw. 5 Card Slot Größen mit PCI und / oder PCI Express Unterstützung erhältlich.

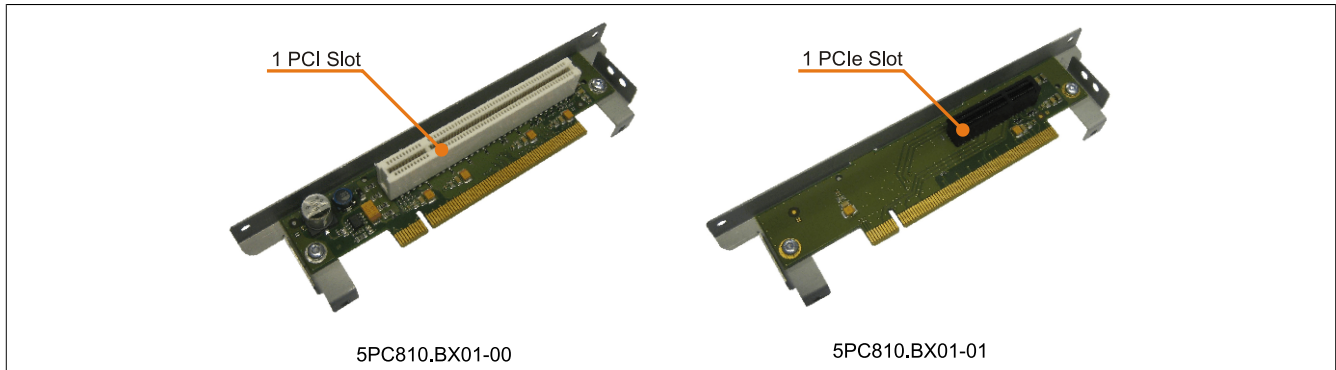


Abbildung 35: 1 Slot Buseinheiten

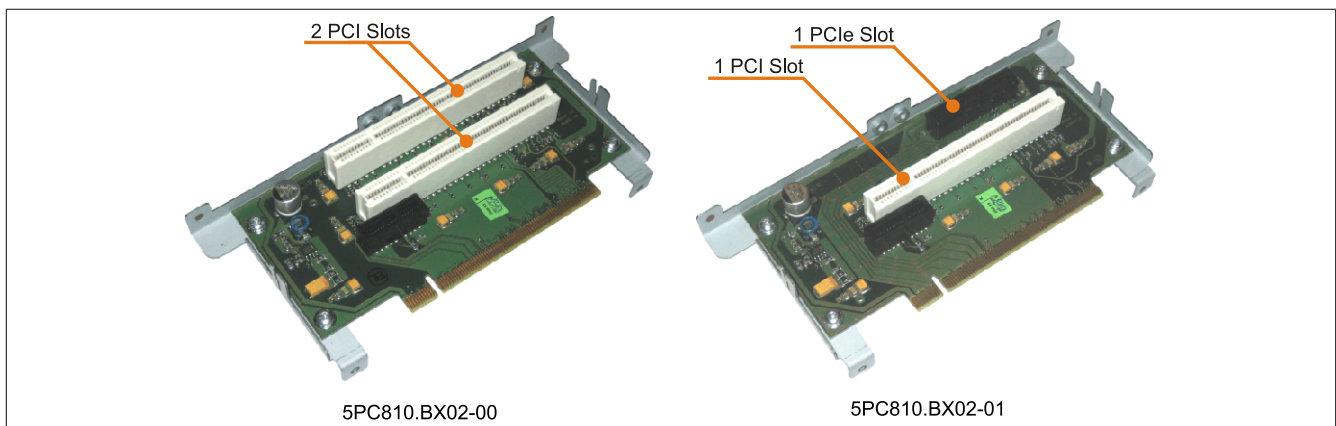


Abbildung 36: 2 Slot Buseinheiten

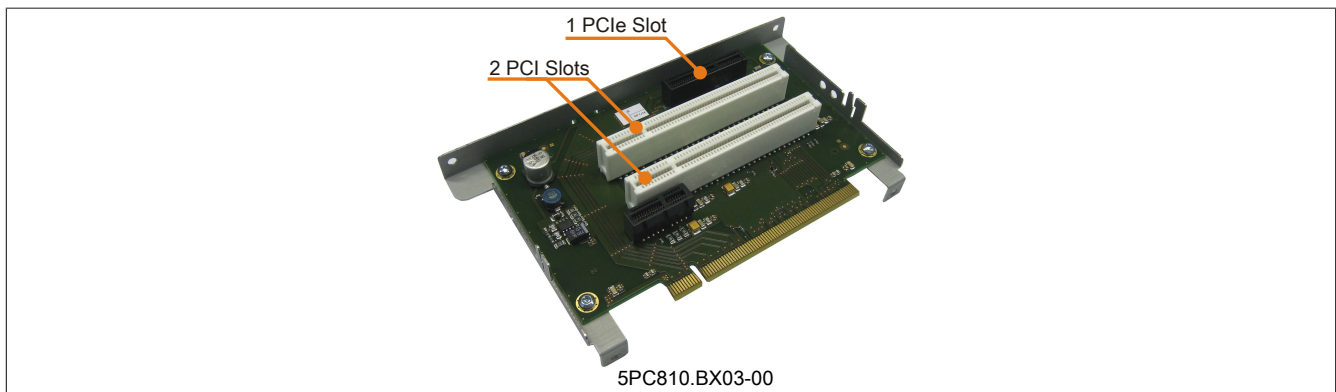


Abbildung 37: 3 Slot Buseinheit

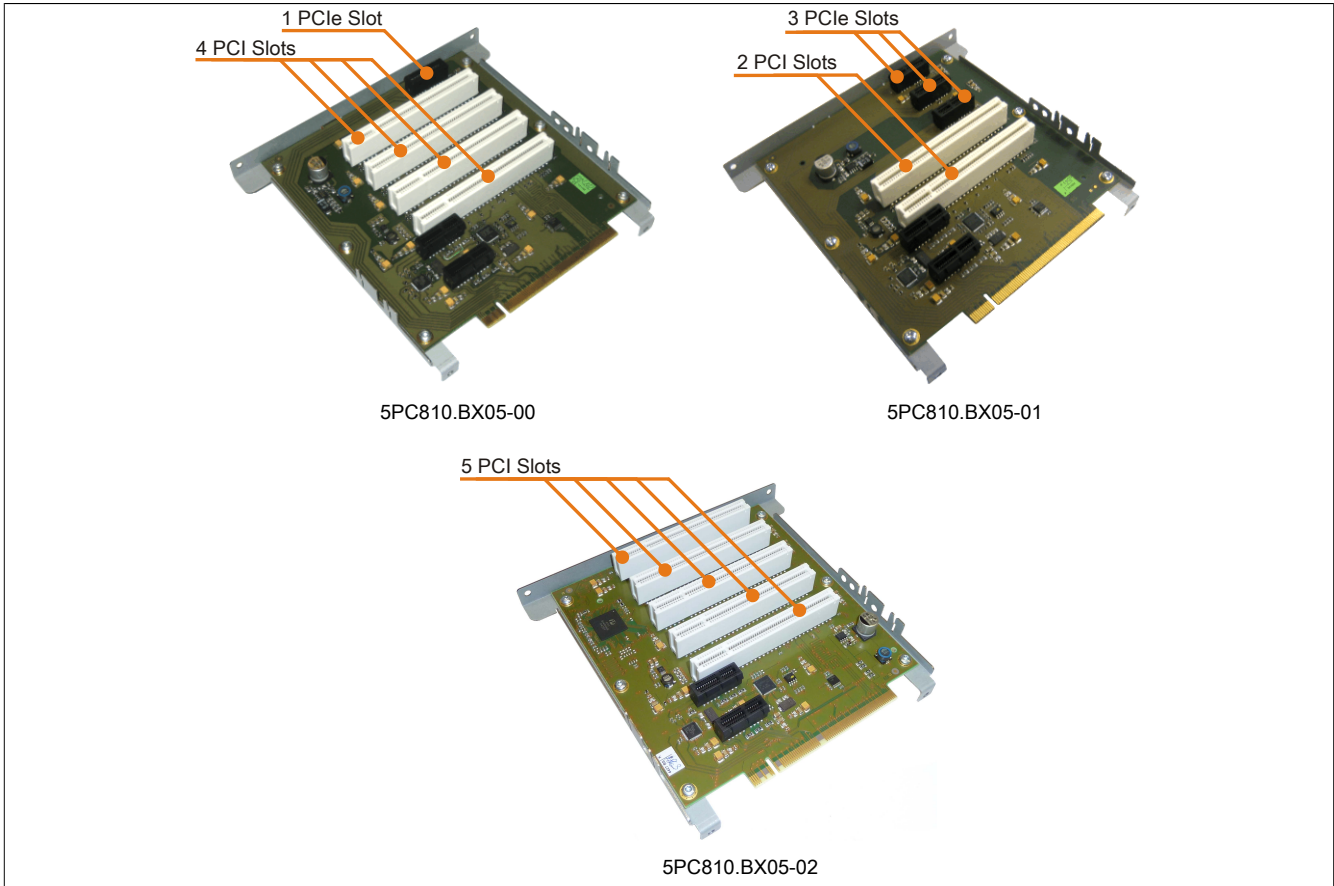


Abbildung 38: 5 Slot Buseinheiten

3.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Buseinheiten	
5PC810.BX01-00	APC810 Bus, 1 PCI	
5PC810.BX01-01	APC810 Bus, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX02-00	APC810 Bus, 2 PCI	
5PC810.BX02-01	APC810 Bus, 1 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX03-00	APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)	
5PC810.BX05-00	APC810 Bus, 4 PCI, 1 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-01	APC810 Bus, 2 PCI, 3 PCI Express (x1)	
5PC810.BX05-02	APC810 Bus, 5 PCI	

Tabelle 48: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.BX01-00	5PC810.BX01-01	5PC810.BX02-00	5PC810.BX02-01	5PC810.BX03-00	5PC810.BX05-00	5PC810.BX05-01	5PC810.BX05-02
Einschübe								
PCIe Slots								
Anzahl	-	1	-	1	1	1	3	-
Ausführung	-	PCIe half-size	-	PCIe half-size	PCIe half-size	PCIe half-size	PCIe half-size	-
Standard	-	1.0a	-	1.0a	1.0a	1.0a	1.0a	-
Bus Speed	-	x4 (10 GByte/s)	-	x4 (10 GByte/s)	x4 (10 GByte/s)	x1 (2,5 GByte/s)	x1 (2,5 GByte/s)	-
PCI Slots								
Anzahl	1	-	2	1	2	4	2	5
Typ	32 Bit	-	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Ausführung	PCI half-size	-	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size	PCI half-size

Tabelle 49: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810. BX01-00	5PC810. BX01-01	5PC810. BX02-00	5PC810. BX02-01	5PC810. BX03-00	5PC810. BX05-00	5PC810. BX05-01	5PC810. BX05-02
Standard	2.2 ¹⁾	-	2.2 ¹⁾	2.2 ¹⁾	2.2 ¹⁾	2.2 ¹⁾	2.2 ¹⁾	2.2 ¹⁾
Bus Speed	33 MHz	-	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz	33 MHz
PCI to PCI Bridge	-	-	-	-	-	-	-	Ja, Slot 4 und 5

Tabelle 49: 5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01,
5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten

- 1) Aufgrund mechanischer Einschränkungen kann eine 64-Bit PCI Karte nicht in jede Systemeinheit bzw. jeden Card Slot gesteckt werden. Eine Tabelle im Anwenderhandbuch gibt eine Übersicht in welchen Card Slot das Stecken von 64-Bit Karten möglich ist.

3.3 CPU Boards GM45

3.3.1 Allgemeines

Die GM45 CPU Boards verfügen über zwei DDR3 Speichersockel für maximal 8 GByte und unterstützen die Dual Channel Memory Technology. Desweiteren ist der Intel® GMA 4500MDH mit 384 MByte Speicher und einer maximalen Auflösung von 2048 x 1537 Pixel (QXGA) integriert.

- AMI BIOS
- Intel® GM45 Chipsatz
- 2x DDR3 Speichersockel
- Dual Channel Memory
- Intel® GMA 4500MDH
- Gigabit Ethernet
- Intel® Core™ 2 Duo T9400 2,53 GHz

3.3.2 Bestelldaten

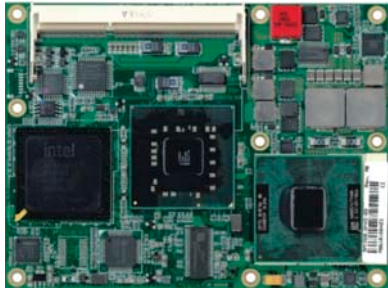
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher für GM45 CPU Boards	
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	

Tabelle 50: 5PC800.BM45-00, 5PC800.BM45-01 - Bestelldaten

3.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01
Allgemeines		
Zertifizierungen CE	Ja	
Controller		
Boot-Loader	embedded AMI BIOS	
Prozessor		
Typ	Intel® Core™2 Duo T9400	Intel® Core™2 Duo P8400
Taktfrequenz	2530 MHz	2260 MHz
Anzahl der Kerne	2	
Architektur	45 nm	
L1 Cache	32 kByte	
L2 Cache	6 MByte	3 MByte
Externer Bus	1066 MHz	
Intel® 64 Architecture	Ja	
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja	
Enhanced Intel SpeedStep® Technology	Ja	
Erweiterter Befehlssatz	G4 Architecture, SSE, SSE2, SSE3	
Chipsatz	Intel® GM45 Intel® 82801 (ICH9M-E)	
Echtzeituhr		
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag ¹⁾	
batteriegepuffert	Ja	
Speichersockel		
Typ	DDR3	
Größe	max. 8 GByte	
Grafik		
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH	
Speicher	bis zu 384 MByte ²⁾	
Farbtiefe	max. 32 Bit	
Auflösung		

Tabelle 51: 5PC800.BM45-00, 5PC800.BM45-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC800.BM45-00	5PC800.BM45-01
DVI	2x Intel compliant SDVO Ports	
RGB	300 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @70 Hz (QXGA)	
Massenspeicherverwaltung	4x SATA	
Power Management	ACPI 3.0 mit Batterie Support	

Tabelle 51: 5PC800.BM45-00, 5PC800.BM45-01 - Technische Daten

- 1) Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).
- 2) Wird im Hauptspeicher allokiert.

3.4 Kühlkörper

3.4.1 5AC801.HS00-01

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kühlkörper	
5AC801.HS00-01	APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PC800.B945-04	Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.	
5PC800.B945-14	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.	
5PC800.BM45-00	Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	
5PC800.BM45-01	Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module	

Tabelle 52: 5AC801.HS00-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HS00-01
Allgemeines	
geeignet für CPU Boards	5PC800.B945-04 / -14 5PC800.BM45-00 5PC800.BM45-01
Mechanische Eigenschaften	
Material	Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
Abmessungen	
Breite	228,7 mm
Höhe	218 mm
Tiefe	28 mm
Gewicht	ca. 2000 g

Tabelle 53: 5AC801.HS00-01 - Technische Daten

3.5 Hauptspeicher

3.5.1 5MMDDR.xxxx-02

Allgemeines

Diese 204-poligen DDR3 Hauptspeicher arbeiten mit einer Speichergeschwindigkeit von 1066 MHz und sind mit einer Speichergröße von 2 GByte und 4 GByte verfügbar.

Werden zwei gleich große (z.B. 2 GByte) Hauptspeicher in das CPU Board gesteckt, so wird die Dual-Channel Memory Technologie unterstützt. Werden zwei ungleich große (z.B. 2 GByte und 4 GByte) Hauptspeicher gesteckt, so wird diese Technologie nicht unterstützt.

Werden bei einem 32-Bit Betriebssystem zwei 2 GByte Module oder ein 4 GByte Modul gesteckt, so sind nur 3 GByte Hauptspeicher verwendbar, bei einem 64-Bit Betriebssystem sind maximal 8 GByte Hauptspeicher verwendbar.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher für GM45 CPU Boards	
5MMDDR.2048-02	SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500	
5MMDDR.4096-02	SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500	

Tabelle 54: 5MMDDR.2048-02, 5MMDDR.4096-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.2048-02	5MMDDR.4096-02
Allgemeines		
Typ	SO-DIMM DDR3 SDRAM	
Speichergröße	2 GByte	4 GByte
Bauart	204 Pin	
Organisation	256M x 64 Bit	512M x 64 Bit
Geschwindigkeit	DDR3-1066 (PC3-8500)	
Zertifizierungen	Ja	
CE		

Tabelle 55: 5MMDDR.2048-02, 5MMDDR.4096-02 - Technische Daten

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6 Laufwerke

3.6.1 5AC801.HDDI-00

Allgemeines

Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 56: 5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 1\%$
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 450 Mbits/s max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 12,5 ms 23 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb ³⁾ Betrieb - 24 Stunden ⁴⁾	-30 bis 85°C -30 bis 85°C

Tabelle 57: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-00
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ⁵⁾	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁶⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 57: 5AC801.HDDI-00 - Technische Daten

- Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
- Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

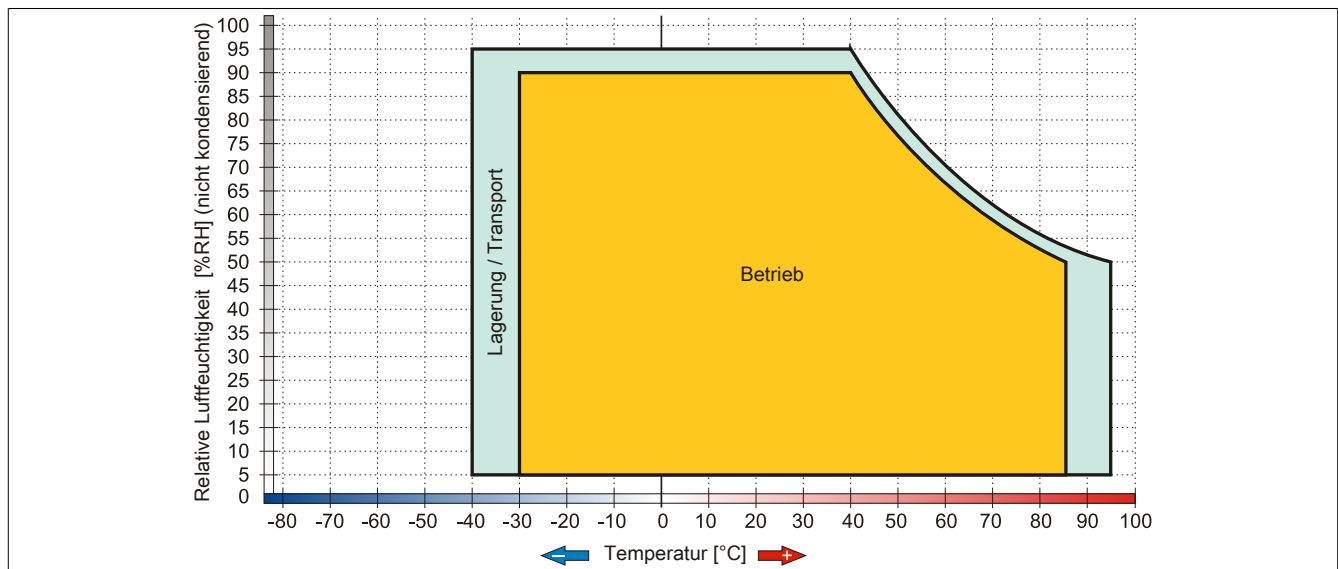


Abbildung 39: 5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.2 5AC801.HDDI-02

Allgemeines

Diese 160 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5AC801.HDDI-02	160 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 58: 5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 1\%$
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	300.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	12 ms
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 84,6 MBits/s max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1,5 ms 12 ms 22 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb Betrieb - 24 Stunden ³⁾ Lagerung Transport	-15 bis 80°C -15 bis 80°C -40 bis 95°C -40 bis 95°C

Tabelle 59: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-02
Luftfeuchtigkeit ⁴⁾	
Betrieb	8 bis 90%, nicht kondensierend ⁵⁾
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend ⁶⁾
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend ⁶⁾
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 1 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g, keine Beschädigung
Schock	
Betrieb	325 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	900 g, 1 ms; keine Beschädigung
Transport	120 g, 11 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁷⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	135 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	MHY2160BH-ESW

Tabelle 59: 5AC801.HDDI-02 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- 5) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- 6) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- 7) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

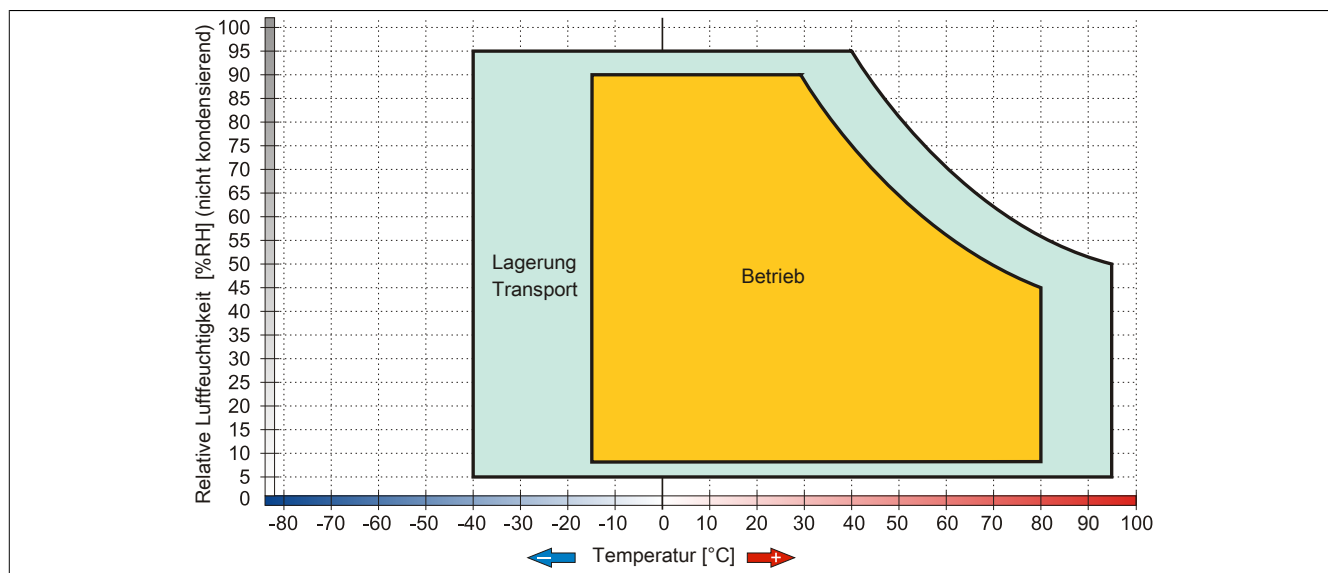


Abbildung 40: 5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.3 5AC801.HDDI-03

Allgemeines

Diese 250 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDI-03	250 GByte SATA Hard Disk (Slide-in compact); 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 60: 5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 1175 MBit/s max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 14 ms 30 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb ³⁾ Betrieb - 24 Stunden ⁴⁾ Lagerung Transport	0 bis 60°C 0 bis 60°C -40 bis 70°C -40 bis 70°C

Tabelle 61: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDI-03
Luftfeuchtigkeit ⁵⁾	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁶⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	134 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 61: 5AC801.HDDI-03 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

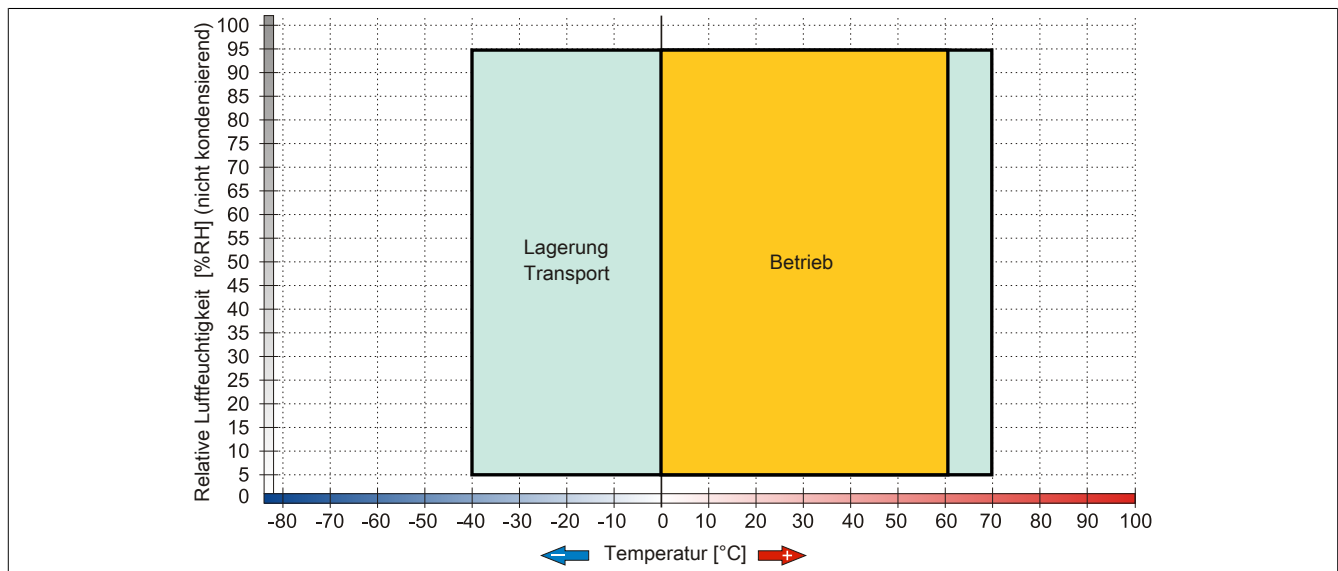


Abbildung 41: 5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.4 5AC801.SSDI-00

Allgemeines

Dieses 32 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Single Level Cell (SLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-00	32 GByte SATA SSD (SLC), Slide-in compact.	

Tabelle 62: 5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	32 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	2.000.000 Stunden
Power On/Off Cycles	50.000
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 250 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 170 MByte/s
IOPS ¹⁾	
4k lesen	35.000

Tabelle 63: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-00
4k schreiben	3.300
Endurance	
garantierte Datenmenge garantiert ergibt bei 5 Jahren	700 TB 350 GByte/Tag
SLC-Flash	Ja
Wear Leveling	statisch
Error Correction Coding (ECC)	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 2.6 compliant, kompatibel mit SATA 1,5 GBit/s und 3 GBit/s Interface Raten ATA/ATAPI-7 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%
Lagerung	5 bis 95%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	7 bis 800 Hz: 2,17 g
Lagerung	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Transport	10 bis 500 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1000 g, 0,5 ms
Lagerung	1000 g, 0,5 ms
Transport	1000 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ²⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSA2SH032G1

Tabelle 63: 5AC801.SSDI-00 - Technische Daten

- 1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
2) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

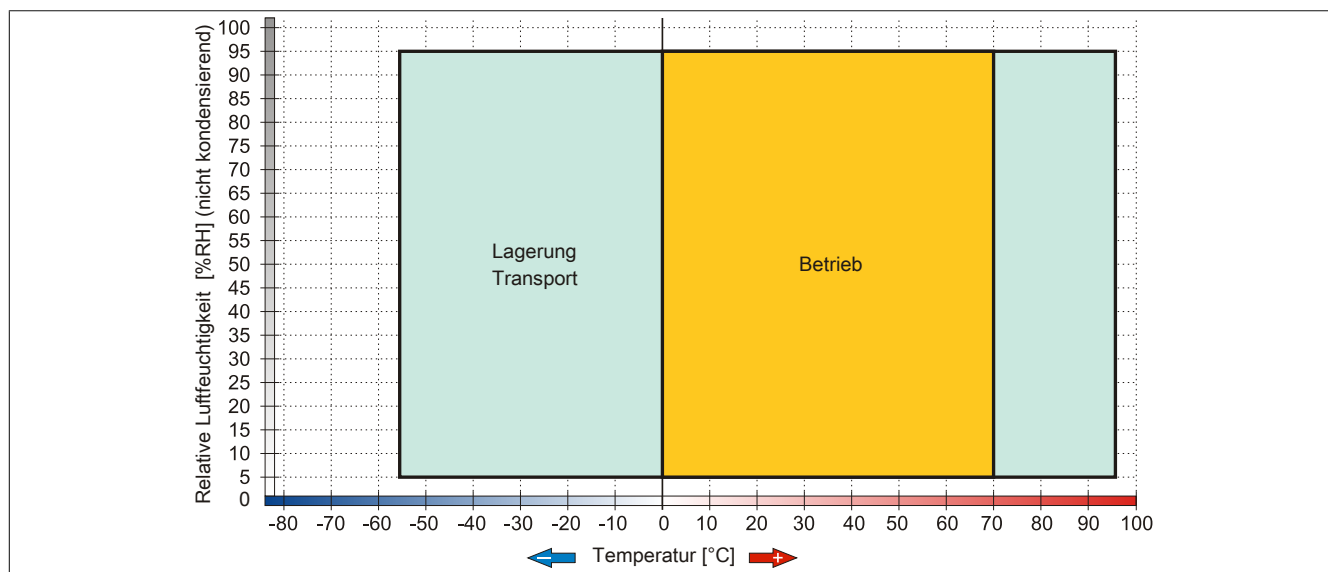


Abbildung 42: 5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Benchmark

Die nachfolgenden zwei Benchmarks zeigen einen Vergleich der Intel Solid State Drive (5AC801.SSDI-00) und der Seagate Hard Disk (5AC801.HDDI-00) beim zyklischen lesen bzw. schreiben.

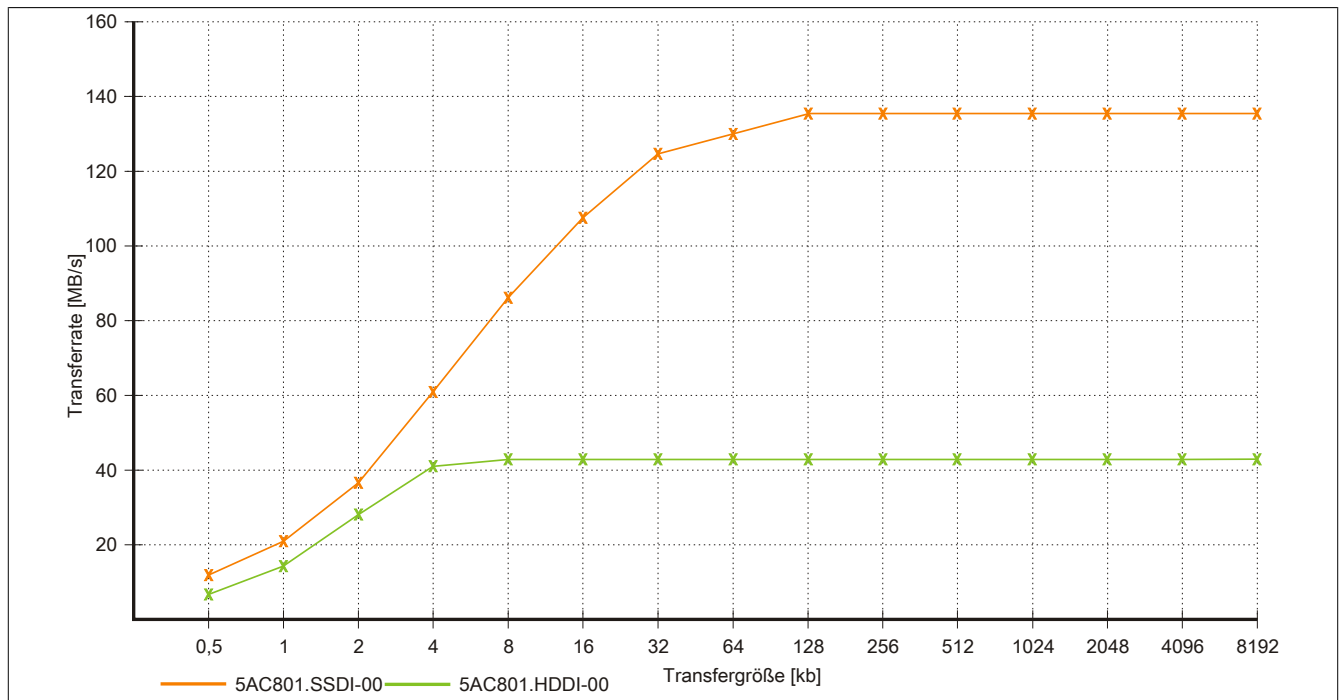


Abbildung 43: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen

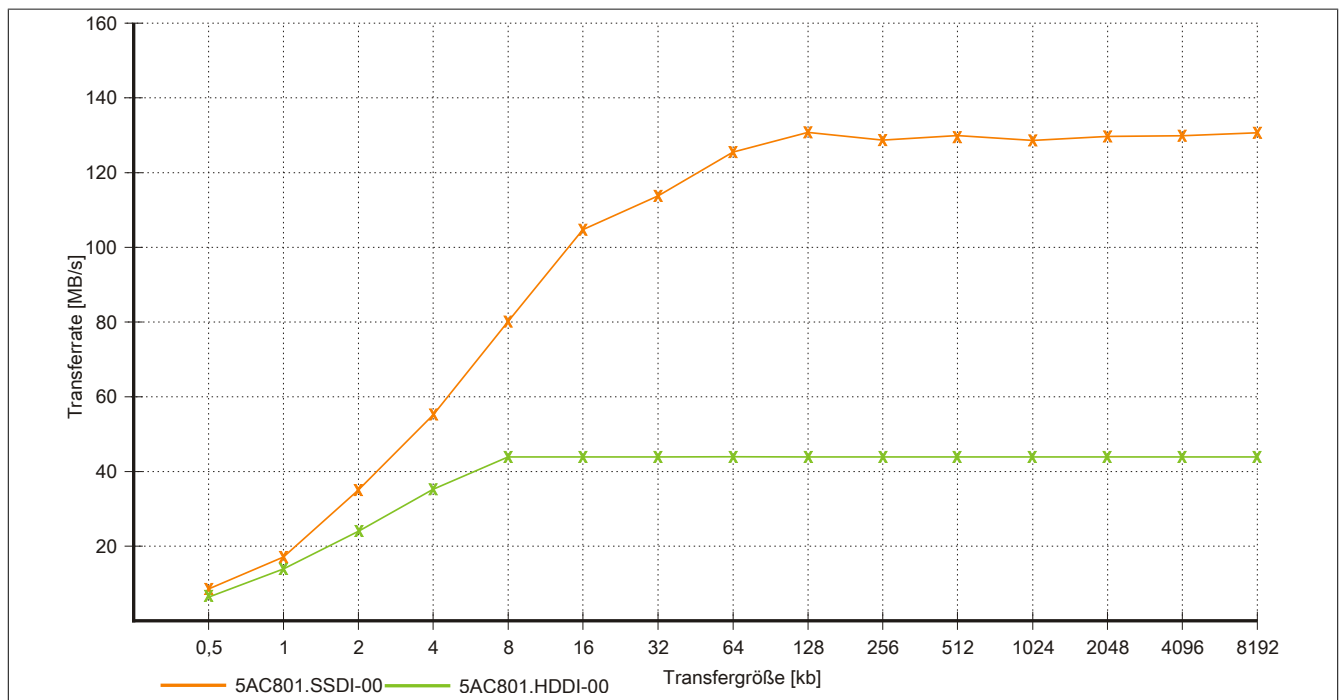


Abbildung 44: 5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben

3.6.5 5AC801.SSDI-01

Allgemeines

Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-01	60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	

Tabelle 64: 5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ¹⁾	
4k lesen	15.000

Tabelle 65: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-01
4k schreiben typisch maximal	23.000 80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%
Lagerung	5 bis 95%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ²⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 65: 5AC801.SSDI-01 - Technische Daten

- 1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
2) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

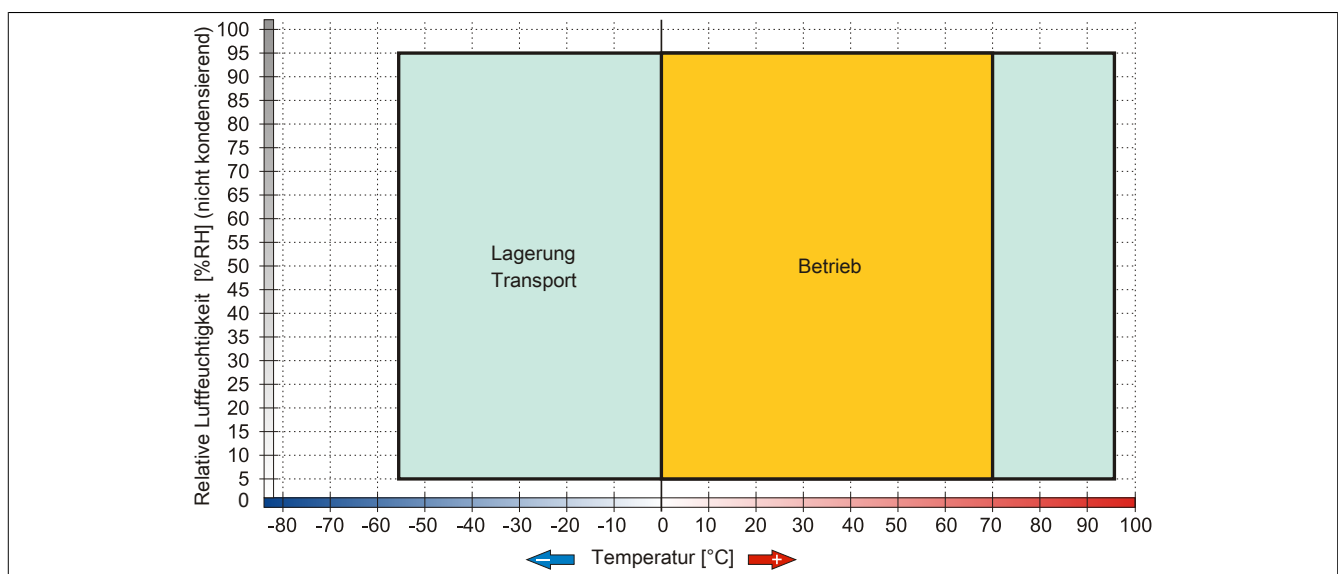


Abbildung 45: 5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.6 5AC801.SSDI-02

Allgemeines

Dieses 180 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Die Slide-in compact SSD kann in der 5 Card Slot Variante des APC810 im Slide-in Slot 2 mit dem 5AC801.ADAS-00 Adapter nicht verwendet werden.

Intern wird das Slide-in compact Laufwerk bei Steckung in den Slide-in compact Slot als SATA I angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.SSDI-02	180 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact	

Tabelle 66: 5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten

Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ¹⁾	
4k lesen	50.000

Tabelle 67: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.SSDI-02
4k schreiben typisch maximal	60.000 80.000
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%
Lagerung	5 bis 95%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ²⁾
Abmessungen	
Breite	13 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	118 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 67: 5AC801.SSDI-02 - Technische Daten

- 1) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
2) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

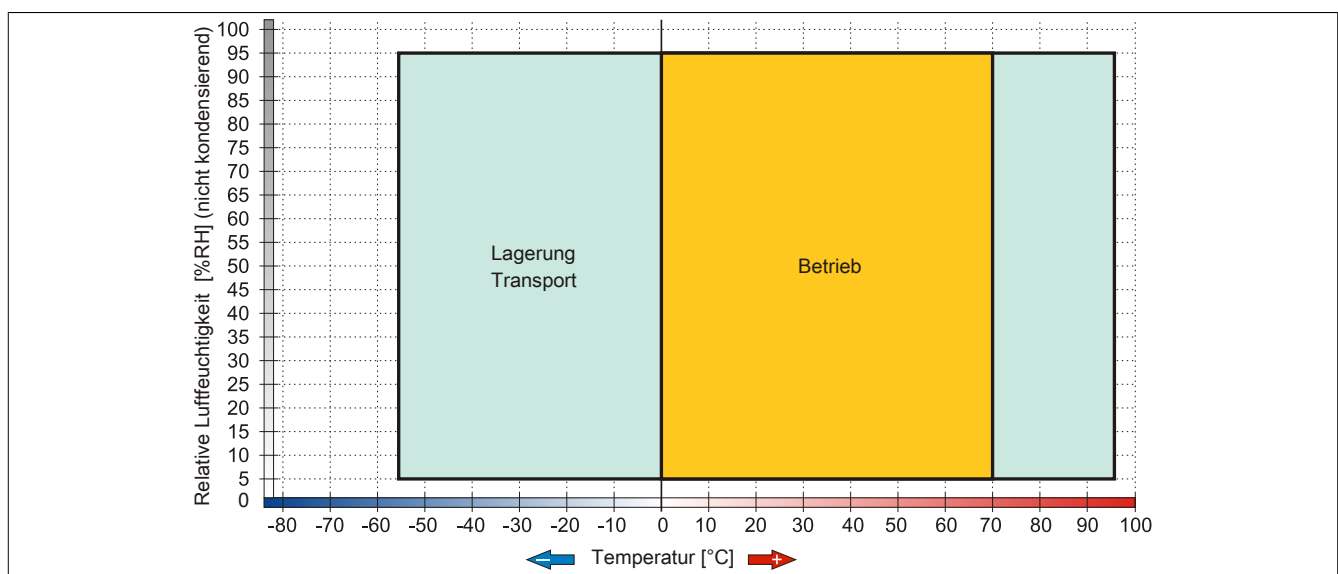


Abbildung 46: 5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.7 5AC801.ADAS-00

Allgemeines

Der Hard Disk Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man Slide-in compact Laufwerke stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Dieser Adapter kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Bei Verwendung in einem APC810

Information:

Der Slide-in compact Adapter kann aus mechanischen Gegebenheiten (Schließen der Fronttüre) nur im Slide-in Slot 1 gesteckt werden.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.ADAS-00	SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.	

Tabelle 68: 5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.ADAS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	328 g

Tabelle 69: 5AC801.ADAS-00 - Technische Daten

3.6.8 5AC801.HDDS-00

Allgemeines

Diese 40 GByte Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA I und USB angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.HDDS-00	40 GByte SATA Hard Disk (Slide-in); 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 70: 5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	40 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	78.140.160
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 1\%$
Hochlaufzeit	typ. 3 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	750.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,6 ms
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 450 MBits/s max. 150 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 12,5 ms 23 ms
Umgebungsbedingungen	

Tabelle 71: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.HDDS-00
Temperatur ²⁾	
Betrieb ³⁾	-30 bis 85°C
Betrieb - 24 Stunden ⁴⁾	-30 bis 85°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit ⁵⁾	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 5000 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁶⁾
Abmessungen	
Breite	22 mm
Höhe	172,5 mm
Tiefe	150 mm
Gewicht	387 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST940817SM

Tabelle 71: 5AC801.HDDS-00 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 70°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 15% pro Stunde.
- 6) Montageweise auf Slide-in compact.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

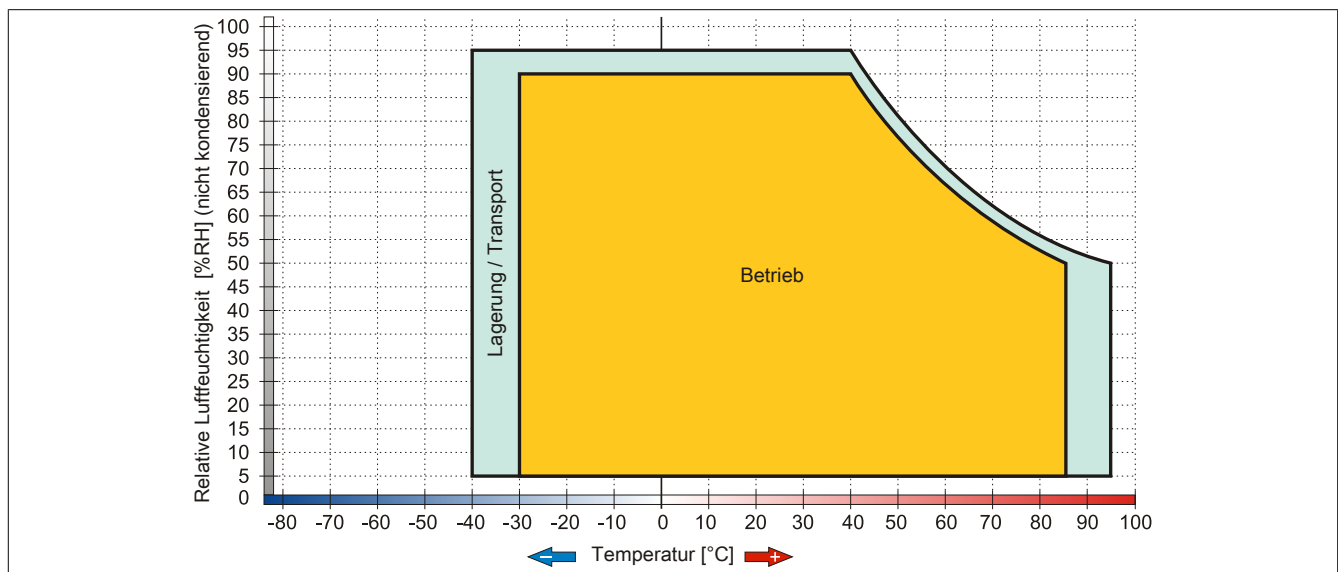


Abbildung 47: 5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.9 5AC801.DVDS-00

Allgemeines

Das DVD-ROM Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA I und USB angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.DVDS-00	Laufwerke DVD-ROM SATA Laufwerk (Slide-in).	

Tabelle 72: 5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
CD / DVD Laufwerk	
Datentransferrate	max. 1,5 GBit/s
Drehzahl	max. 5090 rpm \pm 1%
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session) Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-Video (Double Layer), DVD-R (Single/Multi-border), DVD-R DL (Single/Multi-border), DVD-RW (Single/Multi-border), DVD+R (Single/Multi session), DVD+R DL (Single/Multi session), DVD+RW (Single/Multi session), DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB)
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit CD DVD	max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) max. 19 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit CD DVD	durchschnittlich 130 ms durchschnittlich 140 ms
Lesbare Medien	

Tabelle 73: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.DVDS-00
CD DVD	CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-A CD-R, CD-RW DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit CD DVD	24x 8x
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 55°C ²⁾ -20 bis 60°C -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	8 bis 80%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration Betrieb Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: 0,2g 5 bis 500 Hz: 2g 5 bis 500 Hz: 2g
Schock Betrieb Lagerung Transport	5 g und 11 ms Dauer 60 g und 11 ms Dauer 200 g und 2 ms Dauer 60 g und 11 ms Dauer 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	22 mm 172,5 mm 150 mm
Gewicht	455 g

Tabelle 73: 5AC801.DVDS-00 - Technische Daten

- Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.
- Oberflächentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

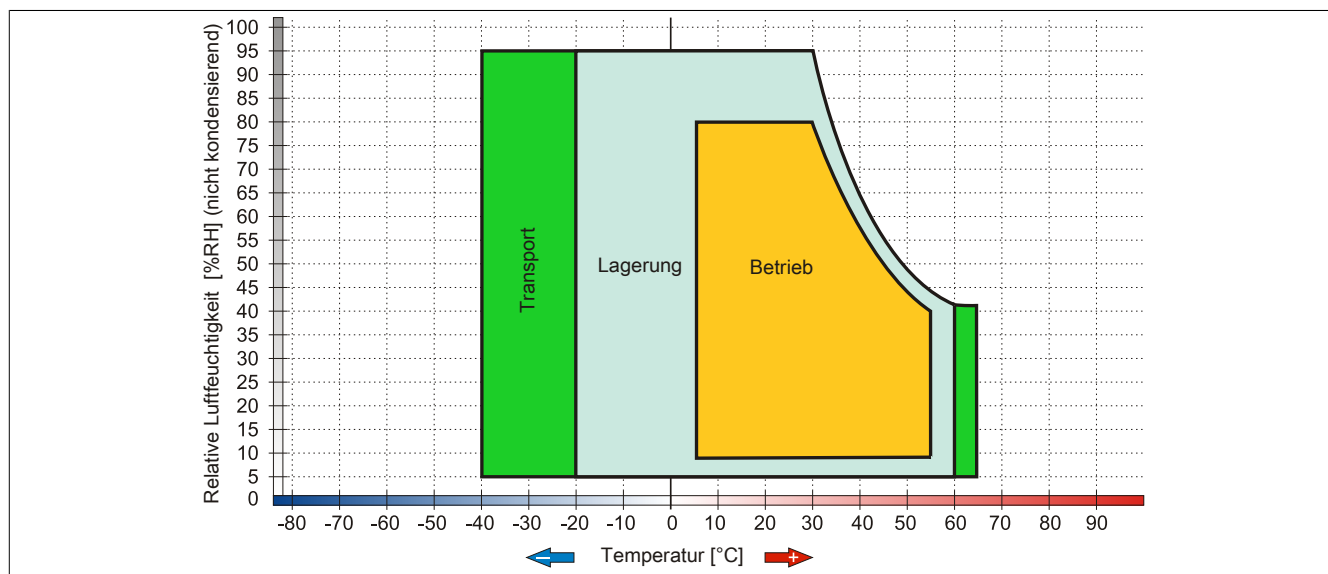


Abbildung 48: 5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Hot-Plug Fähigkeit

Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.

3.6.10 5AC801.DVRS-00

Allgemeines

Das DVD-R/RW Slide-in Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau eines Slide-in Laufwerkes ist jederzeit möglich.

Bei Verwendung in einem APC810

Intern wird das Slide-in Laufwerk bei Steckung in den Slide-in Slot 1 oder Slide-in Slot 2 als SATA I und USB angesprochen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5AC801.DVRS-00	DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk (Slide-in).	
	Optionales Zubehör	
	Sonstiges	
5SWUT1.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	

Tabelle 74: 5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5160 rpm $\pm 1\%$
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	SATA
Hochlaufzeit CD DVD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff) max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit CD DVD	durchschnittlich 140 ms (24x) durchschnittlich 150 ms (8x)
Lesbare Medien	

Tabelle 75: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.DVRS-00
CD DVD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (Double Layer), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW, DVD-RAM
Beschreibbare Medien CD DVD	CD-R, CD-RW DVD-R/RW, DVD-R (Double Layer), DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit CD DVD	24x 8x
Schreibgeschwindigkeit CD-R CD-RW DVD+R DVD+R (Double Layer) DVD+RW DVD-R DVD-R (Double Layer) DVD-RAM ¹⁾ DVD-RW	24x, 16x, 10x und 4x 24x, 16x, 10x und 4x 8x, 4x und 2,4x 6x, 4x und 2,4x 4x und 2x 8x, 4x und 2x 6x, 4x und 2x 5x, 3x und 2x 6x, 4x und 2x
Schreibmethoden CD DVD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 55°C ³⁾ -20 bis 60°C -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	8 bis 80%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration Betrieb Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: 0,2g 5 bis 500 Hz: 2g 5 bis 500 Hz: 2g
Schock Betrieb Lagerung Transport	bei max. 5 g und 11 ms Dauer bei max. 60 g und 11 ms Dauer bei max. 200 g und 2 ms Dauer bei max. 60 g und 11 ms Dauer bei max. 200 g und 2 ms Dauer
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	22 mm 172,5 mm 150 mm
Gewicht	400 g

Tabelle 75: 5AC801.DVRS-00 - Technische Daten

- 1) RAM Treiber werden vom Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Unterstützung der RAM Funktion durch die Brennsoftware „Nero“ (Best. Nr. 5SWUT1.0000-00) oder anderer Brennsoftwarepakete bzw. Treibern von Drittanbietern.
- 2) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Metern NN.
- 3) Oberflächentemperatur des Laufwerks.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

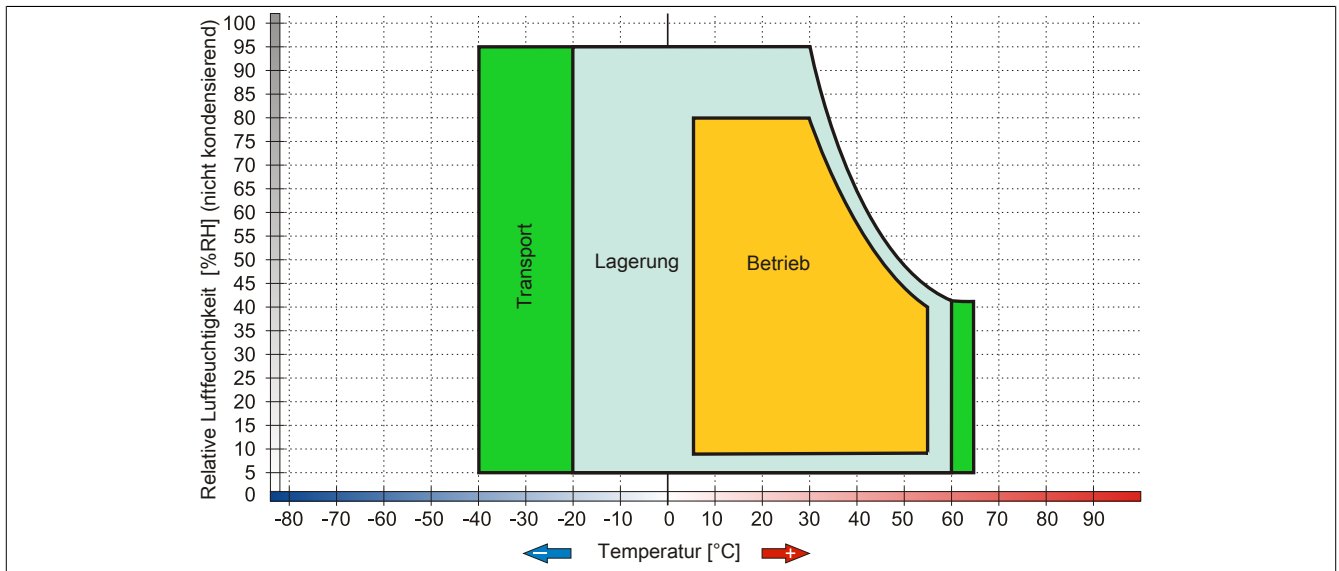


Abbildung 49: 5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.11 5ACPCI.RAIC-03

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusätzlich eine erweiterte Temperatur-spezifikation (ET).

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

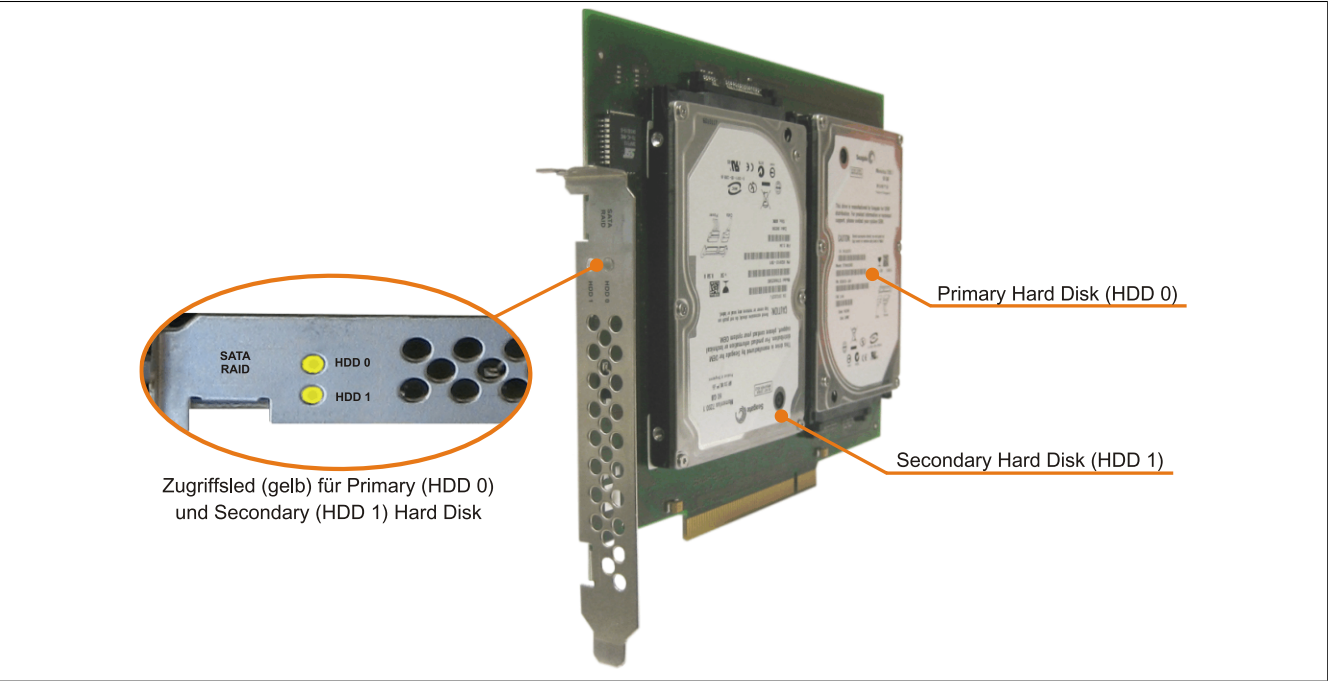


Abbildung 50: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel mindestens 50 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	
5ACPCI.RAIC-03	PCI RAID System SATA 2x 160 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	
	Undefined	
5ACPCI.RAIC-04	160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 76: 5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen CE	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm \pm 1%
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 84,6 MBits/s max. 150 MByte/s
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1,5 ms 12 ms 22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾ Betrieb ²⁾ Betrieb - 24 Stunden ³⁾ Lagerung Transport	-15 bis 80°C -15 bis 80°C -40 bis 95°C -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	8 bis 90%, nicht kondensierend ⁴⁾ 5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾ 5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾
Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock Betrieb Lagerung Transport	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe Betrieb Lagerung	-300 bis 3048 m -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage ⁷⁾	fix
Abmessungen Breite Länge Höhe	70 mm 100 mm 9,5 mm

Tabelle 77: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-03
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Fujitsu
Herstellerbezeichnung	M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 77: 5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten

- 1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- 5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- 6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 7) Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

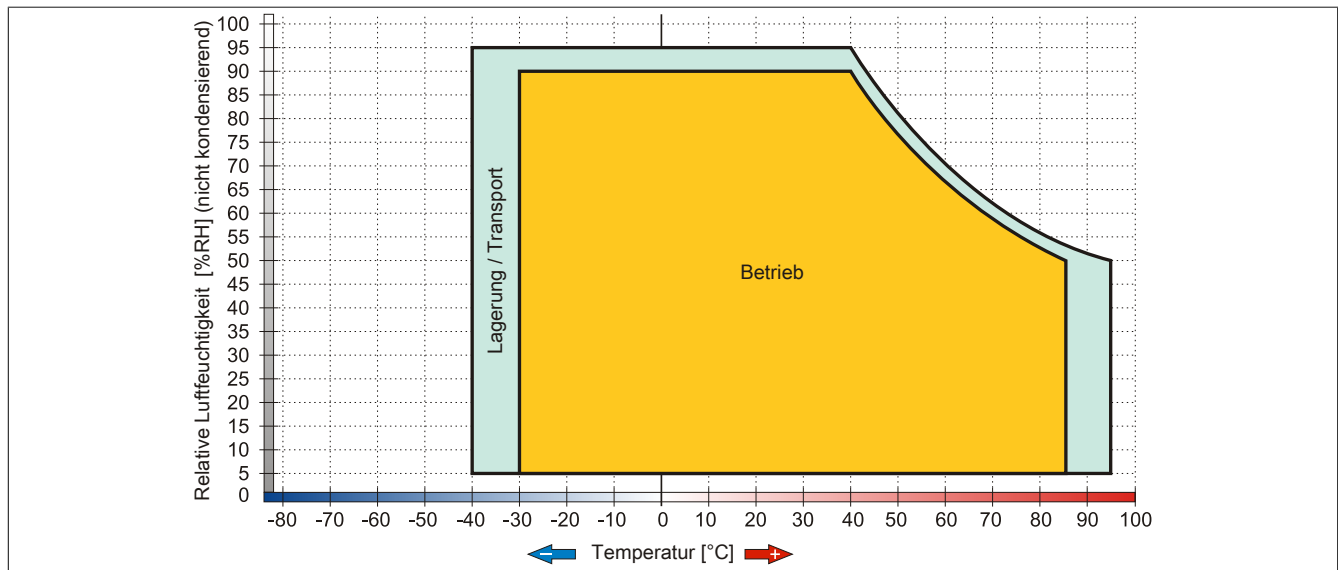


Abbildung 51: 5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 183.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 160GB 5ACPCI.RAIC-04 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 10 "Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1" auf Seite 384.

3.6.12 5ACPCI.RAIC-04

Allgemeines

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 verwendet werden.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5ACPCI.RAIC-04	Undefined 160 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-03; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 78: 5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten

Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-04
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	160 GByte
Anzahl der Köpfe	3
Anzahl der Sektoren	312.581.808
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 1\%$
Hochlaufzeit	typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer	5 Jahre
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 84,6 MBits/s max. 150 MByte/s
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1,5 ms 12 ms 22 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾ Betrieb ²⁾ Betrieb - 24 Stunden ³⁾ Lagerung Transport	-15 bis 80°C -15 bis 80°C -40 bis 95°C -40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	8 bis 90%, nicht kondensierend ⁴⁾ 5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾ 5 bis 95%, nicht kondensierend ⁵⁾
Vibration ⁶⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: max. 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock	

Tabelle 79: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5ACPCI.RAIC-04
Betrieb		max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung		max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
		max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
Transport		max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
		max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung
		max. 450 g, 1 ms; keine Beschädigung
		max. 200 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe		
Betrieb		-300 bis 3048 m
Lagerung		-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite		70 mm
Länge		100 mm
Höhe		9,5 mm
Gewicht		350 g
Herstellerinformation		
Hersteller		Fujitsu
Herstellerbezeichnung		M120-ESW MHY2160BH-ESW

Tabelle 79: 5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten

- 1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Minute maximal 3°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Maximalfeuchtigkeit bei 29°C.
- 5) Maximalfeuchtigkeit bei 40°C.
- 6) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).

Temperatur Luftfeuchtediagramm

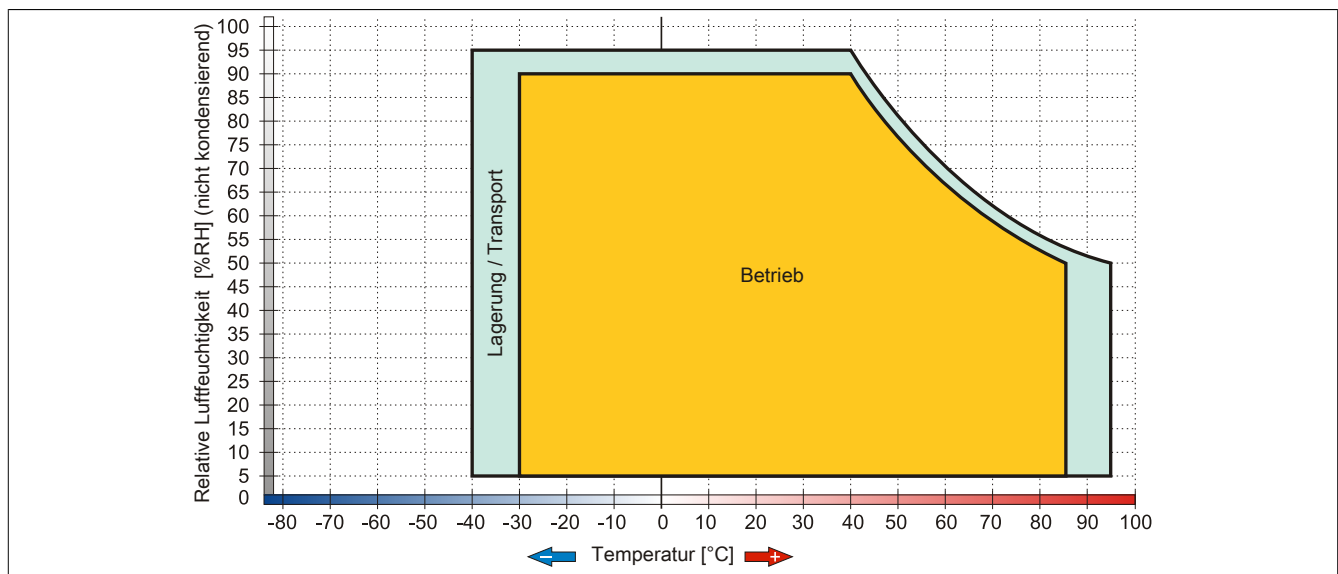


Abbildung 52: 5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.13 5ACPCI.RAIC-05

Allgemeines

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten 250 GByte Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bieten zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET).

- SATA RAID Controller
- RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
- 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
- Benötigt nur 1 PCI Slot
- Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

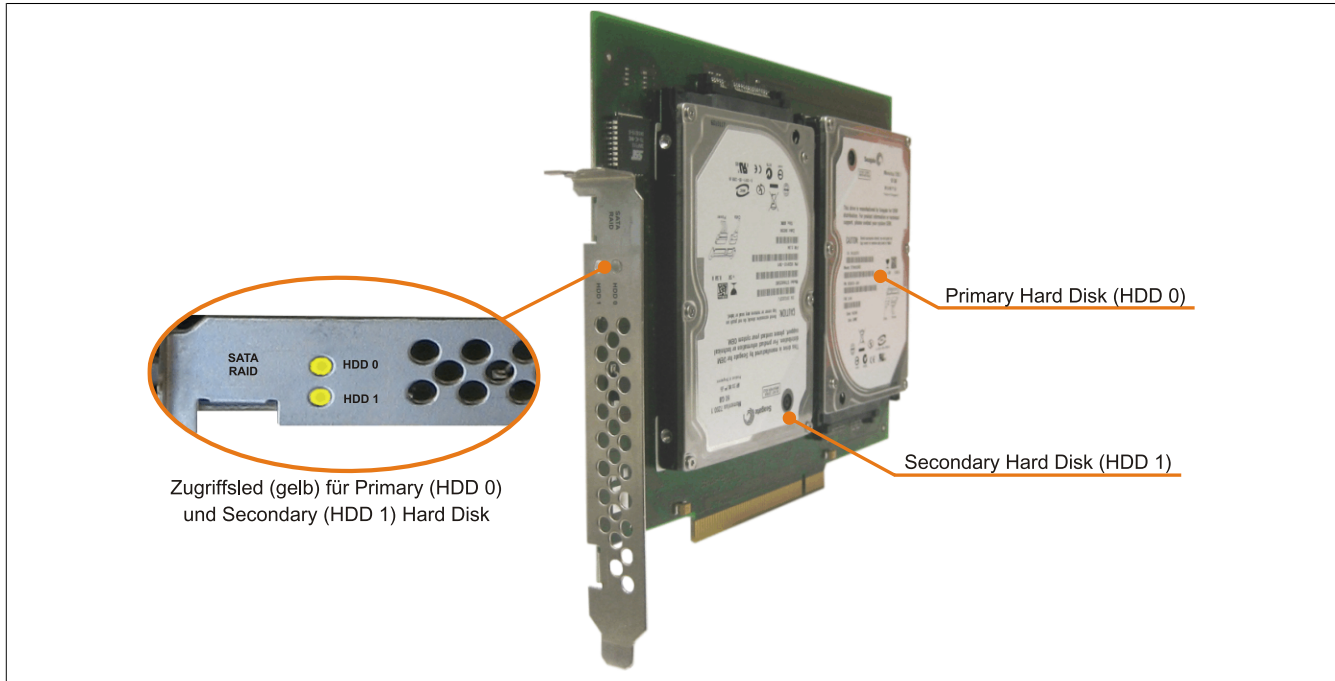


Abbildung 53: PCI SATA RAID Controller

Information:

Der PCI SATA RAID Controller kann nicht als Ersatz für eine „Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)“ eingesetzt werden. Wird das Betriebssystem nicht korrekt beendet, so wird dies beim nächsten Starten des Systems als Fehlerzustand (bei RAID 1 Verbund) erkannt und ein kompletter Rebuild durchgeführt. Dies nimmt in der Regel mindestens 50 Minuten (konfigurierbar) in Anspruch.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5ACPCI.RAIC-05	Laufwerke	
	PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	
	Optionales Zubehör	
5MMHDD.0250-00	Laufwerke	
	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 80: 5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.RAIC-05
Allgemeines	
Anzahl der Hard Disks	2
Zertifizierungen CE	Ja
Controller	
Typ	Sil 3512 SATA Link
Spezifikation	Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate	max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level	unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf	ca. 32 kByte
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
S.M.A.R.T. Support	Ja
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 1175 MBit/s max. 150 MByte/s
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 14 ms 30 ms
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus) 1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾ Betrieb ²⁾ Betrieb - 24 Stunden ³⁾ Lagerung Transport	0 bis 60°C 0 bis 60°C -40 bis 70°C -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ⁴⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration ⁵⁾ Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: max. 0,125 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: max. 0,25 g; Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung 5 bis 500 Hz: 5 g; Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock ⁵⁾ Betrieb Lagerung Transport	max. 125 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 500 g, 1 ms; keine Beschädigung max. 300 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe Betrieb Lagerung	- 300 bis 3048 m - 300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Montage	fix ⁶⁾
Gewicht	350 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 81: 5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten

- 1) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 2) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 3) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.
- 5) Bei Einsatz in vibrations- und schockgefährdeten Bereichen besteht im Betrieb die Möglichkeit von Performanceeinbrüchen (absinken der Übertragungsrate).
- 6) Montageweise auf PCI Einschub.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

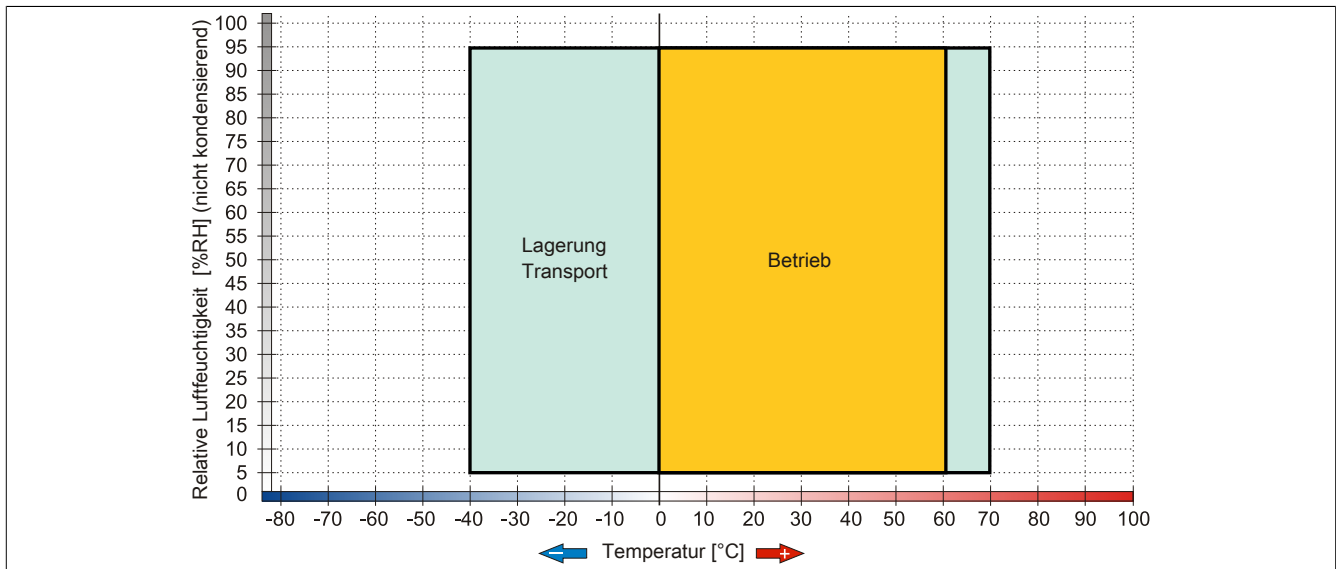


Abbildung 54: 5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Treibersupport

Für den Betrieb des PCI SATA RAID Controllers sind spezielle Treiber notwendig. Es stehen für die unterstützten und freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Ebenfalls auf der B&R Homepage ist die auf .NET basierende SATA Raid™ Serial ATA RAID Management Software zu finden.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

Konfiguration

Konfiguration eines SATA RAID Verbundes Kapitel 3 "Inbetriebnahme", Abschnitt 7 "Konfiguration eines SATA RAID Verbundes" auf Seite 183.

Tauschen einer HDD

Eine Hard Disk kann im Fehlerfalle bei RAID1 (Spiegelung) Konfiguration einfach getauscht werden ohne das System neu installieren zu müssen. Dazu ist die Ersatz SATA HDD 250GB 5MMHDD.0250-00 als Ersatzteil für eine HDD verfügbar.

Eine Tauschanleitung dazu siehe "Wartung / Instandhaltung" auf Seite 360.

3.6.14 5MMHDD.0250-00**Allgemeines**

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-05 verwendet werden.

- 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.	

Tabelle 82: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten

Technische Daten**Information:**

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 1175 MBit/s max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 14 ms 30 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb ³⁾ Betrieb - 24 Stunden ⁴⁾ Lagerung Transport	0 bis 60°C 0 bis 60°C -40 bis 70°C -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ⁵⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	

Tabelle 83: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock	
Betrieb	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport	800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
	600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 3048 m
Lagerung	-300 bis 12192 m
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 83: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

Temperatur Luftfeuchtediagramm

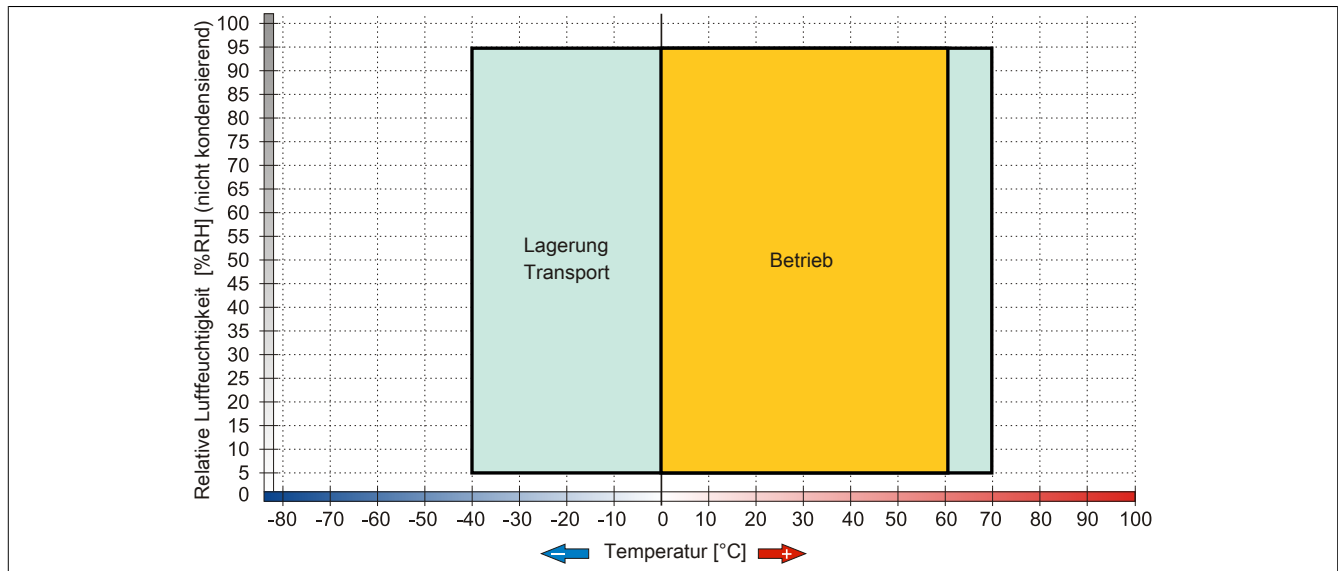


Abbildung 55: 5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.7 Lüfter Kit

Information:

Lüfter sind notwendig wenn Komponenten eingesetzt werden, die eine eingeschränkte Umgebungstemperatur aufweisen, z.B. RAID Controller, DVD Combo, PCI Karten.

Die Lüfter bzw. Staubfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in angemessenem Abstand kontrolliert und bei nicht ausreichender Funktion (z. B. durch Verschmutzung) gereinigt oder ausgetauscht werden.

Für Informationen zu den Einschaltgrenzen des Lüfters siehe Anhang A.

3.7.1 5PC810.FA01-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 1 Card Slot eingebaut werden.

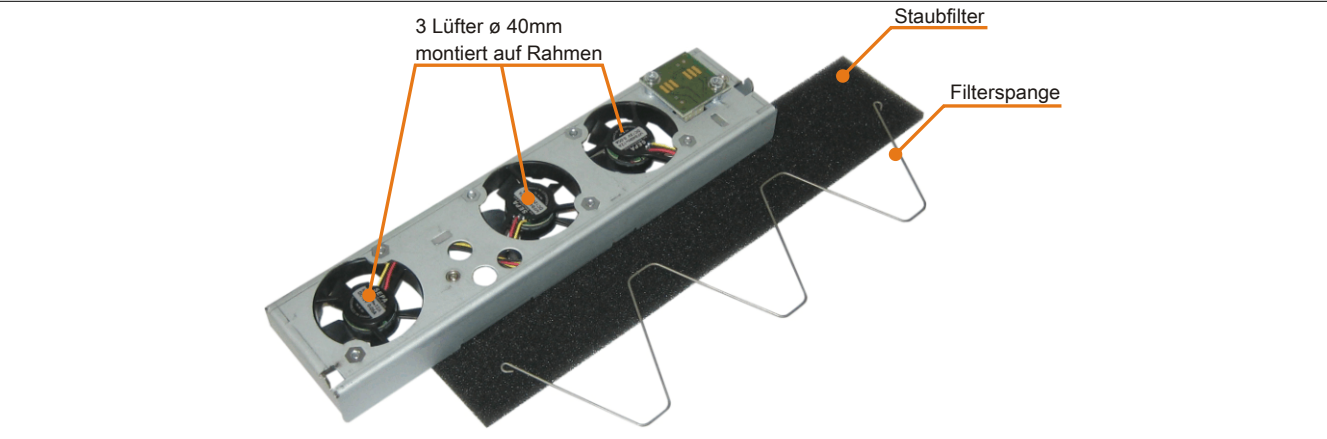


Abbildung 56: 5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA01-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX01-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	

Tabelle 84: 5PC810.FA01-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA01-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 6100 rpm
Geräuschpegel	21 dB
Lebensdauer	29000 Stunden bei 70°C 95000 Stunden bei 20°C
Typ	doppelt kugellagert
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	10 mm

Tabelle 85: 5PC810.FA01-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 367.

3.7.2 5PC810.FA02-01

Allgemeines

Diese Lüfter Kits können optional bei Systemeinheiten mit 2 Card Slots eingebaut werden.

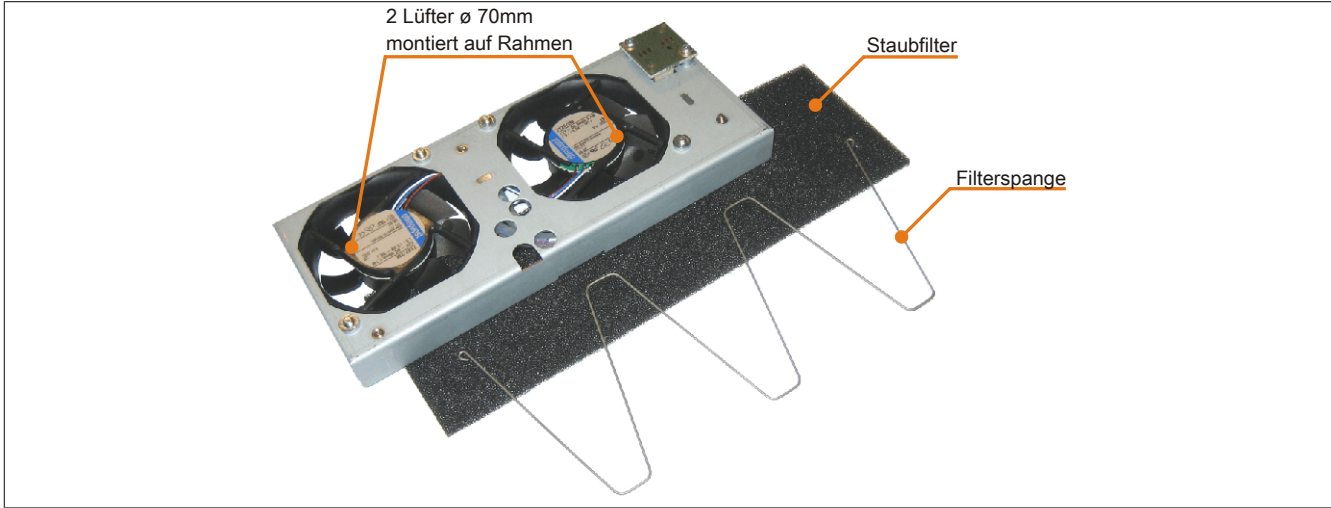


Abbildung 57: 5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA02-01	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	

Tabelle 86: 5PC810.FA02-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA02-01
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	2
Drehzahl	max. 4300 rpm $\pm 12,5\%$
Geräuschpegel	32 dB
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C
Typ	doppelt kugellagert
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	15 mm

Tabelle 87: 5PC810.FA02-01 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 367.

3.7.3 5PC810.FA03-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 3 Card Slots eingebaut werden.

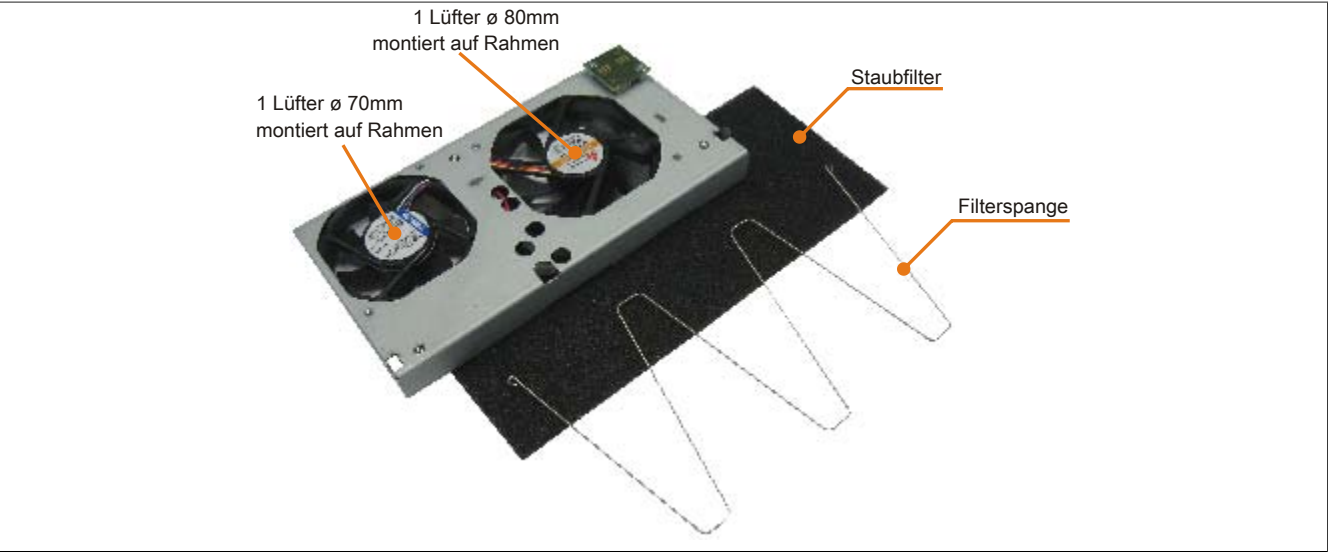


Abbildung 58: 5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA03-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	

Tabelle 88: 5PC810.FA03-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA03-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	2
Drehzahl	Lüfter 1: max. 4300 rpm ±12,5% Lüfter 2: max. 3200 rpm ±10%
Geräuschpegel	Lüfter 1: 32 dB Lüfter 2: 33 dB
Lebensdauer	Lüfter 1: 60000 Stunden bei 40°C Lüfter 2: 75000 Stunden bei 40°C
Typ	doppelt kugelgelagert
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm
Höhe	Lüfter 1: 70 mm Lüfter 2: 80 mm
Tiefe	Lüfter 1: 15 mm Lüfter 2: 15 mm

Tabelle 89: 5PC810.FA03-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 367.

3.7.4 5PC810.FA05-00

Allgemeines

Dieses Lüfter Kit kann optional bei Systemeinheiten mit 5 Card Slots eingebaut werden.

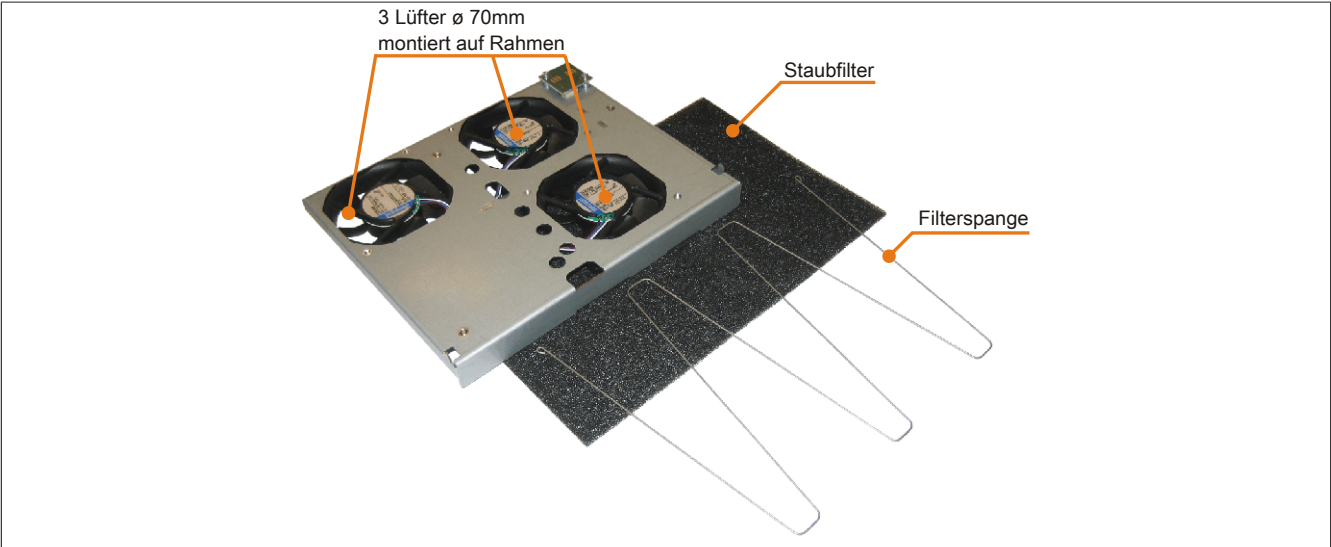


Abbildung 59: 5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Lüfter Kit	
5PC810.FA05-00	APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX05-00.	
	Optionales Zubehör	
	Zubehör	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 90: 5PC810.FA05-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC810.FA05-00
Allgemeines	
Anzahl der Lüfter	3
Drehzahl	max. 4300 rpm ±10%
Geräuschpegel	32 dB
Lebensdauer	60000 Stunden bei 40°C
Typ	doppelt kugelgelagert
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Lüfter	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	15 mm

Tabelle 91: 5PC810.FA05-00 - Technische Daten

Informationen zum Einbau bzw. Tauschen des Lüfter Kits siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung", Abschnitt 6 "Lüfter Kit Einbau / Tausch" auf Seite 367.

3.8 AP Link Steckkarten

AP Link Steckkarten können bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 montiert werden.

3.8.1 5AC801.SDL0-00

Allgemeines

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es möglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren. Bei diesem stehen die Signale DVI und SDL zur Verfügung. RGB Signale werden nicht unterstützt. Details sind den Technische Daten des verwendeten CPU Boards zu entnehmen.

Information:

Die Montage des AP Link SDL Transmitters ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

Informationen zum Einbau des AP Link SDL Transmitters finden sie unter "AP Link Montage" auf Seite 383.

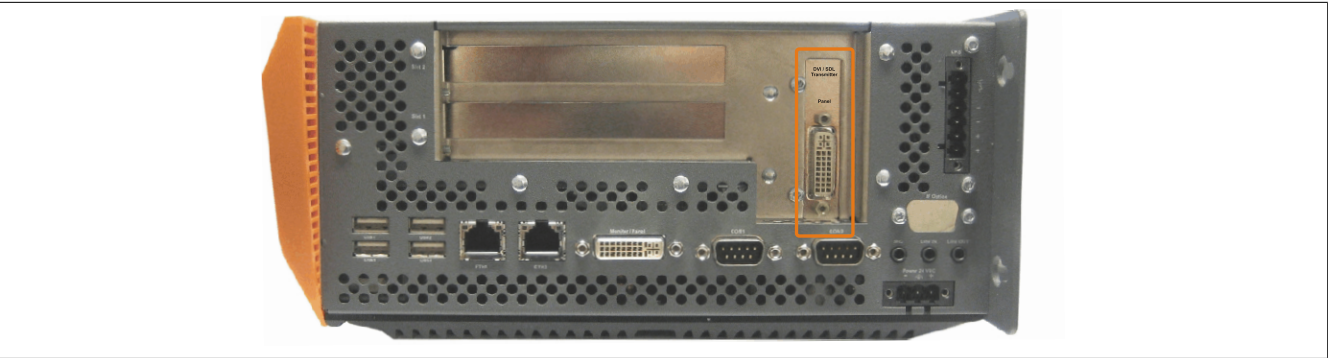


Abbildung 60: 5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Panel Link Steckkarten	
5AC801.SDL0-00	Smart Display Link/DVI-D Transmitter	

Tabelle 92: 5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten

Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	ANALOG RED	Analog Red
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	ANALOG GREEN	Analog Green
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	ANALOG BLUE	Analog Blue
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	ANALOG HORZ SYNC	Analog Horizontal Synchronization
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	ANALOG GND	Analog ground (Return for R, G and B signals)
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

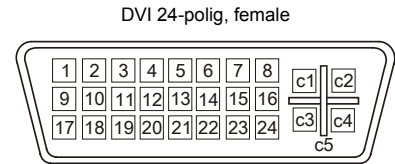


Tabelle 93: Pinbelegung DVI Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 94: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

3.8.2 5AC801.RDYR-00

Allgemeines

Information:

Die Montage des Ready Relais ist nur in Verbindung mit den Systemeinheiten 5PC810.SX02-00, 5PC810.SX03-00 und 5PC810.SX05-00 möglich.

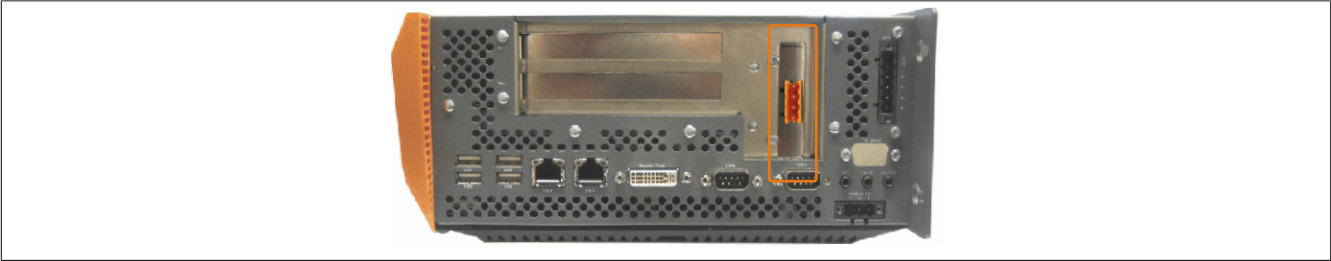


Abbildung 61: Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00

Wird der APC810 eingeschaltet (Power On) werden die Relaiskontakte geschlossen.

Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.RDYR-00	Automation Panel Link Steckkarten Ready Relais für APC810	

Tabelle 95: 5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten

Pinbelegung

Ready Relais Pinbelegung	
Pinbelegung 4-polige Steckerleiste Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 10 A	
Pin	Belegung
1	Schließer
2	Wurzel
3	Öffner
4	n.c.

Tabelle 96: 5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais

3.9 Ready Relais

3.9.1 5AC801.RDYR-01

3.9.2 Allgemeines

Das Ready Relais 5AC801.RDYR-01 kann in den Add-on USV Steckplatz des APC810 gesteckt werden, hierzu muss dieser Steckplatz noch frei verfügbar sein.

Nähere Informationen zur Montage des Ready Relais siehe Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" Abschnitt 12 "Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz" auf Seite 387.

In dem Beipackzettel ist beschrieben, wie die Aufklebestreifen an den Automation PC 810 anzubringen sind.

3.9.3 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC801.RDYR-01	Zubehör Ready Relais für APC810 für die Montage an einem Add-on USV Steckplatz	

Tabelle 97: 5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten

3.9.4 Pinbelegung


Pin	Belegung	Beschreibung	Abbildung
1	-	nicht verbunden	
2	-	nicht verbunden	
3	NO	normally open	
4	COM	Wechselkontakt	
5	NC	normally closed	
6	-	nicht verbunden	

Tabelle 98: 5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung

3.9.5 Lieferumfang

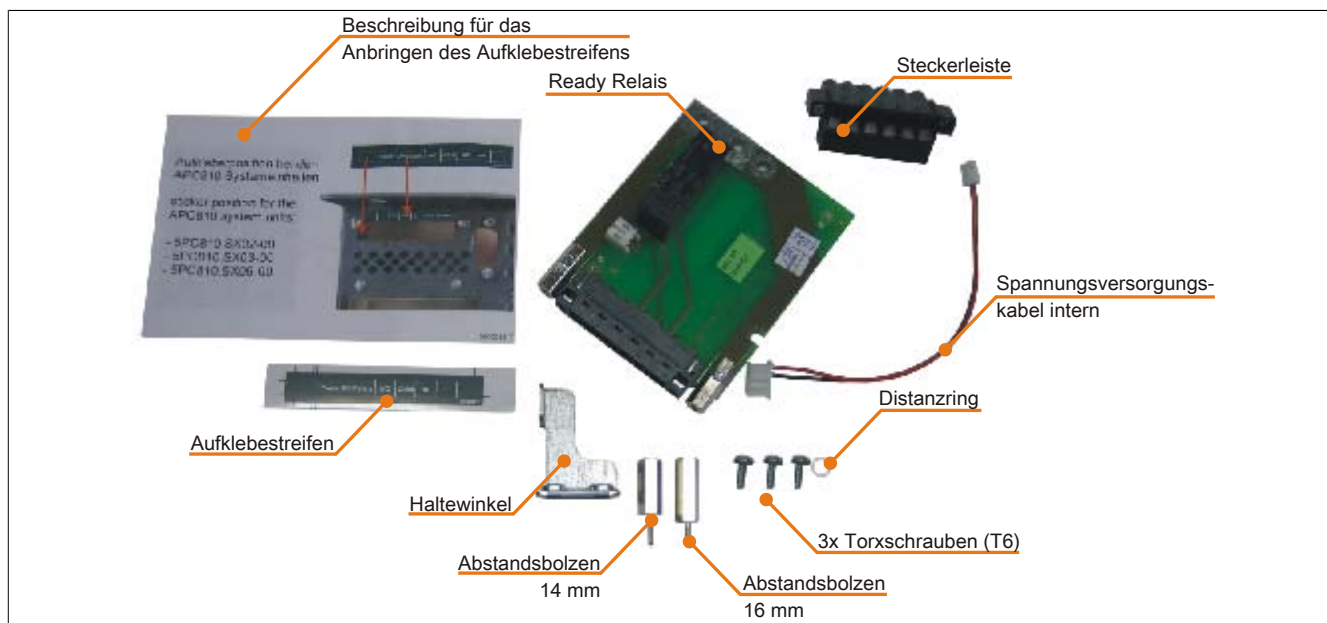


Abbildung 62: 5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang

3.10 Schnittstellenoptionen (IF Option)

3.10.1 Allgemeines

Es kann eine zusätzliche Schnittstelle (CAN oder kombinierte RS232/422/485) in den IF Option Steckplatz des APC810 montiert werden.



Abbildung 63: Schnittstellenoptionen (IF Option)

Information:

Ein nachträglicher Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption ist jederzeit möglich.

Information:

Der Ein- und Ausbau einer Schnittstellenoption darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

3.10.2 5AC600.CANI-00

Allgemeines

Das Add-on CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgerüstet, welcher der CAN Spezifikation 2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable Interrupt) auslösen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Serialadapter	
5AC600.CANI-00	CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 99: 5AC600.CANI-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC600.CANI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Schnittstellen	
CAN	
Anzahl	1
Controller	Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller)
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
Abschlusswiderstand	
Typ	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung	deaktiviert

Tabelle 100: 5AC600.CANI-00 - Technische Daten

Pinbelegung

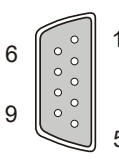
Add-on CAN		9-poliger DSUB-Stecker 
Typ	potenzialgetrennt	
Übertragungs- geschwindigkeit	max. 500 kBit/s	
Buslänge	max. 1000 Meter	
Pin	Belegung	
1	n.c.	
2	CAN LOW	
3	GND	
4	n.c.	
5	n.c.	
6	Reserviert	
7	CAN HIGH	
8	n.c.	
9	n.c.	

Tabelle 101: Pinbelegung CAN

I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	384h / 385h	-
IRQ	IRQ10	NMI ¹

Tabelle 102: Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ

¹ NMI = Non Maskable Interrupt.

Die Einstellung des IRQ kann im BIOS Setup geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

I/O Adresse	Register	Funktion
384h	Adressregister	Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.
385h	Datenregister	Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.

Buslänge und Kabeltyp

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121 % sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 1000	typ. 50
≤ 200	typ. 250
≤ 60	typ. 500

Tabelle 103: CAN Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	2x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω / km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Kabelquerschnitt	
Aderisolation	
Leiterwiderstand	
Verseilung	
Schirm	
Groundleiter	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω / km
Kabelquerschnitt	
Aderisolation	
Leiterwiderstand	
Außenmantel	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnnten Cu-Drähten
Material	
Eigenschaften	
Gesamtschirmung	

Tabelle 104: CAN Kabel Anforderungen

Abschlusswiderstand

Die Verdrahtung eines CAN-Netzes erfolgt in Busstruktur, wobei die beiden Busenden mit einem Abschlusswiderstand zu beschalten sind. Die Add-on CAN Interface Schnittstelle besitzt einen integrierten Abschlusswiderstand (Auslieferungszustand: deaktiviert auf Stellung „Aus“).

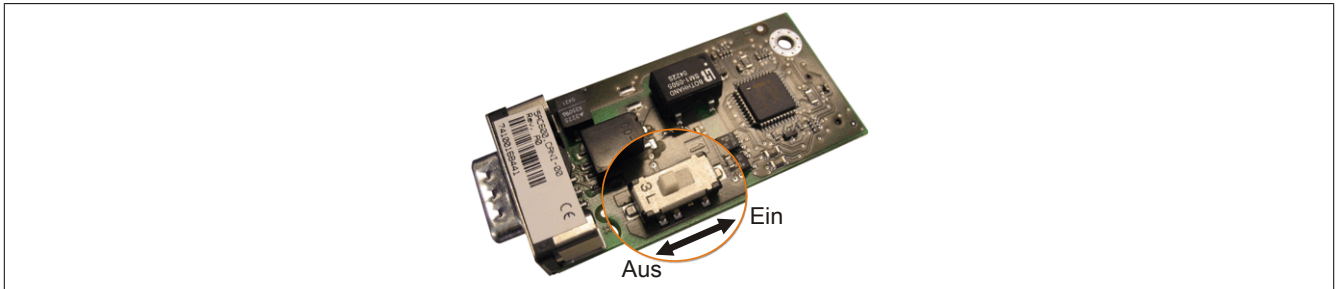


Abbildung 64: 5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface

Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

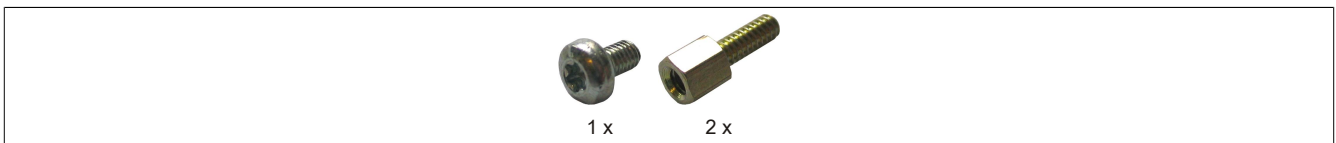


Abbildung 65: 5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial

Treibersupport

Auf Grund der Dual Core Prozessoren ist für Betrieb die INACAN.SYS Treiberversion 2.36, enthalten im PVI Setup 2.6.0.3105, Voraussetzung.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.10.3 5AC600.485I-00

Allgemeines

Die Serielle Schnittstelle ist eine kombinierte RS232/RS422/RS485-Schnittstelle. Die Auswahl der Betriebsart (RS232/RS422/RS485) erfolgt dabei automatisch je nach elektrischer Anschaltung.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5AC600.485I-00	Serialadapter RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.	

Tabelle 105: 5AC600.485I-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC600.485I-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Schnittstellen	
COM1	
Typ	RS232, nicht modemfähig, galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
max. Baudrate	115 kBit/s

Tabelle 106: 5AC600.485I-00 - Technische Daten

Pinbelegung

Add-on RS232/422/485		
	RS232	RS422/485
Typ	RS232 nicht modemfähig; galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungs- geschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 Meter	max. 1200 Meter
Pin	Belegung RS232	Belegung RS422
1	n.c.	TXD\
2	RXD	n.c.
3	TXD	n.c.
4	n.c.	TXD
5	GND	GND
6	n.c.	RXD\
7	RTS	n.c.
8	CTS	n.c.
9	n.c.	RXD

9-poliger DSUB-Stecker

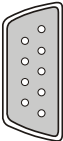


Tabelle 107: Pinbelegung RS232/RS422

I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	2E8h	238, 2F8, 338, 3E8, 3F8
IRQ	IRQ10	IRQ 3, 4, 5, 7, 11, 12

Tabelle 108: Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ

Die Einstellung der I/O Adresse und des IRQ kann im BIOS Setup (unter „Advanced“ - Untermenü „Baseboard/Panel Features“ - Untermenü „Legacy Devices“ Einstellung „COM E“) geändert werden. Bei Veränderung ist auf einen möglichen Konflikt mit einer anderen Ressource zu achten.

Buslänge und Kabeltyp RS232

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
≤ 15	typ. 64
≤ 10	typ. 115
≤ 5	typ. 115

Tabelle 109: RS232 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel	
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,16 mm ² (26AWG), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω / km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω / km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 110: RS232 Kabel Anforderungen

Buslänge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 111: RS422 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω / km Adern
Verseilung	zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω / km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 112: RS422 Kabel Anforderungen

Betrieb als RS485-Schnittstelle

Für den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

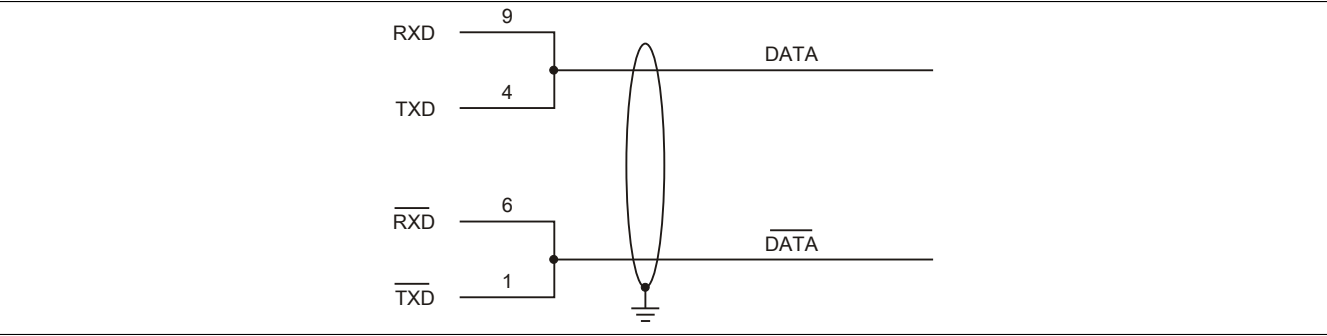


Abbildung 66: Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss für jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgeführt werden, es gibt keine automatische Rückschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitführen der Masseleitung verbessert werden.

Die Leitungsenden der RS485 Schnittstelle sollten (zumindest bei größeren Leitungslängen bzw. größeren Übertragungsraten) abgeschlossen werden. Dazu kann in der Regel ein passiver Abschluss durch verbinden der Signalleitungen über jeweils einen 120 Ω Widerstand an den beiden Busenden verwendet werden.

Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung [m]	Übertragungsrate [kBit/s]
1200	typ. 115

Tabelle 113: RS485 Buslänge und Übertragungsraten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze PE $\leq 82 \Omega / \text{km}$ Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze PE $\leq 59 \Omega / \text{km}$
Außenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 114: RS422 Kabel Anforderungen

Lieferumfang

Für den Einbau sind die im Montagekit beigelegten Schrauben zu verwenden.

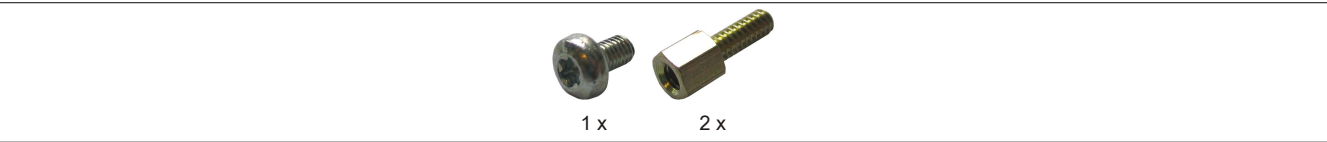


Abbildung 67: 5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Die Geräte werden mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind für M5 Schrauben konzipiert.

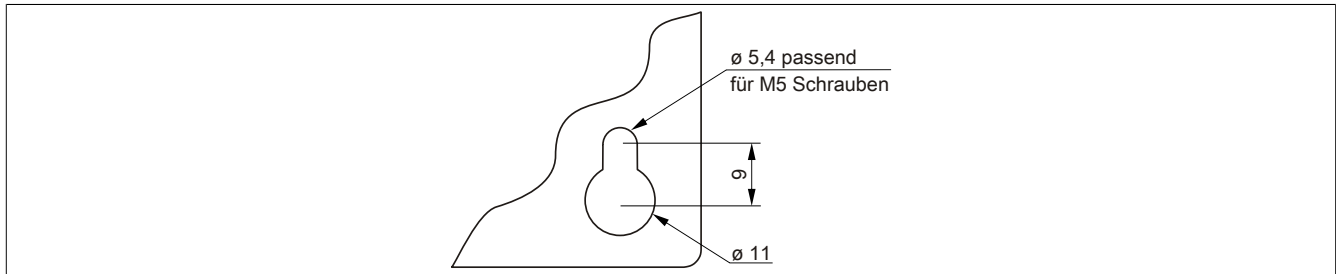


Abbildung 68: Befestigungslasche

Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im Kapitel 2 "Technische Daten", Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 65 entnommen werden.

1.1 Vorgehensweise

1. Den Schaltschrank mit den benötigten Bohrungen versehen. Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen entnommen werden.
2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben am Schaltschrank montieren.

1.2 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Das Gerät muss auf planer Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

1.3 Einbaulagen

Ein APC810 System darf nur wie nachfolgend abgebildet bzw. beschrieben montiert werden.

1.3.1 Einbaulage - senkrecht

Diese Art der Montage kann sowohl für APC810 Systeme mit und ohne Lüfter Kit verwendet werden.

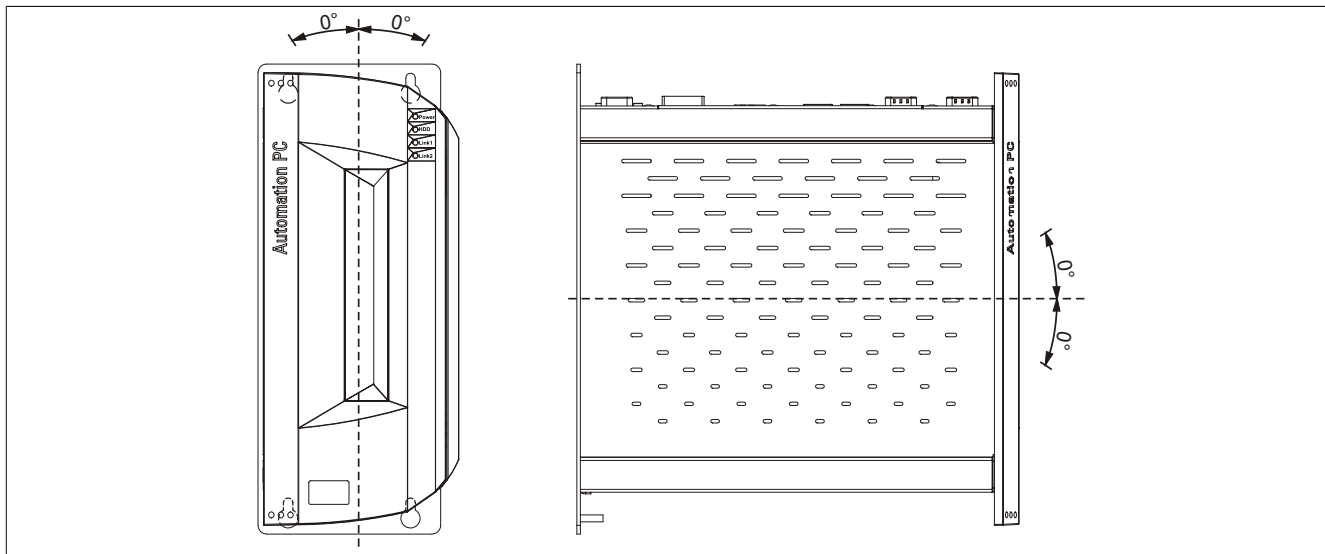


Abbildung 69: Einbaulage - senkrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 151 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.3.2 Einbaulage - waagrecht

Der Betrieb in waagrechtlicher Einbaulage (Kühlkörper nach oben) ist nur in Verbindung mit einem Lüfter Kit erlaubt. Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation muss um 5°C herabgesetzt werden.

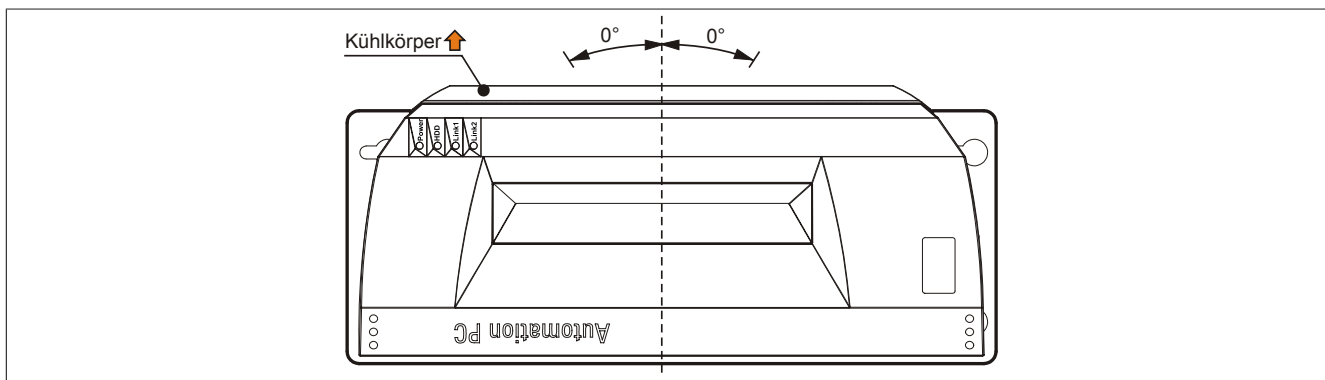


Abbildung 70: Einbaulage - waagrecht

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Abstände wie in Abschnitt "Luftzirkulationsabstände" auf Seite 151 eingehalten werden, um eine natürliche Luftzirkulation zu erreichen.

1.4 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Automation PC 810 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Automation PC 810 Varianten gültig.

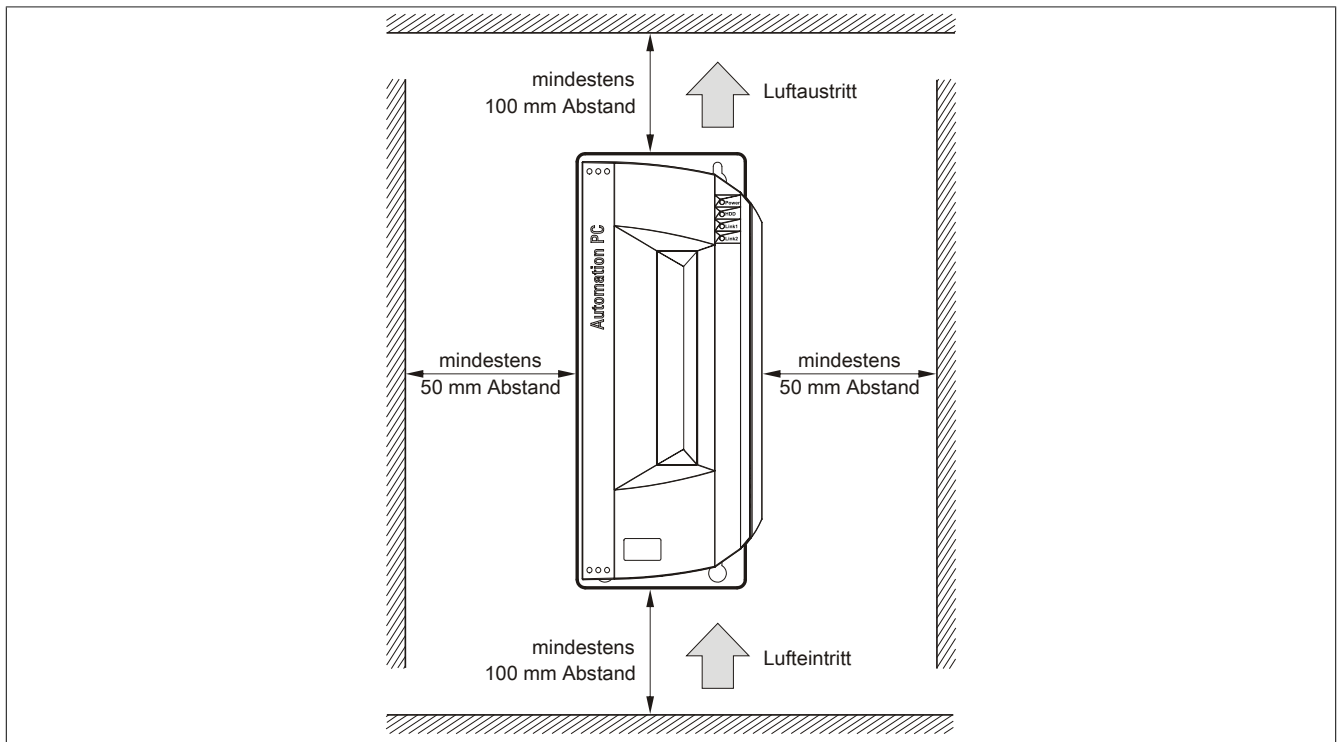


Abbildung 71: Standardmontage - Montageabstände

Diese definierten Abstände gelten sowohl für die senkrechte als auch die waagrechte Montage des APC810.

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben" im Kapitel "Technische Daten").

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel "Technische Daten") vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln darf der Biegeradius an keiner Stelle unterschritten werden.

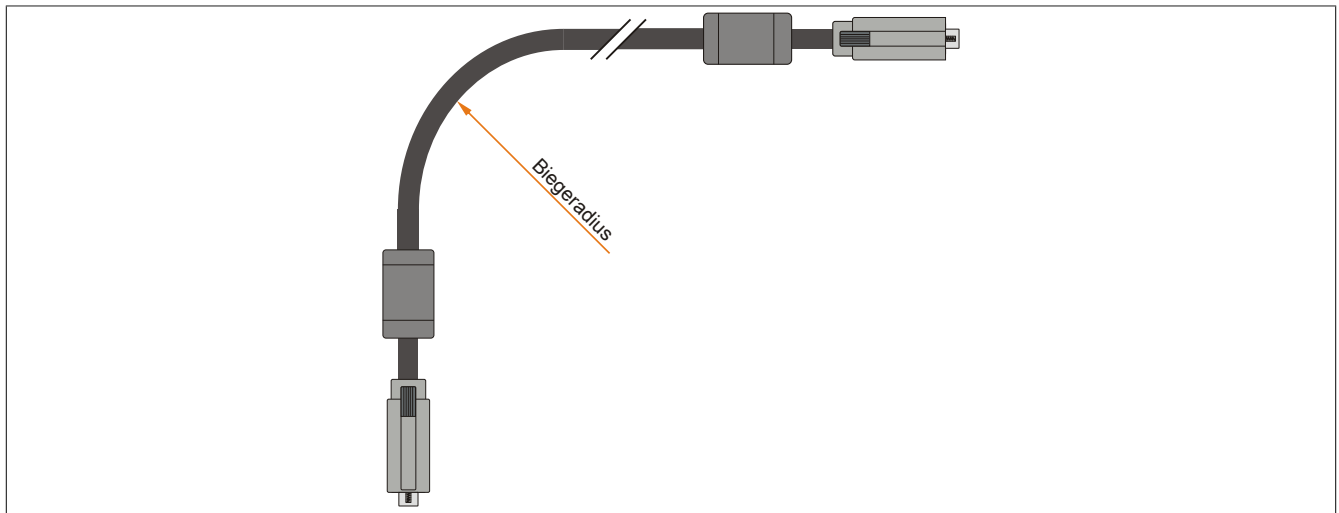


Abbildung 72: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Die Funktionserde des Gerätes besitzt 2 Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

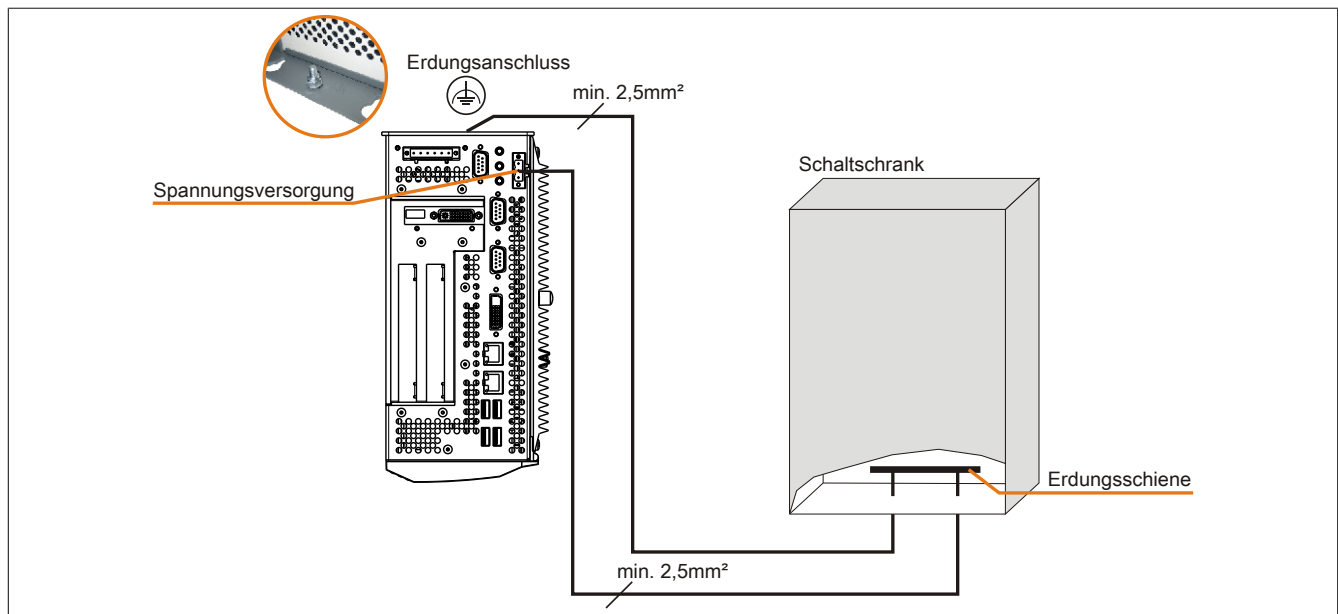


Abbildung 73: Erdungskonzept

4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R Industrie PCs oder Power Panels zu erklären. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen. Dies bedeutet, dass während den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im später verwendeten Schaltschrankgehäuse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor für das zu testende Gerät montiert werden, um die Umgebungstemperatur laufend zu überwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R Industrie PC, in der Nähe der Luftansaugung (nicht in der Nähe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Gerätefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach Gerätefamilie unterschiedlich.

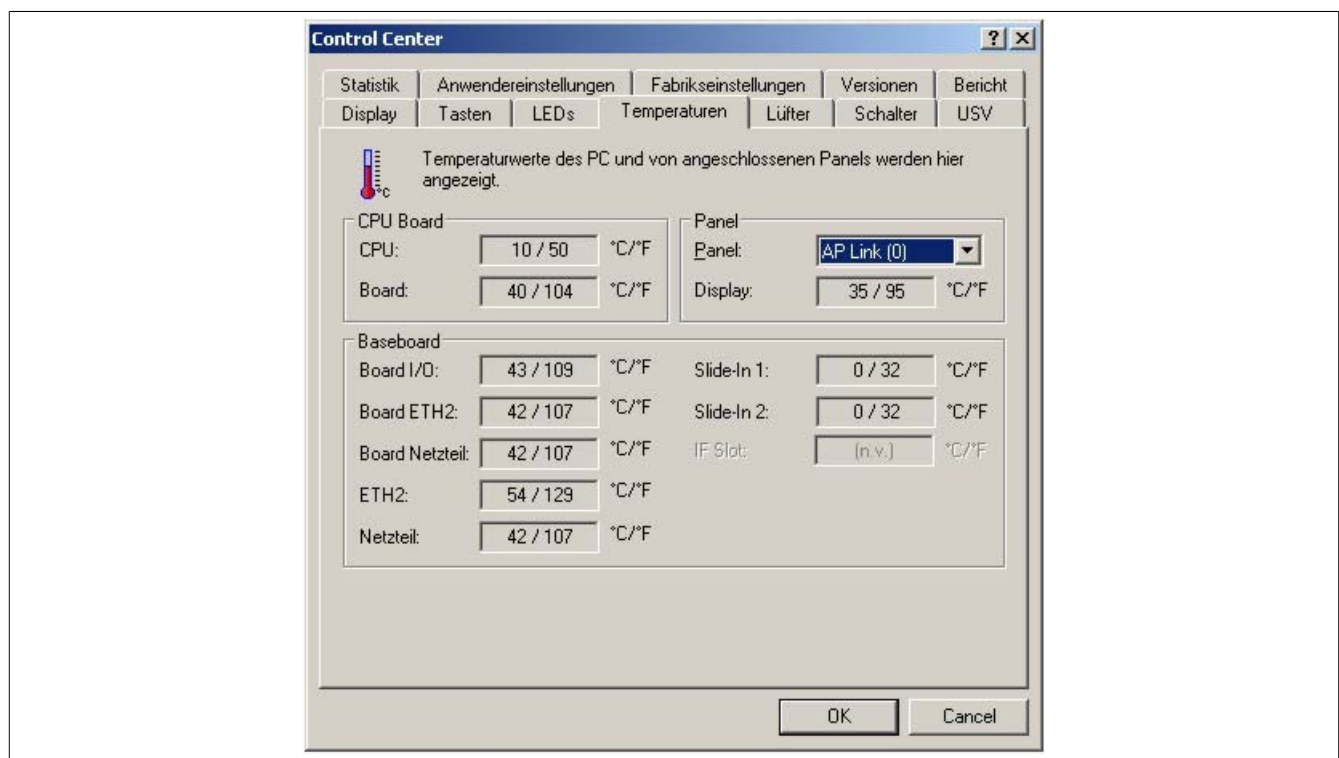
Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt "Temperatursensorpositionen" im "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden empfohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen können im Reiter „Temperaturen“ angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Automation Device Interface (ADI).



Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) eigene SDK's verfügbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.

4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark

Wird zur Temperatúrauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwendung des Softwaretools BurnIn Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool BurnIn ist in einer Standard und Professional Version erhältlich. Zusätzlich zum Softwarepaket sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, ...) und Test-CDs bzw. DVDs erhältlich. Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe System- und Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter können ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen dazu sind unter www.passmark.com zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark BurnIn Pro Version V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.

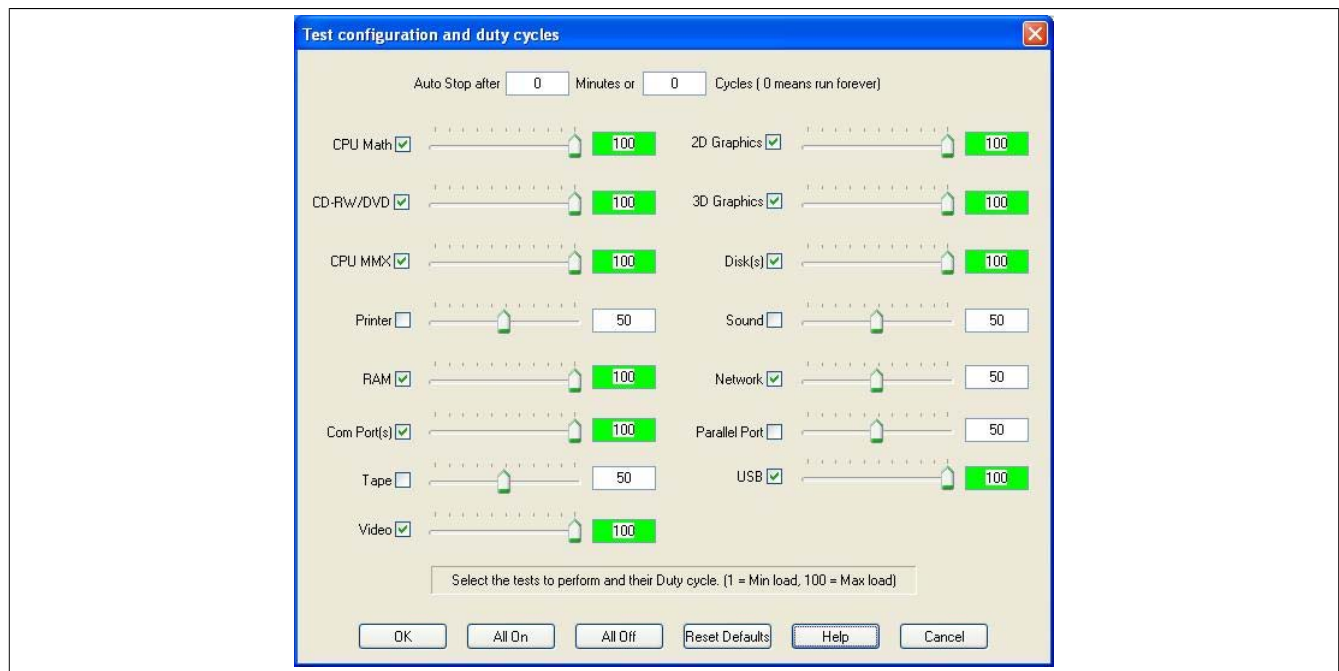


Abbildung 74: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD

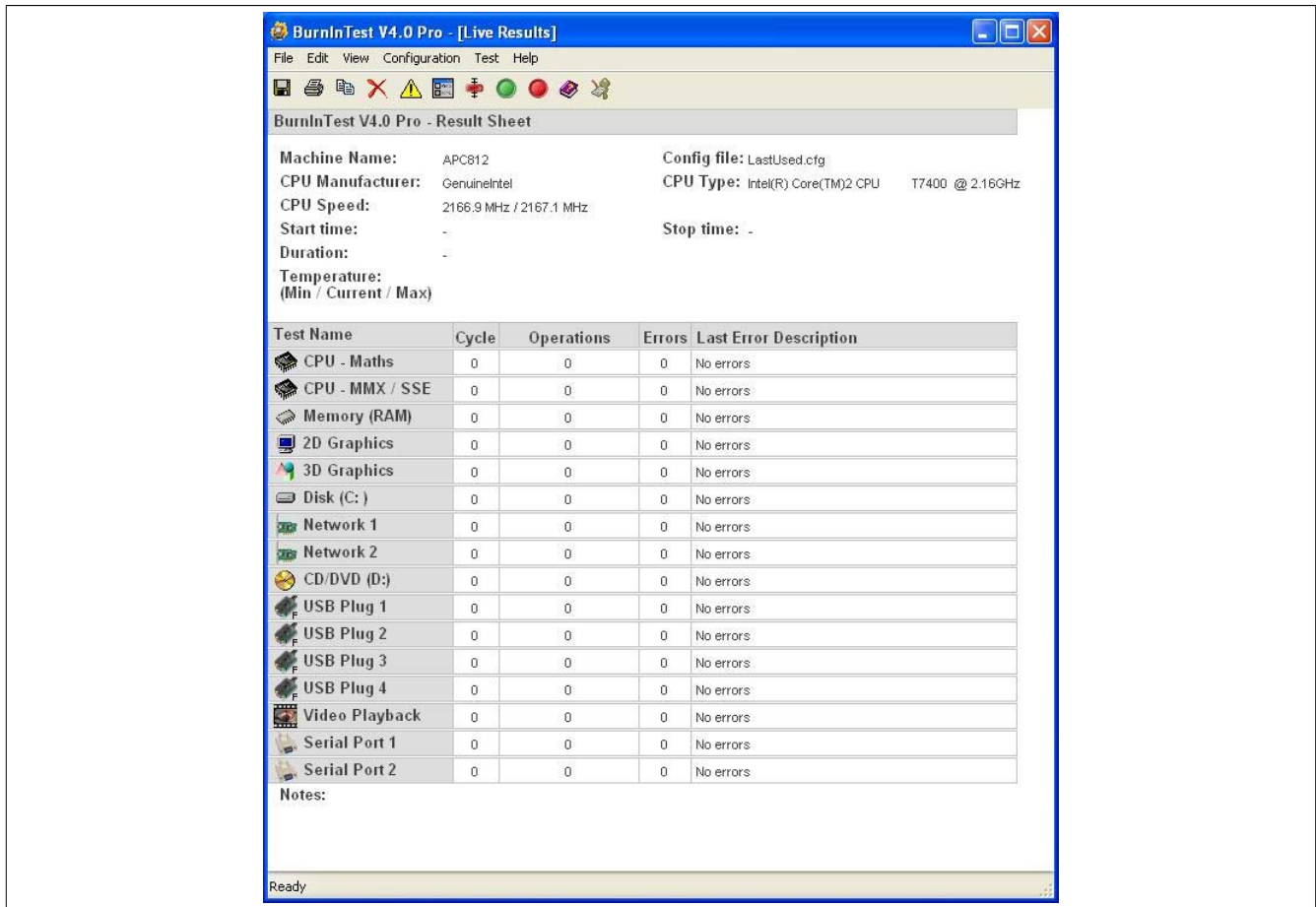


Abbildung 75: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

Je nach Verfügbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen Testproperties vorgenommen werden.

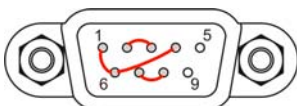
Information:

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfügung, so können auch USB Memory Sticks verwendet werden. Die USB Memory Sticks müssen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfügung stehen. Der Test USB ist dann abzuwählen und die USB Memory Stick Laufwerke müssen in den Diskproperties als Testdevice konfiguriert werden.



Information:

Serielle Loopback Adapter können relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige Pins mit Drähten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.



4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die gerätespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen übernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Für jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel können Beispielprogramme und Implementierungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbüchern spezifizierte Temperaturgrenze nicht überschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgeführt werden können, so können diese z.B. in Büroumgebung durchgeführt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur notwendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, können bei passiven Systemen (Systeme ohne Lüfter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch die Temperaturwerte bei Systemen mit Lüfter Kit hochrechnen zu können, müssen die Lüfter laufen. Weiters ist dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lüfter durchgeführt, so werden die zu testenden Geräte durch diesen Lüfter gekühlt und somit auch die Messergebnisse verfälscht. Bei passiven Geräten sind die Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lüfter durchführen zu können ohne die Messergebnisse zu verfälschen, ist der Lüfter der Klimakammer auszuschalten und eine entsprechend große Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhandbuch gültig.

Temperatursensor	Gemessene Temperatur	Hochgerechnete Temperatur	
Umgebungstemperatur	20°C	35°C	45°C
CPU	48°C	63°C	73°C
CPU Board	51°C	66°C	76°C
Board I/O	51°C	66°C	76°C
Board ETH2	52°C	67°C	77°C
Board Netzteil	51°C	66°C	76°C
ETH2	65°C	80°C	90°C
Netzteil	51°C	66°C	76°C

Tabelle 115: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten, in welcher Art Automation Panel 900 Geräte und/oder Automation Panel 800 mit dem APC810 verbunden werden können. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie können Automation Panel 900 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 800 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 900 Geräte gleichzeitig am Monitor / Panel Ausgang und am optionalen SDL AP Link des APC810 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Was bedeutet „Display Clone“ und „Erweiterter Desktop“ Betrieb?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können pro Strang angeschlossen werden?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können mit einem Automation Panel 800 Gerät pro Strang angeschlossen werden?
- Wie werden die angeschlossenen Geräte intern nummeriert?
- Gibt es Einschränkungen bei der Segmentlänge, wenn ja welche?
- Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benötigt?
- Müssen BIOS Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration geändert werden?

5.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die möglichen AP900 Geräte aufgelistet die mit einem AP800 Gerät an einem Strang angeschlossen werden können.

Automation Panel 800	Automation Panel 900
5AP820.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01
5AP880.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01

Tabelle 116: Auswahl der Displayeinheiten

5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflösung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle oder ein analoger Monitor (über Adapter Best. Nr. 5AC900.1000-00) betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils über eigene Kabel geführt. Sollen USB Geräte am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

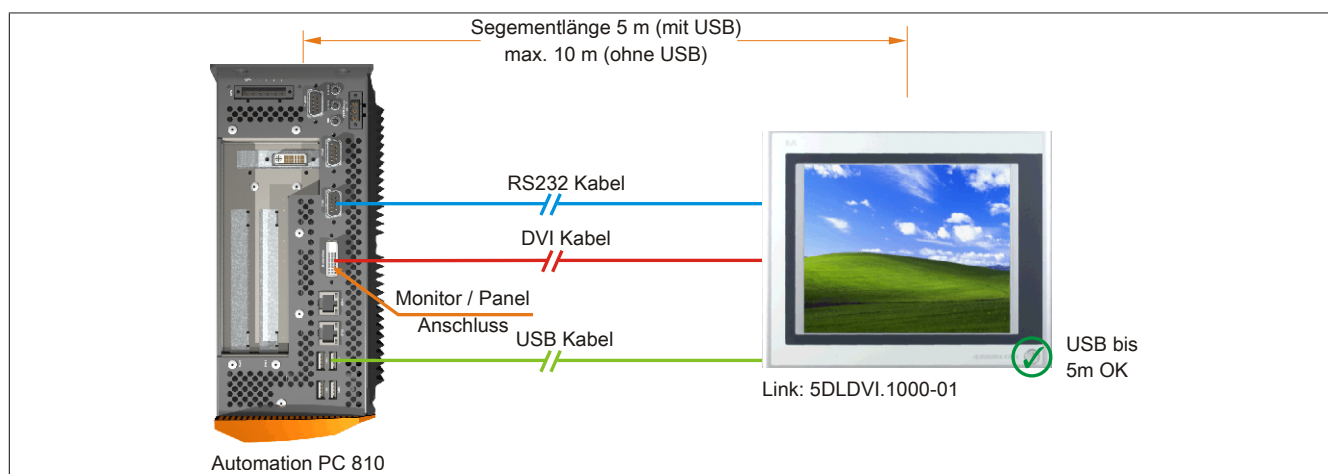


Abbildung 76: Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)

5.2.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	✓	✓	✓	✓	max. SXGA
5PC800.BM45-01	✓	✓	✓	✓	max. SXGA

Tabelle 117: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.2.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DL DVI.1000-01	Automation Panel Link DVI Receiver Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 118: Linkbaugruppen

5.2.3 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 benötigten Typen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	5 m ±80 mm
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	10 m ±100 mm
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	5 m ±80 mm
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	10 m ±100 mm
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	5 m ±50 mm

Tabelle 119: Kabel für DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.2.4 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

Es können folgende Automation Panel 900 Geräte verwendet werden, wobei in seltenen Fällen eine Einschränkung der Segmentlänge in Abhängigkeit der Auflösung besteht.

Bestellnummer	Diagonale	Auflösung	Touchscreen	Tasten	max. Segmentlänge
5AP920.1043-01	10,4"	VGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1214-01	12,1"	SVGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1505-01	15,0"	XGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1706-01	17,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1906-01	19,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾

Tabelle 120: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

1) Keine USB Unterstützung am Automation Panel 900 möglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Übertragungsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geräten möglich.

5.2.5 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

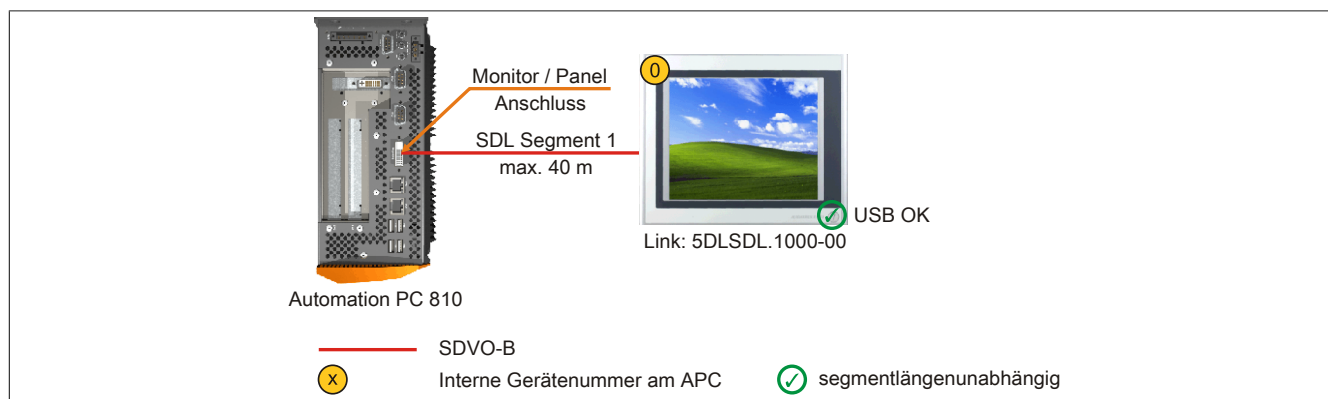


Abbildung 77: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.3.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 121: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.3.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Sericedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 122: Linkbaugruppen

5.3.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm

Tabelle 123: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 123: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 124: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.3.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

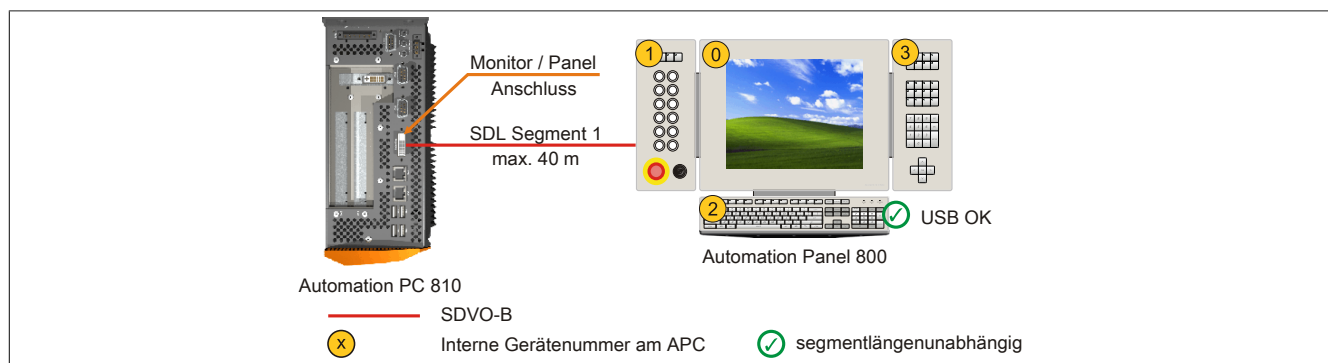


Abbildung 78: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.4.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 125: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.4.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.	25 m ±230 mm
5CASDL.0300-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm

Tabelle 126: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung
	XGA 1024 x 768
1,8	5CASDL.0018-20
5	5CASDL.0050-20
10	5CASDL.0100-20
15	5CASDL.0150-20

Tabelle 127: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung
	XGA 1024 x 768
20	5CASDL.0200-20
25	5CASDL.0250-20
30	5CASDL.0300-30
40	5CASDL.0400-30

Tabelle 127: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.4.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen werden.

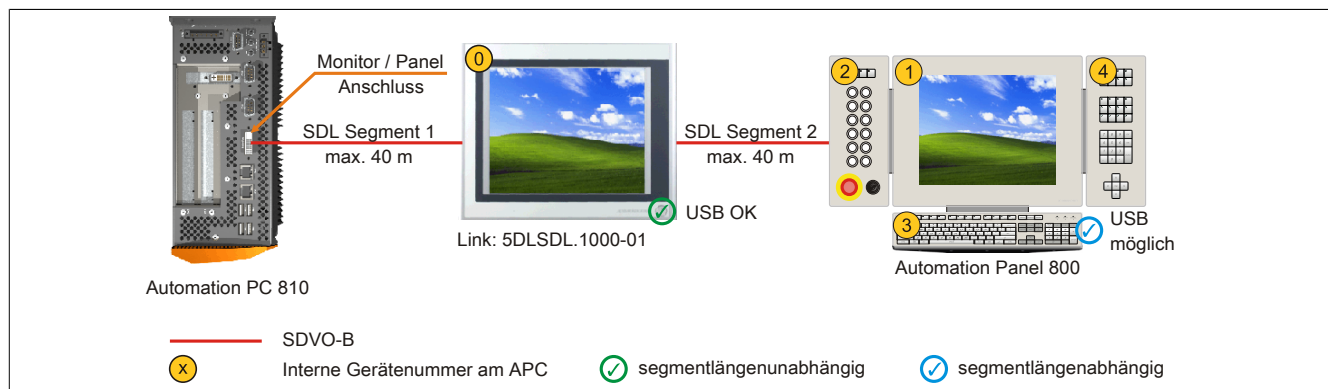


Abbildung 79: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.5.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 128: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.5.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLDLVI.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 129: Linkbaugruppen

5.5.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 161.

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 163.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

5.5.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

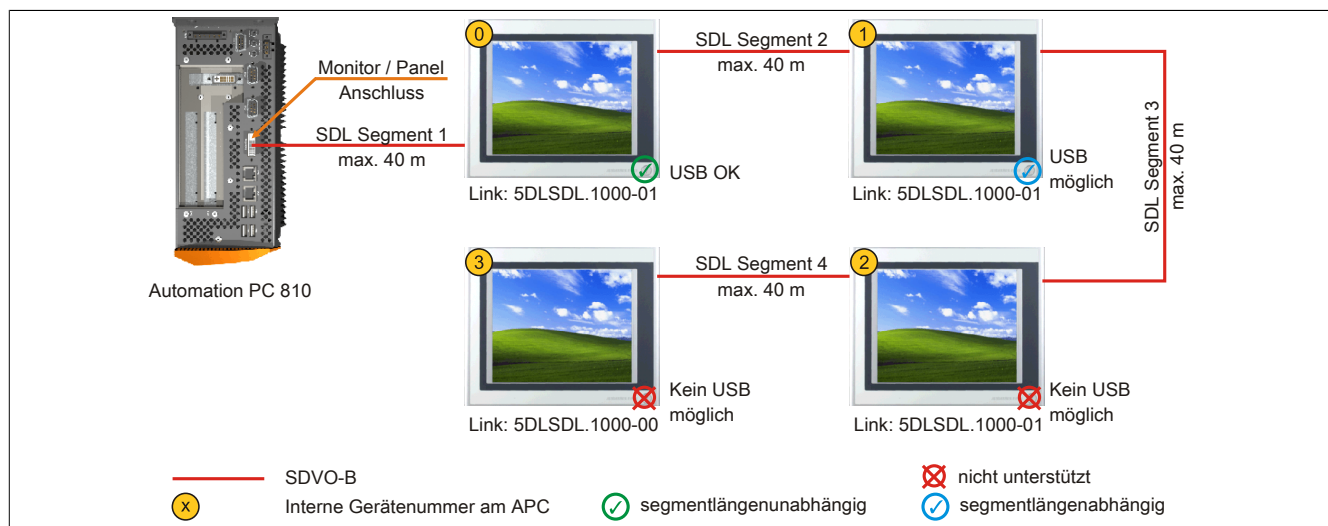


Abbildung 80: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.6.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	✓	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	✓	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 130: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

5.6.2 Linkbaugruppen

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLTVI.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 131: Linkbaugruppen

5.6.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 132: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 133: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.6.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.7 Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

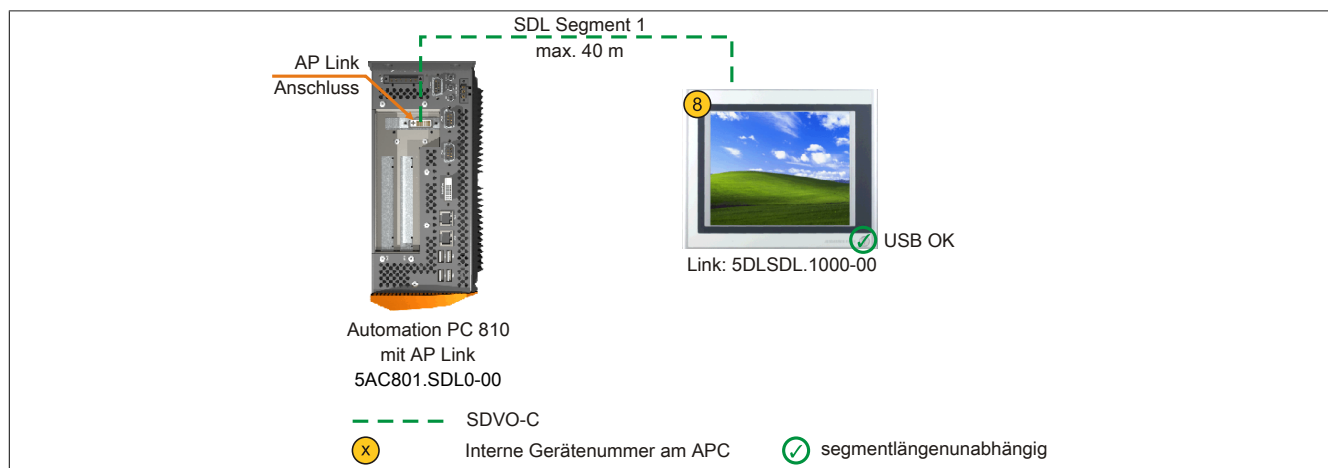


Abbildung 81: Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.7.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 134: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.7.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 135: Linkbaugruppen

5.7.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm

Tabelle 136: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 136: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 137: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.7.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.8 Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link

An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) ist ein Automation Panel 900 über ein SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

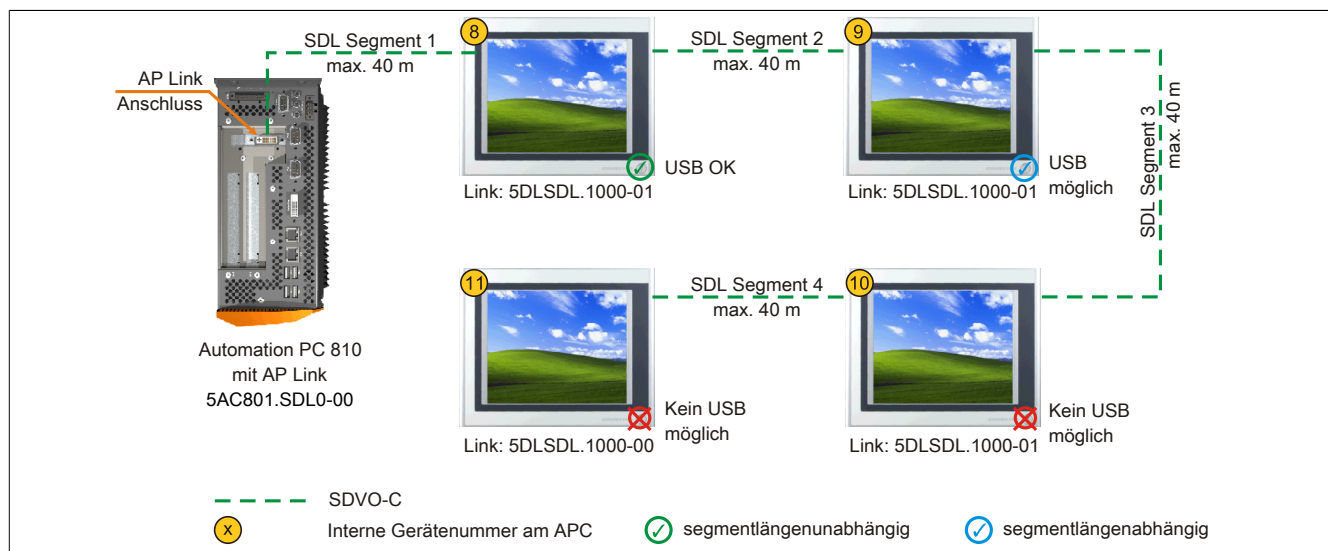


Abbildung 82: Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto)

5.8.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 138: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.8.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 139: Linkbaugruppen

5.8.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 140: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 141: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.8.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am AP Link Anschluss, muss die COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.9 Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An dem optionalen SDL Transmitter (AP Link) wird ein weiteres Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL betrieben. Die Automation Panel zeigen unterschiedliche Bildinhalte (Erweiterter Desktop) und können verschiedene Typen sein.

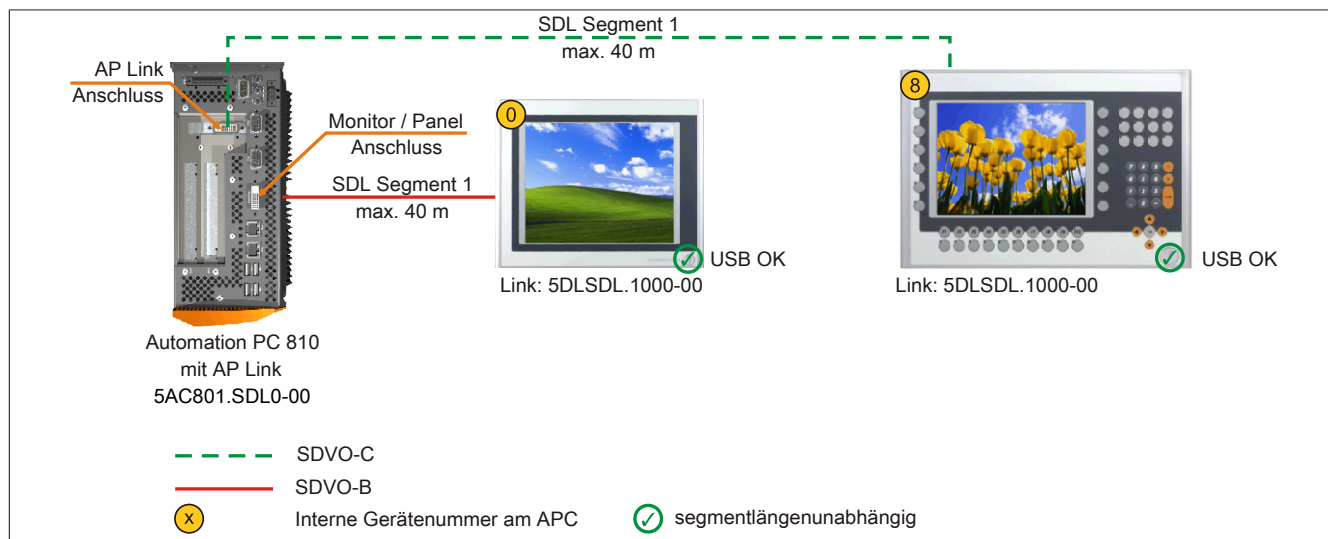


Abbildung 83: Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.9.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 142: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.9.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 143: Linkbaugruppen

5.9.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm

Tabelle 144: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 144: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 145: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.9.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.10 Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind vier Automation Panel 900 (max. UXGA) über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter (AP Link) werden zusätzlich vier Automation Panel 900 (max. UXGA) betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Panel im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) der beiden Stränge unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr jeweils am ersten Panel jedes Stranges zur Verfügung. USB Geräte können dabei nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

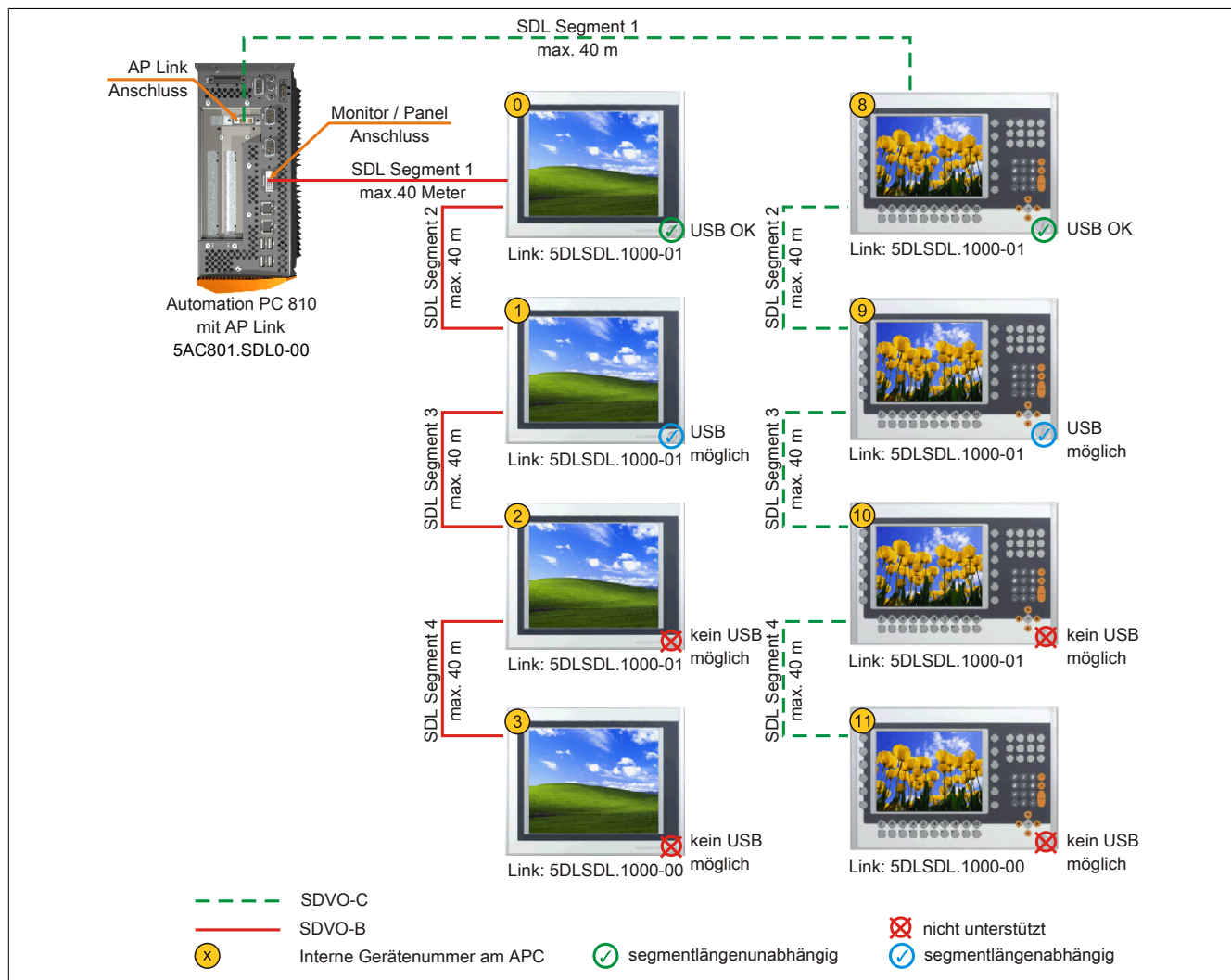


Abbildung 84: Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.10.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 146: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.10.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 147: Linkbaugruppen

5.10.3 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 148: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-03	- - -

Tabelle 149: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-

Tabelle 149: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.10.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

5.11 Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link

An der integrierten SDL Schnittstelle (onboard) sind drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen. An den optionalen SDL Transmitter werden zusätzlich drei Automation Panel 900 (max. UXGA) und ein Automation Panel 800 betrieben. Die Automation Panel in jedem Strang müssen jeweils vom gleichen Typ sein. Die Bildinhalte der beiden Stränge sind verschieden (Erweiterter Desktop), wobei die Displays im jeweiligen Strang denselben Bildinhalt (Display Clone) zeigen.

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an den Automation Panel 900 Geräten angeschlossen werden.

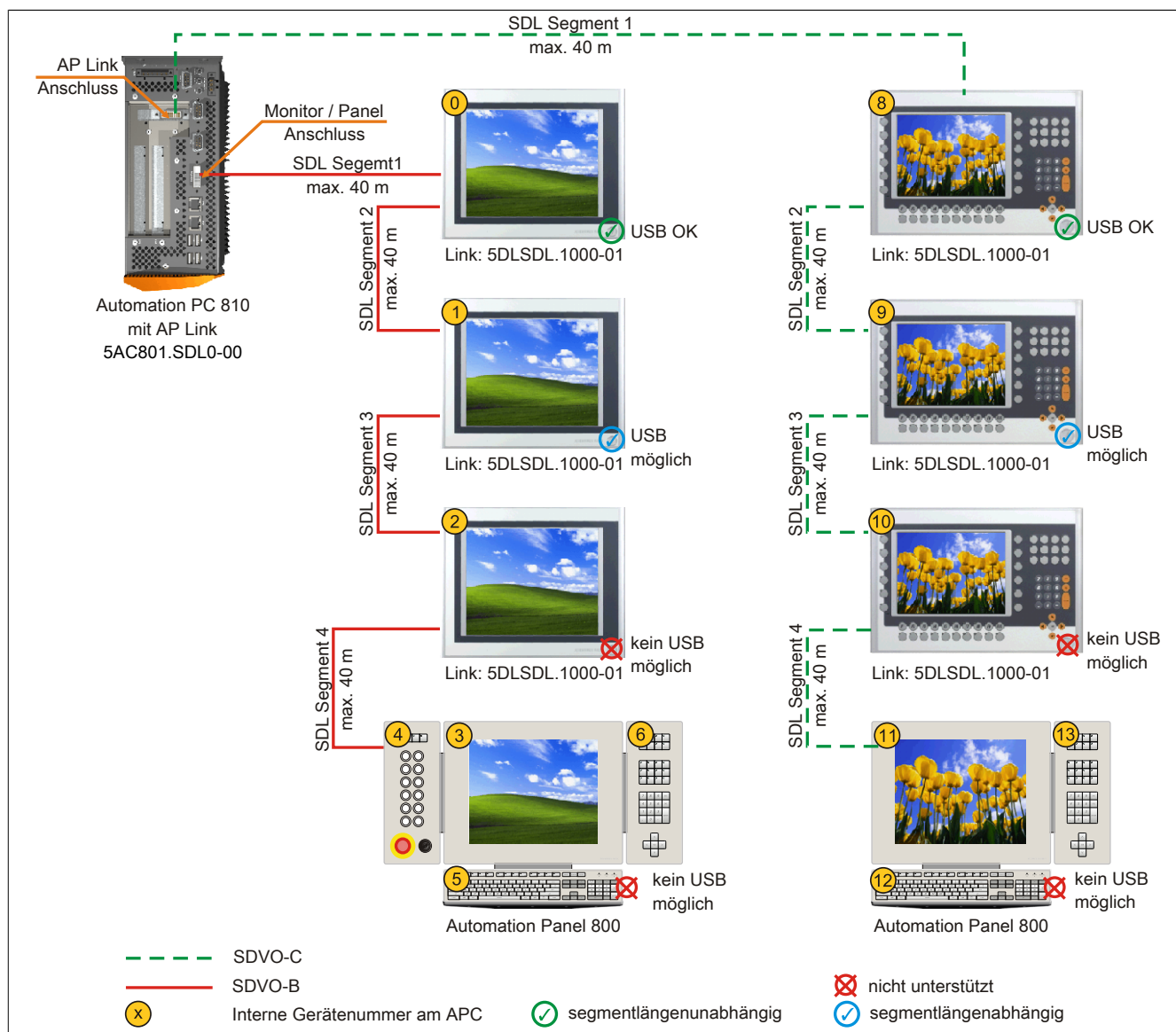


Abbildung 85: Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto)

5.11.1 Voraussetzung Grundsystem

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen von APC810 Systemeinheit und CPU Board um die in der obigen Abbildung gezeigte Konfiguration zu realisieren. Tritt bei der Kombination eine Einschränkung der max. Auflösung auf, so kann man dies auch folgender Tabelle entnehmen (z.B. für den Anschluss eines nicht B&R Automation Panel 900 Gerätes).

CPU Board	mit Systemeinheit				Einschränkung Auflösung
	5PC810.SX01-00 ¹⁾	5PC810.SX02-00	5PC810.SX03-00	5PC810.SX05-00	
5PC800.BM45-00	-	✓	✓	✓	max. UXGA
5PC800.BM45-01	-	✓	✓	✓	max. UXGA

Tabelle 150: Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board

1) Keine Möglichkeit zur AP Link Montage.

5.11.2 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5AC801.SDL0-00	APC810 AP Link SDL Transmitter Automation Panel Link Transmitter SDL	für Automation PC 810

Tabelle 151: Linkbaugruppen

5.11.3 Kabel

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP900 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 161.

Auswahl eines SDL Kabels für den Anschluss des AP800 Displays an das AP900 Display siehe "Kabel" auf Seite 163.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Kapitel "Zubehör".

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung				
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200
1,8	-	-	5CASDL.0018-00 5CASDL.0018-01 5CASDL.0018-20 5CASDL.0018-03	-	-
5	-	-	5CASDL.0050-00 5CASDL.0050-01 5CASDL.0050-20 5CASDL.0050-03	-	-
10	-	-	5CASDL.0100-00 5CASDL.0100-01 5CASDL.0100-20 5CASDL.0100-03	-	-
15	-	-	5CASDL.0150-00 5CASDL.0150-01 5CASDL.0150-20 5CASDL.0150-03	-	-
20	-	-	5CASDL.0200-00 5CASDL.0200-20 5CASDL.0200-03	-	-
25	-	-	5CASDL.0250-00 5CASDL.0250-01 5CASDL.0250-03	-	-
30	-	-	5CASDL.0300-10 5CASDL.0300-13 5CASDL.0300-30	-	-
40	-	-	5CASDL.0400-10 5CASDL.0400-13 5CASDL.0400-30	-	-

Tabelle 152: Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel

5.11.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens der angeschlossenen Panel am Monitor / Panel bzw. AP Link Anschluss, muss die COM C bzw. COM D im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „Advanced - Baseboard / Panel Features - Legacy Devices“).

6 Anschluss von USB Peripheriegeräten

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

6.1 Lokal am APC810

An die 5 USB Schnittstellen können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können die USB Schnittstellen USB1, USB3 und USB5 hierzu jeweils mit 1A bzw. die USB Schnittstellen USB2 und USB4 jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.



Abbildung 86: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810

6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es können nur Eingeräte angeschlossen werden.



Abbildung 87: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI

6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlüsse bei Automation Panel 800 Geräten können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es können nur Eingeräte angeschlossen werden.



Abbildung 88: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL

7 Konfiguration eines SATA RAID Verbundes

Information:

Die nachfolgende Softwarebeschreibung ist für die PCI SATA Controller 5ACPCI.RAIC-01, 5ACPCI.RAIC-03 und 5ACPCI.RAIC-05 gültig.

Für die Konfiguration ist es notwendig in das BIOS des „RAID Configuration Utility“ einzusteigen. Nach dem POST <Strg+S> oder <F4> Drücken um das RAID BIOS aufzurufen.

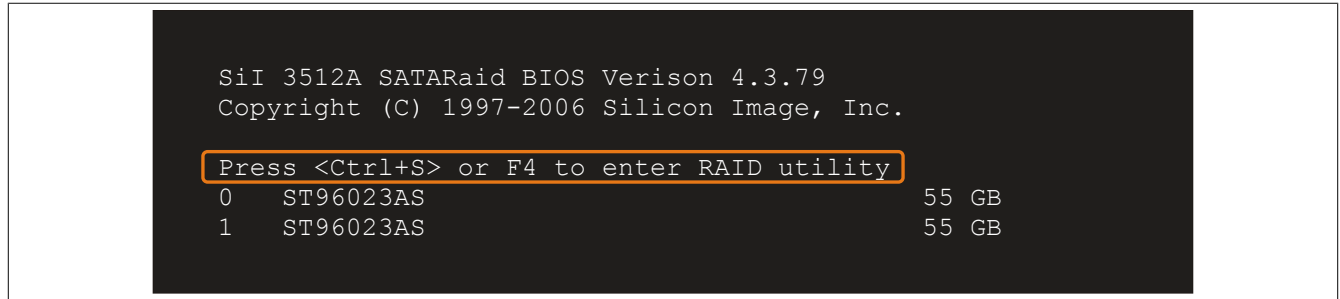


Abbildung 89: Einstieg in das RAID Configuration Utility

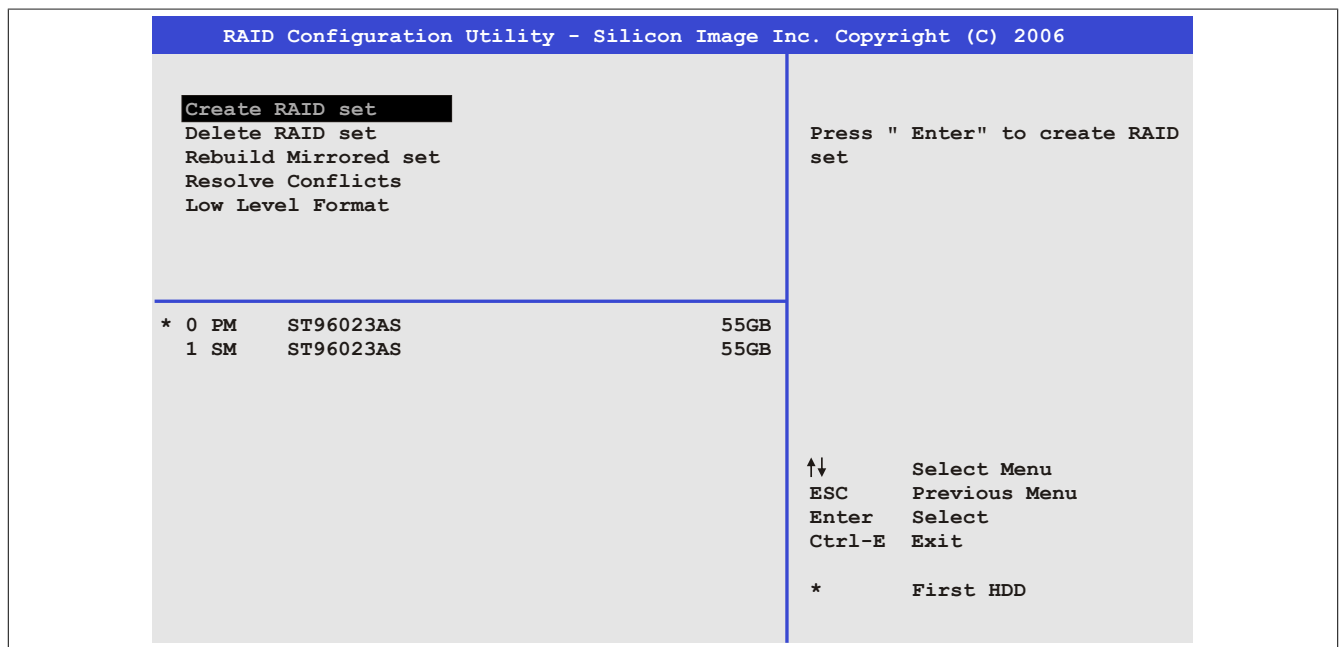


Abbildung 90: RAID Configuration Utility - Menü

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
Cursor ↑	Zum vorherigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Enter	Auswahl des Punktes bzw. Aufruf von Untermenüs.
ESC	Rücksprung zum vorherigen Menü.
Ctrl+E	Ausstieg aus dem Setup und Speichern der vorgenommenen Einstellungen.

Tabelle 153: BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility

7.1 Create RAID Set

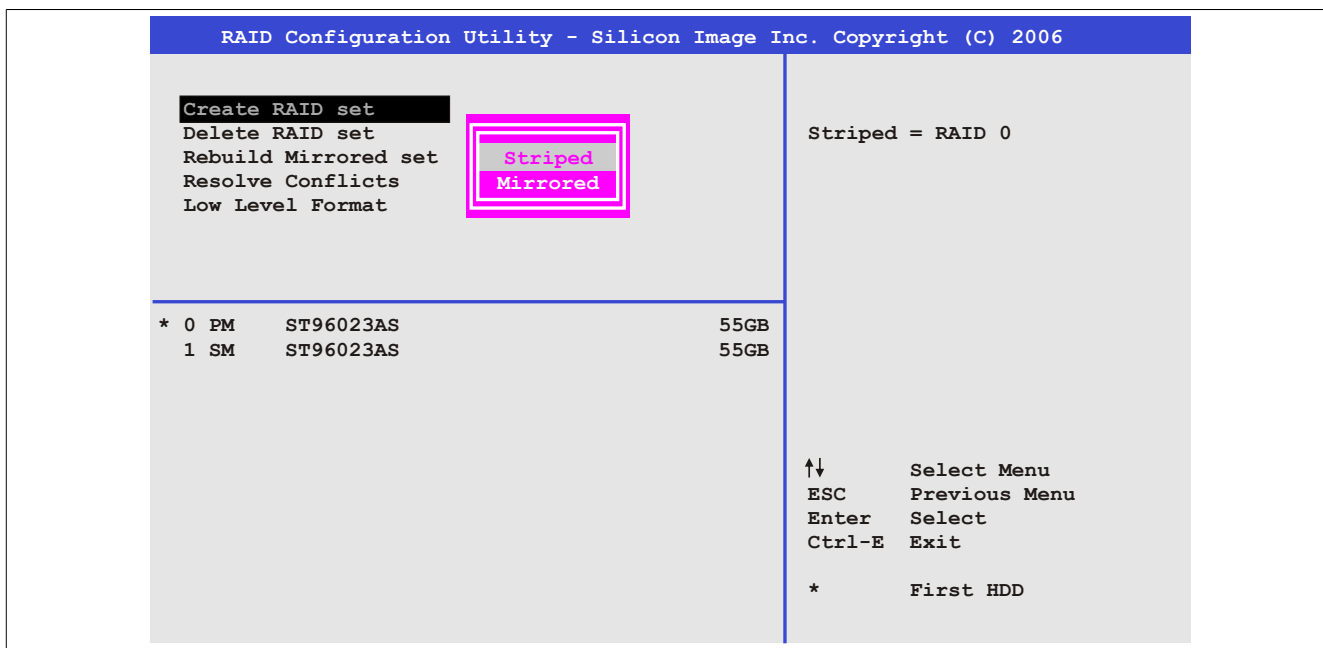


Abbildung 91: RAID Configuration Utility - Menü

Über das Menü „Create RAID set“ ist es möglich das RAID System als „Striped“ = RAID0 oder „Mirrored“ = RAID1 neu zu erstellen.

7.2 Create RAID Set - Striped

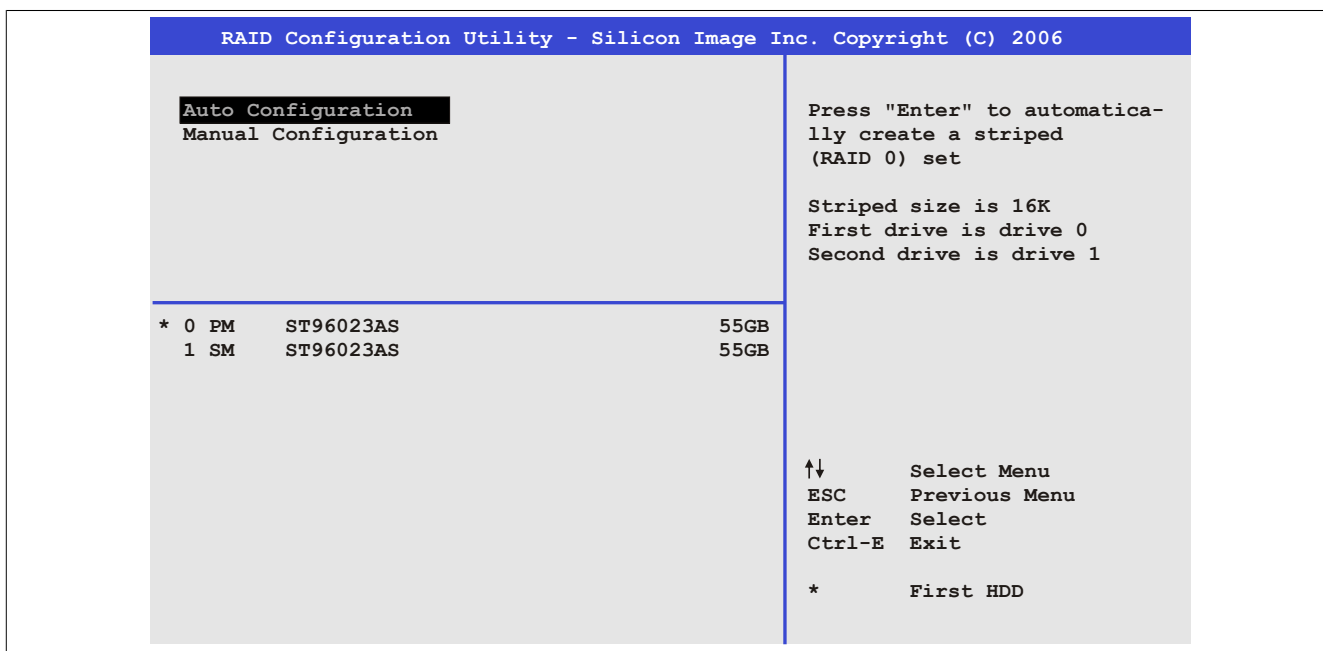


Abbildung 92: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped

„Auto Configuration“

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

„Manual Configuration“

Es ist möglich die erste und zweite HDD zu bestimmen sowie die „Chunk Size“ (=Blockgröße, applikationsabhängig) auszuwählen.

7.3 Create RAID Set - Mirrored

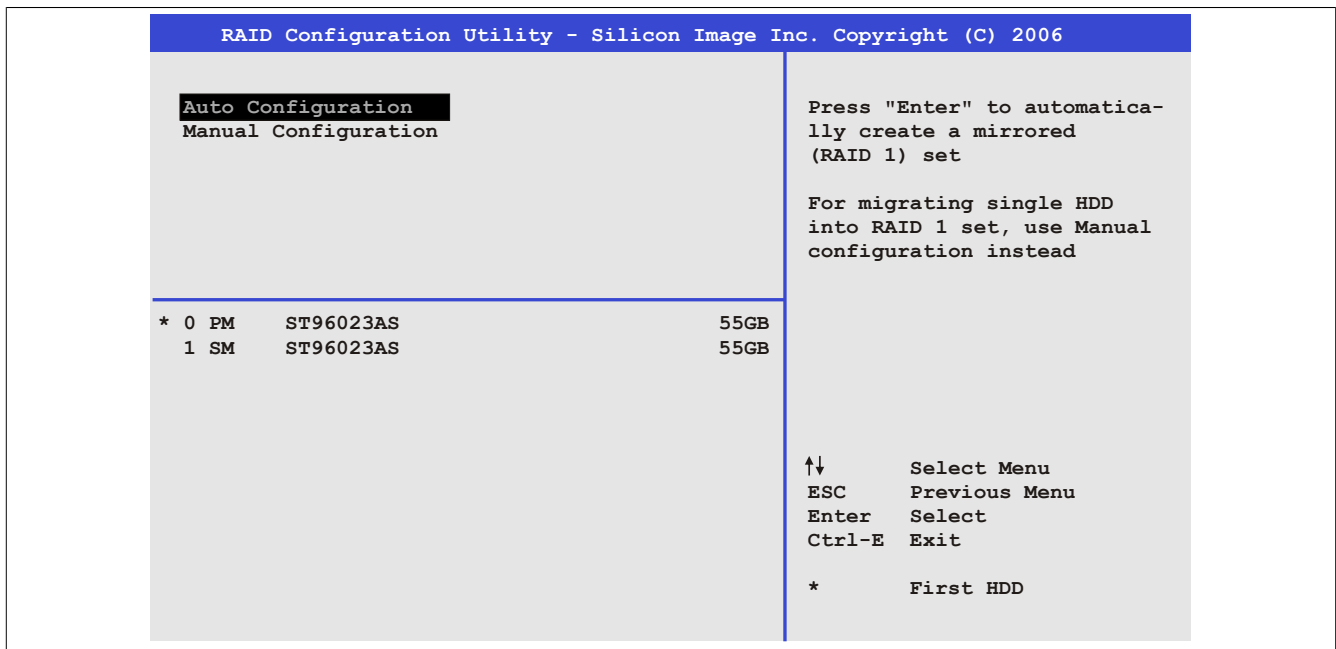


Abbildung 93: RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored

„Auto Configuration“

Bei der Auto Configuration werden alle Einstellungen optimal angepasst.

„Manual Configuration“

Es ist möglich die „Source“ und „Target“ HDD zu bestimmen, sowie ob sofort ein Rebuild (Spiegelung) durchgeführt werden soll (Dauer ca. 50 Minuten) oder nicht.

7.4 Delete RAID Set

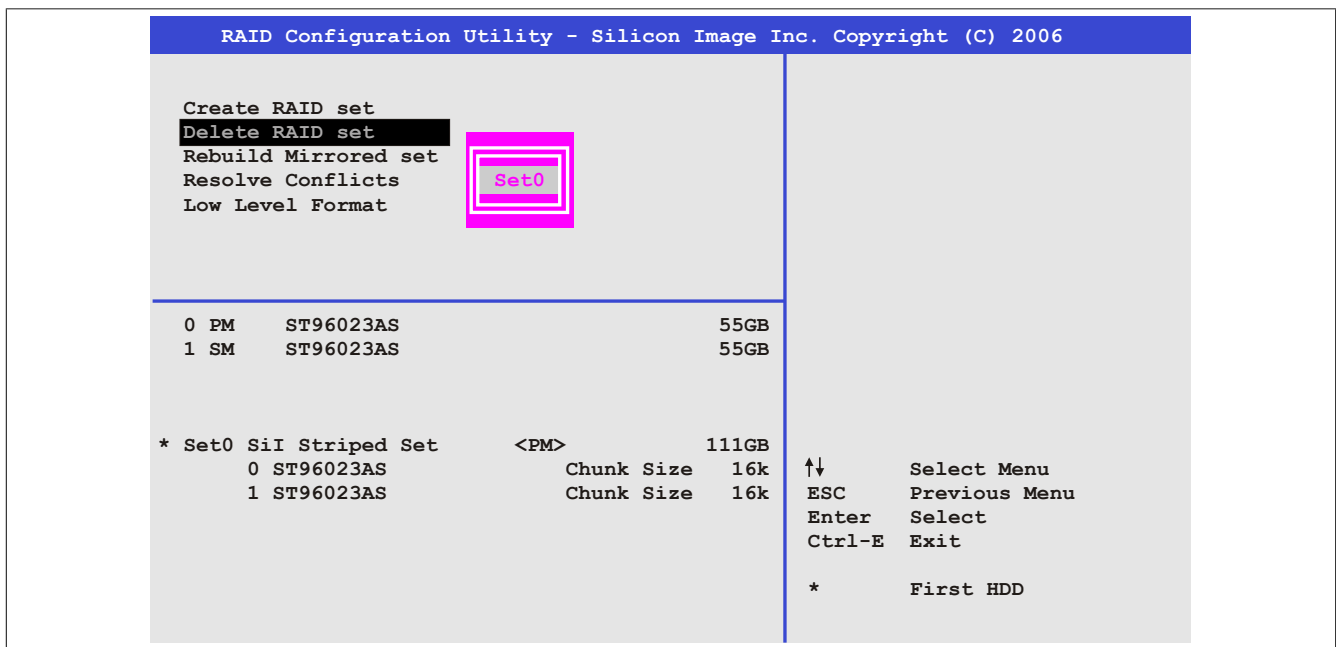


Abbildung 94: RAID Configuration Utility - Delete RAID set

Über das Menü „Delete RAID set“ kann ein bestehender RAID Verbund aufgelöst werden.

7.5 Rebuild Mirrored Set

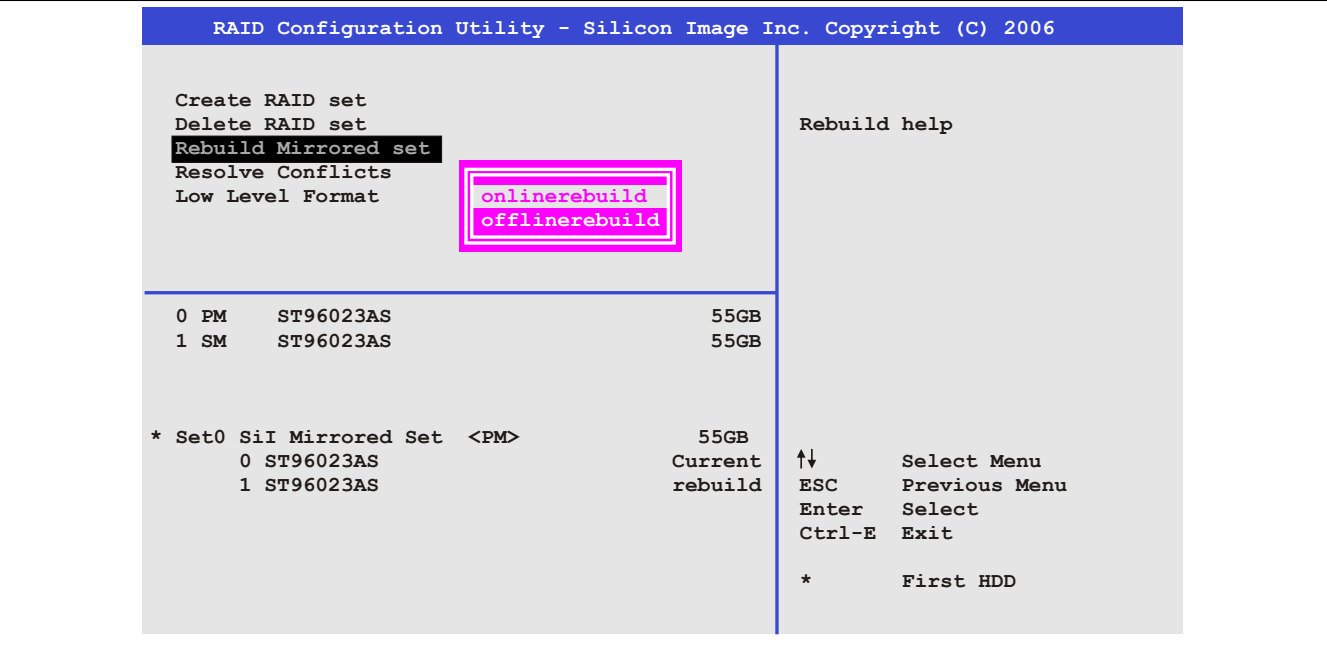


Abbildung 95: RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set

Über das Menü „Rebuild Mirrored set“ kann ein Rebuild Vorgang bei RAID 1 Verbund bei einem Fehlerfalle, nach vorheriger Unterbrechung des Rebuild Vorganges oder beim Tausch einer Hard Disk neu gestartet werden.

Bei der Auswahl „onlinerebuild“ wird der Rebuild nach dem Hochfahren des Systems im laufenden Betrieb durchgeführt. Durch z.B. das installierte SATA RAID Konfigurationsprogramm wird ein Event Pop Up angezeigt: *SA-TARaid detected a new event* und der Rebuild wird gestartet. Dauer des kompletten Rebuilds beträgt ca. 50 Minuten.

Bei der Auswahl „offlinerebuild“ wird sofort ein Rebuild vor dem Start des Betriebssystems durchgeführt (Dauer ca. 30 Minuten).

7.6 Resolve Conflicts

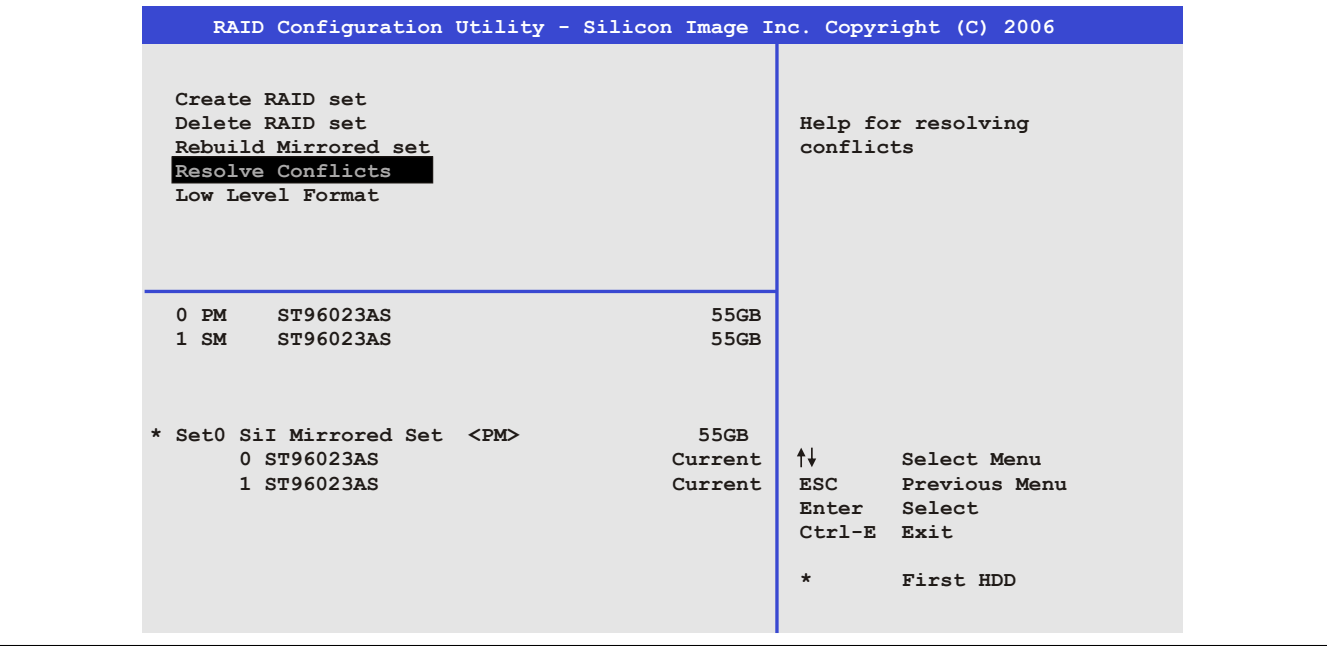


Abbildung 96: RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts

Über das Menü „Resolve Conflicts“ kann man Konflikte eines RAID Verbundes lösen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Status der Festplatten „conflict“ ist.

7.7 Low Level Format

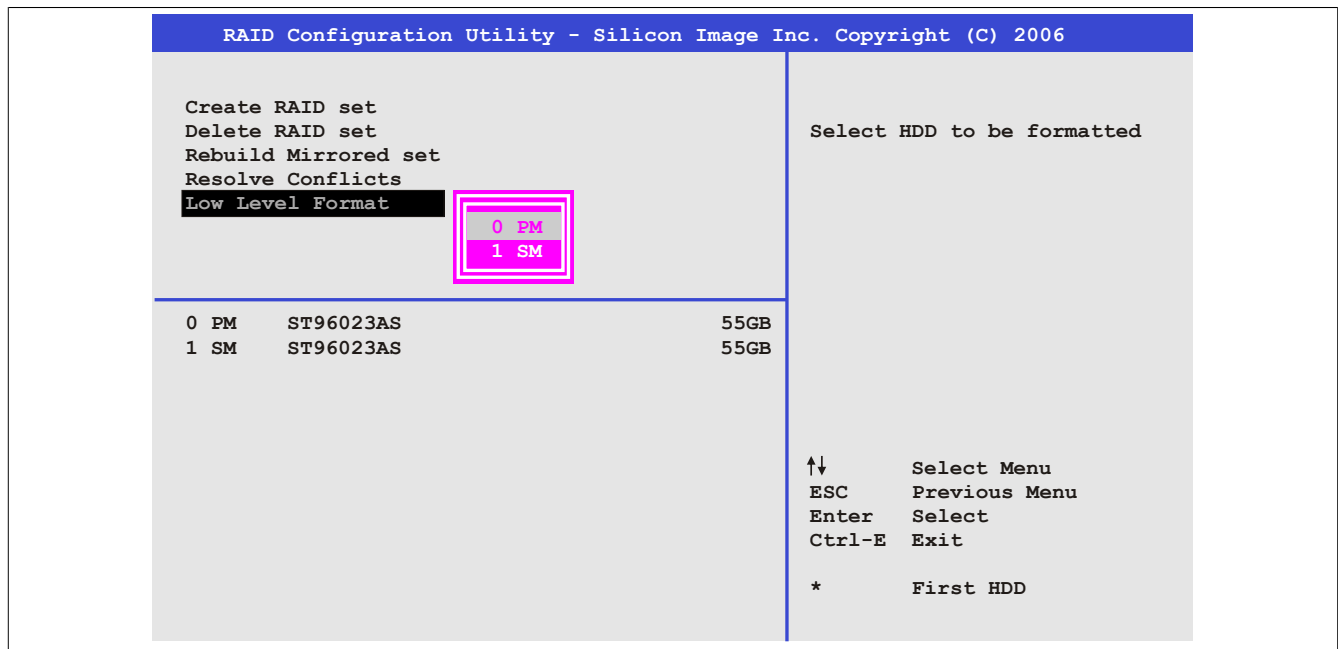


Abbildung 97: RAID Configuration Utility - Low Level Format

Über das Menü „Low Level Format“ können einzelne Hard Disks formatiert werden. Zu diesem Zweck darf kein RAID Verbund konfiguriert sein. Ein Low Level Format einer Festplatte dauert ca. 40 Minuten.

8 Bekannte Probleme / Eigenheiten

8.1 Probleme / Eigenheiten des ersten Fertigungsloses

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind bis einschließlich 07.05.2008 bei den APC800 Geräten des ersten Fertigungsloses bekannt:

- Die Hardware Security Key Schnittstelle wird ab der MTCX FPGA Version 00.06 unterstützt.
- Sporadisch konnte es bei einem Power On passieren, dass die ETH2 Schnittstelle nicht initialisiert wurde und diese somit nicht funktionierte. Das Problem konnte durch einen Reset bzw. Warmstart (Strg+Alt+Entf) behoben werden. Ab der MTCX FPGA Version 00.03 ist dieses Problem behoben.
- First Boot Agent Windows XP Embedded und eingebautes SATA HDD Laufwerk Vor dem Einstecken einer CompactFlash mit einem Windows XP Embedded Image und Ausführung des First Boot Agent muss die BIOS Einstellung „Legacy IDE Channels“ unter Advanced - IDE Configuration auf „PATA only“ eingestellt werden oder es kann das SATA Laufwerk zuvor entfernt werden.
- Bei Verwendung von zwei Grafiksträngen werden beim Windows XP Grafiktreiber die Bezeichnungen „Digitalanzeige“ für den Monitor / Panel Stecker und „Digitalanzeige 2“ für den AP Link Stecker zugewiesen. In der Betriebsart „Erweiterter Desktop“ zeigt sich folgendes Verhalten: Wird das Anzeigegerät Digitalanzeige am Monitor / Panel Stecker entfernt (z.B. Kabelbruch), so wird automatisch die Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige und somit wechseln auch die getätigten Einstellungen im Grafiktreiber von der Digitalanzeige 2 zur Digitalanzeige über. Beim nächsten Reboot des Systems wird der Bildinhalt vom Monitor / Panel Stecker auf den AP Link Stecker umgeleitet. Wird nun die BIOS Option „SDVO/DVI Hotplug Support“ auf „Enabled“ (zu finden unter dem BIOS Menüpunkt „Advanced - Graphics Configuration“) gestellt wird sofort der Bildinhalt automatisch vom getrennten Monitor / Panel Stecker auf den 2'ten Grafikstrang am AP Link Stecker umgeleitet.
- Besonderheiten beim „Kurzen Ausschalten“ - Befindet sich der APC810 im „Standby“ Betrieb - Power LED leuchtet rot (z.B. Windows XP herunterfahren) hält die Pufferung auf Grund von Kondensatoren und dem geringen Leistungsverbrauch etwas länger an. Ist im BIOS die Option „Power Loss Control“ auf „Power On“ oder „Last State“ eingestellt, kann es trotzdem vorkommen, dass das System nicht wieder neu startet, da kein Power Off/On erkannt wurde. Um mit diesen Systemeinheiten sicher zu gehen, dass das System nach einem Power Off/On wieder startet, sollte die Abschaltzeit mindestens 10 Sekunden betragen.
- Ab der MTCX PX32 Firmware \geq V00.11 ist der Reset Taster nur mehr Flanken getriggert, das heißt, dass das Gerät trotz gedrückter Reset Taste durchbootet. Bei MTCX PX32 Firmware $<$ V00.11 startet das System bei längerem Drücken (ca. 10 Sekunden) und wiederloslassen des Reset Tasters nicht mehr.

8.2 Probleme / Eigenheiten nachfolgender Fertigungslose

- Hardwarerevision B0 des Slide-in DVD-ROM - 5AC801.DVDS-00 bietet keine SATA Hotplugfähigkeit. Andere Hardwarerevisionen sind hotplugfähig.
- Die MIC-, Line IN- und Line OUT-Ein/Ausgänge werden aufgrund des Intel GM45 Chipsets nicht unterstützt.
- Der CompactFlash Slot 2 wird aufgrund des Intel GM45 Chipsets nicht unterstützt.
- Im Daisy Chain Betrieb von mehreren AP800/AP900 Geräten via SDL kann es bei der Erkennung des Touchcontrollers zur Anzeige eines roten „X“ beim Touchcontroller Status im Control Center Applet des Touchtreibers kommen. Die Funktion des Touchsystems ist dadurch nicht beeinträchtigt. Dies kann durch Einstellen einer Panel Sperrzeit von 50 ms vermieden werden. Die Panel Sperrzeit kann mit dem B&R Key Editor konfiguriert werden.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.17. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für „Basic Input and Output System“. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS des American Megatrends Inc. verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

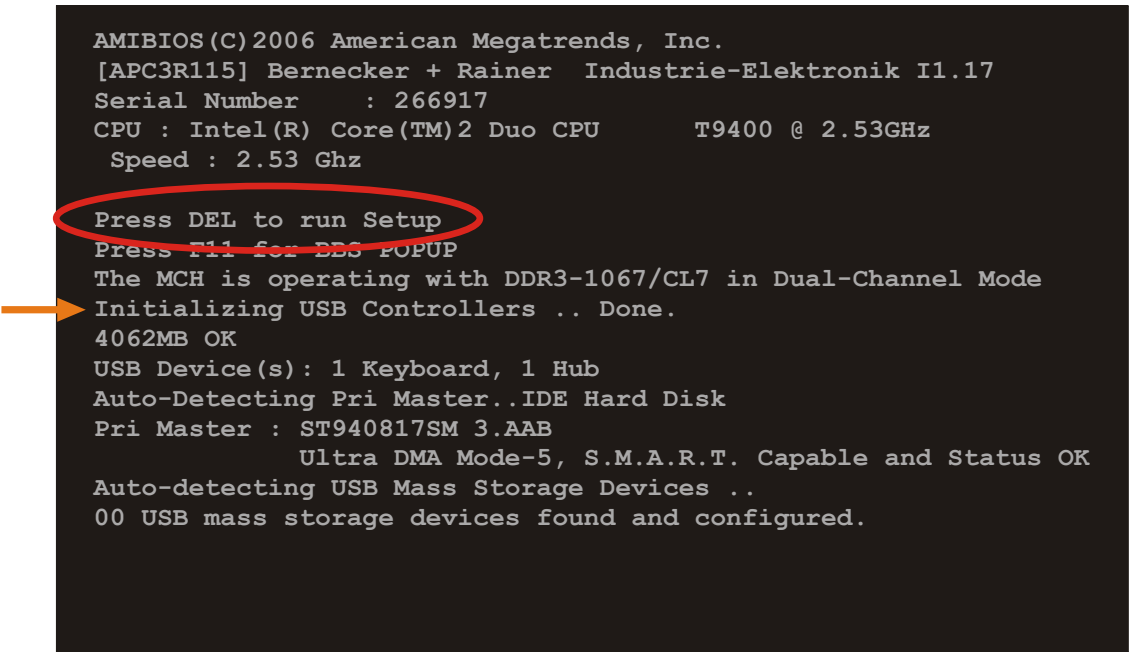
1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM „OK“ sind. Sind diese „OK“, werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese „nicht OK“, werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser „Vorbereitungen“ durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die „Entf“ Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): „Press DEL to run Setup“



```
AMIBIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.  
[APC3R115] Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik I1.17  
Serial Number      : 266917  
CPU : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU          T9400 @ 2.53GHz  
Speed : 2.53 Ghz  
  
Press DEL to run Setup  
Press F11 for DDS POPUP  
The MCH is operating with DDR3-1067/CL7 in Dual-Channel Mode  
Initializing USB Controllers .. Done.  
4062MB OK  
USB Device(s): 1 Keyboard, 1 Hub  
Auto-Detecting Pri Master..IDE Hard Disk  
Pri Master : ST940817SM 3.AAB  
                Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK  
Auto-detecting USB Mass Storage Devices ..  
00 USB mass storage devices found and configured.
```

Abbildung 98: GM45 Boot Screen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

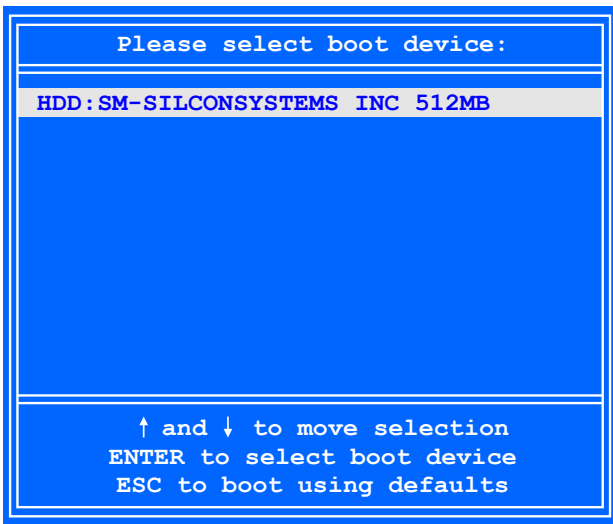
Tasten	Funktion
Entf	Einstieg in das BIOS Setup Menü.
F12	Mit F12 kann vom Netzwerk gebootet werden.
F11	Aufruf des Bootmenüs. Es werden sämtliche bootfähigen Geräte die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit Cursor ↑ und Cursor ↓ und durch Bestätigen von <ENTER> wird von diesem Gerät gebootet.
	
<Pause>	Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Drücken jeder anderen beliebigen Taste läuft der POST weiter.

Tabelle 154: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Objekt.
Cursor →	Zum nächsten Objekt.
+/-	Ändert die Einstellung der ausgewählten Funktion.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
Bild ↑	Auf die vorherige Seite wechseln.
Bild ↓	Auf die nächste Seite wechseln.
Pos 1	Man springt zum ersten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
Ende	Man springt zum letzten BIOS Menüpunkt bzw. Objekt.
F2 / F3	Die Farben des BIOS Setups werden getauscht.
F7	Änderungen werden zurückgesetzt.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 155: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach Drücken der Taste „Entf“ beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

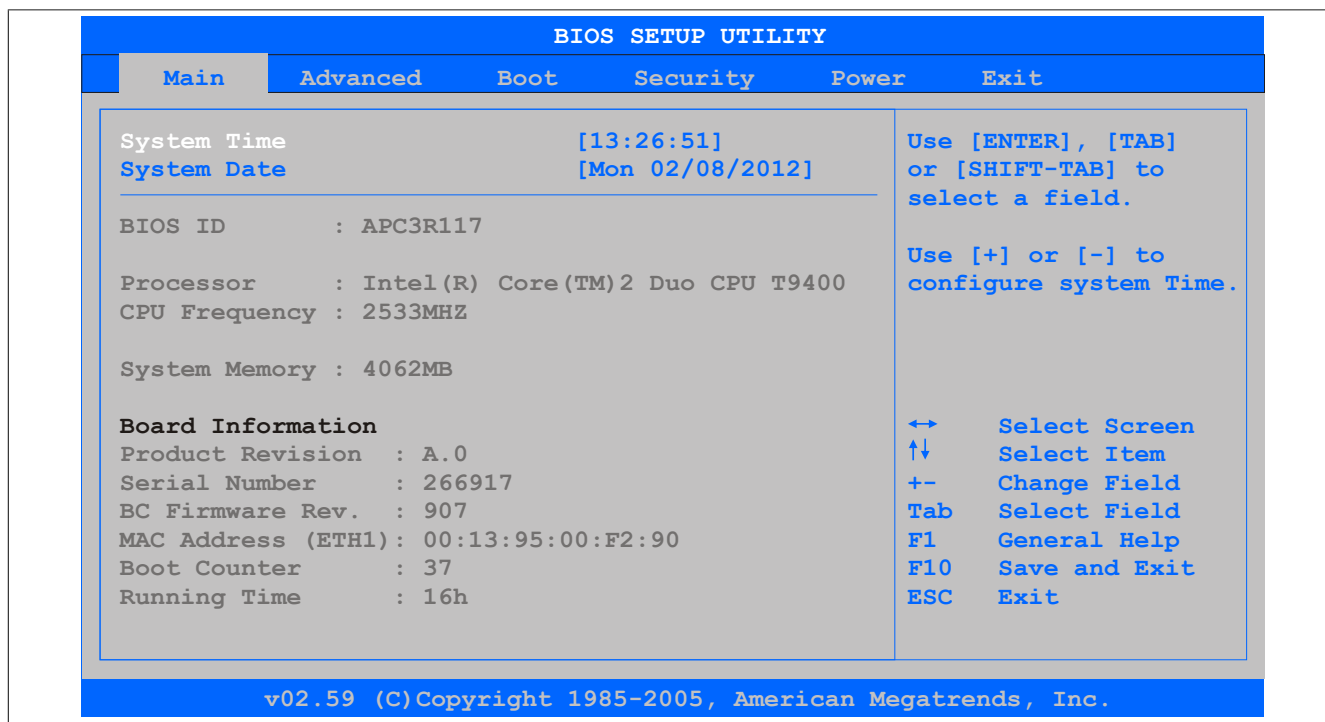


Abbildung 99: GM45 Main Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).
BIOS ID	Anzeige der BIOS Erkennung.	keine	-
Processor	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
CPU Frequency	Anzeige der Prozessor Frequenz.	keine	-
System Memory	Anzeige der Arbeitsspeichergröße.	keine	-
Product Revision	Anzeige der HW-Revision des CPUBoards.	keine	-
Serial Number	Anzeige der Seriennummer des CPUBoards.	keine	-
BC Firmware Rev.	Anzeige der Firmware Revision des CPUBoard-controllers.	keine	-
MAC Address (ETH1)	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH1 Schnittstelle.	keine	-
Boot Counter	Anzeige des Boot Zählers - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins (max. 16777215).	keine	-
Running Time	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden. (max. 65535).	keine	-

Tabelle 156: GM45 Main Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 Advanced

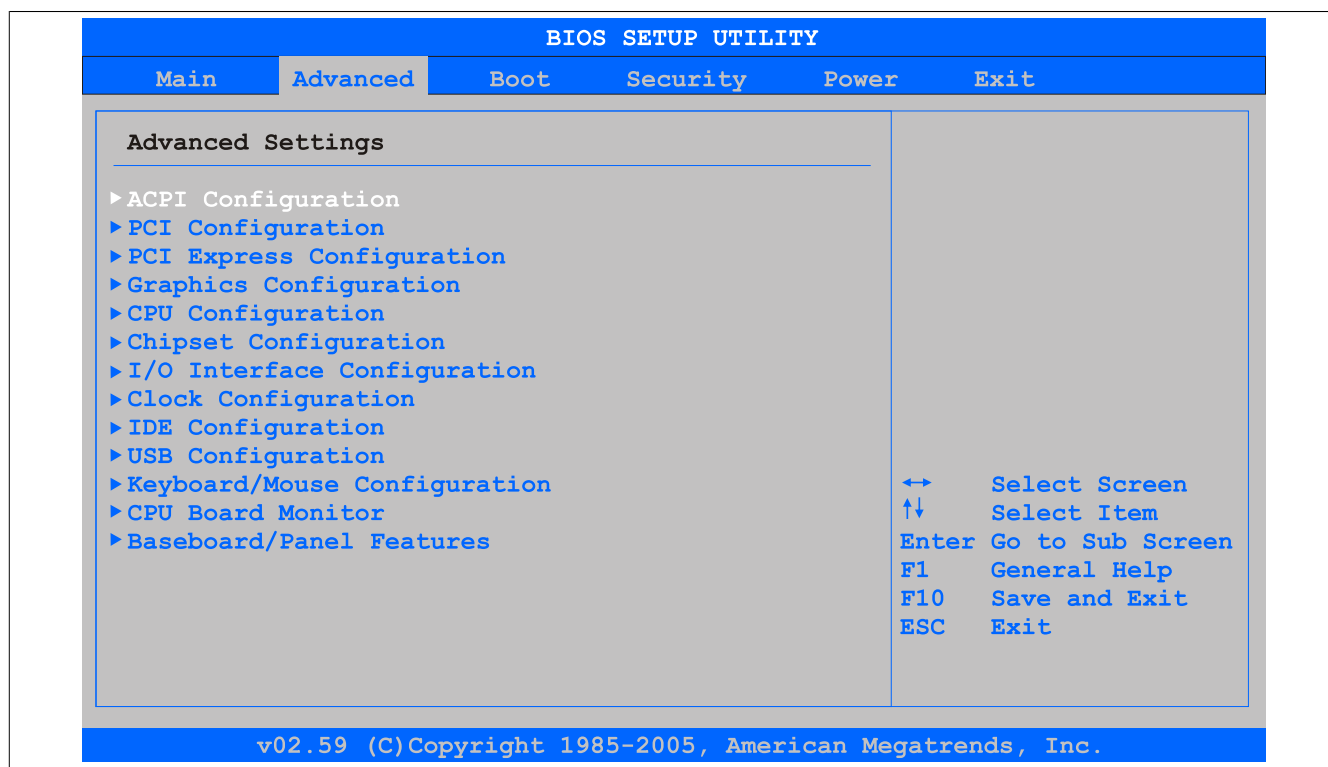


Abbildung 100: GM45 Advanced Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Configuration	Konfiguration der ACPI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Configuration" auf Seite 194
PCI Configuration	Konfiguration der PCI Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Configuration" auf Seite 195
PCI Express Configuration	Konfiguration der PCI Express Configuration.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Configuration" auf Seite 198
Graphics Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Graphics Configuration" auf Seite 200
CPU Configuration	Konfiguration der CPU Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Configuration" auf Seite 202
Chipset Configuration	Konfiguration der Chipset Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Chipset Configuration" auf Seite 204
I/O Interface Configuration	Konfiguration der I/O Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Interface Configuration" auf Seite 205
Clock Configuration	Konfiguration der Clock Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Clock Configuration" auf Seite 206
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration" auf Seite 206
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 212
Keyboard/Mouse Configuration	Konfiguration der Keyboard/Mouse Optionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Keyboard/Mouse Configuration" auf Seite 213
CPU Board Monitor	Zeigt die aktuellen Spannungen wie auch die aktuellen Temperaturen des verwendeten Prozessors an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 214
Baseboard/Panel Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard/Panel Features" auf Seite 215

Tabelle 157: GM45 Advanced Menü

1.4.1 ACPI Configuration

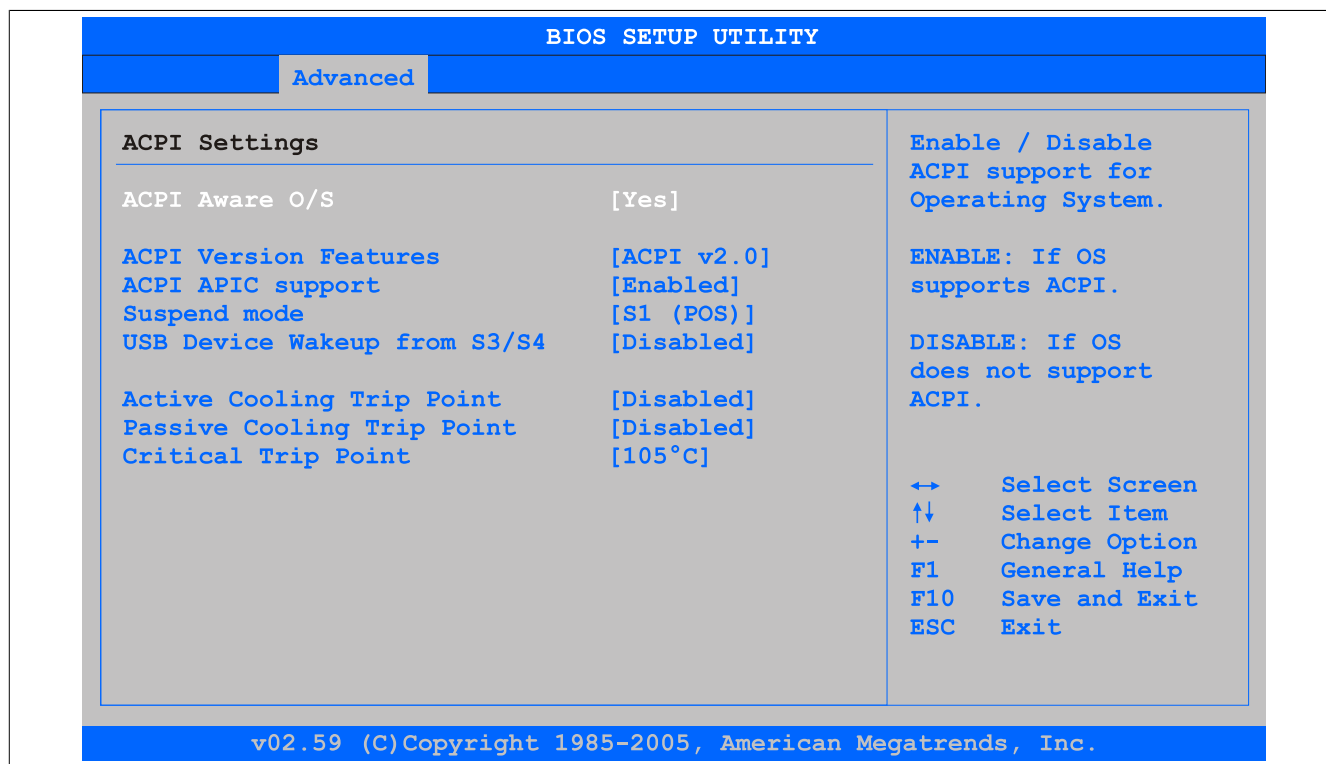


Abbildung 101: GM45 Advanced ACPI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ACPI Aware O/S	Über diese Funktion wird festgelegt, ob das Betriebssystem die ACPI-Funktion (Advanced Configuration and Power Interface) unterstützt.	Yes	Das Betriebssystem unterstützt ACPI.
		No	Das Betriebssystem unterstützt ACPI nicht.
ACPI Version Features	Option zum Einstellen der zu unterstützenden Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Unterstützung in den Treibern sowie in den eingesetzten Betriebssystemen voraus.	ACPI v1.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0
		ACPI v2.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v2.0
		ACPI v3.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
ACPI APIC support	Über diese Option wird die Unterstützung des Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion
Suspend mode	Auswahl des ACPI Status welcher bei Aktivierung des Suspend Modus verwendet werden soll.	S1 (POS)	Einstellung S1 als Suspend Mode. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung.
		S3 (STR)	Einstellung S3 als Suspend Mode. Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in das RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
USB Device Wakeup from S3/S4	Mit dieser Option kann eine Aktivität an einem angeschlossenen USB-Gerät das System aus dem S3/S4 Schlafzustand aufwecken.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Active Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird ein optionaler CPU Lüfter über das Betriebssystem eingeschaltet, wenn die eingestellte CPU Temperatur erreicht ist.	Disabled 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Deaktivierung der Funktion. Temperatureinstellung für den Active Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Passive Cooling Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem die CPU Geschwindigkeit drosselt.	Disabled 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C	Deaktivierung der Funktion. Temperatureinstellung für den Passive Cooling Trip Point. In 10 Grad Schritten einstellbar.
Critical Trip Point	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das System herunterfährt.	80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C, 105°C, 110°C	Temperatureinstellung für den Critical Trip Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 158: GM45 Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.2 PCI Configuration

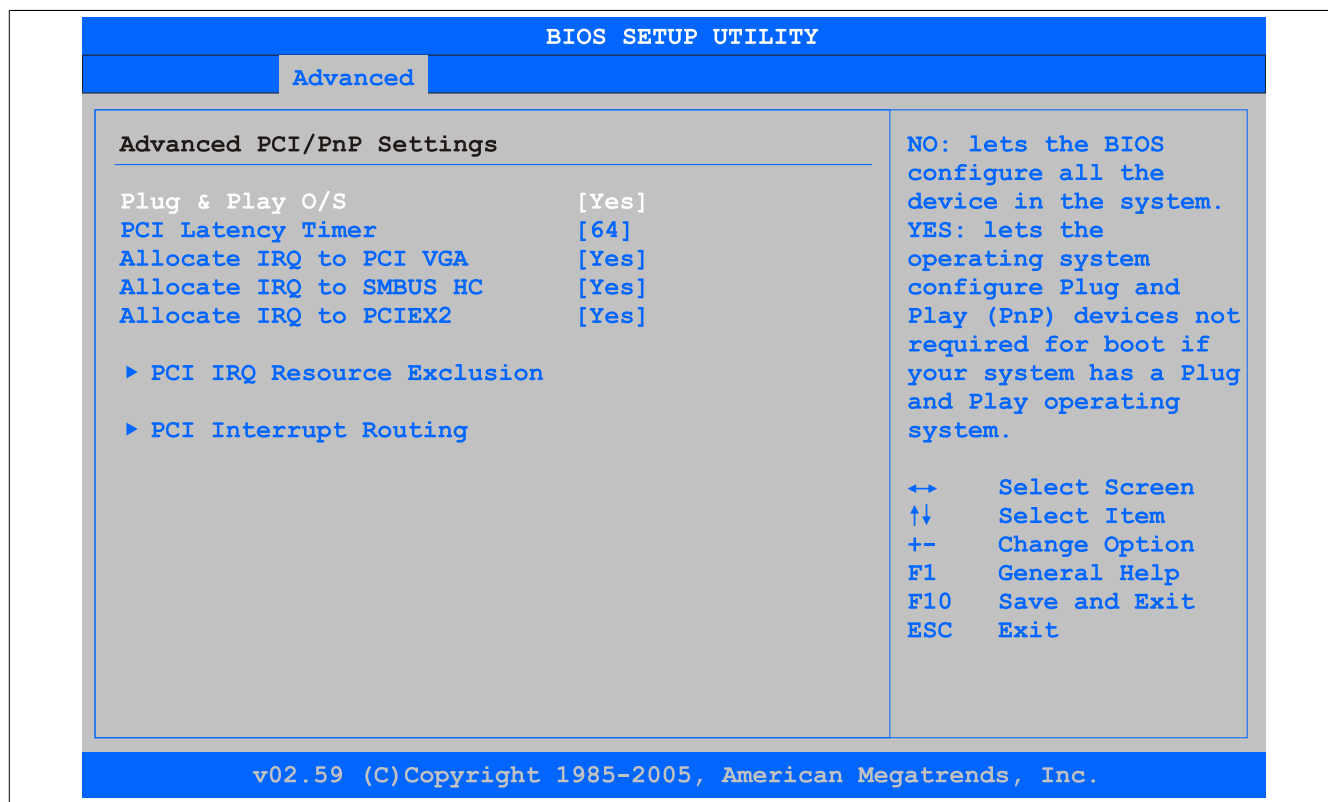


Abbildung 102: GM45 Advanced PCI Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Plug & Play O/S	Dem BIOS kann hier mitgeteilt werden ob das verwendete Betriebssystem Plug & Play-fähig ist.	Yes	Das Betriebssystem übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
		No	BIOS übernimmt die Verteilung der Ressourcen.
PCI Latency Timer	Diese Option kontrolliert, wie lange (in PCI-Ticks) eine Karte des PCI-Bus den Master noch für sich beanspruchen darf, wenn eine andere PCI-Karte bereits einen Zugriff angemeldet hat.	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248	Manuelle Einstellung des Wertes in PCI-Ticks.
Allocate IRQ to PCI VGA	Mit dieser Funktion wird festgelegt ob dem PCI VGA ein Interrupt zugewiesen wird.	Yes	Automatische Zuweisung eines Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrupts.
Allocate IRQ to SMBUS HC	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der SM (System Management) Bus Controller einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrupts.
Allocate IRQ to PCIEX2	Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob der PCIEX2 einen PCI Interrupt zugewiesen bekommt oder nicht.	Yes	Automatische Zuweisung eines PCI Interrupts.
		No	Keine Zuweisung eines Interrupts.
PCI IRQ Resource Exclusion	Konfiguration der PCI IRQ Resource Einstellungen für ISA Legacy Geräte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI IRQ Resource Exclusion" auf Seite 196
PCI Interrupt Routing	Konfiguration des PCI Interrupt Routings	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Interrupt Routing" auf Seite 197

Tabelle 159: GM45 Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten

PCI IRQ Resource Exclusion

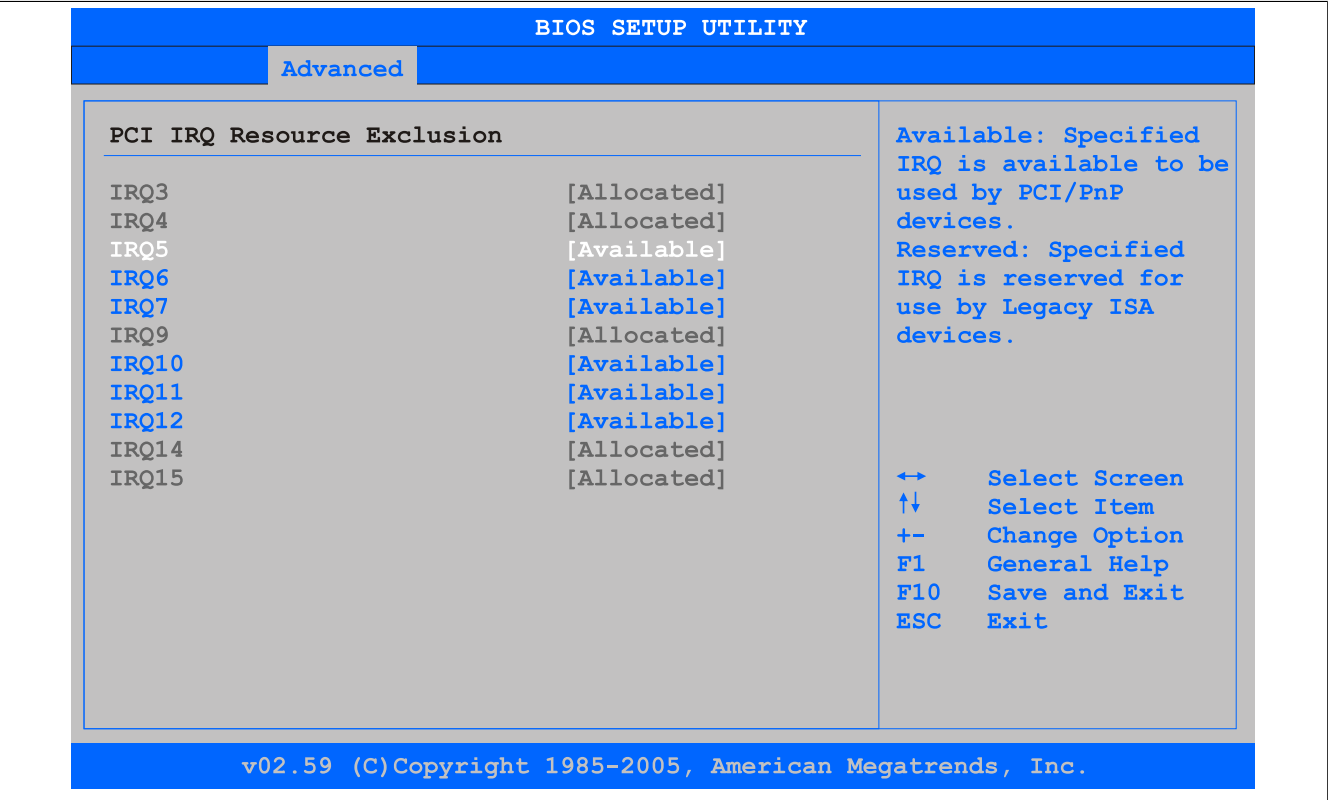


Abbildung 103: GM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IRQx	IRQ Interruptzuweisung für Legacy ISA Geräte.	Allocated	Vom System belegt - kann nicht verwendet werden.
		Available	Verfügbar - kann verwendet werden.
		Reserved	Reserviert - kann nicht verwendet werden.

Tabelle 160: GM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten

PCI Interrupt Routing

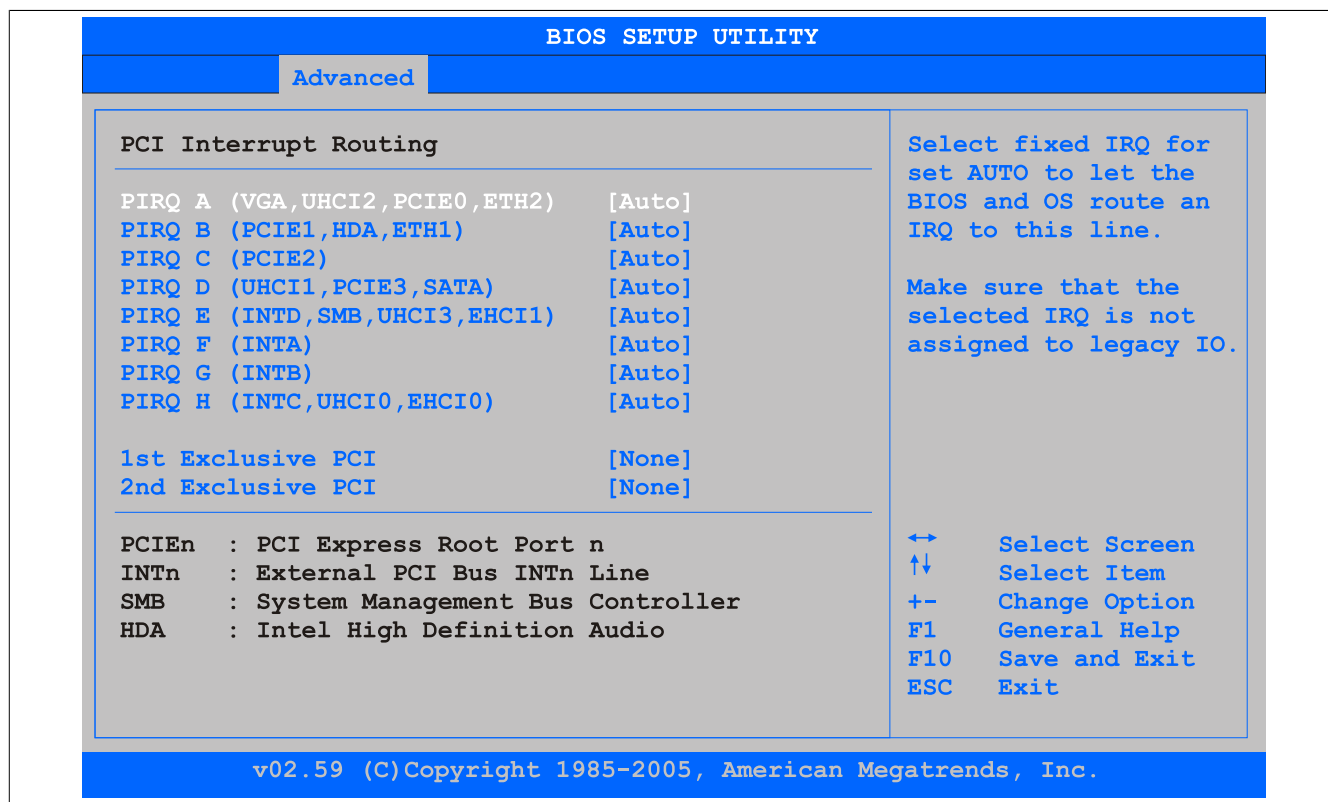


Abbildung 104: GM45 Advanced PCI Interrupt Routing

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PIRQ A (VGA,UHCI2,PCIE0,ETH2)	Option zum Einstellen des PIRQ A.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ B (PCIE1,HDA,ETH1)	Option zum Einstellen des PIRQ B.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ C (PCIE2)	Option zum Einstellen des PIRQ C.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ D (UHCI1,PCIE3,SATA)	Option zum Einstellen des PIRQ D.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ E (INTD,SMB,UHCI3,EHCI1)	Option zum Einstellen des PIRQ E.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ F (INTA)	Option zum Einstellen des PIRQ F.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ G (INTB)	Option zum Einstellen des PIRQ G.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
PIRQ H (INTC,UHCI0,EHCI0)	Option zum Einstellen des PIRQ H.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		5,6,7,9,10,11,12	Manuelle Zuordnung.
1 st Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird.	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		x	Zuweisung des PIRQ als 1st Exklusiv PCI IRQ.

Information:

Wird nur angezeigt wenn ein PIRQ manuell eingestellt wird (z.B. 5).

Tabelle 161: GM45 Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
2 nd Exclusive PCI	Mit dieser Option wird festgelegt, ob der unter PIRQ x zugewiesene IRQ exklusive (kein IRQ sharing) behandelt wird. Information: Wird nur angezeigt wenn zwei PIRQ manuell eingestellt werden.	None	Es wird kein Interrupt zugewiesen.
		x	Zuweisung des PIRQ als 2nd Exclusiv PCI IRQ.

Tabelle 161: GM45 Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten

1.4.3 PCI Express Configuration

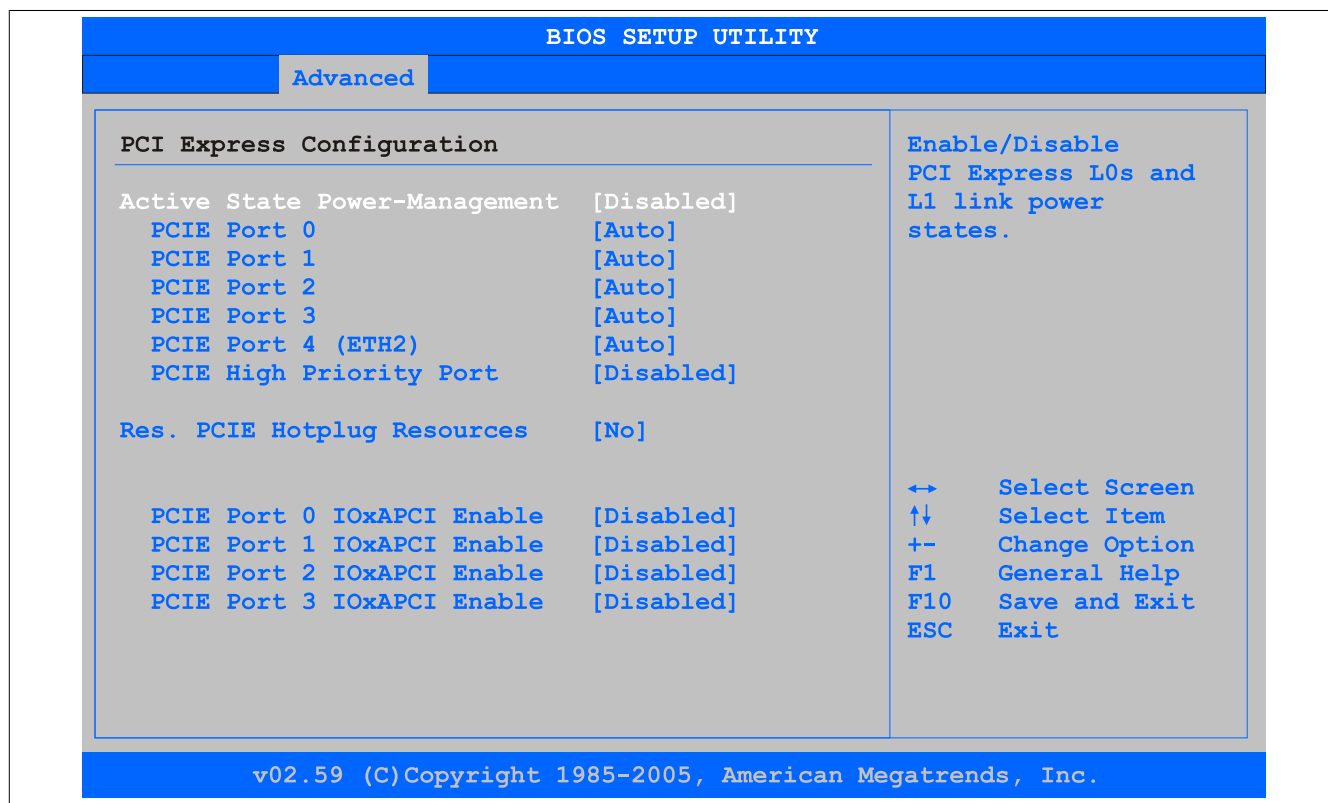


Abbildung 105: GM45 Advanced PCI Express Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Active State Power- Management	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIE Slots wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 0	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte sollten sie die Option deaktivieren.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte sollten sie die Option deaktivieren.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte sollten sie die Option deaktivieren.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.

Tabelle 162: GM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte sollten sie die Option deaktivieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 4 (ETH2)	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie die PCI Express-Anschlussfunktion. Information: Verwenden Sie keine PCI-Express Geräte sollten sie die Option deaktivieren.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE High Priority Port	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Prioritätsport für den PCIE.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Port 0	Aktivierung des Port 0 als Prioritätsport.
		Port 1	Aktivierung des Port 1 als Prioritätsport.
		Port 2	Aktivierung des Port 2 als Prioritätsport.
		Port 3	Aktivierung des Port 3 als Prioritätsport.
		ETH2	Aktivierung des ETH2 Port als Prioritätsport.
Res. PCIE Hotplug Resource	Mit dieser Option kann eine I/O und Memory Resource für einen nicht benutzten PCIE Port reserviert werden. Einen PCIE Port auf Enabled zu setzen und Ressourcen zu reservieren ist für eine ExpressCard hot-plug Unterstützung am betreffenden Port notwendig.	Yes	Resource wird reserviert.
		No	Resource wird nicht reserviert.
PCIE Port 0 IOxAPIC Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 0. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 1 IOxAPIC Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 1. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 2 IOxAPIC Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 2. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PCIE Port 3 IOxAPIC Enable	Mit dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) am PCIE Port 3. Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 162: GM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.4 Graphics Configuration

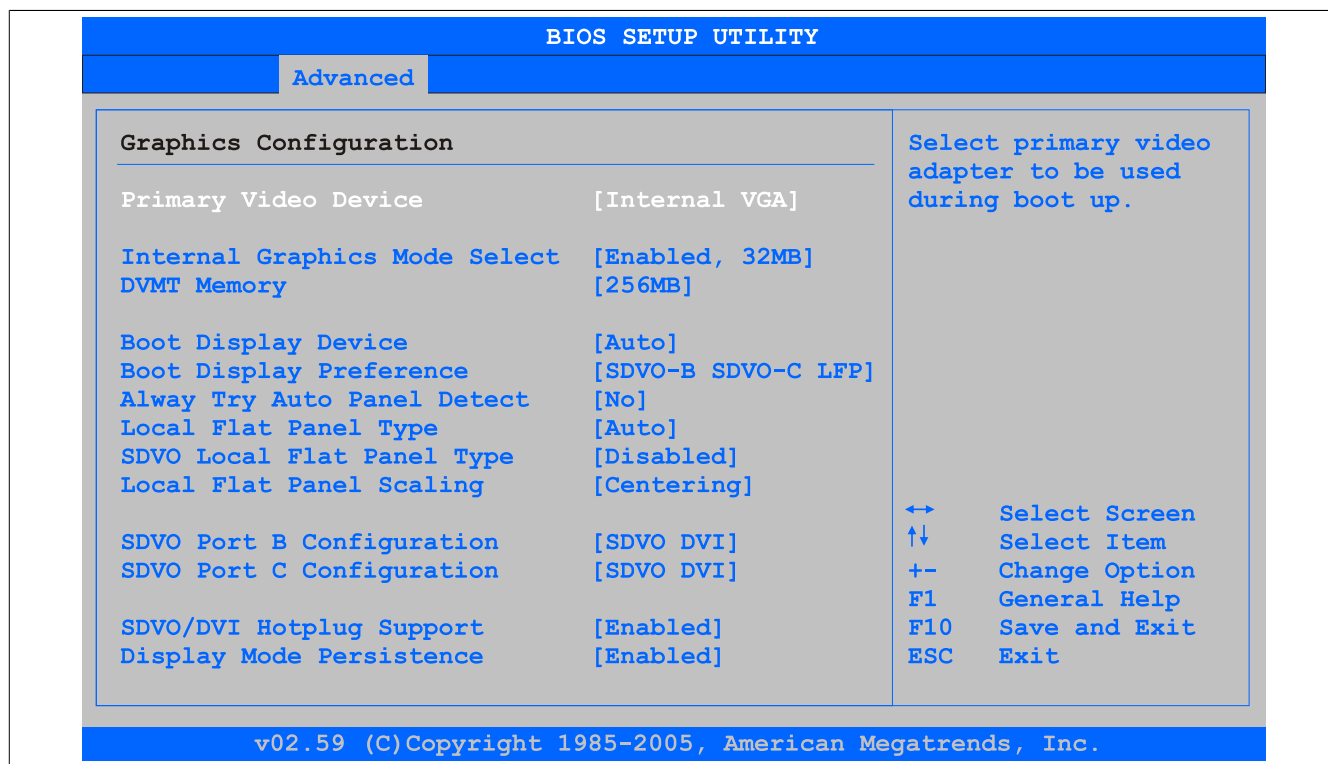


Abbildung 106: GM45 Advanced Graphics Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Video Device	Option zur Auswahl des primären Anzeigegerätes.	Internal VGA	Als Anzeigegerät wird der interne Grafikchip am CPU Board verwendet (Monitor / Panel Anschluss).
		PCI / Int. VGA	Als Anzeigegerät wird der Grafikchip einer gesteckten Grafikkarte verwendet.
Internal Graphics Mode Select	Option zur Einstellung der Speichergröße, welche für den internen Grafikcontroller verwendet werden kann.	Disabled	Keine Reservierung - Deaktivierung des Grafikcontrollers.
		Enabled, 32MB	32MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		Enabled, 64MB	64MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		Enabled, 128MB	128MB Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
DVMT Memory	Option zur Einstellung der verwendeten Speichergröße für den DVMT Modus.	128MB	128MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		256MB	256MB Hauptspeicher können verwendet werden.
		Maximum DVMT	Der restliche freie Hauptspeicher kann verwendet werden.
Boot Display Device	Hier kann festgelegt werden, welcher Videokanal für ein Anzeigegerät beim Booten aktiviert werden soll.	Auto	Automatische Auswahl.
		CRT only	Nur den CRT (Cathode Ray Tube) Kanal benutzen.
		TV only	Nur den TV Kanal benutzen.
		SDVO only	Nur den SDVO (Serial Digital Video Out) Kanal benutzen.
		CRT + SDVO	CRT und SDVO Kanal benutzen.
		LFP only	Nur den LFP (Local Flat Panel) Kanal benutzen.
		CRT + LFP	CRT + LFP Kanal benutzen.
Boot Display Preference	Die Option legt die Reihenfolge fest, in welcher die Geräte an den angeschlossenen Kanälen LFP und SDVO überprüft und gebootet werden sollen.	LFP SDVO-B SDVO-C	Local Flat Panel - Serial Digital Video B output - Serial Video C output.
		LFP SDVO-C SDVO-B	Local Flat Panel - Serial Digital Video C output - Serial Video B output.
		SDVO-B SDVO-C LFP	Serial Digital Video B output - Serial Digital Video C output - Local Flat Panel.
		SDVO-C SDVO-B LFP	Serial Digital Video C output - Serial Digital Video B output - Local Flat Panel.

Information:

Die Einstellung macht nur Sinn, wenn die Option Boot Display Device auf „Auto“ gestellt ist.

Tabelle 163: GM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Always Try Auto Panel Detect	Die Option sucht zuerst EDID Daten in einem externen EEPROM, um den LFP zu konfigurieren. Wurden keine EDID Daten gefunden, werden die unter „Local Flat Panel Type“ ausgewählten Daten verwendet.	No	Deaktivierung der Funktion.
		Yes	Aktivierung der Funktion.
Local Flat Panel Type	Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für den LVDS Kanal eingestellt werden.	Auto	Automatische Erkennung und Einstellung anhand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
		VGA 1x18 (013h)	640 x 480
		SVGA 1x18 (01Ah)	800 x 600
		XGA 1x18 (006h)	1024 x 768
		XGA 2x18 (007h)	1024 x 768
		XGA 1x24 (008h)	1024 x 768
		XGA 2x24 (012h)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (00Ah)	1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 2	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 3	Benutzerdefiniertes Profil
SDVO Local Flat Panel Type	<p>Mit dieser Option kann ein vordefiniertes Profil für den SDVO LVDS Kanal eingestellt werden.</p> <p>Information:</p> <p>Es muss ein SDVO LVDS Sender an einen der SDVO Ports angeschlossen und der betreffende SDVO Port Device auf LVDS gestellt sein.</p>	Disabled	Deaktiviert die Funktion.
		Auto	Automatische Erkennung und Einstellung anhand der EDID Daten.
		VGA 1x18 (002h)	640 x 480
		VGA 1x18 (013h)	640 x 480
		SVGA 1x18 (01Ah)	800 x 600
		XGA 1x18 (006h)	1024 x 768
		XGA 2x18 (007h)	1024 x 768
		XGA 1x24 (008h)	1024 x 768
		XGA 2x24 (012h)	1024 x 768
		SXGA 2x24 (00Ah)	1280 x 1024
		SXGA 2x24 (018h)	1280 x 1024
		UXGA 2x24 (00Ch)	1600 x 1200
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
		Customized EDID 1	Benutzerdefiniertes Profil
Local Flat Panel Scaling	Option zur Ausgabemöglichkeit des Bildinhaltes in Abhängigkeit des eingestellten Local Flat Panel Types.	Centering	Der Bildinhalt wird zentriert am Display ausgegeben.
		Expand Text	Der Text wird auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Graphics	Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
		Expand Text & Graphics	Text und Grafiken werden auf die gesamte Größe des Displays ausgedehnt dargestellt.
SDVO Port B Configuration	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port B angeschlossen ist oder dem Port als HDMI oder Display Port konfigurieren.	Disabled	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		HDMI Port	Port wird als HDMI-Port konfiguriert.
		Display Port	Port wird als Display-Port konfiguriert.
		SDVO DVI	Videosignale werden für ein SDVO DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO TV	Videosignale werden für ein SDVO TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO CRT	Videosignale werden für ein SDVO CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO LVDS	Videosignale werden für ein SDVO LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges SDVO DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
SDVO Port C Configuration	Option zur Auswahl des Anzeigegerätes welches am SDVO Port C angeschlossen ist oder dem Port als HDMI oder Display Port konfigurieren.	Disabled	Kein Anzeigegerät angeschlossen.
		HDMI Port	Port wird als HDMI-Port konfiguriert.
		Display Port	Port wird als Display-Port konfiguriert.
		SDVO DVI	Videosignale werden für ein SDVO DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO TV	Videosignale werden für ein SDVO TV kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO CRT	Videosignale werden für ein SDVO CRT kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO LVDS	Videosignale werden für ein SDVO LVDS kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.
		SDVO DVI-Analog	Videosignale werden für ein analoges SDVO DVI kompatibles Anzeigegerät optimiert ausgegeben.

Tabelle 163: GM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SDVO/DVI Hotplug Support	Ist die Option auf Enabled gestellt, so unterstützt der Windows XP Grafik Treiber „hotplug“ und „configuration mode persistence“ für DVI- Monitore, die an einen DVI SDVO Transmitter angeschlossen sind. „Hotplug“-Unterstützung bedeutet, dass ein angeschlossener DVI Monitor während laufendem Betriebssystem automatisch erkannt und aktiviert wird. „Configuration mode persistence“ bedeutet, dass z.B. eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wird wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen sind auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Enabled	Aktivierung des „Hotplug“- und „Configuration mode persistence“- Modus.
		Disabled	Deaktivierung des „Hotplug“- und „Configuration mode persistence“- Modus.
Display Mode Persistence	Display Mode Persistence bedeutet, dass sich das Betriebssystem an vergangene Display-Anschlusskonfigurationen erinnern und wiederherstellen kann. z.B. wird eine duale DVI Anzeigekonfiguration automatisch wiederhergestellt wenn beide DVI Monitore wieder angeschlossen werden, auch wenn während eines früheren Bootvorgangs nur ein DVI Monitor angeschlossen und aktiviert wurde.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 163: GM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.5 CPU Configuration

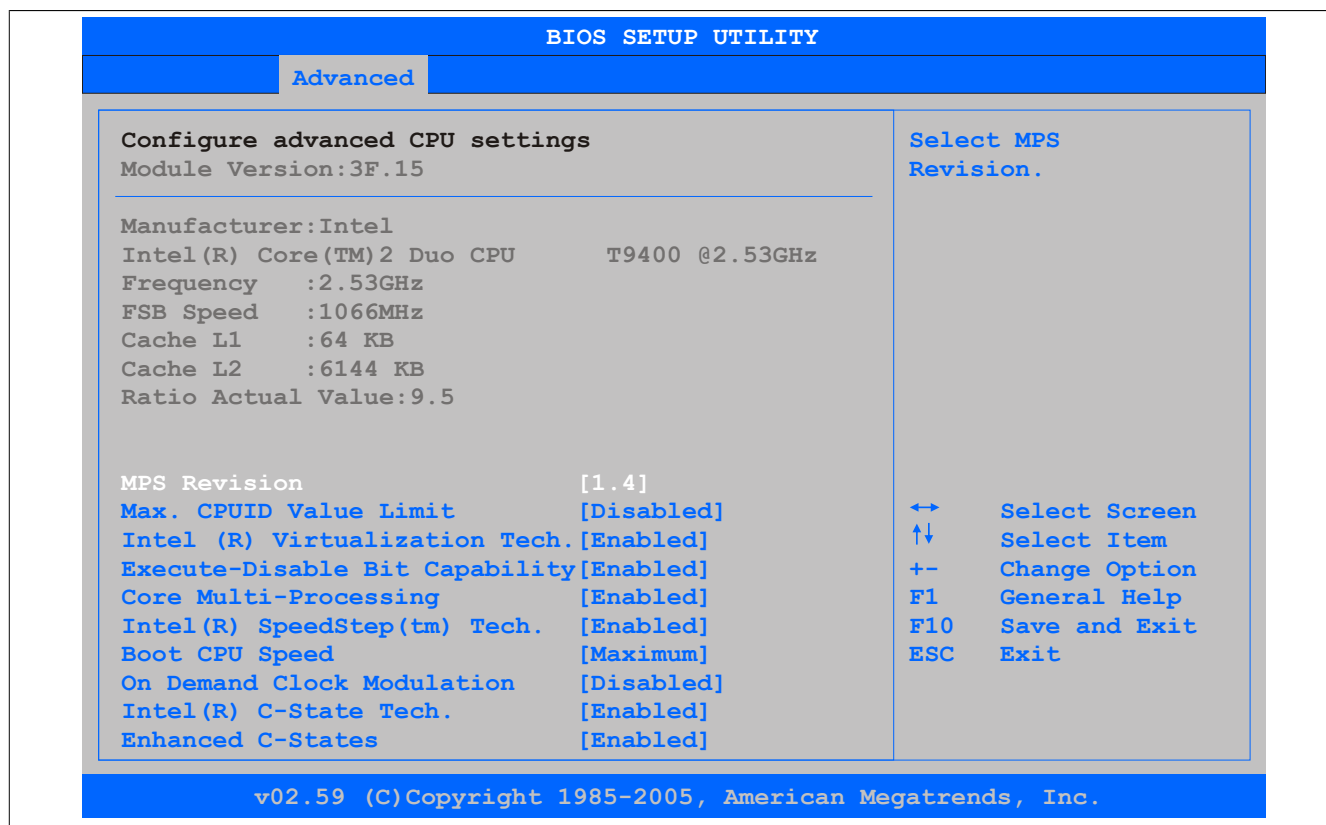


Abbildung 107: GM45 Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
MPS Revision	Diese Option unterstützt den Einsatz von mehreren CPUs (MPS=Multiprozessorsystem).	1.1	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.1
		1.4	Einstellung der MPS Unterstützung Revision 1.4
Max CPUID Value Limit	Option zur Limitierung des CPUID Eingangswertes. Dies kann z.B. bei älteren Betriebssystemen notwendig sein.	Enabled	Der Prozessor limitiert bei Bedarf den maximalen CPUID Eingangswert auf 03h wenn der Prozessor einen höheren Wert unterstützt.
		Disabled	Bei Anfrage des CPUID Eingangswertes liefert der Prozessor den aktuell maximalen Wert zurück.

Tabelle 164: GM45 Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Intel(R) Virtualization Tech.	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Virtuellen Maschine. Information: Um eine Änderung der Einstellung wirksam zu machen, ist ein Neustart erforderlich.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Ist die Funktion aktiviert, kann eine Virtuelle Maschine die zusätzlichen Hardwarekapazitäten verwenden.
Execute-Disable Bit Capability	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der Hardwareunterstützung zur Unterbindung der Datenausführung.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Core Multi-Processing	Bei einem Dual Core Prozessor kann mit dieser Option ein Kern deaktiviert werden.	Enabled	Bei einem Dual Core Prozessor werden beide Kerne genutzt.
		Disbaled	Bei einem Dual Core Prozessor wird nur ein Kern verwendet.
Intel(R) SpeedStep(tm) Tech.	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hoch- oder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Enabled	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
Boot CPU Speed	Option zum Einstellen der CPU Geschwindigkeit. Information: Durch Aktivierung der Intel SpeedStep Technologie kann diese Einstellung bei ACPI Betriebssystemen wieder verändert werden.	Maximum	Maximale CPU Geschwindigkeit
		Minimum	Die CPU Geschwindigkeit wird gedrosselt. LFM = Low Frequency Mode = 1,6 GHz
On Demand Clock Modulation	Option zum Einstellen der CPU Performance mittels "On Demand Clock Modulation".	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		12,5%, 25%, 37,5%, 50%, 62,5%, 75%, 87,5%	z.B.: 75% bedeutet eine Performance Verringerung um 25%
Intel(R) C-State Tech.	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebssystem die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion. Beide Prozessoren werden mit der selben Frequenz betrieben.
		Enabled	Aktivierung der Funktion. Die Prozessoren werden mit unterschiedlicher Frequenz betrieben, es kann somit Energie gespart werden.
Enhanced C-States ¹⁾	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebssystem die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 164: GM45 Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten

1) Einstellung nur sichtbar, wenn *Intel(R) C-State Tech.* auf *Enabled* gestellt ist.

1.4.6 Chipset Configuration

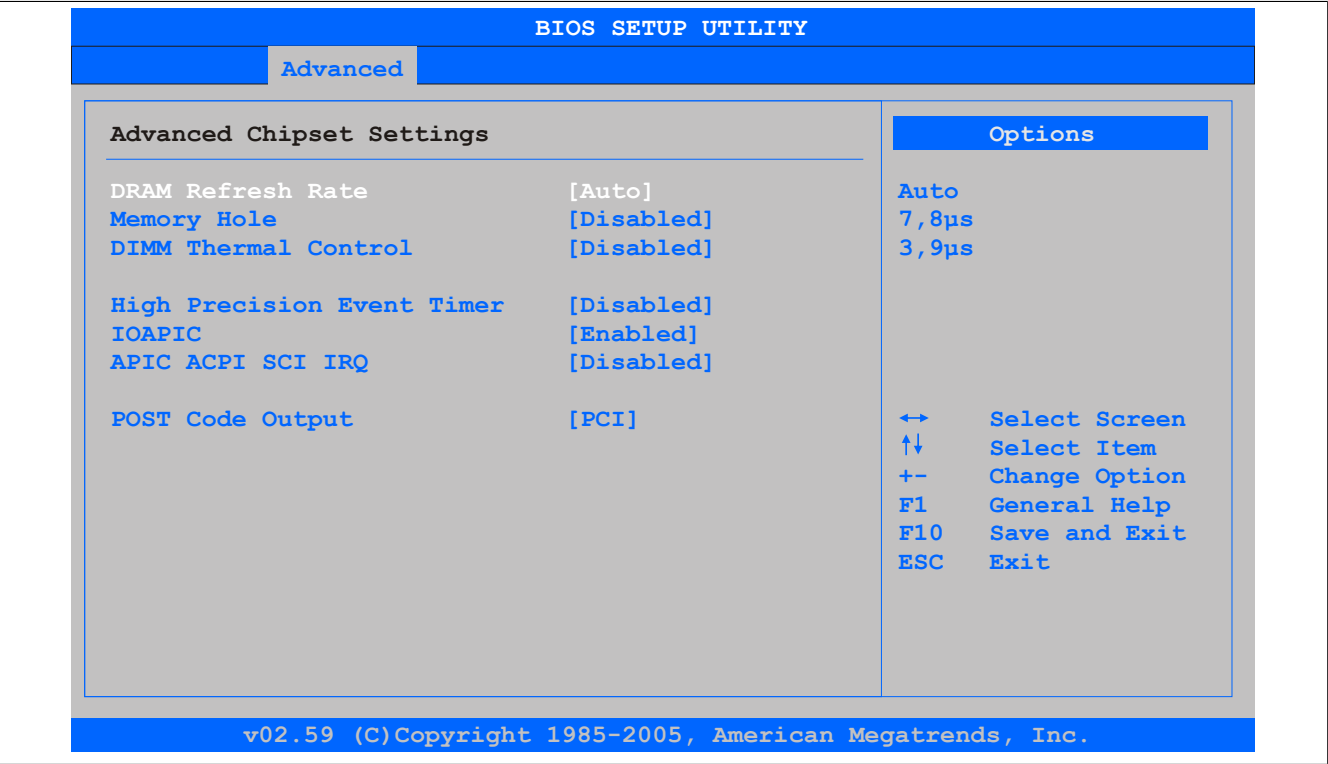


Abbildung 108: GM45 Advanced Chipset Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
DRAM Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
Memory Hole	Option interessant für ISA-Karten mit einem Framebuffer. Bei einem APC810 nicht von Bedeutung.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		15MB-16MB	Der Adressbereich wird reserviert.
DIMM Thermal Control	Option zum Einstellen der maximalen Oberflächentemperatur der DIMM Module. Wird die eingestellte Oberflächentemperatur erreicht, dann wird durch eine Limitierung der Speicherbandbreite eine Kühlung des Modules erreicht.	Disabled	Keine Begrenzung der Oberflächentemperatur.
		40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 85°C, 90°C	Temperaturgrenzwert für die Limitierung.
High Precision Event Timer	Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Multitmedia Anwendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IOAPIC	Diese Option wird verwendet, um den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Information: Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.	Enabled	Bei aktiviertem APIC-Modus werden die dem System zur Verfügung stehenden IRQ-Ressourcen erweitert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
APIC ACPI SCI IRQ	Diese Option wird verwendet, um den SCI IRQ bei APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) Modus zu modifizieren.	Enabled	IRQ20 wird für SCI verwendet.
		Disabled	IRQ9 wird für SCI verwendet.
POST Code Output	Diese Option wird verwendet, wenn der Port 80h/84h BIOS POST Code Output zum PCI Bus oder LPC Bus geroutet werden soll.	PCI	Port 80h/84h wird zum PCI Bus geroutet.
		LPC	Port 80h/84h wird zum LPC Bus geroutet.

Tabelle 165: GM45 Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten

1.4.7 I/O Interface Configuration

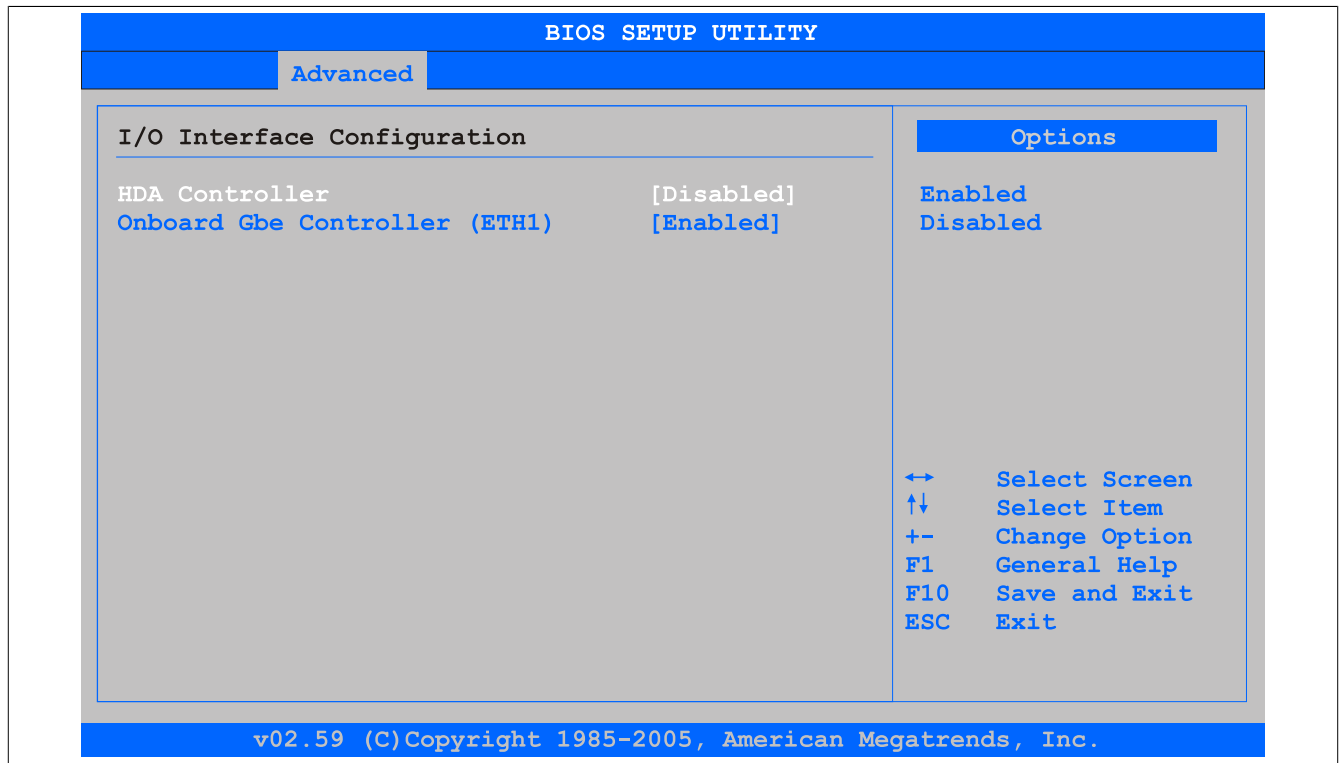


Abbildung 109: GM45 Advanced I/O Interface Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
HDA Controller	Diese Option wird verwendet, um den HDA Controller ein- oder auszuschalten. Information: Das GM45 CPU Board besitzt keinen Sound-Controller.	Enabled	Aktivierung des HDA Controllers.
		Disabled	Deaktivierung des HDA Controllers.
Onboard Gbe Controller (ETH1)	Diese Option wird verwendet, um den Onboard Ethernet Controller ein- oder auszuschalten.	Disabled	Onboard Ethernet Controller wird ausgeschaltet.
		Enabled	Onboard Ethernet Controller wird eingeschaltet.

Tabelle 166: GM45 Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.8 Clock Configuration

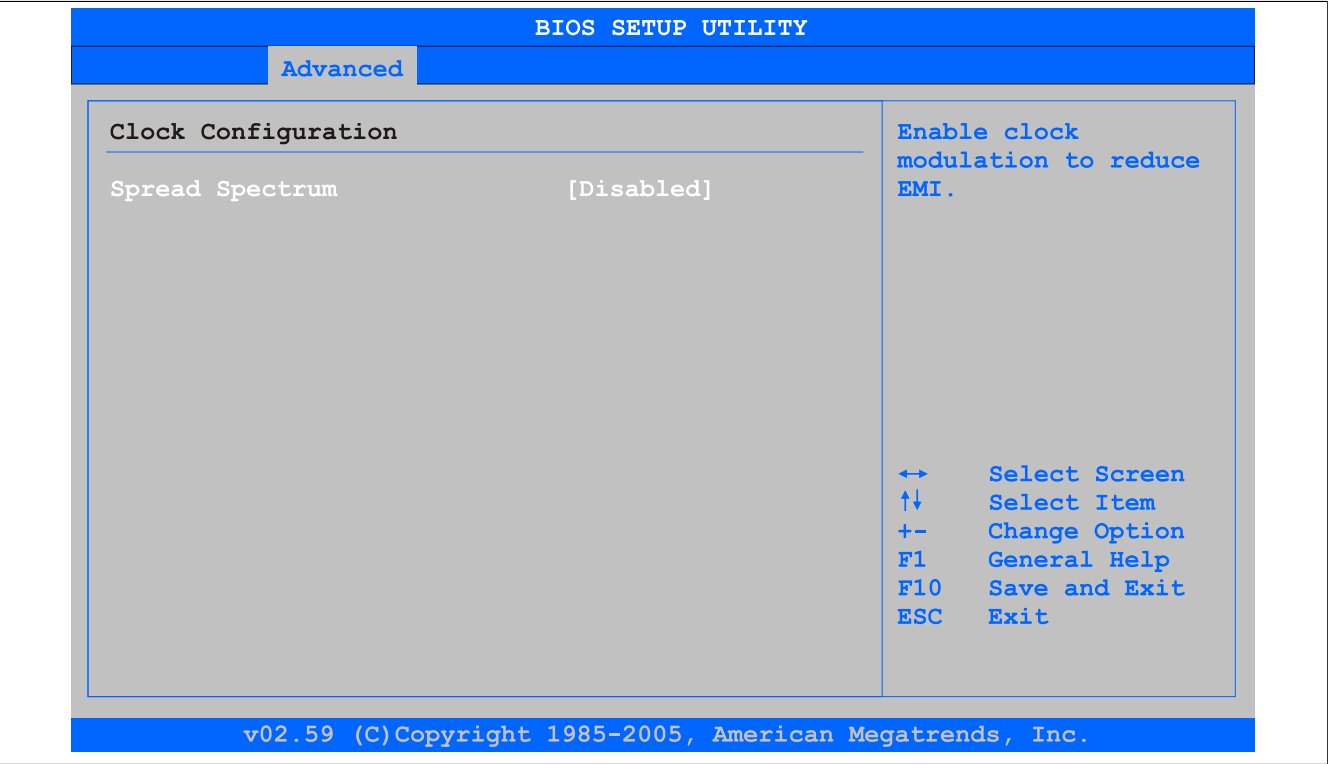


Abbildung 110: GM45 Advanced Clock Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Spread Spectrum	Mit dieser Option kann der Takt geringfügig frequenzmoduliert werden, wodurch sich die elektromagnetische Störstrahlung verringert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 167: GM45 Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.9 IDE Configuration

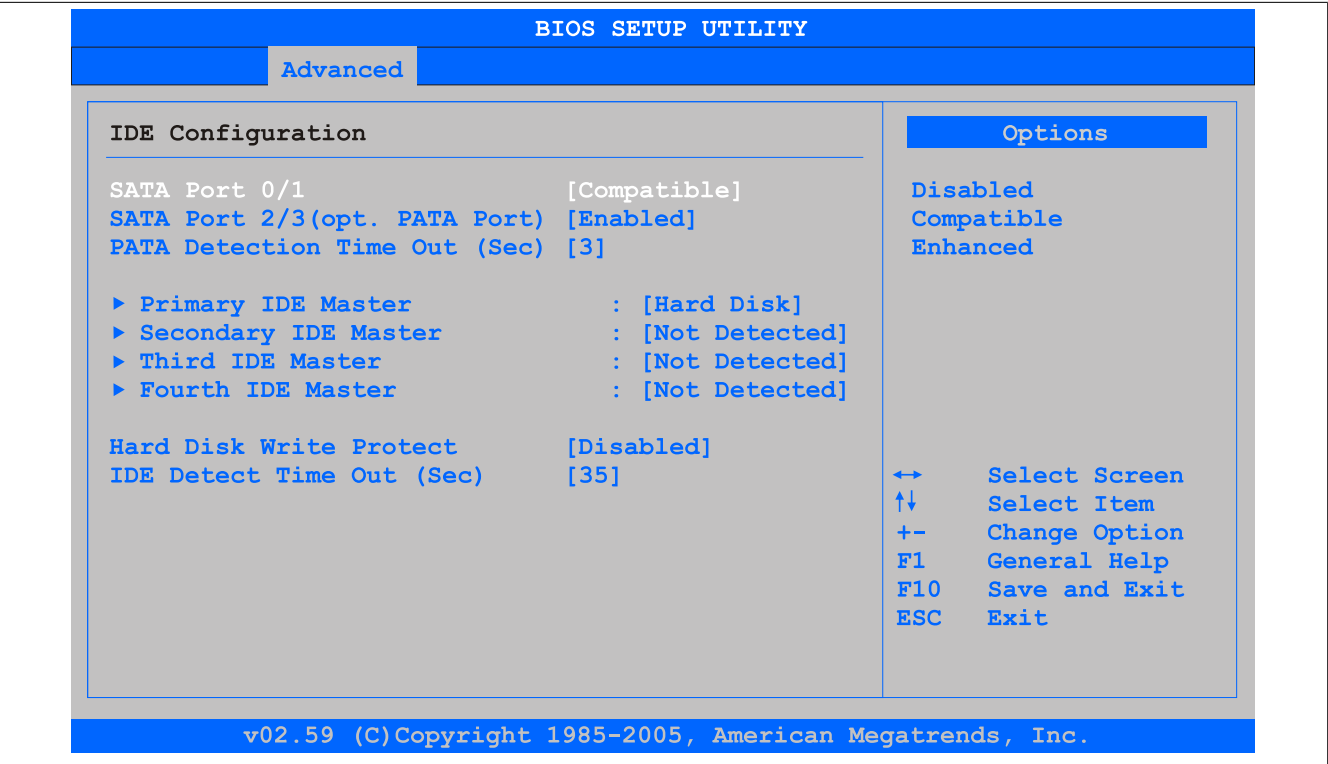


Abbildung 111: GM45 Advanced IDE Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SATA Port 0/1	Option zum Konfigurieren des integrierten SATA Controllers.	Compatible	Der Controller arbeitet in Legacy oder Compatible Modus.
		Disabled	Deaktivierung des Controllers und beider Ports.
		Enhanced	Der Controller arbeitet in Enhanced oder Native Modus.
Configure SATA Port 0/1 as ¹⁾	Hier können die von der Southbridge unterstützten Serial ATA Anschlüsse 0/1 eingestellt werden.	IDE	Die Serial ATA-Festplatte wird als Parallel ATA physikalisches Speicherlaufwerk benutzt.
		RAID	Hier kann RAID 0, 1, 5, 10 oder die Intel® Matrix Storage Technologie mit der Serial ATA Festplatte konfiguriert werden.
		AHCI	Mit der Einstellung AHCI kann man den internen Speichertreiber der SATA-Funktionen aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälligem Schreib-Lese-Zugriff erhöhen, indem das Laufwerk die Reihenfolge der Befehle selbst festlegt.
Hot Plug ²⁾	Option zum Ein- oder Ausschalten des SATA hot-plug Supports.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
SATA Port 2/3 (opt. PATA Port)	Option zum Ein- oder Ausschalten des integrierten SATA Controllers 2 und 3.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
PATA Detection Time Out (Sec) ³⁾	Einstellung des Zeitüberschreitungsgrenzwertes der ATA/ATAPI Geräteerkennung. Diese Option gilt nur für PATA- Kanäle.	0,1,2,3,5,10,15,30	Zeiteinstellung in Sekunden.
Primary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am primären IDE Master Port angeschlossen ist, parametrier.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Primary IDE Master" auf Seite 208
Secondary IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am sekundären IDE Master Port angeschlossen ist, parametrier.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Secondary IDE Master" auf Seite 209
Third IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am dritten IDE Master Port angeschlossen ist, parametrier.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Third IDE Master" auf Seite 210
Fourth IDE Master	Hier wird das im System vorhandene Laufwerk, das am vierten IDE Master Port angeschlossen ist, parametrier.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Fourth IDE Master" auf Seite 211
Hard Disk Write Protect	Hier kann der Schreibschutz für die Festplatte aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
IDE Detect Time Out (Sec)	Einstellung des Zeitüberschreitungsgrenzwertes der ATA/ATAPI Geräteerkennung. Diese Option gilt für SATA- und PATA- Kanäle.	0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35	Zeiteinstellung in Sekunden.

Tabelle 168: GM45 Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *SATA Port 0/1* auf *Enhanced* eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *Configure SATA Port 0/1 as* auf *RAID* oder *AHCI* eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *SATA Port 2/3 (opt. PATA Port)* auf *Enabled* eingestellt ist.

Primary IDE Master

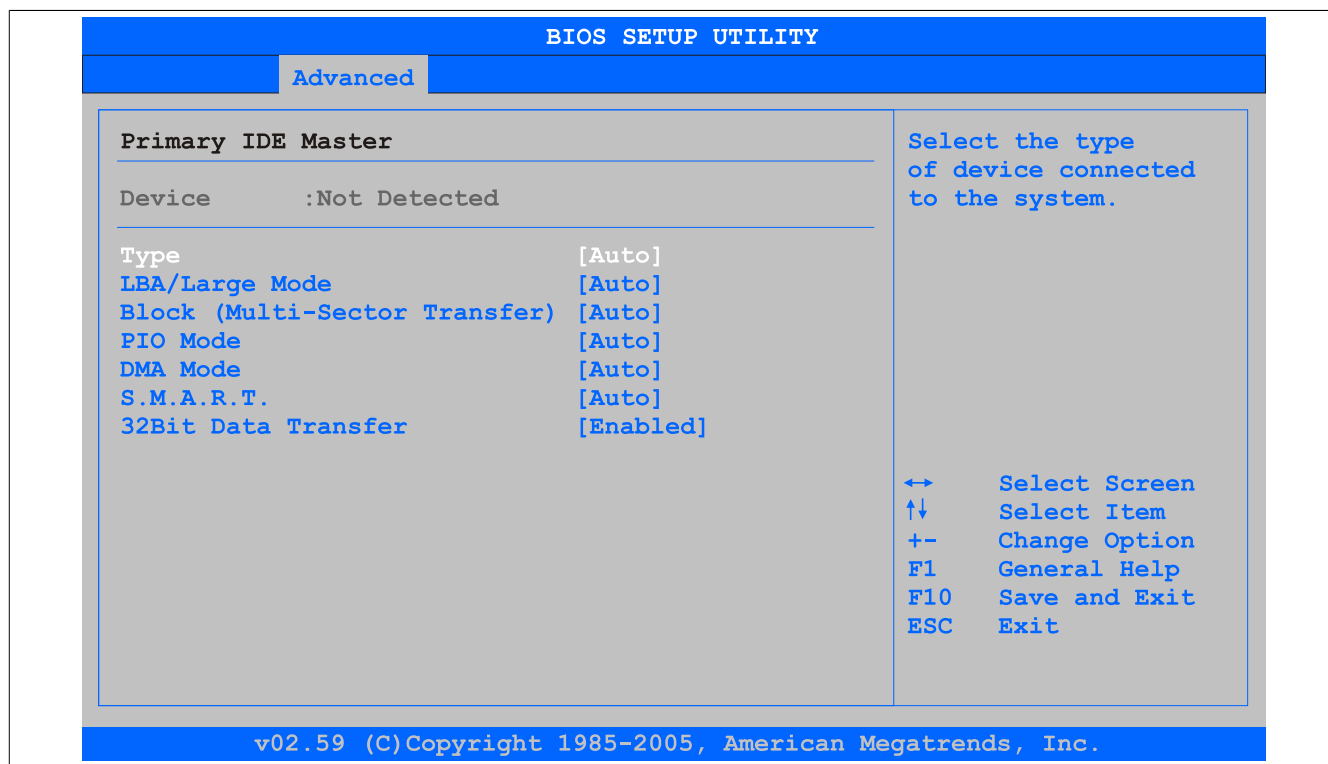


Abbildung 112: GM45 Primary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Primary Master angeschlossenen Laufwerks parametrier.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung un-relevant.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Primary Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 169: GM45 Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten

Secondary IDE Master

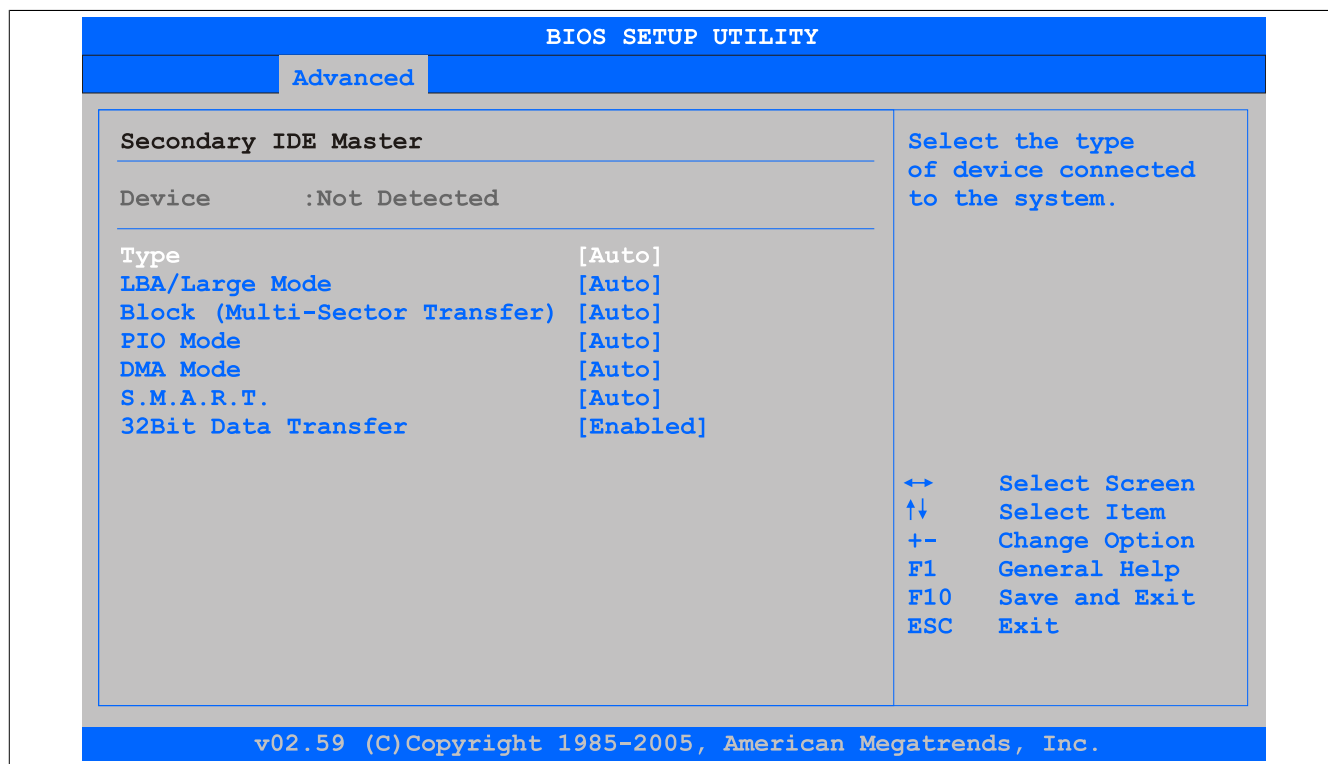


Abbildung 113: GM45 Secondary IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Secondary Master angeschlossenen Laufwerks parametrier.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung un-relevant.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Secondary Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 170: GM45 Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten

Third IDE Master

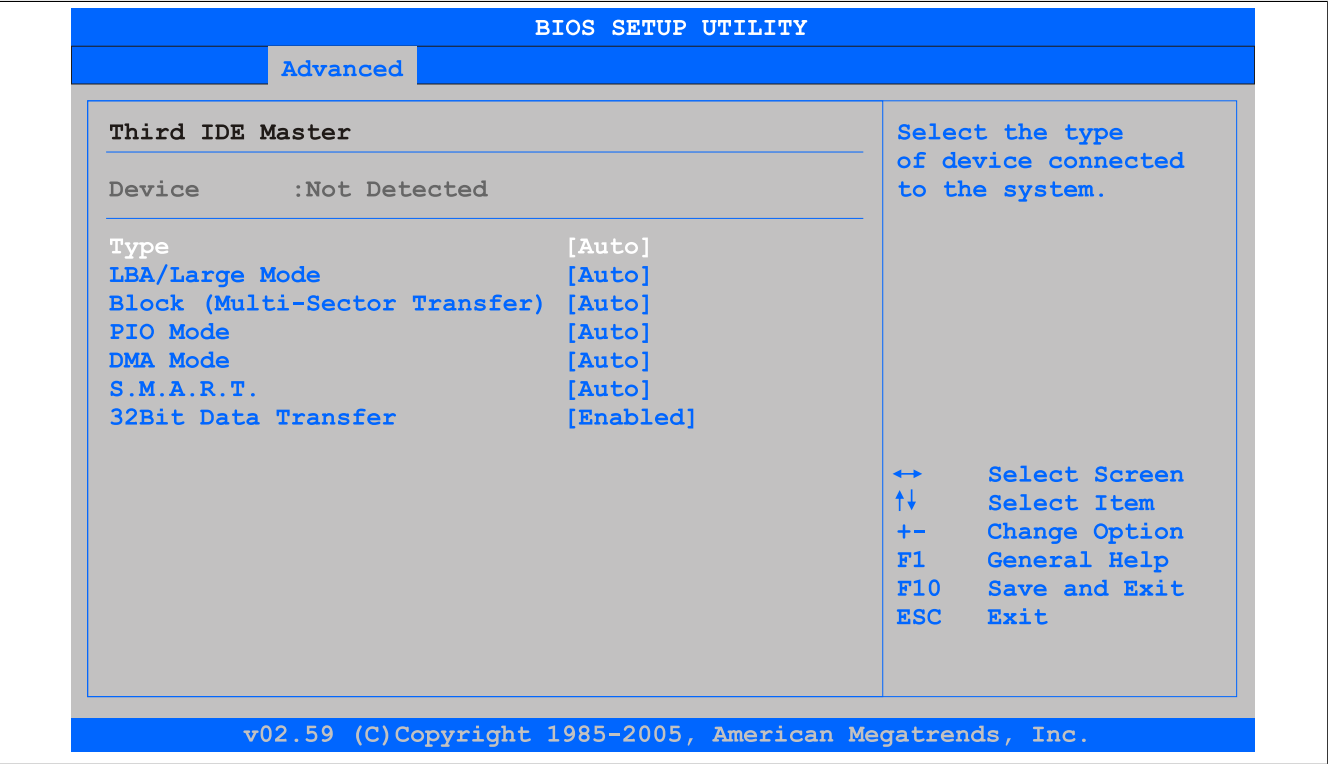


Abbildung 114: GM45 Third IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Third Master angeschlossenen Laufwerks parametriert.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird der Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung un-relevant.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Third Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 171: GM45 Third IDE Master Einstellmöglichkeiten

Fourth IDE Master

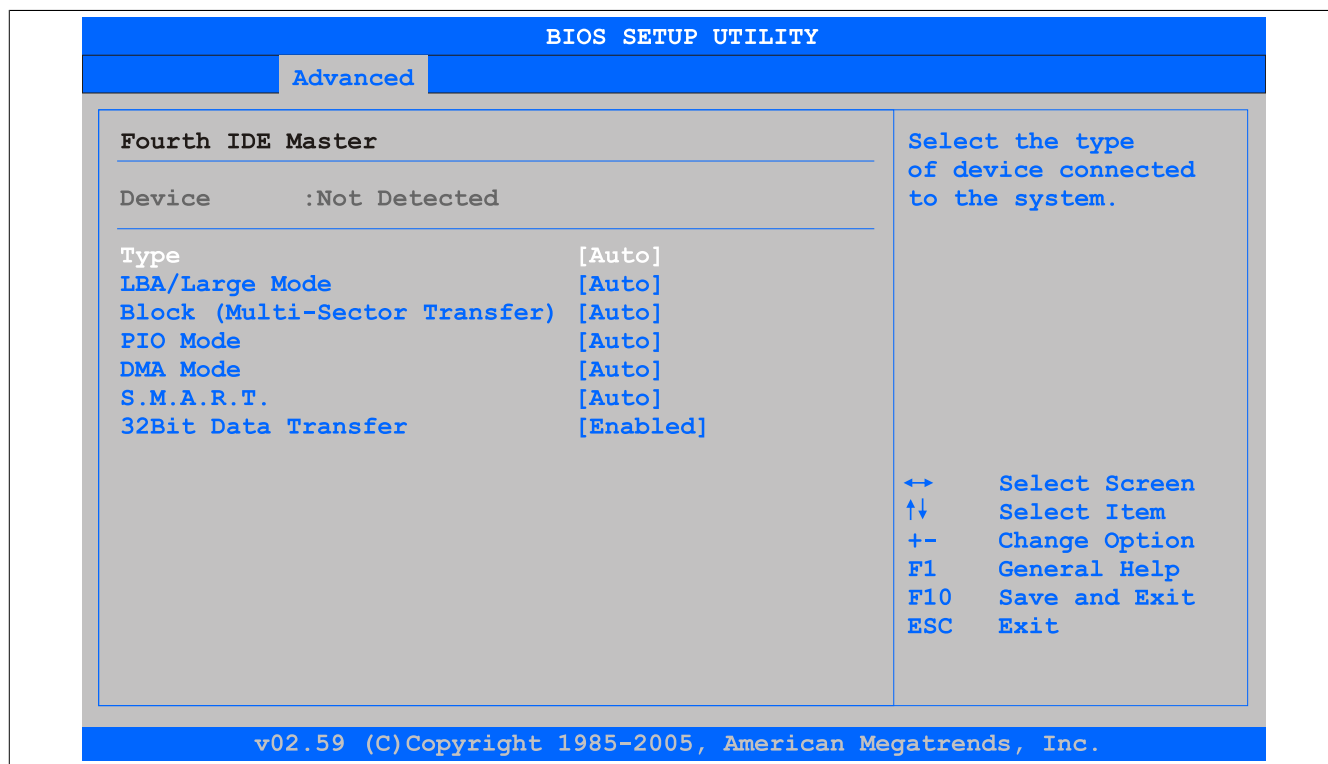


Abbildung 115: GM45 Fourth IDE Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Type	Hier wird der Typ des am Fourth Master angeschlossenen Laufwerks parametrier.	Not Installed	Kein Laufwerk installiert.
		Auto	Automatische Erkennung des Laufwerks und Einstellung der richtigen Werte.
		CD/DVD	CD-/DVD-Laufwerk.
		ARMD	ARMD-Laufwerk (Zip-Laufwerk).
LBA/Large Mode	Mit dieser Option wird das Logical-Block- Addressing/Large Modus für IDE aktiviert.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
Block (Multi-Sector Transfer)	Mit dieser Option wird der Block-Mode von IDE-Festplatten aktiviert. Bei Aktivierung dieser Option wird die Zahl der Blöcke pro Anforderung aus dem Konfigurationssektor der Festplatte ausgelesen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung der Funktion wenn es vom System unterstützt wird.
PIO Mode	Der PIO-Modus bestimmt die Datenrate der Festplatte. Information: Diese Option ist beim APC810 nicht vorhanden. Somit ist diese Einstellung un-relevant.	Auto	Automatische Einstellung des PIO Modus.
		0, 1, 2, 3, 4	Manuelle Einstellung des PIO Modes.
DMA Mode	Hier wird die Datenübertragungsrate zum und vom Fourth Master Laufwerk festgelegt. Der DMA-Mode muss unter Windows im Gerätemanager aktiviert werden, erst dann ist die volle Performance garantiert. Kann nur bei manueller Einstellung des Laufwerkes eingestellt werden.	Auto	Automatische Festlegung der Übertragungsrate.
		Disabled	Manuelle Festlegung der Übertragungsrate.
S.M.A.R.T.	Überwachungsfunktion moderner Festplatten (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).	Auto	Automatische Erkennung und Aktivierung.
		Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
32 Bit Data Transfer	Diese Funktion ermöglicht den 32-Bit IDE Datentransfer.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 172: GM45 Fourth IDE Master Einstellmöglichkeiten

1.4.10 USB Configuration

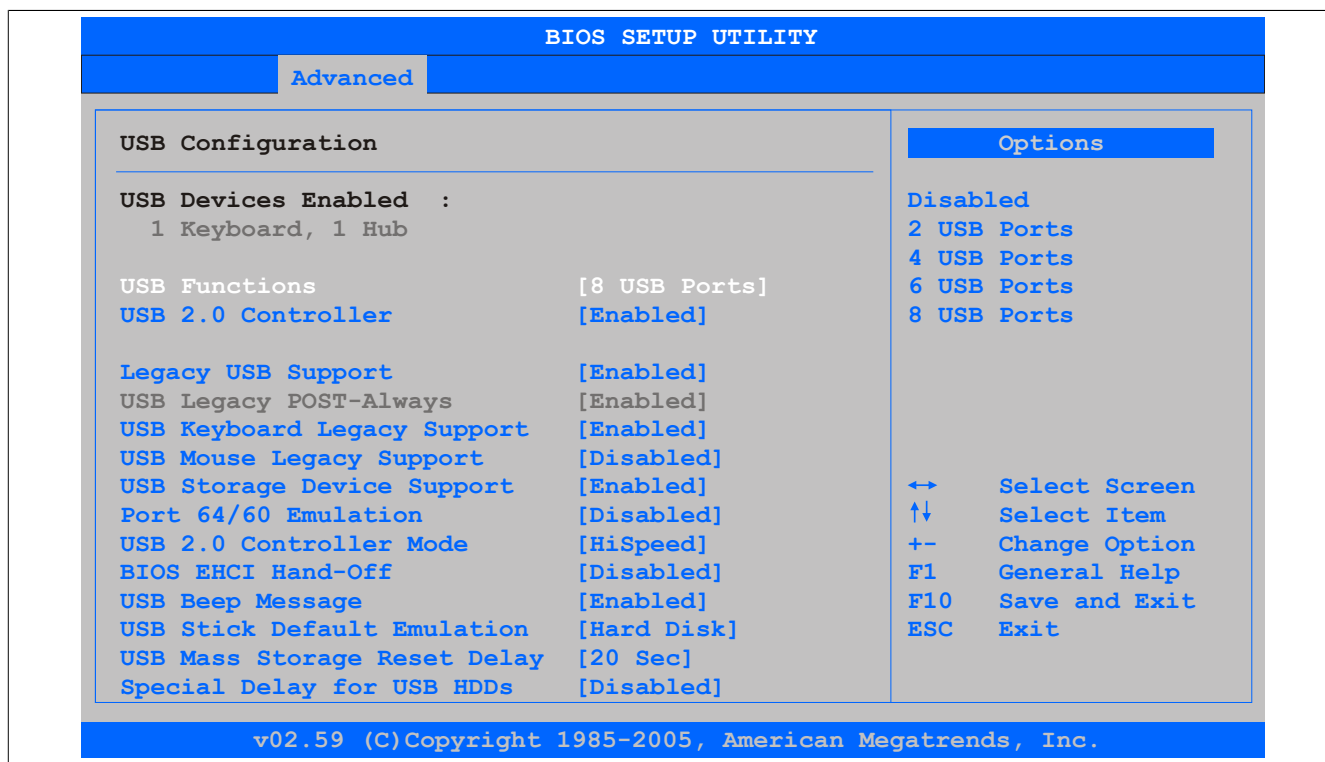


Abbildung 116: GM45 Advanced USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Function	Hier können die USB-Ports aktiviert/deaktiviert werden. Die USB Nummern (z.B. USB1, USB3, usw.) sind am Gehäuse des APC810 aufgedruckt).	Disabled	Deaktivierung der USB-Ports.
		2 USB Ports	USB1, USB3 werden aktiviert.
		4 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4 werden aktiviert.
		6 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5 werden aktiviert.
		8 USB Ports	USB1, USB2, USB3, USB4, USB5, USB an einem AP über SDL werden aktiviert.
USB 2.0 Controller	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des USB 2.0 Modus.	Enabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 2.0 Modus.
		Disabled	Alle USB Schnittstellen laufen im USB 1.1 Modus.
Legacy USB Support	Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Auto	Automatische Aktivierung.
USB Legacy POST-Always	Legacy USB Support ist während des POST (Power On Self Test) gleichgültig der Legacy USB Support Einstellung aktiviert.	keine (automatisch auf Enabled)	Das BIOS Setup kann während des POST mittels einer USB Tastatur aufgerufen werden.
USB Keyboard Legacy Support	Hier kann die USB-Keyboards Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Mouse Legacy Support	Hier kann die USB-Mouse Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Storage Device Support	Hier kann die USB-Massenspeichergerät Unterstützung aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Port 64/60 Emulation	Hier kann die Port 64/60 Emulation aktiviert/deaktiviert werden.	Enabled	USB-Keyboards funktioniert unter Windows NT.
		Disabled	USB-Keyboards funktioniert unter allen Systemen außer Windows NT.
USB 2.0 Controller Mode	Hier können Einstellungen für den USBController vorgenommen werden.	Full Speed	12 MBps
		Hi Speed	480 MBps
BIOS EHCI Hand- Off	Hier kann die Unterstützung für Betriebssysteme ohne vollautomatische EHCI-Funktion eingerichtet werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Beep Message	Option zur Ausgabe jeweils eines Pieptones, wenn ein USB Gerät während des POST vom BIOS erkannt wurde.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
USB Stick Default Emulation	Hier kann eingestellt werden, wie ein USB-Gerät verwendet wird.	Auto	USB-Geräte, deren Speicherkapazität kleiner als 530MB ist werden als Diskettenlaufwerk und die anderen Geräte mit größerer Kapazität als Festplatte simuliert.

Tabelle 173: GM45 Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
		Hard Disk	Ein als HDD formatiertes Laufwerk als FDD (z.B. ZIP-Laufwerk) kann zum Starten des Systems verwendet werden.
USB Mass Storage Reset Delay	Hier kann die Zeit, die der POST für USB Speichergeräte nach dem Gerätstartbefehl warten soll, eingestellt werden. Information: Die Meldung "No USB Mass Storage device detected" (Kein USB Massenspeichergerät entdeckt) wird angezeigt, wenn kein USB Massenspeichergerät installiert wurde.	10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 40 Sec	Manuelle Einstellung des Wertes.
Special Delay for USB HDDs	Option zum Einstellen eines Boot Delay (Bootverzögerung) vor der USB 2.0 Geräteaufzählung, um das Booten von langsam hochlaufe USB Devices (z.B. USB Hard Disks) zu ermöglichen. Information: Diese Option sollte nur bei Bedarf verwendet werden, da der Bootvorgang dann immer um die eingestellte Zeit länger dauert.	Disabled 1 Sec, 2 Sec, 3 Sec, 4 Sec, 5 Sec, 7 Sec, 10 Sec	Deaktivierung der Funktion. Es wird kein Boot Delay hinzugefügt. Es wird ein Boot Delay von 1, 2, 3, 4, 5, 7 bzw. 10 Sekunden hinzugefügt.

Tabelle 173: GM45 Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.11 Keyboard/Mouse Configuration

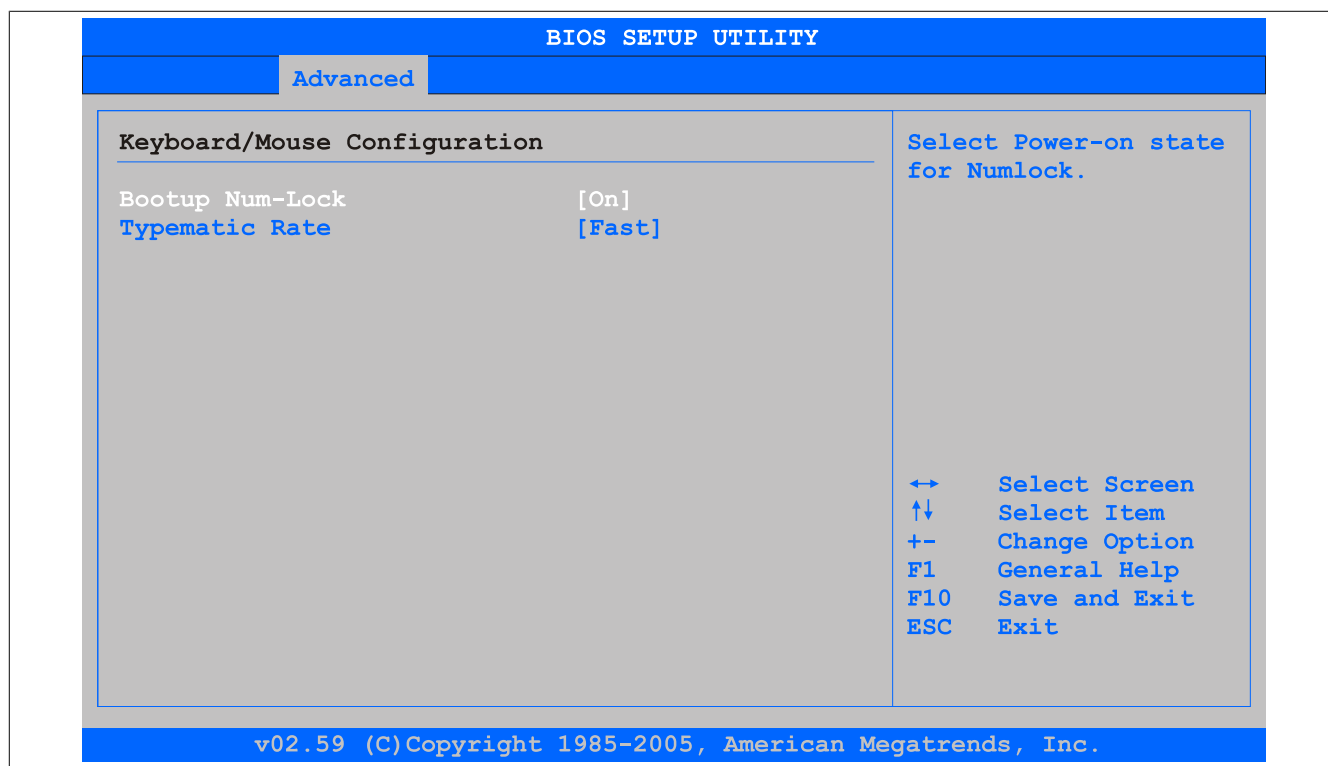


Abbildung 117: GM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Bootup Num-Lock	Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zehnergertastatur (NumLock) beim Booten des Systems definieren.	Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich die Cursorfunktionen aktiviert.
		On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
Typematic Rate	Hier wird die Tastenwiederholungsfunktion eingestellt.	Slow	Langsame Tastenwiederholung.
		Fast	Schnelle Tastenwiederholung.

Tabelle 174: GM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten

1.4.12 CPU Board Monitor

Information:

Die angezeigten Spannungswerte (z.B. Corespannung, Batteriespannung) auf dieser BIOS Setup Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlerzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

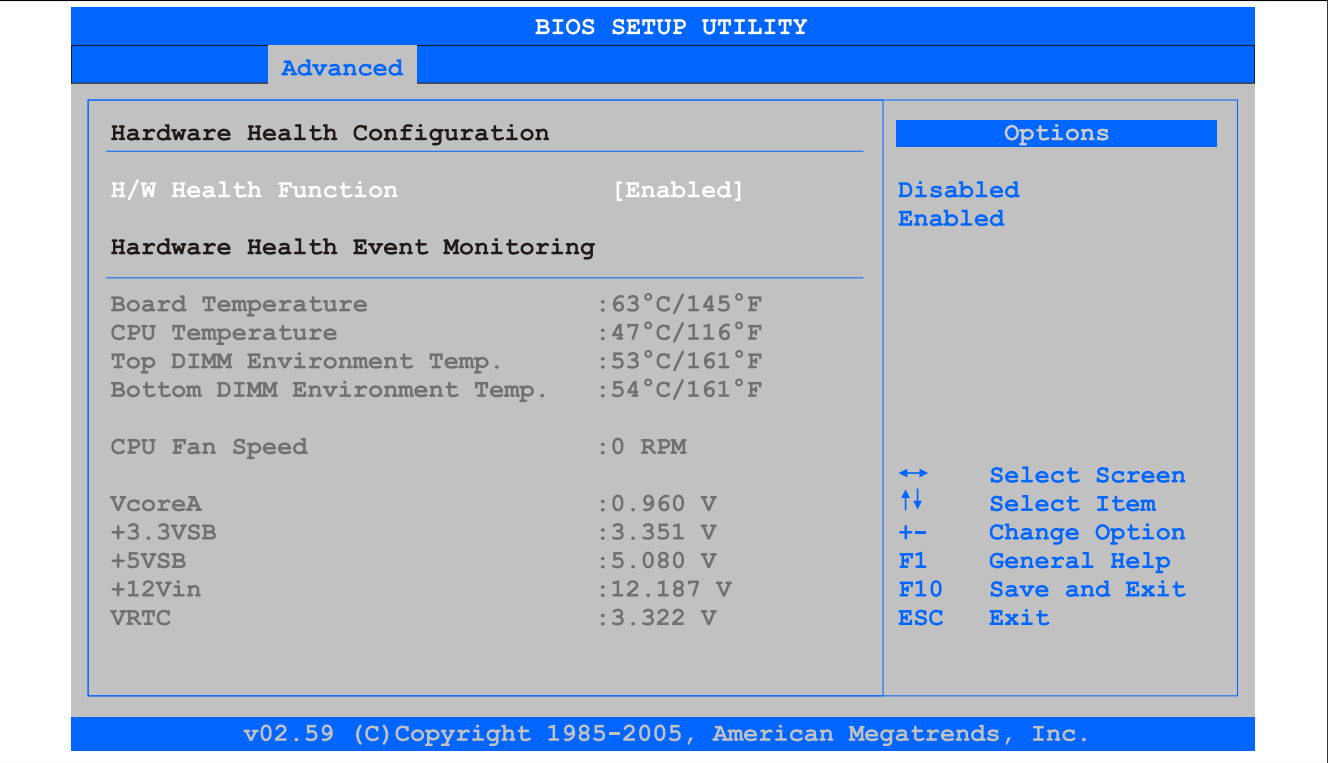


Abbildung 118: GM45 Advanced CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
H/W Health Function	Option zum Anzeigen sämtlicher Werte auf dieser Seite.	Enabled	Anzeigen sämtlicher Werte.
		Disabled	Es werden keine Werte auf dieser Seite angezeigt.
Board Temperature	Temperaturanzeige der Boardtemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
CPU Temperature	Anzeige der Prozessortemperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Top DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 1. DRAM Moduls.	keine	-
Bottom DIMM Enviroment Temp.	Anzeige der Temperatur des 2. DRAM Moduls.	keine	-
CPU Fan Speed	Anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Prozessorlüfters.	keine	-
VcoreA	Anzeige der Prozessorkernspannung A in Volt.	keine	-
+3.3VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 3,3 Volt Versorgung.	keine	-
+5VSB	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 5 Volt Versorgung.	keine	-
+12Vin	Anzeige der aktuell anliegenden Spannung der 12 Volt Versorgung.	keine	-
VRTC	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-

Tabelle 175: GM45 Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.13 Baseboard/Panel Features

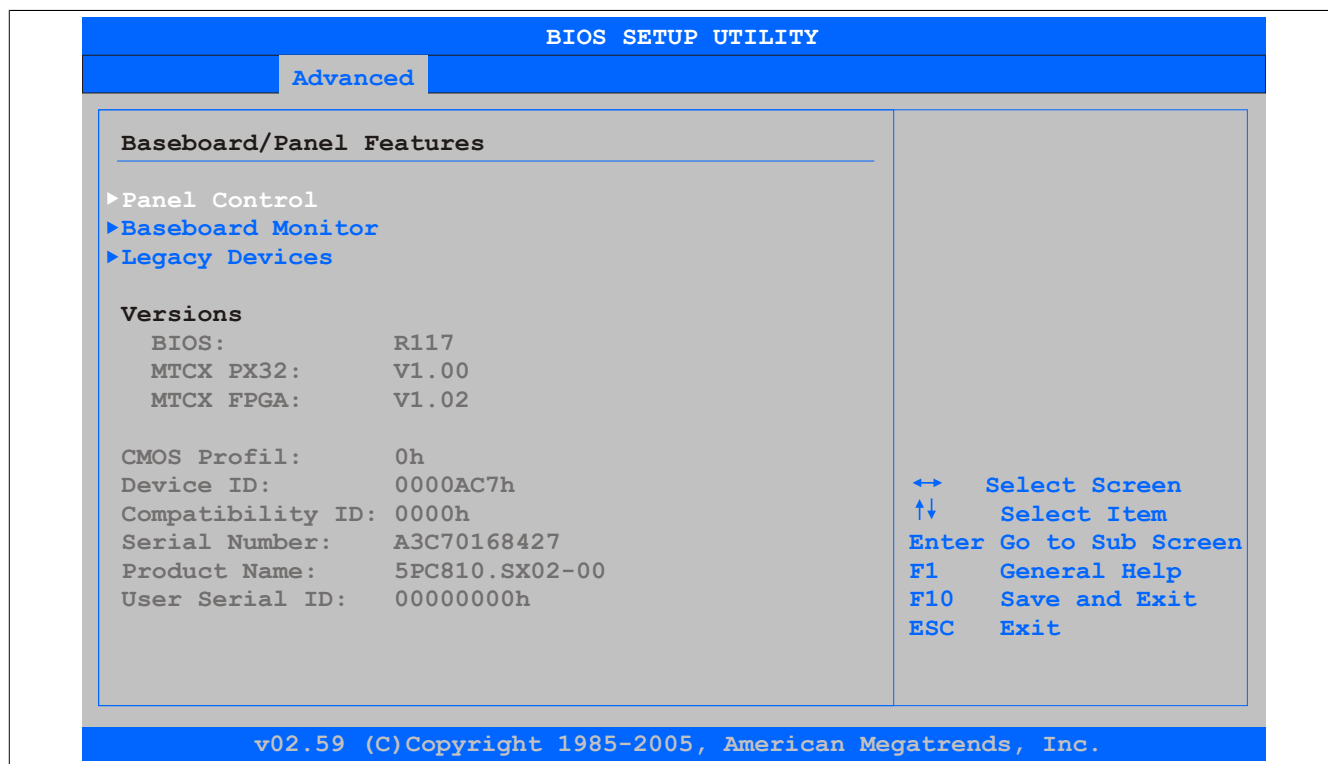


Abbildung 119: GM45 Advanced Baseboard/Panel Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Panel Control	Hier können spezielle Einstellungen für angeschlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control" auf Seite 216
Baseboard Monitor	Anzeige verschiedener Temperaturwerte und Lüfterdrehzahlen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Baseboard Monitor" auf Seite 217
Legacy Devices	Hier können spezielle Einstellungen für die Schnittstellen vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy Devices" auf Seite 218
BIOS	Anzeige der BIOS Version	keine	-
MTCX PX32	Anzeige der MTCX PX32 Firmwareversion.	keine	-
MTCX FPGA	Anzeige der MTCX FPGA Firmwareversion.	keine	-
CMOS Profil	Zeigt die CMOS Profil Nummer an.	keine	-
Device ID	Hexwertanzeige der Hardware-Geräte ID.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-

Tabelle 176: GM45 Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten

Panel Control

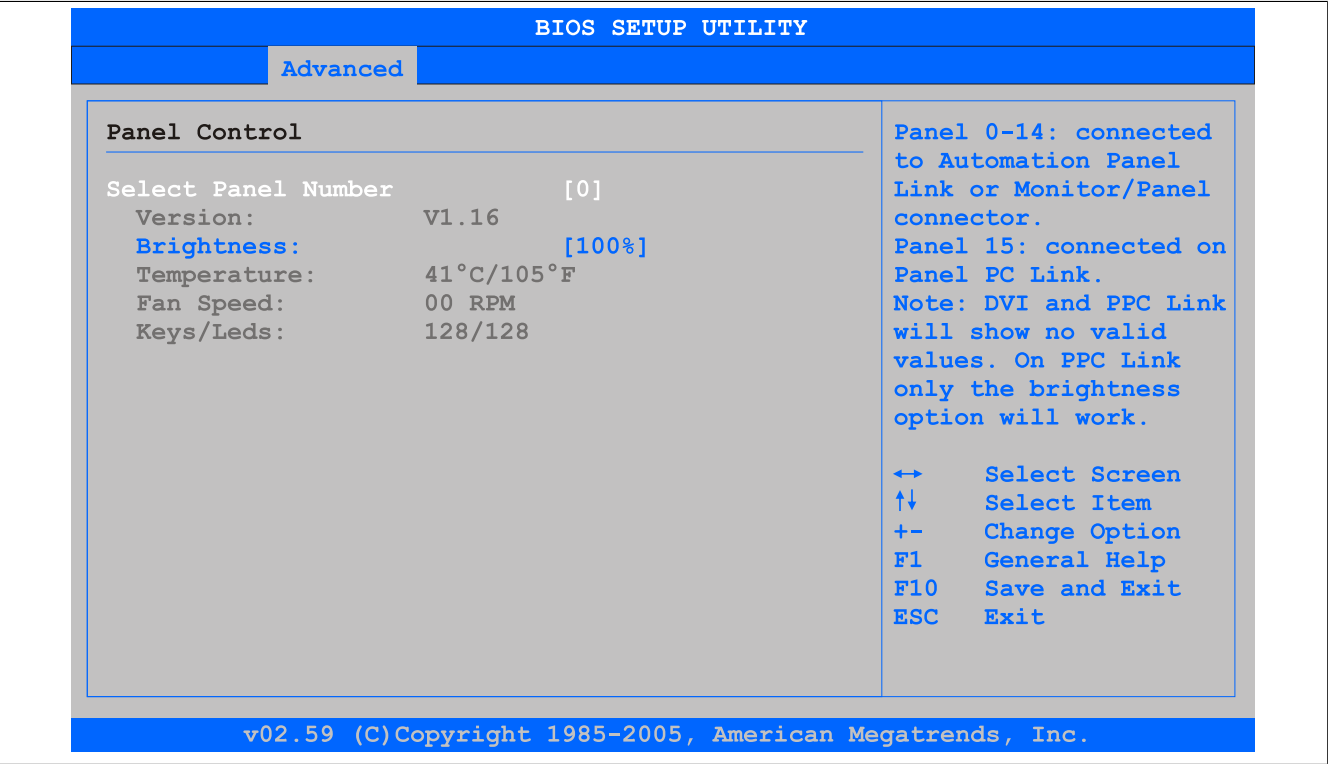


Abbildung 120: GM45 Panel Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Select Panel Number	Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte aus-gelesen bzw. geändert werden sollen.	0...15	Panelauswahl 0 ... 15. Panel 15 ist speziell für Panel PC 800 Systeme vorgesehen.
Version	Anzeige der Firmwareversion des SDLR Control-lers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit beim ausgewählten Pa-nel.	0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewähl-ten Panel. Wird erst beim Speichern und Neu-start des Systems wirksam (z.B. durch Drücken von <F10>).
Temperature	Temperaturanzeige des ausgewählten Panels in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Fan Speed	Lüfterumdrehungsanzeige des ausgewählten Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des ausgewählten Panels.	keine	-

Tabelle 177: GM45 Panel Control Einstellmöglichkeiten

Baseboard Monitor

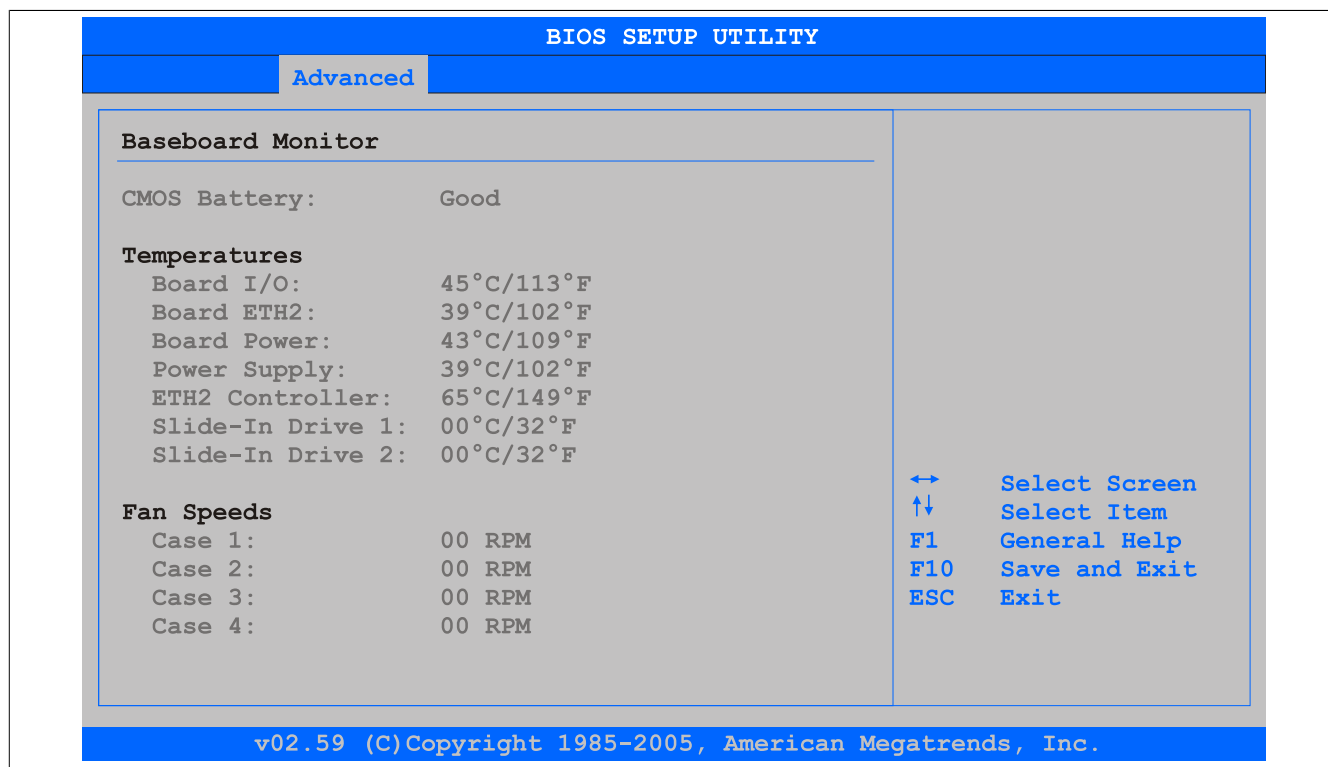


Abbildung 121: GM45 Baseboard Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
CMOS Battery	Zeigt den Status der Batterie an. n.a. - not available Good - Batterie ist in Ordnung. Bad - Batterie ist kaputt.	keine	-
Board I/O	Anzeige der Temperatur im I/O Bereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board ETH2	Anzeige der Temperatur im ETH2 Controller Chipbereich in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Board Power	Anzeige der Netzteilterperatur in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Power Supply	Anzeige der Temperatur im Netzteil in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
ETH2 Controller	Anzeige der Temperatur des ETH2 Controllers in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 1	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 1 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Slide-In Drive 2	Anzeige der Temperatur des Slide-in Laufwerks 2 in Grad Celsius und Fahrenheit.	keine	-
Case 1	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 1.	keine	-
Case 2	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 2.	keine	-
Case 3	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 3.	keine	-
Case 4	Anzeige der Lüfterumdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuselüfters 4.	keine	-

Tabelle 178: GM45 Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten

Legacy Devices

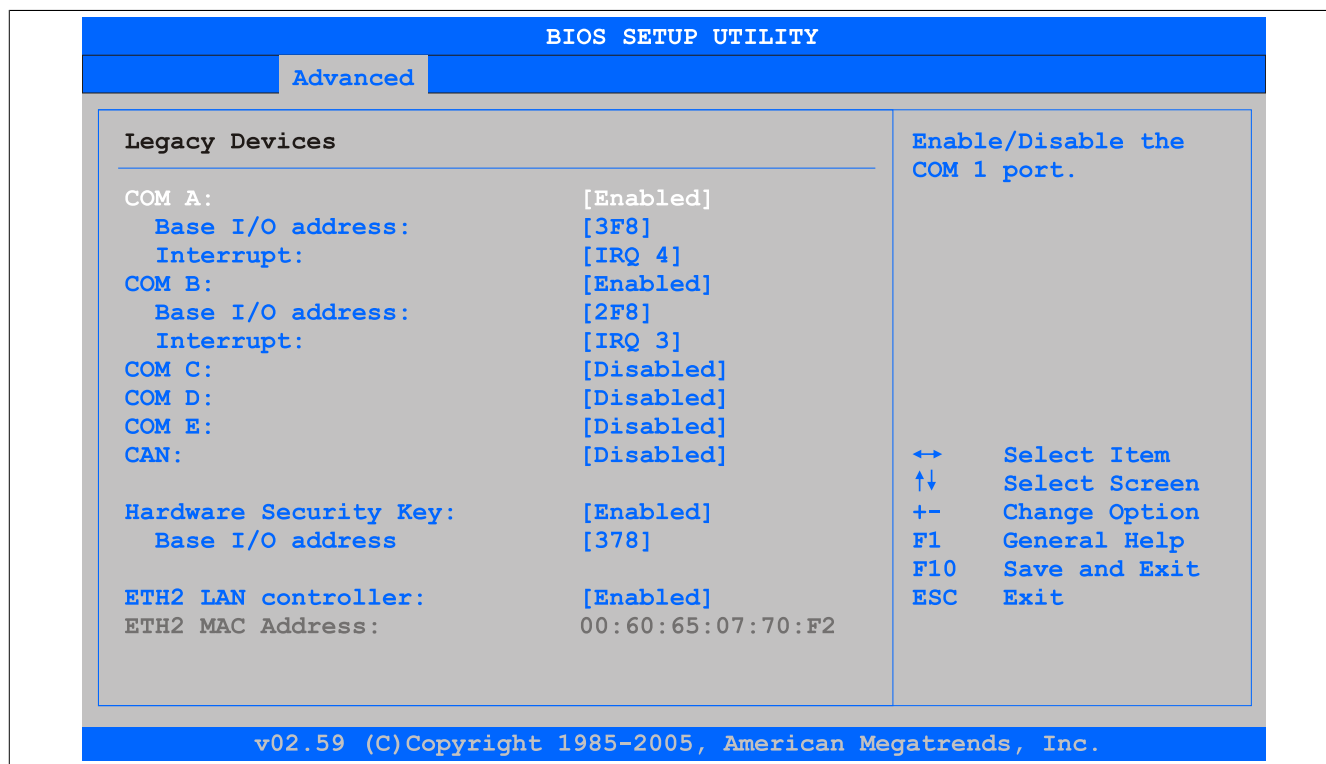


Abbildung 122: GM45 Legacy Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COM A	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM1 im System.	Enabled Disabled	Aktivierung der Schnittstelle. Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM B	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM2 im System.	Disabled Enabled	Deaktivierung der Schnittstelle. Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM C	Einstellung des COM Ports für den Touch Screen am Monitor/Panel Stecker.	Enabled Disabled	Aktivierung der Schnittstelle. Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM D	Einstellung des COM Ports für den Touch Screen am AP Link Stecker.	Enabled Disabled	Aktivierung der Schnittstelle. Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COM E	Einstellung des COM Ports der B&R Add-on Schnittstellenoption 5AC600.4851-00 (IF-Option).	Enabled Disabled	Aktivierung der Schnittstelle. Deaktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ 3, IRQ 4, IRQ 5, IRQ 6, IRQ 7, IRQ 10, IRQ 11, IRQ 12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
CAN	Einstellung des CAN Ports der B&R Add-on CAN Schnittstellenkarte 5AC600.CANI-00 (IF-Option).	Disabled Enabled	Deaktivierung der Schnittstelle. Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Anzeige der Base I/O Adresse des CAN Ports.	keine	-
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den CAN Port.	IRQ 10, NMI	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
Hardware Security Key	Hier werden Einstellungen für den Hardware Security Key (Dongle) vorgenommen.	Disabled Enabled	Deaktivierung der Schnittstelle. Aktivierung der Schnittstelle.
Base I/O address	Auswahl der Base I/O Adresse der Hardware Security Schnittstelle.	278, 378, 3BC	Zuweisung für die Base I/O Adresse für den parallelen Port.

Tabelle 179: GM45 Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
ETH2 LAN controller	Hier kann der Onboard LAN Controller (ETH2) ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Enabled	Aktivierung des Controllers.
		Disabled	Deaktivierung des Controllers.
ETH2 MAC Address	Zeigt die MAC-Adresse des Ethernet 2 Controllers.	keine	-

Tabelle 179: GM45 Legacy Devices Einstellmöglichkeiten

1.5 Boot

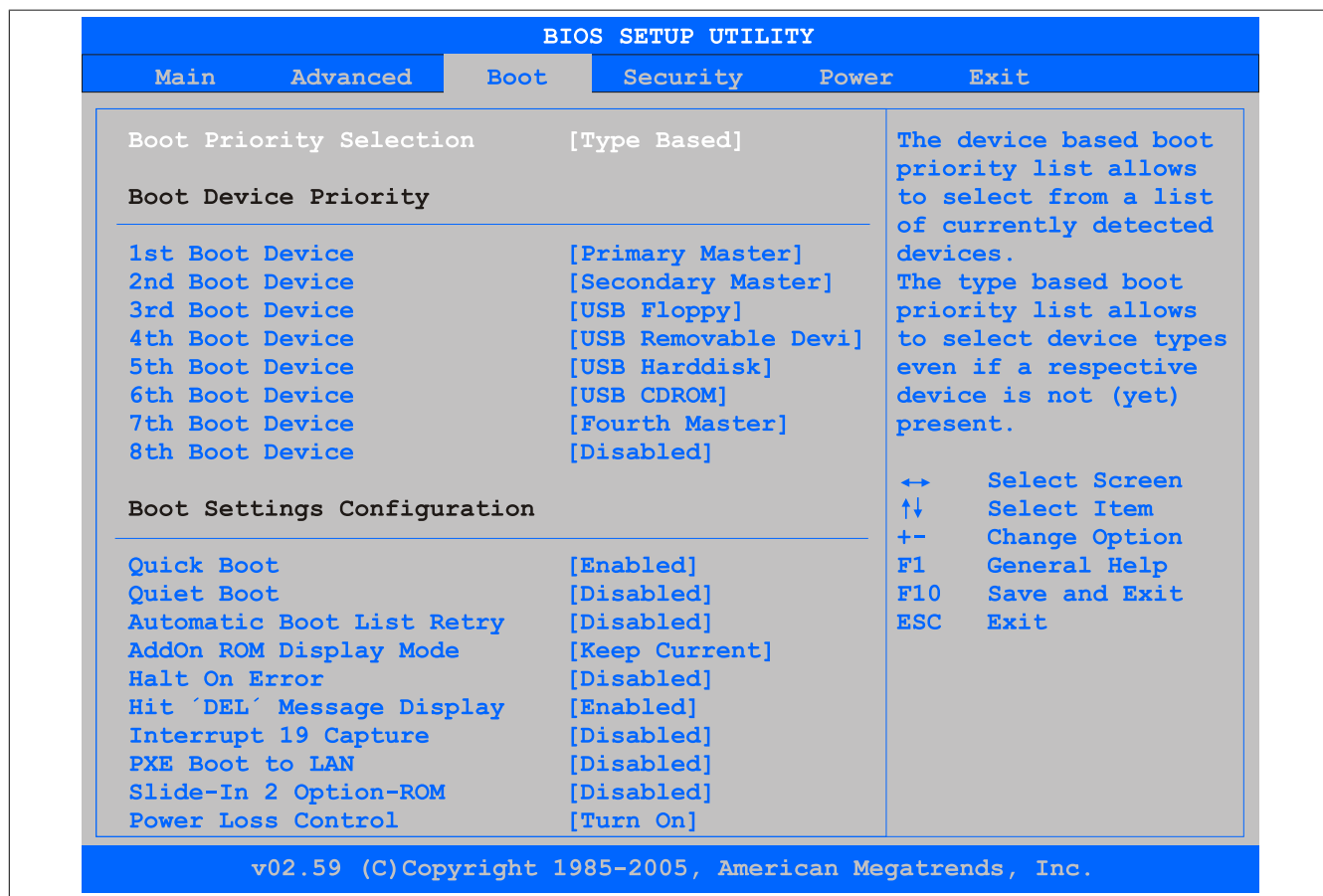


Abbildung 123: GM45 Boot Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Priority Selection	Hier kann eingestellt werden, nach welcher Methode die Laufwerke gebootet werden sollen.	Device Based	Es werden nur die vom System erkannten Geräte aufgelistet. Bei dieser Liste kann danach die Reihenfolge geändert werden. Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.
		Type Based	Mann kann die Bootreihenfolge einer Gerätetypenliste ändern. Es ist auch möglich nicht angeschlossene Gerätetypen in dieser Liste anzugeben. Information: Es ist entweder die Device Based oder die Type Based Methode zu verwenden. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig.

Tabelle 180: GM45 Boot Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
1st Boot Device	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke eingestellt werden.	Disabled, Primary Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave, Legacy Floppy, USB Floppy, USB Harddisk, USB CDROM, USB Removeable Device, Onboard LAN, External LAN, PCI Mass Storage, PCI SCSI Card, Any PCI BEV Device, Third Master, Third Slave, PCI RAID, Local BEV ROM, Fourth Master, Fourth Slave	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
2nd Boot Device			
3rd Boot Device			
4th Boot Device			
5th Boot Device			
6th Boot Device			
7th Boot Device			
8th Boot Device			
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten durch überspringen von einigen POST Vorgängen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt wird.	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
		Disabled	Anzeige der POST Nachricht.
Automatic Boot List Retry	Mit dieser Option wird versucht, das Betriebssystem bei einem Fehlstart automatisch neu zu starten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
AddOn ROM Display Mode	Setzt das Anzeigemodus für das ROM (während dem Bootvorgang).	Force BIOS	Ein weiterer BIOS Teil kann angezeigt werden.
		Keep Current	BIOS Informationen werden angezeigt.
Halt On Error	Die Option legt fest, ob nach einem Fehler der Systemstart während des Power On Self Test (POST) fortgesetzt werden soll.	Enabled	System hält an. Bei jedem Fehler wird das System angehalten.
		Disabled	System hält nicht an. Alle Fehler werden ignoriert.
Hit 'DEL' Message Display	Hier können Einstellungen für die Anzeige der „Hit 'DEL' Message“ vorgenommen werden. Information: Wenn Quiet Boot aktiviert ist wird die Nachricht nicht angezeigt.	Enabled	Die Nachricht wird angezeigt.
		Disabled	Die Nachricht wird nicht angezeigt.
Interrupt 19 Capture	Mit dieser Funktion kann die BIOS Unterbrechung eingeschlossen werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion vom LAN (ETH1) zu booten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Slide-In 2 Option-ROM	Aktivierung/Deaktivierung der Funktion von einem Option ROM für ein Slide-in 2 Laufwerk.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Loss Control	Stellt fest ob das System nach einem Leistungsabfall an/aus ist.	Remain Off	Bleibt ausgeschaltet.
		Turn On	Schaltet ein.
		Last State	Aktiviert den vorherigen Zustand.

Tabelle 180: GM45 Boot Menü Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

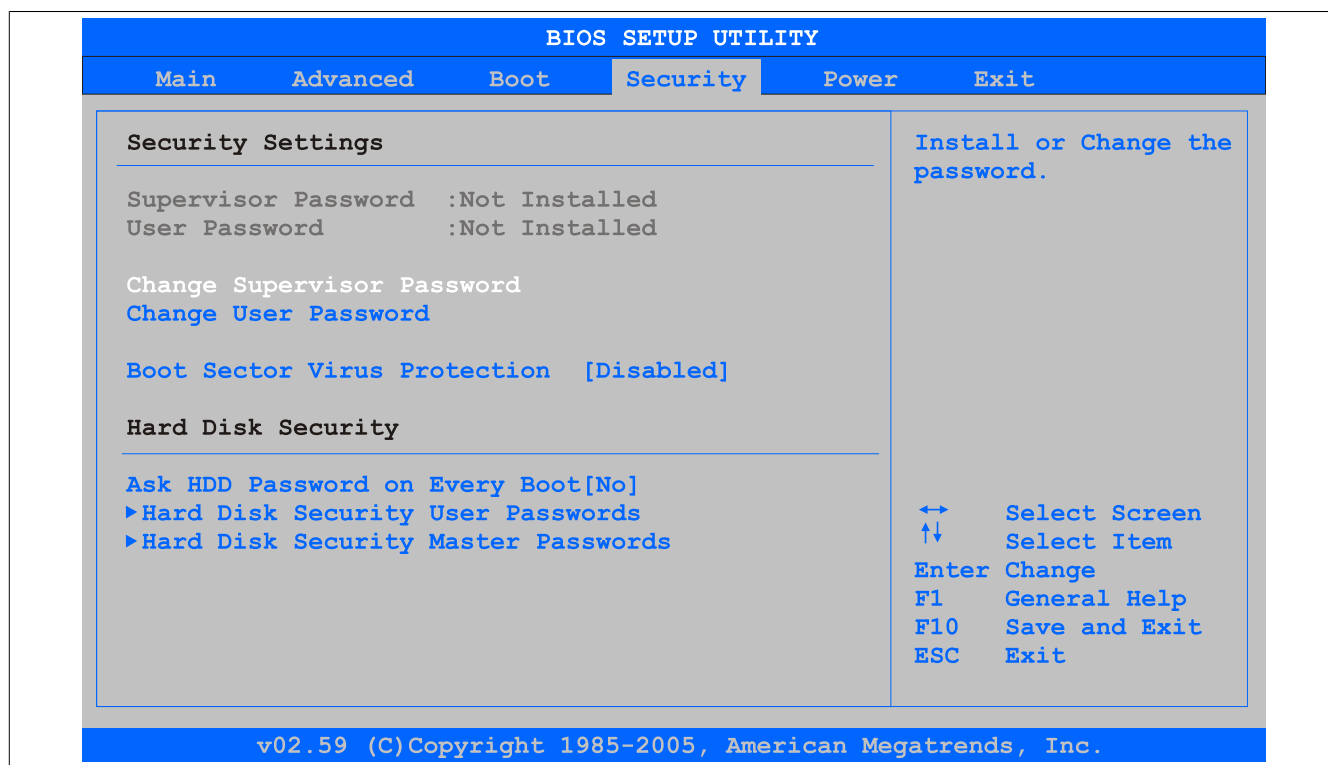


Abbildung 124: GM45 Security Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Change Supervisor Password	Funktion zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Change User Password	Funktion zum Eingeben eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Boot Sector Virus Protection	Mit dieser Option wird beim Zugriff durch ein Programm oder Virus auf den Bootsektor eine Warnung ausgegeben. Information: Mit dieser Option wird nur der Bootsektor geschützt, nicht aber die gesamte Festplatte.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Ask HDD Password on Every Boot	Mit dieser Option kann eingestellt werden, ob ein Hard Disk Passwort bei jedem Bootvorgang eingegeben werden muss. Information: Diese Option ist nur sinnvoll, wenn ein Hard Disk User Security Passwort gesetzt ist.	Yes	Bei jedem Bootvorgang muss das Hard Disk Passwort eingegeben werden.
		No	Beim Bootvorgang muss kein Hard Disk Passwort eingegeben werden.
Hard Disk Security User Passwords	Hier kann das Hard Disk Security User Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security User Password" auf Seite 222
Hard Disk Security Master Passwords	Hier kann das Hard Disk Security Master Passwort erstellt werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Security Master Password" auf Seite 222

Tabelle 181: GM45 Security Menü Einstellmöglichkeiten

1.6.1 Hard Disk Security User Password

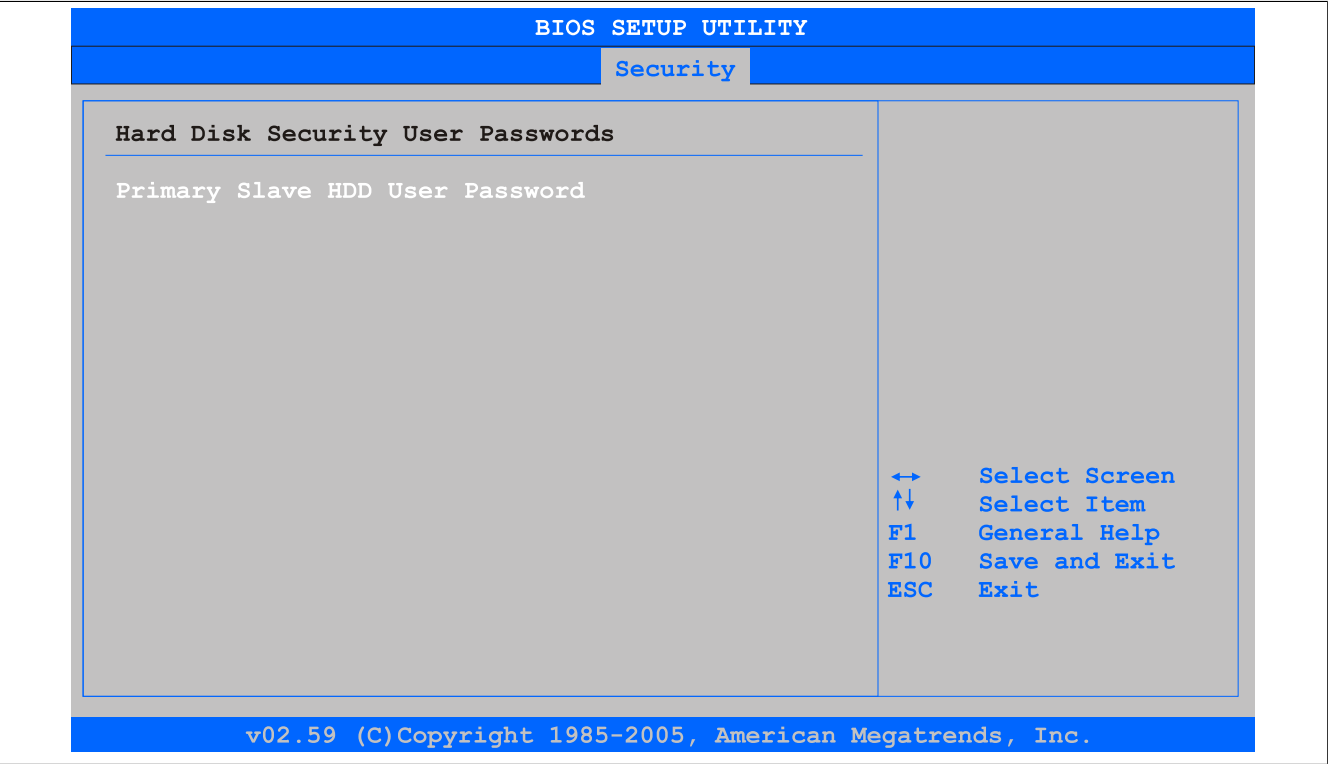


Abbildung 125: GM45 Hard Disk Security User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD User Password	Mit dieser Funktion ist es möglich das User Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern ohne das Gerät neu zu booten. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 182: GM45 Hard Disk Security User Password

1.6.2 Hard Disk Security Master Password

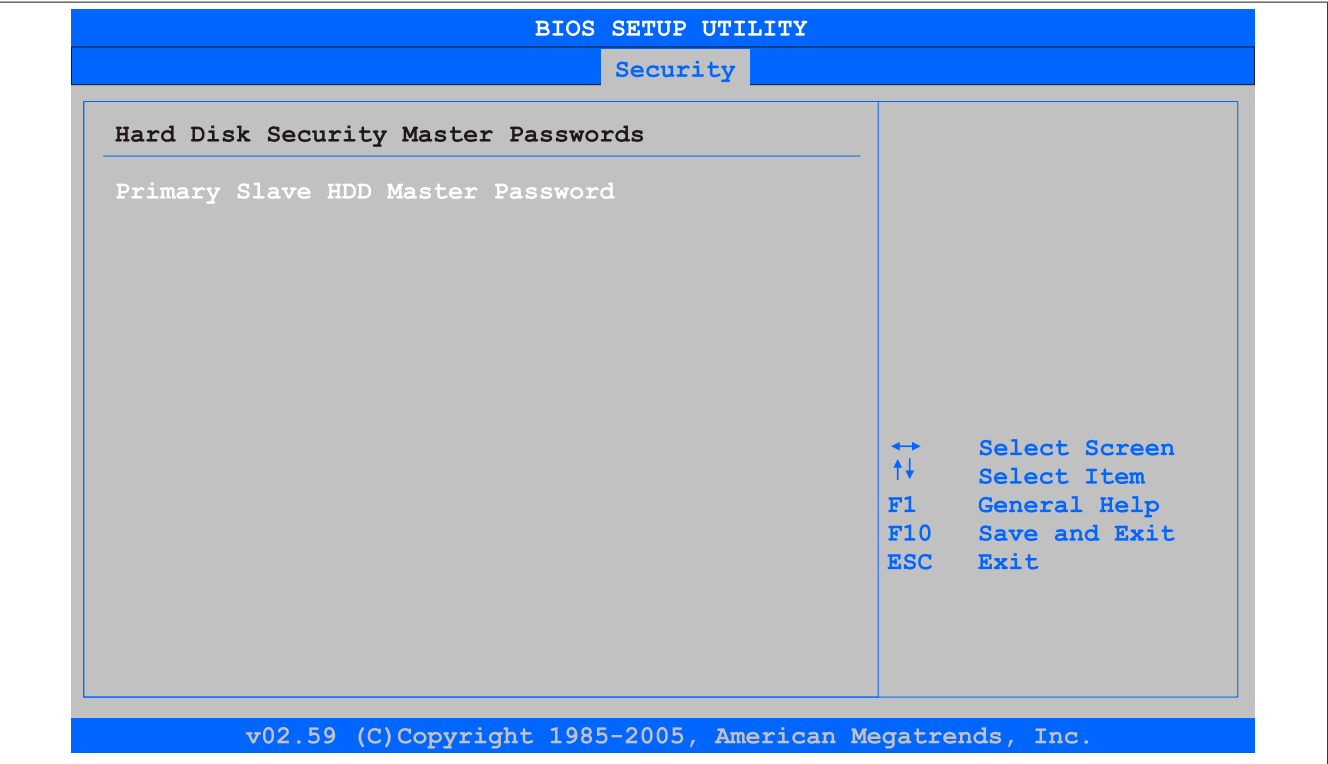


Abbildung 126: GM45 Hard Disk Security Master Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Primary Slave HDD Master Password	Mit dieser Funktion ist es möglich das Master Passwort jeder Festplatte einzustellen oder zu ändern ohne das Gerät neu zu booten.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 183: GM45 Hard Disk Security Master Password

1.7 Power

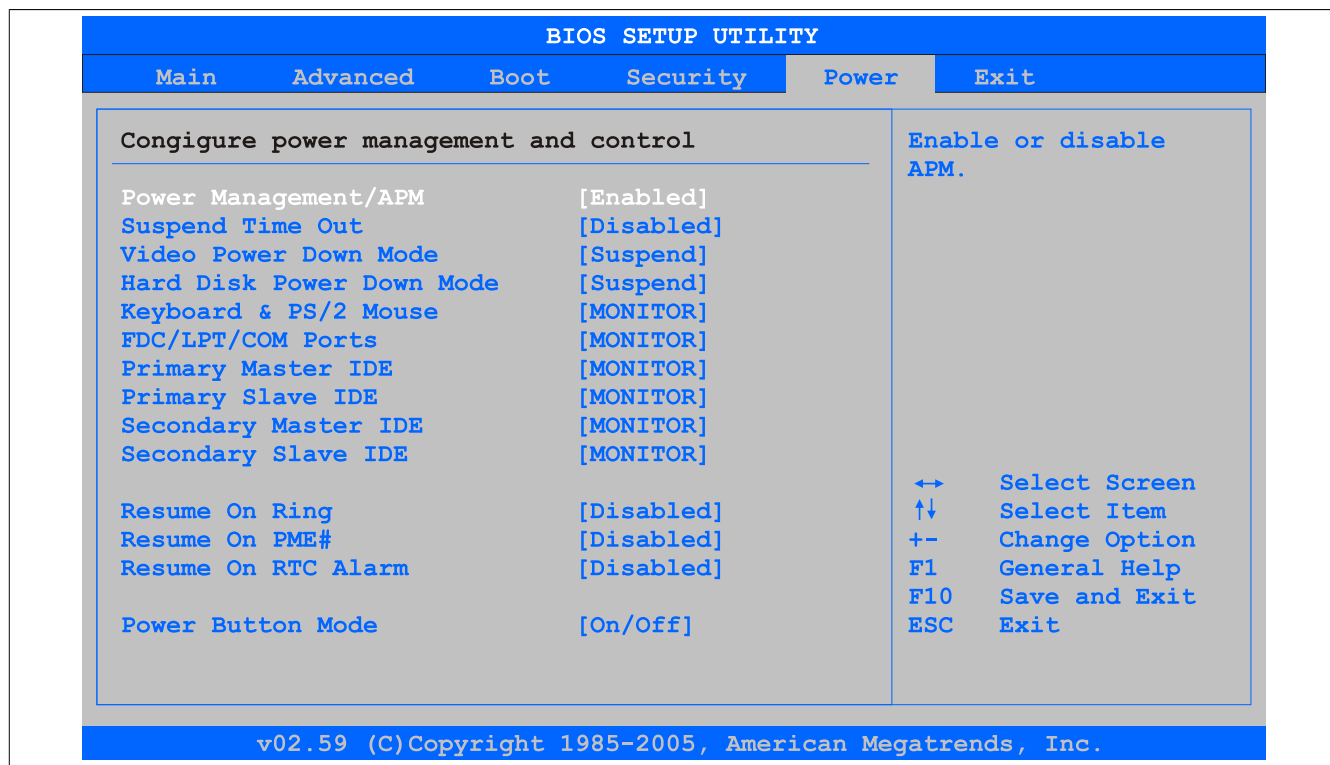


Abbildung 127: GM45 Power Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Power Management/ APM	Diese Option schaltet die APM-Funktionalität ein oder aus. Es handelt sich hierbei um eine erweiterte Plug & Play- und Power Management-Funktionalität.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Suspend Time Out	Unter dieser Option stellen Sie ein, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität des Systems, dieses in den Suspend Modus (es werden alle Komponenten, außer der CPU, soweit wie möglich abgeschaltet) gefahren wird.	1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 50 Min, 60 Min;	Manuelle Einstellung des Wertes.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Video Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus für den Bildschirm festgelegt.	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
		Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Hard Disk Power Down Mode	Unter dieser Option wird der Energiesparmodus für die Festplatte festgelegt.	Disabled	Kein Ausschalten des Bildschirms.
		Standby	Bildschirm geht in Standby Modus.
		Suspend	Bildschirm geht in Suspend Modus.
Keyboard & PS/2 Mouse	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Keyboard oder der PS/2 Mouse kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
FDC/LPT/COM Ports	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am Parallel Port, dem Serial 1&2 Port oder dem Floppy Port kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Primary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.

Tabelle 184: GM45 Power Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Secondary Master IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Secondary Slave IDE	Hier kann die Überwachung von Aktivitäten während des Stromsparmodus festgelegt werden.	MONITOR	Bei Aktivitäten am IRQ des jeweiligen Anschlusses bzw. Gerätes kehrt das System aus dem jeweiligen Stromsparmodus in den Normalzustand zurück.
		IGNORE	Aktivitäten werden ignoriert.
Resume On Ring	Bei einem eingehenden Anruf am Modem wird der PC aus dem Stromsparmodus geholt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On PME#	Unter dieser Option können Sie die PME Weckfunktion ein- bzw. ausschalten.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Resume On RTC Alarm	Unter dieser Option können Sie den Alarm aktivieren und Datum und Uhrzeit für den Systemstart eingeben.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Power Button Mode	Diese Funktion legt fest, welche Funktion der Power Taster haben soll.	On/Off	Power Taster schaltet Ein/Aus.
		Suspend	Unterdrückt die Funktion.

Tabelle 184: GM45 Power Menü Einstellmöglichkeiten

1.8 Exit

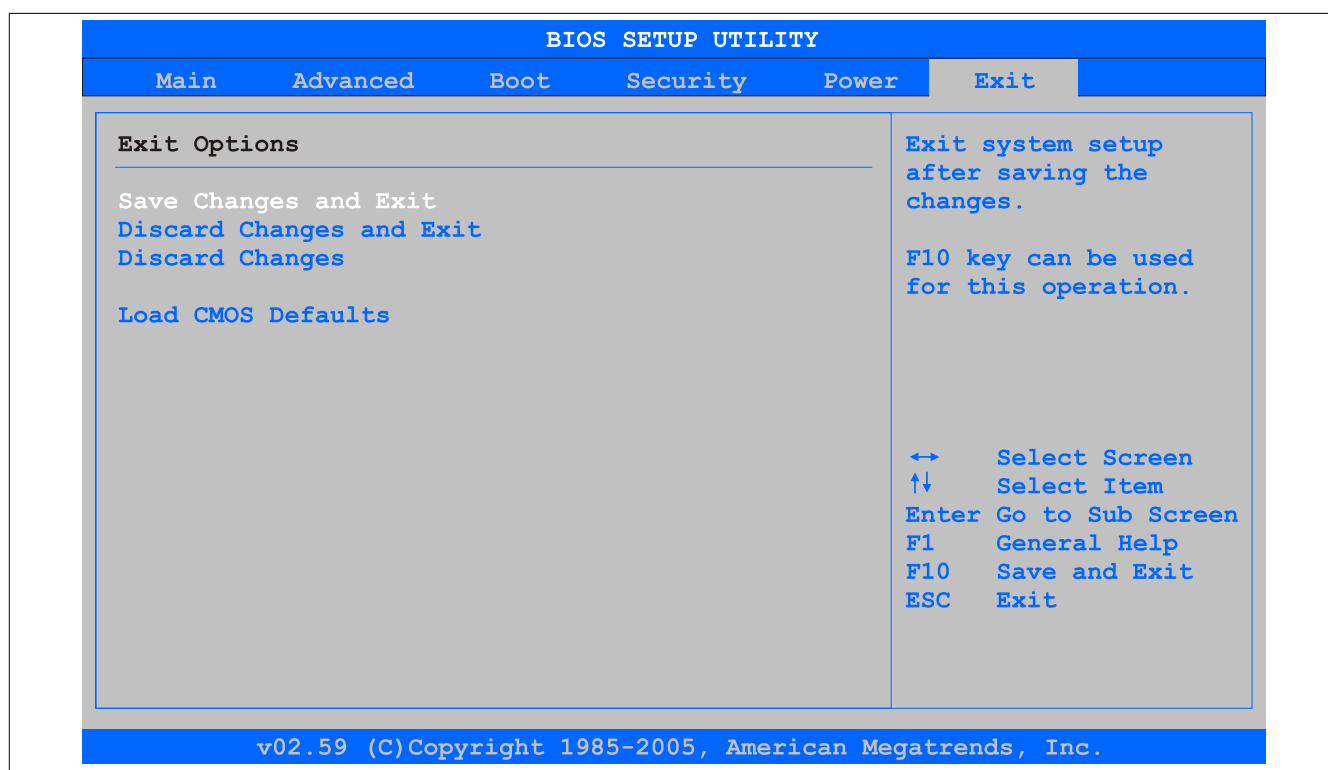


Abbildung 128: GM45 Exit Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Save Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes and Exit	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Das System wird zusätzlich rebootet.	OK / Cancel	
Discard Changes	Wurden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche, so können diese (sofern sie nicht schon gespeichert wurden) wieder zurückgesetzt werden.	OK / Cancel	
Load CMOS Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der DIP Switch Stellungen definierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	

Tabelle 185: GM45 Exit Menü Einstellmöglichkeiten

1.9 BIOS Defaulteinstellungen

Mit Hilfe des CMOS Profile Hex Schalters lassen sich je nach Stellung vordefinierte BIOS Profileinstellungen laden.

Information:

Die bei der Lieferung eingestellte Position des Schalters stellt die optimalen BIOS Defaultwerte für dieses System dar und sollte daher nicht geändert werden.

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion „Load Setup Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenü „Exit“ oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

Profilnummer	Optimiert für	Schalterstellung	Anmerkung
Profil 0	Reserviert	0	
Profil 1	Systemeinheit 5PC810.SX01-00 / 5PC810.SX02-00 / 5PC810.SX03-00	1	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im APC810 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 2	Systemeinheit 5PC810.SX05-00	2	
Profil 3	Systemeinheit 5PC820.SX01-00 / 5PC820.SX01-01	3	Die Defaulteinstellungen für dieses Profil befinden sich im APC820 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.
Profil 4	Reserviert	4	
Profil 5	Systemeinheit 5PC820.1505-00 / 5PC820.1906-00	5	Die Defaulteinstellungen für diese Profile befinden sich im PPC800 Anwenderhandbuch. Dieses kann kostenlos von der B&R Homepage heruntergeladen werden.

Tabelle 186: Profilübersicht

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die BIOS Defaulteinstellungen abhängig von der CMOS Profil Schalterstellung. Gelb eingefärbte Einstellungen stellen die Abweichungen zum BIOS Defaultprofil (=Profil 0) dar.

1.9.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
System Time	-	-	-	
System Date	-	-	-	
BIOS ID	-	-	-	
Prozessor	-	-	-	
CPU Frequency	-	-	-	
System Memory	-	-	-	
Product Revision	-	-	-	
Serial Number	-	-	-	
BC Firmware Rev.	-	-	-	
MAC Address (ETH1)	-	-	-	
Boot Counter	-	-	-	
Running Time	-	-	-	

Tabelle 187: GM45 Main Profileinstellungsübersicht

1.9.2 Advanced

ACPI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
ACPI Aware O/S	Yes	Yes	Yes	
ACPI Version Features	ACPI v2.0	ACPI v2.0	ACPI v2.0	
ACPI APIC support	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend mode	S1 (POS)	S1 (POS)	S1 (POS)	
USB Device Wakeup from S3/S4	Disabled	Disabled	Disabled	
Active Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Passive Cooling Trip Point	Disabled	Disabled	Disabled	
Critical Trip Point	105°C	105°C	105°C	

Tabelle 188: GM45 Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht

PCI Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Plug & Play O/S	No	Yes	Yes	
PCI Latency Timer	64	64	64	
Allocate IRQ to PCI VGA	Yes	Yes	Yes	
Allocate IRQ to SMBUS HC	Yes	Yes	Yes	
PCI IRQ Resource Exclusion				
IRQ3	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ4	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ5	Available	Available	Available	
IRQ6	Available	Available	Available	
IRQ7	Available	Available	Available	
IRQ9	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ10	Available	Available	Available	
IRQ11	Available	Available	Available	
IRQ12	Available	Available	Available	
IRQ14	Allocated	Allocated	Allocated	
IRQ15	Allocated	Allocated	Allocated	
PCI Interrupt Routing				
PIRQ A (VGA,UHCI2,PCIE0, ETH2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ B (PCIE1,HDA,ETH1)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ C (PCIE2)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ D (UHCI1,PCIE3, SATA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ E (INTD,UHCI3,PATA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ F (INTA)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ G (INTB)	Auto	Auto	Auto	
PIRQ H (INTC,UHCI0, EHCI0)	Auto	Auto	Auto	
1st Exclusive PCI	-	-	-	
2nd Exclusive PCI	-	-	-	

Tabelle 189: GM45 Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht

PCI Express Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Active State Power-Management	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 0	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 1	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 2 (IF-Slot)	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 3	Auto	Auto	Auto	
PCIE Port 4 (ETH2)	Auto	Auto	Auto	
PCIE High Priority Port	Disabled	Disabled	Disabled	
Res. PCIE Hotplug Resource	No	No	No	
PCIE Port 0 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 1 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 2 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	
PCIE Port 3 IOxAPIC Enable	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 190: GM45 Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht

Graphics Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Primary Video Device	Internal VGA	Internal VGA	Internal VGA	
Internal Graphics Mode Select	Enabled, 32MB	Enabled, 32MB	Enabled, 32MB	
DVMT Memory	256MB	256MB	256MB	
Boot Display Device	Auto	Auto	Auto	
Boot Display Preference	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	SDVO-B SDVO-C LFP	
Always Try Auto Panel Detect	No	No	No	
Local Flat Panel Type	Auto	Auto	Auto	
SDVO Local Flat Panel Type	Disabled	Disabled	Disabled	
Local Flat Panel Scaling	Centering	Centering	Centering	
SDVO Port B Configuration	SDVO DVI	SDVO DVI	SDVO DVI	
SDVO Port C Configuration	SDVO DVI	SDVO DVI	SDVO DVI	
SDVO/DVI Hotplug Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Display Mode Persistence	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 191: GM45 Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht

CPU Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
MPS Revision	1.4	1.4	1.4	
Max CPUID Value Limit	Disabled	Disabled	Disabled	
Intel(R) Virtualization Tech	Enabled	Enabled	Enabled	
Execute-Disable Bit Capability	Enabled	Enabled	Enabled	
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Enabled	Enabled	Enabled	
Intel(R) C-State Tech.	Disabled	Disabled	Disabled	
Enhanced C-States	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 192: GM45 Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht

Chipset Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
DRAM Refresh Rate	Auto	Auto	Auto	
Memory Hole	Disabled	Disabled	Disabled	
DIMM Thermal Control	Disabled	Disabled	Disabled	
TMRC Mode	Disabled	Disabled	Disabled	
TS on DIMM	Disabled	Disabled	Disabled	
High Precision Event Timer	Disabled	Disabled	Disabled	
IOAPIC	Enabled	Enabled	Enabled	
APIC ACPI SCI IRQ	Disabled	Disabled	Disabled	
POST Code Output	PCI	PCI	PCI	

Tabelle 193: GM45 Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht

I/O Interface Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
HDA Controller	Disabled	Disabled	Disabled	
Onboard Gbe Controller (ETH1)	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 194: GM45 Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht

Clock Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Spread Spectrum	Disabled	Disabled	Disabled	

Tabelle 195: GM45 Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht

IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
SATA Port 0/1	Compatible	Compatible	Compatible	
SATA Port 2/3 (opt. PATA Port)	Enabled	Enabled	Enabled	
PATA Detection Time Out (Sec)	3	3	3	
Hard Disk Write Protect	Disabled	Disabled	Disabled	
IDE Detect Time Out (Sec)	35	35	35	
Primary IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Secondary IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Third IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	

Tabelle 196: GM45 Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	
Fourth IDE Master				
Type	Auto	Auto	Auto	
LBA/Large Mode	Auto	Auto	Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Auto	Auto	
PIO Mode	Auto	Auto	Auto	
DMA Mode	Auto	Auto	Auto	
S.M.A.R.T.	Auto	Auto	Auto	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 196: GM45 Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
USB Function	8 USB Ports	8 USB Ports	8 USB Ports	
USB 2.0 Controller	Enabled	Enabled	Enabled	
Legacy USB Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Legacy POST-Always	-	-	-	
USB Keyboard Legacy Support	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Mouse Legacy Support	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Storage Device Support	Enabled	Enabled	Enabled	
Port 64/60 Emulation	Disabled	Disabled	Disabled	
USB 2.0 Controller Mode	HiSpeed	HiSpeed	HiSpeed	
BIOS EHCI Hand-Off	Disabled	Disabled	Disabled	
USB Beep Message	Enabled	Enabled	Enabled	
USB Stick Default Emulation	Hard Disk	Hard Disk	Hard Disk	
USB Mass Storage Reset Delay	20 Sec	20 Sec	20 Sec	

Tabelle 197: GM45 Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

Keyboard/Mouse Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Bootup Num-Lock	On	On	On	
Typematic Rate	Fast	Fast	Fast	

Tabelle 198: GM45 Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht

CPU Board Monitor

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
H/W Health Function	Enabled	Enabled	Enabled	

Tabelle 199: GM45 Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht

Baseboard/Panel Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Panel Control				
Select Panel Number	-	-	-	
Version	-	-	-	
Brightness	100%	100%	100%	
Temperature	-	-	-	
Fan Speed	-	-	-	
Keys/Leds	-	-	-	
Baseboard Monitor				
CMOS Battery	-	-	-	
Board I/O	-	-	-	
Board ETH2	-	-	-	
Board Power	-	-	-	
Power Supply	-	-	-	
Slide-In Drive 1	-	-	-	
Slide-In Drive 2	-	-	-	
ETH2 Controller	-	-	-	
Case 1	-	-	-	
Case 2	-	-	-	

Tabelle 200: GM45 Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Case 3	-	-	-	
Case 4	-	-	-	
Legacy Devices				
COM A	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	3F8	3F8	3F8	
Interrupt	IRQ4	IRQ4	IRQ4	
COM B	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	2F8	2F8	2F8	
Interrupt	IRQ3	IRQ3	IRQ3	
COM C	Enabled	Disabled	Disabled	
Base I/O address	3E8	-	-	
Interrupt	IRQ11	-	-	
COM D	Disabled	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	-	
Interrupt	-	-	-	
COM E	Disabled	Disabled	Disabled	
Base I/O address	-	-	-	
Interrupt	-	-	-	
CAN	Disabled	Disabled	Disabled	
Hardware Security Key	Enabled	Enabled	Enabled	
Base I/O address	378	378	378	
ETH2 LAN Controller	Enabled	Enabled	Enabled	
ETH2 MAC Adress	-	-	-	

Tabelle 200: GM45 Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht

1.9.3 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Boot Priority Selection	Type Based	Type Based	Type Based	
1st Boot Device	Onboard LAN	Primary Master	Primary Master	
2nd Boot Device	Primary Master	Secondary Master	Secondary Master	
3rd Boot Device	Primary Slave	USB Floppy	USB Floppy	
4th Boot Device	USB Floppy	USB Removable Device	USB Removable Device	
5th Boot Device	USB Removable Device	USB Harddisk	USB Harddisk	
6th Boot Device	USB CDROM	USB CDROM	USB CDROM	
7th Boot Device	Fourth Master	Fourth Master	Fourth Master	
8th Boot Device	Disabled	Disabled	Disabled	
Quick Boot	Enabled	Enabled	Enabled	
Quiet Boot	Disabled	Disabled	Disabled	
Automatic Boot List Retry	Disabled	Disabled	Disabled	
Add-on ROM Display Mode	Keep Current	Keep Current	Keep Current	
Halt On Error	Disabled	Disabled	Disabled	
Hit „DEL“ Message Display	Enabled	Enabled	Enabled	
Interrupt 19 Capture	Disabled	Disabled	Disabled	
PXE Boot to LAN	Enabled	Disabled	Disabled	
Slide-In 2 Option ROM	Enabled	Disabled	Enabled	
Power Loss Control	Turn On	Turn On	Turn On	

Tabelle 201: GM45 Main Profileinstellungsübersicht

1.9.4 Security

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Supervisor Password	-	-	-	
User Password	-	-	-	
Boot Sector Virus Protection	Disabled	Disabled	Disabled	
Ask HDD Password on Every Boot	No	No	No	
Hard Disk Security User Password	-	-	-	
Hard Disk Security Master Password	-	-	-	

Tabelle 202: GM45 Security Profileinstellungsübersicht

1.9.5 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Power Management/APM	Enabled	Enabled	Enabled	
Suspend Time Out	Disabled	Disabled	Disabled	
Video Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Hard Disk Power Down Mode	Suspend	Suspend	Suspend	
Keyboard & PS/2 Mouse	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
FDC/LPT/COM Ports	MONITOR	MONITOR	MONITOR	

Tabelle 203: GM45 Power Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Profil 1	Profil 2	Meine Einstellung
Primary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Primary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Master IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Secondary Slave IDE	MONITOR	MONITOR	MONITOR	
Resume On Ring	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On PME#	Disabled	Disabled	Disabled	
Resume On RTC Alarm	Disabled	Disabled	Disabled	
Power Button Mode	On/Off	On/Off	On/Off	

Tabelle 203: GM45 Power Profileinstellungsübersicht

1.10 BIOS Fehlersignale (Beep Codes)

Während des Booten eines B&R Industrie PCs können von Seiten des BIOS folgende Meldungen bzw. Fehler auftreten, die durch verschiedene Piepscodes signalisiert werden.

Piepsintervall	Bedeutung	erforderliche Benutzerreaktion
1x kurz	Speicher - Refresh ausgefallen.	BIOS Default Werte laden. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
2x kurz	Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft).	Den korrekten Sitz der gesteckten Karten überprüfen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
3x kurz	Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
4x kurz	Timer not Operational: System - Timer.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
5x kurz	Prozessor Error: Prozessor defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
6x kurz	8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt (8042- Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected Mode schalten.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
7x kurz	Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert).	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
8x kurz	Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler Fehler).	Bei gesteckter Grafikkarte diese auf korrekten Sitz überprüfen und eventuell austauschen. Falls der Fehler weiter besteht Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
9x kurz	ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt, EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder nicht korrekt updated.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
10x kurz	CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht gelesen/geschrieben werden.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.
11x kurz	Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem Mainboard defekt.	Industrie PC zur Überprüfung an B&R schicken.

Tabelle 204: BIOS Postcode Meldungen BIOS GM45

1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - 384 kB) – TOM ¹⁾	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area ²⁾
(TOM - 128 MB - 384 kB) – (TOM - 384 kB)	N.A.	VGA frame buffer ³⁾
1024 kB – (TOM - 128 MB - 384 kB)	100000h - N.A.	Extended memory
869 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFFh	Runtime BIOS
832 kB – 869 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 205: RAM-Adressbelegung

- 1) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM
 2) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf „YES“ eingestellt ist.
 3) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 32 MB reduziert werden.

1.11.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Ressourcen
0170h - 0177h	Secondary IDE Kanal
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
0238h - 023Fh	COM5
0278h - 027Fh	Hardware Security Key (LPT2)
02E8h - 02EFh	COM4
02F8h - 02FFh	COM2
0376h - 0376h	Secondary IDE Kanal Kommando Port
0377h - 0377h	Secondary IDE Kanal Status Port
0378h - 037Fh	Hardware Security Key (LPT1)
0384h - 0385h	CAN Controller
03B0h - 03DFh	Video System
03E8h - 03EFh	COM3
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
04D0h - 04D1h	Motherboard Ressourcen
0500h - 053Fh	Motherboard Ressourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Ressourcen
0A00h - 0A7Fh	Motherboard Ressourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus ¹⁾
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 206: I/O-Adressbelegung

- 1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Ressourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fähige Geräte dürfen die I/O Ressourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Systemtimer	•																	
Tastatur		•																
IRQ Kaskade			•															
COM1 (Serial port A)				○	•	○	○	○			○	○	○					
COM2 (Serial port B)				•	○	○	○	○			○	○	○					
ACPI ¹⁾										•								
Echtzeituhr									•									
Coprozessor (FPU)														•				
Primär IDE Kanal ²⁾															•			
Secondary IDE Kanal ²⁾																•		
B&R	COM3 (COM C)			○	○	○	○	○			○	○	○					•
	COM4 (COM D)			○	○	○	○	○			○	○	○					•
	COM5 (COM E)			○	○	○	○	○			○	○	○					•
	CAN			○	○	○	○	○			○	○	○				○	•

Tabelle 207: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.
 2) Wird die SATA Configuration im BIOS für alle SARA Ports auf Enhanced Mode gesetzt, werden die IRQ's 14 und 15 für das Systemfreigegeben und die SATA Ports verwenden irgenwelche anderen IRQ's.

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (**A**dvanced **P**rogrammable Interrupt **C**ontroller) Mode stehen insgesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Windows Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NMI	NO-NE
Systemtimer	•																									
Tastatur		•																								
IRQ Kaskade			•																							
COM1 (Serial port A)				○	•	○	○	○			○	○	○													
COM2 (Serial port B)				•	○	○	○	○			○	○	○													
ACPI ¹⁾									•																	
Echtzeituhr									•																	
Coprozessor (FPU)														•												
Primary IDE Kanal ²⁾															•											
Secondary IDE Kanal ²⁾																•										
B&R	COM3 (COM C)			○	○	○	○	○			○	○	○													•
	COM4 (COM D)			○	○	○	○	○			○	○	○													•
	COM5 (COM E)			○	○	○	○	○			○	○	○													•
	CAN			○	○	○	○	○			○	○	○											○		•
PIRQ A ³⁾																•										
PIRQ B ⁴⁾																	•									
PIRQ C ⁵⁾																		•								
PIRQ D ⁶⁾																			•							
PIRQ E ⁷⁾																				•						
PIRQ F ⁸⁾																					•					
PIRQ G ⁹⁾																						•				
PIRQ H ¹⁰⁾																							•			

Tabelle 208: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.
- 2) Wird die SATA Configuration im BIOS für alle SATA Ports auf Enhanced Mode gesetzt, werden die IRQs 14 und 15 für das Systemfreigegeben und die SATA Ports verwenden irgenwelche anderen IRQ's.
- 3) PIRQ A: für PCIe; UHCI Host Controller 2, VGA Controller, PCI Express Root Port 0, PCI-EX to SATA Bridge
- 4) PIRQ B: für PCIe; HDA Audio, PCI Express Root Port 1, onboard Gigabit LAN Controller
- 5) PIRQ C: für PCIe; PCI Express Root Port 2
- 6) PIRQ D: für PCIe; UHCI Host Controller 1, Serial ATA Controller 0 + 1 in enhanced/native Modus, PCI Express Root Port 3
- 7) PIRQ E: PCI Bus INTD, UHCI Host Controller 3, EHCI Host Controller 1, SM-Bus Controller
- 8) PIRQ F: PCI Bus INTA
- 9) PIRQ G: PCI Bus INTB
- 10) PIRQ H: PCI Bus INTC, UHCI Host Controller 0, EHCI Host Controller 0

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

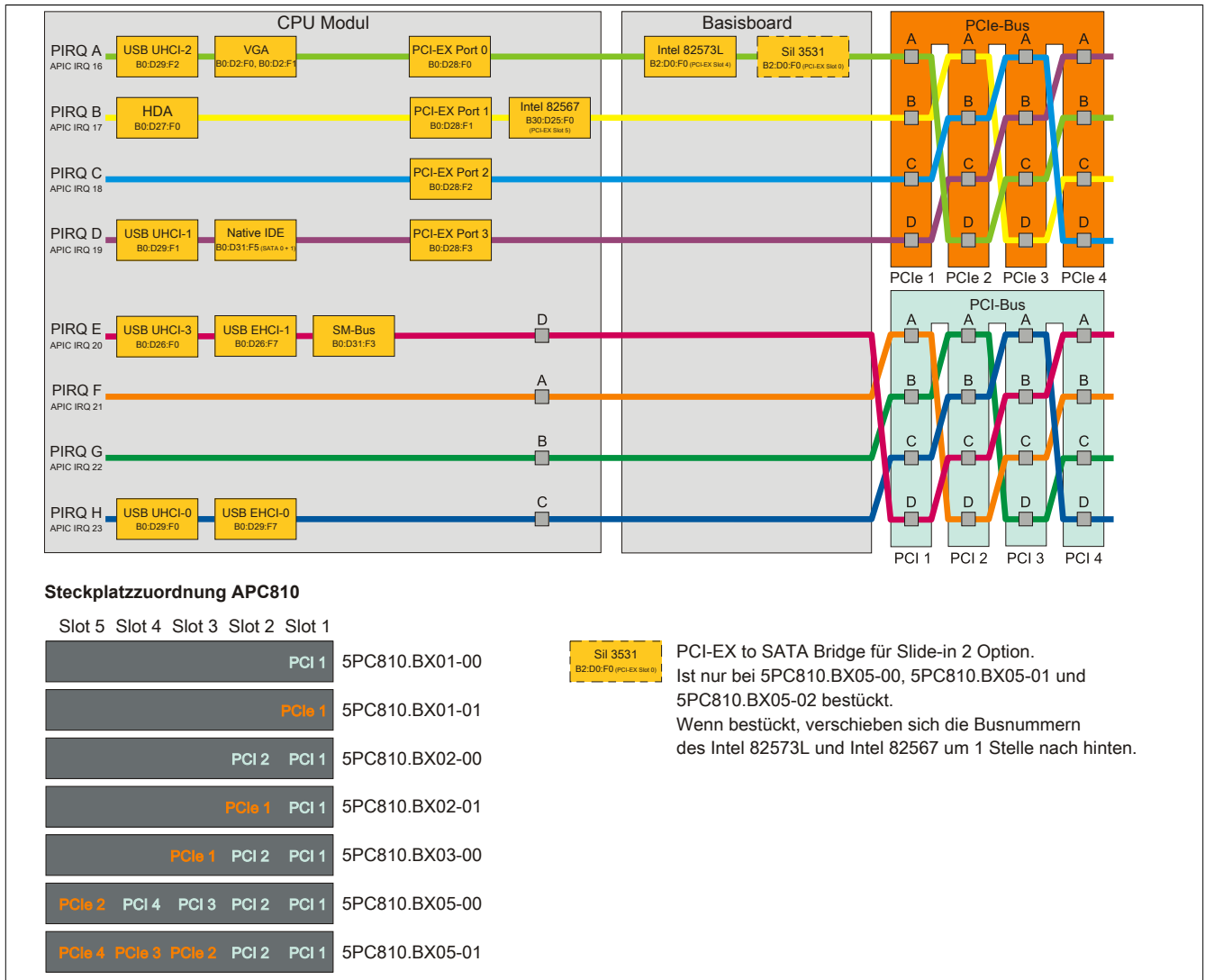


Abbildung 129: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards GM45 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x)

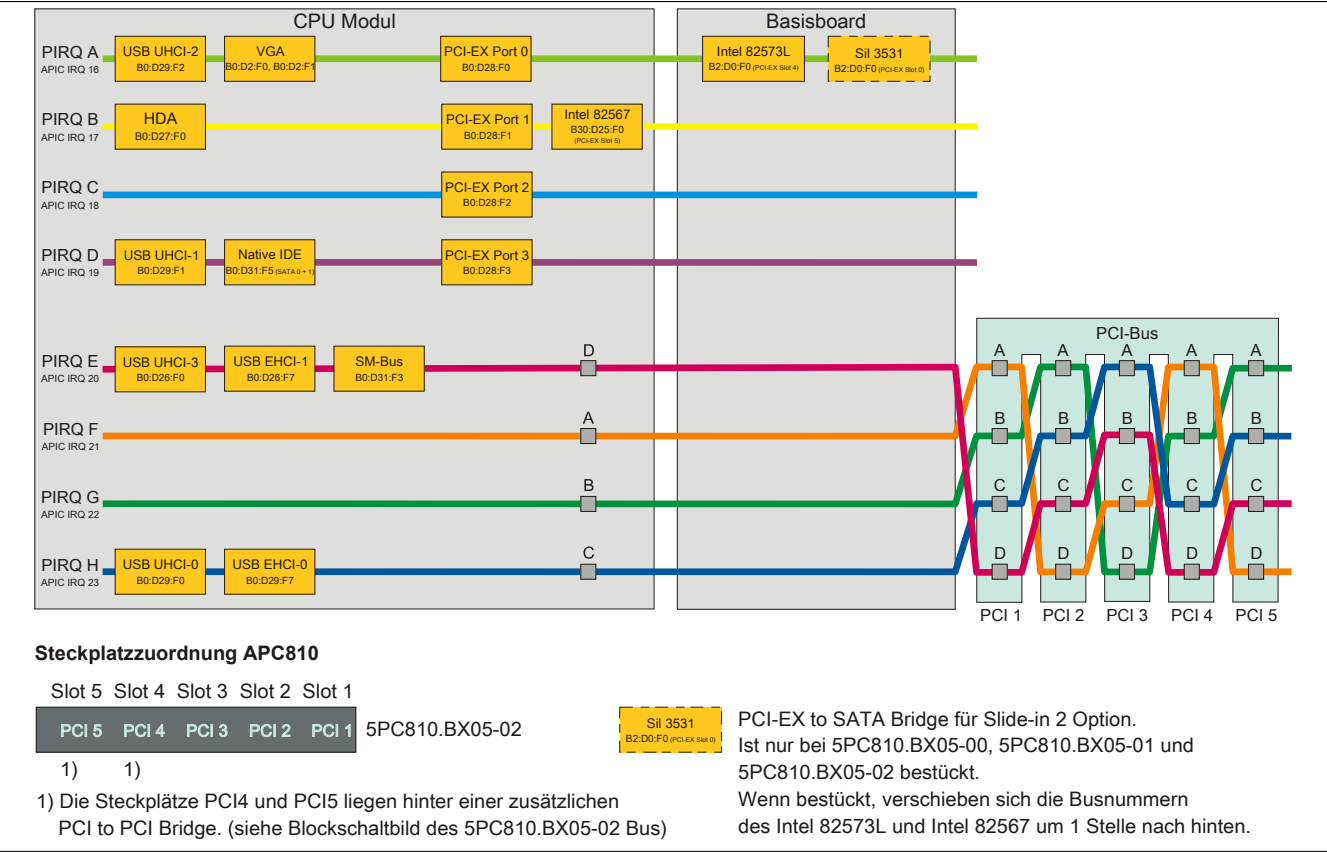


Abbildung 130: PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards GM45 (Buseinheit 5PC810.BX05-02)

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

- Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am APC810 installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit „Entf“ ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „Advanced“ den Unterpunkt „Baseboard/Panel Features“ auswählen.

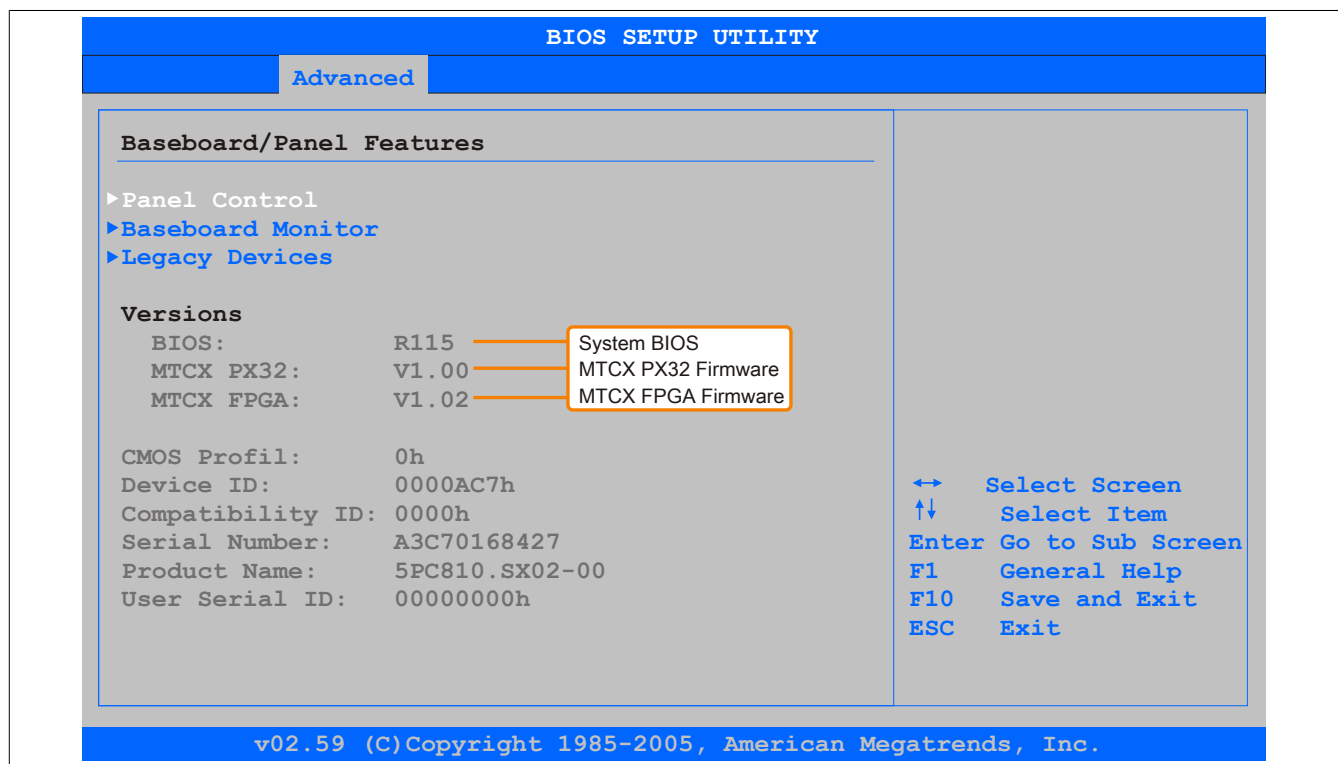


Abbildung 131: Softwareversion

Welche Firmware ist am Automation Panel Link Transmitter installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des APC810 gelangt man mit „Entf“ ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „Advanced“ den Unterpunkt „Baseboard/Panel Features“ und danach den Punkt „Panel Control“ auswählen.

Information:

Die Version kann nur bei angeschlossenem Automation Panel mit AP Link SDL Transmitter (5AC801.SDL0-00) angezeigt werden.

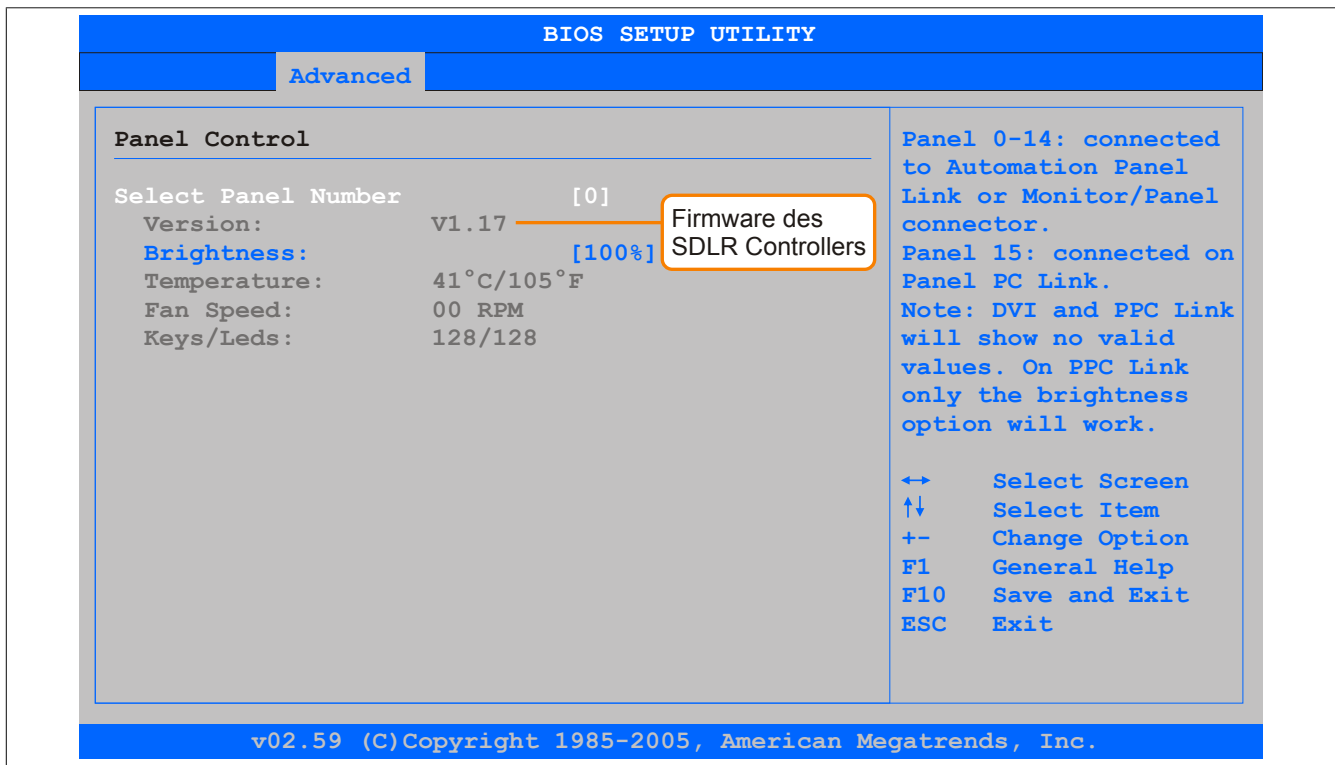


Abbildung 132: Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter

2.1.2 Vorgangsweise mit MS-DOS

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile „sys a:“ oder „format a: /s“ bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 243.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 245.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 246.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

```
1. Upgrade AMI BIOS for BM45 (5PC800.BM45-00, -01)
2. Exit
```

zu Punkt 1:

Das BIOS wird automatisch aktualisiert (Default nach 5 Sekunden).

zu Punkt 2:

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wird automatisch der Punkt 1 „Upgrade AMI BIOS for BM45“ ausgeführt und der APC810 selbstständig aktualisiert.

6. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
7. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

2.1.3 Vorgangsweise mit dem Control Center

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. In der Systemsteuerung das **Control Center** öffnen
3. Die Registerkarte **Versionen** öffnen
4. Unter **CPU Board** bei **BIOS** auf **Update** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.
5. Unter **Dateiname** den Namen der BIOS Datei eingeben oder eine Datei auswählen.
6. Auf **Öffnen** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann abhängig vom verwendeten Speicherbaustein mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Das System muss neu gestartet werden, damit das neue BIOS wirksam wird und die aktualisierte Version angezeigt wird. Beim Beenden des Control Centers, wird eine Aufforderung zum Systemneustart angezeigt.

Information:

Genauere Informationen zum Sichern und Updaten des BIOS ist der Control Center Hilfe zu entnehmen.

2.2 Firmwareupgrade

Mit der „Upgrade APC800 MTCX“ Software ist es möglich, je nach Ausführung des APC810 Systems die Firmware mehrerer Controller (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) zu aktualisieren.

Eine aktuelle „APC800 MTCX Upgrade“ Software kann direkt über den Servicebereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

Um einen Firmwareupgrade durchzuführen, sind folgende Schritte auszuführen:

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. Bootfähiges Medium erstellen.

Information:

Unter MS-DOS, Win95 und Win98 kann eine leere HD Diskette mit der Kommandozeile „sys a:“ oder „format a: /s“ bootfähig gemacht werden.

Informationen zum Erstellen einer Bootdiskette unter Windows XP siehe Seite 243.

Informationen zum Erstellen eines USB Memory Sticks für ein B&R Upgrade siehe Seite 245.

Informationen zum Erstellen einer CompactFlash Karte für ein B&R Upgrade siehe Seite 246.

3. Den Inhalt der *.zip Datei auf das bootfähige Medium kopieren. Falls der B&R Upgrade bereits beim Erstellen mittels B&R Embedded OS Installer hinzugefügt wurde, entfällt dieser Schritt.
4. Das bootfähige Medium am B&R Gerät anstecken und das Gerät neu booten.
5. Nach dem Start gelangt man in folgendes Bootmenü:

Information:

Die nachfolgenden Bootmenüoptionen einschließlich Beschreibung beziehen sich auf die Version 1.00 der APC800 Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, UPSI) Disks. Es kann daher vorkommen, dass diese Beschreibungen nicht mit der vorliegenden Version übereinstimmen.

```

1. Upgrade MTCX (APC810) PX32 and FPGA
2. Upgrade SDLT (APC810) only
3. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on Monitor/Panel
3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)
3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)
3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)
3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)
3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
3.6 Return to Main Menu
4. Upgrade SDLR (AP800/AP900) on AP Link Slot
4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)
4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)
4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)
4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)
4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)
4.6 Return to Main Menu
5. Upgrade Add-on UPS (Firmware and Battery Settings)
5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)
5.2 Upgrade Battery Settings(5AC600.UPSB-00)
5.3 Return to Main Menu
6. Exit

```

zu Punkt 1:

Es wird automatisch der PX32 und FPGA des MTCX aktualisiert (Default nach 5 sec).

zu Punkt 2:

Es wird automatisch der FPGA des SDLT Controllers am AP Link Slot aktualisiert.

zu Punkt 3:

Es wird das Submenü 1 zum Upgrade der SDLR Controller am Monitor/Panel Stecker geöffnet.

3.1 Upgrade SDLR on AP 0 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 0 aktualisiert.

3.2 Upgrade SDLR on AP 1 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 1 aktualisiert.

3.3 Upgrade SDLR on AP 2 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 2 aktualisiert.

3.4 Upgrade SDLR on AP 3 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 3 aktualisiert.

3.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am Monitor/ Panel aktualisiert (Default nach 5 sec).

3.6 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 4:

Es wird das Submenü 2 zum Upgrade der SDLR Controller am AP Link Slot geöffnet.

4.1 Upgrade SDLR on AP 8 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 8 aktualisiert.

4.2 Upgrade SDLR on AP 9 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 9 aktualisiert.

4.3 Upgrade SDLR on AP 10 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 10 aktualisiert.

4.4 Upgrade SDLR on AP 11 (AP800/AP900)

Es wird automatisch der SDLR Controller auf Automation Panel 11 aktualisiert.

4.5 Upgrade all SDLR (AP800/AP900)

Es werden automatisch alle SDLR Controller auf allen Automation Panels am AP Link Slot aktualisiert (Default nach 5 sec).

4.6 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 5:

Es wird das Submenü 3 zum Upgrade der Add-on UPS Firmware und Upgrade der Batterie Settings geöffnet.

5.1 Upgrade Add-on UPS Firmware (5AC600.UPSI-00)

Es wird automatisch die Firmware der Add-on UPSI aktualisiert.

5.2 Upgrade Battery Settings (5AC600.UPSB-00)

Es werden automatisch die Battery Settings für 5AC600.UPSB-00 aktualisiert.

5.3 Return to Main Menu

Zurück ins Hauptmenü

zu Punkt 6:

Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

Information:

Nach erfolgreichem Upgrade muss ein Power Off/On des Systems durchgeführt werden.

2.2.2 Mögliche Upgradeprobleme und Softwareabhängigkeiten (für V1.00)

- Ein Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenem Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) möglich.
- Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 dürfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware größer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.
- Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfähig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betätigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/ On durchgeführt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.
- Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.

2.3 MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP

1. Eine leere 1,44MB HDD Diskette in das Diskettenlaufwerk stecken
2. Windows Explorer öffnen
3. Mit der rechten Maustaste auf das 3½-Diskettenlaufwerk Symbol klicken und den Punkt „Formatieren...“ auswählen.

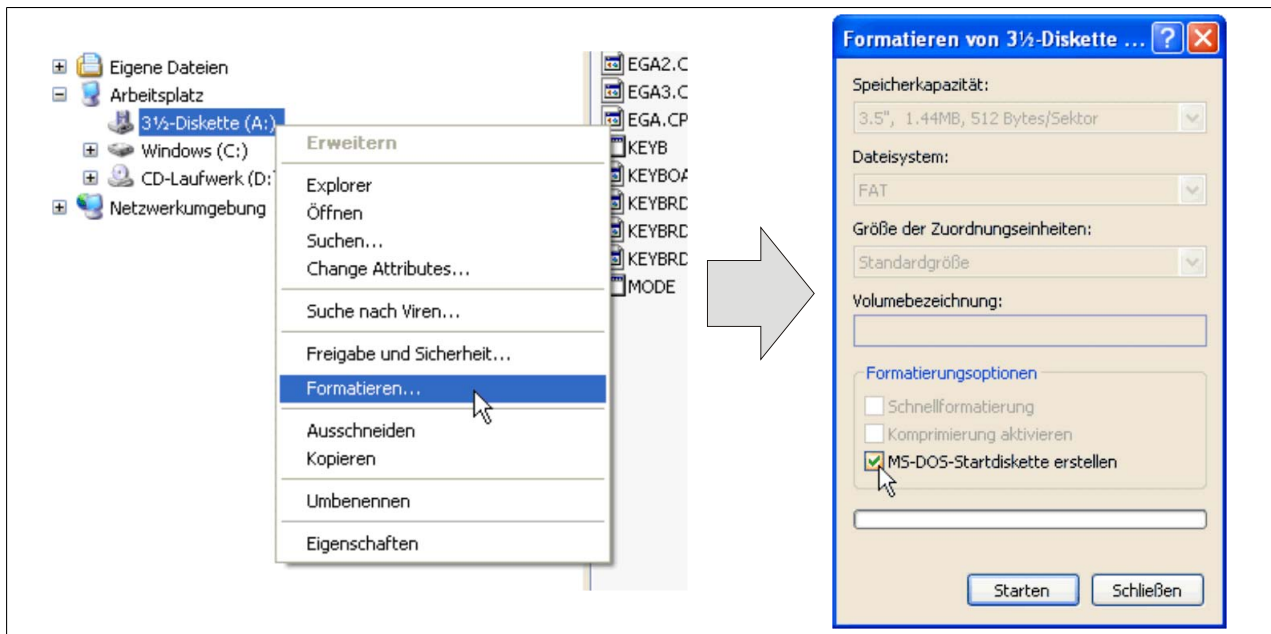


Abbildung 133: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1

4. Danach die Checkbox „**MS-DOS-Startdiskette erstellen**“ anhaken, „**Starten**“ drücken und die nachfolgende Warnmeldung mit „OK“ bestätigen.



Abbildung 134: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2



Abbildung 135: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3

Nach der Erstellung der Startdiskette müssen nun nachträglich einige Dateien dieser Diskette gelöscht werden, da dies wegen der Größe der Updates erforderlich ist.

Dazu müssen alle Dateien (versteckte Systemdateien,...) auf der Diskette angezeigt werden.

Im Explorer- Menüpunkt „Extras“ die Option „Ordneroptionen...“, Registerkarte „Ansicht“, Punkt „Geschützte Systemdateien“ ausblenden (empfohlen) (ist standardmäßig aktiviert) nun deaktivieren und den Punkt „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ aktivieren.

Vorher				Nachher			
Name	Größe	Typ	Geändert am	Name	Größe	Typ	Geändert am
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS	04.10.2004 15:14
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00	DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00	KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00	KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
				MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
				MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 136: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4

Name	Größe	Typ	Geändert am
AUTOEXEC	1 KB	Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS	04.10.2004 15:14
COMMAND	91 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
CONFIG	1 KB	Systemdatei	04.10.2004 15:14
DISPLAY	17 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
EGA2.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA3.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
EGA.CPI	58 KB	CPI-Datei	08.06.2000 17:00
IO	114 KB	Systemdatei	15.05.2001 18:57
KEYB	22 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
KEYBOARD	34 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD2	32 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD3	31 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
KEYBRD4	13 KB	Systemdatei	08.06.2000 17:00
MODE	29 KB	Anwendung für MS-DOS	08.06.2000 17:00
MSDOS	1 KB	Systemdatei	07.04.2001 13:40

Abbildung 137: Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5

Es können nun alle Dateien (markiert) bis auf Command.com, IO.sys und MSDOS.sys gelöscht werden.

2.4 So erstellen Sie einen bootfähigen USB Memory Stick für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen USB Memory Sticks ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss der USB Memory Stick speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.4.1 Was wird benötigt

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen eines bootfähigen USB Memory Sticks benötigt:

- B&R USB Memory Stick
- B&R Industrie PC
- USB Media Drive
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.00)

2.4.2 Vorgangsweise

1. Verbinden des USB-Memorysticks mit dem PC.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren des USB-Memorysticks in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf einen USB-Memorystick installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

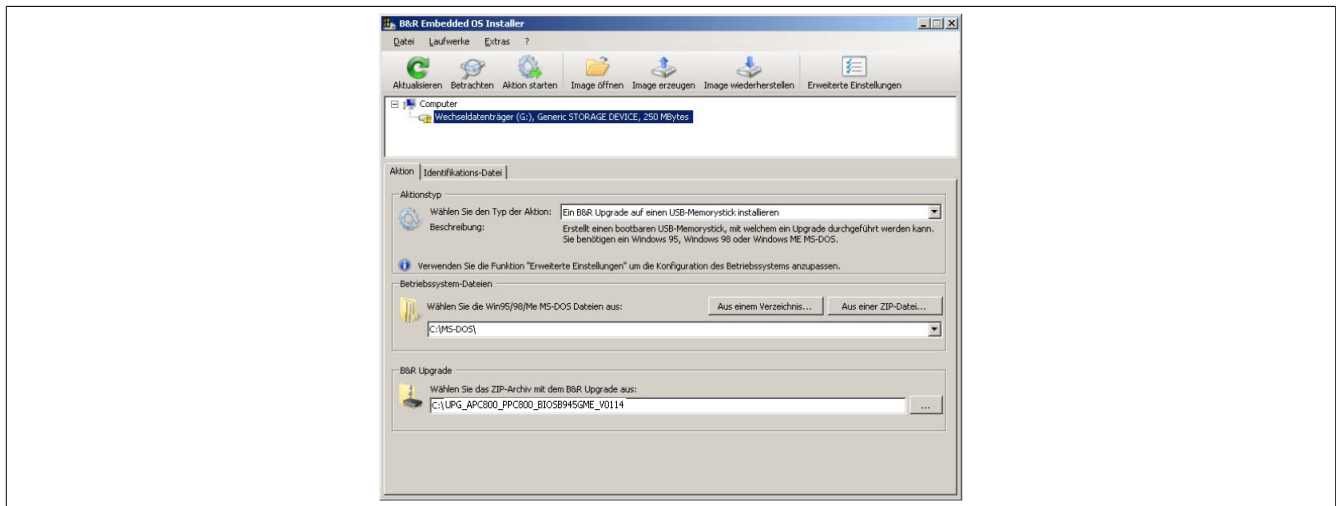


Abbildung 138: Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files

2.4.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 243 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.5 So erstellen Sie eine bootfähige CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

Von den bei B&R erhältlichen CompactFlash Karten ist es möglich in Verbindung mit einem B&R Industrie PC ein Upgrade (z.B. BIOS Upgrade) durchzuführen. Dazu muss die CompactFlash Karte speziell vorbereitet werden. Dies erfolgt mit dem B&R Embedded OS Installer, welcher von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden kann.

2.5.1 Was wird benötigt?

Folgende Peripherie wird für das Erzeugen einer bootfähigen CompactFlash benötigt:

- CompactFlash Karte
- B&R Industrie PC
- B&R Embedded OS Installer (mindestens V3.10)

2.5.2 Vorgangsweise

1. Einstecken der CompactFlash Karte in den CF-Slot des Industrie PCs.
2. Falls die Laufwerksliste nicht automatisch aktualisiert wird, muss die Liste mit dem Befehl **Laufwerke > Aktualisieren** aktualisiert werden.
3. Markieren der CompactFlash Karte in der Laufwerksliste.
4. Wechseln auf die Registerkarte **Aktion** und als Aktionstyp **Ein B&R Upgrade auf eine CompactFlash Karte installieren** auswählen.
5. Den Pfad zu den MS-DOS Betriebssystemdateien angeben. Wenn die Dateien Teil eines ZIP-Archivs sind, auf die Schaltfläche **Aus einer ZIP-Datei...** klicken. Falls die Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert sind, auf die Schaltfläche **Aus einem Verzeichnis...** klicken.
6. In die Textbox **B&R Upgrade** kann optional der Pfad zur ZIP-Datei der B&R Upgrade Disk angegeben und die Datei ausgewählt werden.
7. In der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktion starten** klicken.

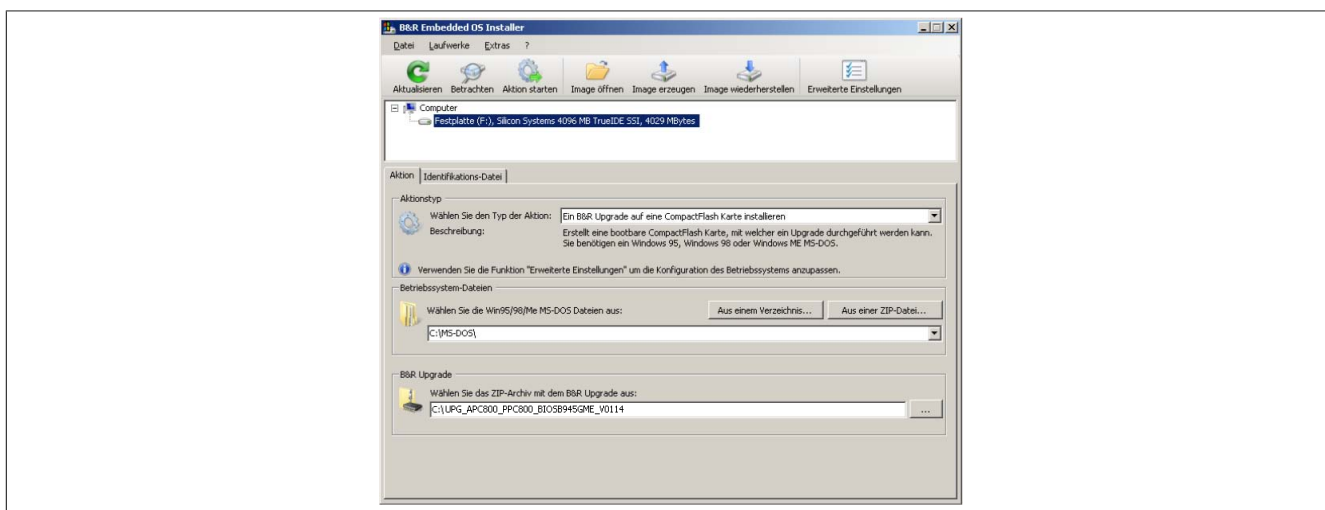


Abbildung 139: Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files

2.5.3 Woher bekomme ich MS-DOS?

Das Erstellen einer MS-DOS Bootdiskette kann im Abschnitt siehe "MS-DOS Bootdiskette erstellen unter Windows XP" auf Seite 243 nachgelesen werden. Abschließend sind die Dateien von der Diskette auf die Festplatte zu kopieren.

2.6 Upgradeprobleme

Mögliche Upgradeprobleme können in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade Disks nachgelesen werden.

3 Microsoft DOS

3.1 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	MS-DOS	
9S0000.01-010	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Deutsch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	 DOS622 Deutsch Diskette 1- Setup Recovery Diskette Darf nur für Backup oder Archivierungszwecke für B&R Automatisierungsgeräte verwendet werden! www.br-automation.com <small>© 1983-2000 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.</small>
9S0000.01-020	OEM Microsoft MS-DOS 6.22, Englisch Disketten, Lieferung nur in Verbindung mit einem neuen PC.	

Tabelle 209: 9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten

3.2 Bekannte Probleme

Für folgende Hardwarekomponenten stehen keine Treiber zur Verfügung oder sind mit Einschränkungen zu rechnen:

- AC97 Sound - keine Unterstützung
- USB 2.0 - es kann nur USB 1.1 Geschwindigkeit erreicht werden.
- Ein zweiter Grafikstrang und somit der Erweiterte Desktop Modus kann nicht genutzt werden.
- Einige „ACPI Control“ Funktionen des BIOS können nicht verwendet werden.

3.3 Auflösungen und Farbtiefe

Die nachfolgende Tabelle zeigt die getesteten Auflösungen und Farbtiefen am Monitor / Panel Stecker mit 945GME CPU Boards.

Auflösungen bei DVI	Farbtiefe		
	8 Bit	16 Bit	24 Bit
640 x 480	✓	✓	✓
800 x 600	✓	✓	✓
1024 x 768	✓	✓	✓
1280 x 1024	✓	✓	✓

Tabelle 210: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen

Auflösungen bei RGB	Farbtiefe		
	8 Bit	16 Bit	24 Bit
640 x 480	✓	✓	✓
800 x 600	✓	✓	✓
1024 x 768	✓	✓	✓
1280 x 1024	✓	✓	✓
1600 x 1200	✓	✓	✓
1920 x 1440	✓	✓	✓

Tabelle 211: Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen

4 Windows XP Professional

4.1 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0500-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0500-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWXP.0500-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 2c, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 212: 5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten

4.2 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilanguage	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-ENG	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-GER	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWXP.0500-MUL	Professional	APC620 APC810 APC820 PPC700 PPC725 PPC800	945GME GM45	SP2c	Multilanguage	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

4.3 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

4.3.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05

Um Windows XP Professional auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des RAID-Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
5. Die Taste „s“ drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. „Enter“ drücken und den Treiber auswählen.
6. Den Setup Anweisungen folgen.
7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810 neu.

4.3.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Si3531 SATA Treibers von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Dateien auf eine Diskette kopieren.
2. Das Media Drive (5MD900.USB2-01 oder 5MD900.USB2-00) an die USB-Schnittstelle anstecken.
3. Diskette und Windows XP Professional CD in das Media Drive einlegen und von der CD booten.
4. Im Setup die Taste F6 drücken, um ein Dritthersteller SCSI oder einen Treiber zu installieren.
5. Die Taste „s“ drücken, wenn gefragt wird ob ein zusätzliches Laufwerk installiert werden soll. Die Diskette in das Floppy Laufwerk stecken. „Enter“ drücken und den Treiber auswählen.
6. Den Setup Anweisungen folgen.
7. Das Setup kopiert die Dateien in den Windows XP Professional Ordner und startet den Automation PC 810 neu.

Information:

- **Nicht alle USB-FDD Laufwerke werden vom Windows XP Setup unterstützt (siehe Microsoft KB 916196).**
- **Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.**

4.4 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich (Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows 7

5.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Die 64 Bit Varianten nutzen die aktuelle PC Infrastruktur voll aus. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7	
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1200-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1400-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 64-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 213: 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.0200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Englisch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.1200-ENG	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.0200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Deutsch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.1200-GER	Professional	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Deutsch	auf Wunsch	20 GByte	2 GByte
5SWWI7.0400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76		64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	20 GByte ¹⁾	2 GByte
5SWWI7.1400-MUL	Ultimate	APC810 APC910 PPC800	945GME Intel® Core™2 Duo GM45 QM77/HM76	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	20 GByte ¹⁾	2 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.4.1 Installation auf PCI SATA RAID Controller - 5ACPCI.RAIC-03, 5ACPCI.RAIC-05

Um Windows 7 auf dem PCI SATA RAID Controller zu installieren, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Raid-Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.
2. Mit Windows 7 DVD booten.
3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
5. Auf „Treiber laden“ klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
6. Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

5.4.2 Besonderheit 5PCI Slot Variante

Bei der Installation auf eine Slide-in HDD, welche im Slide-in Slot 2 (liegt hinter der PCI to SATA Bridge) des APC810 betrieben wird, sind folgende Schritte notwendig:

1. Herunterladen des Sil3531 SATA Treibers für Windows 7 von der B&R Homepage www.br-automation.com und die Daten auf ein Verzeichnis eines USB Memory Sticks kopieren.

2. Mit Windows7 DVD booten.
3. Den Installationsdialogen folgen bis der Dialog "Wo möchten Sie Windows installieren?" angezeigt wird.
4. Den USB Memory Stick mit den RAID Treibern an einen freien USB-Port anstecken.
5. Auf „Treiber laden“ klicken, und mit dem Durchsuchen Button auf das Verzeichnis mit den RAID-Treibern gehen. Anschließend auf Weiter klicken.
6. Den USB Memory Stick entfernen.
7. Nun kann die Windows 7 Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

Information:

Abhängig vom System muss evtl. die Bootreihenfolge im BIOS angepasst werden.

5.5 Eigenheiten, Einschränkungen

- In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.
- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

5.6 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich (Service - Produktbezogene Downloads - BIOS / Treiber / Updates) der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows Embedded Standard 2009

6.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit CompactFlash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0733-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC810 GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 214: 5SWWXP.0733-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Materialnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0733-ENG	APC810	GM45	Englisch	Ja	1 GByte	256 MByte

6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 7.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
Local Network Bridge	✓

Tabelle 215: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 215: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

6.6.1 Touch Screen Treiber

Sollen Automation Panel 800 bzw. Automation Panel 900 Touch Screen Geräte betrieben werden, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert bzw. im Geräte-Manager die Touch Screen Schnittstelle aktualisiert werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist nur auf einen aktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

7 Windows Embedded Standard 7

7.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.⁴⁾ Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

7.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0533-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
5SWWI7.1533-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0633-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1633-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0733-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
5SWWI7.1733-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1 Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0833-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.1833-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 64-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC810 mit GM45 Chipsatz; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Language Pack DVD	
5SWWI7.1000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Language Pack DVD	
5SWWI7.1900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	
5SWWI7.2000-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 64-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	

Tabelle 216: 5SWWI7.0533-ENG, 5SWWI7.1533-ENG, 5SWWI7.0633-ENG, 5SWWI7.1633-ENG, 5SWWI7.0733-MUL, 5SWWI7.1733-MUL, 5SWWI7.0833-MUL, 5SWWI7.1833-MUL - Bestelldaten

4) 64-Bit Versionen werden nicht von allen Systemen unterstützt

7.3 Übersicht

Materialnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0533-ENG	Embedded	APC810	GM45		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	8 GByte	1 GByte
5SWWI7.1533-ENG	Embedded	APC810	GM45	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0633-ENG	Embedded	APC810	GM45		64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1633-ENG	Embedded	APC810	GM45	SP1	64-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	2 GByte
5SWWI7.0733-MUL	Premium	APC810	GM45		32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	8 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1733-MUL	Premium	APC810	GM45	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.0833-MUL	Premium	APC810	GM45		64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1833-MUL	Premium	APC810	GM45	SP1	64-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	2 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

7.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 7.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
32-Bit und 64-Bit Support	✓	✓
Remote Desktop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
BitLocker	-	✓
AppLocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Windows Touch	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessories	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 217: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

7.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (32-Bit: mind. 8 GByte; 64-Bit: mind. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

7.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

7.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert

oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein „Enhanced Write Filter (EWF)“ oder „File Based Write Filter (FBWF)“ aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

8 Automation Runtime

8.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- Garantiert höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Anwendung hardwareunabhängig
- Anwendungen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- Garantierter Determinismus durch zyklisches Laufzeitsystem
- Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie
- Konfiguration der Prioritäten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz
- Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen
- Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Überschreitung
- Ausnahmebehandlung
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C
- Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusätzlich die erweiterte Automation Bibliothek
- Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder über Funktionsaufrufe

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

8.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Based Runtime	
1A4600.10	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	
1A4600.10-2	B&R Automation Runtime ARwin, ARNC0	
1A4600.10-3	B&R Automation Runtime ARwin+PVIControls inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	
1A4600.10-4	B&R Automation Runtime ARwin+ARNC0+PVIControls	
1A4601.06	B&R Automation Runtime AREmb, inkl. Lizenzaufkleber und Kopierschutz	
1A4601.06-2	B&R Automation Runtime AREmb, ARNC0	

Tabelle 218: 1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06, 1A4601.06-2 - Bestelldaten

8.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 2.7 / AR 2.xx Upgrades.

8.4 Automation Runtime Embedded (AREmb)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das AREmb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

9 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

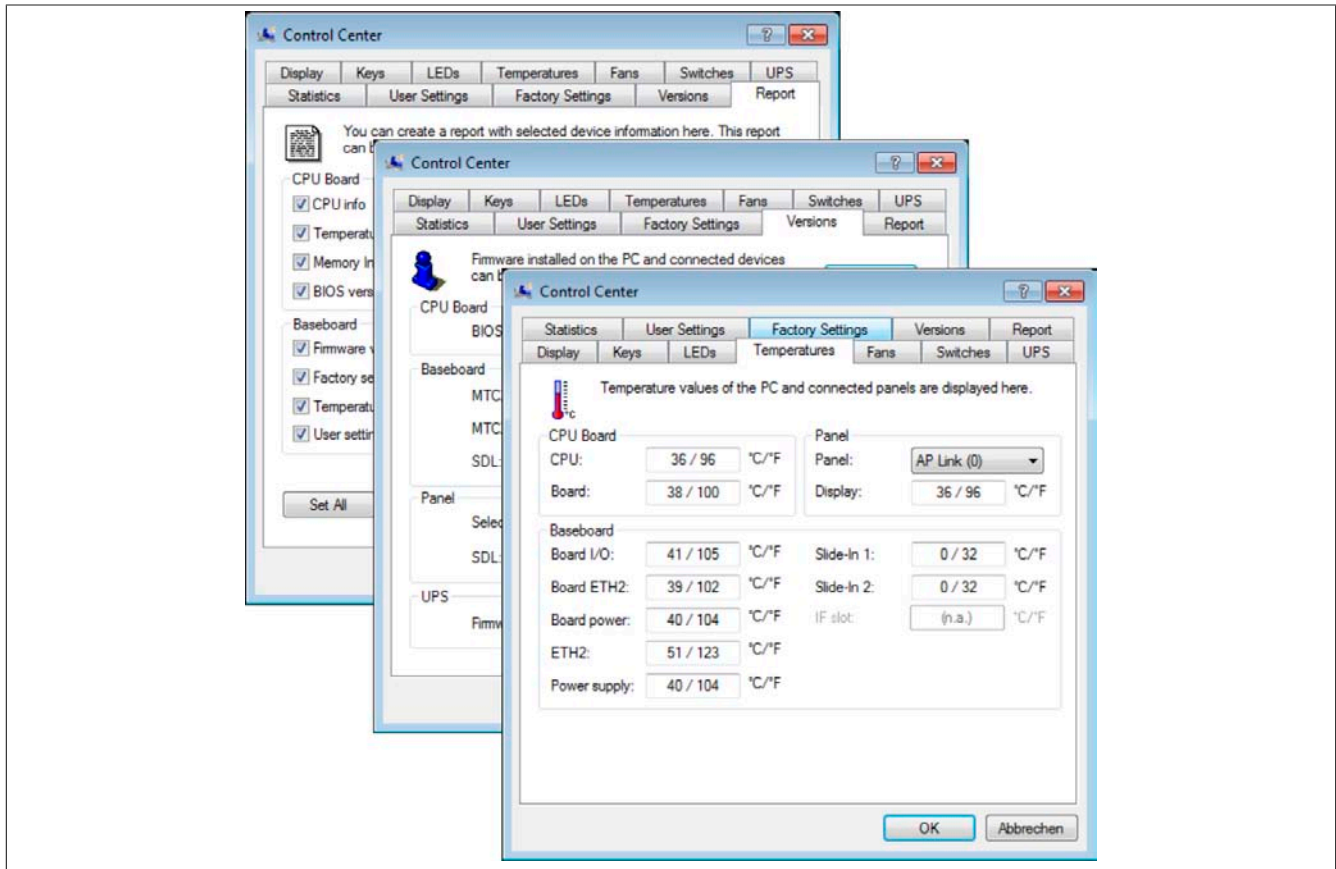


Abbildung 140: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarmer bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

9.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung

- Ändern der User Serial ID

Unterstützt werden folgende Systeme:

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- angeschlossene Automation Panel 800
- angeschlossene Automation Panel 900

9.2 Installation

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
2. Schließen aller Anwendungen
3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

9.3 SDL Equalizer Einstellung

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Die Registerkarte **Display** auswählen
3. Auf **Einstellungen** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt:

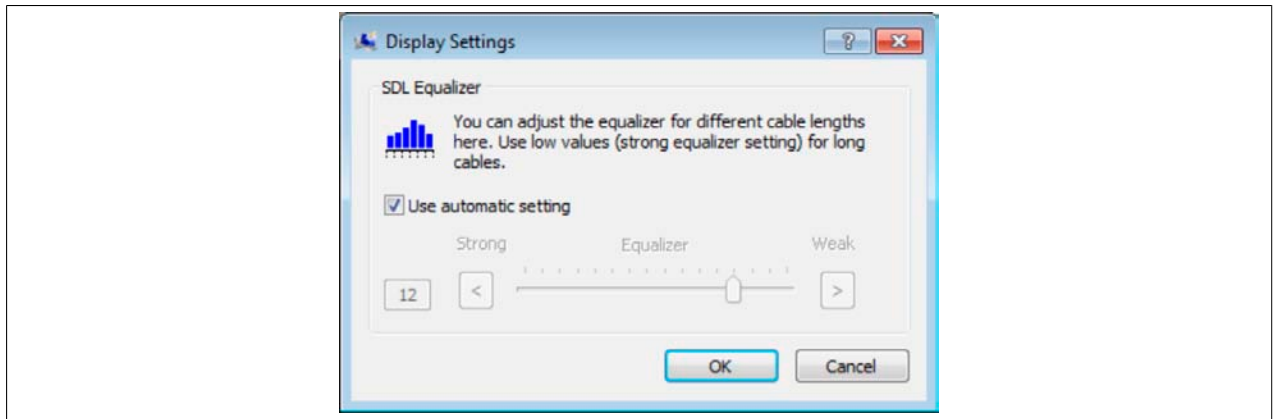


Abbildung 141: ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung

In diesem Dialog können Sie die SDL Equalizereinstellung des Display ändern. Der Equalizer ist im Automation Panel eingebaut und passt das DVI Signal für unterschiedliche Kabellängen an. Der Equalizerwert wird automatisch anhand der Kabellänge ermittelt. Sie können einen anderen Equalizerwert einstellen, um die beste optische Darstellung auf dem Display zu erreichen (z.B. bei schlechter Kabelqualität oder schlechter DVI Signalqualität).

Bei der „Automatischen Einstellung“ wird der Wert anhand der Kabellänge optimal eingestellt.

Der Equalizerwert kann nur geändert werden, wenn die Funktion vom Automation Panel 900 unterstützt wird (ab Panel Firmware Version 1.04 oder höher).

9.4 USV Parametrierung

Hier können die Statuswerte einer optional eingebauten B&R Add-on USV angezeigt und die Batterieeinstellungen der USV bearbeitet, aktualisiert und gesichert werden. Ebenfalls können die Systemeinstellungen der USV konfiguriert werden.

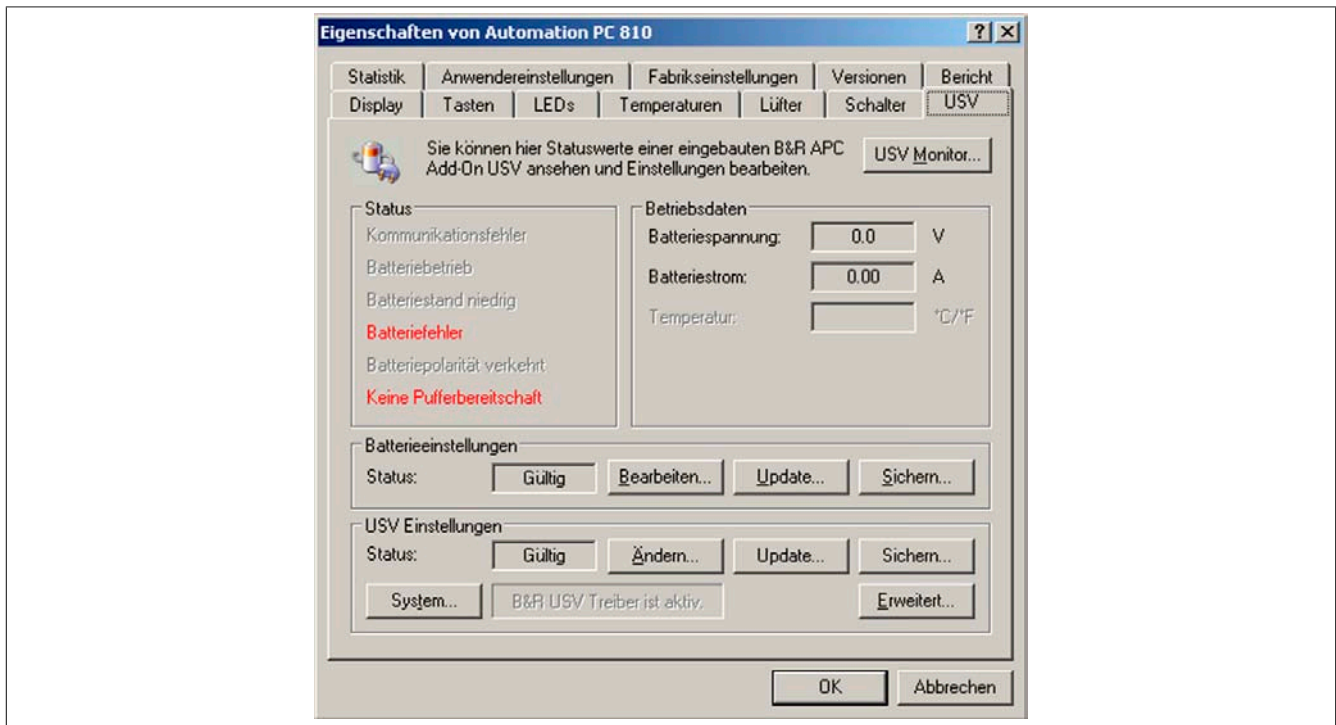


Abbildung 142: ADI Control Center - USV Einstellungen

Vorsicht!

Die eingebaute USV muss in der Systemsteuerung mit Energieoptionen ausgewählt und konfiguriert werden, damit der Batteriebetrieb unterstützt wird.

Information:

Der USV Dienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.10 oder höher unterstützt.

9.4.1 Installation des USV Dienstes für die B&R Add-on USV

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **System** klicken. Die **Energieoptionen** in der Systemsteuerung werden geöffnet. (Die **Energieoptionen** können auch direkt aus der **Systemsteuerung** geöffnet werden.)
4. Registerkarte **USV** auswählen und **Auswählen** klicken.
5. Als Hersteller 'Bernecker + Rainer' und als Modell 'APC Add-on USV' auswählen und auf **Fertig stellen** klicken. Der Wert für den COM Anschluss wird nur für eine seriell angeschlossene USV benötigt und vom APC Add-on USV Treiber ignoriert.
6. Auf **Übernehmen** klicken, um den USV Dienst zu starten. Das dauert ein paar Sekunden und danach werden USV Status und Details angezeigt.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Das Textfeld neben **System** (auf der **USV** Registerkarte im **Control Center**) zeigt ebenfalls an, ob der B&R USV Treiber aktiv ist.

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

9.4.2 Statuswerte der USV anzeigen

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.

Die angezeigten Werte werden automatisch aktualisiert.

Information:

Der „Batteriepolartität verkehrt“ Zustand wird erst mit USV Firmware Version 1.08 oder höher angezeigt.

Bei USV Firmware Version 1.07 oder kleiner kann es beim Wechsel zwischen Batteriebetrieb und Normalbetrieb zu einem Kommunikationsfehler kommen.

3. USV Monitor auswählen, um die Änderungen des USV Status seit dem letzten Start des Systems bzw. des USV Treibers anzuzeigen.

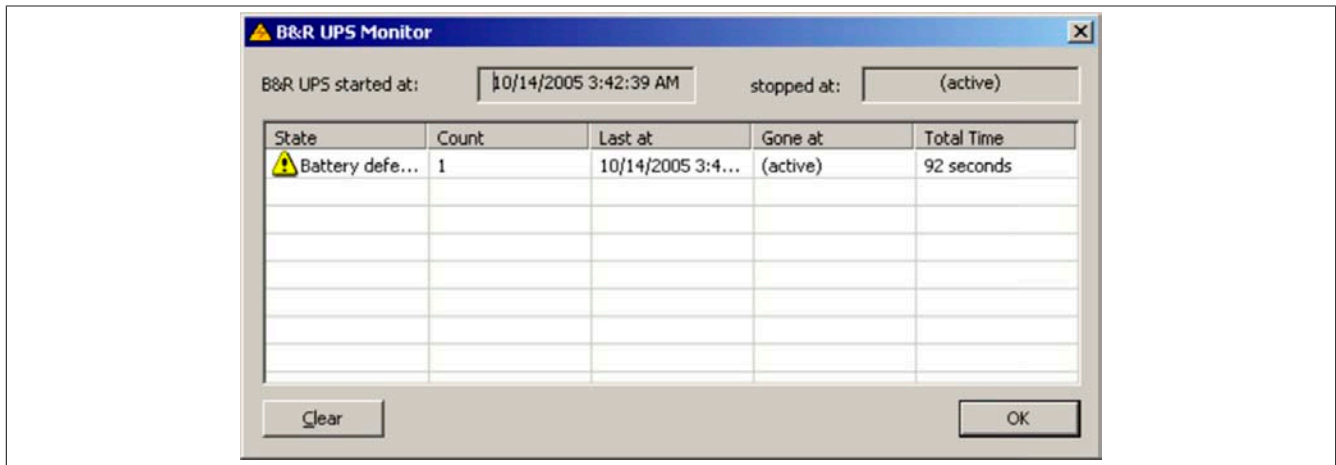


Abbildung 143: ADI Control Center - USV Monitor

Der Dialog wird bei Änderungen des Status automatisch aktualisiert.

Um die angezeigten Zustände aus der Liste zu entfernen, auf **Löschen** klicken.

Information:

Der aktuelle Zustand der USV wird auch bei gestartetem USV Dienst in der Windows Systemsteuerung auf der USV Seite bei den Energieoptionen angezeigt.

Information:

In einer deutschen Windows XP Professional Version wird der Batteriezustand in den Energieoptionen mit "Niedrig" angezeigt, auch wenn die Batterie in Ordnung ist (Windows Fehler). In einer englischen Version werden normalerweise drei Batteriezustände angezeigt: unbekannt, OK, zu ersetzen. Niedriger Batteriestand wird niemals angezeigt.

9.4.3 Batterieeinstellungen der USV bearbeiten

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **Batterieeinstellungen** auf **Bearbeiten** klicken. Datei „Öffnen“ Dialog wird geöffnet.
4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und **öffnen** der Datei.



Abbildung 144: ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen

In diesem Dialog kann man Einstellungen für die verwendete USV Batterie bearbeiten.

Durch Klicken auf **OK** werden die geänderten Einstellungen in die Datei geschrieben. Anschließend können die Batterieeinstellungen der USV mit dieser Datei aktualisiert werden.

Information:

Wenn Einstellungen für nicht von B&R gelieferte Batterien gemacht werden sollen, kopiert man am Besten eine Datei mit Batterieeinstellungen von B&R mit einem neuen Namen ab und passt die Einstellung dieser Datei für die verwendete Batterie an.

Aktuelle Dateien mit Einstellungen für die von B&R gelieferten Batterien können über die B&R „Upgrade PPC800 MTCX“ Software aktualisiert werden.

Information:

- **Ladeschlussspannung, Tiefentladespannung, Lebensdauer und Tiefentladezyklen werden von der aktuellen USV Firmware Version 1.10 nicht verwendet.**
- **Lebensdauer ist erst ab Version 2 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien bei 25°C Umgebungstemperatur.**
- **Tiefentladezyklen ist erst ab Version 3 der USV Batterieeinstellungen enthalten und nur gültig für B&R USV Batterien.**

Information:

Wenn die auf der USV aktuell vorhandenen Batterieeinstellungen bearbeitet werden sollen, müssen diese vorher in einer Datei gesichert werden.

9.4.4 Batterieeinstellungen der USV aktualisieren

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **Batterieeinstellungen** auf **Update** klicken. Datei „Öffnen“ Dialog wird geöffnet.
4. Auswahl der Datei mit den Batterieeinstellungen und **öffnen** der Datei. Der „Download“ Dialog wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Information:

- Während der Aktualisierung der Batterieeinstellungen ist kein USV- Betrieb möglich.
- Wenn die Übertragung abgebrochen wurde, muss der Vorgang so lange wiederholt werden, bis die Batterieeinstellungen erfolgreich aktualisiert wurden. Andernfalls ist anschließend kein Batteriebetrieb mehr möglich.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann, abhängig vom verwendeten Speicherbaustein, mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die USV wird nach erfolgreichem Download automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der USV- Kommunikation kommen.

9.4.5 Batterieeinstellungen der USV sichern

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter Batterieeinstellungen auf **Sichern** klicken. „Speichern unter“ Dialog wird geöffnet.
4. Dateiname eingeben oder eine bestehende Datei auswählen und auf **Speichern** klicken.

Information:

Das Sichern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Die Übertragung kann durch klicken auf **Abbrechen** im „Download“ Dialog abgebrochen werden.

9.4.6 Systemeinstellungen der USV konfigurieren

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.
2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **Ändern** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

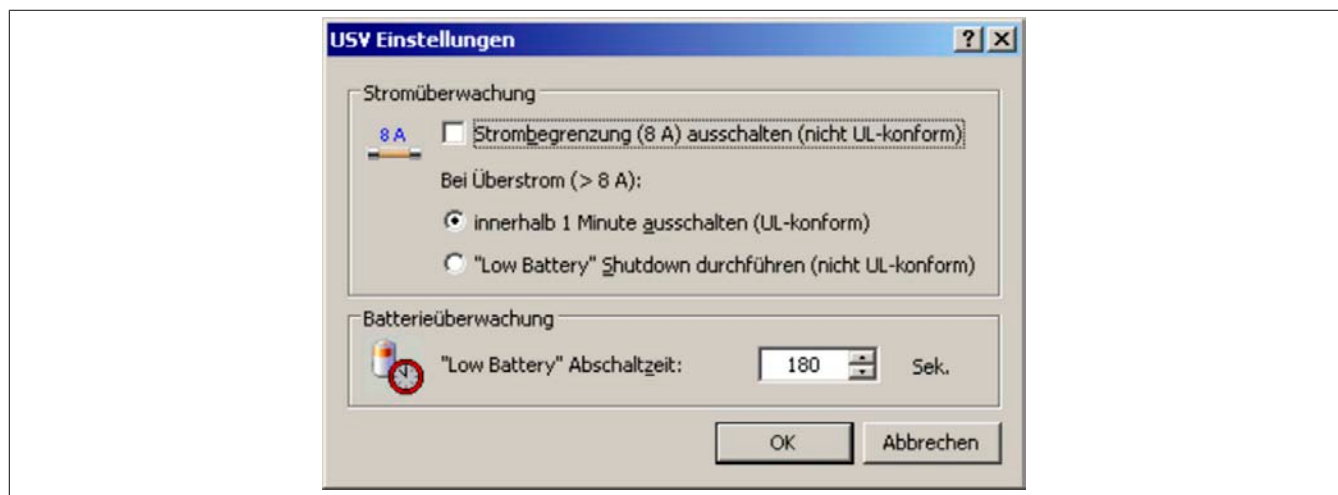


Abbildung 145: ADI Control Center - USV Einstellungen

Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen der USV finden Sie in der Windows Hilfe.

Information:

- Das Ändern von USV Einstellungen wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt. Wenn auf der USV keine geänderten Einstellungen vorhanden sind, werden Fabriks- oder Defaulteinstellungen verwendet.
- Die USV wird nach dem Ändern von USV Einstellungen automatisch neu gestartet. Dabei kann es kurzzeitig zu einem Ausfall der Kommunikation mit der USV kommen.
- Man benötigt Administratorrechte zum Ändern von Energieoptionen und zum Anzeigen des USV Status.

Ausschalten der 8 A Strombegrenzung

Information:

Ein Ausschalten der 8 A Strombegrenzung bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Ein „Low Battery“ Shutdown bei einem Überstrom von > 8 A bei Geräten im Batteriebetrieb ist nicht UL-konform!

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Strombegrenzung (8 A) ausschalten**.

Wenn die Strombegrenzung eingeschaltet ist (Kontrollkästchen ist deaktiviert), prüft die USV im Batteriebetrieb, ob die USV Batterie länger als 16 Sekunden mit mehr als 8 A entladen wird. In diesem Fall wird ein Überstromalarm zum PC signalisiert.

Information:

Die Strombegrenzung wird erst ab USV Firmware Version 1.10 unterstützt.

Durch Aktivieren einer der beiden folgenden Optionen können Sie auswählen, wie sich die USV bei einem Überstromalarm verhält:

Mit **innerhalb 1 Minute ausschalten** schaltet die USV bei Überstrom innerhalb einer Minute ab.

Warnung!

Das Betriebssystem wird dann bei einem Überstrom Alarm nicht ordnungsgemäß niedergefahren!

Mit **"Low Battery" Shutdown durchführen** signalisiert die USV zusätzlich zum Überstromalarm einen "Low Battery" Alarm und schaltet sich nach der eingestellten **"Low Battery" Abschaltzeit** aus. Dadurch wird das Betriebssystem bei aktiviertem USV Dienst ordnungsgemäß niedergefahren.

Ändern der Abschaltzeit der USV bei niedrigem Batteriepegel

Geben Sie die **"Low Battery" Abschaltzeit** in Sekunden an. Das ist die Zeit, die von der USV bei niedrigem Batteriepegel gewartet wird, bevor sie die Stromversorgung abschaltet.

Damit wird verhindert, dass die USV Batterie zu sehr entladen wird, wenn der Windows USV Dienst nicht aktiv ist und die USV daher nicht vom Betriebssystem ausgeschaltet wird.

Wenn der USV Dienst aktiv ist, wird die USV bei niedrigem Batteriepegel vom Betriebssystem mit der Windows USV Dienst **Abschaltzeit** (siehe "Weitere USV Einstellungen ändern", auf Seite 309) abgeschaltet. Die **"Low Battery" Abschaltzeit** wird dann ignoriert.

Information:

- Die **"Low Battery" Abschaltzeit** muss mit mindestens 60 Sekunden angegeben werden, damit das Betriebssystem genug Zeit hat, um bei niedrigem Batteriestand den Abschaltbefehl an die USV zu senden (erfolgt normalerweise nach ca. 30 Sekunden).
- Die **"Low Battery" Abschaltzeit** kann erst ab USV Firmware Version 1.10 eingestellt werden. USV Firmware Version 1.08 verwendet fix 180 Sekunden als Abschaltzeit. USV Firmware Versionen kleiner 1.08 schalten bei niedrigem Batteriepegel nicht selbständig ab.

9.4.7 Weitere USV Einstellungen ändern

1. Über die **Systemsteuerung** das **Control Center** öffnen.

2. Registerkarte **USV** auswählen.
3. Unter **USV Einstellungen** auf **Erweitert** klicken. Es wird folgender Dialog angezeigt.

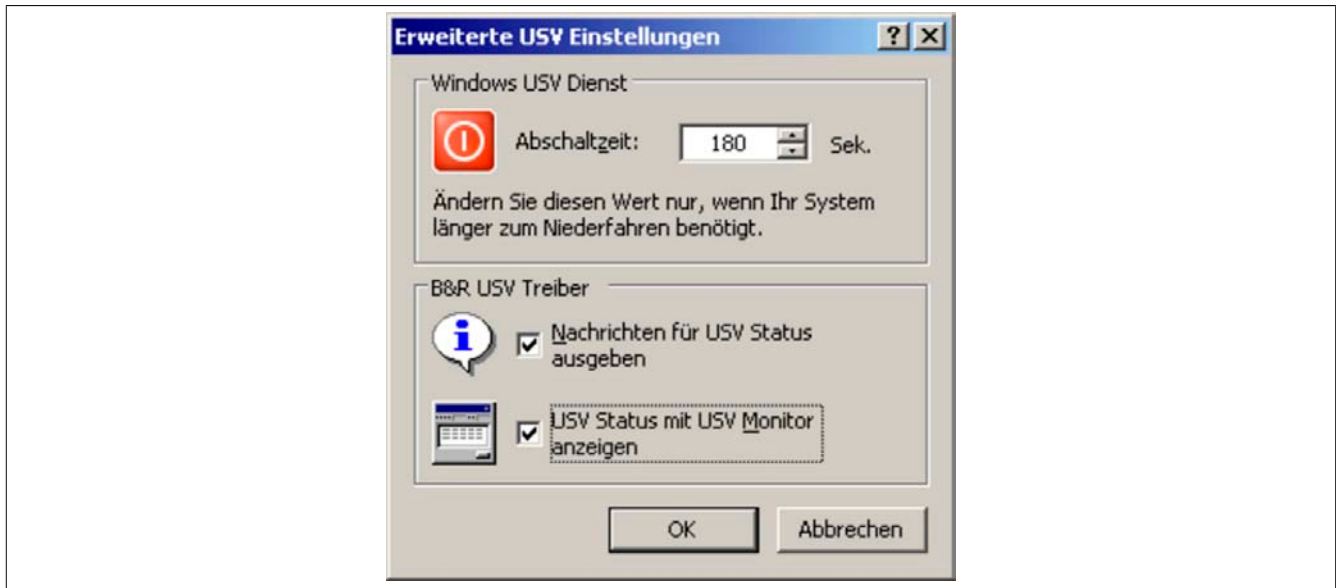


Abbildung 146: ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen

Information:

Man benötigt Administratorrechte zum Anzeigen dieses Dialoges.

Abschaltzeit der USV ändern

Unter **Windows USV Dienst** kann die **Abschaltzeit** in Sekunden angegeben werden. Das ist die Zeit, in der gewartet wird, bis die USV die Stromversorgung abschaltet. Dazu wird vom Windows USV Dienst bei einem kritischen Alarm (z.B. bei niedrigem Batteriestand) ein Shutdown Kommando mit der Abschaltzeit an die USV gesendet und das System heruntergefahren.

Information:

Diese Zeit wird vom Windows USV Dienst ausgewertet, kann aber in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen nicht eingestellt werden. Dieser Wert sollte nur geändert werden, wenn das System länger als die standardmäßig eingestellten 180 Sekunden zum Niederfahren benötigt.

Vorsicht!

Die angegebene Zeit muss größer sein als die für das Niederfahren des Betriebssystems benötigte Zeit.

Benachrichtigungen der USV aktivieren

Unter **B&R USV Treiber** das Kontrollkästchen **Nachrichten für USV Status ausgeben** aktivieren. Es wird dann vom B&R USV Treiber bei jeder Änderung des USV Status eine Meldung ausgegeben.

Information:

Das Niederfahren des Systems wird nur vom Windows USV Dienst gemeldet. Vom USV Dienst werden auch weitere Benachrichtigungen gesendet, wenn diese in den USV Systemeinstellungen der Energieoptionen aktiviert sind. Diese Benachrichtigungen werden nur ausgegeben, wenn der Windows Nachrichtendienst (Messenger)⁵⁾ gestartet ist und der PC an einem Netzwerk angeschlossen ist. Außerdem werden einige Zustände der B&R Add-on USV vom Windows USV Dienst nicht erkannt und daher nicht gemeldet, z.B. wenn keine Batterieeinstellungen auf der USV vorhanden sind. Die Windows Dienste sind in der Systemsteuerung unter Verwaltung in Dienste zu finden.

Ist zusätzlich das Kontrollkästchen **USV Status mit USV Monitor anzeigen** aktiviert, so wird nicht bei jeder Änderung eine neue Meldung ausgegeben, sondern nur eine allgemeine Meldung und Aufforderung zum Starten des B&R USV Monitors. Solange der USV Monitor aktiv ist, werden keine neuen Meldungen ausgegeben.

5) Der Windows Nachrichtendienst wird erst mit B&R Windows XP Embedded Version 2.20 oder höher unterstützt.

Information:

Alle Änderungen des USV Status werden unabhängig von diesen Optionen im Windows Ereignisprotokoll (unter „Anwendung“) eingetragen.

9.4.8 Ablauf bei einem Powerfail**Over Current Shutdown**

Wenn im Batteriebetrieb für eine Dauer von 16 Sekunden ein Überstrom $>8\text{ A}$ erreicht wird, wird der Over Current Shutdown eingeleitet. Dem System steht insgesamt eine Abschaltzeit von einer Minute zur Verfügung.

Wird während dieser Zeit die Versorgung wieder hergestellt wird der Abschaltvorgang abgebrochen.

Information:

Der Over Current Shutdown hat die höchste Priorität.

Low Battery Shutdown

Wird bei einem Spannungsausfall das LowBatteryFlag gesetzt wird der „Low Battery“ Shutdown eingeleitet, er verhindert die Totentladung des Akkus. Nach Ablauf der Ausschaltzeit (per Default 3 Minuten) schaltet die USV aus.

Sollte während dem Abschaltvorgang ein „Overcurrent“ Shutdown oder ein „Standard“ Shutdown erkannt werden, wird der „Low Battery“ Shutdown durch den jeweiligen Vorgang ersetzt.

Standard Shutdown

Der Standard Shutdown wird bei aktiviertem USV Dienst schlagend, die Ausschaltzeit beträgt per Default 3 Minuten.

Wenn die Versorgungsspannung während der Ausschaltzeit wiederkehrt, wird der Shutdown abgebrochen.

Wenn die Versorgungsspannung während des Abschaltvorganges wiederkehrt läuft der Shutdowntimer solange bis der B&R Industrie PC den Standby Modus erreicht hat und führt dann einen Reboot des Systems aus.

10 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer)

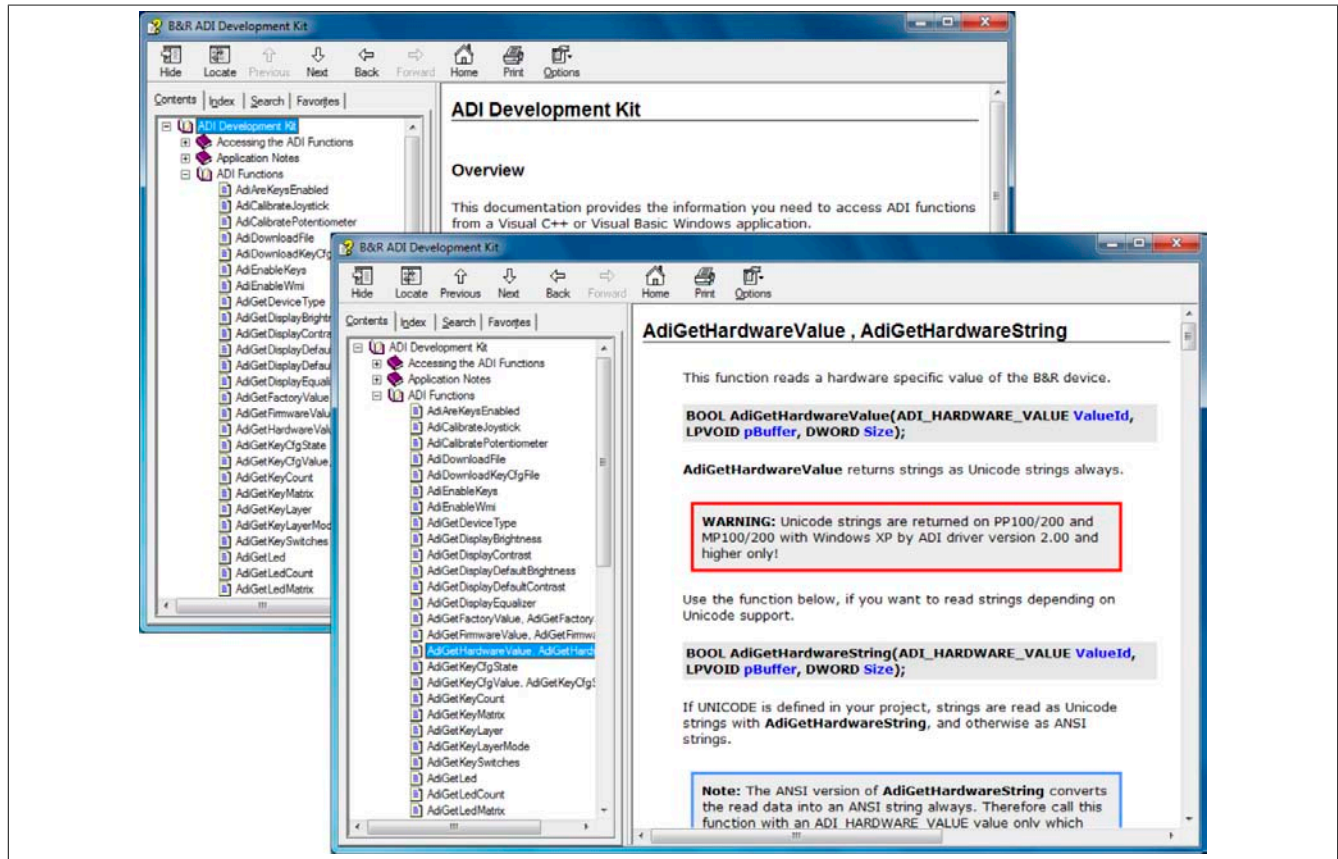


Abbildung 147: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.40)

Features:

- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateien für Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 3.40):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

11 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstützte Programmiersprachen:

- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#

Systemvoraussetzungen:

- Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit
 - Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
 - Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer

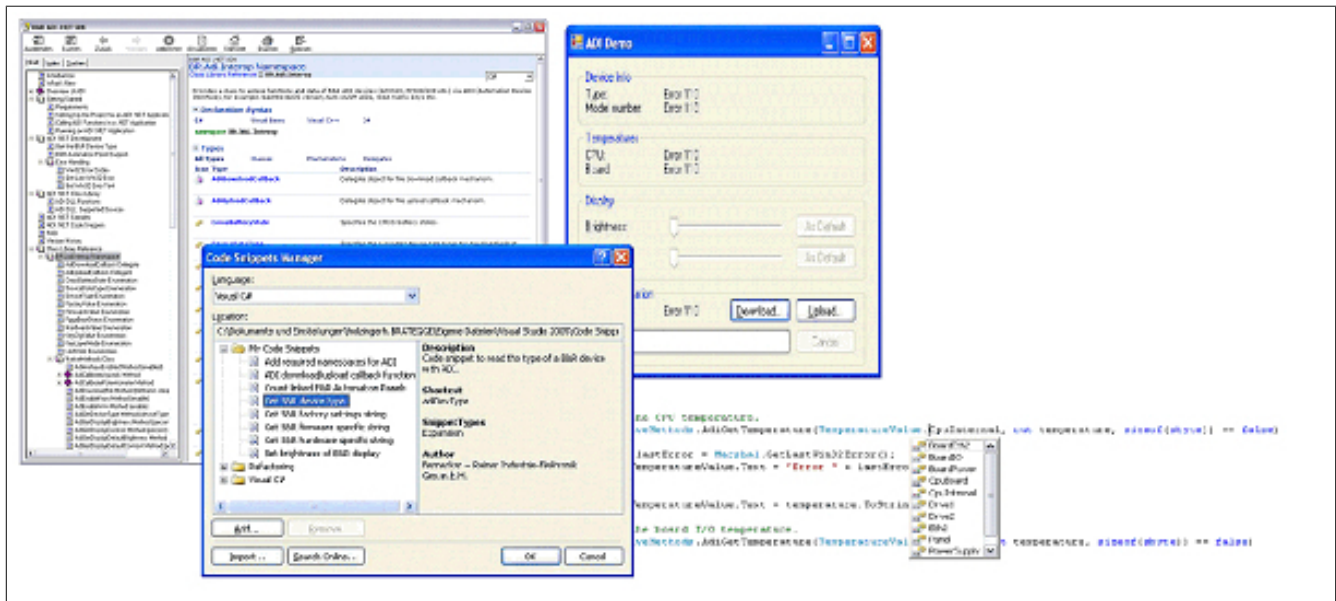


Abbildung 148: ADI .NET SDK Screenshots (Version 1.80)

Features (ab Version 1.80):

- ADI .NET Class Library.
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei) und MS Help 2.0 Format (.HxS Datei). (Hilfe ist in Englisch)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 1.80):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

12 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.

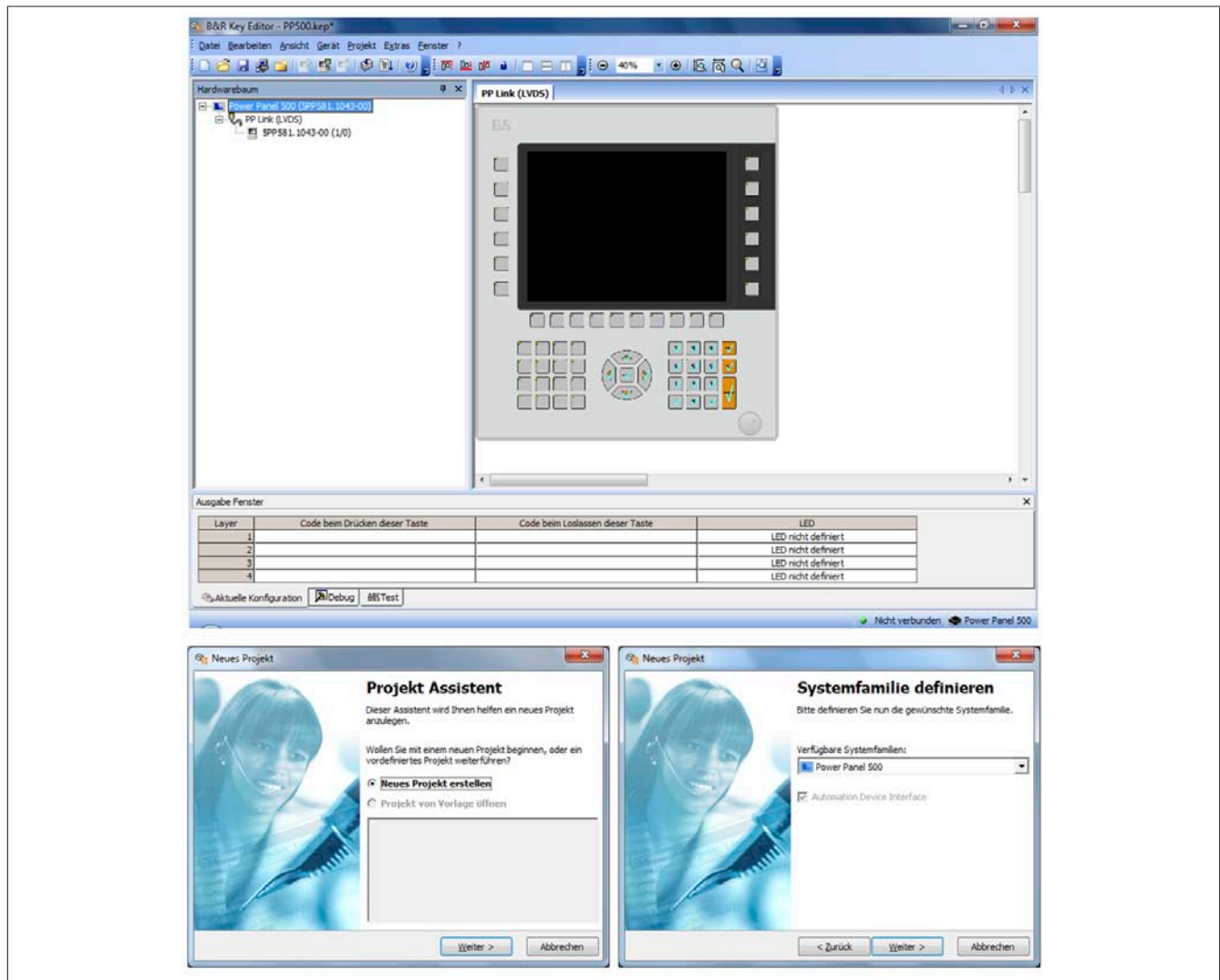


Abbildung 149: B&R Key Editor Screenshots Version 3.30 (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 3.30):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation Panel 800
- Automation Panel 830

- Automation Panel 900
- IPC2000, IPC2001, IPC2002
- IPC5000, IPC5600
- IPC5000C, IPC5600C
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Weiters ist dieser auf der B&R HMI Treiber- und Utilities- DVD (Best. Nr. 5SWH-MI.0000-00) zu finden.

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Gültige europäische Richtlinien

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

2 Normenübersicht

Norm	Beschreibung
EN 55011 Klasse A	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Produktnorm Funkstörungen, industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte), Grenzwerte und Messverfahren; Gruppe 1 (Geräte, die keine HF zur Materialbearbeitung selbst erzeugen) und Gruppe 2 (Geräte, die HF zur Materialbearbeitung selbst erzeugen)
EN 55022 Klasse A	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktnorm Funkstöreigenschaften; Einrichtungen der Informationstechnik (ITE-Geräte), Grenzwerte und Messverfahren
EN 60060-1	Hochspannungs-Prüftechnik - Teil 1: Allgemeine Festlegungen und Prüfbedingungen
EN 60068-2-1	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfgruppe A: Trockene Kälte
EN 60068-2-2	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfgruppe B: Trockene Wärme
EN 60068-2-3	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Feuchte Wärme, konstant
EN 60068-2-6	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Schwingen, sinusförmig
EN 60068-2-14	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung N: Temperaturwechsel
EN 60068-2-27	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Schocken
EN 60068-2-30	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung und Leitfaden: Feuchte Wärme, zyklisch
EN 60068-2-31	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Kippfallen und Umstürzen, vornehmlich für Geräte
EN 60068-2-32	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung: Frei Fallen
EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
EN 60664-1	Isulationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen
EN 60721-3-2	Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 2: Transport
EN 60721-3-3	Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflussgrößen und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 3: Ortsfester Einsatz, wettergeschützt
EN 61000-3-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme für Geräte mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter
EN 61000-3-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN 61000-3-11	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-11: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 75 A je Leiter, die einer Sonderanschlussbedingung unterliegen
EN 61000-4-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst
EN 61000-4-5	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
EN 61000-4-6	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
EN 61000-4-8	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-8: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
EN 61000-4-18	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-18: Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen gedämpft schwingende Wellen
EN 61000-4-29	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-29: Prüf- und Messverfahren - Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen an Gleichstrom-Netzeingängen
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm Störfestigkeit - Teil 2: Industriebereich
EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Fachgrundnorm Störaussendung - Teil 2: Industriebereich
EN 61131-2	Produktnorm, Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
Germanischer Lloyd 2003	Germanischer Lloyd 2003: Ergänzende Vorschriften und Richtlinien - Teil 7: Richtlinien für die Durchführung von Baumusterprüfungen
UL 508	Industrial Control Equipment (UL = Underwriters Laboratories)
47 CFR	Federal Communications Commission (FCC), 47 CFR Part 15 Subpart B class A

Tabelle 219: Normenübersicht

3 Störaussendungsanforderungen (Emission)

Emission	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Netzgebundene Emission	EN 55011 / EN 55022	EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich) EN 55011: Produktnorm Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM Geräte), Klasse A (Industriebereich) EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE Geräte), Klasse A (Industriebereich) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen EN 50091-2: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Klasse A 47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC) Germanischer Lloyd 2003
Störaussendung, Elektromagnetische Strahlung	EN 55011 / EN 55022	EN 61000-6-4: Fachgrundnorm (Industriebereich) EN 55011: Produktnorm Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM Geräte), Klasse A (Industriebereich) EN 55022: Produktnorm Einrichtungen der Informationstechnik (ITE Geräte), Klasse A (Industriebereich) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen EN 50091-2: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Klasse A 47 CFR Part 15 Subpart B class A (FCC) Germanischer Lloyd 2003
Oberschwingungsströme für Geräte mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter	EN 61000-3-2	EN 61000-3-2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme für Geräte mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter
Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen	EN 61000-3-3	EN 61000-3-3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen Klasse A/D
Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 75 A je Leiter, die einer Sonderanschlussbedingung unterliegen	EN 61000-3-11	EN 61000-3-11: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 75 A je Leiter, die einer Sonderanschlussbedingung unterliegen Klasse A/D

Tabelle 220: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Emission

3.1 Netzgebundene Emission

Prüfdurchführung nach EN 55011 / EN 55022	Grenzwerte nach EN 61000-6-4	Grenzwerte nach EN 55011 Klasse A	Grenzwerte nach EN 55022 Klasse A
Netzanschlüsse 150 kHz - 500 kHz	-	79 dB (µV) Quasispitzenwert 66 dB (µV) Mittelwert	79 dB (µV) Quasispitzenwert 66 dB (µV) Mittelwert
Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	-	73 dB (µV) Quasispitzenwert 60 dB (µV) Mittelwert	73 dB (µV) Quasispitzenwert 60 dB (µV) Mittelwert
AC Netzanschlüsse 150 kHz - 500 kHz	79 dB (µV) Quasispitzenwert 66 dB (µV) Mittelwert	-	-
AC Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	73 dB (µV) Quasispitzenwert 60 dB (µV) Mittelwert	-	-
Sonstige Anschlüsse 150 kHz - 500 kHz	-	-	97 - 87 dB (µV) und 53 - 43 dB (µA) Quasispitzenwert 84 - 74 dB (µV) und 40 - 30 dB (µA) Mittelwert
Sonstige Anschlüsse 500 kHz - 30 MHz	-	-	87 dB (µV) und 43 dB (µA) Quasispitzenwert 74 dB (µV) und 30 dB (µA) Mittelwert
Prüfdurchführung nach EN 55011 / EN 55022	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach 47 CFR Part 15 Subpart B class A	
AC Netzanschlüsse 150 kHz - 500 kHz	79 dB (µV) Quasispitzenwert 66 dB (µV) Mittelwert	79 dB (µV) Quasispitzenwert 66 dB (µV) Mittelwert	
AC Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	73 dB (µV) Quasispitzenwert 60 dB (µV) Mittelwert	73 dB (µV) Quasispitzenwert 60 dB (µV) Mittelwert	
Prüfdurchführung nach CISPR 16-1, 16-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003		
Netzanschlüsse 10 kHz - 150 kHz	96 dB(µV) – 50 dB (µV)		
Netzanschlüsse 150 kHz - 500 kHz	60 dB(µV) – 50 dB (µV)		
Netzanschlüsse 500 kHz - 30 MHz	50 dB (µV)		

Tabelle 221: Prüfanforderung netzgebundene Emission Industriebereich

3.2 Störaussendung, Elektromagnetische Strahlung

Prüfdurchführung nach EN 55011 / EN 55022	Grenzwerte nach EN 61000-6-4	Grenzwerte nach EN 55011 Klasse A	Grenzwerte nach EN 55022 Klasse A
30 MHz - 230 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 40 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 40 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 40 dB (µV/m) Quasispitzenwert
230 MHz - 1 GHz gemessen in 10 m Entfernung	< 47 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 47 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 47 dB (µV/m) Quasispitzenwert
Prüfdurchführung nach EN 55011 / EN 55022	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 50091-2 Klasse A	
30 MHz - 230 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 40 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 40 dB (µV/m) Quasispitzenwert	
230 MHz - 1 GHz gemessen in 10 m Entfernung	< 47 dB (µV/m) Quasispitzenwert	< 47 dB (µV/m) Quasispitzenwert	
Prüfdurchführung	Grenzwerte nach 47 CFR Part 15 Subpart B class A		
30 MHz - 88 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 90 dB (µV/m) Quasispitzenwert		
88 MHz - 216 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 150 dB (µV/m) Quasispitzenwert		
216 MHz - 960 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 210 dB (µV/m) Quasispitzenwert		
> 960 MHz gemessen in 10 m Entfernung	< 300 dB (µV/m) Quasispitzenwert		
Prüfdurchführung CISPR 16-1, CISPR 16-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003		
150 kHz - 300 kHz gemessen in 3 m Entfernung	< 80 dBµV/m - 52 dBµV/m Quasispitzenwert		
300 kHz - 30 MHz gemessen in 3 m Entfernung	< 52 dBµV/m - 34 dBµV/m Quasispitzenwert		
30 MHz - 2 GHz gemessen in 3 m Entfernung	< 54 dBµV/m Quasispitzenwert		
Außer für 156 MHz - 165 MHz gemessen in 3 m Entfernung	< 24 dBµV/m Quasispitzenwert		

Tabelle 222: Prüfanforderung Elektromagnetische Strahlung Industriebereich

4 Störfestigkeitsanforderung (Immunität)

Immunität	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Elektrostatische Entladung (ESD)	EN 61000-4-2	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)	EN 61000-4-3	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)	EN 61000-4-4	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	EN 61000-4-5	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen	EN 61000-4-6	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	EN 61000-4-8	EN 61000-6-2: Fachgrundnorm (Industrie) EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
Störfestigkeit gegen gedämpft schwingende Wellen	EN 61000-4-18	EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
Störfestigkeit gegen Spannungsschwankungen	EN 61000-4-29	EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen Spannungsunterbrechungen	EN 61000-4-29	EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen Germanischer Lloyd 2003
Störfestigkeit gegen Änderung der Versorgungsspannung	EN 61131-2	EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen
Störfestigkeit gegen allmähliches Abschalten / Zuschalten	EN 61131-2	EN 61131-2: Produktnorm Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 223: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Immunität

Bewertungskriterien nach EN 61000-6-2

Kriterium A:

Das Betriebsmittel muss während der Prüfung weiterhin bestimmungsgemäß arbeiten. Es darf keine Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom Hersteller beschriebenen minimalen Betriebsqualität auftreten.

Kriterium B:

Das Betriebsmittel muss nach der Prüfung weiterhin bestimmungsgemäß arbeiten. Es darf keine Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens oder kein Funktionsausfall unterhalb einer vom Hersteller beschriebenen minimalen Betriebsqualität auftreten.

Kriterium C:

Ein zeitweiliger Funktionsausfall ist erlaubt, wenn die Funktion sich selbst wiederherstellt, oder die Funktion durch Betätigung der Einstell- bzw. Bedienelemente wiederherstellbar ist.

Kriterium D:

Minderung oder Ausfall der Funktion, die nicht mehr hergestellt werden kann (Betriebsmittel zerstört).

4.1 Elektrostatische Entladung (ESD)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-2	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003
Kontaktentladung auf pulverbeschichtete und blanke Metallteile des Gehäuses	±4 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	±4 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	±6 kV, 10 Entladungen, Kriterium B
Luftentladung auf Kunststoffteile des Gehäuses	±8 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	±8 kV, 10 Entladungen, Kriterium B	±8 kV, 10 Entladungen, Kriterium B

Tabelle 224: Prüfanforderung elektrostatische Entladung (ESD)

4.2 Hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-3	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003
Gehäuse, verdrahtet	80 MHz - 1 GHz, 10 V/m, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	2 GHz - 2,7 GHz, 1 V/m, 1,4 GHz - 2 GHz, 3 V/m, 80 MHz - 1 GHz, 10 V/m, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	80MHz - 2 GHz, 10V/m, 80% Amplitudenmodulation mit 1kHz, 1%/3Sec Kriterium A

Tabelle 225: Prüfanforderung hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld)

4.3 Schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-4	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach Germanischer Lloyd 2003
AC Netzein-/ausgänge	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B	-
AC Netzeingänge	-	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B
DC Netzein-/ausgänge > 3 m ¹⁾	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B	-
DC Netzausgänge	-	-	±2 kV, Kriterium B
Funktionserdanschlüsse, Signalleitungen und I/Os > 3 m	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B
Ungeschirmte AC Ein-/Ausgänge > 3 m	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B	-
Analoge I/Os	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B

Tabelle 226: Prüfanforderung schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)

1) Bei EN 55024 ohne Längenbeschränkung

4.4 Stoßspannungen (Surge)

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-5	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach Germanischer Lloyd 2003
AC Netzein-/ausgänge, L zu L	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	-
AC Netzein-/ausgänge, L zu PE	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B	-
DC Netzein-/ausgänge, L+ zu L-, > 30 m	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	-
DC Netzein-/ausgänge, L zu PE, > 30 m	±2 kV, Kriterium B	±2 kV, Kriterium B	-
DC Netzeingänge, L+ zu L-	-	-	±0,5 kV, Kriterium A
DC Netzeingänge, L zu PE	-	-	±1 kV, Kriterium A
Signalanschlüsse > 30 m	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	-
Alle geschirmten Kabel	±1 kV, Kriterium B	±1 kV, Kriterium B	-

Tabelle 227: Prüfanforderung Stoßspannungen (Surge)

4.5 Leitungsgeführte Störgrößen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-6	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003
AC Netzein-/ausgänge	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 10 V ¹⁾ , 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A
DC Netzein-/ausgänge	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 10 V ¹⁾ , 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A
Funktionserdeanschlüsse	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 10 V ¹⁾ , 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A
Signalanschlüsse > 3 m	150 kHz - 80 MHz, 10 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 3 V, 80% Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A	150 kHz - 80 MHz, 10 V ¹⁾ , 80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz, Dauer 3 Sekunden, Kriterium A

Tabelle 228: Prüfanforderung leitungsgeführte Störgrößen

1) Trägersignalspannung auf 10Veff gemäß IEC 60945 bei folgenden Frequenzen erhöhen: 2MHz; 3MHz; 4MHz; 6,2 MHz; 8,2MHz; 12,6MHz; 16,5MHz; 18,8 MHz; 22MHz; 25MHz

4.6 Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-8	Grenzwerte nach EN 61000-6-2	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Prüfrichtung x, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	
Prüfrichtung y, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	
Prüfrichtung z, Prüfung im Feld einer Induktionsspule 1 m x 1 m	30 A/m, Kriterium A	30 A/m, Kriterium A	

Tabelle 229: Prüfanforderung Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

4.7 Spannungsschwankungen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-29	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003	
Stromversorgungsanschlüsse	30 min bei 0,85 x U _e bzw. 1,2 x U _e Welligkeit dauerhaft 0,05 x U _e	30 min bei 0,75 x U _e bzw. 1,3 x U _e	

Tabelle 230: Prüfanforderung Spannungsschwankungen

4.8 Spannungsunterbrechungen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-29	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwert nach Germanischer Lloyd 2003	
DC Netzeingänge	20 Unterbrechungen für 10 ms (PS2)	3 Unterbrechungen für 30 s in 5 min	

Tabelle 231: Prüfanforderung Spannungsunterbrechungen

4.9 Änderung Versorgungsspannung

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Stromversorgungsanschlüsse	100% auf 90% /60s - 90% auf 100% /60s 100% auf 0% /5s - 0% auf 100% /5s		

Tabelle 232: Prüfanforderung Änderung Versorgungsspannung

4.10 Allmähliches Abschalten / Zuschalten

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Versorgungsspannung	100% auf 0% /60s - 0% auf 100% /60s		

Tabelle 233: Prüfanforderung allmähliches Abschalten / Zuschalten

4.11 Gedämpft schwingende Wellen

Prüfdurchführung nach EN 61000-4-18	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Netzein-/ausgänge, L zu L	±1 kV, 1 MHz, Wiederholrate 400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden, Anschlusslänge 2 m, Kriterium B		
Netzein-/ausgänge, L zu PE	±2,5 kV, 1 MHz, Wiederholrate 400/Sekunde, Dauer 2 Sekunden, Anschlusslänge 2 m, Kriterium B		

Tabelle 234: Prüfanforderung gedämpft schwingende Wellen

5 Mechanische Bedingungen

Vibration	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Vibration Betrieb	EN 60068-2-6	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Vibration Transport (verpackt)	EN 60068-2-6	EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Schock Betrieb	EN 60068-2-27	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Schock Transport (verpackt)	EN 60068-2-27	EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Kippfallen (verpackt)	EN 60068-2-31	EN 60721-3-2 Klasse 2M1 EN 60721-3-2 Klasse 2M2 EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Freier Fall (verpackt)	EN 60068-2-32	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 235: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Vibration

5.1 Vibration Betrieb

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-6	Grenzwerte nach EN 61131-2		Grenzwerte nach EN 60721-3-3 Klasse 3M4	
Vibration Betrieb: Dauerbeanspruchung mit gleitender Frequenz in allen 3 Achsen (x, y, z), 1 Oktave pro Minute	10 Sweeps je Achse		10 Sweeps je Achse	
	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert
	5 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 9 Hz	Amplitude 3 mm
	9 - 150 Hz	Beschleunigung 1 g	9 - 200 Hz	Beschleunigung 1 g

Tabelle 236: Prüfanforderung Vibration Betrieb

5.2 Vibration Transport (verpackt)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-6	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Vibration Transport: Dauerbeanspruchung mit gleitender Frequenz in allen 3 Achsen (x, y, z)	10 Sweeps je Achse, verpackt		10 Sweeps je Achse, verpackt		10 Sweeps je Achse, verpackt	
	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert	Frequenz	Grenzwert
	2 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 9 Hz	Amplitude 3,5 mm	2 - 8 Hz	Amplitude 7,5 mm
	9 - 200 Hz	Beschleunigung 1 g	9 - 200 Hz	Beschleunigung 1 g	8 - 200 Hz	Beschleunigung 2 g
	200 - 500 Hz	Beschleunigung 1,5 g	200 - 500 Hz	Beschleunigung 1,5 g	200 - 500 Hz	Beschleunigung 4 g

Tabelle 237: Prüfanforderung Vibration Transport (verpackt)

5.3 Schock Betrieb

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-27	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 60721-3-3 Klasse 3M4
Schock Betrieb: Impulsförmige (Halbsinus) Beanspruchung in allen 3 Achsen (x, y, z)	Beschleunigung 15 g, Dauer 11 ms, 18 Schocks	Beschleunigung 10 g, Dauer 11 ms

Tabelle 238: Prüfanforderung Schock Betrieb

5.4 Schock Transport (verpackt)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-27	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3
Impulsförmige (Halbsinus) Beanspruchung in allen 3 Achsen (x, y, z)	Beschleunigung 10 g, Dauer 11 ms, je 3 Schocks, verpackt	Beschleunigung 30 g, Dauer 6 ms, je 4 Schocks, verpackt	Beschleunigung 100 g, Dauer 6 ms, je 3 Schocks, verpackt

Tabelle 239: Prüfanforderung Schock Transport

5.5 Kippfallen

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-31	Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Kippfallen und Umstürzen	Geräte: Kippen/Umstürzen um jede Kante, verpackt		Geräte: Kippen/Umstürzen um jede Kante, verpackt		Geräte: Kippen/Umstürzen um jede Kante, verpackt	
	Gewicht	erforderlich	Gewicht	erforderlich	Gewicht	erforderlich
	< 20 kg	Ja	< 20 kg	Ja	< 20 kg	Ja
	20 - 100 kg	-	20 - 100 kg	Ja	20 - 100 kg	Ja
	> 100 kg	-	> 100 kg	-	> 100 kg	Ja

Tabelle 240: Prüfanforderung Kippfallen

5.6 Freier Fall (verpackt)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-32	Grenzwerte nach EN 61131-2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M1		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M2		Grenzwerte nach EN 60721-3-2 Klasse 2M3	
Freier Fall	Geräte mit Versandverpackung jeweils 5 Falltests		Geräte verpackt		Geräte verpackt		Geräte verpackt	
	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht	Höhe
	< 10 kg	1,0 m	< 20 kg	0,25 m	< 20 kg	1,2 m	< 20 kg	1,5 m
	10 - 40 kg	0,5 m	20 - 100 kg	0,25 m	20 - 100 kg	1,0 m	20 - 100 kg	1,2 m
	> 40 kg	0,25 m	> 100 kg	0,1 m	> 100 kg	0,25 m	> 100 kg	0,5 m
	Geräte mit Produktverpackung jeweils 5 Falltests							
	Gewicht	Höhe						
	< 10 kg	0,3 m						
	10 - 40 kg	0,3 m						
	> 40 kg	0,25 m						

Tabelle 241: Prüfanforderung Freier Fall

6 Klimabedingungen

Temperatur und Feuchte	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Worst Case Betrieb	UL 508	UL 508: Industrial Control Equipment EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Wärme	EN 60068-2-2	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Trockene Kälte	EN 60068-2-1	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Große Temperaturschwankungen	EN 60068-2-14	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Temperaturschwankungen im Betrieb	EN 60068-2-14	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Feuchte Wärme zyklisch	EN 60068-2-30	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Feuchte Wärme konstant (Lager)	EN 60068-2-3	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Tabelle 242: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Temperatur und Feuchte

6.1 Worst Case Betrieb

Prüfdurchführung nach UL 508	Grenzwerte nach UL 508	Grenzwerte nach EN 61131-2
Worst Case Betrieb. Betrieb des Gerätes mit der laut Datenblatt spezifizierten max. Umgebungstemperatur bei der max. spezifizierten Belastung	3 Stunden bei max. Umgebungstemperatur (min. +40°C) Dauer ca. 5 h	3 Stunden bei max. Umgebungstemperatur (min. +40°C) Dauer ca. 5 Stunden

Tabelle 243: Prüfanforderung Worst Case Betrieb

6.2 Trockene Wärme

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-2	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Trockene Wärme	16 Stunden bei +70°C, 1 Zyklus anschließend 1 Stunde Akklimatisierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 17 h		

Tabelle 244: Prüfanforderung trockene Wärme

6.3 Trockene Kälte

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-1	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Trockene Kälte	16 Stunden bei -40°C, 1 Zyklus anschließend 1 Stunde Akklimatisierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 17 h		

Tabelle 245: Prüfanforderung trockene Kälte

6.4 Große Temperaturschwankungen

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-14	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Große Temperaturschwankungen	3 Stunden bei -40°C und 3 Stunden bei +70°C, 5 Zyklen anschließend 2 Stunden Akklimatisierung und auf Funktion prüfen, Dauer ca. 14 h		

Tabelle 246: Prüfanforderung große Temperaturschwankungen

6.5 Temperaturschwankungen im Betrieb

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-14	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Offene Geräte: Diese können auch ein Gehäuse (housing) besitzen und werden in Schaltschränke eingebaut	3 Stunden bei +5°C und 3 Stunden bei 55°C, 5 Zyklen, Temperaturgradient 3°C / min, während der Prüfung wird der Prüfling gelegentlich mit Spannung versorgt, Dauer ca. 30 h		
Geschlossene Geräte: Das sind Geräte, die laut Datenblatt ein umhüllendes Gehäuse (enclosure) mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen besitzen.	3 Stunden bei +5°C und 3 Stunden bei 55°C, 5 Zyklen, Temperaturgradient 3°C / min, während der Prüfung wird der Prüfling gelegentlich mit Spannung versorgt, Dauer ca. 30 h		

Tabelle 247: Prüfanforderung Temperaturschwankungen im Betrieb

6.6 Feuchte Wärme zyklisch

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-30	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Wechselklima	24 Stunden bei +25°C / +55°C und 97% / 83% RH, 2 Zyklen, anschließend 2 Stunden Akklimatisierung sowie Funktions- und Isolationsprüfung durchführen, Dauer ca. 50 h		

Tabelle 248: Prüfanforderung Feuchte Wärme zyklisch

6.7 Feuchte Wärme konstant (Lager)

Prüfdurchführung nach EN 60068-2-3	Grenzwerte nach EN 61131-2		
Feuchte Wärme konstant (Lager)	48 Stunden bei +40°C und 92,5% RH, anschließend innerhalb von 3 Stunden Isolationsprüfung, Dauer ca. 49 Stunden		

Tabelle 249: Prüfanforderung Feuchte Wärme konstant (Lager)

7 Sicherheit

Sicherheit	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Erdungswiderstand	EN 61131-2	EN 60204-1: Elektrische Ausrüstung von Maschinen EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Isolationswiderstand		EN 60204-1: Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Hochspannung	EN 60060-1	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen UL 508: Industrial Control Equipment
Restspannung	EN 61131-2	EN 60204-1: Elektrische Ausrüstung von Maschinen EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen
Ableitstrom		VDE 0701-1: Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte
Überlast	UL 508	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen UL 508: Industrial Control Equipment
Simulation Bauteildefekt	UL 508	EN 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen UL 508: Industrial Control Equipment

Tabelle 250: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Sicherheit

7.1 Erdungswiderstand

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 60204-1		Grenzwerte nach EN 61131-2
Erdungswiderstand: Gehäuse (von beliebigen Metallteil auf Erdungsklemme)	Kleinsten wirksamer Querschnitt des Schutzleiters für den zu prüfenden Zweig	Maximal gemessener Spannungsabfall bei einem Prüfstrom von 10 A	Prüfstrom 30 A für 2 min, < 0,1 Ω
	1,0 mm ²	3,3 V	
	1,5 mm ²	2,6 V	
	2,5 mm ²	1,9 V	
	4,0 mm ²	1,4 V	
	> 6,0 mm ²	1,0 V	

Tabelle 251: Prüfanforderung Erdungswiderstand

7.2 Isolationswiderstand

Prüfdurchführung	Grenzwerte nach EN 60204-1		
Isolationswiderstand: Hauptstromkreise zu Schutzleiter.	> 1 MΩ bei 500 V Gleichspannung		

Tabelle 252: Prüfanforderung Isolationswiderstand

7.3 Hochspannung

Prüfdurchführung nach EN 60060-1	Grenzwerte nach EN 61131-2				Grenzwerte nach UL 508		
Hochspannung: Primärkreise zu Sekundärkreise und zu Schutzleiter (vor dem Test dürfen Transformatoren, Spulen, Varistoren, Kondensatoren oder Bauteile, die zum Schutz vor Überspannungen dienen, entfernt werden)	Eingangsspannung	Prüfspannung			Eingangs- spannung	Prüfspannung	
		1,2/50 µs Spannungs- stoßSpitze	AC, 1 min	DC, 1 min		AC, 1 min	AC, 1 min
	0 - 50 VAC 0 - 60 VDC	850 V	510 V	720 V	≤ 50 V	500 V	707 V
	50 - 100 VAC 60 - 100 VDC	1360 V	740 V	1050 V	> 50 V	1000 V + 2 x U _N	(1000 V + 2 x U _N) x 1,414
	100 - 150 VAC 100 - 150 VDC	2550 V	1400 V	1950 V			
	150 - 300 VAC 150 - 300 VDC	4250 V	2300 V	3250 V			
	300 - 600 VAC 300 - 600 VDC	6800 V	3700 V	5250 V			
	600 - 1000 VAC 600 - 1000 VDC	10200 V	5550 V	7850 V			

Tabelle 253: Prüfanforderung Hochspannung

7.4 Restspannung

Prüfdurchführung nach EN 61131-2	Grenzwerte nach EN 60204-1	Grenzwerte nach EN 61131-2	
Restspannung nach dem Abschalten	< 60 V nach 5 sec (aktive Teile) < 60 V nach 1 sec (Steckstifte)	< 60 V nach 5 sec (aktive Teile) < 60 V nach 1 sec (Steckstifte)	

Tabelle 254: Prüfanforderung Restspannung

7.5 Ableitstrom

Prüfdurchführung	Grenzwerte nach VDE 0701-1		
Ableitstrom: Phase zu Erde	< 3,5 mA		

Tabelle 255: Prüfanforderung Ableitstrom

7.6 Überlast

Prüfdurchführung nach UL 508	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach UL 508	
Überlast von Transistorausgängen	50 Schaltungen, 1,5 I _N , 1 sec Ein / 9 sec Aus	50 Schaltungen, 1,5 I _N , 1 sec Ein / 9 sec Aus	

Tabelle 256: Prüfanforderung Überlast

7.7 Bauteildefekt

Prüfdurchführung nach UL 508	Grenzwerte nach EN 61131-2	Grenzwerte nach UL 508	
Simulation des Defektwerdens von Bauteilen bei Netzteilen	Kein Entzünden des umhüllenden Baumwollgewebes Keine spannungsführende berührbare Teile	Kein entzünden des umhüllenden Baumwollgewebes Keine spannungsführende berührbare Teile	

Tabelle 257: Prüfanforderung Bauteildefekt

8 Sonstige Prüfungen

Sonstige Prüfungen	Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach
Schutzart	-	EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Verschmutzungsgrad	-	EN 60664-1: Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen

Tabelle 258: Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen sonstige Prüfungen

8.1 Schutzart

Prüfdurchführung nach	Grenzwerte nach EN 60529		
Bedeutung für den Schutz des Betriebsmittels	IP2. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\geq 12,5$ mm Durchmesser		
Bedeutung für den Schutz von Personen	IP2. Schutz gegen Zugang zu gefährlichen Teilen wie Fingern		
Schutz gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Wirkungen	IP0. Nicht geschützt		

Tabelle 259: Prüfanforderung Schutzart

9 Internationale Zulassungen

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.



Zulassungen	
USA und Kanada 	Alle wichtigen B&R Produkte sind von Underwriters Laboratories geprüft und gelistet und werden vierteljährlich durch einen UL-Inspektor überprüft. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert Ihnen die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.
Europa 	Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden selbstverständlich erfüllt.

Tabelle 260: Internationale Zulassungen

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status „Bad“, ausgetauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 261: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Allgemeines		
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C	
Elektrische Eigenschaften		
Kapazität	950 mAh	
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)	
Spannungsbereich	3V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		

Tabelle 262: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Lagerung	-20 bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	0 bis 95%	
Lagerung	0 bis 95%	
Transport	0 bis 95%	

Tabelle 262: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 263: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9		0TB103.91
Feldklemme			
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL		
Anzahl der Pole	3 (female)		
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme		Ausführung als Federzugklemme ²⁾
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)		
Kontaktabstand	5,08 mm		
Anschlussquerschnitt			
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14		AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen		0,20 bis 1,50 mm²	
eindrähtig		0,20 bis 2,50 mm²	
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²		0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse		0,20 bis 1,50 mm²	
Anzugsmoment	0,4 Nm		-
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	300 V		
Nennstrom ¹⁾	10 A / Kontakt		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ		

Tabelle 264: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

- 1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!
 2) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

3 Ersatz Lüfterfilter

3.1 Allgemeines

Information:

Die Lüfterfilter stellen ein Verschleißteil dar und müssen in einem angemessenen Zeitabstand kontrolliert werden, ob noch genügend Luftdurchlass für die Kühlung gewährleistet ist. Ein Austausch bzw. die Reinigung des Luftfilters ist dann sinngemäß.

3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.FA01-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX01-00; 5 Stk.	
5AC801.FA02-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk.	
5AC801.FA03-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX03-00; 5 Stk.	
5AC801.FA05-00	APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX05-00; 5 Stk.	

Tabelle 265: 5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten

4 DVI - Monitor Adapter

4.1 5AC900.1000-00

4.2 Allgemeines

Mit diesem Adapter ist es möglich, an der DVI-I Schnittstelle einen Standard-Monitor anzuschließen.

4.3 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Sonstiges	
5AC900.1000-00	Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.	

Tabelle 266: 5AC900.1000-00 - Bestelldaten

5 CompactFlash Karten

5.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

5.2 Grundlagen

CompactFlash Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- Verwendete Flashtechnologie
- Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash Speichers

5.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash Karten mit MLC (Multi Level Cell) und SLC (Single Level Cell) Flashbausteinen erhältlich.

SLC Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash Karten mit SLC Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

5.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer CompactFlash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- Kein Wear Leveling
- Dynamic Wear Leveling
- Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden. Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

5.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

5.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) ist ein Industriestandard für Massenspeicher der eingeführt wurde, um wichtige Parameter zu überwachen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung und Speicherung von kritischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzuständen vorherzusagen.

5.2.5 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

5.3 5CFCRD.xxxx-06

5.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 307

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 267: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

5.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-06	5CFCRD.1024-06	5CFCRD.2048-06	5CFCRD.4096-06	5CFCRD.016G-06	5CFCRD.032G-06
Allgemeines						
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre					
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen					
Lifetime Monitoring	Ja					
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)					
Wartung	keine					
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4					
kontinuierliches Lesen	typisch	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	36 MByte/s
	maximal	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	34 MByte/s	37 MByte/s
kontinuierliches Schreiben						

Tabelle 268: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-06	5CFCRD.1024-06	5CFCRD.2048-06	5CFCRD.4096-06	5CFCRD.016G-06	5CFCRD.032G-06
typisch	15 MByte/s	15 MByte/s	15 MByte/s	14 MByte/s	28 MByte/s	28 MByte/s
maximal	18 MByte/s	18 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	30 MByte/s	30 MByte/s
Zertifizierungen CE	Ja					
Endurance						
garantierte Datenmenge garantiert ¹⁾ ergibt bei 5 Jahren ¹⁾	50 TB 27,40 GByte/Tag	100 TB 54,79 GByte/Tag	200 TB 109,59 GByte/Tag	400 TB 219,18 GByte/Tag	1600 TB 876,72 GByte/Tag	3200 TB 1753,44 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen garantiert	100.000					
SLC-Flash	Ja					
Wear Leveling	statisch					
Error Correction Coding (ECC)	Ja					
S.M.A.R.T. Support	Ja					
Unterstützung						
Hardware	PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820					
Betriebssysteme						
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Ja					
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²⁾	Ja ²⁾
Windows CE 5.0	Nein					
Software						
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Deve- lopment Setup ≥ V3.0.0.3020)	≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Deve- lopment Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb	0 bis 70°C					
Lagerung	-65 bis 150°C					
Transport	-65 bis 150°C					
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	max. 85% bei 85°C					
Lagerung	max. 85% bei 85°C					
Transport	max. 85% bei 85°C					
Vibration						
Betrieb	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Schock						
Betrieb	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Lagerung	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Transport	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Meereshöhe						
Betrieb	max. 4.572 m					
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						
Breite	42,8 ±0,10 mm					
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe	3,3 ±0,10 mm					
Gewicht	10 g					

Tabelle 268: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CF-
CRD.4096-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

- 1) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
2) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

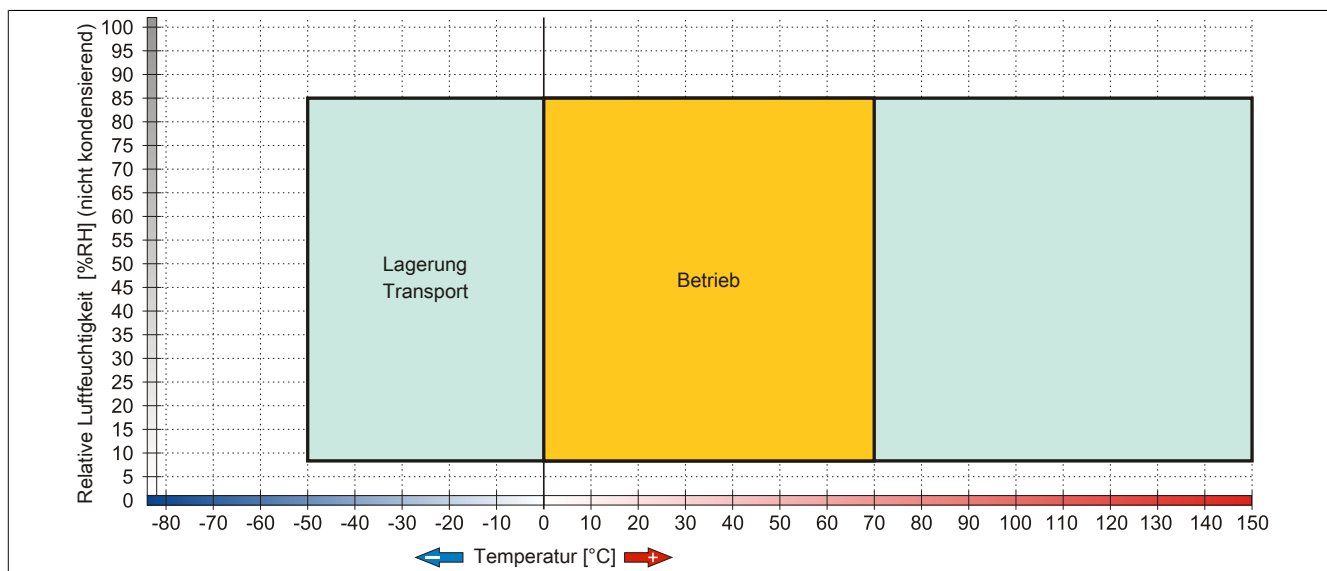


Abbildung 150: 5CFCD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.3.5 Abmessungen

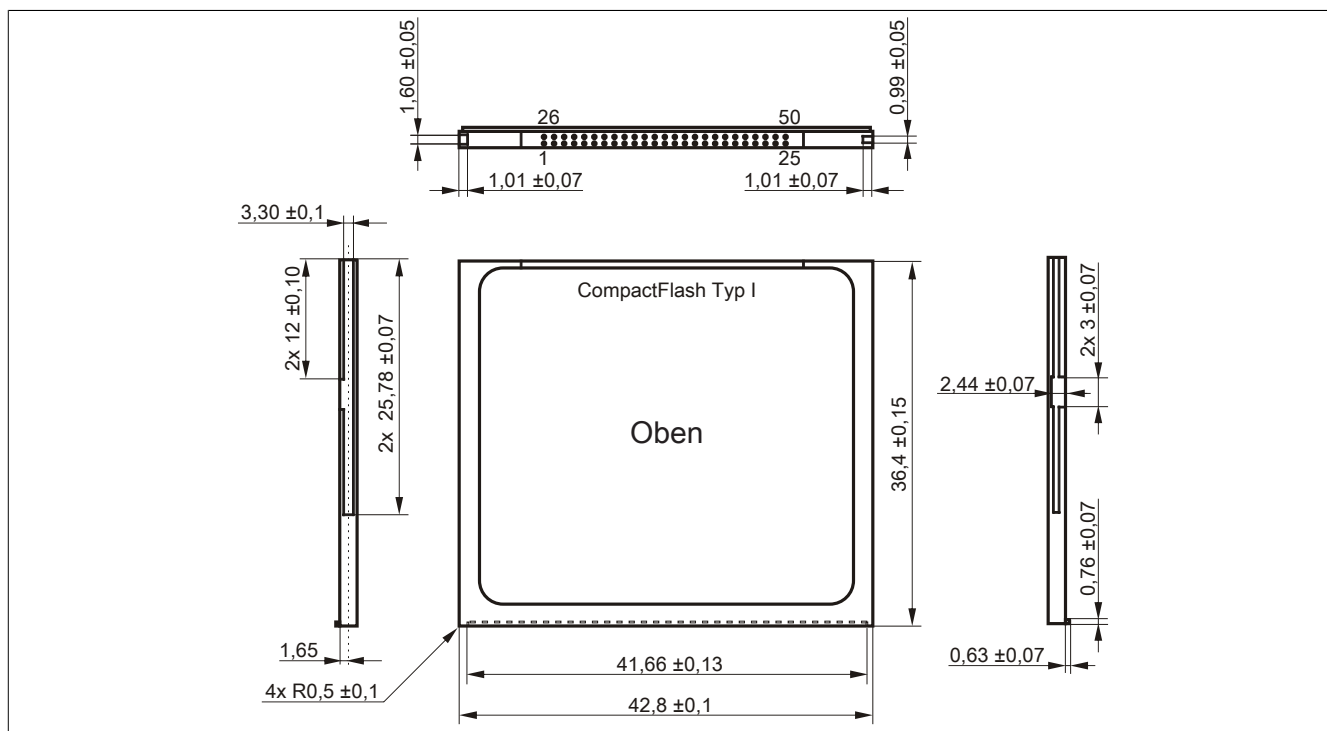


Abbildung 151: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.3.6 Benchmark

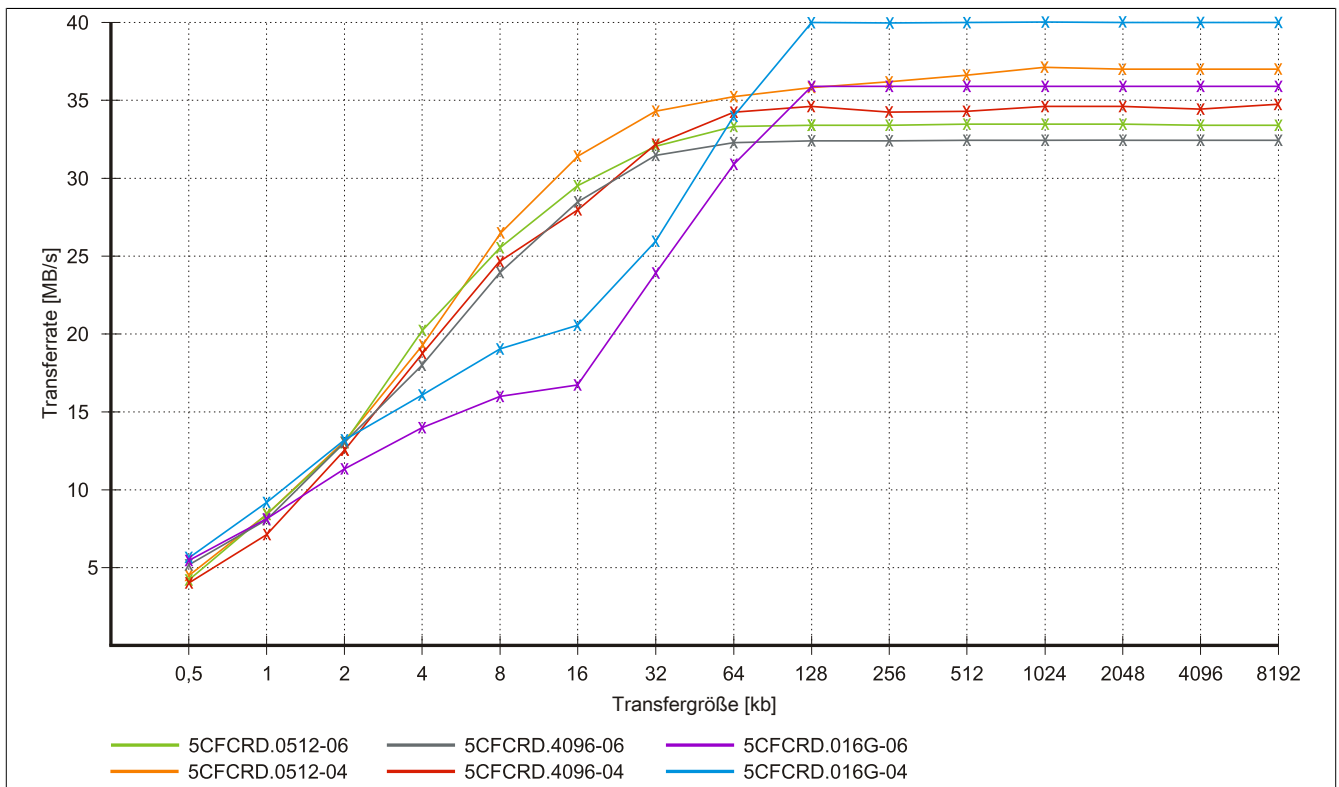


Abbildung 152: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

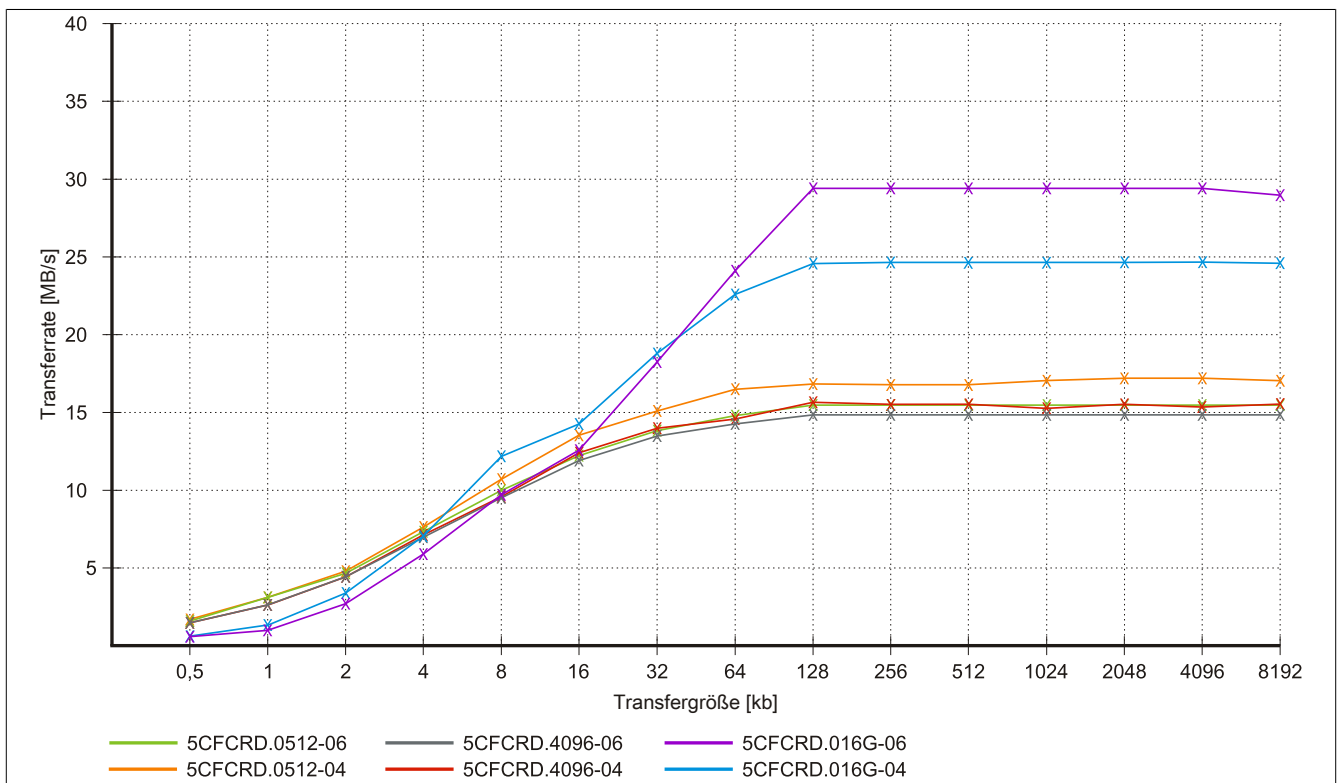


Abbildung 153: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

5.4 5CFCRD.xxxx-04

5.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 307

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

5.4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0512-04	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-04	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-04	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-04	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-04	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.016G-04	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 269: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten

5.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Allgemeines						
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre					
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen					
Lifetime Monitoring	Ja					
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)					
Wartung	keine					
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4					
kontinuierliches Lesen typisch	35 MByte/s (240X) ¹⁾	35 MByte/s (240X) ¹⁾	35 MByte/s (240X) ¹⁾	33 MByte/s (220X) ¹⁾	27 MByte/s (180X) ¹⁾	36 MByte/s (240X) ¹⁾

Tabelle 270: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
maximal	37 MByte/s (260X) ¹⁾	37 MByte/s (260X) ¹⁾	37 MByte/s (260X) ¹⁾	34 MByte/s (226X) ¹⁾	28 MByte/s (186X) ¹⁾	37 MByte/s (247X) ¹⁾
kontinuierliches Schreiben typisch	17 MByte/s (110X)	17 MByte/s (110X)	17 MByte/s (110X)	16 MByte/s (106X)	15 MByte/s (100X)	18 MByte/s (120X)
maximal	20 MByte/s (133X)	20 MByte/s (133X)	20 MByte/s (133X)	18 MByte/s (120X)	17 MByte/s (110X)	19 MByte/s (126X)
Zertifizierungen CE	Ja					
Endurance						
garantierte Datenmenge garantiert ²⁾ ergibt bei 5 Jahren ²⁾	50 TB 27,40 GByte/Tag	100 TB 54,79 GByte/Tag	200 TB 109,59 GByte/Tag	400 TB 219,18 GByte/Tag	800 TB 438,36 GByte/Tag	1600 TB 876,72 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen typisch ³⁾ garantiert	2.000.000 100.000					
SLC-Flash	Ja					
Wear Leveling	statisch					
Error Correction Coding (ECC)	Ja					
S.M.A.R.T. Support	Nein					
Unterstützung						
Hardware	PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820					
Betriebssysteme						
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein					
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Ja					
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ⁴⁾
Windows CE 5.0	Nein					
Software						
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.0.3020)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb	0 bis 70°C					
Lagerung	-65 bis 150°C					
Transport	-65 bis 150°C					
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	max. 85% bei 85°C					
Lagerung	max. 85% bei 85°C					
Transport	max. 85% bei 85°C					
Vibration						
Betrieb	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)					
Schock						
Betrieb	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Lagerung	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Transport	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)					
Meereshöhe						
Betrieb	max. 4.572 m					
Mechanische Eigenschaften						
Abmessungen						

Tabelle 270: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CF-
CRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD.0512-04	5CFCRD.1024-04	5CFCRD.2048-04	5CFCRD.4096-04	5CFCRD.8192-04	5CFCRD.016G-04
Breite	42,8 ±0,10 mm					
Länge	36,4 ±0,15 mm					
Höhe	3,3 ±0,10 mm					
Gewicht	10 g					

Tabelle 270: 5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CF-CRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten

- 1) Geschwindigkeitsangaben mit 1X = 150 kByte/s. Alle Angaben beziehen sich auf die Samsung Flash Chips, CompactFlash Karte in UDMA Mode 4, Zykluszeit 30 ns in True-IDE Mode mit sequentiellm Schreiben/Lesen- Test.
- 2) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
- 3) Abhängig von der durchschnittlichen Filegröße.
- 4) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

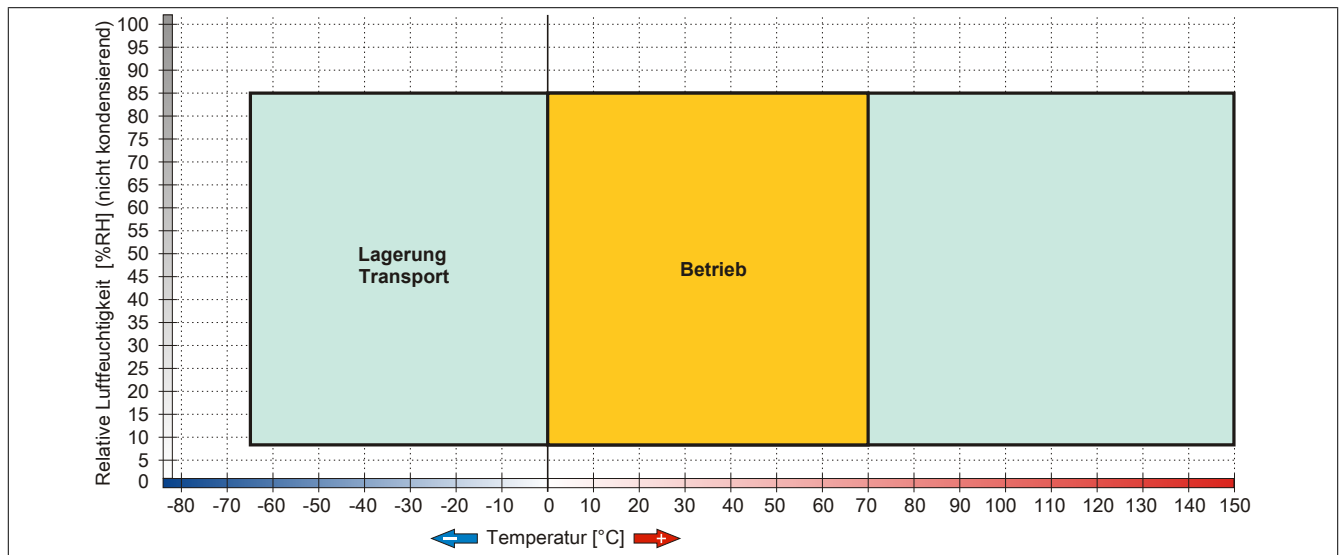


Abbildung 154: 5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.4.5 Abmessungen

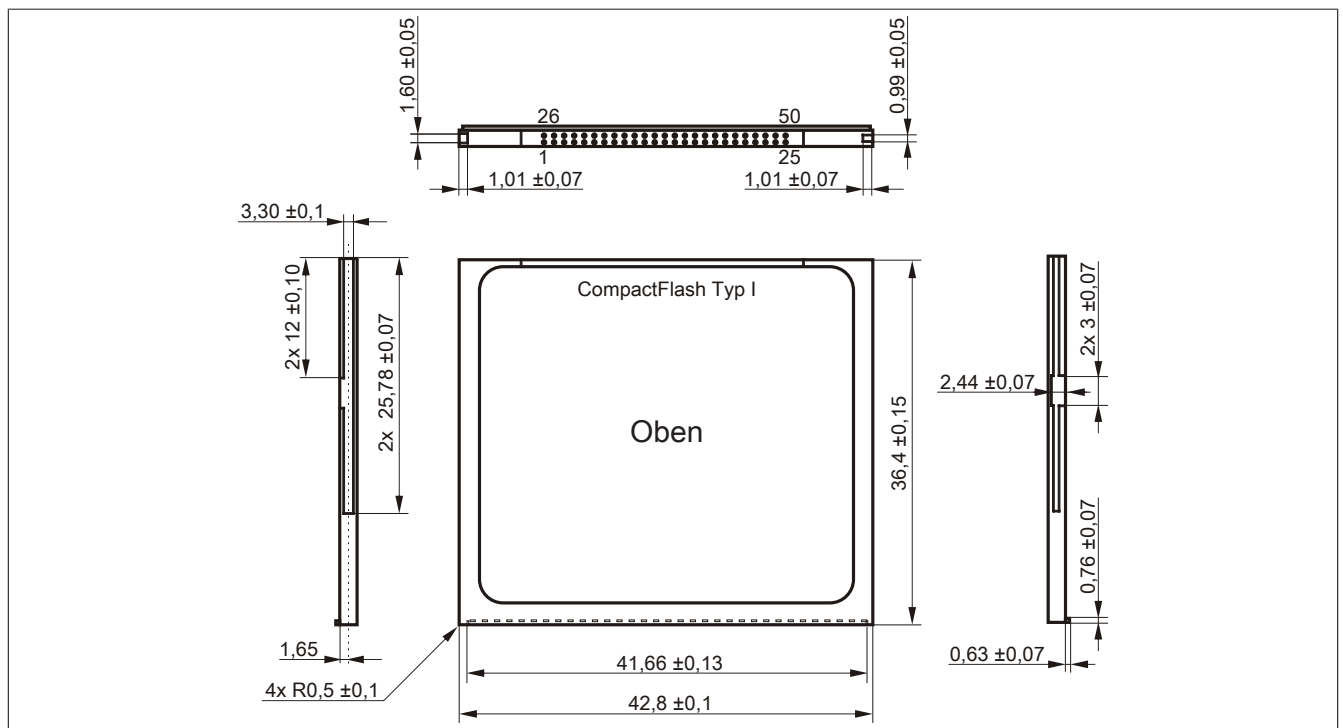


Abbildung 155: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.4.6 Benchmark

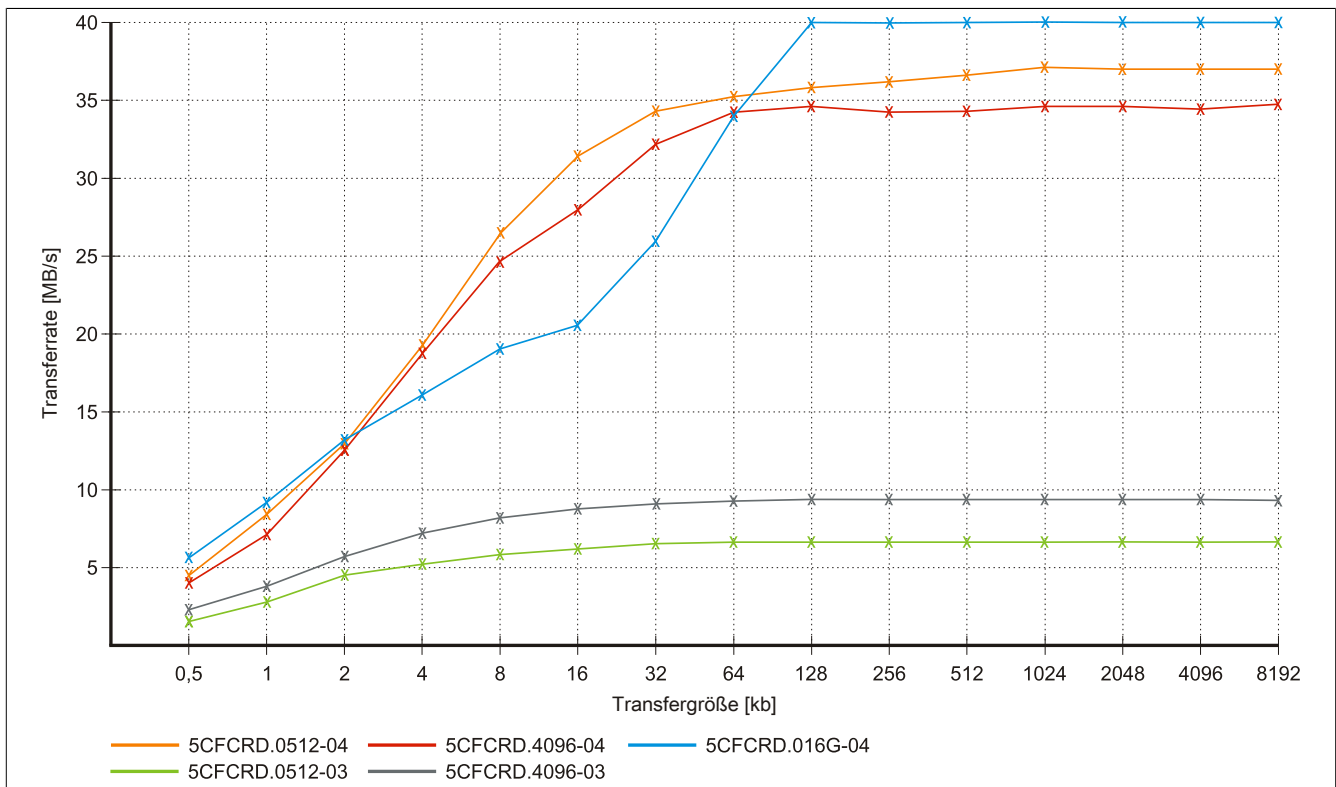


Abbildung 156: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

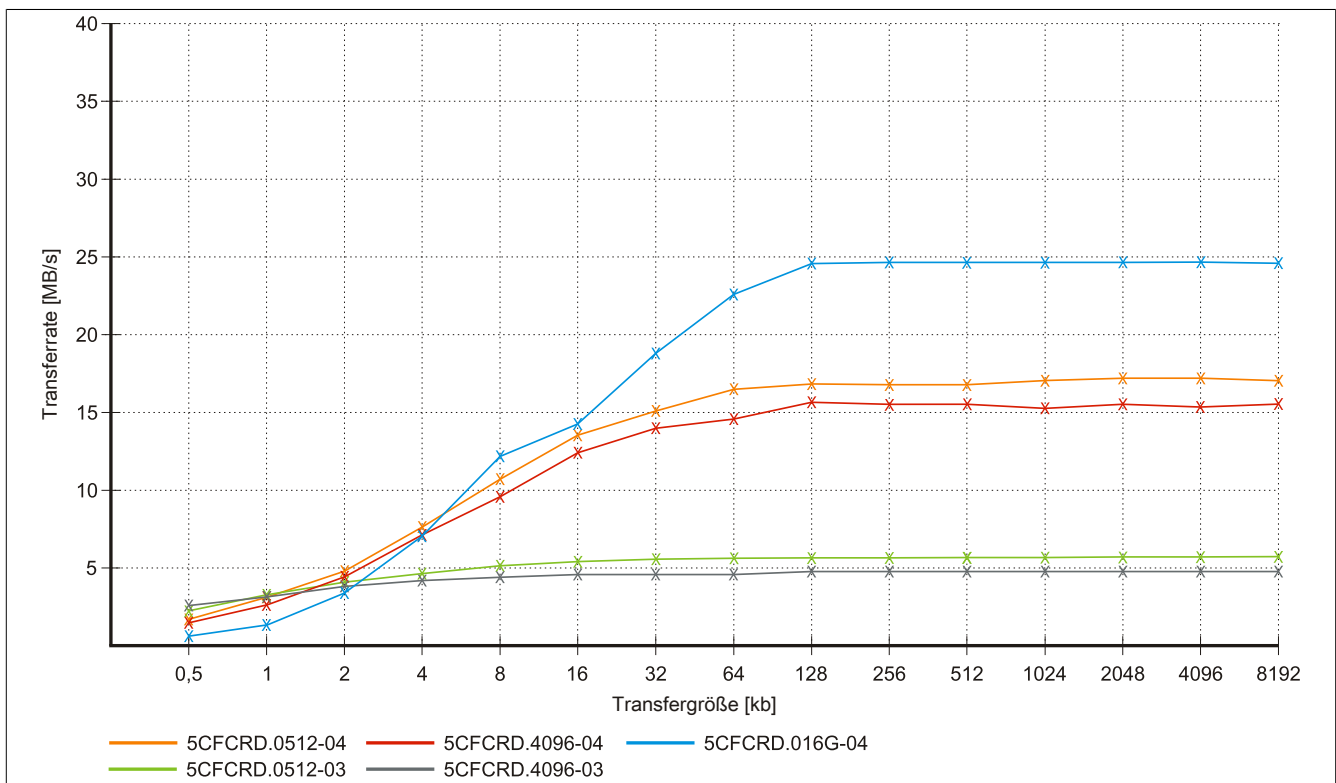


Abbildung 157: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04

5.5 5CFCRD.xxxx-03

5.5.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx- 03 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 307

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1GB unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

5.5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	

Tabelle 271: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

5.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD.0064-03	5CFCRD.0128-03	5CFCRD.0256-03	5CFCRD.0512-03	5CFCRD.1024-03	5CFCRD.2048-03	5CFCRD.4096-03	5CFCRD.8192-03
Allgemeines								
Kapazität	64 MByte	128 MByte	256 MByte	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre							
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen							

Tabelle 272: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0064-03	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD. 1024-03	5CFCRD. 2048-03	5CFCRD. 4096-03	5CFCRD. 8192-03
Lifetime Monitoring	Ja							
MTBF	> 4.000.000 Stunden (bei 25°C)							
Wartung	keine							
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-4, Multiword DMA Mode 0-2							
kontinuierliches Lesen typisch	8 MByte/s							
kontinuierliches Schreiben typisch	6 MByte/s							
Zertifizierungen CE	Ja							
Endurance								
Lösch- / Schreibzyklen typisch	> 2.000.000							
SLC-Flash	Ja							
Wear Leveling	statisch							
Error Correction Coding (ECC)	Ja							
S.M.A.R.T. Support	Nein							
Unterstützung								
Hardware	MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820							
Betriebssysteme								
Windows 7 32-Bit	Nein							
Windows 7 64-Bit	Nein							
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein							
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Embedded	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ¹⁾
Windows CE 5.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Software								
PVI Transfer Tool	≥ V2.57 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.5.3.3005)							
B&R Embedded OS Installer	≥ V2.21							
Umgebungsbedingungen								
Temperatur								
Betrieb	0 bis 70°C							
Lagerung	-50 bis 100°C							
Transport	-50 bis 100°C							
Luftfeuchtigkeit								
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend							
Vibration								
Betrieb	max. 16,3 g (159 m/s² 0-peak)							
Lagerung	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Transport	max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Schock								
Betrieb	max. 1000 g (9810 m/s² 0-peak)							
Lagerung	max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Transport	max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Meereshöhe								
Betrieb	max. 24.383 m							
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen								
Breite	42,8 ±0,10 mm							
Länge	36,4 ±0,15 mm							
Höhe	3,3 ±0,10 mm							
Gewicht	11,4 q							

Tabelle 272: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

1) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

5.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

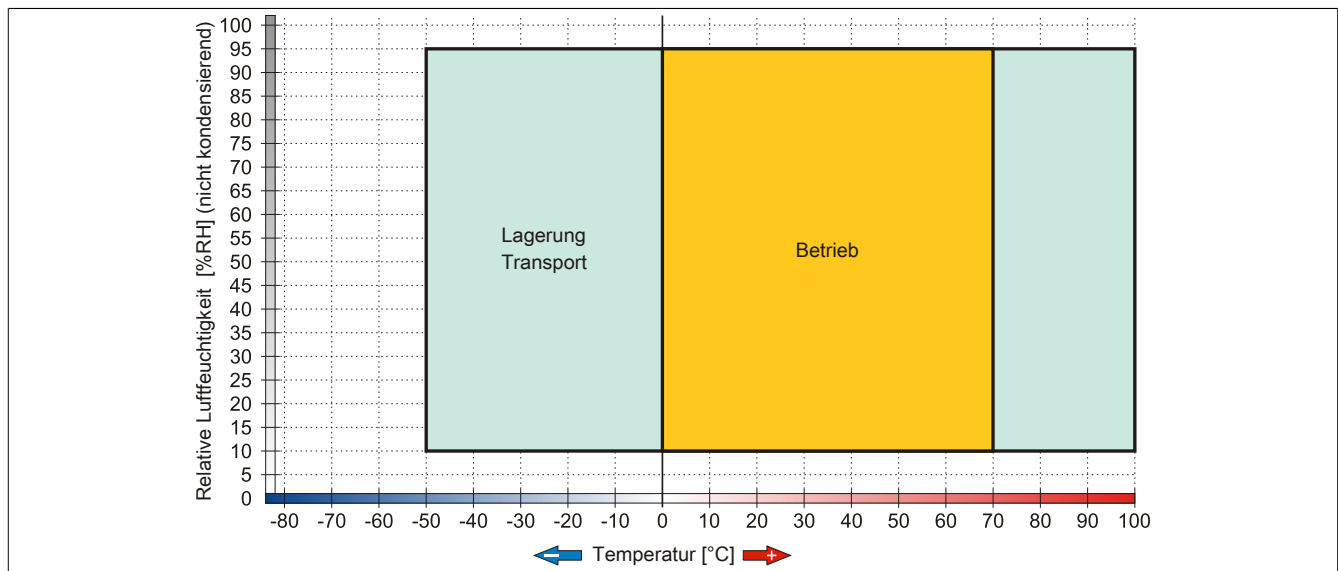


Abbildung 158: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

5.5.5 Abmessungen

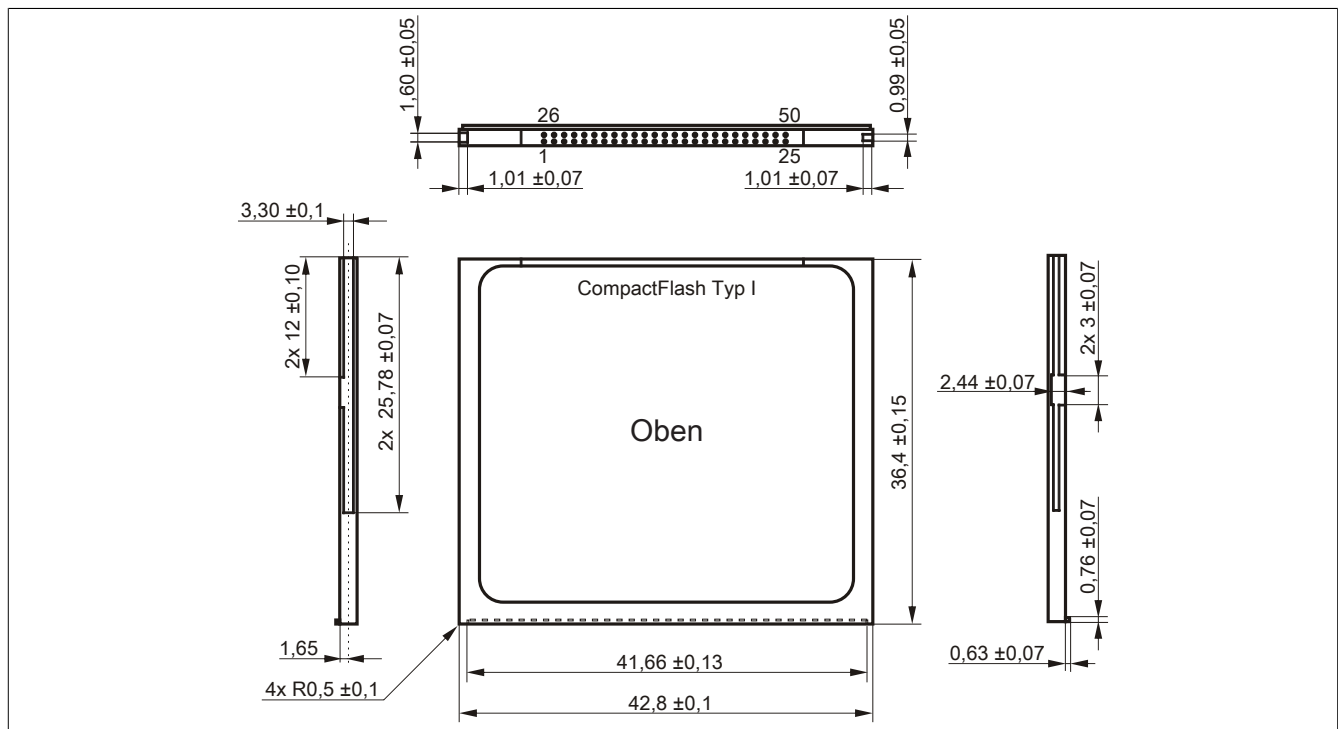


Abbildung 159: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

5.6 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

- Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

6 USB Media Drive

6.1 5MD900.USB2-01

6.1.1 Allgemeines

Das USB Media Drive ist eine Laufwerkskombination aus Disketten-, DVD-RW/CD-RW- Laufwerk, CompactFlash Slot und rück- und frontseitigem USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes USB Diskettenlaufwerk
- Integriertes DVD-RW/CD-RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss (bis zu 480 MBit High Speed)
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB/B 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

6.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-01	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, FDD, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUT1.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	

Tabelle 273: 5MD900.USB2-01 - Bestelldaten

6.1.3 Schnittstellen

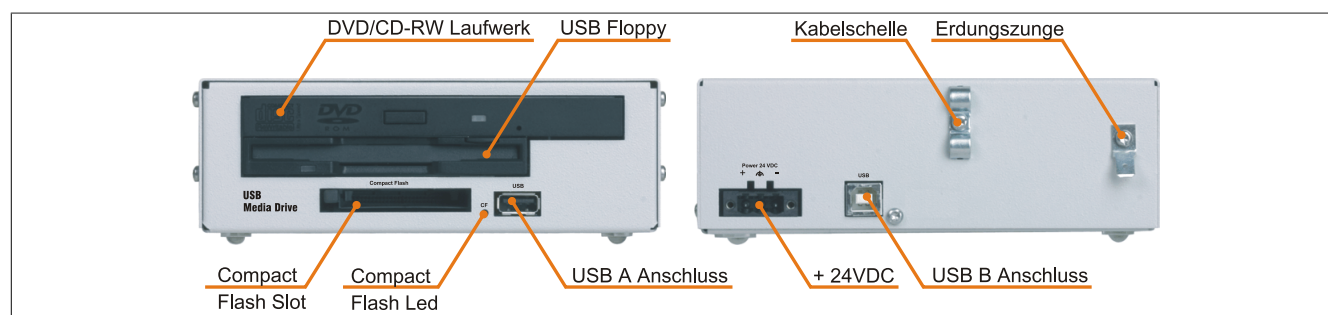


Abbildung 160: 5MD900.USB2-01 - Schnittstellen

6.1.4 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Typ	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	8 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm $\pm 1\%$
Geräuschpegel	ca. 48 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	130 ms (24x)
DVD	130 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 - 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 - 4x
DVD+RW	3,3 - 8x
DVD-R	2 - 6x
DVD-R (Double Layer)	2 - 4x
DVD-RAM	3 - 5x
DVD-RW	2 - 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential, Multi-session
Diskettenlaufwerk	
Datentransferrate	250 kBit/s (720 KByte) bzw. 500 kBit/s (1.25 MByte und 1.44 MByte)
Diskettenmedien	High Density (2HD) oder Normal Density (2DD) 3.5" Disketten
Kapazität	720 KByte / 1.25 MByte / 1.44 MByte (formatiert)
MTBF	30.000 POH (Power on Hours)
Rotationsgeschwindigkeit	bis zu 360 rpm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC $\pm 25\%$

Tabelle 274: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-01
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 274: 5MD900.USB2-01 - Technische Daten

1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

6.1.5 Abmessungen

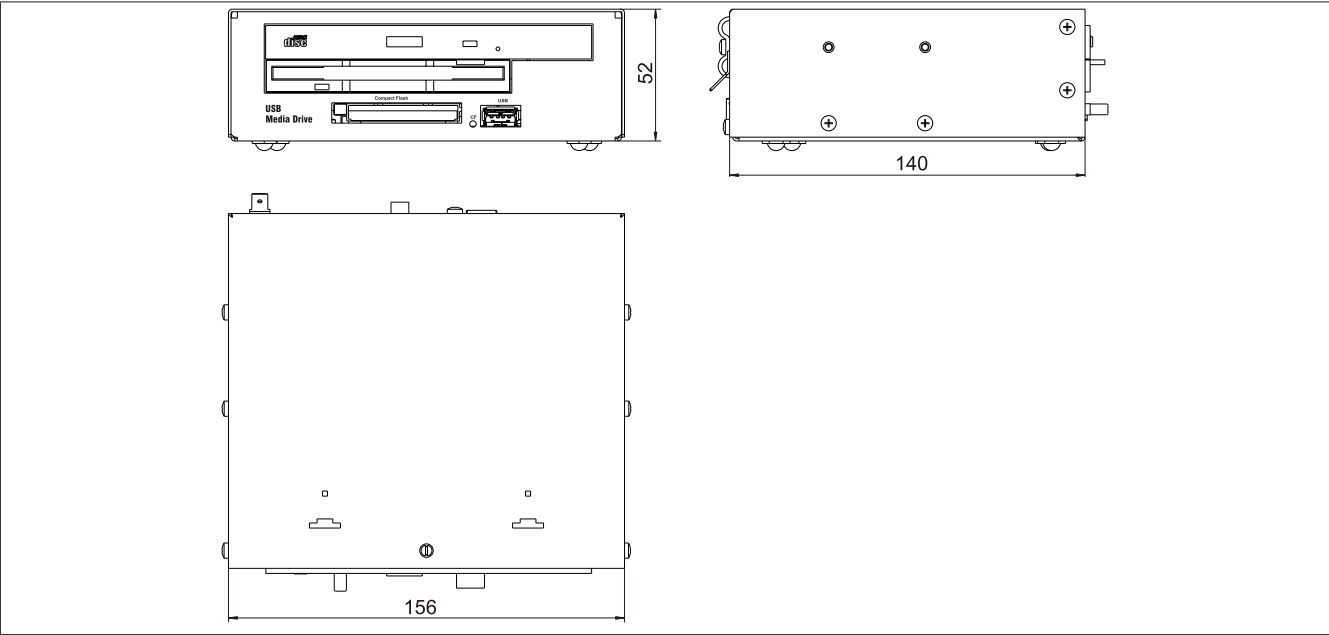


Abbildung 161: 5MD900.USB2-01 - Abmessungen

6.1.6 Abmessungen mit Frontklappe

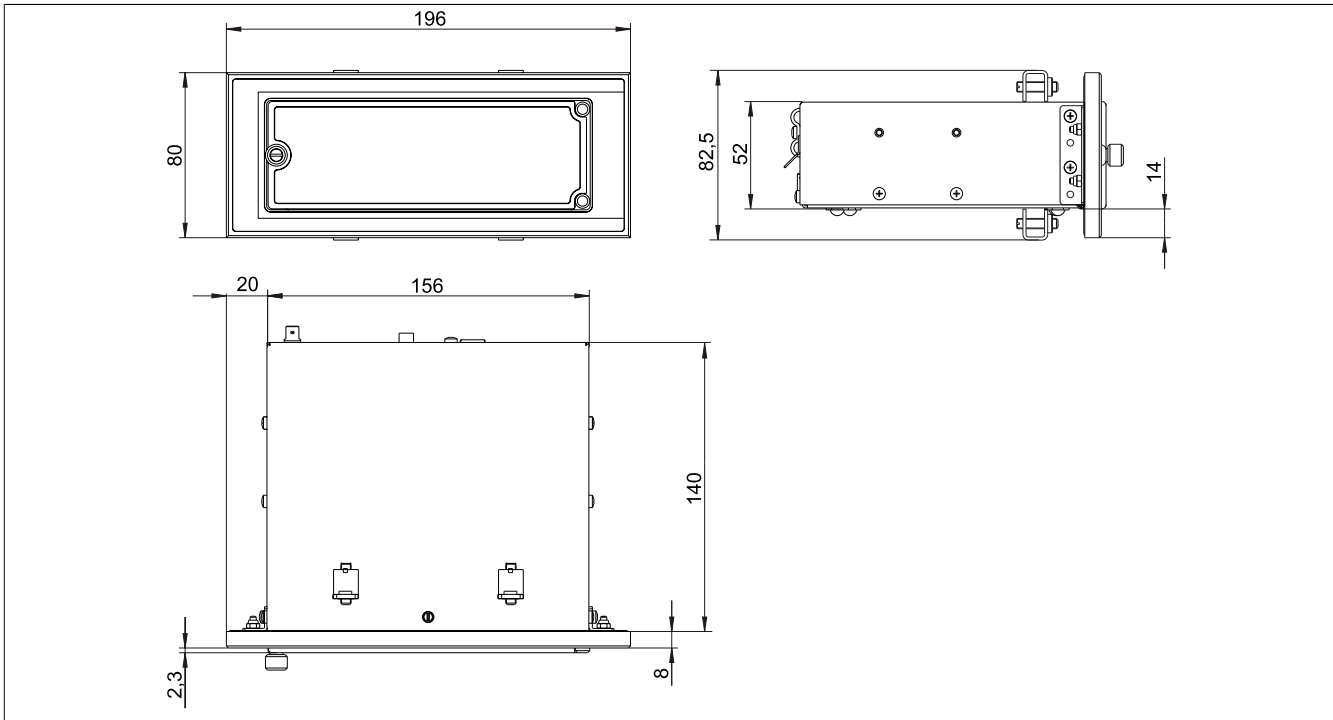


Abbildung 162: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche

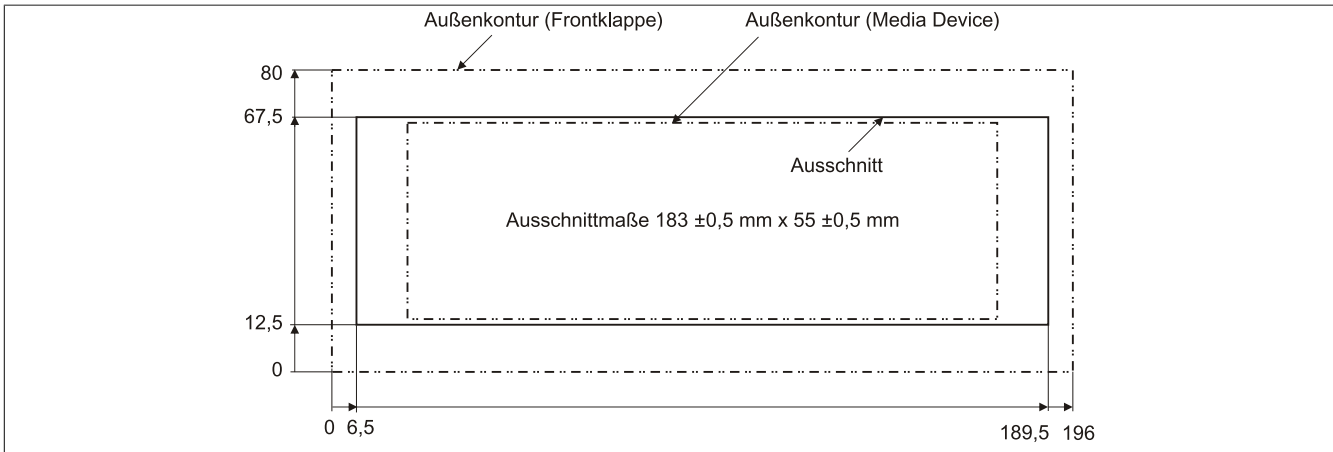


Abbildung 163: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienwinkel

Tabelle 275: 5MD900.USB2-01 - Lieferumfang

6.1.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienwinkel werden beige packt) geeignet.

Einbaulagen

Aufgrund der beschränkten Einbaulage bei den verwendeten Komponenten (Floppy, DVDCDRW Laufwerk) darf das USB Media Drive Laufwerk nur wie folgt abgebildet montiert und betrieben werden.

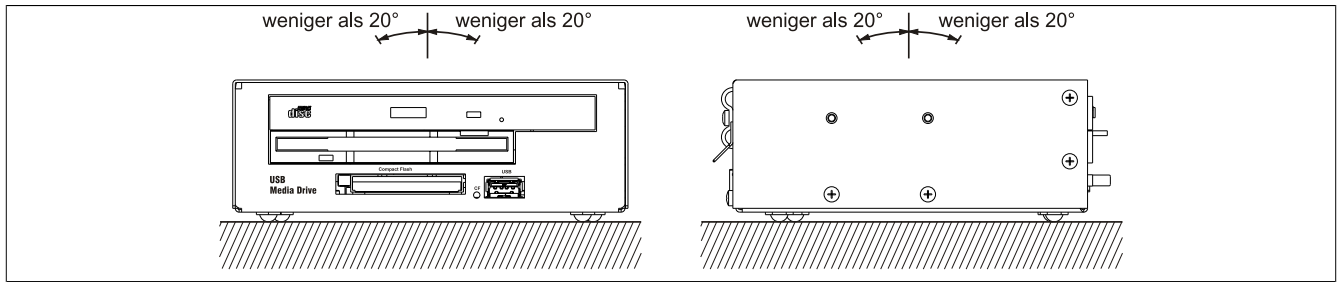


Abbildung 164: 5MD900.USB2-01 - Einbaulage

6.2 5MD900.USB2-02

6.2.1 Allgemeines

Das USB Media Drive besitzt ein DVD-R/RW DVD+R/RW- Laufwerk, einen CompactFlash Slot sowie einen rück- und frontseitigen USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes DVD-R/RW DVD+R/RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

6.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUT1.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 276: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten

6.2.3 Schnittstellen

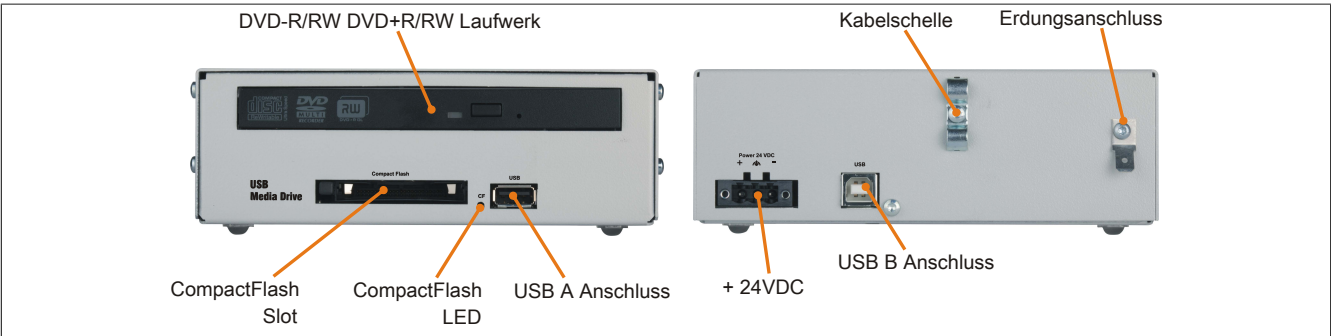


Abbildung 165: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen

6.2.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Typ	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	

Tabelle 277: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm $\pm 1\%$
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	typ. 140 ms (24x)
DVD	typ. 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 bis 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 bis 4x
DVD+RW	3,3 bis 8x
DVD-R	2 bis 6x
DVD-R (Double Layer)	2 bis 4x
DVD-RAM	3 bis 5x
DVD-RW	2 bis 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC $\pm 25\%$
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s ² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	

Tabelle 277: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 277: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

- 1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

6.2.5 Abmessungen

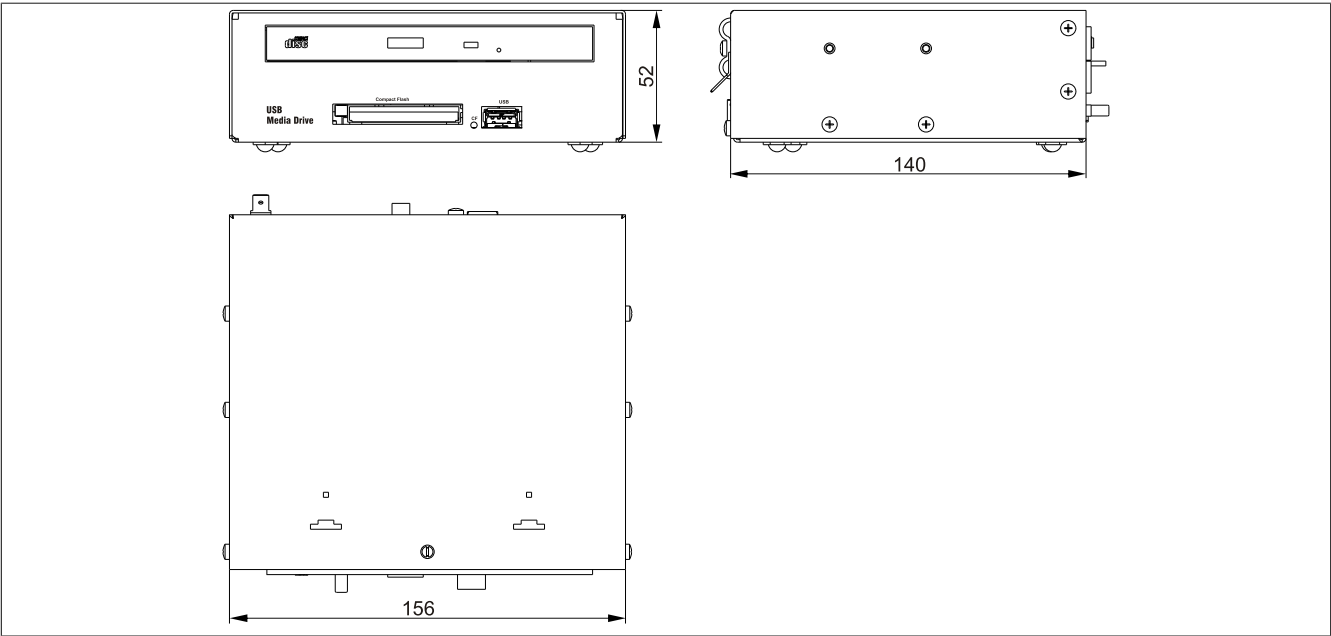


Abbildung 166: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen

6.2.6 Abmessungen mit Frontklappe

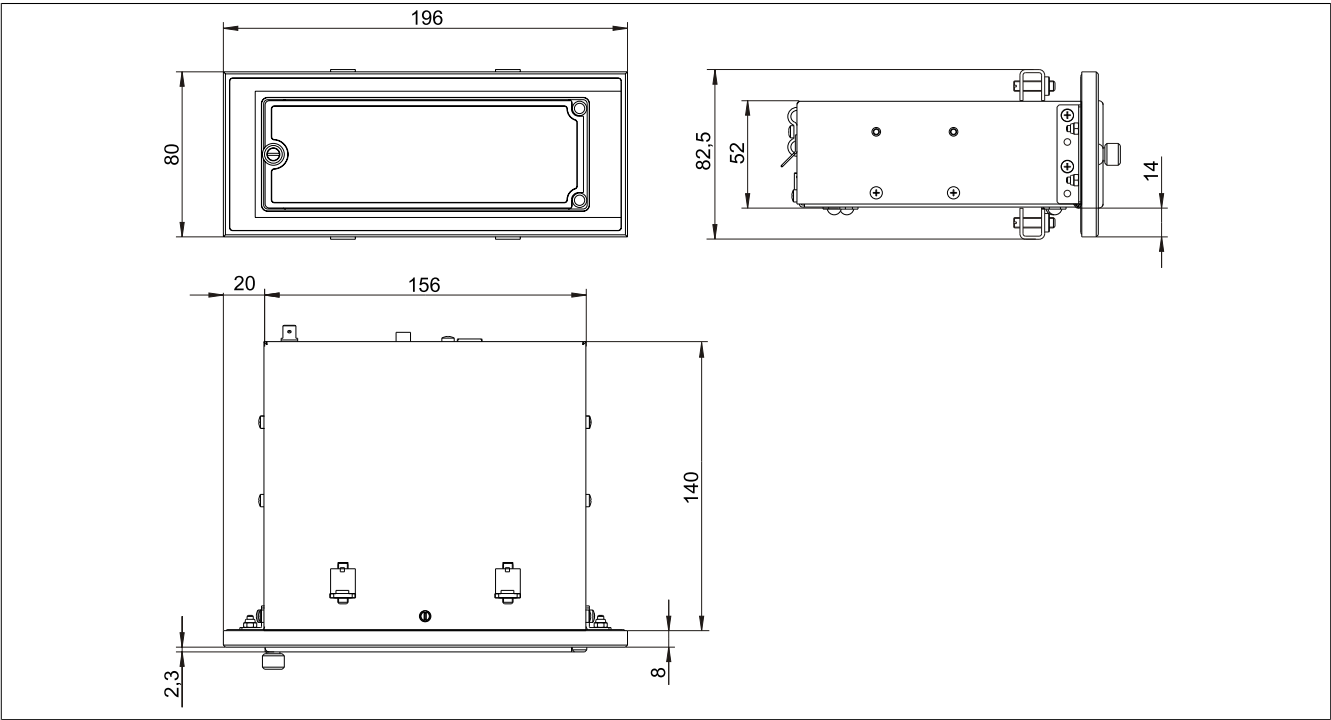


Abbildung 167: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.7 Einbau in Wanddurchbrüche

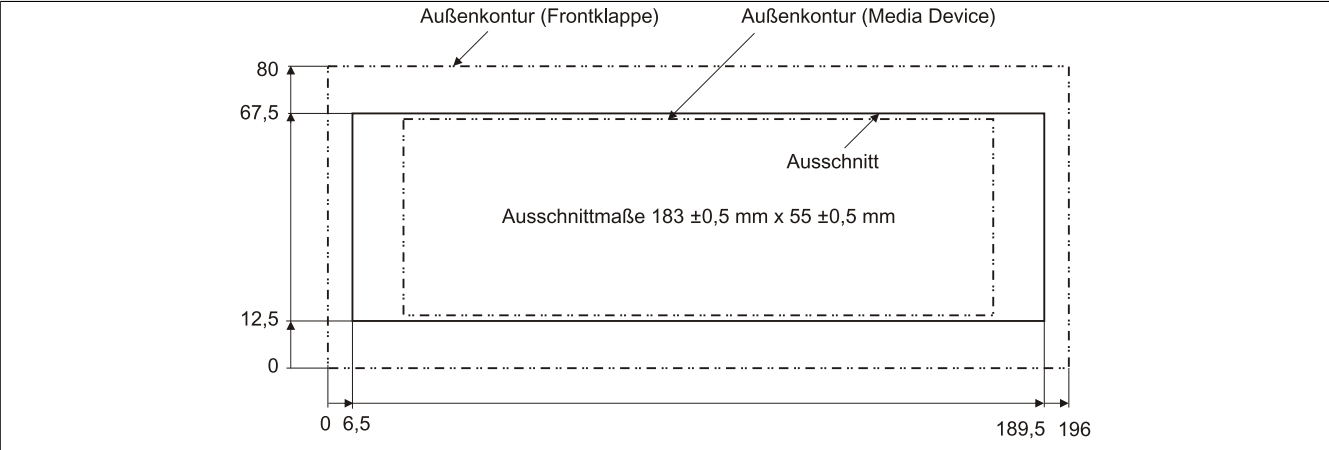


Abbildung 168: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6.2.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschiene Winkel

Tabelle 278: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang

6.2.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschiene Winkel werden beige packt) geeignet.

Einbaulagen

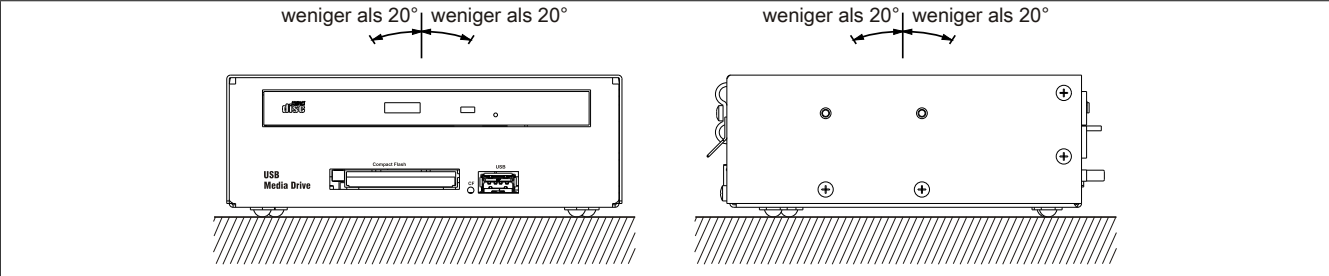


Abbildung 169: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage

6.3 5A5003.03

6.3.1 Allgemeines

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	

Tabelle 279: 5A5003.03 - Bestelldaten

6.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5A5003.03
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Dekorfolie	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen	
Breite	196 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	8 mm

Tabelle 280: 5A5003.03 - Technische Daten

6.3.4 Abmessungen

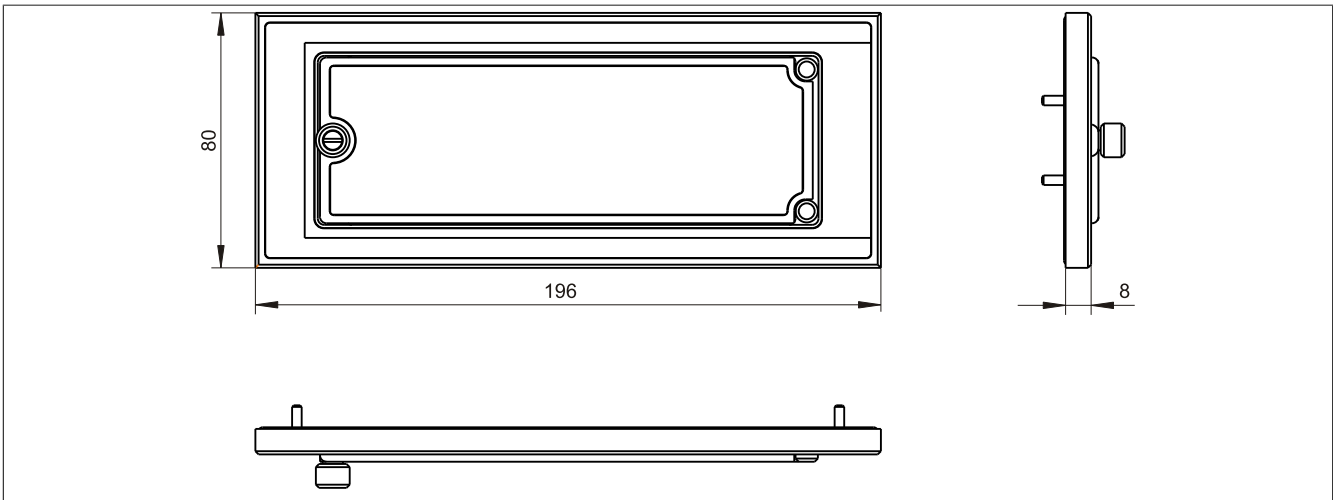


Abbildung 170: 5A5003.03 - Abmessungen

6.3.5 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive
4	M3 Sicherungsmutter
4	Haube Halteklammer

Tabelle 281: 5A5003.03 - Lieferumfang

6.3.6 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.

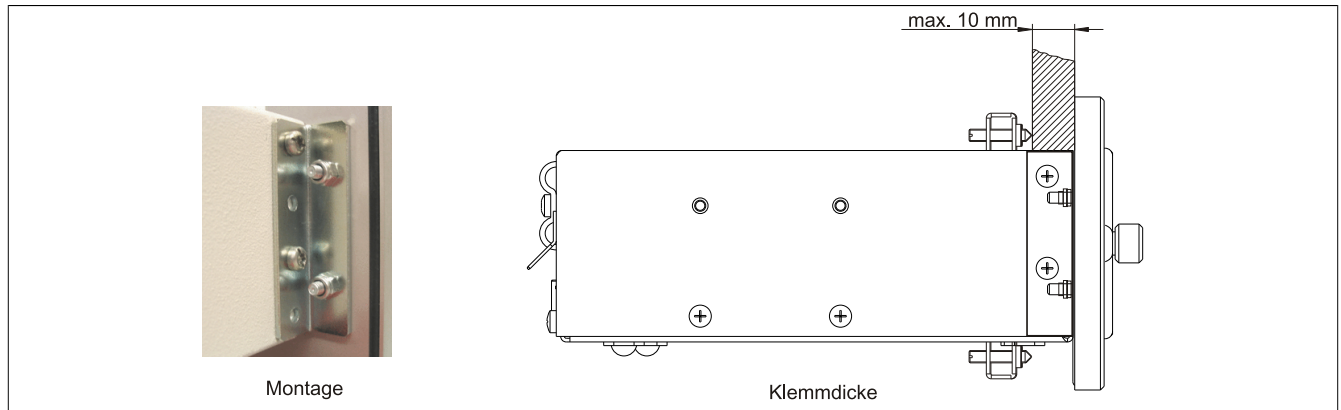


Abbildung 171: Frontklappenmontage und Klemmdicke

Einbau in Wanddurchbrüche

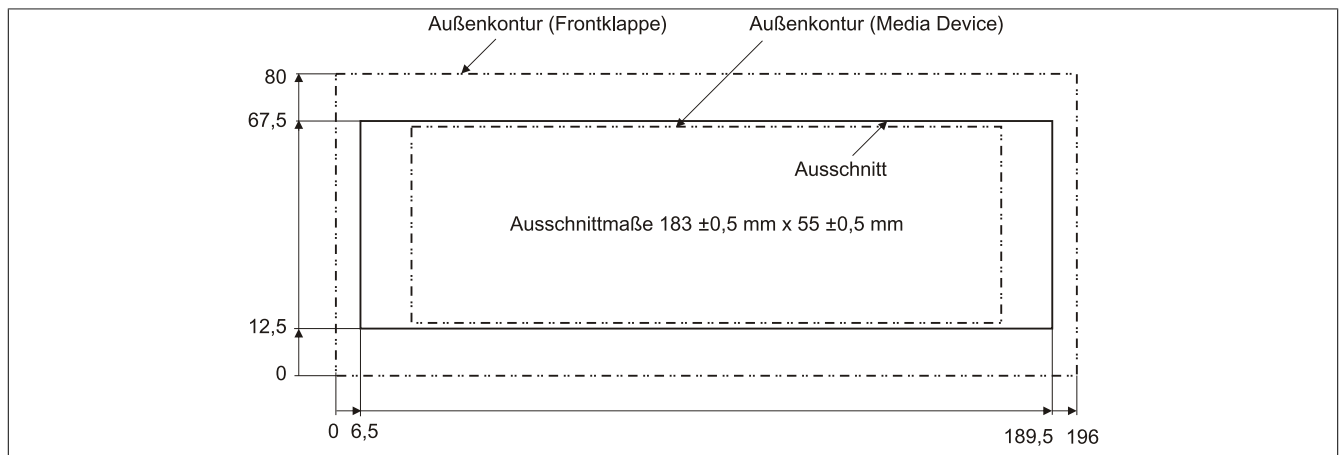


Abbildung 172: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

7 USB Memory Sticks

7.1 5MMUSB.2048-00

7.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können. Es kommen USB Memory Sticks des Speicherspezialisten SanDisk zum Einsatz.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Controller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk/mbr“ auf den USB Memory Stick ausgeführt wird.

7.1.2 Bestelldaten

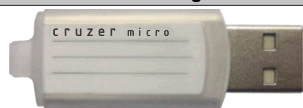
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5MMUSB.2048-00	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte	

Tabelle 282: 5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten

7.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöriteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Allgemeines	
Datenerhaltung	10 Jahre
LEDs	1 LED (grün) ¹⁾
MTBF	100.000 Stunden (bei 25°C)
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen CE	Ja
Schnittstellen	
USB	
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 8,7 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 1,7 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	650 µA Schlafmodus, 150 mA Lesen/Schreiben

Tabelle 283: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-00
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	10 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 90%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Lagerung	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Transport	10 bis 500 Hz: 2 g (19,6 m/s² 0-peak), Schwingungsrate 1/Minute
Schock	
Betrieb	max. 40 g (392 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Lagerung	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Transport	max. 80 g (784 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3048 m
Lagerung	max. 12192 m
Transport	max. 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	19 mm
Länge	52,2 mm
Höhe	7,9 mm

Tabelle 283: 5MMUSB.2048-00 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

7.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

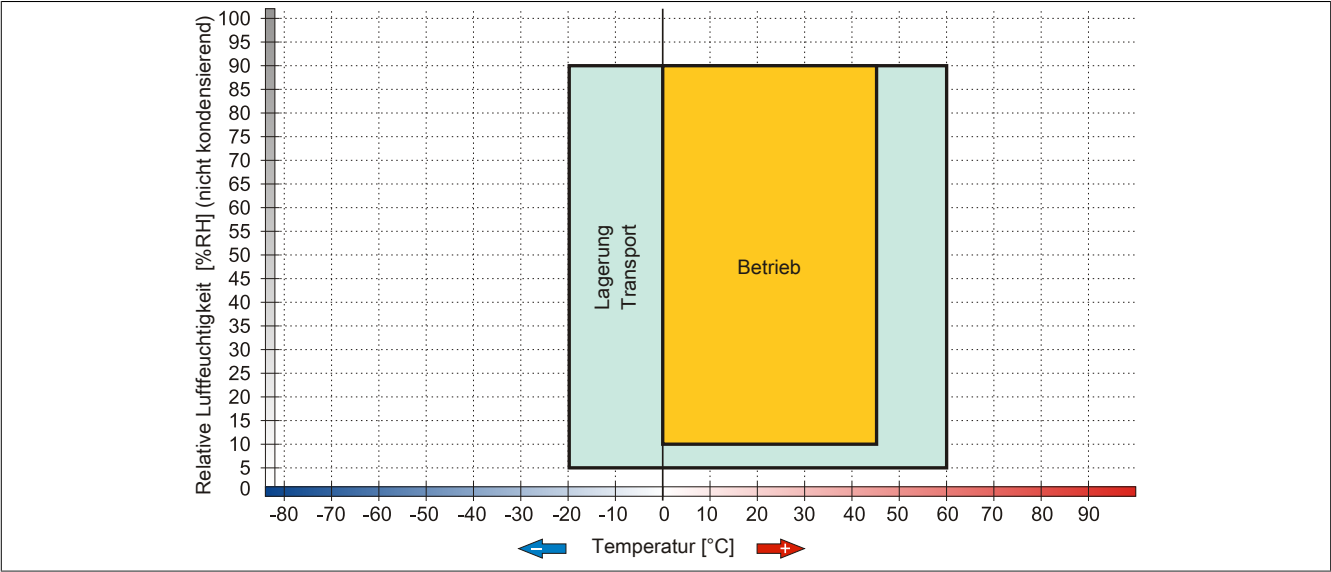


Abbildung 173: 5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

7.2 5MMUSB.2048-01

7.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
 - Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Controller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk / mbr“ auf den USB Memory Stick ausgeführt wird.
- USB 1.1, USB 2.0
 - Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
 - Hohe Datenerhaltung
 - Umgebungstemperatur Betrieb: 0 bis 70°C

7.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R	

Tabelle 284: 5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten

7.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01
Allgemeines	
Datenerhaltung	> 10 Jahre
LEDs	1 LED (grün) ¹⁾
MTBF	> 3.000.000 Stunden
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Wartung	keine
Zertifizierungen CE	Ja
Schnittstellen	
USB	
Typ	USB 1.1, USB 2.0
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
sequentielles Lesen	max. 31 MByte/s
sequentielles Schreiben	max. 30 MByte/s
Unterstützung	
Betriebssysteme	
Windows 7	Ja
Windows XP Professional	Ja
Windows XP Embedded	Ja
Windows ME	Ja
Windows 2000	Ja
Windows CE 5.0	Ja
Windows CE 4.2	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Stromaufnahme	max. 500 µA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C

Tabelle 285: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01
Lagerung	-50 bis 100°C
Transport	-50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	85%, nicht kondensierend
Lagerung	85%, nicht kondensierend
Transport	85%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)
Schock	
Betrieb	max. 1500 g (peak)
Lagerung	max. 1500 g (peak)
Transport	max. 1500 g (peak)
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3048 m
Lagerung	max. 12192 m
Transport	max. 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	17,97 mm
Länge	67,85 mm
Höhe	8,35 mm

Tabelle 285: 5MMUSB.2048-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

7.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

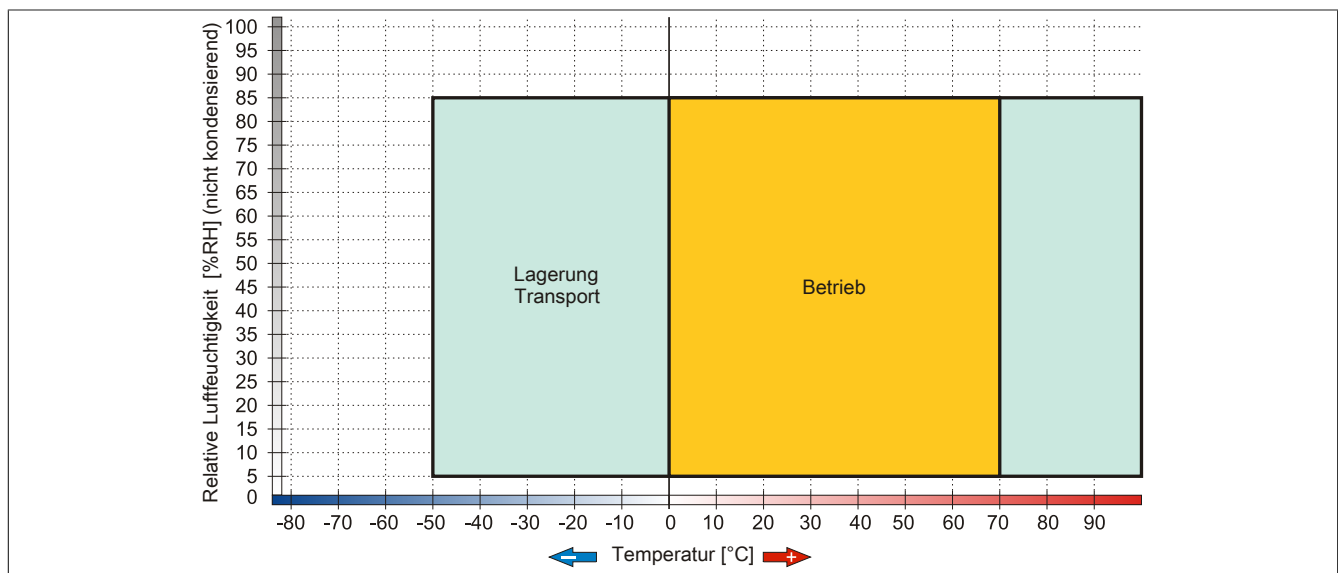


Abbildung 174: 5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

8 HMI Drivers & Utilities DVD

8.1 5SWHMI.0000-00

8.1.1 Allgemeines

Diese DVD beinhaltet Treiber, Utilities, Softwareupgrades und Anwenderhandbücher für B&R Panel System Produkte (siehe B&R Homepage www.br-automation.com - Bereich Industrie PCs bzw. Visualisieren und Bedienen).

Der Inhalt der DVD ist zum Zeitpunkt der Erstellung mit denen unter dem Downloadbereich auf der B&R Homepage (unter Service - "Produktbezogene Downloads") befindlichen Dateien ident.

8.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5SWHMI.0000-00	Sonstiges HMI Drivers & Utilities DVD	

Tabelle 286: 5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten

8.1.3 Inhalt (V2.10)

BIOS Upgrades für die Produkte

- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 815E und 855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board X855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME N270 BIOS
- Automation PC 680
- Automation PC 810 / Automation PC 820 / Panel PC 800 B945GME BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 945GME N270 CPU Board BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 GM45 CPU Board BIOS
- Provit 2000 Produktfamilie - IPC2000/2001/2002
- Provit 5000 Produktfamilie - IPC5000/5600/5000C/5600C
- Power Panel 100 BIOS Geräte
- Mobile Panel 100 BIOS Geräte
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 User Boot Logo
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 REMHOST Utility
- Power Panel 300/400 BIOS Geräte
- Power Panel 300/400 BIOS User Boot Logo
- Panel PC 310

Treiber für die Geräte

- Automation Device Interface (ADI)
- Audio
- Chipset
- CD-ROM
- LS120
- Grafik
- Netzwerk

- PCI / SATA RAID Controller
- Touch Screen
- Touch Pad
- Schnittstellenkarte

Firmware Upgrades

- Automation PC 620 / Panel PC 700 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 810 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 820 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Mobile Panel 100 (SMCX)
- Panel PC 300 (MTCX)
- Power Panel 100 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (MTCX)
- Panel PC 800 (MTCX, SDLR, SDLT)
- USV Firmware

Utilities / Tools

- B&R Embedded OS Installer
- Windows CE Tools
- User Boot Logo Konvertierungsprogramm
- SATA RAID Installations Utility
- Automation Device Interface (ADI)
- CompactFlash Lebensdauerrechner (Silicon Systems)
- Miscellaneous
- MTC Utilities
- Key Editor
- MTC & Mkey Utilities
- Mkey Utilities
- USV Konfigurationssoftware
- ICU ISA Konfiguration
- Intel PCI NIC Boot ROM
- Diagnoseprogramme

Windows

- Windows CE 6.0
- Windows CE 5.0
- Windows CE 4.2
- Windows CE 4.1
- Windows CE Tools
- Windows Embedded Standard 2009
- Thin Client
- Windows NT Embedded
- Windows XP Embedded
- VNC Viewer

MCAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- Visualisieren und Bedienen Geräte
- Einschubstreifenvordrucke
- Kundenspezifische Designs

ECAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- Automation PCs
- Automation Panel 900
- Panels (Power Panel)

Dokumentationen für

- Automation PC 620
- Automation PC 680
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation Panel 800
- Automation Panel 900
- Panel PC 310
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 15/21/35/41
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Mobile Panel Anschlussbox
- Provit 2000
- Provit 3030
- Provit 4000
- Provit 5000
- Provit Benchmark
- Provit Mkey
- Windows CE 5.0 Hilfe
- Windows CE 6.0 Hilfe
- Windows NT Embedded Applikation Guide
- Windows XP Embedded Applikation Guide
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Implementierungsanleitungen
- B&R Hilscher Feldbus Karten (CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET)

Service Tools

- Acrobat Reader 5.0.5 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Power Archiver 6.0 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Internet Explorer 5.0 (Deutsch und Englisch)
- Internet Explorer 6.0 (Deutsch und Englisch)

9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Der B&R Industrie PC sorgt mit der optionalen integrierten USV dafür, dass das PC System auch nach einem Spannungsausfall Schreibvorgänge zu Ende führen kann. Erkennt die USV einen Spannungsausfall wird unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umgeschaltet. Alle laufenden Programme werden durch die USV Software korrekt beendet. Inkonsistente Daten sind damit ausgeschlossen (funktioniert nur wenn die USV bereits konfiguriert wurde und der Treiber aktiviert ist).

Information:

- **Der Monitor wird von der USV nicht gepuffert und fällt somit bei einem Stromausfall aus.**
- **Genauere Informationen zur Unterbrechungsfreien Stromversorgung können im USV-Anwenderhandbuch (der externen USV) nachgelesen werden. Dieses kann von der B&R Homepage heruntergeladen werden.**

Durch die Integration der Ladeschaltung in das Gehäuse des B&R Industrie PC, reduziert sich die Installation auf das Anschließen des Verbindungskabels zur Batterieeinheit die neben dem PC montiert wird.

Bei der Konstruktion der Batterieeinheit wurde auf die Wartungsfreundlichkeit besonderer Wert gelegt. Die Batterien sind frontseitig optimal zugänglich und im Servicefall in wenigen Augenblicken getauscht.

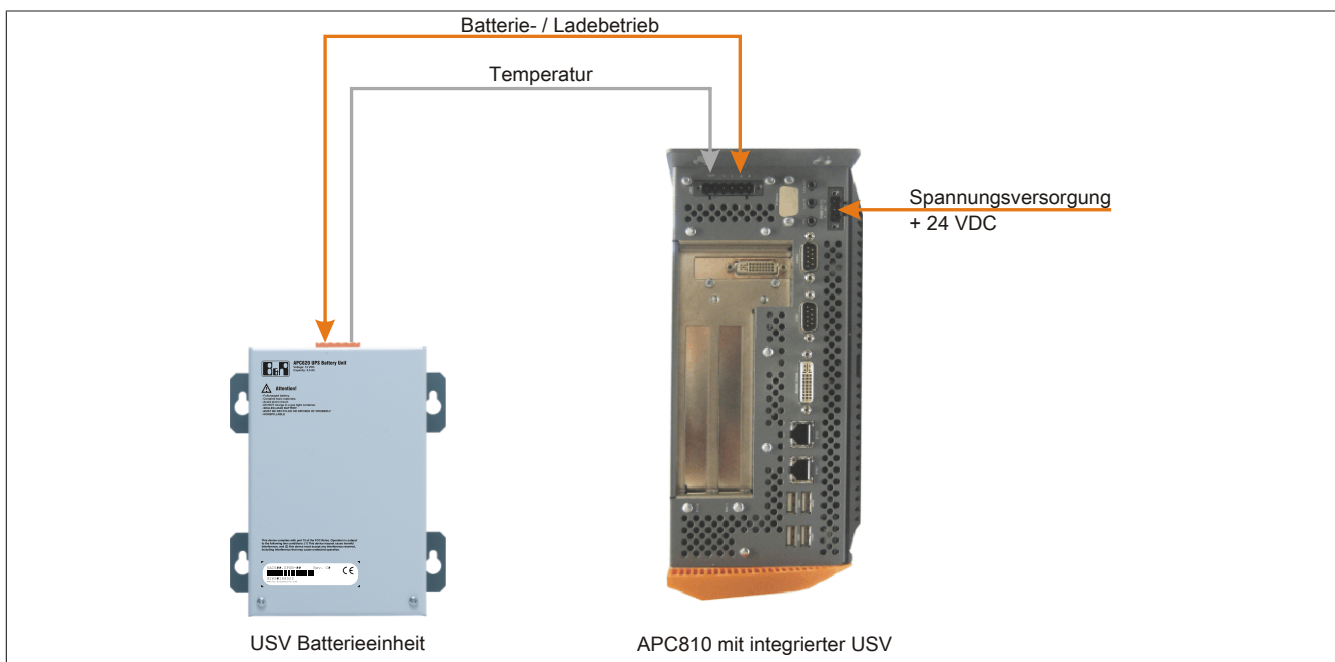


Abbildung 175: USV Prinzip

9.1 Features

- Wartungsfreie Akkus mit langer Lebensdauer
- Kommunikation über integrierte Schnittstelle
- Temperatursensor
- Treibersoftware
- Tiefentladeschutz

9.2 Was wird benötigt

- Eine passende Systemeinheit.
- Add-on USV Modul 5AC600.UPS1-00
- Batterieeinheit 5AC600.USB-00
- USV Verbindungskabel 0,5 Meter (5CAUPS.0005-00) oder 3 Meter (5CAUPS.0030-00)
- Parametrierung der B&R USV mittels ADI Control Center.

9.3 5AC600.UPSI-00

9.3.1 Allgemeines

Das Add-on USV Modul kann leicht bei einer geeigneten Systemeinheit (benötigte Revision siehe Abschnitt 9.2 "Was wird benötigt" auf Seite 326) integriert werden.

9.3.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSI-00	USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.	
	Erforderliches Zubehör	
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 287: 5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten

9.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöerteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5AC600.UPSI-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	max. 7,5 Watt
Netzausfallüberbrückung	max. 20 min bei 150 W Last
Tiefentladeschutz	Ja, bei 10 V der Batterieeinheit
kurzschlussfest	Nein
Ladekenndaten Batterie	
Ladestrom	max. 0,5 A
Umschaltswelle	
Batteriebetrieb	13 V
Netzbetrieb	15 V

Tabelle 288: 5AC600.UPSI-00 - Technische Daten

9.3.4 Montage

Die Montage erfolgt mit dem mitgeliefertem Montagematerial. Weitere Informationen zur Montage sind im Kapitel Kapitel 7 "Wartung / Instandhaltung" zu finden.

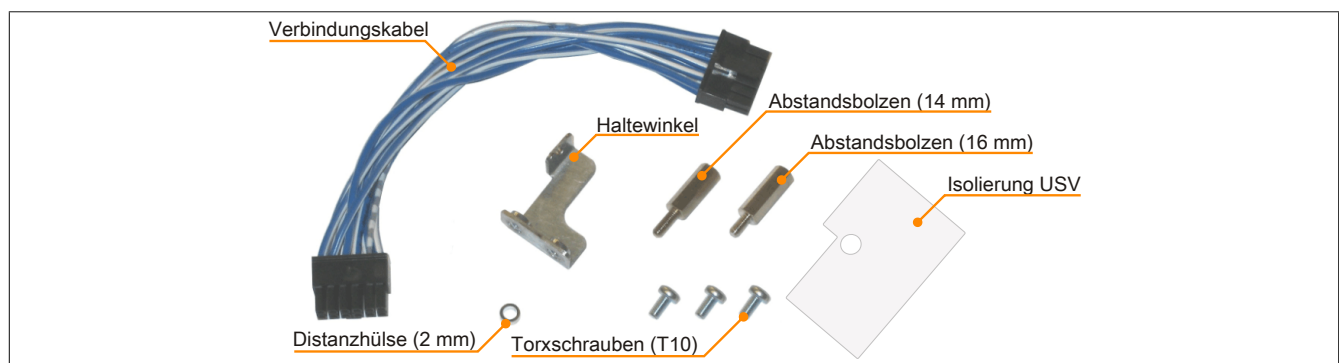


Abbildung 176: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

9.4 5AC600.UPSB-00

9.4.1 Allgemeines

Die Batterieeinheit stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) erneuert werden.

9.4.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5AC600.UPSB-00	Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.	

Tabelle 289: 5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten

9.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

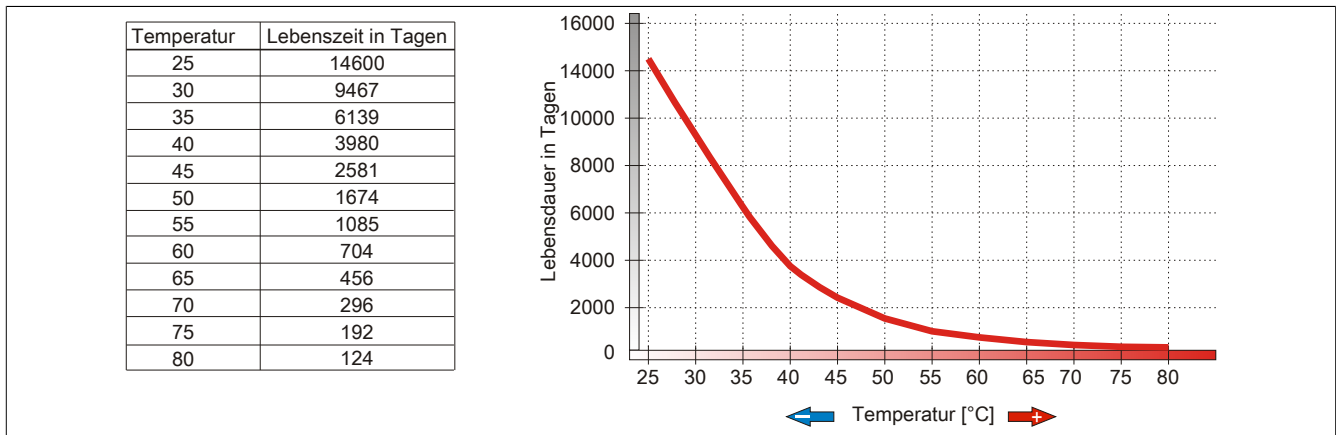
Produktbezeichnung	5AC600.UPSB-00
Allgemeines	
Batterie	
Typ	Energys Cyclon 12 V 5 Ah (6 Stk. in Serie geschaltet)
Lebensdauer	10 Jahre ¹⁾
Ausführung	Single Cell
Temperatursensor	NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung	alle 6 Monate 1 mal laden
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Ladedauer bei Low Battery	typ. 15 Stunden
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	12 V
Batteriestrom	max. 8 A
Kapazität	5 Ah
Tiefentladespannung	10 V
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Ladebetrieb	-30 bis 60°C
Betrieb	-40 bis 80°C
Lagerung	-65 bis 80°C
Transport	-65 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	104 mm ²⁾
Länge	170,5 mm
Höhe	87,5 mm
Gewicht	ca. 3200 g

Tabelle 290: 5AC600.UPSB-00 - Technische Daten

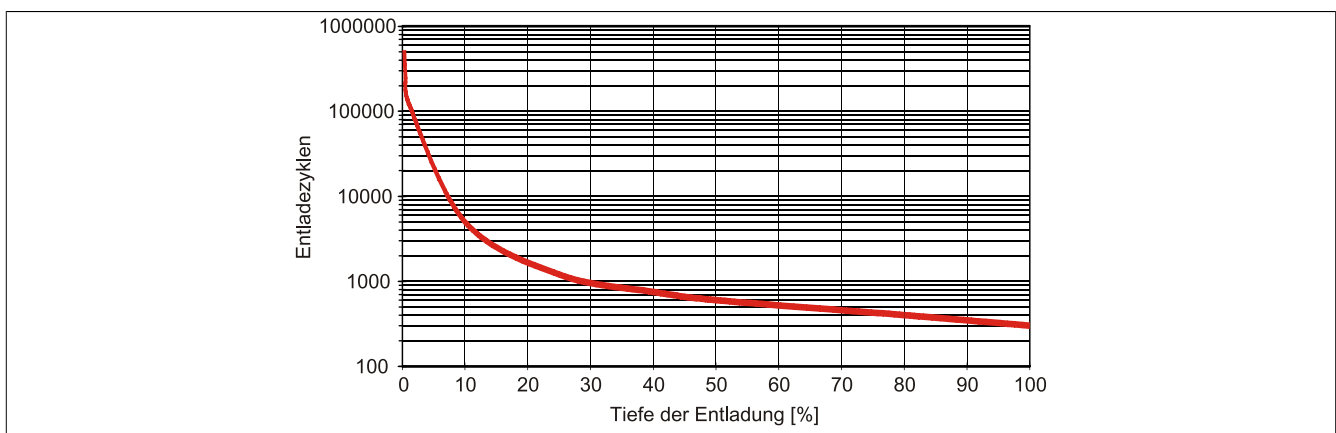
1) bei 25°C (bis 80% Batteriekapazität)

2) Abmessung ohne Montagelaschen.

9.4.4 Temperatur Lebensdauerdiagramm bis 20% Batteriekapazität



9.4.5 Tiefentladezyklen



9.4.6 Abmessungen

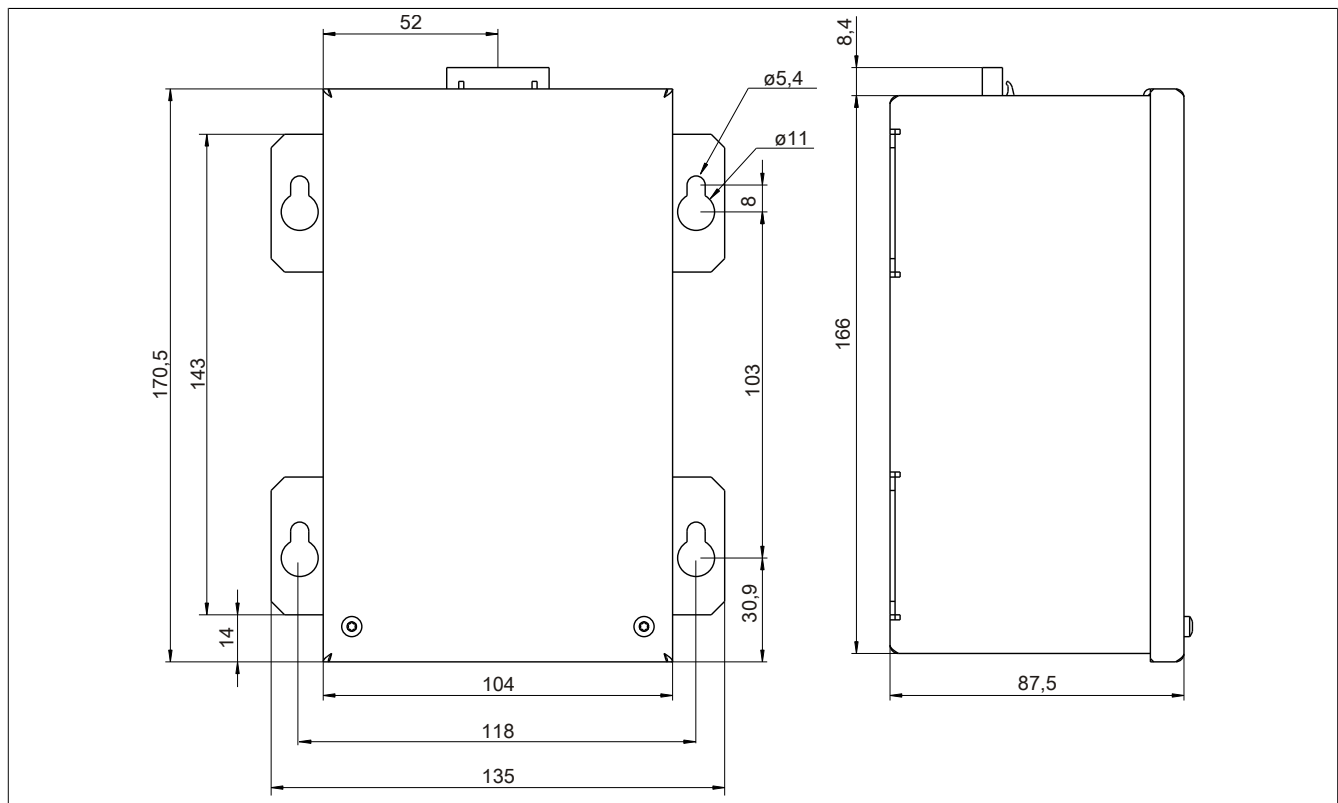


Abbildung 179: 5PC600.UPSB-00 - Abmessungen

9.4.7 Bohrschablone

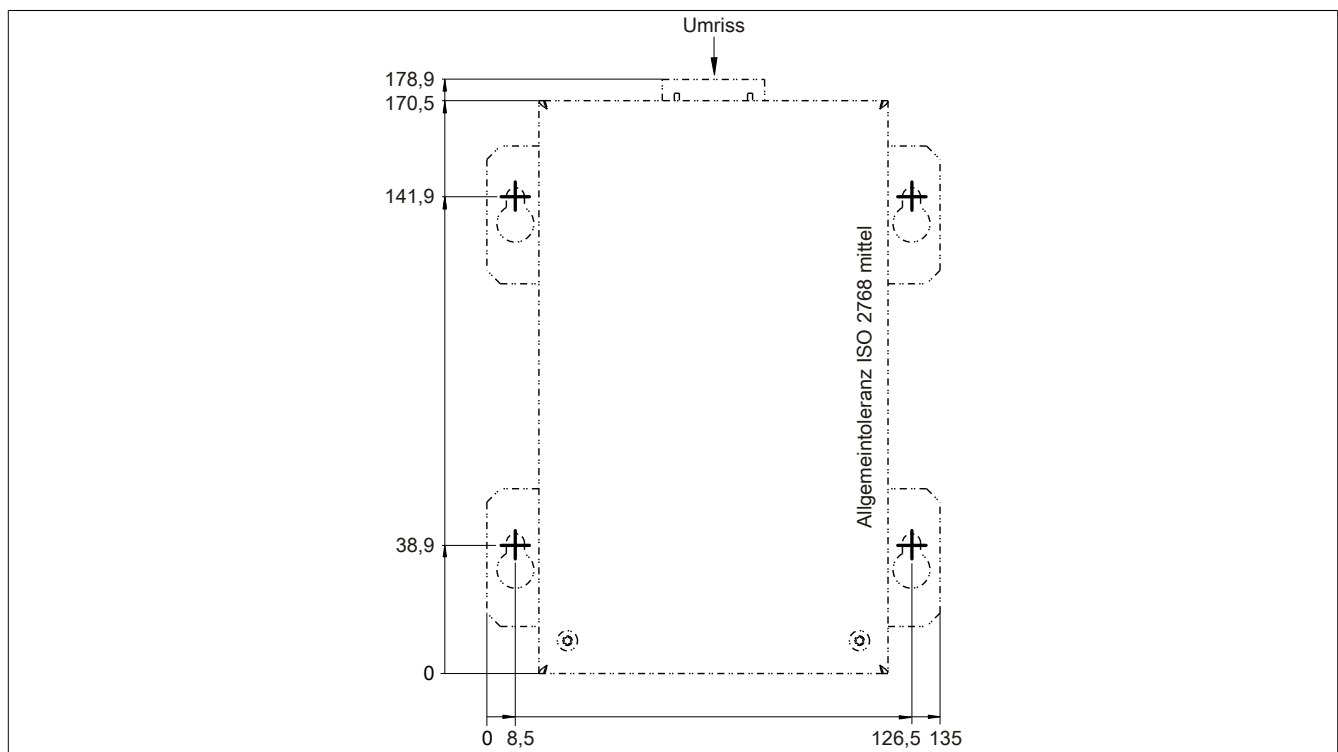


Abbildung 180: 5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone

9.4.8 Montagevorschriften

Auf Grund der speziellen Bauweise dieser Akkumulatoren können diese in jeder beliebigen Lage betrieben so wie auch gelagert werden.

9.5 5CAUPS.00xx-00

9.5.1 Allgemeines

Das USV Verbindungskabel stellt die Verbindung zwischen dem Add-on USV Modul 5AC600.UPSI-00 und der Batterieeinheit 5AC600.UPSB-00 her. Es ist in den Längen 0,5 m und 3 m erhältlich.

9.5.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
5CAUPS.0005-00	USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	
5CAUPS.0030-00	USV Kabel 3 m; für USV 5AC600.UPSI-00.	

Tabelle 291: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten

9.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CAUPS.0005-00	5CAUPS.0030-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
c-UL-us	Ja	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	2x 0,5 mm² (AWG 20) 4x 2,5 mm² (AWG 13)	
Leiterwiderstand	bei 0,5 mm² max. 39 Ω/km bei 2,5 mm² max. 7,98 Ω/km	
Außenmantel		
Material	thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis	
Farbe	fenstergrau (ähnlich RAL 7040)	
Steckverbindung		
Typ	Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig / Buchsenleiste Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig	
Elektrische Eigenschaften		
Betriebsspannung	max. 300 V	
Betriebsspitzenspannung	typ. 12 VDC / max. 15 VDC	
Prüfspannung		
Ader/Ader	1500 V	
Strombelastbarkeit	10 A bei 20°C	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
bewegt	-5 bis 80°C	
ruhend	-30 bis 80°C	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	0,5 m	3 m
Durchmesser	8,5 mm ±0,2 mm	
Biegeradius		
bewegt	10x Leitungsdurchmesser	
feste Verlegung	5x Leitungsdurchmesser	
Gewicht	ca. 100 g	ca. 470 g

Tabelle 292: 5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten

10 PCI Einsteckkarten

10.1 5ACPCI.ETH1-01

10.1.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über einen 10/100 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 1 Netzwerkanschluss (10/100 MBit/s)



Abbildung 181: 5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100

10.1.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH1-01	PCI Ethernet Card 1x 10/100	

Tabelle 293: 5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten

10.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58A
Diagnose Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen CE	Ja
Schnittstellen	
Ethernet Anzahl	1

Tabelle 294: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH1-01
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 294: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ethernet Anschluss		
Controller	Intel 82551ER	
Versorgung	Universalkarte (2 Kerben) für 3,3V bzw. 5V	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)

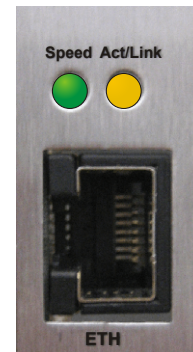


Tabelle 295: 5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten

10.1.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

10.1.5 Abmessungen

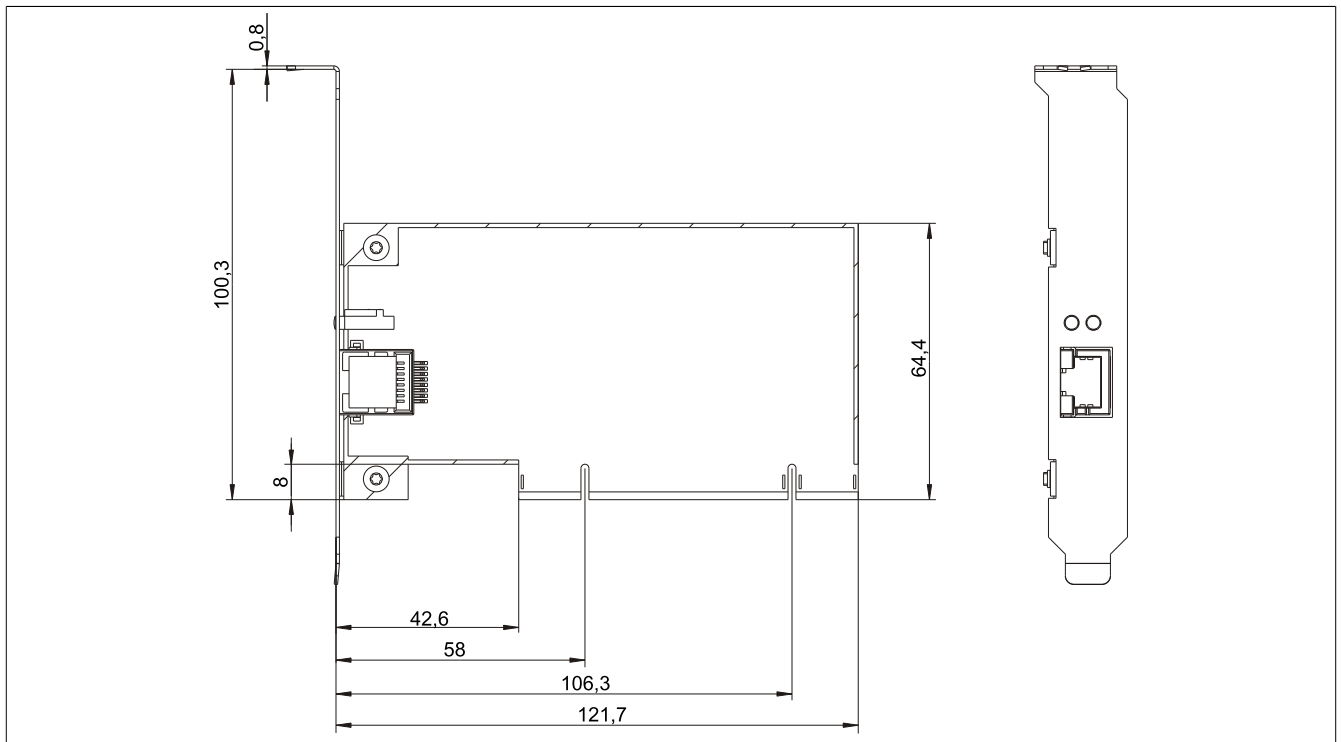


Abbildung 182: 5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen

10.2 5ACPCI.ETH3-01

10.2.1 Allgemeines

Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über drei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.

- PCI Ethernet Karte
- 3 Netzwerkanschlüsse (10/100 MBit/s)



Abbildung 183: 5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100

10.2.2 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5ACPCI.ETH3-01	PCI Ethernet Card 3x 10/100	

Tabelle 296: 5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten

10.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$A58B
Diagnose	
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
Schnittstellen	
Ethernet	
Anzahl	3

Tabelle 297: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5ACPCI.ETH3-01
Controller	Intel 82551ER
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 297: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

Ethernet Schnittstelle

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Ethernet Anschlüsse		
Controller	jeweils Intel 82551ER	
Versorgung	Universalkarte (2 Kerben) für 3,3V bzw. 5V	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)

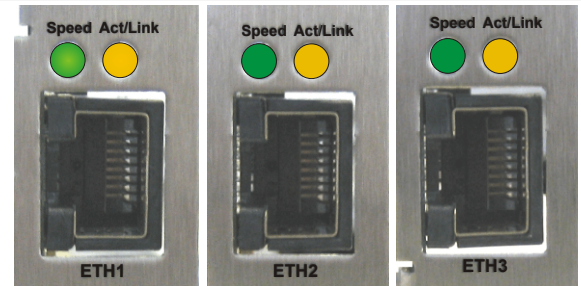


Tabelle 298: 5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten

10.2.4 Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82551ER ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme (Windows XP Professional, Windows XP Embedded und DOS) im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

10.2.5 Abmessungen

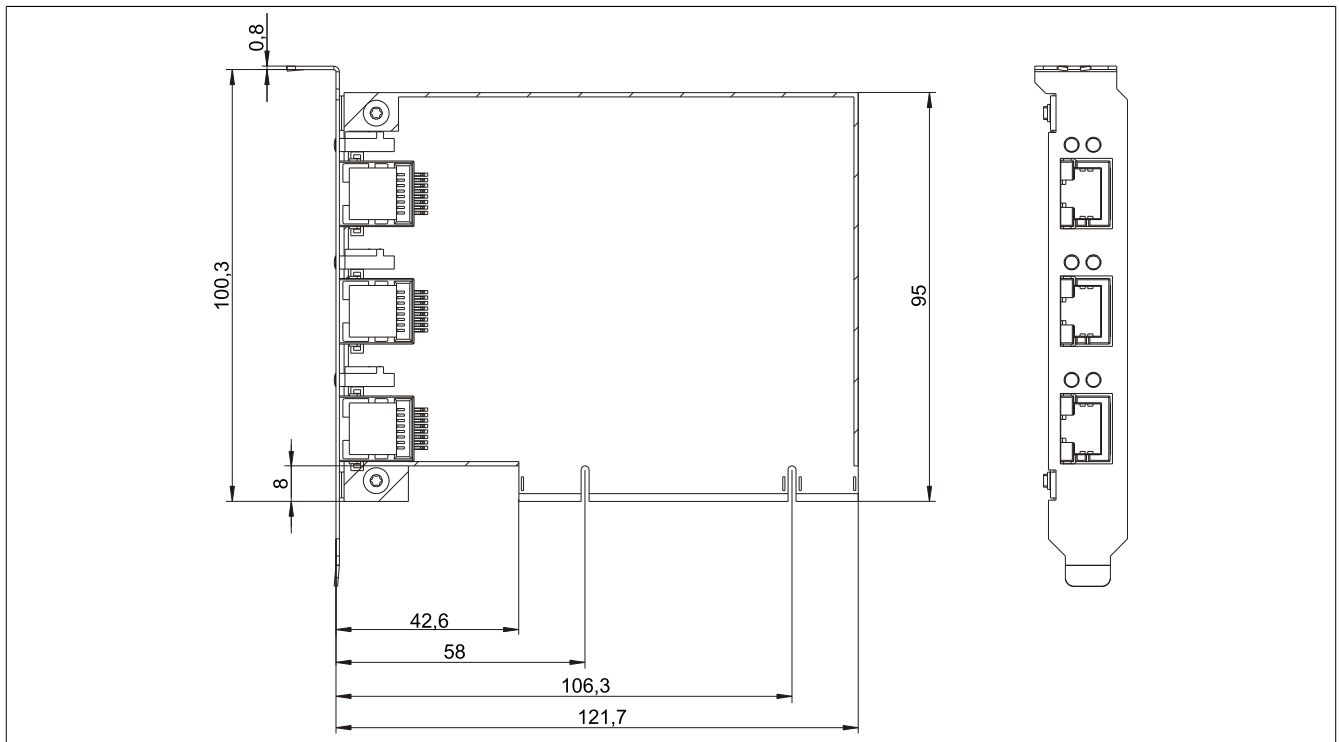


Abbildung 184: 5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen

11 Kabel

11.1 DVI Kabel

11.1.1 5CADVI.0xxx-00

Allgemeines

Die DVI Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	

Tabelle 299: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
c-UL-us	Ja		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 28		
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt		
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 86%		
Außenmantel			
Material	PVC		
Farbe	beige		
Bedruckung	AWM STYLE 20276 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN		
Steckverbindung			
Typ	2x DVI-D (18+1), male		
Steckzyklen	100		
Elektrische Eigenschaften			
Leiterwiderstand	max. 237 Ω/km		
Isolationswiderstand	min. 100 MΩ/km		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser	max. 8,5 mm		
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)		
Gewicht	ca. 260 g	ca. 460 g	ca. 790 g

Tabelle 300: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

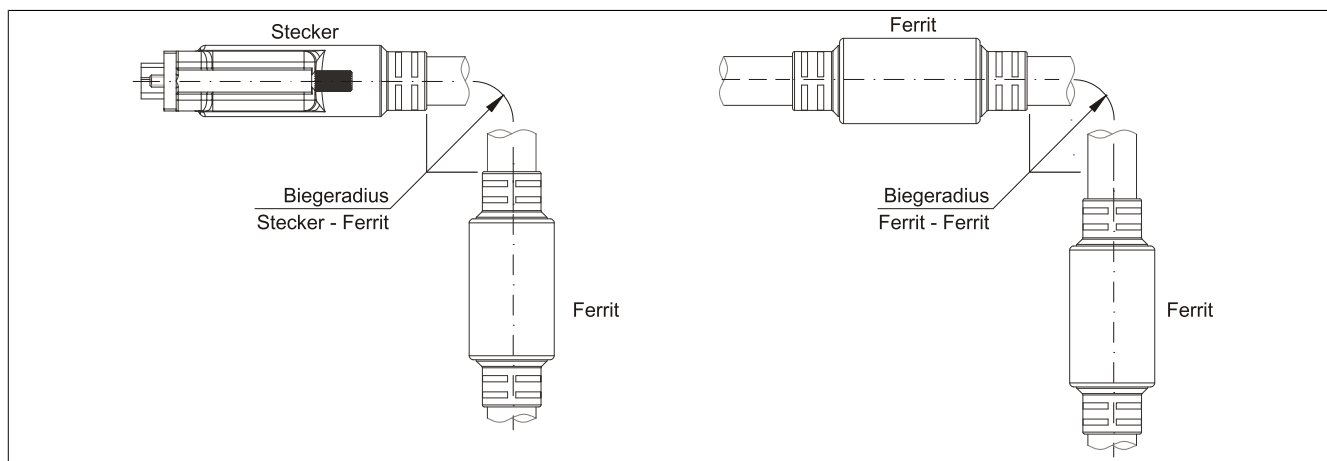


Abbildung 185: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

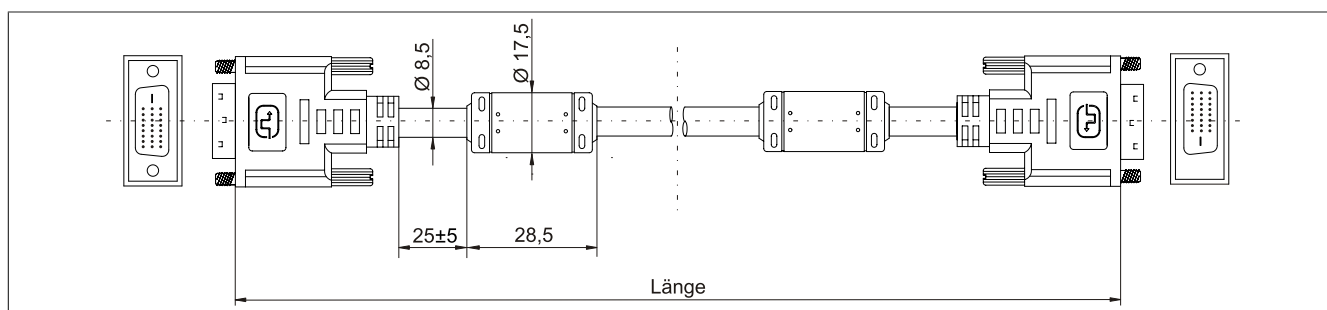


Abbildung 186: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

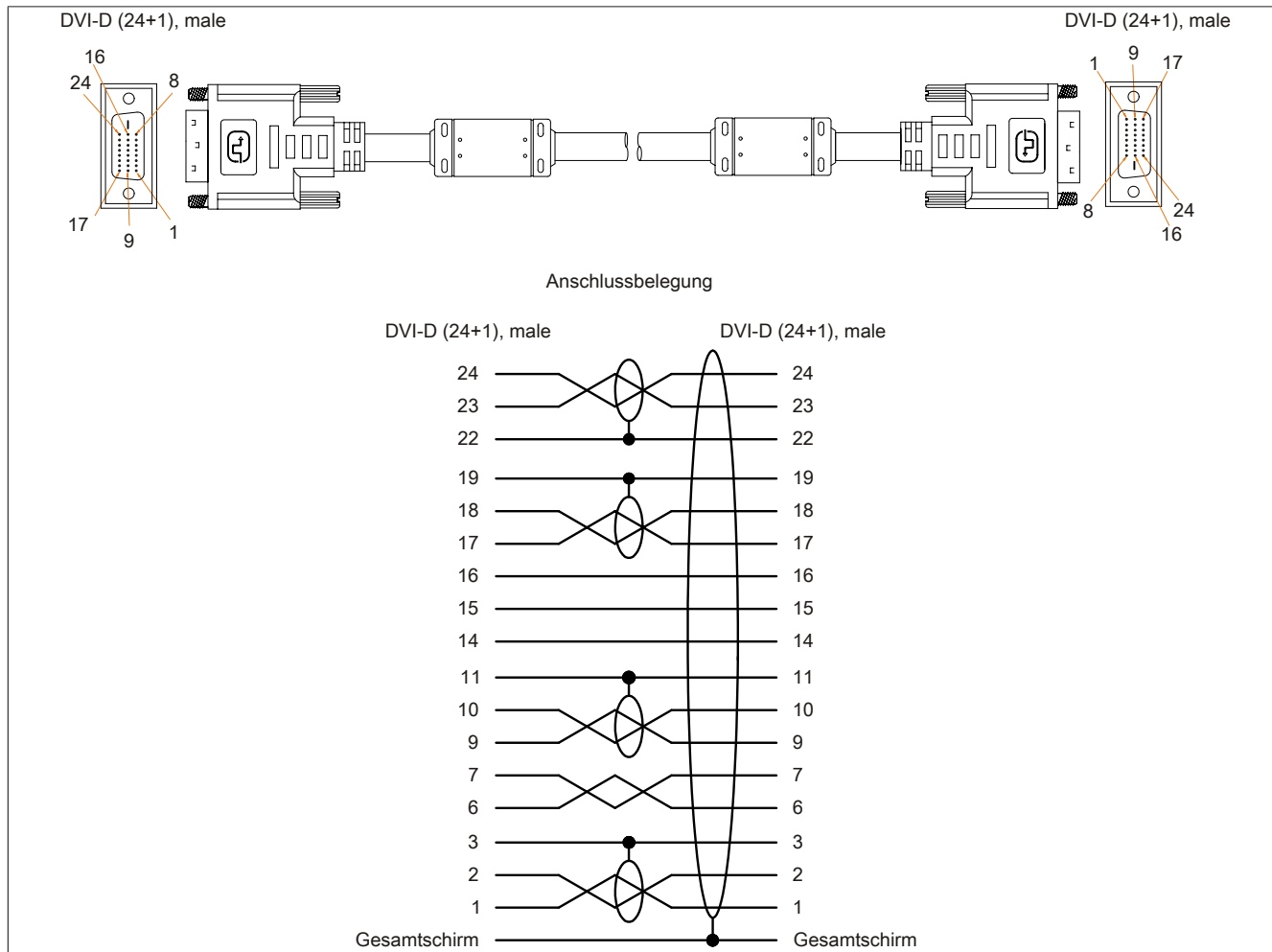


Abbildung 187: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

11.2 SDL Kabel

11.2.1 5CASDL.0xxx-00

Allgemeines

Die SDL Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	

Tabelle 301: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja						
CE							
c-UL-us							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24				
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%						
Außenmantel	PVC schwarz E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	100						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Elektrische Eigenschaften							
Leiterwiderstand	- ≤ 93 Ω/km -						
AWG 24							
AWG 28							
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen	1,8 m ±30 mm 5 m ±30 mm 10 m ±50 mm 15 m ±100 mm 20 m ±100 mm 25 m ±100 mm 30 m ±100 mm typ. 8,6 ±0,2 mm max. 9 mm typ. 11 ±0,2 mm max. 11,5 mm						
Länge							
Durchmesser							
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)						
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)						
Gewicht	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 302: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

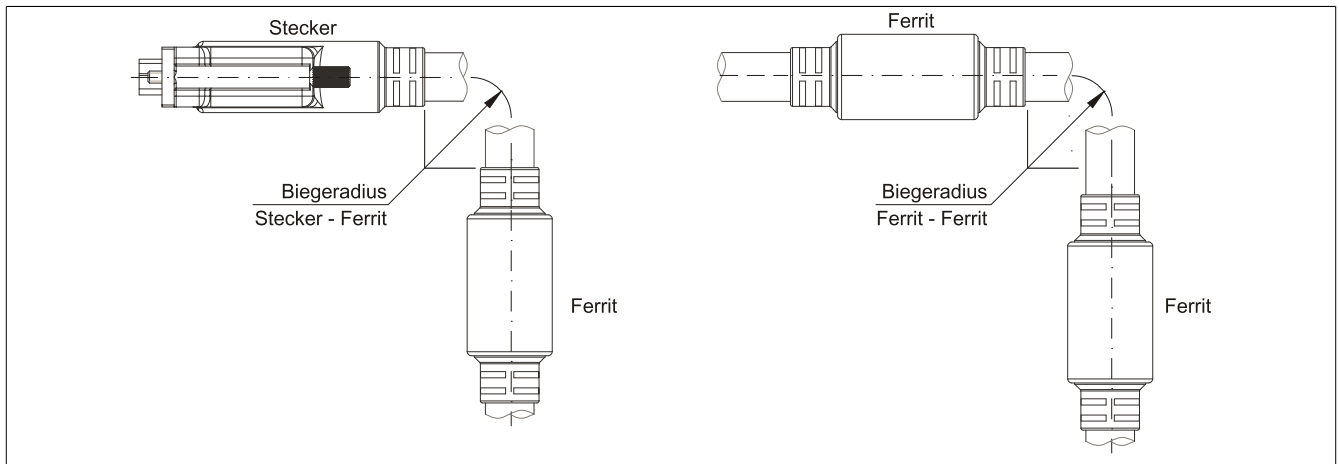


Abbildung 188: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

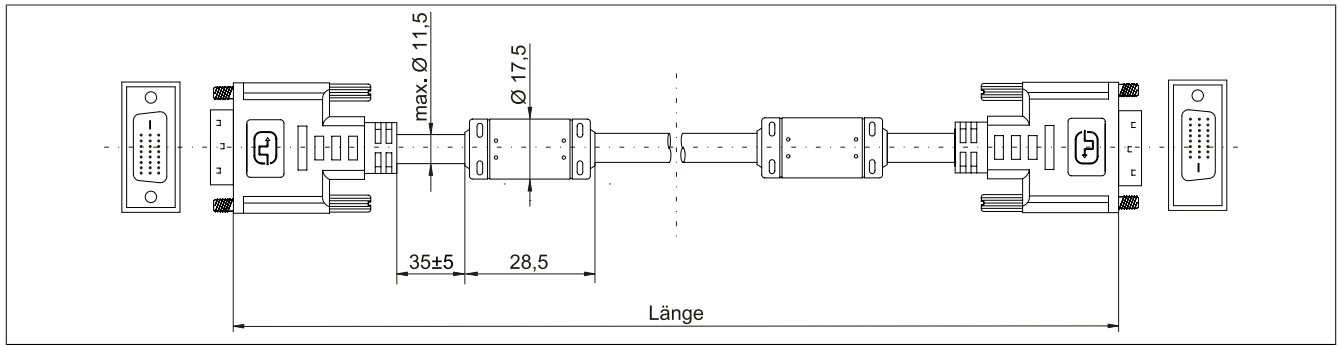


Abbildung 189: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

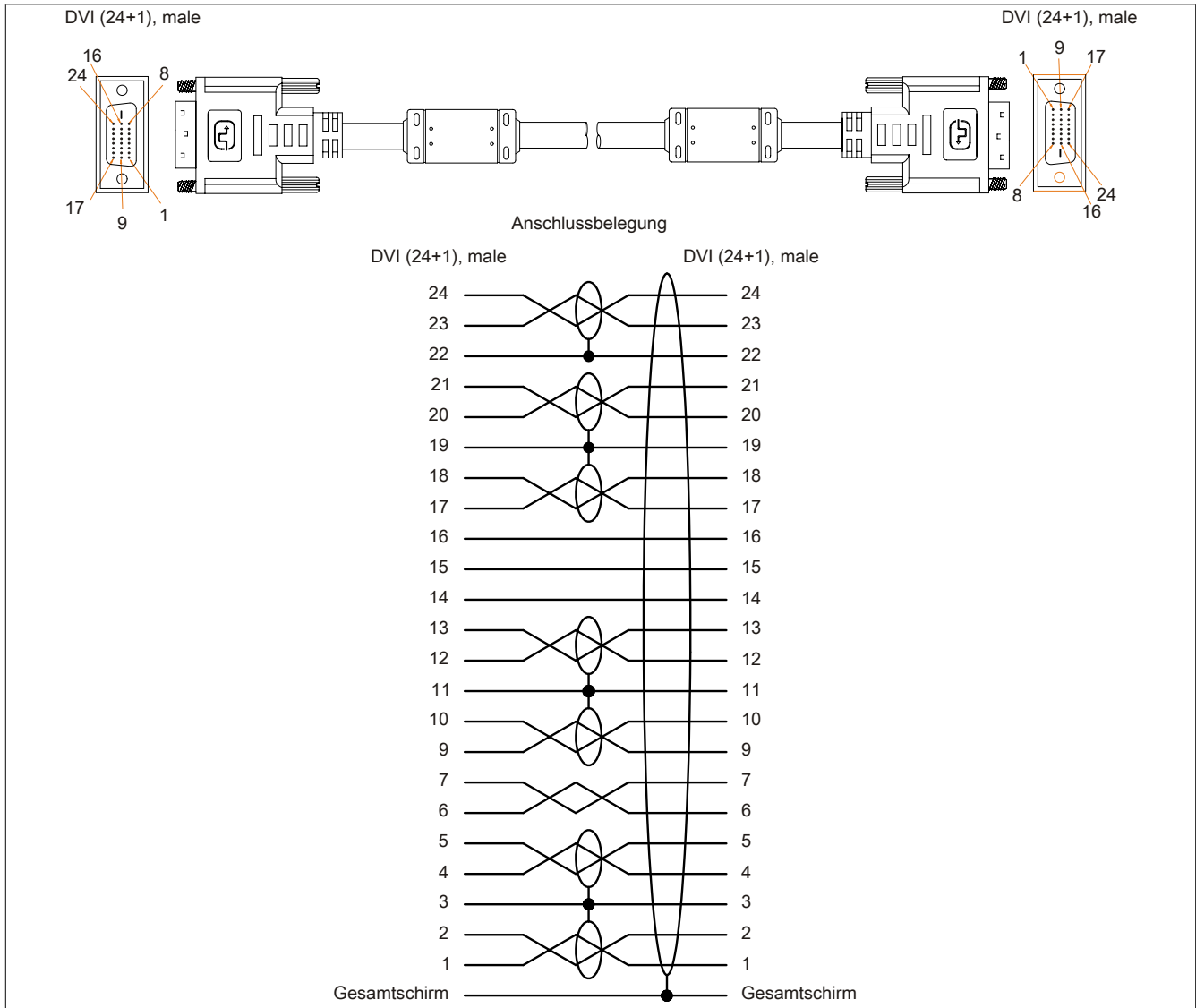


Abbildung 190: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

11.3 SDL Kabel mit 45° Stecker

11.3.1 5CASDL.0xxx-01

Allgemeines

Die SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	

Tabelle 303: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
c-UL-us	Ja			
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24	
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt			
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%			
Außenmantel				
Material	PVC			
Farbe	schwarz			
Steckverbindung				
Typ	2x DVI-D (24+1), male			
Steckzyklen	100			
Kontakte	vergoldet			
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung			
Elektrische Eigenschaften				
Leiterwiderstand				
AWG 24	-		≤ 93 Ω/km	
AWG 28	≤ 237 Ω/km		-	
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm
Durchmesser	max. 9 mm		max. 11,5 mm	
Biegeradius				
feste Verlegung	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)			
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)			
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g

Tabelle 304: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

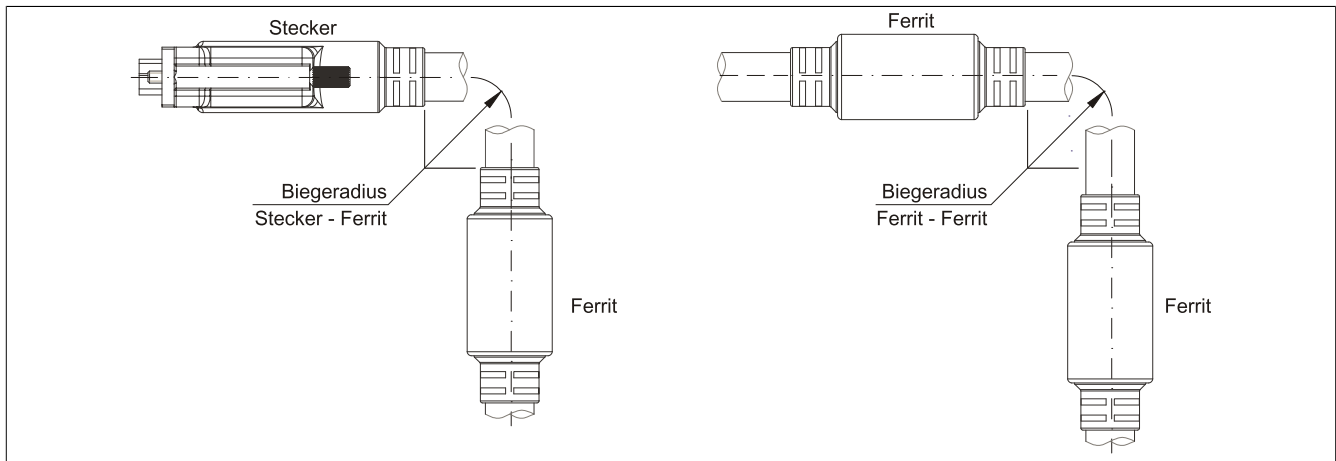


Abbildung 191: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

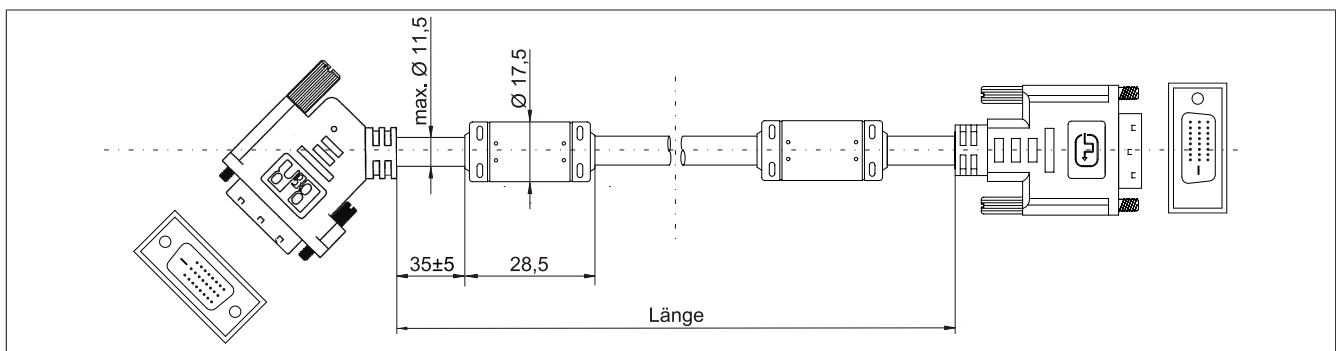


Abbildung 192: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

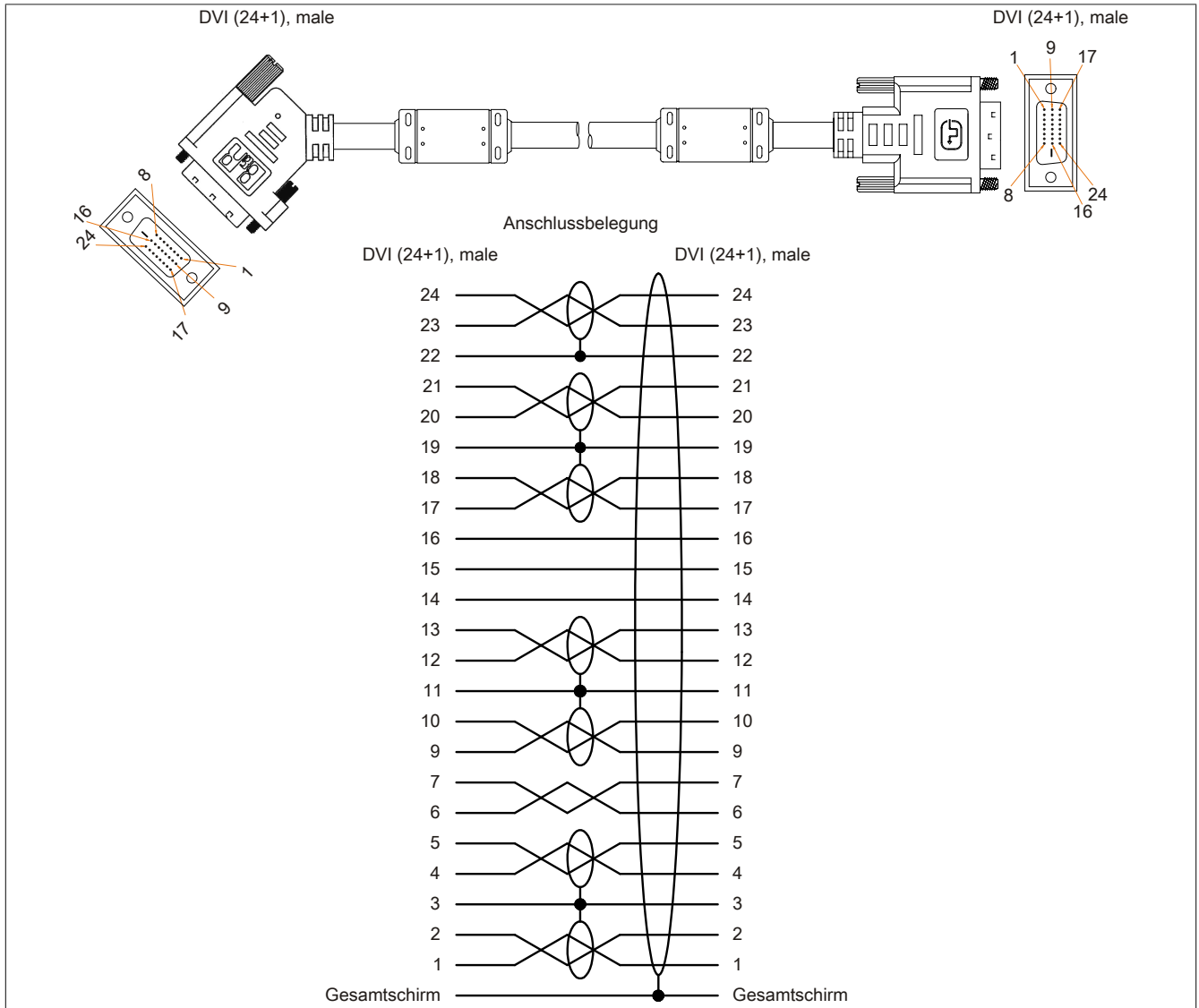


Abbildung 193: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

11.4 SDL Kabel flex

11.4.1 5CASDL.0xxx-03

Allgemeines

Die SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	

Tabelle 305: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja						
CE							
c-UL-us							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)						
Eigenschaften	halogen- und silikonfrei						
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	alukaschierte Folie + verzinntes Kupfergeflecht						
Außenmantel	Spezial-TMPU - seidenmatt schwarz (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E 63216						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	min. 200						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Elektrische Eigenschaften							
Betriebsspannung	≤ 30 V						
Prüfspannung	1 kV 0,5 kV						
Ader/Ader							
Ader/Schirm							
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω						
Leiterwiderstand	≤ 95 Ω/km ≤ 145 Ω/km						
AWG 24							
AWG 26							
Isolationswiderstand	> 200 MΩ/km						
Einsatzbedingungen							
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V						
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)						
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10						
Umgebungsbedingungen							
Temperatur	-20 bis 80°C -5 bis 60°C -20 bis 80°C						
Lagerung							
bewegt							
feste Verlegung							

Tabelle 306: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Länge	1,8 m ±20 mm 5 m ±45 mm 10 m ±90 mm 15 m ±135 mm 20 m ±180 mm 25 m ±225 mm 30 m ±270 mm						
Durchmesser	max. 12 mm						
Biegeradius							
feste Verlegung	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit)						
flexible Verlegung	≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)						
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)						
Schleppkettendaten							
Biegewechsel	300.000						
Geschwindigkeit	4800 Zyklen/Stunde						
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser						
Hub	460 mm						
Gewicht	ca. 460 g	ca. 1020 g	ca. 1940 g	ca. 2840 g	ca. 3740 g	ca. 4560 g	ca. 5590 g
Zugbelastbarkeit							
in Betrieb	≤ 50 N						
bei Verlegung	≤ 400 N						

Tabelle 306: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

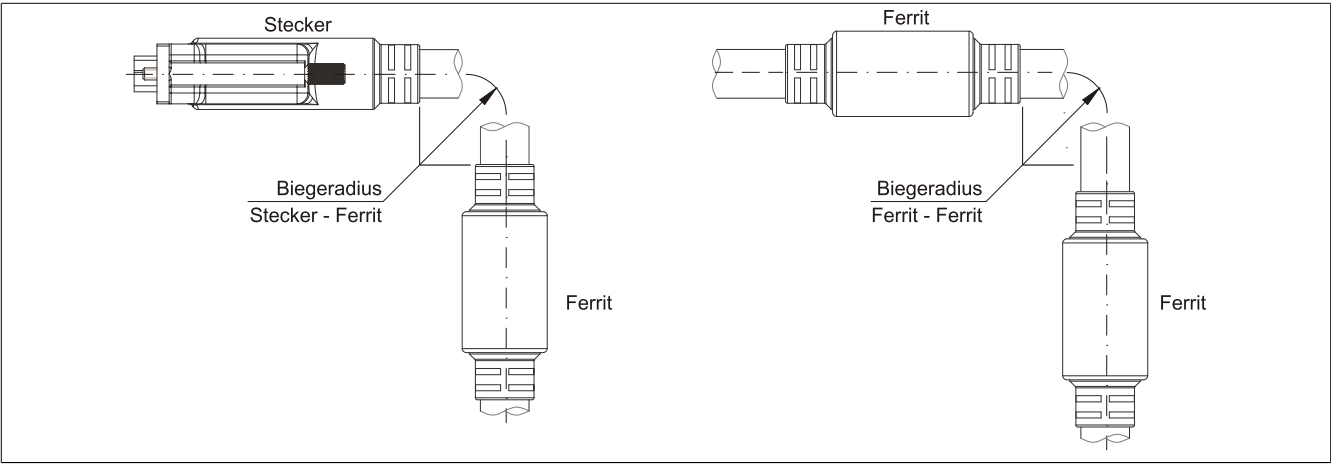


Abbildung 194: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

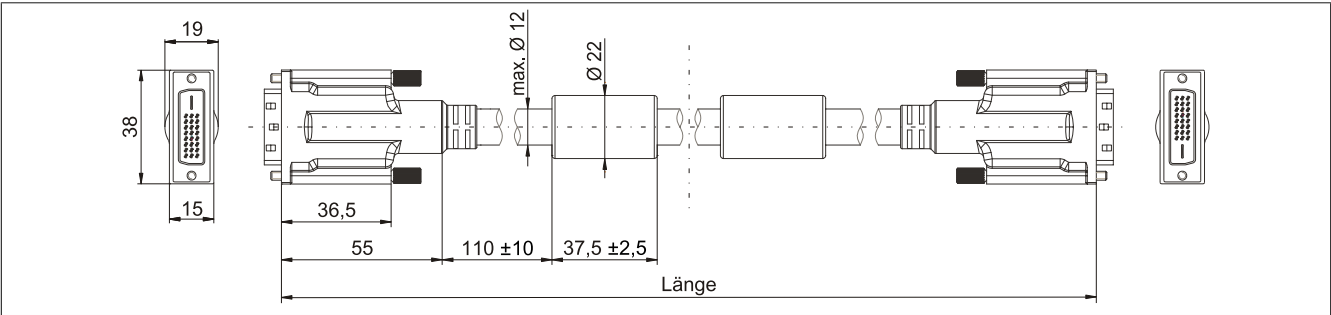


Abbildung 195: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

Aufbau

Element	Belegung	Querschnitt
DVI	TMDS Daten 0	26 AWG
	TMDS Daten 1	26 AWG
	TMDS Daten 2	26 AWG
	TMDS Takt	26 AWG
USB	XUSB0	26 AWG
	XUSB1	26 AWG
Daten	SDL	26 AWG
Steueradern	DDC Takt	24 AWG
	DDC Daten	24 AWG
	+5 V	24 AWG
	Masse	24 AWG
	Hot Plug Detect	24 AWG

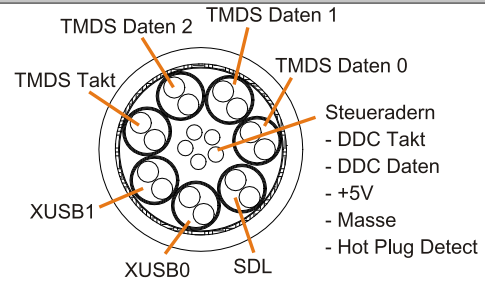


Tabelle 307: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

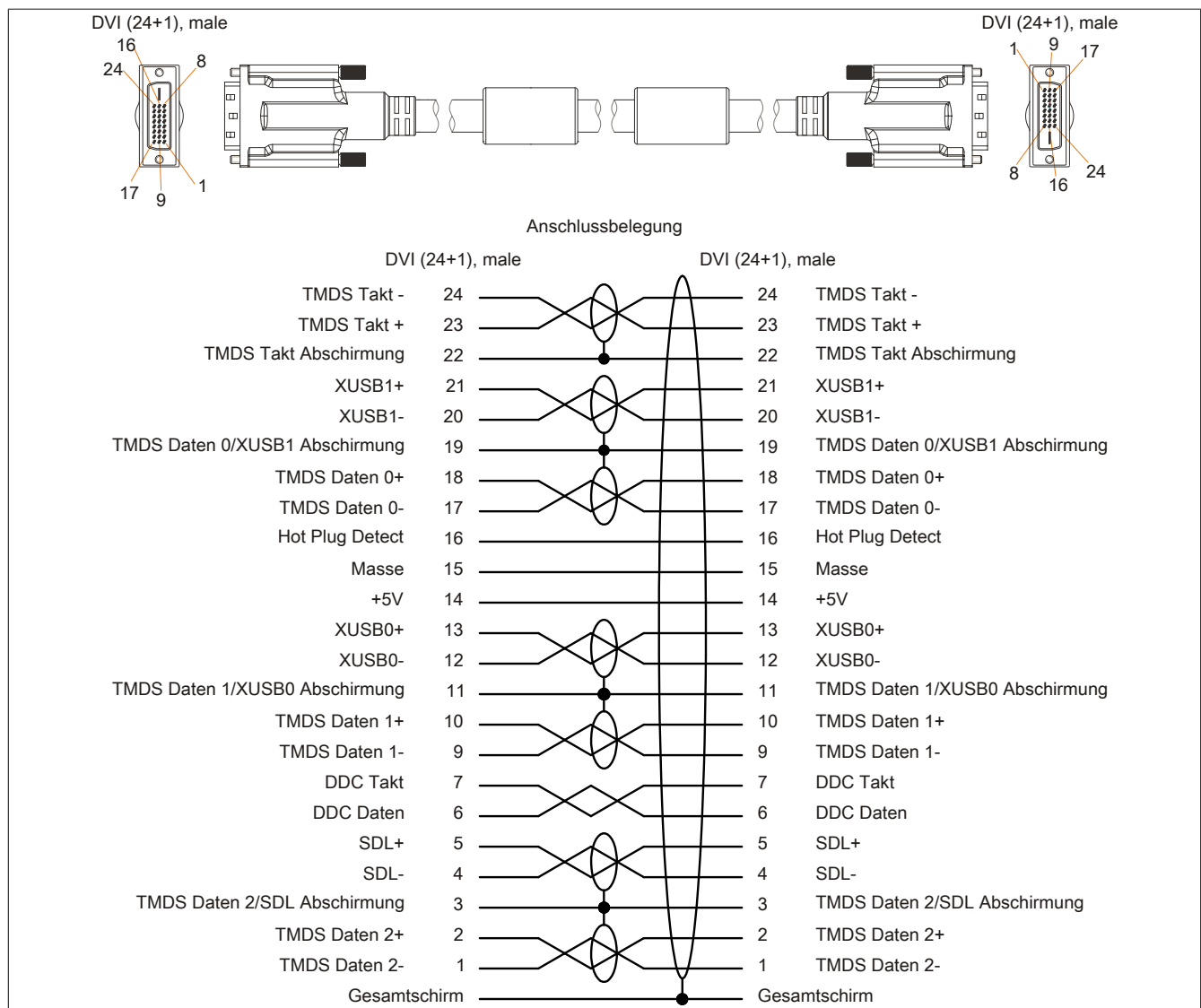


Abbildung 196: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

11.5 SDL Kabel flex mit Extender

11.5.1 5CASDL.0xx0-13

Allgemeines

Die SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

Bestelldaten

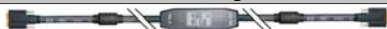
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	

Tabelle 308: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines			
Zertifizierungen CE c-UL-us		Ja Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt		AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)	
Eigenschaften		halogen- und silikonfrei	
Schirm		Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt	
Gesamtschirmung		alukaschierte Folie + verzinnertes Kupfergeflecht	
Außenmantel Material Farbe Bedruckung		Spezial-TMPU - seidenmatt schwarz (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216	
Steckverbindung			
Typ		2x DVI-D (24+1), male	
Steckzyklen		min. 200	
Kontakte		vergoldet	
mechanischer Schutz		Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung	
Elektrische Eigenschaften			
Betriebsspannung		≤ 30 V	
Prüfspannung Ader/Ader Ader/Schirm		1 kV 0,5 kV	
Wellenwiderstand		100 ±10 Ω	
Leiterwiderstand AWG 24 AWG 26		≤ 95 Ω/km ≤ 145 Ω/km	
Isolationswiderstand		> 200 MΩ/km	
Einsatzbedingungen			
Approbation		UL AWM 20236 80°C 30V	
Flammwidrigkeit		gemäß UL758 (cable vertical flame test)	
Öl- und Hydrolysebeständigkeit		gemäß VDE 0282-10	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur Lagerung bewegt feste Verlegung		-20 bis 60°C -5 bis 60°C -20 bis 60°C	
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen Länge Durchmesser Extender Box Breite Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm max. 12 mm 35 mm 125 mm	43 m ±410 mm

Tabelle 309: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Höhe	18,5 mm		
Biegeradius feste Verlegung	$\geq 6 \times$ Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) $\geq 10 \times$ Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) $\geq 15 \times$ Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)		
Beweglichkeit flexible Verlegung	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)		
Schleppkettendaten	300.000 4800 Zyklen/Stunde 180 mm; 15x Kabeldurchmesser 460 mm		
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit in Betrieb bei Verlegung	$\leq 50 \text{ N}$ $\leq 400 \text{ N}$		

Tabelle 309: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Biegeradiusspezifikation

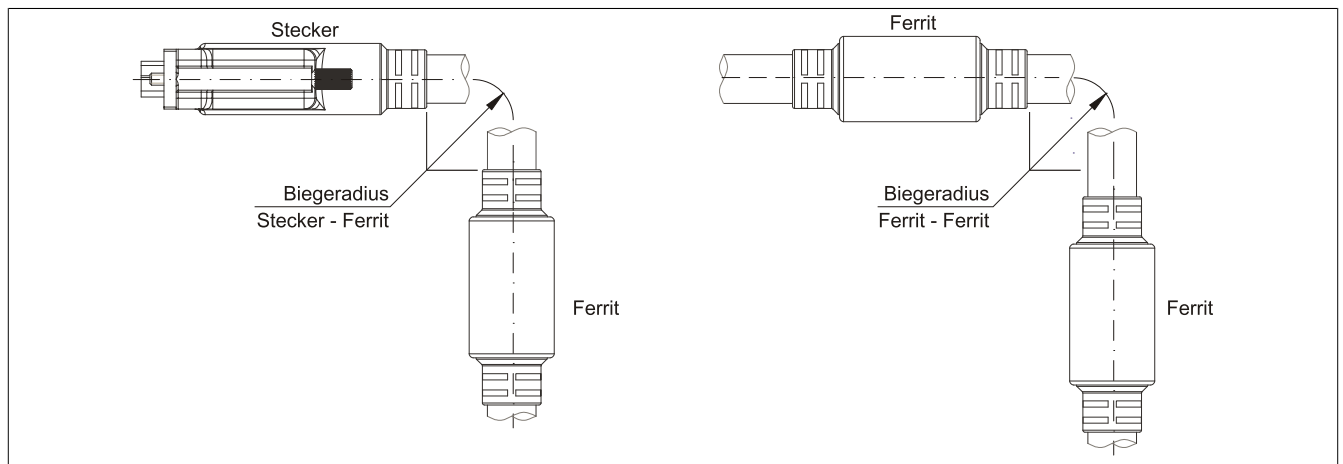


Abbildung 197: Biegeradiusspezifikation

Abmessungen

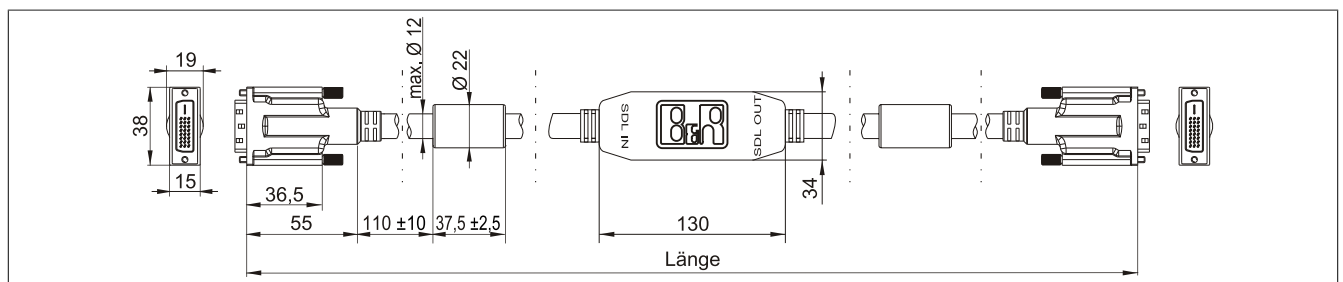


Abbildung 198: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

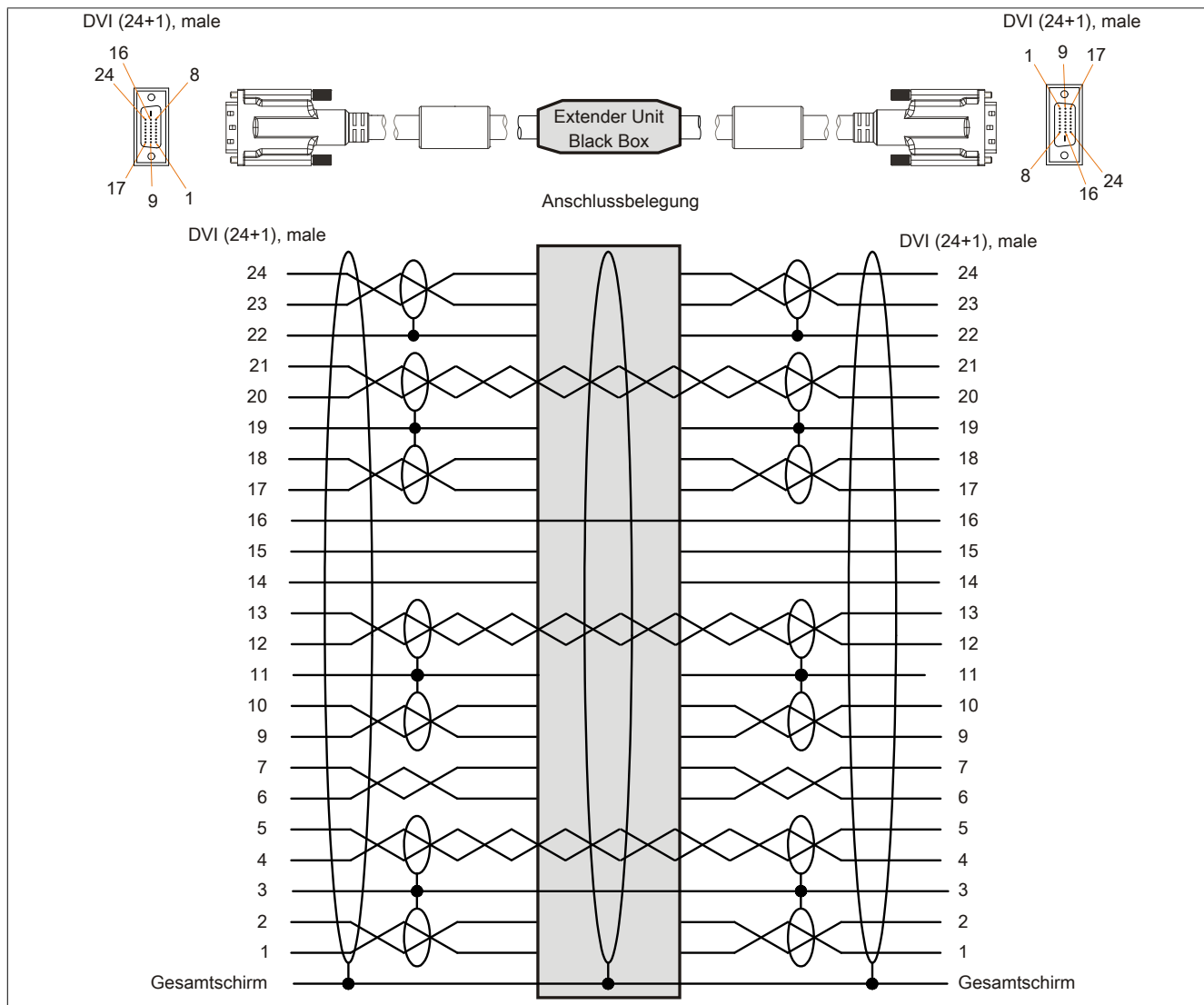


Abbildung 199: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

Kabelanschluss

Das SDL Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel 900 Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet:

- Das Ende „SDL IN“ mit dem Videoausgang des z.B. APC910 (Monitor / Panel Ausgang) oder Panel OUT einer AP900 AP Link Steckkarte verbinden.
- Das Ende „SDL OUT“ mit dem Anzeigegerät z.B. Automation Panel 900 über Automation Panel Link Einsteckkarte (Panel IN) anschließen.

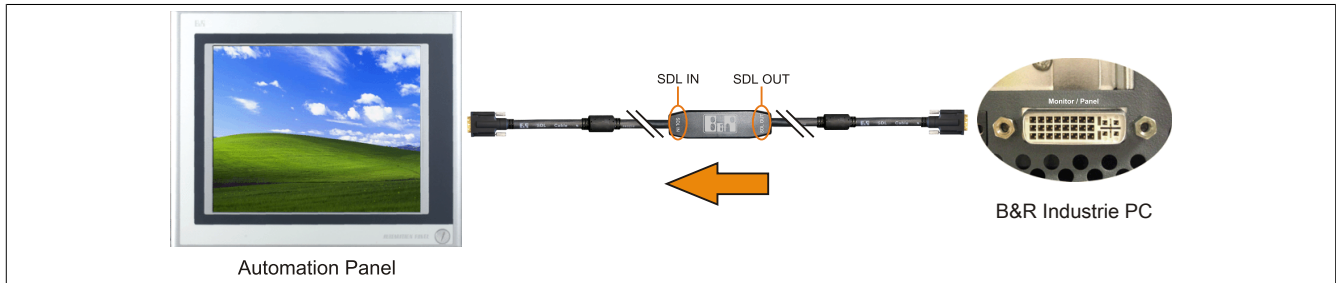


Abbildung 200: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender

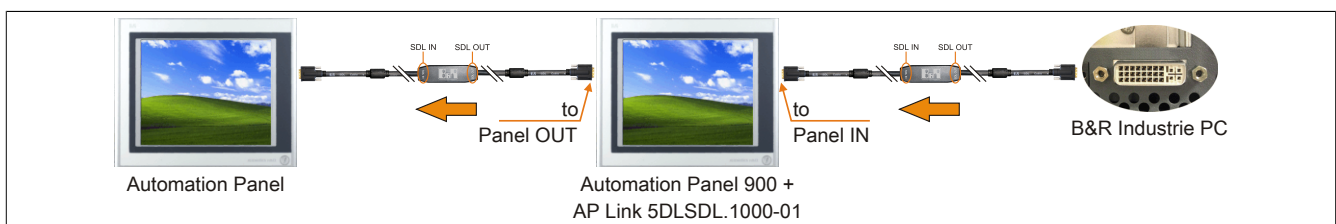


Abbildung 201: Beispiel für die Signalrichtung Display - Display für das SDL Kabel flex mit Extender

11.6 USB Kabel

11.6.1 5CAUSB.00xx-00

Allgemeines

Die USB Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 310: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00	5CAUSB.0050-00
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE	Ja	
c-UL-us	Ja	
Kabelaufbau		
Drahtquerschnitt	AWG 24, 28	
Schirm	Kabel gesamt	
Außenmantel		
Farbe	beige	
Steckverbindung		
Typ	USB Typ A male und USB Typ B male	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm
Durchmesser	max. 5 mm	
Biegeradius	min. 100 mm	

Tabelle 311: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

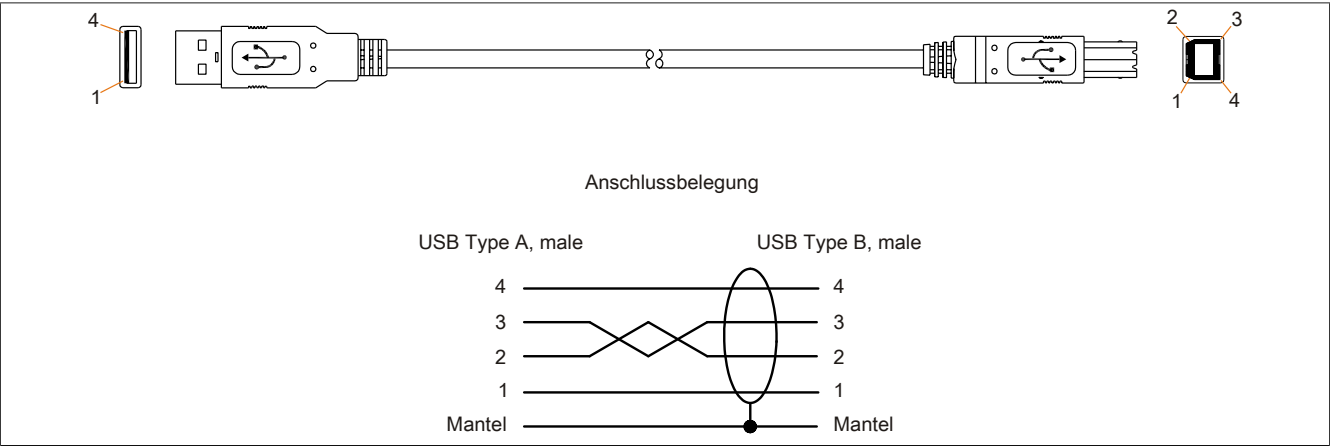


Abbildung 202: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

11.7 RS232 Kabel

11.7.1 9A0014.xx

Allgemeines

Die RS232 Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232 Schnittstellen.

Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 312: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen CE	Ja		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 26		
Schirm	Kabel gesamt		
Außenmantel Farbe	beige		
Steckverbindung			
Typ	9-polige DSUB Buchse, male / female		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen Länge Durchmesser	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm max. 5 mm	10 m ±100 mm
Biegeradius	min. 70 mm		

Tabelle 313: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

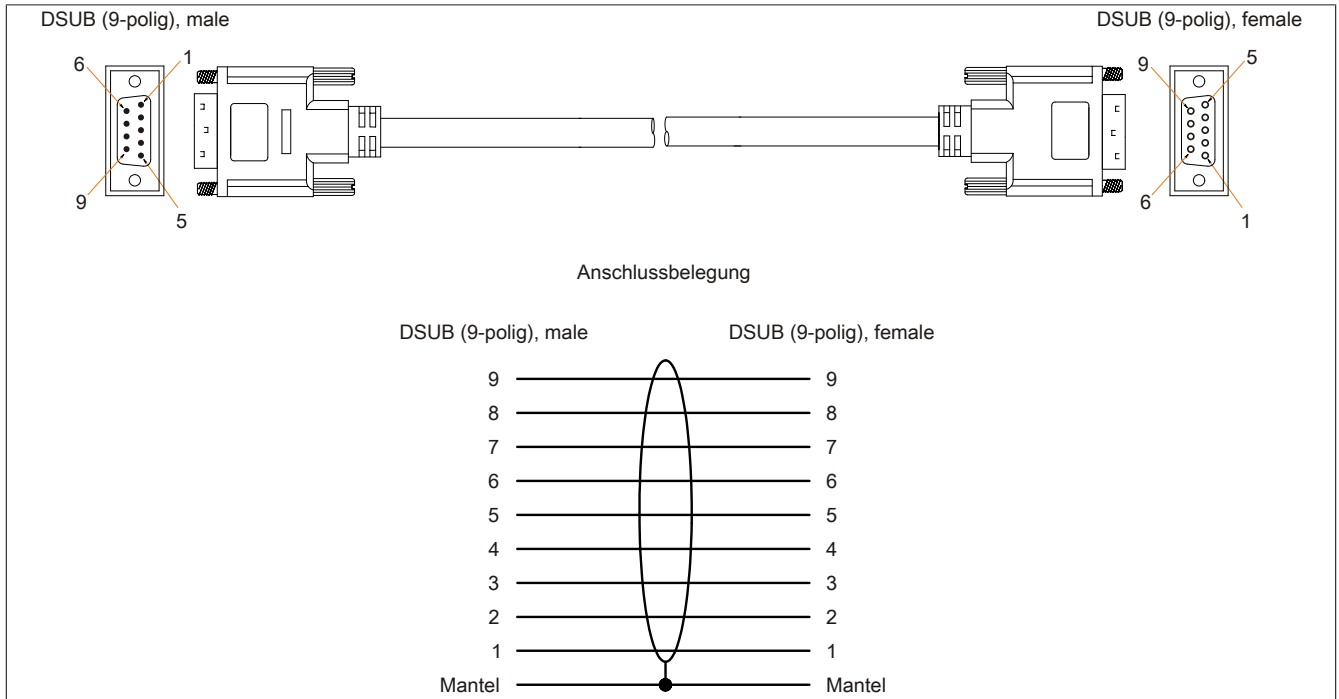


Abbildung 203: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

11.8 Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00

11.8.1 Allgemeines

Dieses Versorgungskabel dient zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten. Es wird dabei an das Basisboard angesteckt.

Vorraussetzungen und Vorgangsweise siehe dazu "Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard" auf Seite 391.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

11.8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Undefined	Image not found for 5CAMSC.0001-00!
5CAMSC.0001-00	APC620 Versorgungskabel intern - kundenspezifische Variante -	

Tabelle 314: 5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten

11.8.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAMSC.0001-00
Allgemeines	
Zertifizierungen CE	Ja
Kabelaufbau	
Drahtquerschnitt	AWG 22
Steckverbindung	
Typ	1x Disk Drive Power Stecker 4-polig male, 1x Steckergehäuse 4-polig female
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Länge	100 mm ±5 mm
Beweglichkeit	flexibel

Tabelle 315: 5CAMSC.0001-00 - Technische Daten

12 HDD Ersatzdiskablage

12.1 5AC801.FRAM-00

12.1.1 Allgemeines

Um eine Hard Disk so schnell wie möglich mit einer Ersatz Hard Disk wechseln zu können, gibt es die Möglichkeit ein Gehäuse am APC810 zu montieren, in dem die Erstaz HDD aufbewahrt werden kann.

Nähere Informationen zur Montage der HDD Ersatzdiskablage siehe Kapitel Wartung / Instandhaltung.

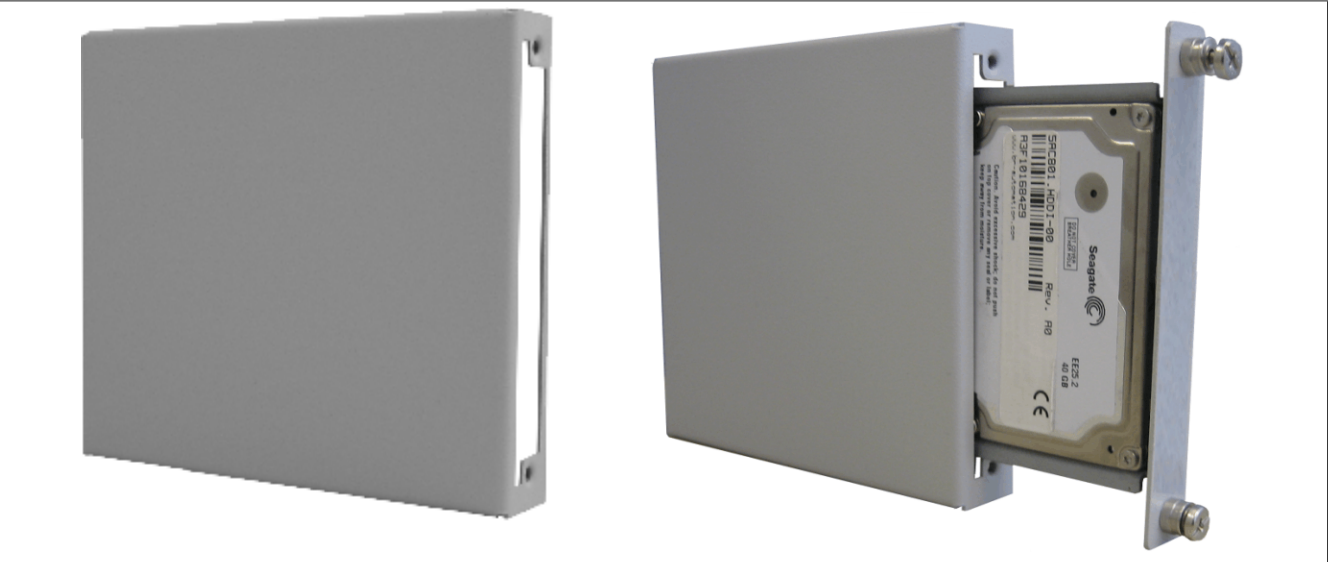


Abbildung 204: HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00

12.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC801.FRAM-00	APC810 SATA Hard Disk Ersatzablage	

Tabelle 316: 5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten

12.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5AC801.FRAM-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	106 mm
Höhe	101 mm
Tiefe	18 mm

Tabelle 317: 5AC801.FRAM-00 - Technische Daten

12.1.4 Abmessungen

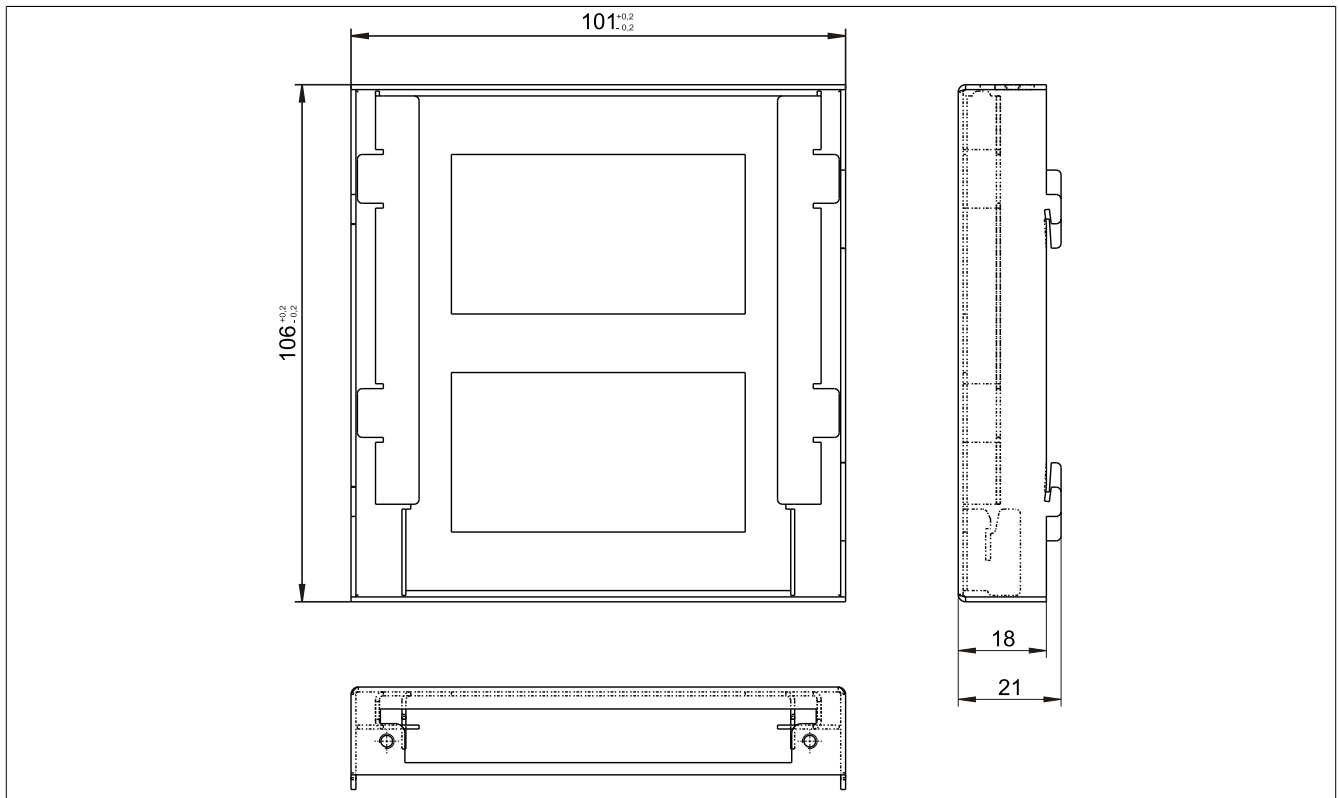


Abbildung 205: 5AC801.FRAM-00 - Abmessungen

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 318: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

1.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.

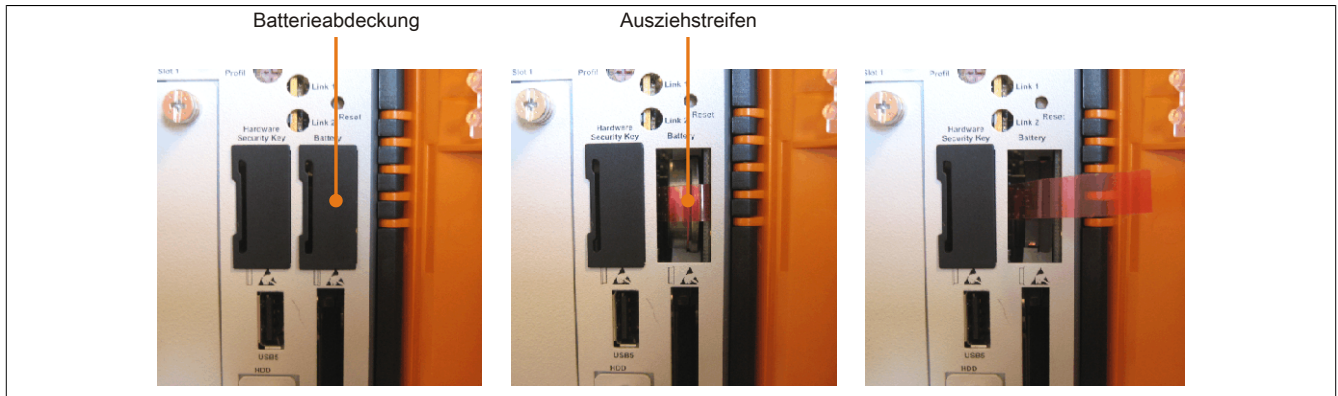


Abbildung 206: Batterie entfernen

- Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

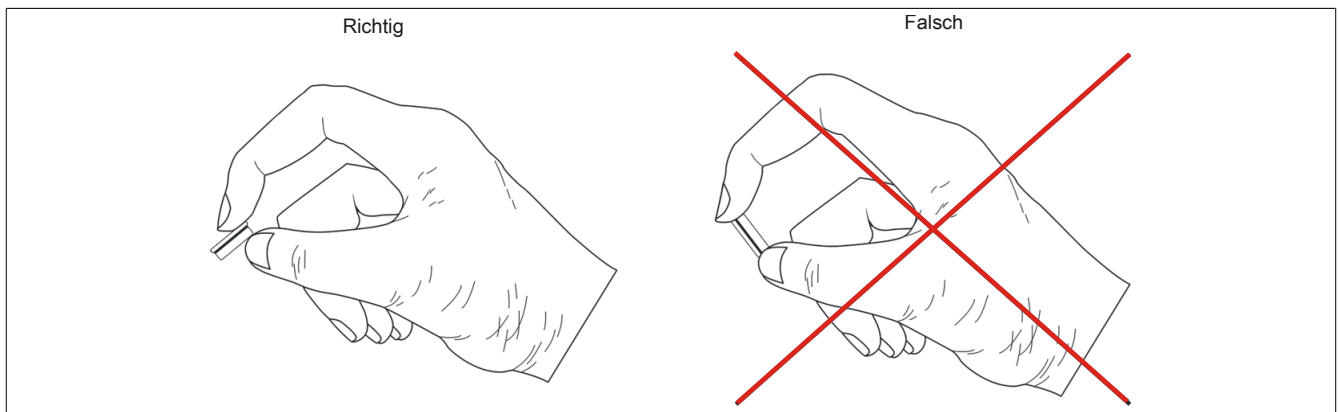


Abbildung 207: Batteriehandhabung

- Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.

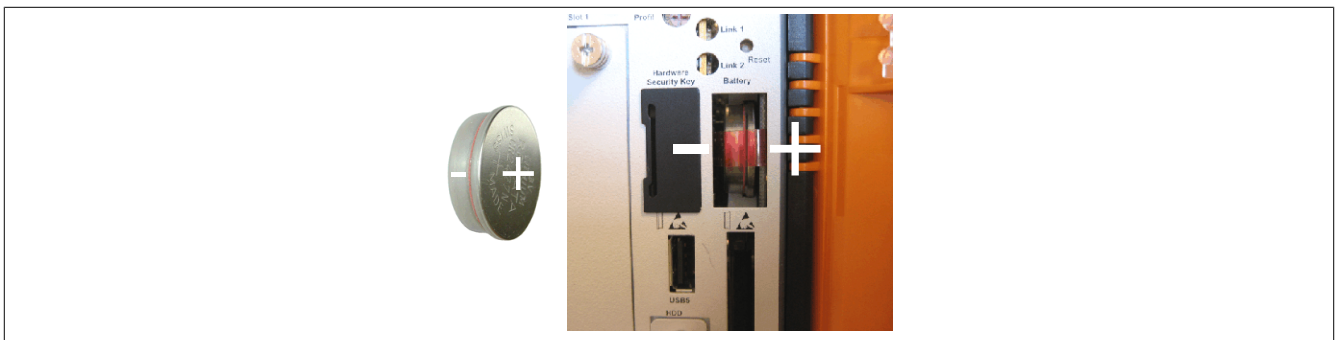


Abbildung 208: Batteriepolartität

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen - Netzstecker anstecken und Power Taster drücken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 CompactFlash Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CompactFlash Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) schnell und sicher möglich.

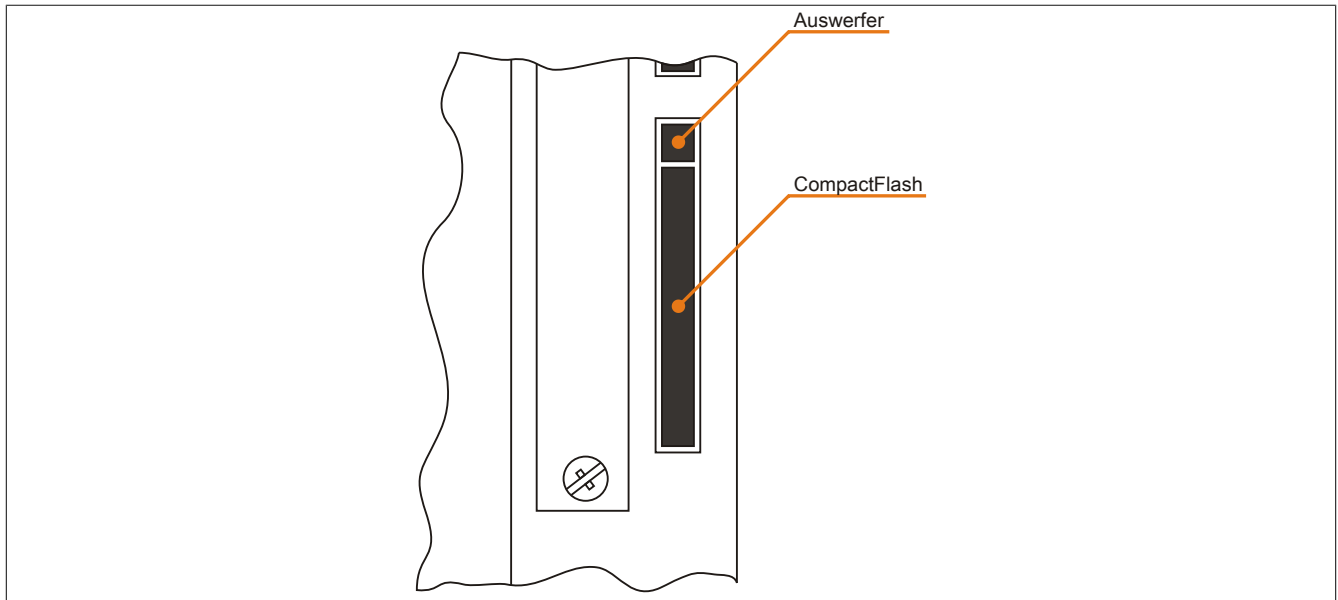


Abbildung 209: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)

3 Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Information:

Die SATA I Schnittstelle besitzt die Fähigkeit zum Austausch von Datenträgern im laufenden Betrieb (Hot-Plug). Um diese Eigenschaft nutzen zu können, muss dies vom Betriebssystem unterstützt werden.

3.1 Vorgangsweise

1. 2 Schnellverschlusschrauben der Schutzabdeckung bzw. des Slide-in compact Laufwerks lösen und entfernen.



Abbildung 210: Schnellverschlusschrauben lösen

2. Compact SATA Laufwerk einschieben und mit den Schnellverschlusschrauben befestigen.



Abbildung 211: Compact SATA Laufwerk einschieben

4 Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch

Slide-in Laufwerke können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden.

4.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschluss-schrauben.

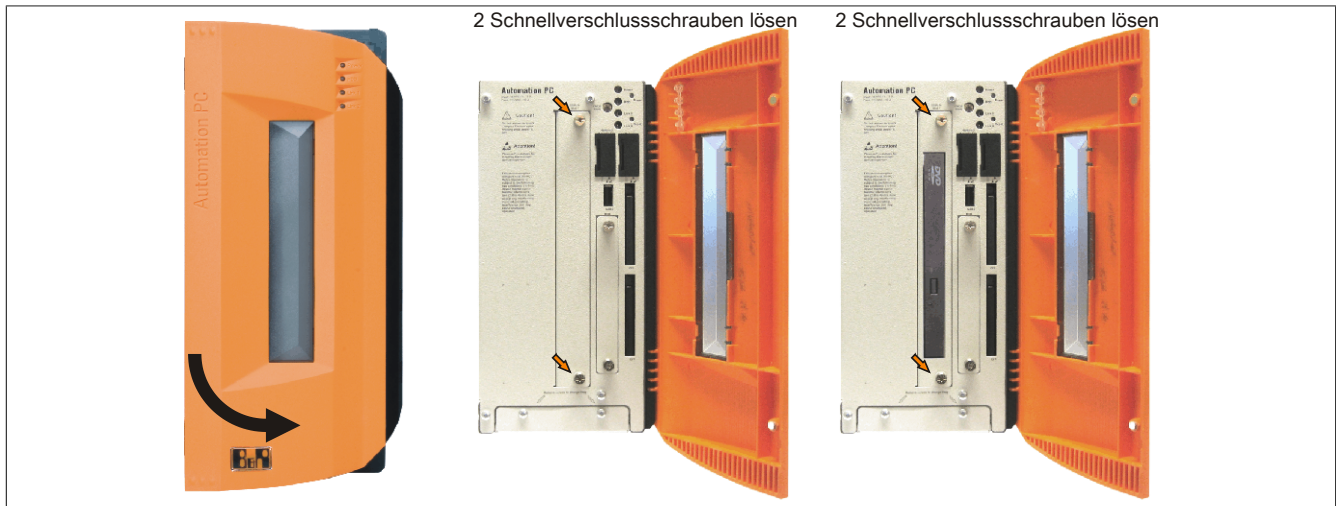


Abbildung 212: Schnellverschluss-schrauben lösen

4. Slide-in Laufwerk einstecken und mit den beiden Schnellverschluss-schrauben fixieren.

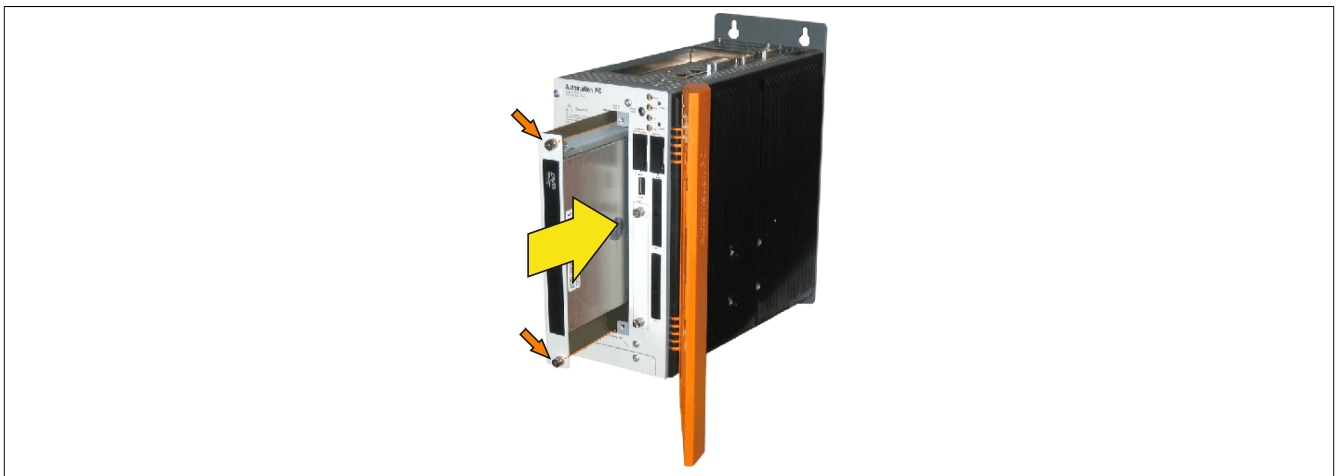


Abbildung 213: Slide-in Laufwerkseinbau

5 Slide-in compact Adapter Montage

Slide-in compact Adapter können bei Systemeinheiten mit 2, 3 oder 5 Card Slots eingebaut und getauscht werden. Mit dem Slide-in compact Adapter kann ein Slide-in compact Laufwerk (z.B. Slide-in compact HDD) in einem Slide-in Slot montiert werden.

5.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Slide-in Blindmodules bzw. Slide-in Laufwerks durch Lösen der 2 Schnellverschluss-schrauben.

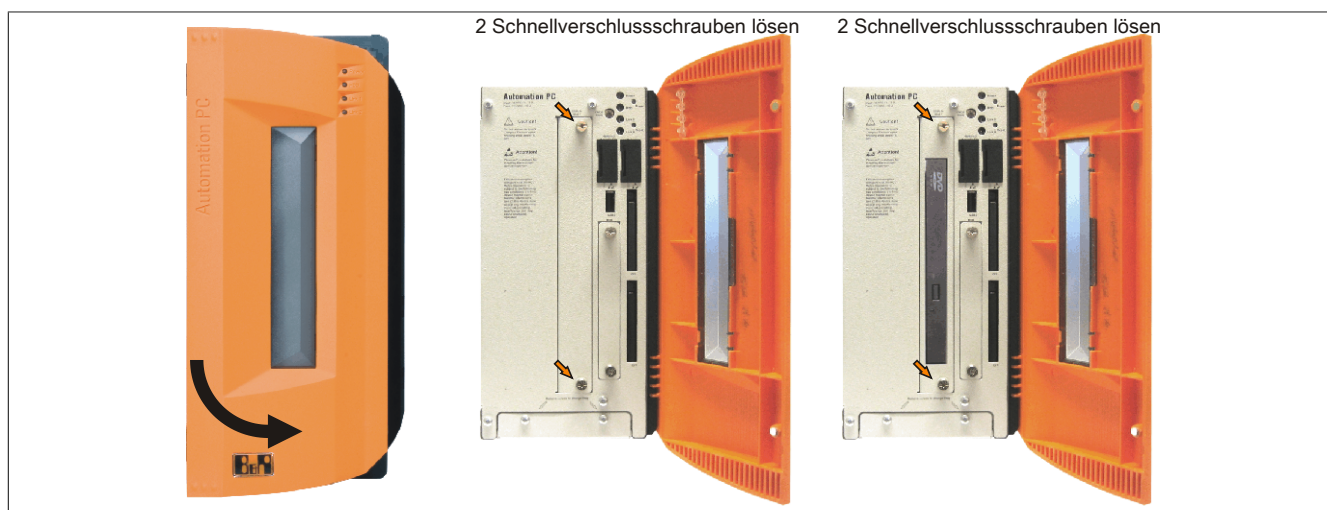


Abbildung 214: Schnellverschluss-schrauben lösen

4. Slide-in compact Adapter einstecken und mit den beiden Schnellverschluss-schrauben fixieren.

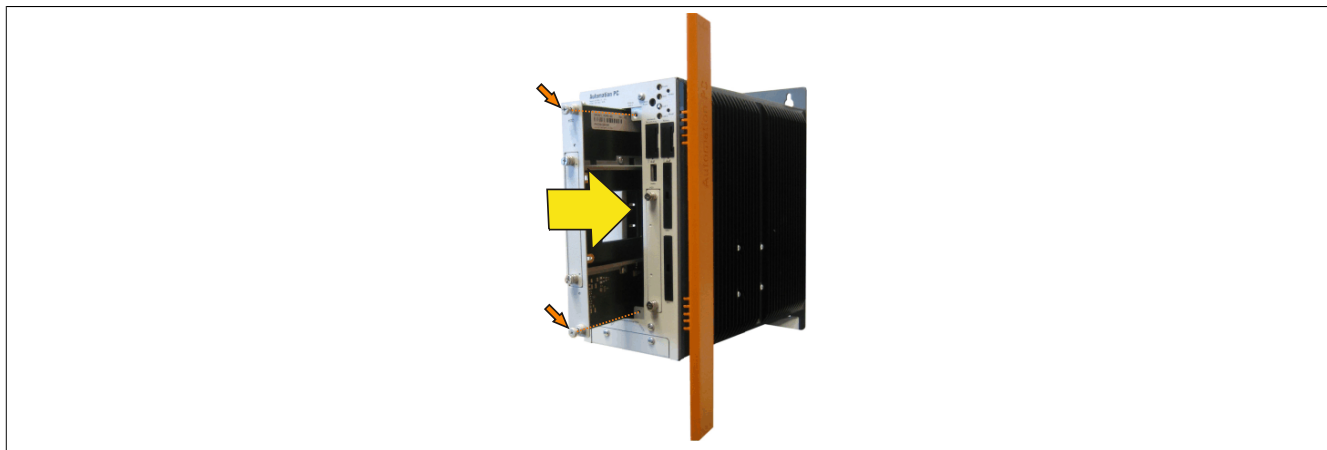


Abbildung 215: Slide-in compact Adapter Einbau

5. Nach der Montage kann ein Slide-in compact Laufwerk montiert werden.

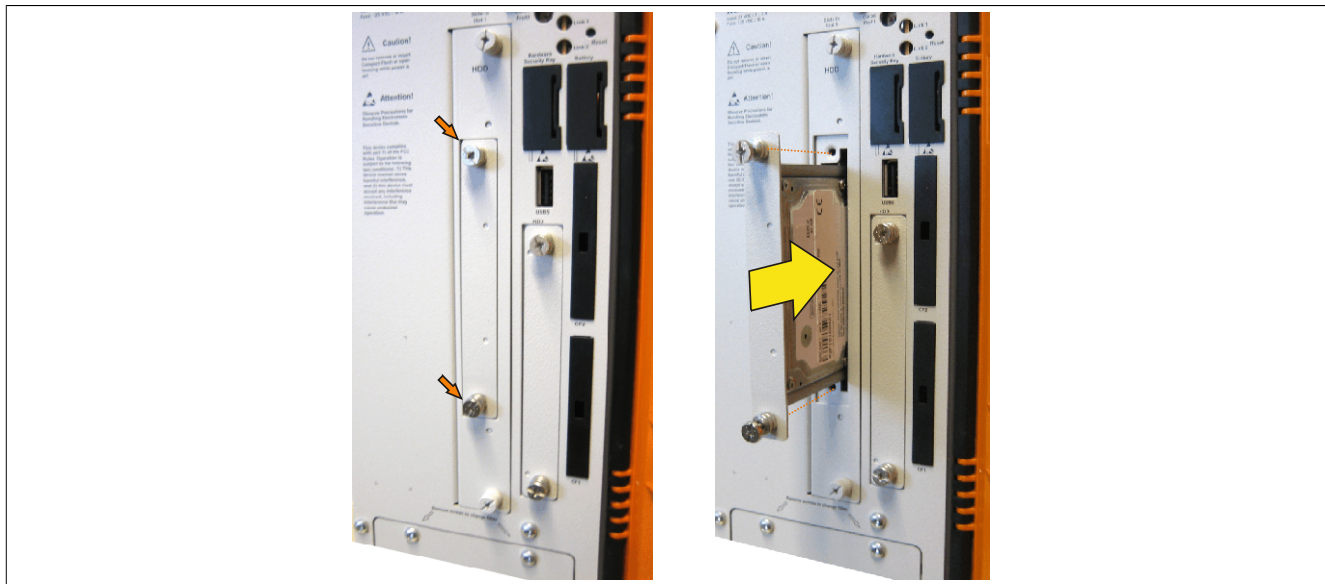


Abbildung 216: Slide-in compact Laufwerk montieren

6 Lüfter Kit Einbau / Tausch

6.1 Vorgangsweise

1. Lüfter Kit Abdeckung entfernen. Torx (T10) Schrauben lösen und Abdeckung nach vorne schieben.



Abbildung 217: Lüfter Kit Einschub entfernen

2. Den Rahmen einlegen - Kontaktplatinenseite auf die Schleifkontakte an der Systemeinheit - und mit den Schnellverschlusschrauben befestigen.

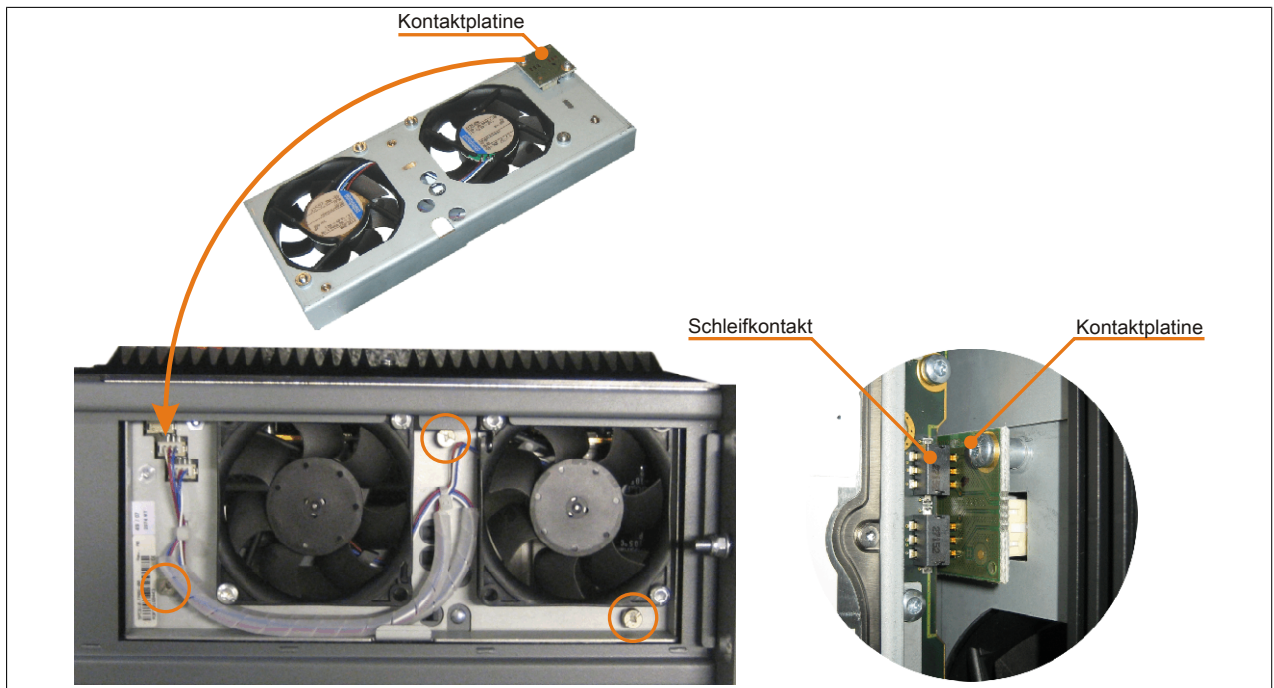


Abbildung 218: Lüfter Kit einlegen und befestigen

3. Staubfilter in die Lüfter Kit Abdeckung einlegen und mit der Filterspanne fixieren.

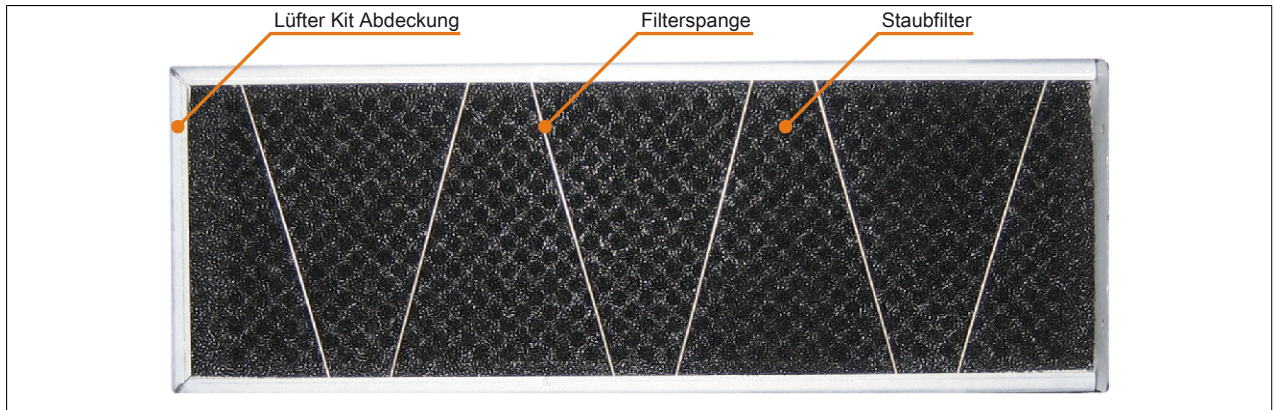


Abbildung 219: Staubfilter mit Filterspange fixieren

4. Lüfter Kit Abdeckung im Gehäuse einsetzen und mit den zuvor gelösten Torxschrauben befestigen.

Information:

Regelmäßige Kontrolle des Staubfilters je nach Einsatzgebiet und Verschmutzungsgrad.
Der Einbau ist bei allen APC810 Modellen ähnlich vorzunehmen.

7 Montage des USV Moduls

Die Montage erfolgt mit dem beigelegten Montagematerial beim USV Modul.

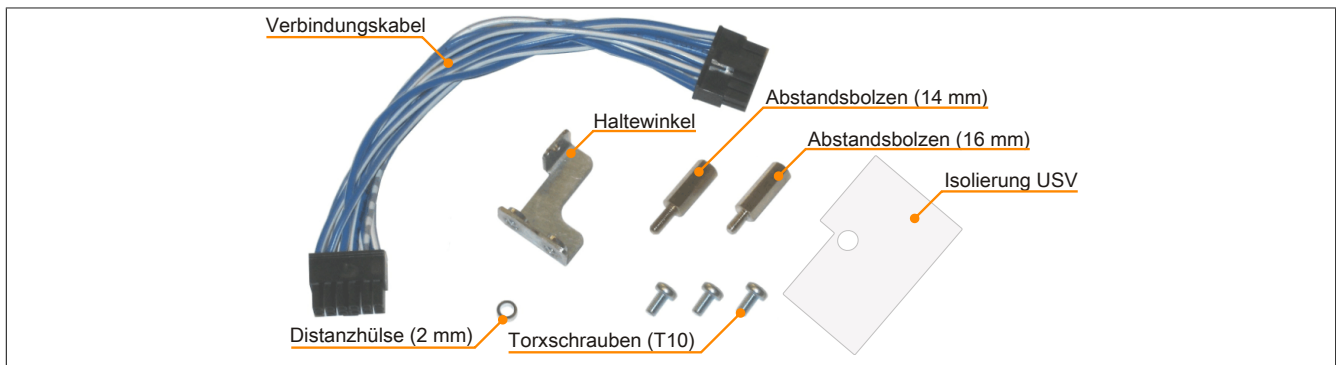


Abbildung 220: 5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial

Die Montage unterscheidet sich je nach Systemeinheitenvariante (1,2 oder 5 Card Slots) bzw. auch ob ein Add-on Schnittstellenmodul (IF Option) im APC810 montiert ist.

7.1 Montage ohne montiertem Add-on Schnittstellenmodul

Je nach Systemeinheitenvariante und montiertem oder nicht montiertem Add-on Interfacemodul sind unterschiedliche Teile zu verwenden.

7.1.1 APC810 1 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.



Abbildung 221: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

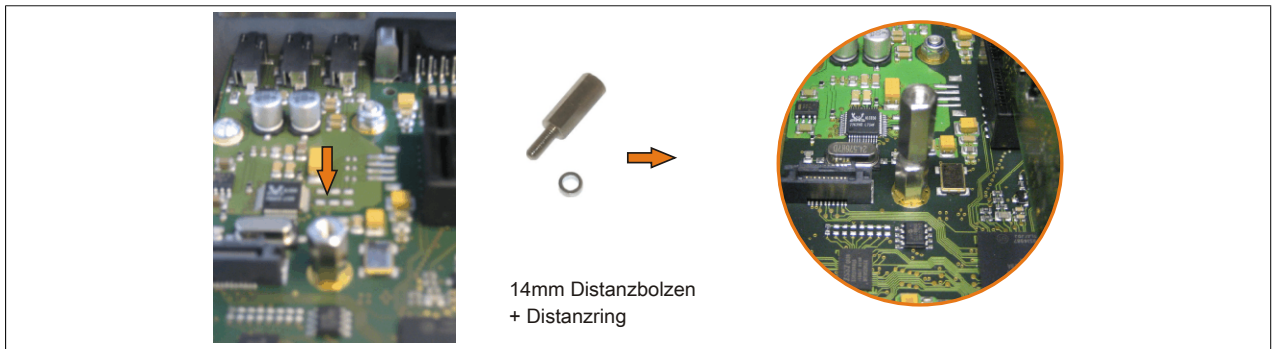


Abbildung 222: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

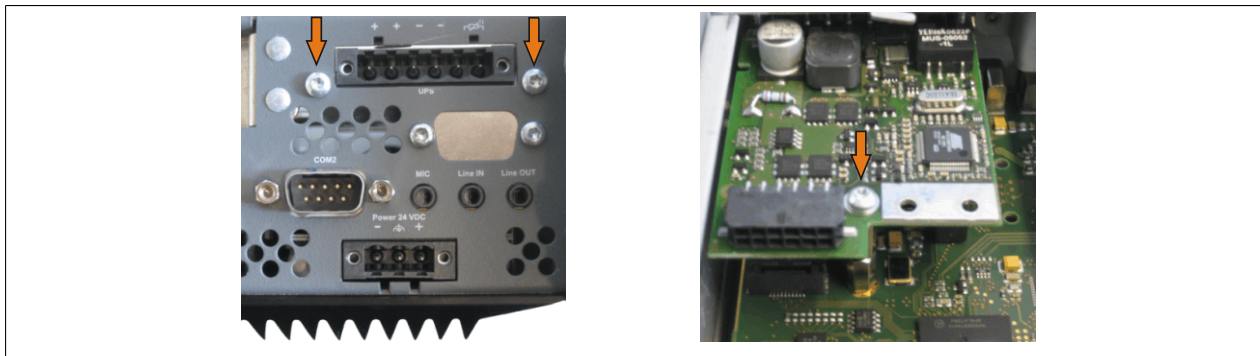


Abbildung 223: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

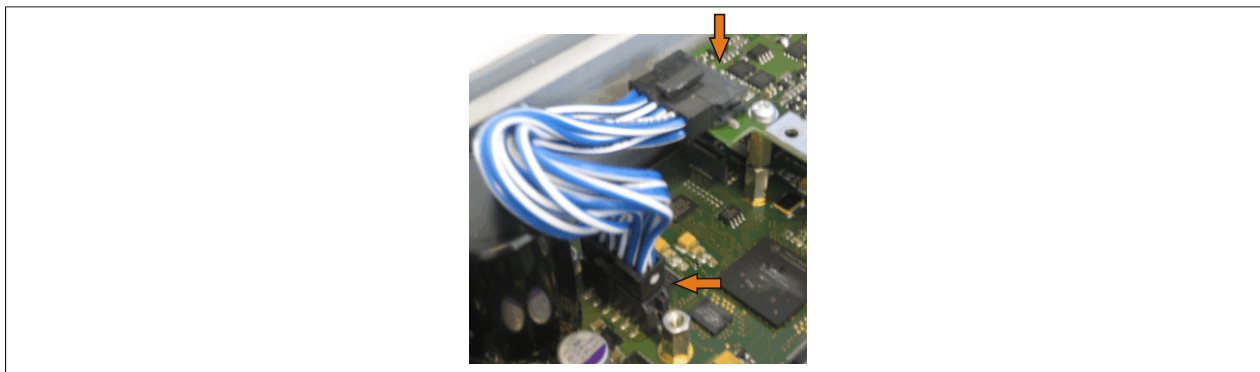


Abbildung 224: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

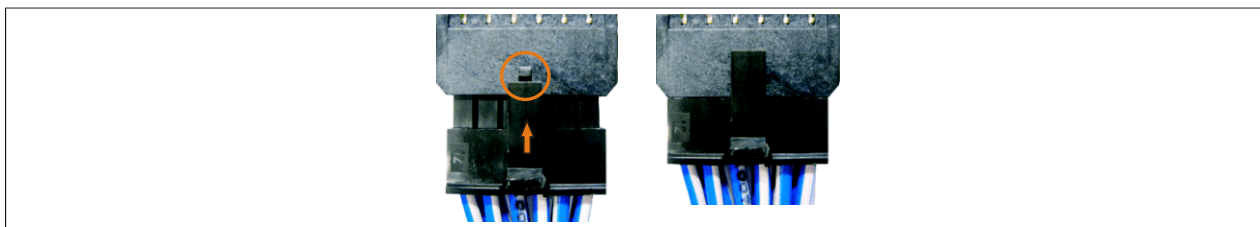


Abbildung 225: Steckerverriegelung

6. Seitendeckel montieren.

7.1.2 APC810 2 und 3 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

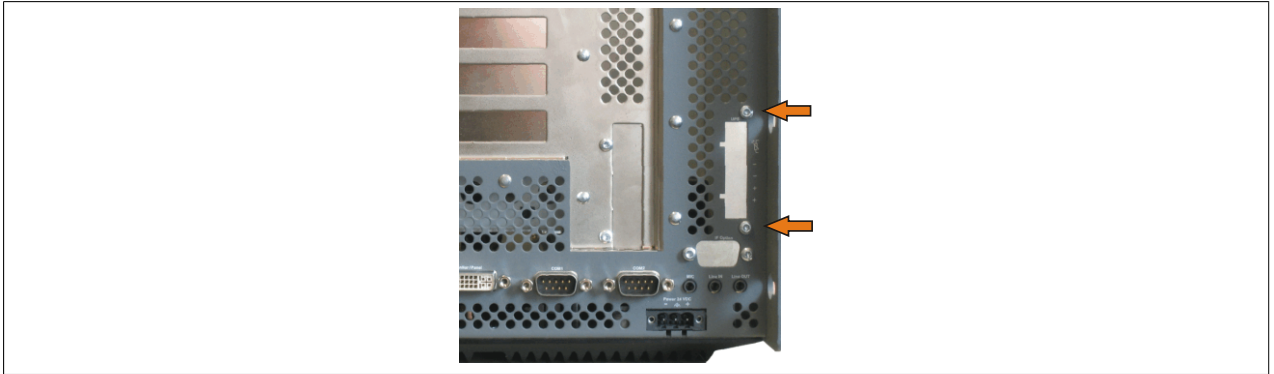


Abbildung 226: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring am Basisboard montieren (mittels Innensechskant- Schraubendreher Größe 5).

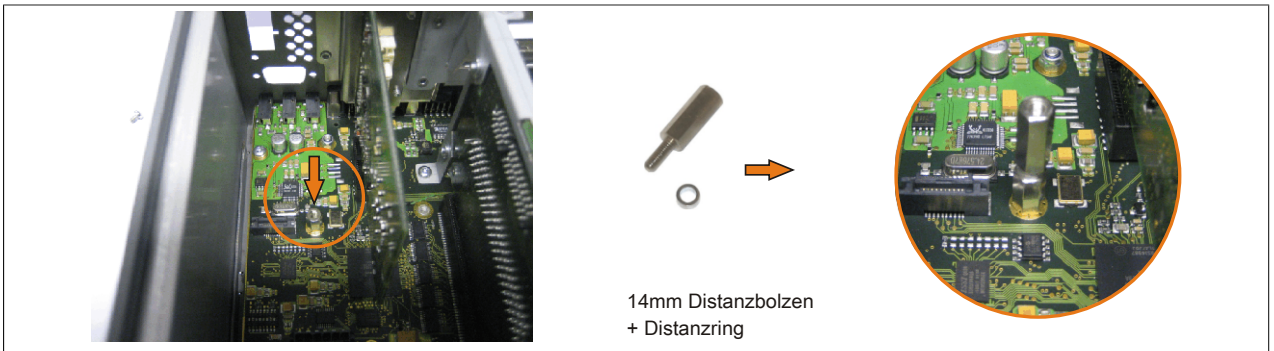


Abbildung 227: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

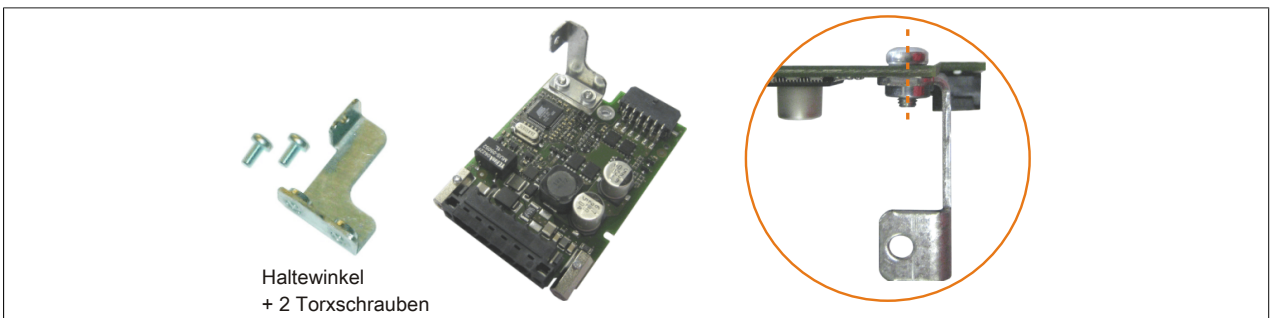


Abbildung 228: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

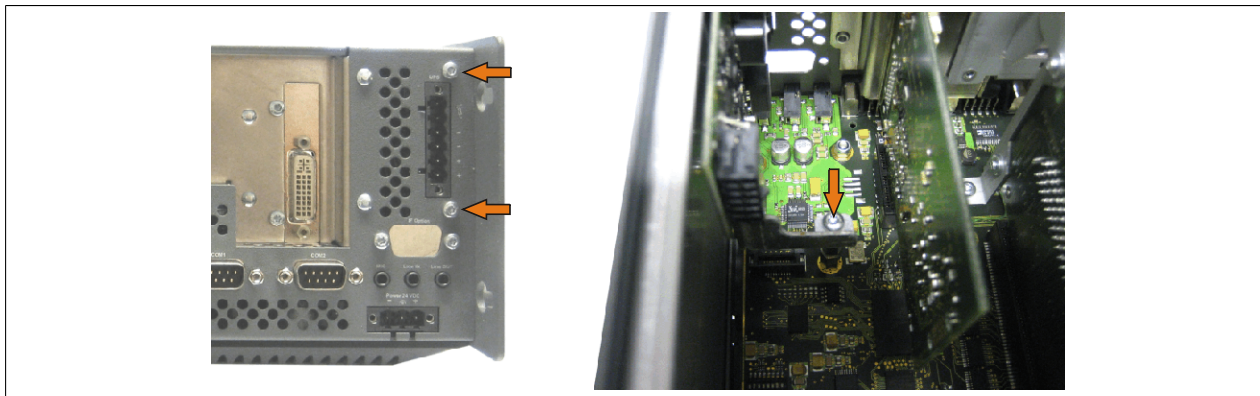


Abbildung 229: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

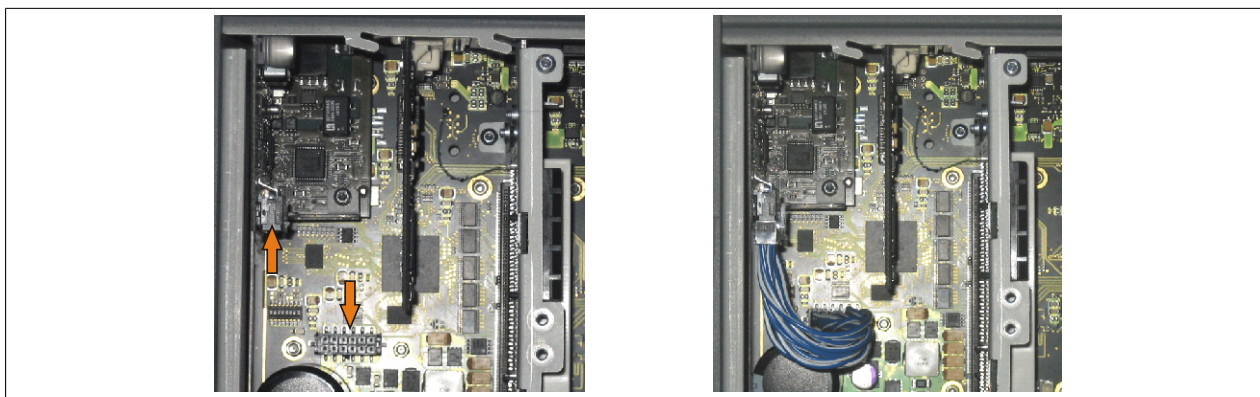


Abbildung 230: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

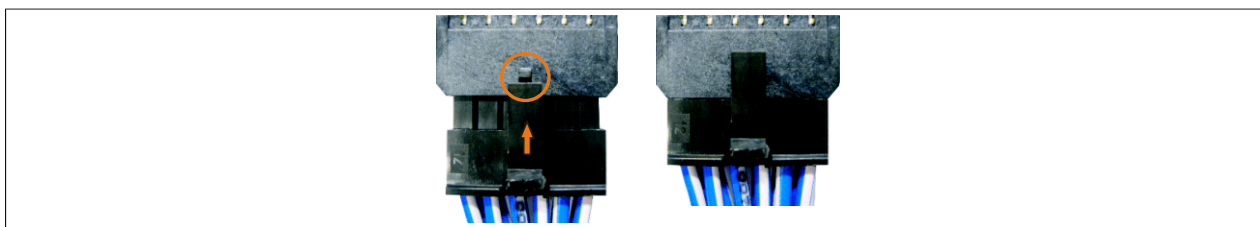


Abbildung 231: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren.

7.1.3 APC810 5 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

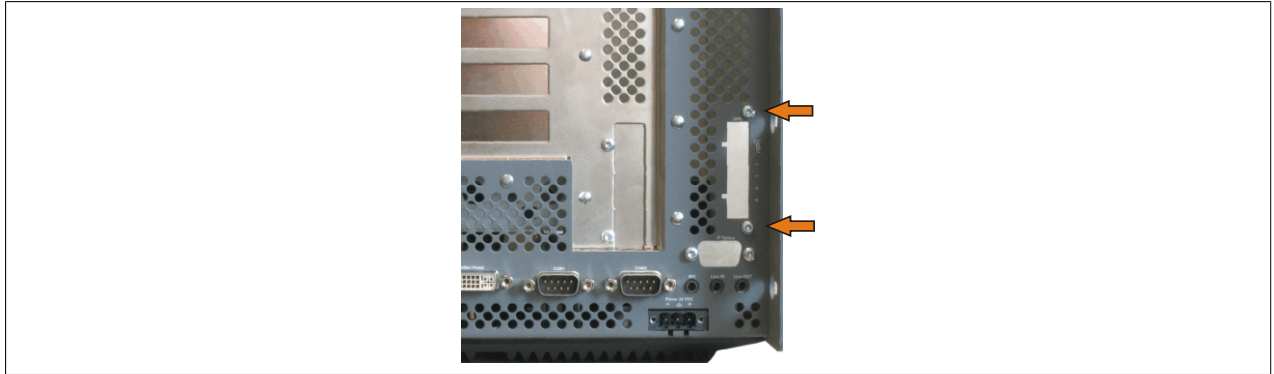


Abbildung 232: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

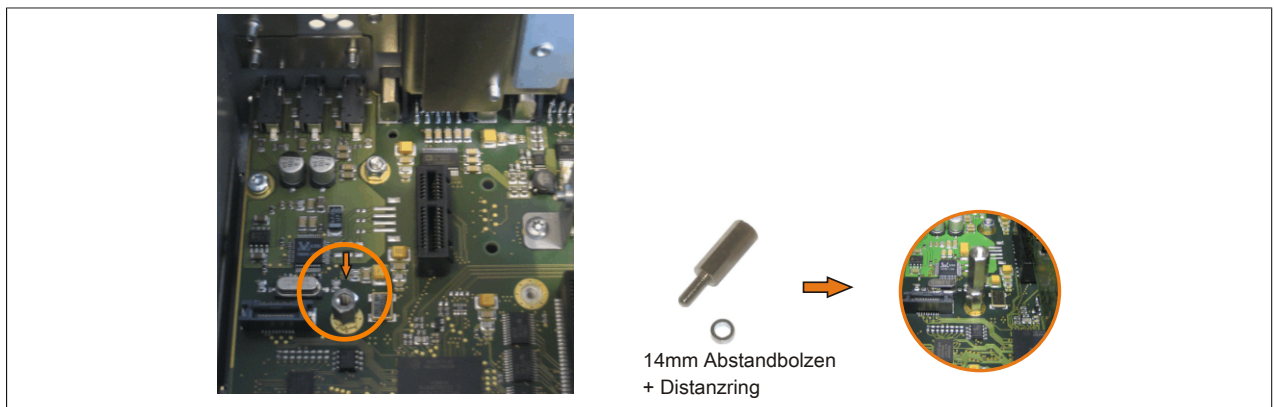


Abbildung 233: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

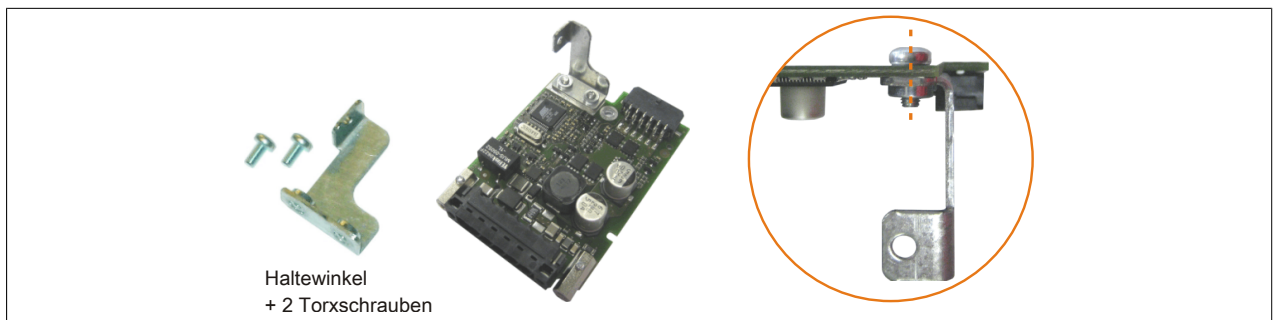


Abbildung 234: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 2 Torxschrauben (T10) am Gehäuse und 1 Torxschraube (T10) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial zu verwenden.

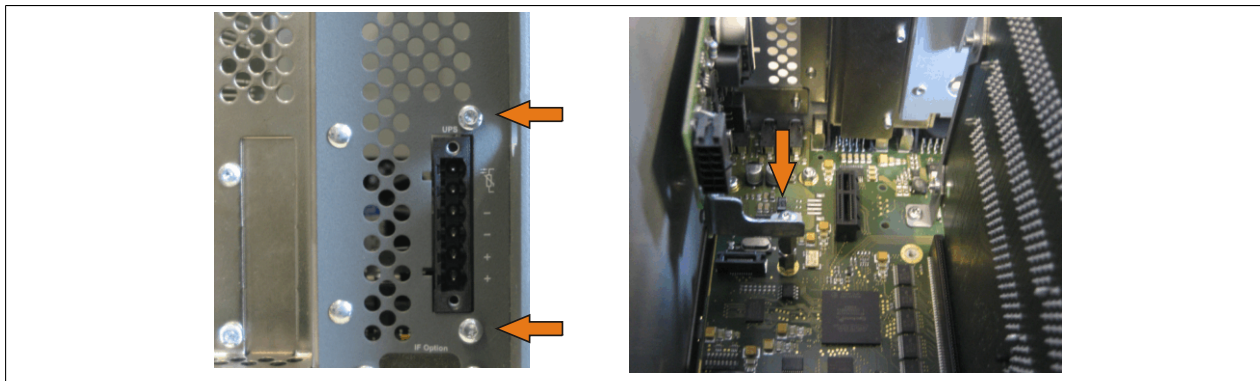


Abbildung 235: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anbringen (siehe markierte Buchsen)

Abbildung 236: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

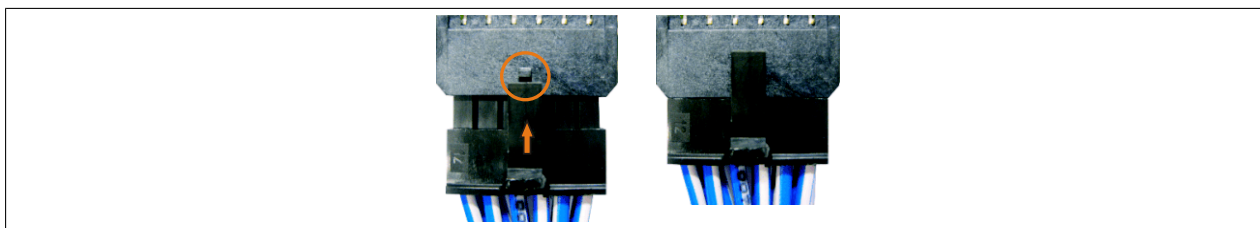


Abbildung 237: Steckerverriegelung

7. Seitendeckel montieren

7.2 Montage mit montiertem Add-on Schnittstellenmodul

7.2.1 APC810 1 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

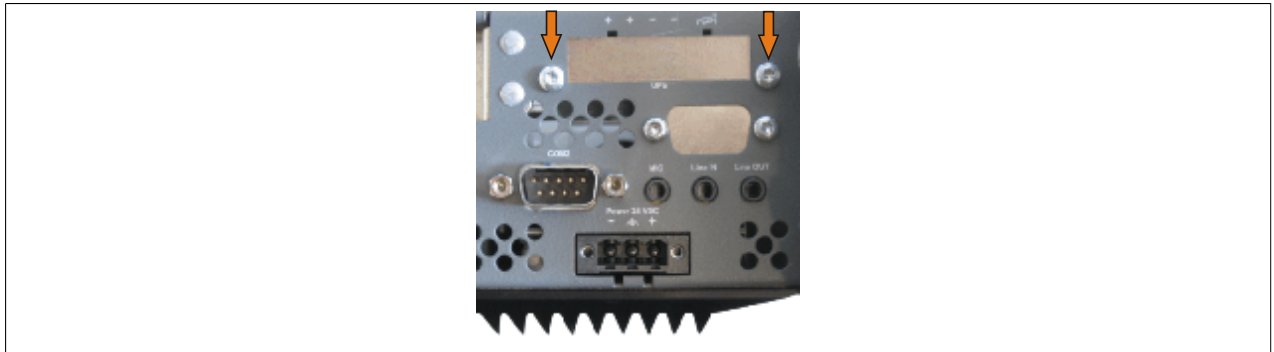


Abbildung 238: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

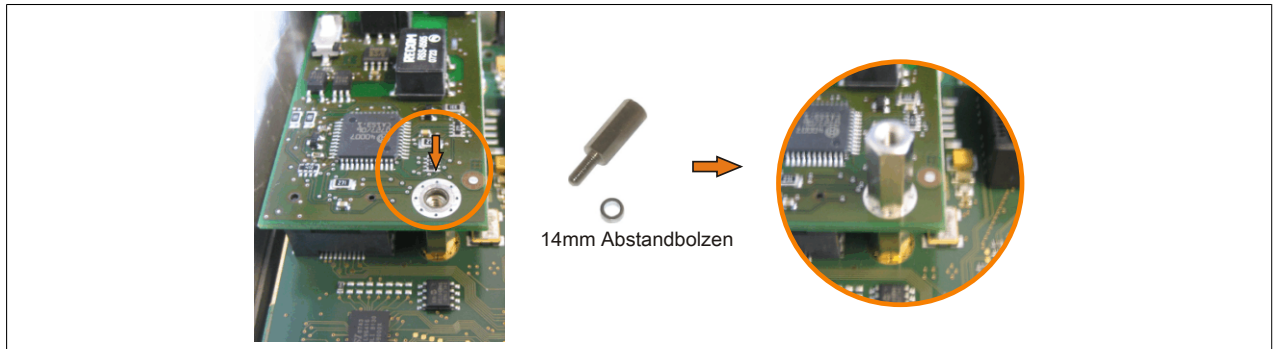


Abbildung 239: Distanzbolzen montieren

4. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

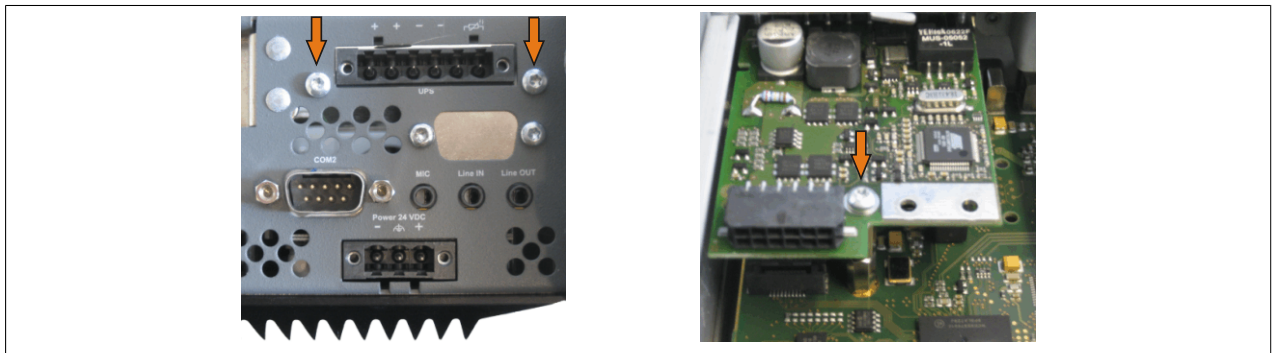


Abbildung 240: USV Modul montieren

5. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

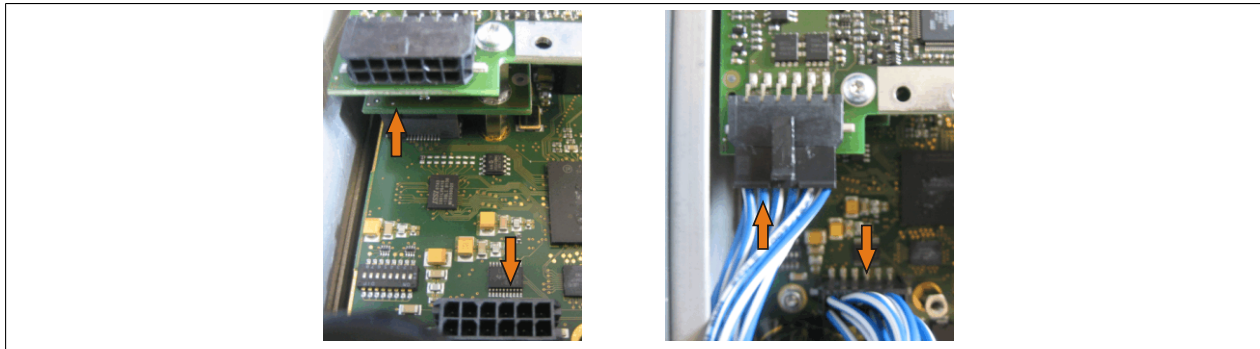


Abbildung 241: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

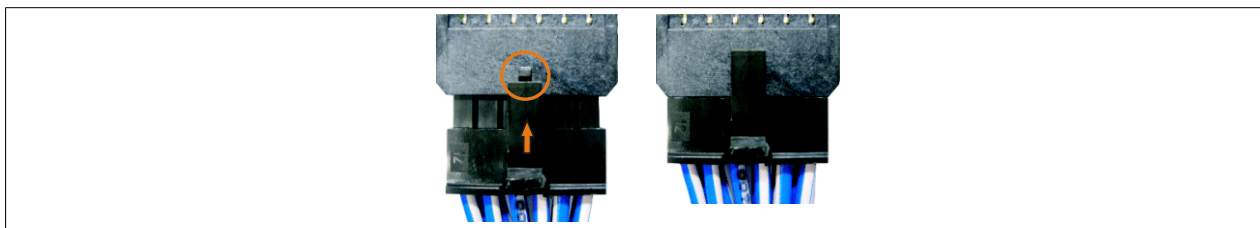


Abbildung 242: Steckerverriegelung

6. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.2 APC810 2 und 3 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

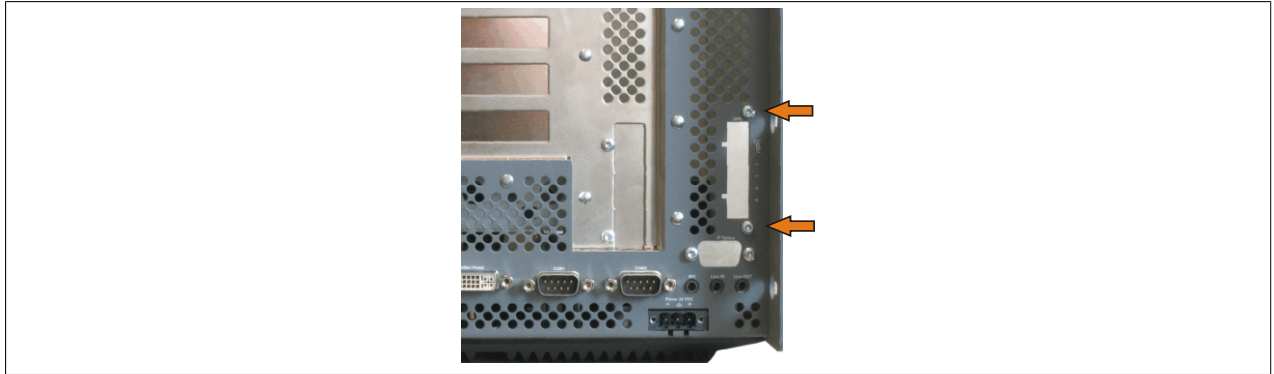


Abbildung 243: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

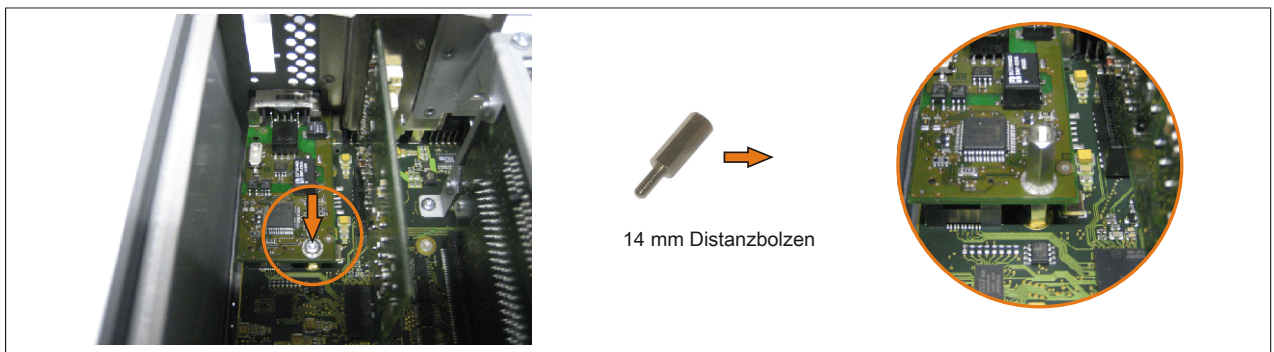


Abbildung 244: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

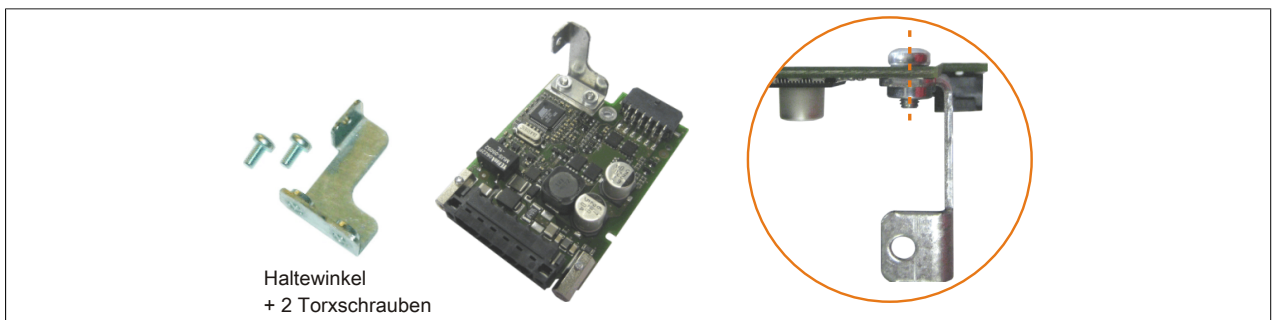


Abbildung 245: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

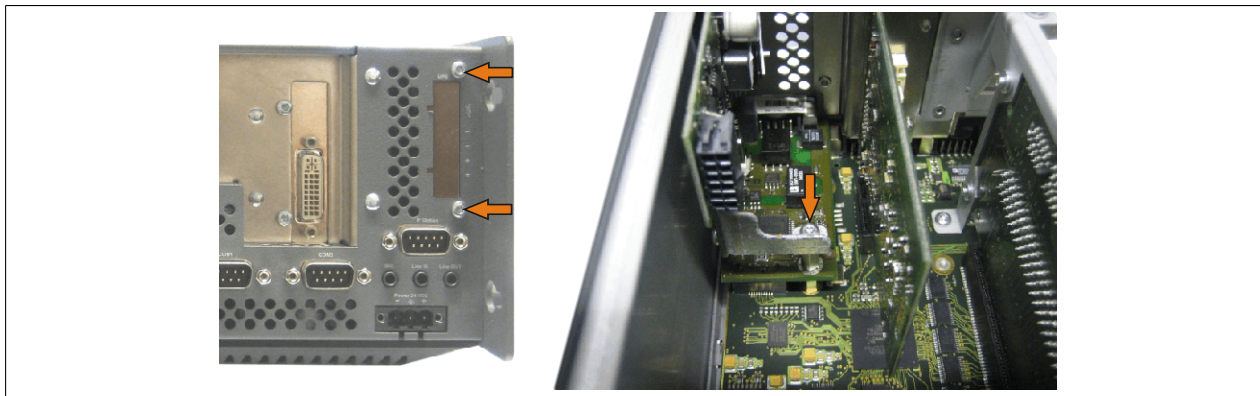


Abbildung 246: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

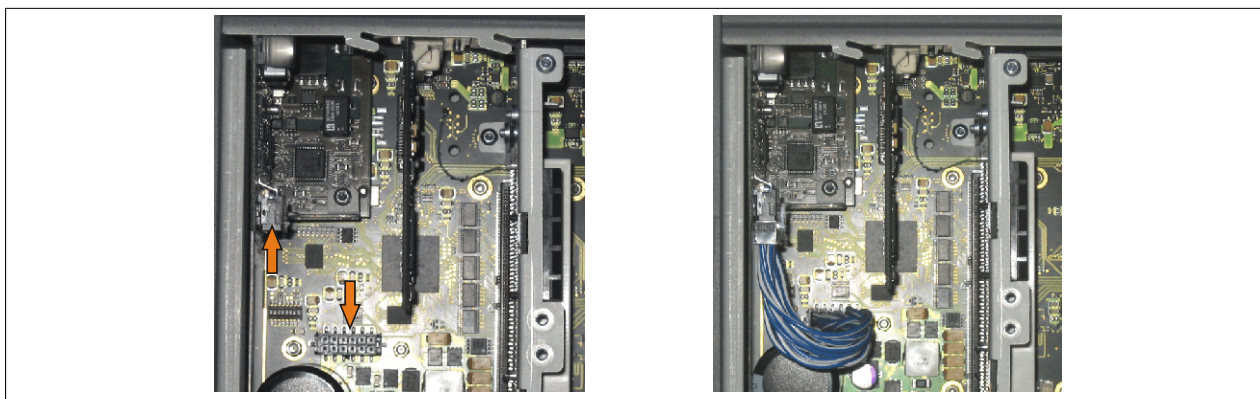


Abbildung 247: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

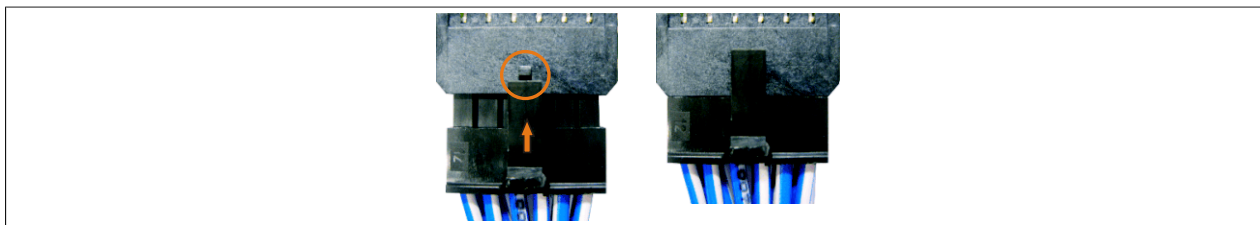


Abbildung 248: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

7.2.3 APC810 5 Card Slot

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung durch lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

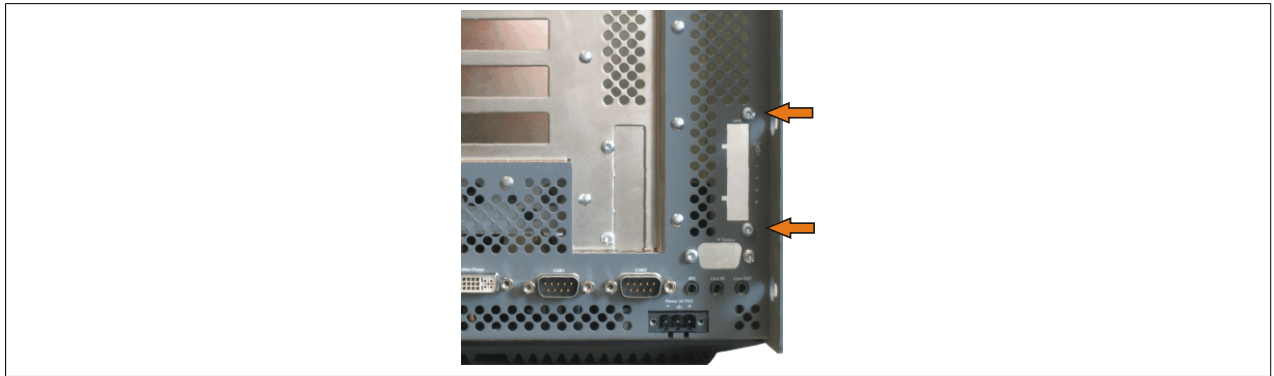


Abbildung 249: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen montieren (mittels Innensechskant Schraubendreher Größe 5).

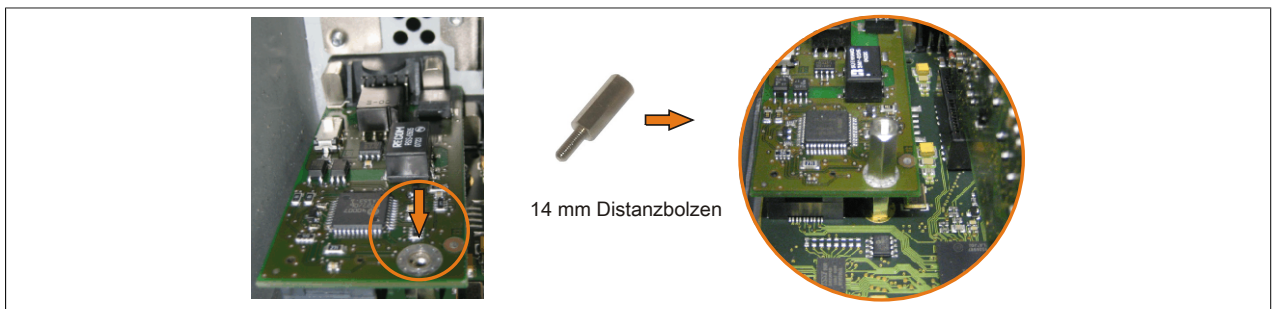


Abbildung 250: Distanzbolzen montieren

4. Haltewinkel mit 2 Torxschrauben (T10) am USV Modul montieren.

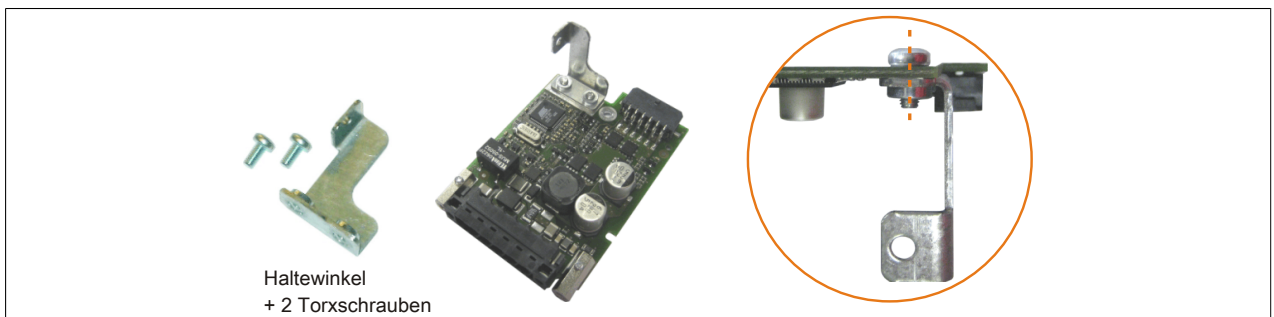


Abbildung 251: Haltewinkel montieren

5. USV Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben und eine Torxschraube aus dem Montagematerial zu verwenden.

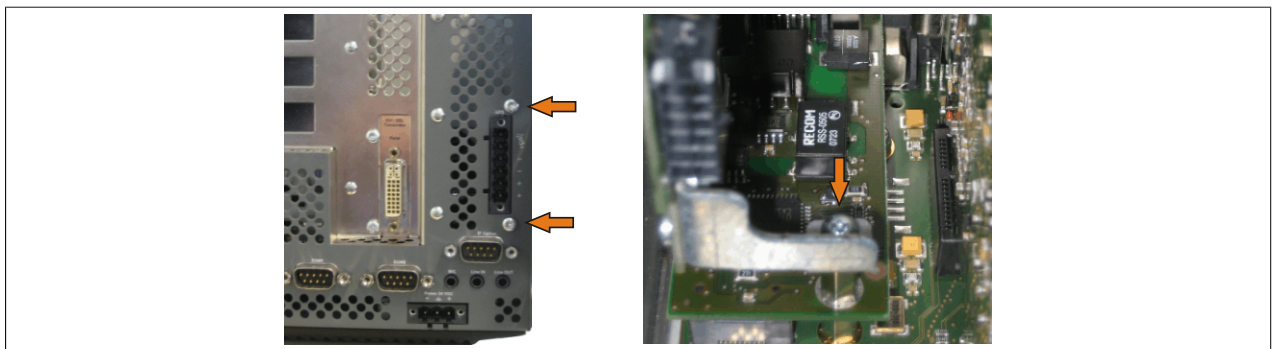


Abbildung 252: USV Modul montieren

6. Verbindungskabel anstecken (siehe markierte Buchsen).

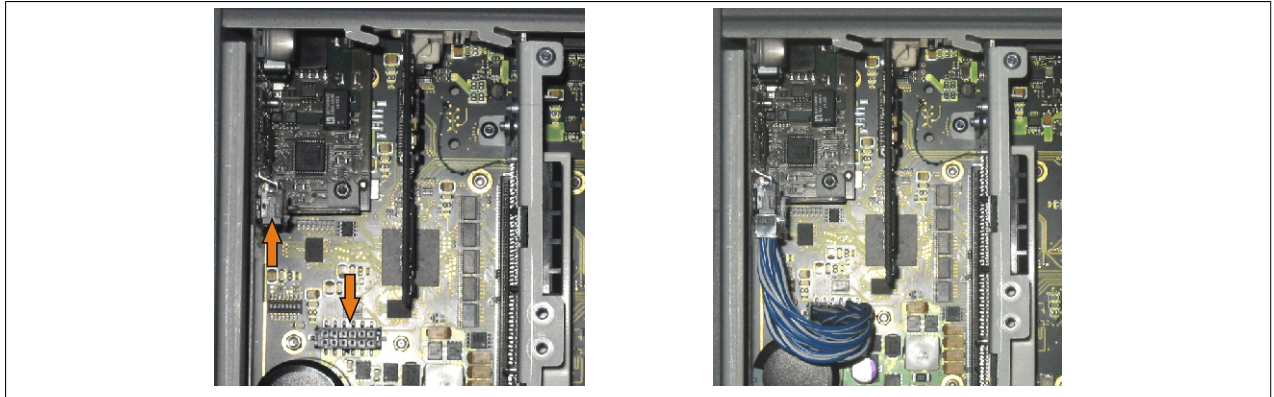


Abbildung 253: Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des Verbindungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

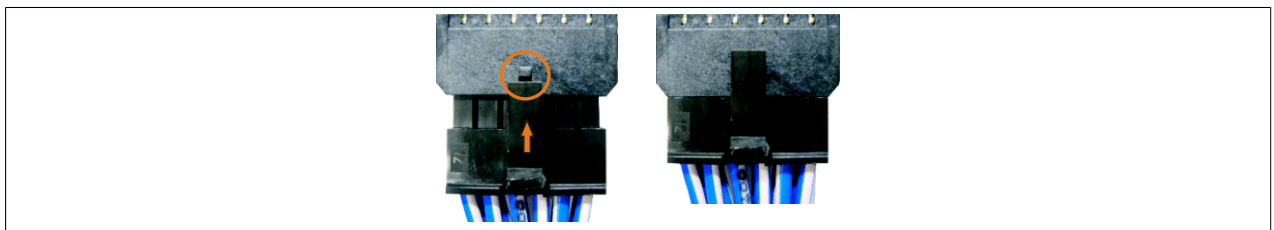


Abbildung 254: Steckerverriegelung

7. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

8 Seitendeckeldemontage

Die Seitenabdeckung kann einfach durch lösen von Torx (T10) Schrauben entfernt werden. Je nach System variiert die Anzahl der Torxschrauben.

8.1 APC810 mit 1 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangenen Frontabdeckung. Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.



Abbildung 255: APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage

8.2 APC810 mit 2 und 3 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangenen Frontabdeckung. Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung durch schieben nach vorne zu entfernen.

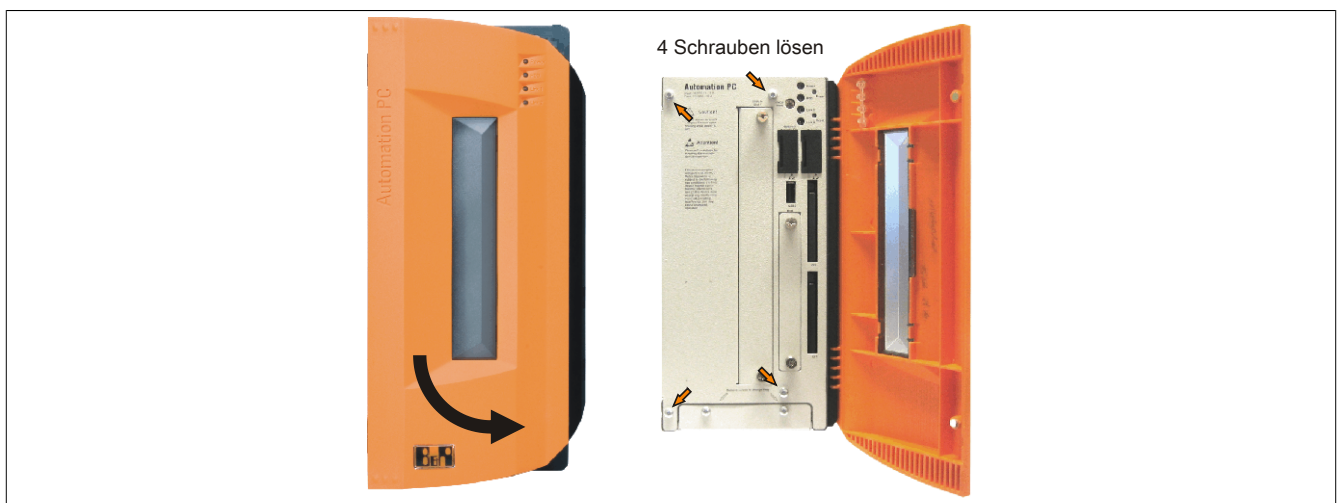


Abbildung 256: APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage

8.3 APC810 mit 5 Card Slot

1. Zuleitung zum Automation PC 810 spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Öffnen der orangenen Frontabdeckung . Hinter der Abdeckung müssen die in der nachfolgenden Abbildung markierten Kombitorxschrauben (T10) gelöst werden.
4. Nach dem Lösen der Schrauben ist die Seitenabdeckung nach vorne zu entfernen.

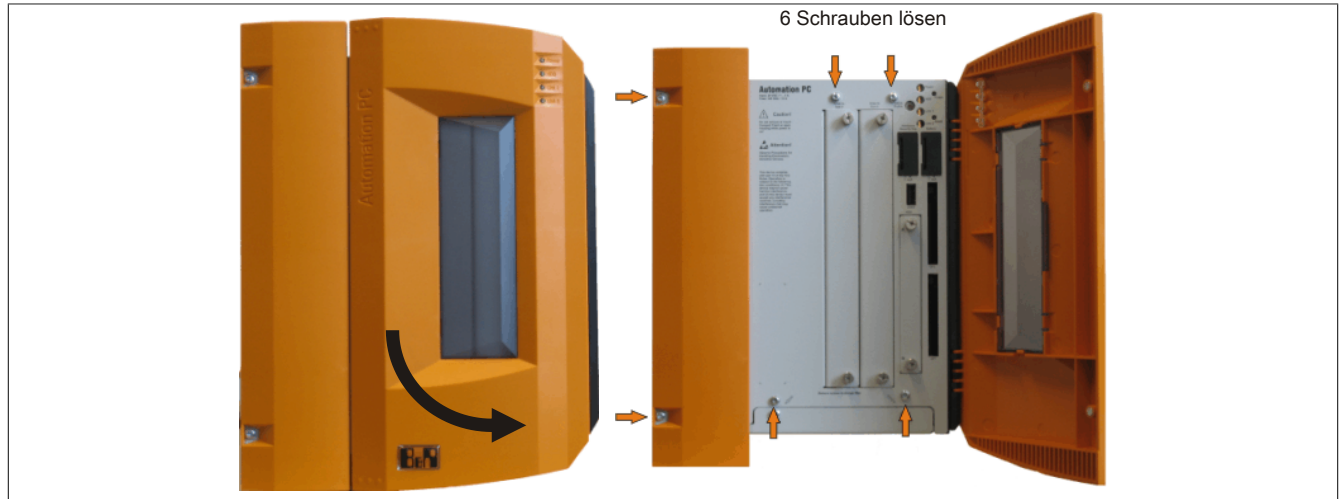


Abbildung 257: APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage

9 AP Link Montage

9.1 Vorgangsweise

1. Seitendeckel entfernen (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. AP Link Modulabdeckung durch Lösen von den 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

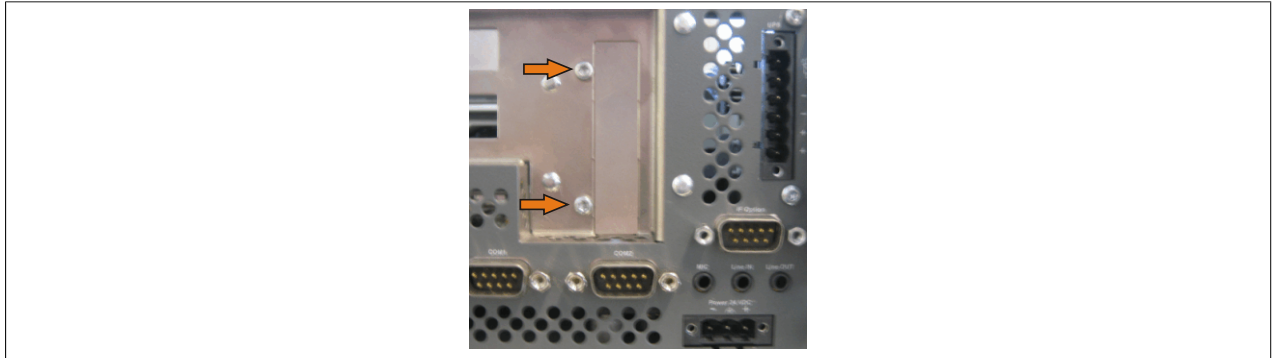


Abbildung 258: AP Link Modulabdeckung entfernen

3. Die AP Link Karte in den dafür vorgesehenen Slot stecken.

Warnung!

Beim Einstecken der AP Link Karte ist darauf zu achten, dass diese richtig in den AP Link Slot einrastet.

Die Karte nicht mit Gewalt in den Slot drücken.

4. AP Link Modul mit 3 Torxschrauben (T10) montieren. Es sind die zuvor entfernten Torxschrauben aus dem Montagematerial sowie eine zusätzliche Torxschraube zu verwenden.

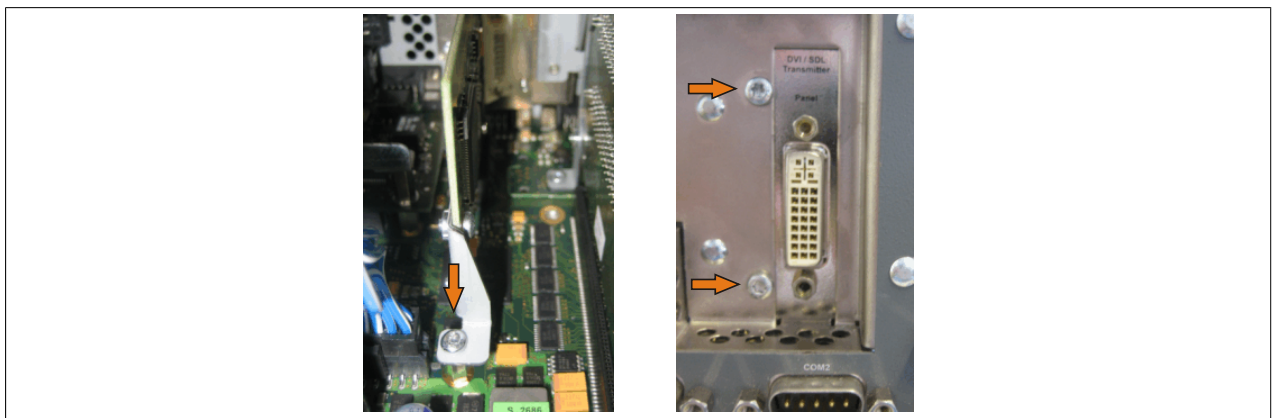


Abbildung 259: AP Link Modul montieren

5. Abdeckblech und Seitendeckel montieren.

10 Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk bei RAID 1

Als Beispiel wird angenommen, dass bei einer RAID 1 Konfiguration die Secondary Hard Disk (HDD1) defekt ist. In diesem Fall ist es möglich, die defekte Hard Disk durch eine Ersatz SATA Hard Disk zu ersetzen.

Bestellnummer PCI SATA RAID Controller	Bestellnummer benötigte Ersatz SATA-HDD	Anmerkung
5ACPCI.RAIC-03	5ACPCI.RAIC-04	160 GByte Hard Disk
5ACPCI.RAIC-05	5MMHDD.0250-00	250 GByte Hard Disk

Tabelle 319: Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller

Für den Tausch der Hard Disk wird ein Torx Schraubendreher der Größe 10 benötigt.

10.1 Vorgangsweise

1. Zuleitung zum Gerät spannungslos machen.
2. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
3. Entfernung des Seitendeckels.
4. Entfernung des SATA RAID Einschubes.
5. Lösen der richtigen 4 Befestigungsschrauben (M3x5).

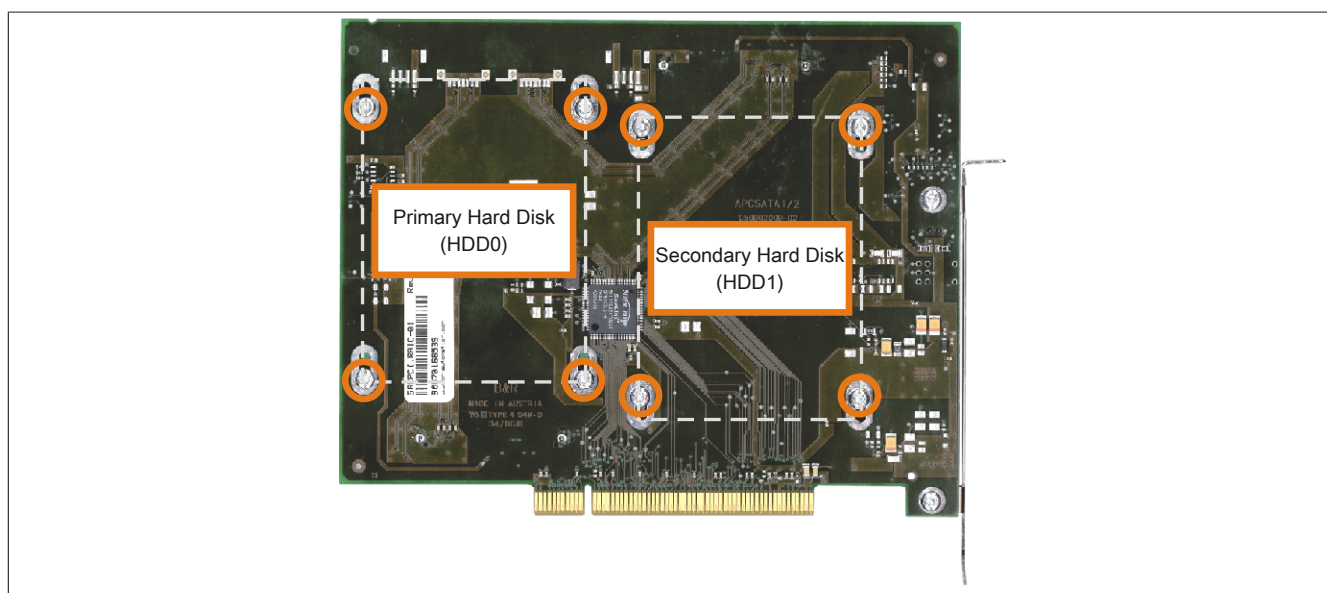


Abbildung 260: Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung

6. Vorderseitig die Hard Disk nach unten hin wegschieben (Bild 1).
7. Neue Hard Disk vorsichtig in die Steckverbindung (Bild 2) aufstecken und dabei die Hard Disk nur an der Stirnseite, nicht an der Oberseite, berühren.

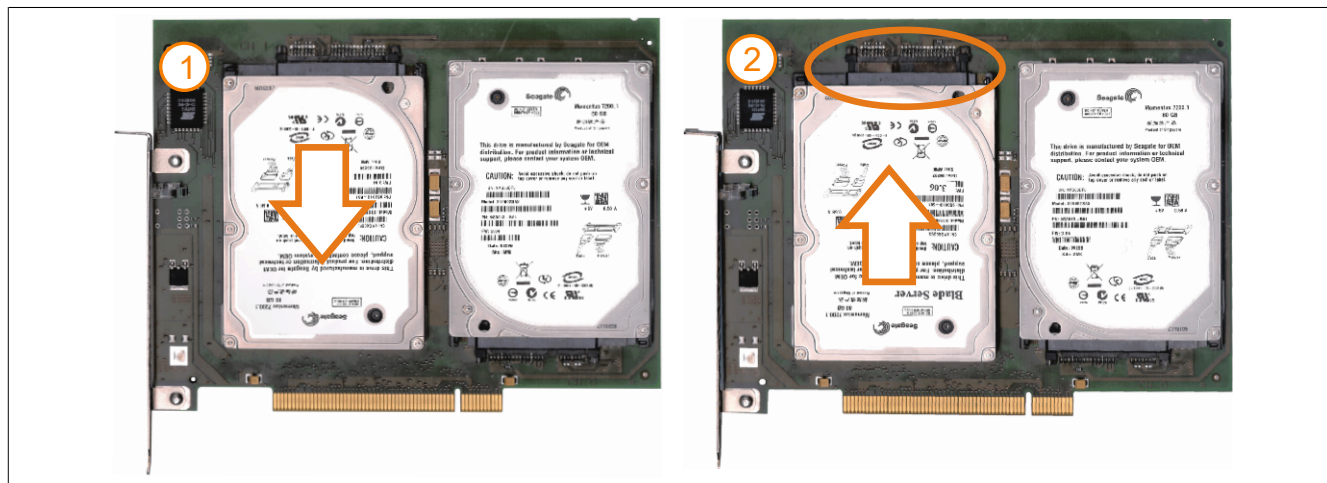


Abbildung 261: Hard Disk Tausch

8. Hard Disk mit den zuvor gelösten 4 Befestigungsschrauben (M3x5) wieder fixieren.

9. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
10. Nach dem Starten des Systems wird eine Fehlermeldung durch das RAID BIOS ausgegeben „RAID1 set is in Critical status - press any key to enter Configuration Utility“.
11. Es muss ein Rebuild im SATA RAID BIOS durchgeführt werden - siehe "Rebuild Mirrored Set" auf Seite 186.

11 Montage der HDD Ersatzdiskablage

11.1 Vorgangsweise

1. Die Ersatz HDD in die Ersatzdiskablage einschieben und mit den Schnellverschlusschrauben befestigen.



Abbildung 262: Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage

2. Die HDD Ersatzdiskablage mit den dafür vorgesehenen Haken am Gehäuse des APC810 an den Lüftungsschlitzen montieren.

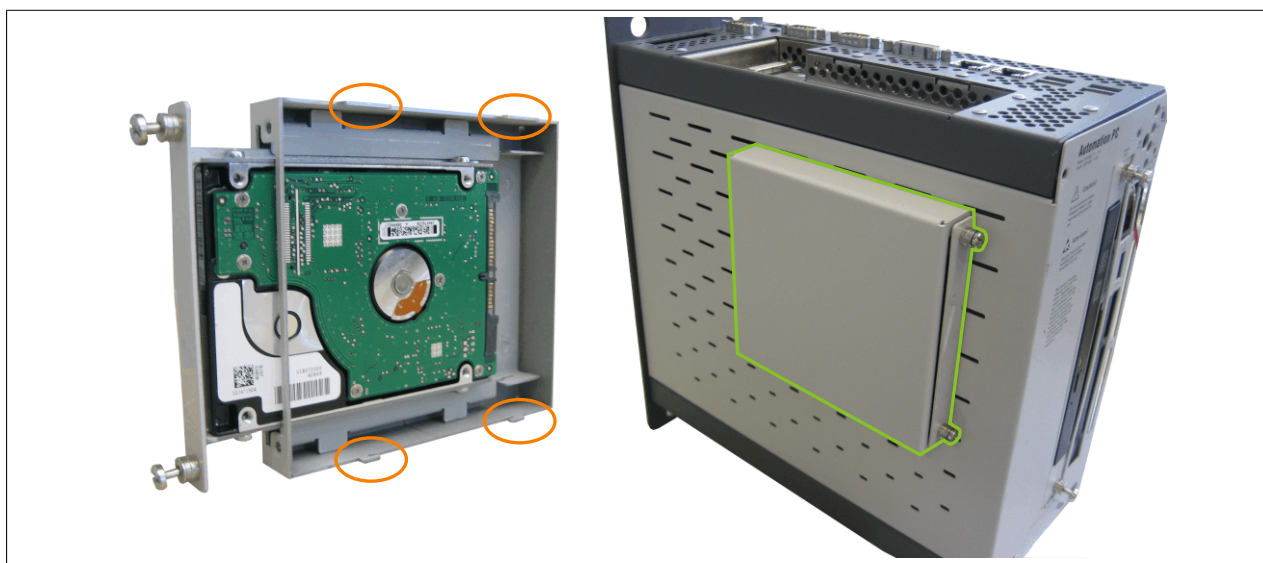


Abbildung 263: Montage der Ersatzdiskablage am APC810

12 Montage des Ready Relais /2 am Add-on USV Steckplatz

12.1 Vorgangsweise

1. Seitendeckel entfernen (siehe Abschnitt 8 "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381).
2. USV Modulabdeckung oder montierte USV durch lösen der 2 markierten Torxschrauben (T10) entfernen.

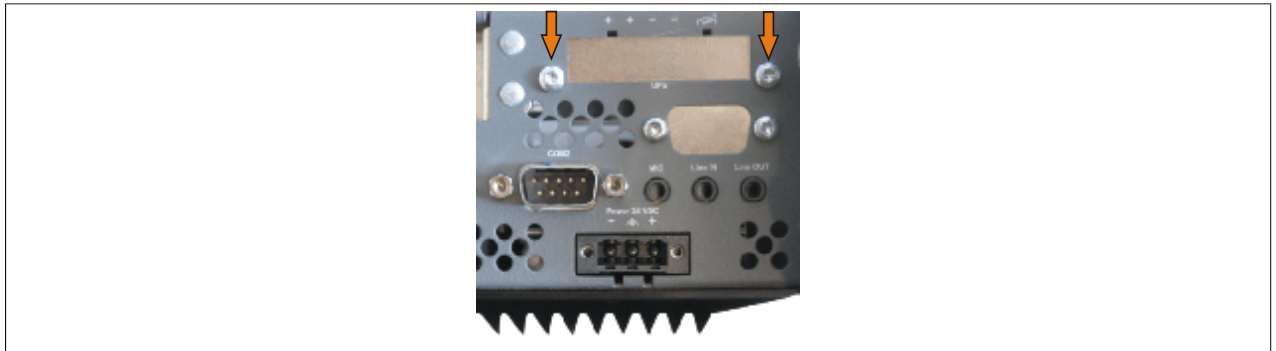


Abbildung 264: USV Modulabdeckung entfernen

3. Distanzbolzen und Distanzring (sofern nicht schon von der USV montiert) am Basisboard anbringen (mittels Innensechskant-Schraubendreher Größe 5). Bei den APC810 Systemeinheiten 5PC810.SX01-00, 5PC810.SX02-00 und 5PC810.SX03-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 14 mm zu verwenden, bei der Systemeinheit 5PC810.SX05-00 ist der Distanzbolzen mit einer Länge von 16 mm zu verwenden.

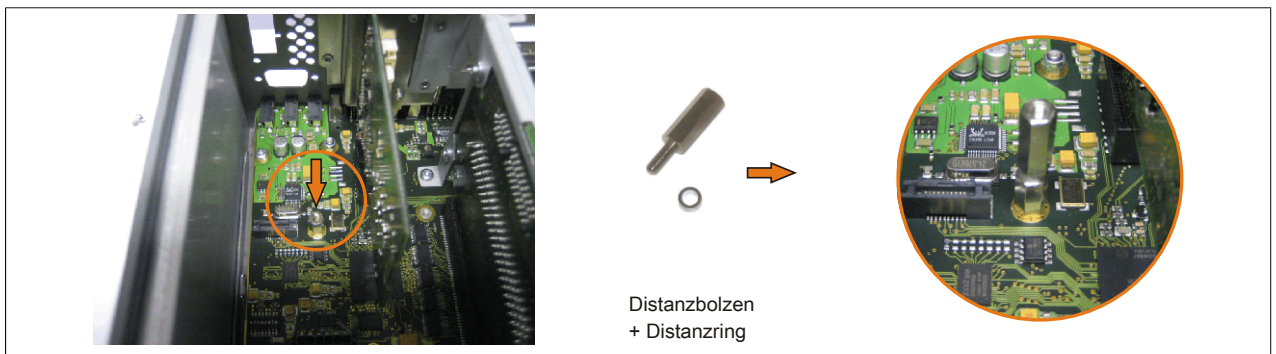


Abbildung 265: Distanzbolzen und Distanzring montieren

4. Ready Relais mit 2 Torxschrauben (T6) und dem Haltewinkel am Gehäuse und 1 Torxschraube (T6) am Basisboard (Distanzbolzen) montieren.

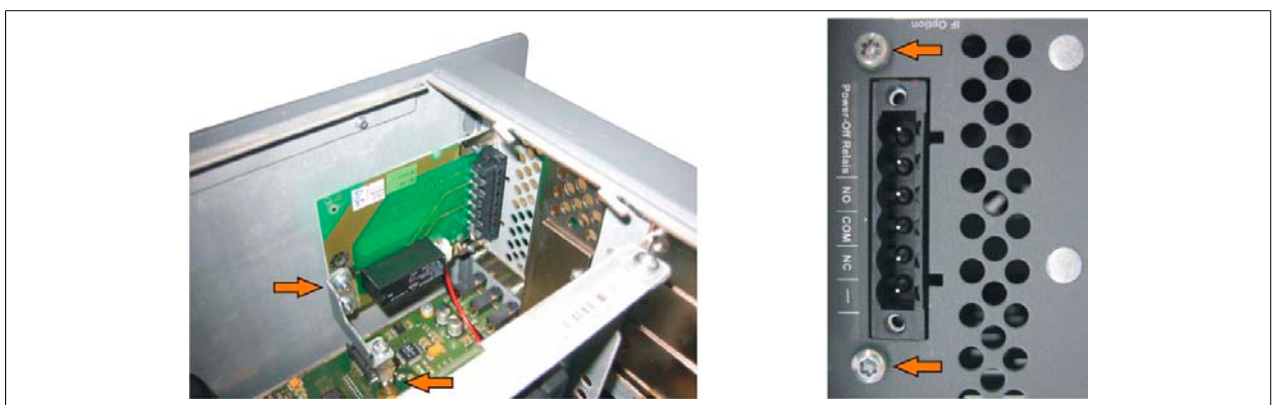


Abbildung 266: Ready Relais montieren

5. Verbindungskabel anstecken

Information:

Beim Anschluss des internen Spannungsversorgungskabels ist darauf zu achten, dass dabei die Verriegelung der Stecker einrastet.

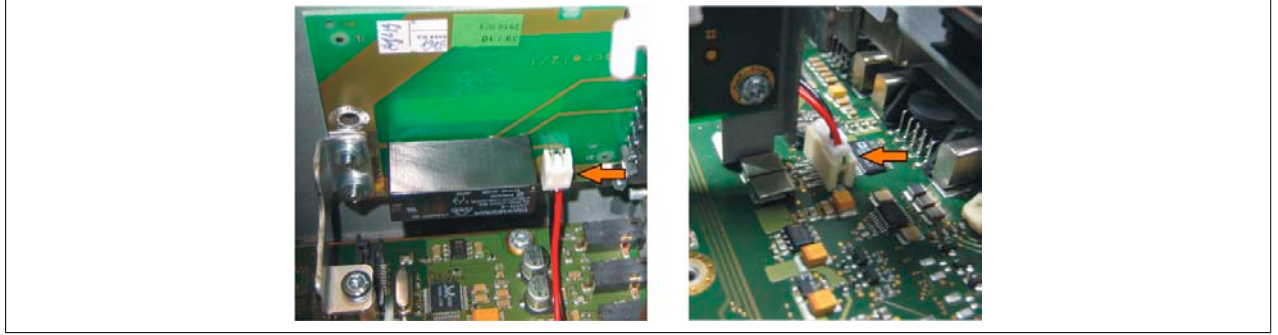


Abbildung 267: Verbindungskabel anstecken

6. Seitendeckel montieren

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf der Basisboardplatine (Bestandteil jeder Systemeinheit) des APC810 Gerätes.

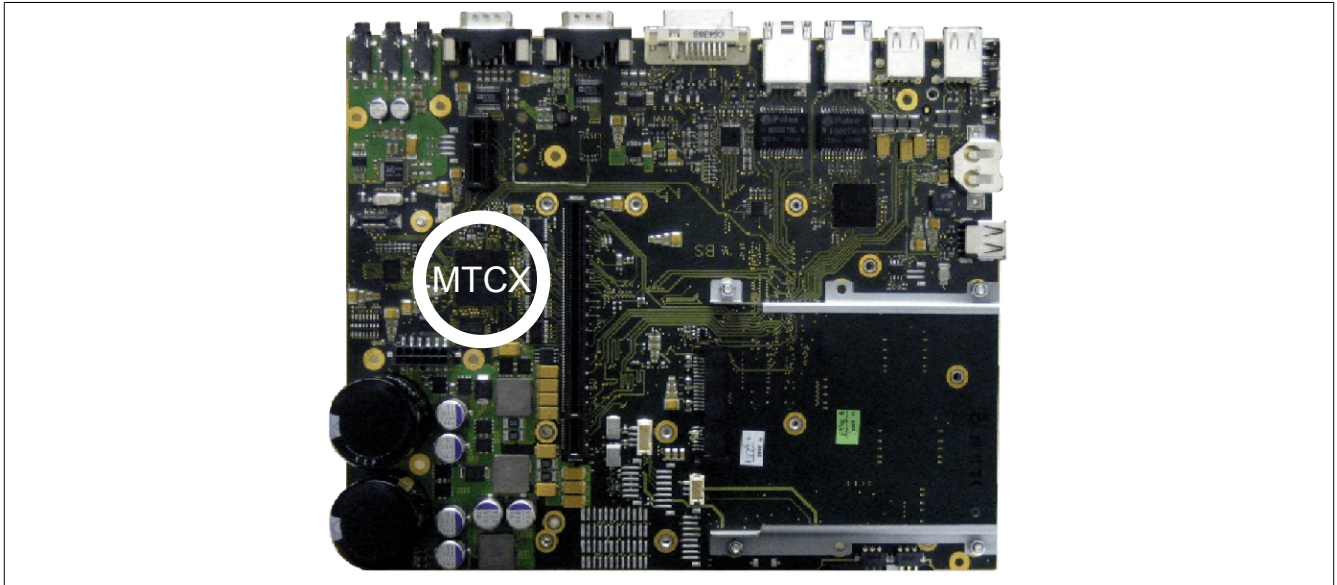


Abbildung 268: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- Power On (Power OK Sequencing) und Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung (I/O Bereich, Power Supply, Slide-in Laufwerk 1/2)
- Lüfterregelung
- Tasten und LED Behandlung/Koordination (Matrixtastatur von B&R Displayeinheiten)
- Erweiterter Desktop Betrieb (Tasten, USB Weiterleitung)
- Daisy Chain Display Betrieb (Touch Screen, USB Weiterleitung)
- Panel Sperrmechanismus (konfigurierbar über B&R Control Center - ADI Treiber)
- Backlight Steuerung eines angeschlossenen B&R Displays
- Statistikdatenermittlung (Power Cycles - jedes einschalten, Power On und Lüfterstunden werden ermittelt - jede volle Stunde wird gezählt z.B. 50 Minuten keine Erhöhung)
- SDL Datenübertragung (Display, Matrixtastatur, Touch Screen, Servicedaten, USB)
- Status LEDs (HDD, Panel Lock, Link 1, Link 2)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade⁶⁾ erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt Advanced - Baseboard/Panel Features) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

1.1 Temperaturüberwachung Lüfterregelung

Der MTCX überwacht mit Hilfe von Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" auf Seite 28) ständig die Temperatur, in deren Abhängigkeit die Lüfter geregelt werden. Die Drehzahl ist von der gemessenen Temperatur abhängig. Die Grenzwerte sind abhängig von der verwendeten MTCX Firmware Version.

6) Kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Sensorbereich	Einschalttemperatur	Max Lüfterdrehzahl bei:
CPU	65°C	81°C
Board CPU	65°C	81°C
Board I/O	60°C	76°C
Board ETH2	60°C	76°C
Board Power	60°C	76°C
Power Supply	60°C	76°C
ETH2 Controller	70°C	86°C
Slide-in 1/2	44°C	60°C

Tabelle 320: Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V0.06)

Ab der Einschalttemperatur wird mit minimaler Lüfterdrehzahl gestartet. Die maximale Lüfterdrehzahl wird bei Einschalttemperatur + 16°C erreicht. In diesem Bereich wird die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperatur geregelt.

z.B. bei Slide-in 1/2: $44^{\circ}\text{C} + 16^{\circ}\text{C} = 60^{\circ}\text{C}$ --> maximale Lüfterdrehzahl

Die Lüfter werden erst wieder ausgeschaltet, wenn die Bewertungstemperatur im Zeitraum von 4 Stunden (=Nachlaufzeit) mehr als 6°C unter der Einschalttemperatur liegt.

2 Anschluss eines externen Verbrauchers an das Basisboard

Ein Stecker auf dem Basisboard ermöglicht zur internen Versorgung von z.B. speziellen PCI Karten die Abzweigung von +5 VDC und +12 VDC.

Mit dem "Versorgungskabel intern 5CAMSC.0001-00" auf Seite 357 kann die Spannung abgegriffen werden. Der Stecker liegt in der Nähe der Buseinheit(en) und kann an dieser mit einem Kabelbinder fixiert werden (siehe Pfeil in Abbildung). Zum Erreichen des Steckers sind der APC810 Seitendeckel (siehe "Seitendeckeldemontage" auf Seite 381) sowie eventuelle Slide-in Laufwerke und PCI Steckkarten zu entfernen.

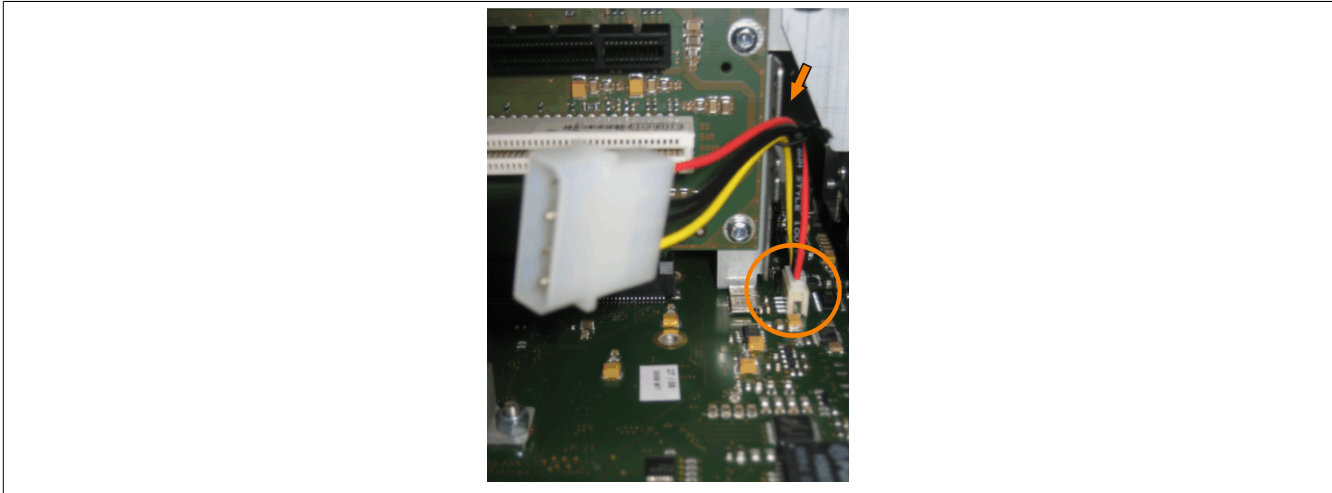


Abbildung 269: Position Stecker für externen Verbraucher


Stecker für den externen Verbraucher			
Pin	Belegung	Leistung	4-polige Stiftleiste, male 
1	+12 VDC	max. 10 Watt	
2	GND		
3	GND	max. 5 Watt	
4	+5 VDC		

Tabelle 321: Pinbelegung Stecker am Basisboard

Anschlüsse sind über eine 1A Multifuse abgesichert.

3 Glossar

Abbildung 1:	Konfiguration - Grundsystem.....	24
Abbildung 2:	Konfiguration - optionale Komponenten.....	25
Abbildung 3:	Temperatursensorpositionen.....	28
Abbildung 4:	Spannungsversorgung für Systemeinheiten.....	30
Abbildung 5:	Serialnummernaufkleber Vorderseite.....	37
Abbildung 6:	Serialnummernaufkleber Rückseite.....	37
Abbildung 7:	Beispiel Serialnummernsuche - A3C70168444.....	38
Abbildung 8:	5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-00 Blockschaltbild.....	39
Abbildung 9:	5PC810.SX01-00 + 5PC810.BX01-01 Blockschaltbild.....	40
Abbildung 10:	5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-00 Blockschaltbild.....	41
Abbildung 11:	5PC810.SX02-00 + 5PC810.BX02-01 Blockschaltbild.....	42
Abbildung 12:	5PC810.SX03-00 + 5PC810.BX03-00 Blockschaltbild.....	43
Abbildung 13:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-00 Blockschaltbild.....	44
Abbildung 14:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-01 Blockschaltbild.....	45
Abbildung 15:	5PC810.SX05-00 + 5PC810.BX05-02 Blockschaltbild.....	46
Abbildung 16:	Abmessungen Standard half-size 32-Bit PCI Karte.....	56
Abbildung 17:	Abmessungen Standard half-size PCIe Karte.....	56
Abbildung 18:	Status LEDs Vorderseite.....	58
Abbildung 19:	5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Oberseite.....	67
Abbildung 20:	5PC810.SX01-00 - Schnittstellen Vorderseite.....	68
Abbildung 21:	5PC810.SX01-00 - Abmessungen.....	71
Abbildung 22:	5PC810.SX01-00 - Bohrschablone.....	72
Abbildung 23:	5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Oberseite.....	75
Abbildung 24:	5PC810.SX02-00 - Schnittstellen Vorderseite.....	76
Abbildung 25:	5PC810.SX02-00 - Abmessungen.....	79
Abbildung 26:	5PC810.SX02-00 - Bohrschablone.....	80
Abbildung 27:	5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Oberseite.....	83
Abbildung 28:	5PC810.SX03-00 - Schnittstellen Vorderseite.....	84
Abbildung 29:	5PC810.SX03-00 - Abmessungen.....	87
Abbildung 30:	5PC810.SX03-00 - Bohrschablone.....	88
Abbildung 31:	5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Oberseite.....	91
Abbildung 32:	5PC810.SX05-00 - Schnittstellen Vorderseite.....	92
Abbildung 33:	5PC810.SX05-00 - Abmessungen.....	94
Abbildung 34:	5PC810.SX05-00 - Bohrschablone.....	95
Abbildung 35:	1 Slot Buseinheiten.....	96
Abbildung 36:	2 Slot Buseinheiten.....	96
Abbildung 37:	3 Slot Buseinheit.....	96
Abbildung 38:	5 Slot Buseinheiten.....	97
Abbildung 39:	5AC801.HDDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	104
Abbildung 40:	5AC801.HDDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	106
Abbildung 41:	5AC801.HDDI-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	108
Abbildung 42:	5AC801.SSDI-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	110
Abbildung 43:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Lesen.....	111
Abbildung 44:	5AC801.SSDI-00 - ATTO Disk Benchmark v2.34 zyklisches Schreiben.....	111
Abbildung 45:	5AC801.SSDI-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	113
Abbildung 46:	5AC801.SSDI-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	115
Abbildung 47:	5AC801.HDDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	118
Abbildung 48:	5AC801.DVDS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	120
Abbildung 49:	5AC801.DVRS-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	123
Abbildung 50:	PCI SATA RAID Controller.....	124
Abbildung 51:	5ACPCI.RAIC-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	126
Abbildung 52:	5ACPCI.RAIC-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	128
Abbildung 53:	PCI SATA RAID Controller.....	129
Abbildung 54:	5ACPCI.RAIC-05 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	131
Abbildung 55:	5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	133
Abbildung 56:	5PC810.FA01-00 - Lüfter Kit.....	134
Abbildung 57:	5PC810.FA02-01 - Lüfter Kit	135

Abbildung 58:	5PC810.FA03-00 - Lüfter Kit.....	136
Abbildung 59:	5PC810.FA05-00 - Lüfter Kit.....	137
Abbildung 60:	5PC810.SX02-00 - Montagebeispiel mit der Systemeinheit.....	138
Abbildung 61:	Montagebeispiel mit der Systemeinheit 5PC810.SX02-00.....	140
Abbildung 62:	5AC801.RDYR-01 - Lieferumfang.....	142
Abbildung 63:	Schnittstellenoptionen (IF Option).....	143
Abbildung 64:	5AC600.CANI-00 - Abschlusswiderstand Add-on CAN Interface.....	145
Abbildung 65:	5AC600.CANI-00 - Lieferumfang / Montagematerial.....	145
Abbildung 66:	Add-on RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus.....	148
Abbildung 67:	5AC600.485I-00 - Lieferumfang / Montagematerial.....	148
Abbildung 68:	Befestigungsglasche.....	149
Abbildung 69:	Einbaulage - senkrecht.....	150
Abbildung 70:	Einbaulage - waagrecht.....	150
Abbildung 71:	Standardmontage - Montageabstände.....	151
Abbildung 72:	Biegeradius Kabelanschluss.....	152
Abbildung 73:	Erdungskonzept.....	153
Abbildung 74:	Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.....	155
Abbildung 75:	Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD.....	156
Abbildung 76:	Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto).....	159
Abbildung 77:	Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto).....	161
Abbildung 78:	Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto).....	163
Abbildung 79:	Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto).....	165
Abbildung 80:	Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto).....	167
Abbildung 81:	Ein Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto).....	169
Abbildung 82:	Vier Automation Panel 900 über SDL AP Link (Symbolfoto).....	171
Abbildung 83:	Zwei Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto).....	173
Abbildung 84:	Acht Automation Panel 900 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto).....	175
Abbildung 85:	Sechs AP900 und zwei AP800 über SDL onboard und SDL AP Link (Symbolfoto).....	178
Abbildung 86:	Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC810.....	181
Abbildung 87:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI.....	182
Abbildung 88:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL.....	182
Abbildung 89:	Einstieg in das RAID Configuration Utility.....	183
Abbildung 90:	RAID Configuration Utility - Menü.....	183
Abbildung 91:	RAID Configuration Utility - Menü.....	184
Abbildung 92:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Striped.....	184
Abbildung 93:	RAID Configuration Utility - Create RAID set - Mirrored.....	185
Abbildung 94:	RAID Configuration Utility - Delete RAID set.....	185
Abbildung 95:	RAID Configuration Utility - Rebuild Mirrored set.....	186
Abbildung 96:	RAID Configuration Utility - Resolve Conflicts.....	186
Abbildung 97:	RAID Configuration Utility - Low Level Format.....	187
Abbildung 98:	GM45 Boot Screen.....	190
Abbildung 99:	GM45 Main Menü.....	192
Abbildung 100:	GM45 Advanced Menü.....	193
Abbildung 101:	GM45 Advanced ACPI Configuration.....	194
Abbildung 102:	GM45 Advanced PCI Configuration.....	195
Abbildung 103:	GM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion.....	196
Abbildung 104:	GM45 Advanced PCI Interrupt Routing.....	197
Abbildung 105:	GM45 Advanced PCI Express Configuration.....	198
Abbildung 106:	GM45 Advanced Graphics Configuration.....	200
Abbildung 107:	GM45 Advanced CPU Board Monitor.....	202
Abbildung 108:	GM45 Advanced Chipset Configuration.....	204
Abbildung 109:	GM45 Advanced I/O Interface Configuration.....	205
Abbildung 110:	GM45 Advanced Clock Configuration.....	206
Abbildung 111:	GM45 Advanced IDE Configuration.....	206
Abbildung 112:	GM45 Primary IDE Master.....	208
Abbildung 113:	GM45 Secondary IDE Master.....	209
Abbildung 114:	GM45 Third IDE Master.....	210

Abbildung 115:	GM45 Fourth IDE Master.....	211
Abbildung 116:	GM45 Advanced USB Configuration.....	212
Abbildung 117:	GM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration.....	213
Abbildung 118:	GM45 Advanced CPU Board Monitor.....	214
Abbildung 119:	GM45 Advanced Baseboard/Panel Features.....	215
Abbildung 120:	GM45 Panel Control.....	216
Abbildung 121:	GM45 Baseboard Monitor.....	217
Abbildung 122:	GM45 Legacy Devices.....	218
Abbildung 123:	GM45 Boot Menü.....	219
Abbildung 124:	GM45 Security Menü.....	221
Abbildung 125:	GM45 Hard Disk Security User Password.....	222
Abbildung 126:	GM45 Hard Disk Security Master Password.....	222
Abbildung 127:	GM45 Power Menü.....	223
Abbildung 128:	GM45 Exit Menü.....	224
Abbildung 129:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards GM45 (Buseinheiten 5PC810.BX0x-0x).....	235
Abbildung 130:	PCI und PCIe Routing mit aktiviertem APIC CPU Boards GM45 (Buseinheit 5PC810.BX05-02).....	236
Abbildung 131:	Softwareversion.....	237
Abbildung 132:	Firmwareversion des AP Link SDL Transmitter.....	238
Abbildung 133:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 1.....	243
Abbildung 134:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 2.....	243
Abbildung 135:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 3.....	243
Abbildung 136:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 4.....	244
Abbildung 137:	Bootdiskette erstellen unter Windows XP Schritt 5.....	244
Abbildung 138:	Erstellung eines USB Memory Sticks für B&R Upgrade Files.....	245
Abbildung 139:	Erstellung einer CompactFlash Karte für B&R Upgrade Files.....	246
Abbildung 140:	ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto).....	259
Abbildung 141:	ADI Control Center - SDL Equalizer Einstellung.....	261
Abbildung 142:	ADI Control Center - USV Einstellungen.....	262
Abbildung 143:	ADI Control Center - USV Monitor.....	263
Abbildung 144:	ADI Control Center - USV Batterieeinstellungen.....	264
Abbildung 145:	ADI Control Center - USV Einstellungen.....	265
Abbildung 146:	ADI Control Center - Erweiterte USV Einstellungen.....	267
Abbildung 147:	ADI Development Kit Screenshots (Version 3.40).....	269
Abbildung 148:	ADI .NET SDK Screenshots (Version 1.80).....	271
Abbildung 149:	B&R Key Editor Screenshots Version 3.30 (Symbolfoto).....	273
Abbildung 150:	5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten.....	298
Abbildung 151:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I.....	298
Abbildung 152:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06.....	299
Abbildung 153:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06.....	299
Abbildung 154:	5CFCRD.xxxx-04 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten.....	302
Abbildung 155:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I.....	302
Abbildung 156:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04.....	303
Abbildung 157:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-03 mit 5CFCRD.xxxx-04.....	303
Abbildung 158:	5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten.....	306
Abbildung 159:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I.....	306
Abbildung 160:	5MD900.USB2-01 - Schnittstellen	308
Abbildung 161:	5MD900.USB2-01 - Abmessungen	310
Abbildung 162:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe.....	311
Abbildung 163:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe.....	311
Abbildung 164:	5MD900.USB2-01 - Einbaulage	312
Abbildung 165:	5MD900.USB2-02 - Schnittstellen.....	313
Abbildung 166:	5MD900.USB2-02 - Abmessungen.....	315
Abbildung 167:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe.....	315
Abbildung 168:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe.....	316

Abbildung 169:	5MD900.USB2-02 - Einbaulage	316
Abbildung 170:	5A5003.03 - Abmessungen.....	317
Abbildung 171:	Frontklappenmontage und Klemmdicke.....	318
Abbildung 172:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe.....	318
Abbildung 173:	5MMUSB.2048-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	320
Abbildung 174:	5MMUSB.2048-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	322
Abbildung 175:	USV Prinzip.....	326
Abbildung 176:	5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial.....	327
Abbildung 177:	Temperatur Lebensdauerdiagramm.....	329
Abbildung 178:	Tiefentladezyklen.....	329
Abbildung 179:	5PC600.UPSB-00 - Abmessungen.....	330
Abbildung 180:	5PC600.UPSB-00 - Bohrschablone.....	330
Abbildung 181:	5ACPCI.ETH1-01 - PCI Ethernet Card 10/100.....	332
Abbildung 182:	5ACPCI.ETH1-01 - Abmessungen.....	334
Abbildung 183:	5ACPCI.ETH3-01 - PCI Ethernet Card 10/100.....	335
Abbildung 184:	5ACPCI.ETH3-01 - Abmessungen.....	337
Abbildung 185:	Biegeradiusspezifikation.....	339
Abbildung 186:	5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen.....	339
Abbildung 187:	5CADVI.0xxx-00 - Belegung.....	340
Abbildung 188:	Biegeradiusspezifikation.....	342
Abbildung 189:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen.....	342
Abbildung 190:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung.....	343
Abbildung 191:	Biegeradiusspezifikation.....	345
Abbildung 192:	5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen.....	345
Abbildung 193:	5CASDL.0xxx-01 - Belegung.....	346
Abbildung 194:	Biegeradiusspezifikation.....	348
Abbildung 195:	5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen.....	348
Abbildung 196:	5CASDL.0xxx-03 - Belegung.....	349
Abbildung 197:	Biegeradiusspezifikation.....	351
Abbildung 198:	5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen.....	351
Abbildung 199:	5CASDL.0xx0-13 - Belegung.....	352
Abbildung 200:	Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender.....	353
Abbildung 201:	Beispiel für die Signalrichtung Display - Display für das SDL Kabel flex mit Extender.....	353
Abbildung 202:	5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel.....	354
Abbildung 203:	9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel	356
Abbildung 204:	HDD Ersatzdiskablage - 5AC801.FRAM-00.....	358
Abbildung 205:	5AC801.FRAM-00 - Abmessungen.....	359
Abbildung 206:	Batterie entfernen.....	361
Abbildung 207:	Batteriehandhabung.....	361
Abbildung 208:	Batteriepolarität.....	361
Abbildung 209:	CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto).....	362
Abbildung 210:	Schnellverschlusschrauben lösen.....	363
Abbildung 211:	Compact SATA Laufwerk einschieben.....	363
Abbildung 212:	Schnellverschlusschrauben lösen.....	364
Abbildung 213:	Slide-in Laufwerkseinbau.....	364
Abbildung 214:	Schnellverschlusschrauben lösen.....	365
Abbildung 215:	Slide-in compact Adapter Einbau.....	365
Abbildung 216:	Slide-in compact Laufwerk montieren.....	366
Abbildung 217:	Lüfter Kit Einschub entfernen.....	367
Abbildung 218:	Lüfter Kit einlegen und befestigen.....	367
Abbildung 219:	Staubfilter mit Filterspange fixieren.....	368
Abbildung 220:	5AC600.UPSI-00 Add-on USV Modul Montagematerial.....	369
Abbildung 221:	USV Modulabdeckung entfernen.....	369
Abbildung 222:	Distanzbolzen und Distanzring montieren.....	369
Abbildung 223:	USV Modul montieren.....	370
Abbildung 224:	Verbindungskabel anstecken.....	370
Abbildung 225:	Steckerverriegelung.....	370

Abbildung 226:	USV Modulabdeckung entfernen.....	371
Abbildung 227:	Distanzbolzen und Distanzring montieren.....	371
Abbildung 228:	Haltewinkel montieren.....	371
Abbildung 229:	USV Modul montieren.....	372
Abbildung 230:	Verbindungskabel anstecken.....	372
Abbildung 231:	Steckerverriegelung.....	372
Abbildung 232:	USV Modulabdeckung entfernen.....	373
Abbildung 233:	Distanzbolzen und Distanzring montieren.....	373
Abbildung 234:	Haltewinkel montieren.....	373
Abbildung 235:	USV Modul montieren.....	374
Abbildung 236:	Verbindungskabel anstecken.....	
Abbildung 237:	Steckerverriegelung.....	374
Abbildung 238:	USV Modulabdeckung entfernen.....	375
Abbildung 239:	Distanzbolzen montieren.....	375
Abbildung 240:	USV Modul montieren.....	375
Abbildung 241:	Verbindungskabel anstecken.....	376
Abbildung 242:	Steckerverriegelung.....	376
Abbildung 243:	USV Modulabdeckung entfernen.....	377
Abbildung 244:	Distanzbolzen montieren.....	377
Abbildung 245:	Haltewinkel montieren.....	377
Abbildung 246:	USV Modul montieren.....	378
Abbildung 247:	Verbindungskabel anstecken.....	378
Abbildung 248:	Steckerverriegelung.....	378
Abbildung 249:	USV Modulabdeckung entfernen.....	379
Abbildung 250:	Distanzbolzen montieren.....	379
Abbildung 251:	Haltewinkel montieren.....	379
Abbildung 252:	USV Modul montieren.....	379
Abbildung 253:	Verbindungskabel anstecken.....	380
Abbildung 254:	Steckerverriegelung.....	380
Abbildung 255:	APC810 1 Card Slot Seitendeckeldemontage.....	381
Abbildung 256:	APC810 2 Card Slot Seitendeckeldemontage.....	381
Abbildung 257:	APC810 5 Card Slot Seitendeckeldemontage.....	382
Abbildung 258:	AP Link Modulabdeckung entfernen.....	383
Abbildung 259:	AP Link Modul montieren.....	383
Abbildung 260:	Rückseite des SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-03 Schraubenzuordnung.....	384
Abbildung 261:	Hard Disk Tausch.....	384
Abbildung 262:	Montage der Ersatz Hard Disk an der Ersatzdiskablage.....	386
Abbildung 263:	Montage der Ersatzdiskablage am APC810.....	386
Abbildung 264:	USV Modulabdeckung entfernen.....	387
Abbildung 265:	Distanzbolzen und Distanzring montieren.....	387
Abbildung 266:	Ready Relais montieren.....	387
Abbildung 267:	Verbindungskabel anstecken.....	388
Abbildung 268:	Position des MTCX Controllers.....	389
Abbildung 269:	Position Stecker für externen Verbraucher.....	391

Tabelle 1:	Handbuchhistorie.....	13
Tabelle 2:	Umweltgerechte Werkstofftrennung.....	17
Tabelle 3:	Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise.....	18
Tabelle 4:	Nennmaßbereiche.....	18
Tabelle 5:	Umgebungstemperatur mit Lüfter.....	27
Tabelle 6:	Temperatursensorpositionen.....	28
Tabelle 7:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten.....	29
Tabelle 8:	Leistungskalkulation APC 1 Slot.....	31
Tabelle 9:	Leistungskalkulation APC 1 Slot.....	32
Tabelle 10:	Leistungskalkulation APC 2 Slot.....	33
Tabelle 11:	Leistungskalkulation APC 2 Slot.....	34
Tabelle 12:	Leistungskalkulation APC 3 Slot.....	35
Tabelle 13:	Leistungskalkulation APC 5 Slot.....	36
Tabelle 14:	Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC.....	47
Tabelle 15:	Pinbelegung COM1.....	48
Tabelle 16:	Pinbelegung COM2.....	48
Tabelle 17:	Monitor / Panel Anschluss - RGB, DVI, SDL.....	49
Tabelle 18:	Pinbelegung DVI Anschluss.....	49
Tabelle 19:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	49
Tabelle 20:	Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung.....	50
Tabelle 21:	Ethernet Anschluss (ETH1).....	51
Tabelle 22:	Ethernet Anschluss (ETH2).....	52
Tabelle 23:	USB1, USB2, USB3, USB4 Anschluss.....	53
Tabelle 24:	USB5 Anschluss.....	53
Tabelle 25:	MIC, Line IN, Line OUT.....	54
Tabelle 26:	Add-on Schnittstellensteckplatz.....	54
Tabelle 27:	Add-on USV Steckplatz (ohne und mit montierter USV).....	55
Tabelle 28:	Daten Status LEDs.....	58
Tabelle 29:	CMOS Profile Schalter.....	58
Tabelle 30:	Power Taster.....	59
Tabelle 31:	Reset Taster.....	59
Tabelle 32:	Batterie.....	60
Tabelle 33:	Bedeutung Batteriestatus.....	60
Tabelle 34:	Hardware Security Key.....	61
Tabelle 35:	CompactFlash Slot (CF1).....	62
Tabelle 36:	CompactFlash Slot (CF2).....	62
Tabelle 37:	Slide-in Slot 1.....	63
Tabelle 38:	Slide-in Slot 2.....	63
Tabelle 39:	Slide-in compact Slot.....	64
Tabelle 40:	5PC810.SX01-00 - Bestelldaten.....	65
Tabelle 41:	5PC810.SX01-00 - Technische Daten.....	68
Tabelle 42:	5PC810.SX02-00 - Bestelldaten.....	73
Tabelle 43:	5PC810.SX02-00 - Technische Daten.....	76
Tabelle 44:	5PC810.SX03-00 - Bestelldaten.....	81
Tabelle 45:	5PC810.SX03-00 - Technische Daten.....	84
Tabelle 46:	5PC810.SX05-00 - Bestelldaten.....	89
Tabelle 47:	5PC810.SX05-00 - Technische Daten.....	92
Tabelle 48:	5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Bestelldaten.....	97
Tabelle 49:	5PC810.BX01-00, 5PC810.BX01-01, 5PC810.BX02-00, 5PC810.BX02-01, 5PC810.BX03-00, 5PC810.BX05-00, 5PC810.BX05-01, 5PC810.BX05-02 - Technische Daten.....	97
Tabelle 50:	5PC800.BM45-00, 5PC800.BM45-01 - Bestelldaten.....	99
Tabelle 51:	5PC800.BM45-00, 5PC800.BM45-01 - Technische Daten.....	99
Tabelle 52:	5AC801.HS00-01 - Bestelldaten.....	101
Tabelle 53:	5AC801.HS00-01 - Technische Daten.....	101
Tabelle 54:	5MMDDR.2048-02, 5MMDDR.4096-02 - Bestelldaten.....	102
Tabelle 55:	5MMDDR.2048-02, 5MMDDR.4096-02 - Technische Daten.....	102

Tabelle 56:	5AC801.HDDI-00 - Bestelldaten.....	103
Tabelle 57:	5AC801.HDDI-00 - Technische Daten.....	103
Tabelle 58:	5AC801.HDDI-02 - Bestelldaten.....	105
Tabelle 59:	5AC801.HDDI-02 - Technische Daten.....	105
Tabelle 60:	5AC801.HDDI-03 - Bestelldaten.....	107
Tabelle 61:	5AC801.HDDI-03 - Technische Daten.....	107
Tabelle 62:	5AC801.SSDI-00 - Bestelldaten.....	109
Tabelle 63:	5AC801.SSDI-00 - Technische Daten.....	109
Tabelle 64:	5AC801.SSDI-01 - Bestelldaten.....	112
Tabelle 65:	5AC801.SSDI-01 - Technische Daten.....	112
Tabelle 66:	5AC801.SSDI-02 - Bestelldaten.....	114
Tabelle 67:	5AC801.SSDI-02 - Technische Daten.....	114
Tabelle 68:	5AC801.ADAS-00 - Bestelldaten.....	116
Tabelle 69:	5AC801.ADAS-00 - Technische Daten.....	116
Tabelle 70:	5AC801.HDDS-00 - Bestelldaten.....	117
Tabelle 71:	5AC801.HDDS-00 - Technische Daten.....	117
Tabelle 72:	5AC801.DVDS-00 - Bestelldaten.....	119
Tabelle 73:	5AC801.DVDS-00 - Technische Daten.....	119
Tabelle 74:	5AC801.DVRS-00 - Bestelldaten.....	121
Tabelle 75:	5AC801.DVRS-00 - Technische Daten.....	121
Tabelle 76:	5ACPCI.RAIC-03 - Bestelldaten.....	124
Tabelle 77:	5ACPCI.RAIC-03 - Technische Daten.....	125
Tabelle 78:	5ACPCI.RAIC-04 - Bestelldaten.....	127
Tabelle 79:	5ACPCI.RAIC-04 - Technische Daten.....	127
Tabelle 80:	5ACPCI.RAIC-05 - Bestelldaten.....	129
Tabelle 81:	5ACPCI.RAIC-05 - Technische Daten.....	130
Tabelle 82:	5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten.....	132
Tabelle 83:	5MMHDD.0250-00 - Technische Daten.....	132
Tabelle 84:	5PC810.FA01-00 - Bestelldaten.....	134
Tabelle 85:	5PC810.FA01-00 - Technische Daten.....	134
Tabelle 86:	5PC810.FA02-01 - Bestelldaten.....	135
Tabelle 87:	5PC810.FA02-01 - Technische Daten.....	135
Tabelle 88:	5PC810.FA03-00 - Bestelldaten.....	136
Tabelle 89:	5PC810.FA03-00 - Technische Daten.....	136
Tabelle 90:	5PC810.FA05-00 - Bestelldaten.....	137
Tabelle 91:	5PC810.FA05-00 - Technische Daten.....	137
Tabelle 92:	5AC801.SDL0-00 - Bestelldaten.....	138
Tabelle 93:	Pinbelegung DVI Anschluss.....	139
Tabelle 94:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	139
Tabelle 95:	5AC801.RDYR-00 - Bestelldaten.....	140
Tabelle 96:	5AC801.RDYR-00 - Pinbelegung Ready Relais.....	140
Tabelle 97:	5AC801.RDYR-01 - Bestelldaten.....	141
Tabelle 98:	5AC801.RDYR-01 - Pinbelegung.....	141
Tabelle 99:	5AC600.CANI-00 - Bestelldaten.....	143
Tabelle 100:	5AC600.CANI-00 - Technische Daten.....	143
Tabelle 101:	Pinbelegung CAN.....	144
Tabelle 102:	Add-on CAN - I/O Adresse und IRQ.....	144
Tabelle 103:	CAN Buslänge und Übertragungsrate.....	144
Tabelle 104:	CAN Kabel Anforderungen.....	144
Tabelle 105:	5AC600.485I-00 - Bestelldaten.....	146
Tabelle 106:	5AC600.485I-00 - Technische Daten.....	146
Tabelle 107:	Pinbelegung RS232/RS422.....	146
Tabelle 108:	Add-on RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ.....	146
Tabelle 109:	RS232 Buslänge und Übertragungsrate.....	147
Tabelle 110:	RS232 Kabel Anforderungen.....	147
Tabelle 111:	RS422 Buslänge und Übertragungsraten.....	147
Tabelle 112:	RS422 Kabel Anforderungen.....	147

Tabelle 113:	RS485 Buslänge und Übertragungsraten.....	148
Tabelle 114:	RS422 Kabel Anforderungen.....	148
Tabelle 115:	Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot.....	157
Tabelle 116:	Auswahl der Displayeinheiten.....	158
Tabelle 117:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	159
Tabelle 118:	Linkbaugruppen.....	159
Tabelle 119:	Kabel für DVI Konfigurationen.....	159
Tabelle 120:	Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen.....	160
Tabelle 121:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	161
Tabelle 122:	Linkbaugruppen.....	161
Tabelle 123:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	161
Tabelle 124:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	162
Tabelle 125:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	163
Tabelle 126:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	163
Tabelle 127:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	163
Tabelle 128:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	165
Tabelle 129:	Linkbaugruppen.....	165
Tabelle 130:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	167
Tabelle 131:	Linkbaugruppen.....	167
Tabelle 132:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	168
Tabelle 133:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	168
Tabelle 134:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	169
Tabelle 135:	Linkbaugruppen.....	169
Tabelle 136:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	169
Tabelle 137:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	170
Tabelle 138:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	171
Tabelle 139:	Linkbaugruppen.....	171
Tabelle 140:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	172
Tabelle 141:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	172
Tabelle 142:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	173
Tabelle 143:	Linkbaugruppen.....	173
Tabelle 144:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	173
Tabelle 145:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	174
Tabelle 146:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	175
Tabelle 147:	Linkbaugruppen.....	176
Tabelle 148:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	176
Tabelle 149:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	176
Tabelle 150:	Mögliche Kombinationen von Systemeinheit und CPU Board.....	178
Tabelle 151:	Linkbaugruppen.....	179
Tabelle 152:	Segmentlängen, Auflösungen und SDL Kabel.....	179
Tabelle 153:	BIOS relevante Tasten im RAID Configuration Utility.....	183
Tabelle 154:	Biosrelevante Tasten beim POST.....	191
Tabelle 155:	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü.....	191
Tabelle 156:	GM45 Main Menü Einstellmöglichkeiten.....	192
Tabelle 157:	GM45 Advanced Menü.....	193
Tabelle 158:	GM45 Advanced ACPI Configuration Einstellmöglichkeiten.....	194
Tabelle 159:	GM45 Advanced PCI Configuration Einstellmöglichkeiten.....	195
Tabelle 160:	GM45 Advanced PCI IRQ Resource Exclusion Einstellmöglichkeiten.....	196
Tabelle 161:	GM45 Advanced PCI Interrupt Routing Einstellmöglichkeiten.....	197
Tabelle 162:	GM45 Advanced PCI Express Configuration Einstellmöglichkeiten.....	198
Tabelle 163:	GM45 Advanced Graphics Configuration Einstellmöglichkeiten.....	200
Tabelle 164:	GM45 Advanced CPU Configuration Einstellmöglichkeiten.....	202
Tabelle 165:	GM45 Advanced Chipset Einstellmöglichkeiten.....	204
Tabelle 166:	GM45 Advanced I/O Interface Configuration Einstellmöglichkeiten.....	205
Tabelle 167:	GM45 Advanced Clock Configuration Einstellmöglichkeiten.....	206
Tabelle 168:	GM45 Advanced IDE Configuration Einstellmöglichkeiten.....	207
Tabelle 169:	GM45 Primary IDE Master Einstellmöglichkeiten.....	208

Tabelle 170:	GM45 Secondary IDE Master Einstellmöglichkeiten.....	209
Tabelle 171:	GM45 Third IDE Master Einstellmöglichkeiten.....	210
Tabelle 172:	GM45 Fourth IDE Master Einstellmöglichkeiten.....	211
Tabelle 173:	GM45 Advanced USB Configuration Einstellmöglichkeiten.....	212
Tabelle 174:	GM45 Advanced Keyboard/Mouse Configuration Einstellmöglichkeiten.....	213
Tabelle 175:	GM45 Advanced CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten.....	214
Tabelle 176:	GM45 Advanced Baseboard/Panel Features Einstellmöglichkeiten.....	215
Tabelle 177:	GM45 Panel Control Einstellmöglichkeiten.....	216
Tabelle 178:	GM45 Baseboard Monitor Einstellmöglichkeiten.....	217
Tabelle 179:	GM45 Legacy Devices Einstellmöglichkeiten.....	218
Tabelle 180:	GM45 Boot Menü Einstellmöglichkeiten.....	219
Tabelle 181:	GM45 Security Menü Einstellmöglichkeiten.....	221
Tabelle 182:	GM45 Hard Disk Security User Password.....	222
Tabelle 183:	GM45 Hard Disk Security Master Password.....	223
Tabelle 184:	GM45 Power Menü Einstellmöglichkeiten.....	223
Tabelle 185:	GM45 Exit Menü Einstellmöglichkeiten.....	224
Tabelle 186:	Profilübersicht.....	225
Tabelle 187:	GM45 Main Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 188:	GM45 Advanced - ACPI Configuration Profileinstellungsübersicht.....	225
Tabelle 189:	GM45 Advanced - PCI Configuration Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 190:	GM45 Advanced - PCI Express Configuration Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 191:	GM45 Advanced - Graphics Configuration Profileinstellungsübersicht.....	226
Tabelle 192:	GM45 Advanced - CPU Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 193:	GM45 Advanced - Chipset Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 194:	GM45 Advanced - I/O Interface Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 195:	GM45 Advanced - Clock Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 196:	GM45 Advanced - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht.....	227
Tabelle 197:	GM45 Advanced - USB Configuration Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 198:	GM45 Advanced - Keyboard/Mouse Configuration Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 199:	GM45 Advanced - CPU Board Monitor Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 200:	GM45 Advanced - Baseboard/Panel Features Profileinstellungsübersicht.....	228
Tabelle 201:	GM45 Main Profileinstellungsübersicht.....	229
Tabelle 202:	GM45 Security Profileinstellungsübersicht.....	229
Tabelle 203:	GM45 Power Profileinstellungsübersicht.....	229
Tabelle 204:	BIOS Postcode Meldungen BIOS GM45.....	231
Tabelle 205:	RAM-Adressbelegung.....	232
Tabelle 206:	I/O-Adressbelegung.....	232
Tabelle 207:	IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode.....	233
Tabelle 208:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode.....	234
Tabelle 209:	9S0000.01-010, 9S0000.01-020 - Bestelldaten.....	247
Tabelle 210:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei DVI Signalen.....	247
Tabelle 211:	Getestete Auflösungen und Farbtiefen bei RGB Signalen.....	247
Tabelle 212:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL, 5SWWXP.0500-ENG, 5SWWXP.0500-GER, 5SWWXP.0500-MUL - Bestelldaten.....	248
Tabelle 213:	5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL, 5SWWI7.0200-ENG, 5SWWI7.1200-ENG, 5SWWI7.0200-GER, 5SWWI7.1200-GER, 5SWWI7.0400-MUL, 5SWWI7.1400-MUL - Bestelldaten.....	250
Tabelle 214:	5SWWXP.0733-ENG - Bestelldaten.....	253
Tabelle 215:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009.....	253
Tabelle 216:	5SWWI7.0533-ENG, 5SWWI7.1533-ENG, 5SWWI7.0633-ENG, 5SWWI7.1633-ENG, 5SWWI7.0733-MUL, 5SWWI7.1733-MUL, 5SWWI7.0833-MUL, 5SWWI7.1833-MUL - Bestelldaten.....	255
Tabelle 217:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7.....	256
Tabelle 218:	1A4600.10, 1A4600.10-2, 1A4600.10-3, 1A4600.10-4, 1A4601.06, 1A4601.06-2 - Bestelldaten.....	258
Tabelle 219:	Normenübersicht.....	275
Tabelle 220:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Emission.....	276

Tabelle 221:	Prüfanforderung netzgebundene Emission Industriebereich.....	276
Tabelle 222:	Prüfanforderung Elektromagnetische Strahlung Industriebereich.....	277
Tabelle 223:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Immunität.....	278
Tabelle 224:	Prüfanforderung elektrostatische Entladung (ESD).....	278
Tabelle 225:	Prüfanforderung hochfrequente elektromagnetische Felder (HF Feld).....	278
Tabelle 226:	Prüfanforderung schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst).....	279
Tabelle 227:	Prüfanforderung Stoßspannungen (Surge).....	279
Tabelle 228:	Prüfanforderung leitungsgeführte Störgrößen.....	279
Tabelle 229:	Prüfanforderung Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen.....	279
Tabelle 230:	Prüfanforderung Spannungsschwankungen.....	279
Tabelle 231:	Prüfanforderung Spannungsunterbrechungen.....	280
Tabelle 232:	Prüfanforderung Änderung Versorgungsspannung.....	280
Tabelle 233:	Prüfanforderung allmähliches Abschalten / Zuschalten.....	280
Tabelle 234:	Prüfanforderung gedämpft schwingende Wellen.....	280
Tabelle 235:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Vibration.....	281
Tabelle 236:	Prüfanforderung Vibration Betrieb.....	281
Tabelle 237:	Prüfanforderung Vibration Transport (verpackt).....	281
Tabelle 238:	Prüfanforderung Schock Betrieb.....	281
Tabelle 239:	Prüfanforderung Schock Transport.....	281
Tabelle 240:	Prüfanforderung Kippfallen.....	282
Tabelle 241:	Prüfanforderung Freier Fall.....	282
Tabelle 242:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Temperatur und Feuchte.....	283
Tabelle 243:	Prüfanforderung Worst Case Betrieb.....	283
Tabelle 244:	Prüfanforderung trockene Wärme.....	283
Tabelle 245:	Prüfanforderung trockene Kälte.....	283
Tabelle 246:	Prüfanforderung große Temperaturschwankungen.....	283
Tabelle 247:	Prüfanforderung Temperaturschwankungen im Betrieb.....	283
Tabelle 248:	Prüfanforderung Feuchte Wärme zyklisch.....	284
Tabelle 249:	Prüfanforderung Feuchte Wärme konstant (Lager).....	284
Tabelle 250:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen Sicherheit.....	285
Tabelle 251:	Prüfanforderung Erdungswiderstand.....	285
Tabelle 252:	Prüfanforderung Isolationswiderstand.....	285
Tabelle 253:	Prüfanforderung Hochspannung.....	285
Tabelle 254:	Prüfanforderung Restspannung.....	285
Tabelle 255:	Prüfanforderung Ableitstrom.....	286
Tabelle 256:	Prüfanforderung Überlast.....	286
Tabelle 257:	Prüfanforderung Bauteildefekt.....	286
Tabelle 258:	Übersicht Grenzwert- und Prüfdurchführungsnormen sonstige Prüfungen.....	287
Tabelle 259:	Prüfanforderung Schutzart.....	287
Tabelle 260:	Internationale Zulassungen.....	288
Tabelle 261:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten.....	289
Tabelle 262:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten.....	289
Tabelle 263:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten.....	291
Tabelle 264:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten.....	291
Tabelle 265:	5AC801.FA01-00, 5AC801.FA02-00, 5AC801.FA03-00, 5AC801.FA05-00 - Bestelldaten.....	292
Tabelle 266:	5AC900.1000-00 - Bestelldaten.....	293
Tabelle 267:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten.....	296
Tabelle 268:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten.....	296
Tabelle 269:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Bestelldaten.....	300
Tabelle 270:	5CFCRD.0512-04, 5CFCRD.1024-04, 5CFCRD.2048-04, 5CFCRD.4096-04, 5CFCRD.8192-04, 5CFCRD.016G-04 - Technische Daten.....	300
Tabelle 271:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten.....	304
Tabelle 272:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten.....	304

Tabelle 273:	5MD900.USB2-01 - Bestelldaten.....	308
Tabelle 274:	5MD900.USB2-01 - Technische Daten.....	309
Tabelle 275:	5MD900.USB2-01 - Lieferumfang.....	311
Tabelle 276:	5MD900.USB2-02 - Bestelldaten.....	313
Tabelle 277:	5MD900.USB2-02 - Technische Daten.....	313
Tabelle 278:	5MD900.USB2-02 - Lieferumfang.....	316
Tabelle 279:	5A5003.03 - Bestelldaten.....	317
Tabelle 280:	5A5003.03 - Technische Daten.....	317
Tabelle 281:	5A5003.03 - Lieferumfang.....	317
Tabelle 282:	5MMUSB.2048-00 - Bestelldaten.....	319
Tabelle 283:	5MMUSB.2048-00 - Technische Daten.....	319
Tabelle 284:	5MMUSB.2048-01 - Bestelldaten.....	321
Tabelle 285:	5MMUSB.2048-01 - Technische Daten.....	321
Tabelle 286:	5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten.....	323
Tabelle 287:	5AC600.UPSI-00 - Bestelldaten.....	327
Tabelle 288:	5AC600.UPSI-00 - Technische Daten.....	327
Tabelle 289:	5AC600.UPSB-00 - Bestelldaten.....	328
Tabelle 290:	5AC600.UPSB-00 - Technische Daten.....	328
Tabelle 291:	5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Bestelldaten.....	331
Tabelle 292:	5CAUPS.0005-00, 5CAUPS.0030-00 - Technische Daten.....	331
Tabelle 293:	5ACPCI.ETH1-01 - Bestelldaten.....	332
Tabelle 294:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten.....	332
Tabelle 295:	5ACPCI.ETH1-01 - Technische Daten.....	333
Tabelle 296:	5ACPCI.ETH3-01 - Bestelldaten.....	335
Tabelle 297:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten.....	335
Tabelle 298:	5ACPCI.ETH3-01 - Technische Daten.....	336
Tabelle 299:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten.....	338
Tabelle 300:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten.....	338
Tabelle 301:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten.....	341
Tabelle 302:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten.....	341
Tabelle 303:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten.....	344
Tabelle 304:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten.....	344
Tabelle 305:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten.....	347
Tabelle 306:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten.....	347
Tabelle 307:	Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03.....	349
Tabelle 308:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten.....	350
Tabelle 309:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten.....	350
Tabelle 310:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten.....	354
Tabelle 311:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten.....	354
Tabelle 312:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten.....	355
Tabelle 313:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten.....	355
Tabelle 314:	5CAMSC.0001-00 - Bestelldaten.....	357
Tabelle 315:	5CAMSC.0001-00 - Technische Daten.....	357
Tabelle 316:	5AC801.FRAM-00 - Bestelldaten.....	358
Tabelle 317:	5AC801.FRAM-00 - Technische Daten.....	358
Tabelle 318:	Bedeutung Batteriestatus.....	360
Tabelle 319:	Übersicht benötigte Ersatz SATA-HDD für PCI SATA HDD RAID Controller.....	384
Tabelle 320:	Temperaturgrenzen der Lüfterregelung (MTCX PX32 V0.06).....	390
Tabelle 321:	Pinbelegung Stecker am Basisboard.....	391

0AC201.91.....	289
0TB103.9.....	291
0TB103.91.....	291
1A4600.10.....	258
1A4600.10-2.....	258
1A4600.10-3.....	258
1A4600.10-4.....	258
1A4601.06.....	258
1A4601.06-2.....	258
4A0006.00-000.....	289
5A5003.03.....	317
5AC600.485I-00.....	146
5AC600.CANI-00.....	143
5AC600.UPSB-00.....	328
5AC600.UPSI-00.....	327
5AC801.ADAS-00.....	116
5AC801.DVDS-00.....	119
5AC801.DVRS-00.....	121
5AC801.FA01-00.....	292
5AC801.FA02-00.....	292
5AC801.FA03-00.....	292
5AC801.FA05-00.....	292
5AC801.FRAM-00.....	358
5AC801.HDDI-00.....	103
5AC801.HDDI-02.....	105
5AC801.HDDI-03.....	107
5AC801.HDDS-00.....	117
5AC801.HS00-01.....	101
5AC801.RDYR-00.....	140
5AC801.RDYR-01.....	141
5AC801.SDL0-00.....	138
5AC801.SSDI-00.....	109
5AC801.SSDI-01.....	112
5AC801.SSDI-02.....	114
5AC900.1000-00.....	293
5ACPCI.ETH1-01.....	332
5ACPCI.ETH3-01.....	335
5ACPCI.RAIC-03.....	124
5ACPCI.RAIC-04.....	127
5ACPCI.RAIC-05.....	129
5CADVI.0018-00.....	338
5CADVI.0050-00.....	338
5CADVI.0100-00.....	338
5CAMSC.0001-00.....	357
5CASDL.0018-00.....	341
5CASDL.0018-01.....	344
5CASDL.0018-03.....	347
5CASDL.0050-00.....	341
5CASDL.0050-01.....	344
5CASDL.0050-03.....	347
5CASDL.0100-00.....	341
5CASDL.0100-01.....	344
5CASDL.0100-03.....	347
5CASDL.0150-00.....	341
5CASDL.0150-01.....	344
5CASDL.0150-03.....	347
5CASDL.0200-00.....	341
5CASDL.0200-03.....	347
5CASDL.0250-00.....	341
5CASDL.0250-03.....	347
5CASDL.0300-00.....	341
5CASDL.0300-03.....	347

5CASDL.0300-13.....	350
5CASDL.0400-13.....	350
5CASDL.0430-13.....	350
5CAUPS.0005-00.....	331
5CAUPS.0030-00.....	331
5CAUSB.0018-00.....	354
5CAUSB.0050-00.....	354
5CFCRD.0064-03.....	304
5CFCRD.0128-03.....	304
5CFCRD.016G-04.....	300
5CFCRD.016G-06.....	296
5CFCRD.0256-03.....	304
5CFCRD.032G-06.....	296
5CFCRD.0512-03.....	304
5CFCRD.0512-04.....	300
5CFCRD.0512-06.....	296
5CFCRD.1024-03.....	304
5CFCRD.1024-04.....	300
5CFCRD.1024-06.....	296
5CFCRD.2048-03.....	304
5CFCRD.2048-04.....	300
5CFCRD.2048-06.....	296
5CFCRD.4096-03.....	304
5CFCRD.4096-04.....	300
5CFCRD.4096-06.....	296
5CFCRD.8192-03.....	304
5CFCRD.8192-04.....	300
5MD900.USB2-01.....	308
5MD900.USB2-02.....	313
5MMDDR.2048-02.....	102
5MMDDR.4096-02.....	102
5MMHDD.0250-00.....	132
5MMUSB.2048-00.....	319
5MMUSB.2048-01.....	321
5PC800.BM45-00.....	99
5PC800.BM45-01.....	99
5PC810.BX01-00.....	97
5PC810.BX01-01.....	97
5PC810.BX02-00.....	97
5PC810.BX02-01.....	97
5PC810.BX03-00.....	97
5PC810.BX05-00.....	97
5PC810.BX05-01.....	97
5PC810.BX05-02.....	97
5PC810.FA01-00.....	134
5PC810.FA02-01.....	135
5PC810.FA03-00.....	136
5PC810.FA05-00.....	137
5PC810.SX01-00.....	65
5PC810.SX02-00.....	73
5PC810.SX03-00.....	81
5PC810.SX05-00.....	89
5SWHMI.0000-00.....	323
5SWWI7.0100-ENG.....	250
5SWWI7.0100-GER.....	250
5SWWI7.0200-ENG.....	250
5SWWI7.0200-GER.....	250
5SWWI7.0300-MUL.....	250
5SWWI7.0400-MUL.....	250
5SWWI7.0533-ENG.....	255
5SWWI7.0633-ENG.....	255
5SWWI7.0733-MUL.....	255

5SWWI7.0833-MUL.....	255
5SWWI7.1100-ENG.....	250
5SWWI7.1100-GER.....	250
5SWWI7.1200-ENG.....	250
5SWWI7.1200-GER.....	250
5SWWI7.1300-MUL.....	250
5SWWI7.1400-MUL.....	250
5SWWI7.1533-ENG.....	255
5SWWI7.1633-ENG.....	255
5SWWI7.1733-MUL.....	255
5SWWI7.1833-MUL.....	255
5SWWXP.0500-ENG.....	248
5SWWXP.0500-GER.....	248
5SWWXP.0500-MUL.....	248
5SWWXP.0600-ENG.....	248
5SWWXP.0600-GER.....	248
5SWWXP.0600-MUL.....	248
5SWWXP.0733-ENG.....	253
9A0014.02.....	355
9A0014.05.....	355
9A0014.10.....	355
9S0000.01-010.....	247
9S0000.01-020.....	247

A

Ableitstrom.....	286
Abmessungen.....	
APC810 1 Card Slot.....	71
APC810 2 Card Slot.....	79
APC810 3 Card Slot.....	87
APC810 5 Card Slot.....	94
Standard half-size PCIe Karte.....	56
Standard half-size PCI Karte.....	56
ACPI.....	233, 234
Add-on Schnittstellensteckplatz.....	54
Add-on USV Modul.....	327
Add-on USV Steckplatz.....	55
ADI.....	259
.NET SDK.....	271
Development Kit.....	269
SDL Equalizer Einstellung.....	261
Allgemeintoleranz.....	18
Anleitung Temperaturtest.....	154
Anschluss externer Verbraucher.....	391
Anschluss von Kabeln.....	152
APC810 1 Card Slot.....	
Abmessungen.....	71
Bohrschablone.....	72
Leistungskalkulation.....	31
Schnittstellen.....	67
Technische Daten.....	68
APC810 2 Card Slot.....	
Abmessungen.....	79
Bohrschablone.....	80
Leistungskalkulation.....	33
Schnittstellen.....	75
Technische Daten.....	76
APC810 3 Card Slot.....	
Abmessungen.....	87
Bohrschablone.....	88
Leistungskalkulation.....	35
Schnittstellen.....	83
Technische Daten.....	84
APC810 5 Card Slot.....	
Abmessungen.....	94
Bohrschablone.....	95
Leistungskalkulation.....	36
Schnittstellen.....	91
Technische Daten.....	92
AP Link Montage.....	383
AP Link Steckplatz.....	55
ARemb.....	258
ARwin.....	258
Audio.....	54
Auflösung.....	99
Auflösung DVI.....	50
Auflösung SDL.....	49, 139
Auswertung Temperaturen.....	154
Automation Runtime.....	258
Automation Runtime Embedded.....	258
Automation Runtime Windows.....	258

B

B&R Automation Device Interface.....	259
--------------------------------------	-----

B&R CompactFlash.....	300
B&R Control Center.....	259
B&R Embedded OS Installer.....	246
B&R Key Editor.....	273
Batteriepolart��t verkehrt.....	263
Batteriestatusermittlung.....	60, 360
Batteriewechsel.....	360
Bauteildefekt.....	286
Beep Codes.....	231
Befestigungslasche.....	149
Beispielprogramme.....	157
Bema��ungsnorm.....	18
Betriebssystem	
Windows 7.....	250
Windows Embedded Standard 2009.....	253
Windows Embedded Standard 7.....	255
Windows XP Professional.....	248
Biegeradius.....	152
BIOS Defaulteinstellungen.....	225
BIOS Fehlersignale.....	231
BIOS GM45	
ACPI Configuration.....	194
Advanced.....	193
Baseboard Monitor.....	217
Boot.....	219
Chipset Configuration.....	204
Clock Configuration.....	206
CPU Board Monitor.....	214
CPU Configuration.....	202
Exit.....	224
Graphics Configuration.....	200
Hard Disk Security Master Password.....	222
Hard Disk Security User Password.....	222
I/O Interface Configuration.....	205
IDE Configuration.....	206
Keyboard/Mouse Configuration.....	213
Legacy Devices.....	218
Main.....	192
Panel Control.....	216
PCI Configuration.....	195
PCI Express Configuration.....	198
Power.....	223
Security.....	221
USB Configuration.....	212
BIOS Setup Tasten.....	191
BIOS Upgrade.....	237
Blockschaltbilder.....	39
Blockschaltbild Spannungsversorgung.....	30
Burst.....	279

C

Card Slot Steckplatz.....	56
CF1.....	62
CF2.....	62
CMOS Profile Schalter.....	58
COM1.....	48, 48
COM2.....	48, 48
CompactFlash	
Benchmark.....	303
CompactFlash Karten.....	294
CompactFlash Slot.....	62, 62

CompactFlash Tausch.....	362
Control Center.....	154, 259
CPU Boards GM45.....	99

D

Dongle.....	61
Dual-Channel Memory.....	102
DVI.....	49
DVI Kabel.....	338
Dynamic Wear Leveling.....	294

E

Einbaulagen.....	150
Einsteckkarte.....	332
Elektrostatische Entladung.....	278
Embedded OS Installer.....	246
EMV-Richtlinie.....	275
Entsorgung.....	17, 17
Erdung.....	47, 153
Erdungsanschluss.....	153
Erdungswiderstand.....	285
ESD.....	15, 278
Einzelbauteile.....	15
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse.....	15
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse.....	15
gerechte Handhabung.....	15
Verpackung.....	15
ETH1.....	51
ETH2.....	52
Ethernet.....	51, 52
Europäische Richtlinien.....	275
Externer Verbraucher.....	391

F

Feuchte Wärme.....	284
Firmwareupgrade.....	240
Freiraum.....	151
Funktionserde.....	153

G

Geräteschnittstellen.....	47
Gesamtgerät.....	26
GM45.....	99

H

Handbuchhistorie.....	13
Hardware Security Key.....	61
Hauptspeicher.....	102
HF Feld.....	278
HMI Drivers & Utilities DVD.....	323
Hochspannung.....	285

I

I/O-Adressbelegung.....	232
Implementierungsanleitung.....	157

Internationale Zulassungen.....	288
Interrupt- Zuweisung.....	233
Isolationswiderstand.....	285

K

Kabel.....	338
DVI Kabel.....	338
SDL Kabel.....	341
SDL Kabel flex.....	347
SDL Kabel flex mit Extender.....	350
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	344
USB Kabel.....	354
Key Editor.....	273
Kippfallen.....	282
Klimabedingungen.....	283
Klimakammer.....	157
Konfiguration	
Grundsystem.....	24
optionale Komponenten.....	25

L

LED.....	58
Leitungsgeführte Störgrößen.....	279
Loopback Adapter.....	156
Low Battery.....	266, 268
Lüfter Kit.....	134
Lüfter Kit Einbau / Tausch.....	367
Lüfterregelung.....	389
Luftfeuchtigkeitsangaben.....	29
Luftzirkulation.....	151, 151

M

Maintenance Controller Extended.....	389
MIC, Line IN, Line OUT.....	54
Monitor / Panel Anschluss.....	49
Montage.....	149
Montage der HDD Ersatzdiskablage.....	386
Montage des Ready Relais /2.....	387
Montage des USV Moduls.....	369
MS-DOS.....	247
MTCX.....	389

P

Parity Error.....	231
PCI.....	332
PCI / PCIe.....	56
Powerfail.....	268
Power Taster.....	59

R

RAM-Adressbelegung.....	232
Relative Luftfeuchtigkeit.....	29
Reporterstellung.....	259
Reset Taster.....	59
Ressourcenaufteilung	
I/O-Adressbelegung.....	232

Restspannung.....	285
Richtlinien.....	18
RS232 Kabel.....	355

S

Schnittstellen.....	47
SDL.....	49
SDL Kabel.....	341
SDL Kabel flex.....	347
SDL Kabel flex mit Extender.....	350
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	344
Security Key.....	61
Seitendeckeldemontage.....	381
Sensor.....	28
Serialnummernaufkleber.....	37, 37
Serielle Schnittstelle.....	48, 48
Sicherheit.....	285
Sicherheitshinweise.....	15
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	15
Betrieb.....	16
Montage.....	16
Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	15
Transport und Lagerung.....	16
Umgebungsbedingungen.....	16
Umweltgerechte Entsorgung.....	17
Vorschriften und Maßnahmen.....	15
Werkstofftrennung.....	17
Slide-in compact Adapter Montage.....	365
Slide-in compact Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	363
Slide-in Slot.....	63, 63
Slide-in Slot Laufwerkseinbau bzw. -tausch.....	364
Smart Display Link.....	49
Softwareversionen.....	259
Spannungsversorgung.....	47
Spannungsversorgungsstecker.....	291
Spannungsversorgung.....	153
Static Wear Leveling.....	294
Status LEDs.....	58
Störfestigkeit.....	153
Störungsableitung.....	153
Surge.....	279

T

Tauschen einer PCI SATA RAID Hard Disk.....	384
Temperaturangaben.....	26
Temperaturauswertung.....	155
Temperaturschwankungen.....	283
Temperatursensorpositionen.....	28
Temperaturtest.....	154
Temperaturüberwachung.....	389
Temperaturüberwachung Lüfterregelung.....	389
Trockene Kälte.....	283
Trockene Wärme.....	283

U

Überlast.....	286
Umgebungstemperatur	
maximal mit Lüfter Kit.....	27
minimal.....	28

Unterbrechungsfreie Stromversorgung.....	326
Upgrade	
BIOS.....	237
Firmware.....	240
Upgradeinformationen.....	237
Upgradeprobleme.....	246
USB Kabel.....	354
USB Media Drive.....	308
USB Memory Stick.....	319
USB Peripheriegeräte.....	181
USB Schnittstellen.....	53
User Serial ID.....	260
USV.....	326
Abschaltzeit der USV.....	267
Ändern der Abschaltzeit.....	266
Batterieeinstellungen aktualisieren.....	264
Batterieeinstellungen bearbeiten.....	263
Batterieeinstellungen sichern.....	265
Installation des USV Dienstes.....	262
Low Battery Shutdown.....	268
Over Current Shutdown.....	268
Powerfail.....	268
Standard Shutdown.....	268
Statuswerte der USV anzeigen.....	263
Systemeinstellungen der USV.....	265
USV Parametrierung.....	262
USV Parametrierung.....	262

V

Vorgehensweise Temperaturtest.....	154
------------------------------------	-----

W

WES2009.....	253
WES7.....	256
Windows 7.....	250
Windows Embedded Standard 2009.....	253
Windows Embedded Standard 7.....	255
Windows XP Professional.....	248
Worst Case Betrieb.....	283

Z

Zubehör.....	289
--------------	-----